

# 上海伟测半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书附录

（一）发行保荐书	第 1-34页
（二）财务报表及审计报告	第35-156页
（三）审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告	第157-188页
（四）内部控制鉴证报告	第189-202页
（五）经注册会计师核验的非经常性损益明细表	第203-216页
（六）法律意见书	第217-456页
（七）律师工作报告	第457-601页
（八）公司章程（草案）	第602-644页
（九）中国证监会同意发行人本次公开发行注册的文件	第645-646页

**方正证券承销保荐有限责任公司**

**关于**

**上海伟测半导体科技股份有限公司**

**首次公开发行股票并在科创板上市**

**之**

**发行保荐书**

 **方正证券承销保荐有限责任公司**  
**FOUNDER FINANCING SERVICES CO.,LTD**

二〇二二年七月

# 目 录

第一节 本次证券发行基本情况 .....	4
一、保荐机构及工作人员简介 .....	4
二、发行人基本情况简介 .....	5
三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明 .....	5
四、保荐机构内部审核程序和内核意见 .....	6
第二节 保荐机构承诺 .....	8
第三节 本次证券发行的推荐意见 .....	9
一、发行人就本次证券发行依法履行的决策程序 .....	9
三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 .....	9
四、本次发行符合《科创板注册管理办法》规定的发行条件 .....	10
五、关于私募投资基金股东履行备案程序的核查意见 .....	11
六、发行人及其控股股东等责任主体承诺事项的核查意见 .....	12
七、关于聘请第三方机构和个人等相关行为的说明 .....	13
八、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》的核查意见 .....	13
九、发行人主要风险提示 .....	14
十、发行人的发展前景 .....	22
十一、保荐机构的保荐意见 .....	30

**方正证券承销保荐有限责任公司**  
**关于上海伟测半导体科技股份有限公司**  
**首次公开发行股票并在科创板上市之**  
**发行保荐书**

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“伟测科技”、“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”、“保荐机构”或“本保荐机构”）作为本次首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《科创板注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，方正承销保荐及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性和及时性。

（如无特别说明，本发行保荐书中相关用语或释义与《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》相同）

## 第一节 本次证券发行基本情况

### 一、保荐机构及工作人员简介

#### (一) 保荐机构名称

方正证券承销保荐有限责任公司

#### (二) 保荐机构保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况

方正承销保荐指定吉丽娜、牟军为上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人；指定侯丽萍为项目协办人，指定代礼正、赵文婧、张梦然、李皎莹、杨凌霄、王宣植、廖訢轩为其他项目组成员。

##### 1、项目保荐代表人保荐业务主要执业情况

吉丽娜女士，保荐代表人、注册会计师，管理学硕士，曾就职于平安证券、九州证券及安永华明会计师事务所，具有6年以上投行业务经验及3年审计业务经验，曾参与广信材料、中马传动、鸿辉光通等IPO项目以及西部材料非公开发行项目和斯迪克非公开发行项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

牟军先生，保荐代表人，硕士学历，曾就职于平安证券、华林证券、华泰联合、九州证券投行部，10年以上投行业务经验，曾参与苏州华电、雅鹿控股、艾普网络、网讯新材、鸿辉光通等IPO项目，西部材料非公开发行项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

##### 2、项目协办人保荐业务主要执业情况

侯丽萍女士，注册会计师，管理学硕士，曾就职于平安证券及普华永道会计师事务所，具有5年以上投行业务及审计业务经验，参与了伟测科技IPO项目；曾参与中国太平洋保险、众安保险等上市公司上市审计及年度审计服务工作；曾参与镁信健康项目财务咨询工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

##### 3、其他项目组成员

方正承销保荐指定代礼正、赵文婧、张梦然、李皎莹、杨凌霄、王宣植、廖訢轩作为本次发行的其他项目组成员。

## 二、发行人基本情况简介

公司名称	上海伟测半导体科技股份有限公司
英文名称	Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd.
法定代表人	骈文胜
有限公司成立日期	2016年5月6日
股份公司成立日期	2020年9月4日
注册资本	人民币6,540.80万元
住所	上海市浦东新区东胜路38号A区2栋2F
邮政编码	201201
电话	021-58958216
互联网网址	www.v-test.com.cn
电子信箱	ir@v-test.com.cn
业务范围	一般项目：半导体芯片的研发、测试、销售，电子器件制造（除显示器件、集成电路，有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的），电子产品、计算机软硬件的开发及销售，仪器仪表、机电设备的销售，自有设备租赁，从事半导体芯片测试领域内的技术服务、技术咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
本次证券发行类型	首次公开发行股票并在科创板上市

## 三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明

### （一）本次发行前，保荐机构与发行人之间的关联关系

保荐机构方正承销保荐的母公司为方正证券，方正证券的控股股东为方正集团，方正集团目前正在执行重整计划，执行完毕后，中国平安拟间接控制方正证券并间接控制保荐机构。截至本发行保荐书签署日，方正集团的重整计划尚未执行完毕，且需履行中国证券监督管理委员会等相关监管机构的审批程序。

通过股东穿透核查，中国平安间接持有发行人1.52%的股份，方正集团间接持有发行人0.026%的股份。根据《公司法》《企业会计准则第36号-关联人披露》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本保荐机构与发行人不存在关联关系，本保荐机构的合规部已对本次保荐行为进行了利益冲突审查，并出具了不存在利益冲突情形的合规审查意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定。

除上述情形外，保荐机构与发行人之间不存在如下情形：

1、截至本发行保荐书出具日，发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方不持有方正承销保荐或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份；

2、截至本发行保荐书出具日，本保荐机构的保荐代表人及其配偶，方正承销保荐的董事、监事、高级管理人员不拥有发行人权益，也不存在在发行人任职的情况；

3、截至本发行保荐书出具日，本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在相互提供担保或者融资的情况；

4、截至本发行保荐书出具日，本保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

## **（二）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方通过参与本次发行战略配售持有发行人股份情况**

保荐机构母公司方正证券将安排其子公司方正投资参与本次发行战略配售，具体按照上海证券交易所的相关规定执行，保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上海证券交易所提交相关文件。

## **四、保荐机构内部审核程序和内核意见**

### **（一）方正承销保荐内部审核程序**

为保证项目质量，保荐机构实行项目流程管理，在项目立项、内核等环节进行严格把关，控制项目风险。保荐机构制订了《投资银行股权融资业务内核工作规则》《投资银行股权融资项目立项工作规则》《投资银行股权融资业务尽职调查规则》等内部制度对内部审核程序予以具体规范。

本保荐机构项目内部审核流程的主要环节如下：

内部审核主要环节	决策机构	执行部门
立项	立项审核小组	质量控制部
内核	内核委员会	风险管理部内核组

项目申请文件由保荐代表人发表明确推荐意见后，由质量控制部门对项目

进行了现场检查并对全套发行申请文件进行初审，并将初审意见反馈给项目组，项目组根据初审反馈意见组织发行人及相关中介机构对申请文件进行修改、补充和完善后，质量控制部将内核申请材料等文件提交风险管理部内核组，由其组织相关人员履行问核程序，完成后风险管理部内核组发布内核会议通知，将会议相关情况和内核申请相关材料送达内核委员会审核；在内核委员对发行股票申请文件进行认真、细致的审核后，召开内核会议，对有关问题进行认真讨论，并出具内核意见。

依照《方正承销保荐投资银行股权融资业务内核工作规则》，本保荐机构于2022年7月12日召开了内核会议，出席会议的委员7人。内核委员会认真审核了由方正承销保荐作为保荐机构的上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件，并从专业的角度对申请材料中较为重要的问题进行了充分讨论，经内核委员投票表决通过，形成内核意见。

## **（二）内核意见**

方正承销保荐本次内核会议审议认为：上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市符合相关法律法规的要求，同意保荐发行人首次公开发行股票并在科创板上市。



## 第二节 保荐机构承诺

本保荐机构承诺，已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。

本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，承诺如下：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、上交所有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会、上交所采取的监管措施；

（九）中国证监会、上交所规定的其他事项。

## 第三节 本次证券发行的推荐意见

### 一、发行人就本次证券发行依法履行的决策程序

发行人就本次证券发行履行的内部决策程序如下：

（一）2021年9月20日，发行人召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》等议案。

（二）2021年10月8日，发行人召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》等议案。

（三）2022年6月27日，发行人召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司首次公开发行股票并在科创板上市保荐机构的议案》。

依据《公司法》、《证券法》及《科创板注册管理办法》等法律法规及发行人《公司章程》的规定，发行人申请在境内首次公开发行股票并在科创板上市已履行了完备的内部决策程序。

经核查，本保荐机构认为发行人已就本次股票发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策程序。

### 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明

本保荐机构对本次证券发行是否符合《证券法》规定的发行条件进行了尽职调查和审慎核查，核查结论如下：

- （一）伟测科技具备健全且运行良好的组织机构；
- （二）伟测科技具有持续经营能力；
- （三）伟测科技最近三年财务会计报告被出具标准无保留意见审计报告；
- （四）伟测科技及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；
- （五）伟测科技符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他

条件。

#### **四、本次发行符合《科创板注册管理办法》规定的发行条件**

##### **（一）符合《科创板注册管理办法》第十条的规定**

经本保荐机构查证确认，发行人前身为上海伟测半导体科技有限公司，以截至2020年4月30日经审计的净资产折合为5,000万股，各发起人按原出资比例持有股份公司股份。

发行人依法设立且持续经营3年以上，不存在根据法律、法规以及发行人章程需要终止的情形，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《科创板注册管理办法》第十条的规定。

##### **（二）符合《科创板注册管理办法》第十一条的规定**

经本保荐机构查证确认，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量；审计机构已出具了标准无保留意见的审计报告。

经本保荐机构查证确认，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性；审计机构已出具了无保留结论的内部控制鉴证报告。

发行人符合《科创板注册管理办法》第十一条的规定。

##### **（三）符合《科创板注册管理办法》第十二条的规定**

经本保荐机构查证确认，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与主要股东及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

经本保荐机构查证确认，最近2年内发行人主营业务、管理团队和核心技术人员稳定，没有发生重大不利变化；发行人控股股东和受控股股东支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近2年实际控制人没有发生变更，不存在导致控

制权可能变更的重大权属纠纷。

经本保荐机构查证确认，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，符合《科创板注册管理办法》第十二条的规定。

#### **（四）符合《科创板注册管理办法》第十三条的规定**

经本保荐机构查证确认，最近3年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《科创板注册管理办法》第十三条的规定。

综上，本保荐机构认为，发行人符合《公司法》、《证券法》、《科创板注册管理办法》规定的首次公开发行股票并在科创板上市的实质条件。

### **五、关于私募投资基金股东履行备案程序的核查意见**

保荐机构核查了发行人全体机构股东的营业执照、公司章程等资料，查阅了《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定，查询了全国企业信用信息公示系统、证券投资基金业协会网站公示系统等。

经核查，发行人股东中，江苏惠泉、深圳南海、苏民无锡、苏民投君信、南京金浦、远海明晟、德同合心、南山基金、广西泰达、云泽裕庆已经按照《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定于中国证券投资基金业协会完成备

案。

经核查，发行人股东中，下述股东不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》界定的私募投资基金，不需要履行上述备案程序，具体情况如下：

1、自然人股东涂洁、顾成标无需履行前述备案程序；

2、上海蕊测半导体科技有限公司为公司控股股东，是公司创始团队的持股平台，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，不需履行私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案程序。

3、上海芯伟半导体合伙企业（有限合伙）是公司的员工持股平台，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，不需履行私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案程序。

4、江苏新潮创新投资集团有限公司为市场化半导体产业投资平台，成立时间为2000年9月，持有多家公司股权，不存在以非公开方式向其他投资者募集资金的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》界定的私募投资基金，不需履行私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案程序。

5、无锡先锋智造投资合伙企业（有限合伙）是苏民无锡私募基金的内部员工的跟投平台，不存在以非公开方式向其他投资者募集资金的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》界定的私募投资基金，不需履行私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案程序。

## **六、发行人及其控股股东等责任主体承诺事项的核查意见**

保荐机构对发行人及其控股股东等责任主体承诺事项是否履行相应的决策程序、承诺的内容是否合法、合理、失信约束或补救措施的及时有效性等情况进行了核查，核查手段包括对相关主体进行访谈，获取相关主体出具的承诺函和声明文件等。

经核查，保荐机构认为，发行人及其实际控制人、控股股东、公司董事、监事及高级管理人员等责任主体已就股份锁定期限、锁定期满后的减持价格、避免同业竞争、减少和规范关联交易、稳定股价、填补被摊薄即期回报相关措施、公开发行及上市文件无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等事项做出了公开承诺，并提出了承诺约束措施。相关责任主体的承诺事项均履行了必要的决策程序，承诺内容及约束或补救措施合法、合理、及时、有效。

## **七、关于聘请第三方机构和个人等相关行为的说明**

根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）等规定，本保荐机构就在投资银行类业务中有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称“第三方”）等相关行为进行核查。

### **（一）本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查**

在本次发行保荐业务中，本保荐机构不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。

### **（二）发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查**

本保荐机构对发行人有偿聘请第三方等相关行为进行了核查。经核查，发行人在律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等该类项目依法需聘请的证券服务机构之外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。

## **八、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的核查意见**

经核查，发行人已结合自身经营情况，基于客观假设，对即期回报摊薄情况进行了合理预计。同时，考虑到本次公开发行时间的不可预测性和未来市场竞争环境变化的可能性，发行人已披露了本次公开发行的必要性和合理性、本次募集资金投资项目与发行人现有业务的关系、发行人从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况，制订了切实可行的填补即期回报措施，董事、高级管理人员做出了相应承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场

中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）中关于保护中小投资者合法权益的精神。

## **九、发行人主要风险提示**

### **（一）经营风险**

#### **1、集成电路行业的周期性波动风险**

公司主要业务是向集成电路行业中的芯片设计企业、封装企业、晶圆制造企业、IDM 企业提供测试服务，与集成电路行业的发展高度相关。全球集成电路行业在技术和市场两方面呈现周期性波动的特点。2011 年到 2012 年，全球集成电路行业平稳发展；2013 年到 2018 年，全球集成电路产业快速发展，销售额快速增长；2019 年，全球集成电路产业销售额出现负增长；2020 年，因新冠疫情的蔓延以及芯片需求的上升，“缺芯潮”持续演绎，行业发展回暖。2020 年至今，集成电路行业处于景气上升的周期，但不排除未来由于行业周期性波动而步入下行周期，从而对发行人的经营业绩产生不利影响。

#### **2、集成电路测试行业竞争加剧的风险**

集成电路测试业务的主要经营主体包括独立第三方测试企业和封测一体化企业两大类。公司是最近几年新崛起的独立第三方测试企业，虽然发展速度较快，但是与封测一体化企业和3家台资独立第三方测试巨头相比，在收入规模、专业技术、获客渠道等方面尚存在较大的差距。在收入规模方面，以日月光、安靠科技、长电科技、通富微电和华天科技为代表的封测一体化企业和京元电子、矽格、欣铨3家全球最大的独立第三方测试巨头的测试服务收入规模是公司的数倍至十多倍不等。在专业技术方面，以日月光为代表的台资封测一体化企业和3家全球最大的独立第三方测试巨头均具有较为深厚的技术积累和技术优势。在获客渠道方面，封测一体化企业利用“封装加测试的一站式服务”的协同获客模式，在芯片成品测试方面具有较强的获客渠道优势，而3家全球最大的独立第三方测试巨头长期面向全球范围的客户提供测试服务，在获取国际知名客户方面具有十分明显的渠道优势。随着集成电路产业景气度的上升，集成电路测试需求也不断扩大，从而吸引了独立第三方测试企业和封测一体化企业等各类测

试服务商继续扩大产能、增加投入，市场竞争变得日趋激烈。若公司未来无法在上述几个方面不断缩小与封测一体化企业和独立第三方测试头部企业之间的差距，将有可能在竞争中处于不利地位。

### **3、进口设备依赖的风险**

报告期内，公司产能持续扩张，固定资产投资规模持续增长。公司现有机器设备以进口设备为主，主要供应商包括 Advantest（爱德万）、Teradyne（泰瑞达）、Semics 等国际知名测试设备厂商。公司进口设备主要是测试机、探针台、分选机及相关配件，是公司测试业务的关键设备。截至目前，公司现有进口设备及募集资金投资项目所需进口设备未受到管制。若未来国际贸易摩擦特别是中美贸易冲突加剧，美国进一步加大对半导体生产设备的出口管制力度和范围，从而使本公司所需的测试设备出现进口受限的情形，将对本公司生产经营产生不利影响。

### **4、客户集中度较高的风险**

2019 年至 2021 年末，公司前五大客户的营业收入占公司营业收入的比例分别为 42.47%、37.76%和 45.22%，报告期末客户集中度较高。若未来公司与下游主要客户合作出现不利变化，或原有客户因市场竞争加剧、宏观经济波动以及自身产品等原因导致市场份额下降，且公司未能及时拓展新客户，则公司将会存在收入增速放缓甚至下降的风险。

### **5、公司发展需要投入大量资金的风险**

集成电路测试行业属于资本密集型行业，产能规模是集成电路测试厂商的核心竞争力的体现，为了维持公司的竞争力，公司需持续扩大测试规模，保证充足的测试产能。因此，公司需不断添置测试机、分选机和探针台等测试设备。截至 2021 年 12 月 31 日，公司固定资产及使用权资产中专用设备的净值为 92,593.41 万元，占公司总资产的比重为 59.00%。若公司未来融资渠道、融资规模受限，导致发展资金短缺，可能对公司的持续发展和市场地位造成不利影响。



## **6、经营场所房屋租赁风险**

截至 2021 年末，公司仅在无锡拥有一处房产，其他经营场所均为租赁房产，且租赁房屋存在未办理租赁备案的情形。截至本发行保荐书签署日，公司与出租方租赁关系稳定，公司未发生过因租赁房产而对公司经营造成不利影响的情形，但未来仍存在租赁的经营场所因到期或整体无法继续租赁或者租金大幅度上涨，从而对公司的日常经营造成不利影响的风险。

## **7、劳务外包用工风险**

报告期内，为了应对业务规模大幅扩张，提高产能调整与生产组织的灵活性，公司将部分辅助性的工作与岗位采用劳务外包的方式进行，劳务外包人数占比较大。由于外包服务人员非公司员工，公司仅对其实施间接管理，有可能出现外包工作质量、安全操作等问题。同时，虽然报告期内公司与劳务外包公司形成了较为稳定的合作关系，但是存在双方因合作产生分歧而提前终止合同的可能性。此外，公司业务规模和用工规模的变动，也会影响到劳务外包用工量的稳定性。上述因素均将对公司未来的生产经营带来不利影响。

## **8、客户测试物保管不善的风险**

公司在为客户提供测试服务过程中，需代客户保管被测试的晶圆和芯片，公司承担保管风险。虽然公司已建立完善的测试物管理体系，并针对部分客户的测试物购买了财产保险以降低风险，但由于晶圆和芯片较为脆弱，且对存放环境的温度、湿度等有特定要求，若公司在保管期间因管理不善或其他原因导致测试物毁损、灭失的，公司将承担赔偿责任，从而对公司经营业绩产生不利影响。

## **9、新冠疫情对于公司生产经营的影响**

2020年初以来，全球多个国家和地区相继爆发新冠疫情，公司及客户、供应商的生产经营均受到了不同程度的影响。2022年3月以来，公司总部所在地的上海市爆发了新一轮的新冠疫情，公司通过闭环生产，保障了生产的连续性，本轮疫情未对公司的生产经营造成重大不利影响。但是，如果疫情反复爆发或者防疫措施再次升级，可能会对公司未来经营情况和盈利水平产生不利影响。

## **(二) 财务风险**

### **1、公司经营业绩无法保持持续快速增长的风险**

2019年至2021年，公司营业收入从7,793.32万元增至49,314.43万元，年均复合增长率超过100%，实现了持续快速增长；公司扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润分别为1,053.86万元、3,260.15万元和12,759.72万元，亦保持了持续快速增长。公司收入及净利润的持续增长主要受益于集成电路行业处于景气周期、集成电路测试行业的国产化进程加速以及公司自身竞争力的提升。如果未来集成电路产业景气度下降，行业竞争加剧，以及公司无法在技术实力、产能规模、服务品质等方面保持竞争优势，或者公司未能妥善处理快速发展过程中的经营问题，公司将面临经营业绩无法保持持续快速增长的风险。

### **2、主营业务毛利率下降的风险**

报告期内，公司主营业务毛利率分别为52.24%、51.75%和51.17%，维持在较高的水平。公司产品毛利率同产能利用率、测试设备折旧、人力成本、主要原材料价格波动、市场供需关系等经营层面变化直接相关。同时，由于公司测试平台及配置种类较多，不同平台和配置的单价及成本差异较大，因此平台和配置的结构变化也会对公司主营业务毛利产生较大影响。若未来上述因素发生不利变化比如产能利用率下降、设备折旧增加、人力成本上升或市场需求萎缩导致服务价格下降、成本上升，则公司主营业务毛利率可能出现下降的风险。

### **3、公司固定资产折旧较大，且生产设备折旧年限显著长于可比公司，对经营业绩影响较大的风险**

截至2021年12月31日，公司固定资产（含使用权资产）的原值为112,872.25万元。报告期各年度，固定资产（含使用权资产）的折旧金额分别为1,506.67万元、3,168.36万元和8,573.66万元，占同期息税折旧摊销前利润的比例分别为44.09%、40.15%和32.85%，固定资产（含使用权资产）折旧对利润的影响较大。公司的固定资产（含使用权资产）主要为生产设备，其折旧年限为5-10年，而同行业可比公司京元电子机器设备折旧年限为2-8年，华岭股

份为 3-5 年，公司生产设备的折旧年限显著长于两家可比公司，主要系公司根据生产设备的使用寿命和未来预计可产生经济利益的年限并结合生产使用过程中的实际情况而综合确定的。若公司参照可比公司京元电子和华岭股份平均折旧年限（即所有专用设备的折旧年限为 5 年）计提折旧，报告期内，将会减少公司净利润的金额分别为 1,019.14 万元、2,398.54 万元和 5,522.05 万元，占各期净利润比重分别为 90.37%、68.83%和 41.78%，将对公司盈利水平产生较大的不利影响。

#### **4、在建工程投资规模较大的风险**

集成电路测试行业是资本密集型行业，设备投入规模较大是行业的典型特征。报告期内，为了支持主营业务的快速发展，公司的在建工程投资规模也随之逐年增加。报告期各年度，公司在建工程分别新增 13,529.21 万元、38,507.44 万元和 55,813.18 万元，在建工程各期末余额分别为 4,254.69 万元、9,581.01 万元及 10,962.96 万元。公司在建工程投资规模较大，一方面产生了较大资金需求，如果公司未能做好投融资方面的规划，可能会给公司带来财务风险；另一方面，未来如果市场需求出现重大变化，可能导致公司的在建工程无法按时投入使用或者转成固定资产后的产能利用率较低，从而发生资产减值的风险，对公司经营业绩造成不利影响。

#### **5、净资产收益率和每股收益下降的风险**

2019 年至 2021 年，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为 9.26%、11.71%和 17.41%，2020 年至 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的基本每股收益为 0.63 元/股和 2.01 元/股。本次发行完成后，公司净资产及总股本将在短时间内大幅增长，募集资金投资项目有一定的建设周期，项目产生效益尚需一段时间。因此，公司存在短期内净资产收益率及每股收益下降的风险。

#### **6、税收优惠政策变化及所得税税率上升的风险**

公司的主要经营主体为母公司上海伟测及子公司无锡伟测。母公司上海伟测为高新技术企业，享受国家高新技术企业 15%所得税税率，同时自 2017 年至

2021 年度享受集成电路企业所得税两免三减半优惠。从 2022 年起，上海伟测的集成电路企业所得税两免三减半优惠到期，所得税税率将由 12.5%上升至 15%，存在所得税税率上升从而减少公司净利润的风险。此外，子公司无锡伟测系 2020 年底设立，目前正在计划申请高新技术企业资质以及正在实施相关工作以满足集成电路企业所得税两免三减半优惠政策。若未来国家税收优惠政策收紧，或者母公司上海伟测未能持续满足高新技术企业资质，以及子公司无锡伟测未能成功申请高新技术企业资质和未能满足集成电路企业所得税两免三减半优惠政策，将对公司净利润造成一定不利影响。

## **7、负债金额增加较快的风险**

报告期内，随着公司业务的扩张，公司不断加大固定资产的投入，导致公司负债金额快速增长，公司各年末的负债金额为13,722.18万元、28,912.75万元和67,039.69万元，增长率为110.70%和131.87%，增长较快。报告期内公司资产负债率为40.71%、33.77%和42.72%，整体呈上升趋势。若公司未能适度地控制负债经营的规模、未能合理地调整资产与负债匹配程度，则可能发生偿债能力降低的风险。

### **（三）技术风险**

#### **1、技术更新不及时与研发失败风险**

随着信息技术的发展，集成电路产品更新换代的速度越来越快，高性能、多功能的复杂 SoC 以及各类先进封装形式的芯片渐成主流，公司研发的测试方案要不断满足高端芯片对测试的有效性、可靠性、稳定性以及经济性的需求，研发难度大大增加。此外，客户的测试需求也在不断变化，各类定制化要求层出不穷，公司要随之更新测试技术以适应市场的变化。如果公司未能在技术研发上持续投入，未能吸引和培养更加优秀的技术人才，可能存在研发的测试方案或开发的测试技术不能达到新型芯片产品的测试指标，导致研发失败的风险，进而对公司的经营造成不利影响。

#### **2、核心技术泄密风险**

经过多年的技术创新和研发积累，公司的测试方案开发能力与测试技术水

平跻身国内先进行列。与此同时，公司十分重视对核心技术的保护工作，制定了包括信息安全保护制度在内的一系列严格完善的保密制度，并和核心技术人员签署了保密协议，对其离职后做出了严格的竞业限制规定，以确保核心技术的保密性。但由于技术秘密保护措施的限制性、技术人员的流动性及其他不可控因素，公司仍存在核心技术泄密的风险。如上述情况发生，可能在一定程度上削弱公司的技术优势并产生不利影响。

### **3、研发与技术人才短缺或流失的风险**

集成电路测试行业属于技术密集型产业，测试方案开发、测试量产都依赖于理论知识和工程经验丰富的技术人员。目前，与广阔的市场空间相比，专业测试研发技术人员严重匮乏。此外，同行业竞争对手可能通过更优厚的待遇吸引公司技术人才，同时，公司可能会受其他因素影响导致技术人才流失。上述情况将对公司测试方案的研发以及测试技术能力的储备造成影响，进而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

## **（四）法律风险**

### **1、对赌协议风险**

公司控股股东蕊测半导体和核心高管骈文胜、闻国涛、路峰与苏民无锡、无锡先锋、江苏走泉、深圳南海、江苏新潮、南京金浦等投资者签署的相关投资协议中存在股权回购等对赌条款。虽然各方已经签署书面协议约定对赌条款自公司向中国证监会或证券交易所递交正式 IPO 申报材料之日即刻终止，但如果公司未能成功上市，则公司投资者将要求自动恢复上述对赌条款。对赌条款效力恢复后，可能会对公司股权结构和日常经营的稳定性产生不利影响。

### **2、知识产权保护与侵权的风险**

公司作为集成电路测试行业的代表性企业，在发展过程中形成了一系列的专利技术、商标与软件著作权。截至 2022 年 6 月末，公司共获授权 12 项发明专利、38 项实用新型专利、13 项软件著作权以及 3 项集成电路布图设计登记证书。若其他企业侵犯公司知识产权，或公司在生产经营过程中对其他企业知识产权造成侵害，发生专利、商标、软著等知识产权纠纷，公司可能需要通过法

律诉讼等方式维护自身权益，由此可能需承担较大的法律和经济成本，而诉讼结果也存在一定的不确定性，将对公司的生产经营造成不利影响。

## **（五）内控风险**

### **1、公司规模扩张带来的内控管理风险**

公司近年营业收入整体增长较快，报告期各期，公司的营业收入分别为 7,793.32 万元、16,119.62 万元和 49,314.43 万元。未来，随着发行人上市募集资金投资项目的实施与落地，公司的业务规模进一步扩大，将对公司的经营管理水平和内部控制有效性提出更高的要求。如果公司整体的治理水平不能随着公司业务规模的扩张而持续提升，内部控制制度不能持续完善和有效执行，将对公司的生产经营产生不利影响。

### **2、实际控制人风险**

本次发行前，骈文胜先生通过蕊测半导体控制本公司 41.33% 股权，为公司实际控制人。本次发行完成后，预计骈文胜先生通过蕊测半导体控制公司股权比例为 31.00%，仍对公司重大经营决策有实质性影响。若实际控制人利用其控股地位，对公司经营决策、利润分配等重大事项进行干预，将可能损害公司其他股东的利益。

## **（六）募集资金投资项目风险**

### **1、募集资金投资项目管理和组织实施风险**

公司募集资金投资规模较大，对公司管理大额资金和资金规划运作能力提出了较高要求，多个募投项目同时实施也要求公司必须具备相应的组织能力和管理水平。募投项目实施后，公司的资产规模、业务规模及人员规模将进一步扩大，研发、运营和管理团队将相应增加，公司在人事、研发、采购、生产、销售等方面的管理能力需要不断提高。公司募集资金投资项目涉及装修等工程内容，亦对公司管理能力及项目实施能力提出挑战。如公司管理水平未随经营规模的扩大及时提升，将会对募集资金投资项目的按期实施及正常运转造成不利影响，进而会对公司经营发展带来不利影响。

## **2、关于募投项目新增产能无法消化的风险**

公司本次募投项目新增产能系基于国内半导体产业发展态势、集成电路测试需求情况、公司产销情况、现有客户及业务布局情况、公司整体发展战略等因素综合确定。本次募投项目达产后，公司的产能将大幅提升。虽然公司已对募投项目的必要性和可行性进行了充分、严谨的论证，但新增产能的消化需要依托于客户的需求情况、公司测试服务的品质与销售拓展能力等，具有一定不确定性。如果未来市场需求、相关政策、竞争对手策略、公司市场开拓等方面出现重大不利变化，则公司可能面临本次募投项目新增产能无法消化的风险。

## **3、募集资金投资项目新增折旧及摊销导致业绩下滑的风险**

本次募集资金投资项目实施后，将陆续新增固定资产投资，导致相应的折旧和摊销大幅增加，募投项目未来完全投产后预计每年折旧及摊销金额增加约5,000万元。如果因市场环境等因素发生变化，公司经营业绩成长水平或募集资金投资项目投产后盈利水平整体不及预期，募投项目新增的折旧及摊销将对公司的经营业绩产生不利影响。

### **（七）发行失败风险**

公司股票拟在上海证券交易所科创板上市，除公司经营和财务状况之外，发行结果还将受到国内外宏观经济形势、资本市场走势和各类重大突发事件等多方面因素的影响，存在未能达到预计市值上市条件的风险，以及因投资者认购不足而导致的发行失败风险。

## **十、发行人的发展前景**

### **（一）集成电路产业处在政策机遇期**

作为关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，集成电路行业近年来得到了国家政策的大力鼓励和支持。从2000年出台的《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》开始，国家颁布了多项支持集成电路行业发展的产业政策及措施，例如《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、《集成电路产业“十二五”发展规划》及

《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等，这些优惠政策涉及投融资、税收和进出口等各个领域，为集成电路企业创造了有利的发展环境。2018年，中兴和华为禁令事件发生以后，我国掀起了集成电路产业发展的高潮，高规格的国家政策也及时跟进出台，助推行业攻坚克难。2020年8月4日，国务院发布《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》，多维度政策加大对本土集成电路产业的支持，构建新型举国体制推动集成电路产业高质量发展。

## **（二）中国大陆芯片设计业和晶圆制造业的快速发展带动测试需求扩大**

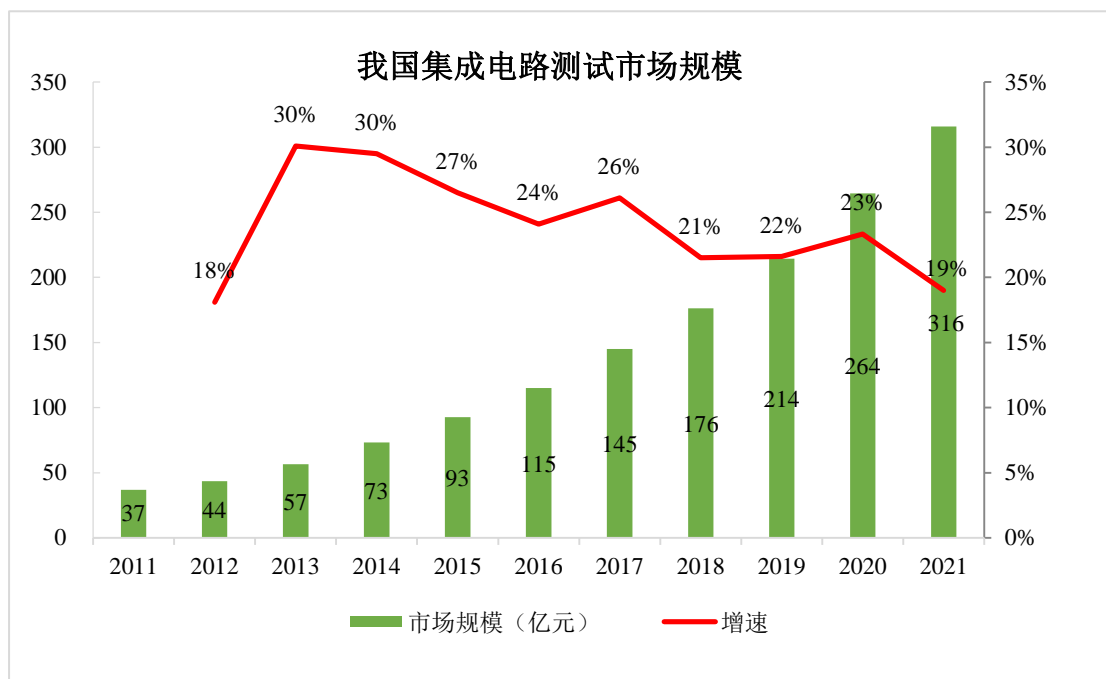
芯片设计公司是测试服务的最主要买方，2019年-2021年我国芯片设计行业的收入增速分别为21.60%、23.33%和19.60%，保持了较高的增速，芯片设计行业的快速发展带动了测试需求的快速增长。

在晶圆制造业方面，中兴与华为断供事件促使我国加快了集成电路制造业的国产化进程，国内晶圆建厂潮愈演愈烈，晶圆制造产线规模加速扩张。根据SEMI《300mm Fab Outlook to 2024》的数据，在2019-2024年间，全球将有38座新建12寸晶圆厂投入营运，其中中国大陆拥有其中的8座。中国大陆12寸晶圆的产能份额将由2015年的8%增长至2024年的20%，届时达到150万片/月。根据SEMI《World Fab Forecast》的数据，2020年全球将有18座晶圆厂开工建设，项目总投资达到500亿美元，其中中国新建晶圆厂达到11座，总投资达240亿美元。随着晶圆制造业市场规模的扩大，为之配套服务的晶圆测试业务也将迎来发展的热潮。

## **（三）集成电路测试产业市场空间巨大**

根据台湾地区工研院的统计，集成电路测试成本约占设计营收的6%-8%，假设取中值7%，结合中国半导体行业协会关于我国芯片设计业务的营收数据测算，2019年我国集成电路测试市场规模为214亿元，同比增长22%，2020年我国集成电路测试市场规模为264亿元，同比增长23%；2021年我国集成电路测试市场规模为316亿元，同比增长19%。按照上述方法测算，2011年-2021年我国集成电路测试市场规模和增速的情况如下：

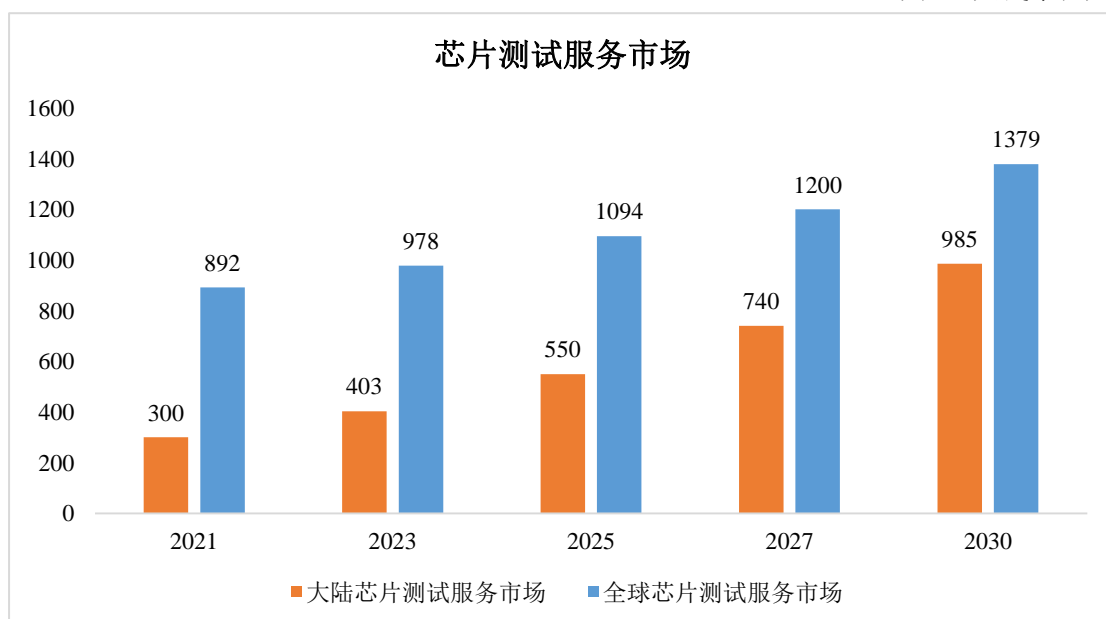




数据来源：根据中国半导体行业协会、台湾地区工研院的数据测算

另据 Gartner 咨询和法国里昂证券预测，2021 年中国大陆的测试服务市场规模为 300 亿元，全球的市场规模为 892 亿元。2025 年，预期全球测试服务市场将达到 1094 亿元，其中，中国测试服务市场将达到 550 亿元，占比 50.3%，5 年内存在超过 250 亿的巨量增长空间。

单位：人民币亿元



数据来源：Gartner、法国里昂证券

#### (四) 发行人核心技术突出、技术水平领先

## 1、核心技术简介

公司虽然成立时间较短，但创始团队与研发团队均在集成电路测试行业深耕多年，专注于测试技术开发和测试工艺的改进，目前已经形成了一系列核心技术，具体如下：

序号	核心技术名称	技术来源	对应专利或软件著作权	应用范围
<b>一、测试方案开发技术</b>				
1	5G通信射频前端晶圆测试解决方案	自主研发	一种集成电路精确测试小电阻的方法（专利号：202011160294.6）	5G射频前端芯片
2	基于ARM架构的高性能处理器的测试解决方案	自主研发	一种Wafer ID烧写防呆的系统（专利号：202011523844.6）	处理器芯片
3	高性能汽车电子芯片测试解决方案	自主研发	多晶硅工艺保险丝的熔断装置及方法（专利号：202110248636.8）	汽车电子芯片
4	高性能区块链算力芯片晶圆测试方案	自主研发	芯片内部温度检测仪电路设计布图（登记号：BS.215515048）	AI、区块链芯片
5	WiFi6无线网络通讯芯片测试解决方案	自主研发	一种电路板测试装置（专利号：201721231664.4）	无线网络芯片
6	基于TCG架构的先进网络安全芯片晶圆测试解决方案	自主研发	晶圆区域性问题的分析系统及方法（专利号：202110310750.9）	安全芯片
7	高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案	自主研发	一种防止集成电路针测扎偏的装置（专利号：201721787486.3）	数字通信芯片
8	第3代快闪存储器IP的晶圆测试方案	自主研发	电流值智能检测仪电路设计布图（登记号：BS.215515021）	存储器芯片
9	高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案	自主研发	一种抗干扰晶圆测试机外壳（专利号：201720068188.2）	数模转换芯片
10	32位微控制单元芯片晶圆测试解决方案	自主研发	一种子母式探针卡装配结构（202120864029.X）	微控制器芯片
11	高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案	自主研发	一种易于安装的晶圆测试装置（专利号：201720068329.0）	图像传感器芯片
12	现场可编程逻辑门阵列芯片测试解决方案	自主研发	智能电压值检测装置电路设计布图（登记号：BS.215515064）	可编程逻辑门阵列芯片
<b>二、测试工艺难点突破与精益测试提效技术</b>				
1	芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术	自主研发	多晶硅工艺保险丝的熔断装置及方法（专利号：202110248636.8）	晶圆测试芯片成品测试

序号	核心技术名称	技术来源	对应专利或软件著作权	应用范围
2	晶圆测试中烧写写入工艺防呆管控技术	自主研发	一种Wafer ID烧写防呆的系统（专利号：202011523844.6）	晶圆测试
3	测试机配置匹配提效技术	自主研发	一种测试机匹配检测系统及其方法（专利号：202011533224.0）； 一种集成电路检测设备（专利号：202121569857.7）	晶圆测试 芯片成品测试
4	晶圆测试过程中针痕精密管控工艺技术	自主研发	一种防止集成电路针测扎偏的装置（专利号：201721787486.3）	晶圆测试
5	低温测试工艺结霜控制技术	自主研发	一种防止测试载板结霜的装置（专利号：202120866185.X）； 料盘翘曲平整装置（专利号：202121715058.6）	晶圆测试 芯片成品测试
6	晶圆测试良率分析和优选管控技术	自主研发	晶圆区域性问题的分析系统及方法（专利号：202110310750.9）	晶圆测试
7	薄片晶圆测试技术	自主研发	-	晶圆测试
8	多平台联动提效技术	自主研发	一种多平台联动提效机构（专利号：202011489734.2）	晶圆测试
<b>三、设备改造升级技术</b>				
1	探针台自动清洁装置	自主研发	一种芯片测试机上的真空除尘结构（专利号：201721787488.2）	晶圆测试
2	测试机多方位使用兼容装置	自主研发	一种芯片测试机的翻转机构（专利号：201721787489.7）	晶圆测试 芯片成品测试
3	解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	自主研发	一种背银、背金晶圆测试稳压装置（专利号：201720068189.7）	晶圆测试
4	晶圆进出晶舟盒防呆自动监测装置	自主研发	-	晶圆测试
5	晶圆测试机抗干扰外壳装置	自主研发	一种抗干扰晶圆测试机外壳（专利号：201720068188.2）	晶圆测试
6	晶圆外观检测平台的改造装置	自主研发	一种真空吸附检测台的承载平台（专利号：201721231321.8）	晶圆测试
<b>四、测试治具设计技术</b>				
1	修调卡及线缆快速验证装置	自主研发	一种方便操作的便携式有线线缆检测机构（专利号：202120554510.9）	晶圆测试 芯片成品测试

序号	核心技术名称	技术来源	对应专利或软件著作权	应用范围
2	自动降温装置	自主研发	一种自动降温器（专利号：201721231457.9）；一种用于半导体自动分选机快速降温装置（专利号：202121422099.6）	晶圆测试
3	延长墨管使用寿命的装置	自主研发	一种自动油墨打点器（专利号：201721231624.X） 一种延长墨管使用寿命的装置（专利号：202120868460.1）	晶圆测试
4	可选择性导片装置	自主研发	-	晶圆测试
5	测试方案开发的系统验证板	自主研发	一种Chroma Q-type转接板开路断路检验装置（专利号：202120877907.1）	晶圆测试 芯片成品测试
6	晶圆测试中对位辅助调整装置	自主研发	一种可以提高打点产品效率的模具（专利号：201721231323.7）	晶圆测试
7	晶圆测试探针卡精密管控技术	自主研发	腐蚀粉在整形铂金探针的应用和铂金探针的整形方法（专利号：202110234659.3）； 一种探针卡拆卸防呆装置（专利号：202120870208.4）	晶圆测试
<b>五、自动化测试及数据分析技术</b>				
1	数据挖掘与多维度分析系统	自主研发	伟测自动测试报告系统（软著号：软著登字第2042850号）； 伟测TEL型号探针台的晶圆图转换软件（软著号：软著登字第8590308号）； 伟测TXT&Excel与晶圆&Bin坐标对比软件（软著号：软著登字第8672298号）； 伟测测试机STDF大文件压缩转换软件（软著号：软著登字第8672285号）； 伟测测试机XML/TXT文件探针台的MAP图转换软件（软著号：软著登字第9248208号）	数据分析系统
2	测试参数大数据多维度统计分析系统	自主研发	伟测自动测试报告系统（软著号：软著登字第2042850号）； 伟测TEL型号探针台的晶圆图转换软件（软著号：	数据分析系统

序号	核心技术名称	技术来源	对应专利或软件著作权	应用范围
			软著登字第8590308号)； 伟测TXT&Excel与晶圆 &Bin坐标对比软件（软著 号：软著登字第8672298 号）； 伟测测试机STDF大文件压 缩转换软件（软著号：软 著登字第8672285号）； 伟测测试机CSV文件到 TSK探针台的晶圆图转换 软件（软著号：软著登字 第9043690号）； 伟测测试机XML/TXT文件 探针台的 MAP图转换软件 （软著号：软著登字第 9248208号）；	
3	生产稼动率统计分析和管 控系统	自主研发	伟测自动测试报告系统 （软著号：软著登字第 2042850号）； 伟测TEL型号探针台的晶 圆图转换软件（软著号： 软著登字第8590308号）	数据分析系 统
4	Mapping分析系统	自主研发	伟测自动测试报告系统 （软著号：软著登字第 2042850号）； 伟测TEL型号探针台的晶 圆图转换软件（软著号： 软著登字第8590308号）； 伟测TXT&Excel与晶圆 &Bin坐标对比软件（软著 号：软著登字第8672298 号）； 伟测测试机STDF大文件压 缩转换软件（软著号：软 著登字第8672285号）； 伟测测试机CSV文件到 TSK探针台的晶圆图转换 软件（软著号：软著登字 第9043690号）； 伟测测试机XML/TXT文件 探针台的 MAP图转换软件 （软著号：软著登字第 9248208号）；	数据分析系 统
5	Test Time & Index Time 侦测与分析系统	自主研发	伟测自动测试报告系统 （软著号：软著登字第 2042850号）； 伟测TEL型号探针台的晶 圆图转换软件（软著号：	数据分析系 统

序号	核心技术名称	技术来源	对应专利或软件著作权	应用范围
			软著登字第8590308号)	

## 2、技术水平及特点

公司成立以来专注于测试工艺的改进和不同类型芯片测试方案的开发，公司主要核心技术来源于自主研发，相关技术在生产应用过程中不断升级和积累，并运用于公司的主要产品中。公司的技术先进性主要体现在测试方案开发能力强、测试技术水平领先和生产自动化程度高三个方面。

在测试方案开发方面，公司建立起了从软件开发到硬件设计的完整研发体系，拥有基于泰瑞达 UltraFlex、爱德万 V93000、泰瑞达 J750 和 Chroma 等中高端平台的复杂 SoC 测试解决方案开发能力，可开发的芯片类型包括 CPU、MCU、射频通讯芯片、图像传感器芯片、车规毫米波雷达芯片、嵌入式闪存存储芯片、FPGA、高精度电源管理芯片等，在行业内持续保持方案开发的领先优势。

在测试技术水平方面，公司测试技术水平主要体现在晶圆测试的尺寸覆盖度、温度范围、最高 Pin 数、最大同测数、最小 Pad 间距以及芯片成品测试的封装尺寸大小、测试频率等技术指标，公司在上述测试技术指标保持国内领先地位，接近国际一流厂商水平。

在生产自动化方面，公司自主开发的测试生产管理系统在晶圆测试预警与反馈、测试良率分析、远程测试控制、生产回溯与质量优化、无纸化作业等方面实现了全流程自动化，不仅提高了测试效率、降低了测试成本，而且大幅度减少了测试中的呆错现象，保证了测试服务的品质。

技术上的优势带动公司客户数量和业绩规模快速增长，报告期内，公司营业收入分别 7,793.32 万元、16,119.62 万元及 49,314.43 万元，年均复合增长率超过 100%，在成立后短短五年发展成为第三方集成电路测试行业中规模位居前列的内资企业之一。

### （五）发行人市场地位领先

公司是国内领先的独立第三方集成电路测试企业，先后被评为国家高新技

术企业、浦东新区企业研发机构、国家级“专精特新”小巨人企业。自 2016 年 5 月成立以来，公司经营业绩连续保持高速增长，成为第三方集成电路测试行业成长性最为突出的企业之一。截至本发行保荐书出具日，公司已经发展成为第三方集成电路测试行业中规模位居前列的内资企业之一。

公司积极把握集成电路测试产业的国产化替代的历史机遇，一方面加大研发投入，重点突破各类高端芯片的测试工艺难点，另一方面大力扩充高端测试的产能规模。截至本发行保荐书出具日，公司高端测试设备机台数量在中国大陆名列前茅，已经成为中国大陆高端芯片测试服务的主要供应商之一。

公司的技术实力、服务品质、产能规模获得了行业的高度认可，积累了广泛的客户资源，其中不乏紫光展锐、中兴微电子、晶晨半导体、中颖电子、比特大陆、卓胜微、兆易创新、普冉半导体、长电科技、中芯国际、北京君正、安路科技、复旦微电子等国内外知名厂商。

未来，公司将继续依托自身的技术优势、丰富的测试生产经验、产能优势、人才优势和区位优势，致力于成为国内领先、世界一流的集成电路测试服务及解决方案提供商。同时，公司不断提高自身服务水准与创新能力、提升在行业中的领先地位的同时，也进一步促进中国独立测试行业的发展，助力集成电路产业供应链本土化、国产化。

综上，本保荐机构认为发行人的发展前景良好。

## **十一、保荐机构的保荐意见**

综上所述，本保荐机构认为：伟测科技本次公开发行股票符合《公司法》、《证券法》、《科创板注册管理办法》、《保荐办法》和《上市规则》等有关首次公开发行股票的法律法规规定。伟测科技主营业务突出，在同行业具有较强的竞争力，发展潜力和前景良好，公司法人治理结构完善、运作规范，募集资金投向符合国家产业政策。本次公开发行股票有利于全面提升公司的核心竞争力，增强公司盈利能力。

因此，本保荐机构同意对上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市予以保荐。

附件：

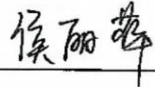
**1、《方正证券承销保荐有限责任公司保荐代表人专项授权书》**

（以下无正文）



(本页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书》之签字盖章页)

项目协办人:

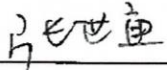
  
侯丽萍

保荐代表人:

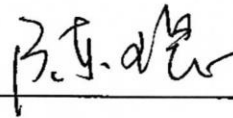
  
吉丽娜

  
牟军

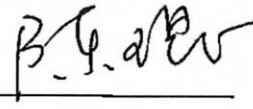
内核负责人

  
张世通

保荐业务负责人:

  
陈琨

保荐机构总裁:

  
陈琨

保荐机构董事长:

  
徐子兵

方正证券承销保荐有限责任公司



## 方正证券承销保荐有限责任公司保荐代表人专项授权书

### 上海证券交易所：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及有关文件的规定，我公司同意授权吉丽娜及牟军担任上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人，负责该公司本次发行上市的尽职推荐和持续督导等保荐工作。

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市申请文件受理指引》第三条的规定，现就上述两名签字保荐代表人的情况作出如下说明与承诺：

截至本授权书签署日：

一、吉丽娜最近 3 年的保荐执业情况：（1）目前无申报的在审企业；（2）最近三年内未曾担任过已完成的首发、再融资项目签字保荐代表人；

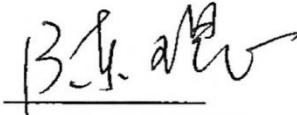
二、牟军最近 3 年的保荐执业情况：（1）目前无申报的在审企业；（2）最近 3 年内曾担任过西部金属材料股份有限公司非公开发行股票项目的签字保荐代表人，以上项目已完成发行；

三、最近三年，吉丽娜及牟军均无违规记录，未被中国证监会采取过监管措施，亦未受到过证券交易所公开谴责或中国证券业协会自律处分。

（以下无正文）

(本页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目保荐代表人专项授权书》之签字盖章页)

法定代表人：

  
陈 琨

保荐代表人签字：

  
吉丽娜

  
牟 军

方正证券承销保荐有限责任公司

2022年7月16日



上海伟测半导体科技股份有限公司

三年期申报审计报告

## 目 录

一、审计报告·····	第 1—5 页
二、财务报表·····	第 6—13 页
（一）合并及母公司资产负债表·····	第 6—7 页
（二）合并及母公司利润表·····	第 8 页
（三）合并及母公司现金流量表·····	第 9 页
（四）合并及母公司所有者权益变动表·····	第 10—13 页
三、财务报表附注·····	第 14—116 页

# 审计报告

天健审（2022）6-268号

上海伟测半导体科技股份有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称伟测科技公司）财务报表，包括2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度、2020年度、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了伟测科技公司2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度、2020年度、2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于伟测科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2019年度、2020年度、2021

年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

## （一）收入确认

### 1. 事项描述

相关会计年度：2019 年度、2020 年度、2021 年度

相关信息披露详见财务报表附注三(二十)、五(二)1 及十四(一)。

伟测科技公司的营业收入主要来自于集成电路测试，包括晶圆测试和芯片成品测试。2019 年度、2020 年度和 2021 年度，伟测科技公司营业收入金额分别为人民币 7,793.32 万元、16,119.62 万元和 49,314.43 万元，其中集成电路测试业务的营业收入为人民币 7,500.86 万元、15,232.18 万元和 47,210.65 万元，占营业收入的 96.25%、94.49%和 95.73%。

伟测科技公司主要提供晶圆和芯片成品测试服务。测试服务收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定完成测试服务并交付测试结果，且测试服务收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭据且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

由于营业收入是伟测科技公司关键业绩指标之一，可能存在伟测科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、检测报告、交付测试结果记录及客户对账单等；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证销售额；

(6) 对公司主要客户实施现场走访、调查，了解公司主要客户的实际经营状况及与客户交易情况；

(7) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 固定资产账面价值确定

### 1. 事项描述

相关会计期间： 2019 年度、2020 年度、2021 年度

相关信息披露详见财务报表附注三(十二)、(十六)及五(一)10。

截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，伟测科技公司固定资产账面价值分别为 19,727.44 万元、48,666.00 万元和 71,029.69 万元，占资产总额的比例分别为 58.52%、56.84%和 45.26%。

管理层对确定在建工程转入固定资产的时点、估计相应固定资产的折旧年限（预计使用寿命）与残值率等会计估计等方面的判断，会对固定资产的账面价值确定造成影响。

由于确认固定资产的账面价值涉及重大的管理层判断，且其对财务报表具有重要性，我们将固定资产账面价值确定确认为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对固定资产账面价值确定，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与固定资产确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 根据固定资产的性质和消耗方式，结合公司固定资产具体的生产损耗情况、预计使用寿命已满时的状态及处置方式，并通过了解同行业公司情况，评价管理层对固定资产的经济可使用年限及残值的估计；

(3) 以抽样方式检查与固定资产初始确认相关会计处理的支持性文件，包括固定资产采购合同、发票、付款单据等资料，抽查测试其入账价值及会计处理是否正确，抽查固定资产验收报告，评价在建工程转入固定资产的时点是否准确；

(4) 复核折旧费用的计提与分配是否正确；

(5) 参与公司年度固定资产盘点，执行监盘程序，了解固定资产的使用状态；



(6) 检查与固定资产相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估伟测科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

伟测科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督伟测科技公司的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对伟测科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致伟测科技公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就伟测科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

二〇二二年四月十五日

# 资产负 债 表 ( 资 产 )

编制单位: 上海伟世半导体科技股份有限公司 单位: 人民币元

资产	注释号	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:							
货币资金	1	149,697,852.53	89,593,661.06	93,426,732.97	73,149,680.93	23,480,227.00	23,480,164.12
交易性金融资产	2			29,990,000.00	29,990,000.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产							
衍生金融资产							
应收票据	3	4,030,000.00	30,000.00	1,886,860.00	1,886,860.00	730,000.00	730,000.00
应收账款	4	130,693,275.45	114,105,117.03	64,273,751.43	66,883,082.53	31,428,765.75	31,428,765.75
应收款项融资	5	535,519.48	477,554.20	962,940.10	519,450.00	92,096.00	92,096.00
预付款项	6	49,363.97	210,043,856.59	447,954.73	91,404.73	1,001,777.47	1,001,777.47
其他应收款	7	25,404,805.18	86,706,451.55	13,254,389.47	29,395,556.43	14,097,105.59	14,097,105.59
存货	8	6,336,607.23	2,799,687.98	3,623,857.16	1,996,516.84	1,529,967.74	1,529,967.74
合同资产							
持有待售资产							
一年内到期的非流动资产							
其他流动资产	9	76,430,212.61	8,531,243.60	45,559,776.40	26,541,833.80	13,145,488.00	13,145,488.00
流动资产合计		393,177,636.45	512,287,572.01	253,426,262.26	230,454,385.26	85,505,427.55	85,505,364.67
非流动资产:							
债权投资							
可供出售金融资产							
其他债权投资							
持有至到期投资							
长期应收款							
长期股权投资							
其他权益工具投资							
其他非流动金融资产							
投资性房地产							
固定资产	10	710,296,863.56	317,869,937.17	486,660,031.76	354,549,084.15	197,274,428.09	197,274,428.09
在建工程	11	109,629,604.00	4,674,979.71	95,810,116.57	43,064,259.40	42,546,867.00	42,546,867.00
生产性生物资产							
油气资产							
使用权资产	12	277,252,478.16	102,123,811.38				
无形资产	13	10,051,864.54	1,923,891.36	1,710,182.20	1,670,520.64	1,714,958.83	1,714,958.83
开发支出							
商誉							
长期待摊费用	14	38,091,066.07	15,078,119.62	18,102,520.13	10,237,342.64	8,693,663.72	8,693,663.72
递延所得税资产	15	1,273,311.23	834,234.25	427,076.08	420,062.92	207,294.24	207,294.24
其他非流动资产	16	29,580,128.02	514,987.29			1,159,904.66	1,159,904.66
非流动资产合计		1,176,175,315.58	673,049,960.78	602,709,926.74	559,971,269.75	251,597,116.54	251,597,116.54
资产总计		1,569,352,952.03	1,185,337,532.79	856,136,189.00	790,425,655.01	337,102,544.09	337,132,481.21

法定代表人: 



主管会计工作的负责人: 



会计机构负责人: 



# 资产负债表（负债和所有者权益）

单位：人民币元

编制单位：上海伟创半导体科技股份有限公司	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
17	102,907,849.31	88,907,849.31	40,345,006.85	40,345,006.85	17,116,151.95	17,116,151.95
18	88,672,718.58	14,000,000.00	91,533,049.37	62,538,916.31	18,171,762.47	18,171,762.47
19		12,818,415.96			40,419.80	40,419.80
20	24,164,048.97	14,322,487.90	10,031,390.51	9,017,906.75	3,482,884.86	3,482,884.86
21	14,286,725.07	3,268,026.86	2,703,209.72	2,617,081.44	810,535.56	810,535.56
22	4,610,115.79	2,459,101.93	2,448,692.64	1,716,621.64	2,135,447.08	2,135,447.08
23	160,619,522.96	92,403,952.11	58,456,595.04	43,133,392.08	42,738,318.65	42,738,318.65
	395,260,980.68	228,219,834.07	205,517,944.13	159,368,925.07	84,496,820.37	84,496,820.37
24	166,670,450.52	49,310,044.79	6,969,197.23	6,969,197.23		
25	90,488,433.28	37,422,985.67				
26			72,177,041.80	52,100,195.20	47,146,667.39	47,146,667.39
27	17,977,036.87	13,023,333.17	4,463,333.25	4,463,333.25	5,578,333.33	5,578,333.33
	275,135,920.67	99,756,363.63	83,609,572.28	63,532,725.68	52,725,000.72	52,725,000.72
	670,396,901.35	327,976,197.70	289,127,516.41	222,901,650.75	137,221,821.09	137,221,821.09
28	65,408,000.00	65,408,000.00	61,320,000.00	61,320,000.00	35,916,786.00	35,916,786.00
29	672,596,678.02	672,596,678.02	476,684,678.02	476,684,678.02	147,080,173.07	147,080,173.07
30	11,948,535.88	11,948,535.88	2,951,932.62	2,951,932.62	1,799,173.51	1,799,173.51
31	149,002,836.78	107,408,121.19	26,052,061.95	26,567,393.62	15,084,590.42	15,115,827.54
	898,956,050.68	857,351,335.09	567,008,672.59	567,524,004.26	199,880,723.00	199,911,960.12
	1,569,932,952.03	1,185,337,532.79	856,136,189.00	790,425,655.01	337,102,544.09	337,132,481.21



王沛



王沛



文胜

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

单位:人民币元

注释号	2021年度		2020年度		2019年度	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	493,144,257.09	431,545,972.30	191,196,220.78	157,719,537.46	77,933,235.29	77,933,235.29
减: 营业成本	244,304,848.77	268,151,381.99	79,663,501.70	79,619,074.77	37,695,464.29	37,695,464.29
税金及附加	767,349.96	342,711.27	288,748.78	202,620.50	76,680.52	76,680.52
销售费用	11,153,818.10	8,583,920.29	5,489,818.23	4,761,702.82	2,847,104.07	2,847,104.07
管理费用	21,794,131.07	15,375,337.78	13,157,528.34	10,488,441.00	7,212,675.01	7,212,675.01
研发费用	47,742,834.01	32,280,465.69	21,013,963.09	20,019,307.63	13,371,662.77	13,371,662.77
财务费用	15,162,236.74	8,313,068.10	6,834,089.27	7,604,550.77	5,912,198.62	5,912,198.62
其中: 利息费用	18,786,576.38	11,466,776.95	7,836,069.62	7,435,622.38	6,190,247.54	6,190,247.54
利息收入	2,037,553.26	1,976,489.58	95,284.40	89,504.46	38,766.81	38,766.81
加: 其他收益	4,959,672.74	4,302,576.44	4,675,681.02	4,650,381.02	2,116,056.12	2,116,056.12
投资收益 (损失以“-”号填列)	234,395.92	234,395.92	39,057.54	39,057.54		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益						
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益						
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)						
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)						
信用减值损失 (损失以“-”号填列)						
资产减值损失 (损失以“-”号填列)						
资产处置收益 (损失以“-”号填列)						
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-5,214,465.01	-3,095,890.62	-1,518,670.42	-1,287,521.31	-1,059,922.20	-1,059,922.20
加: 营业外收入						
减: 营业外支出	195,653.15	-176,986.49			-36,898.60	-36,898.60
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	152,394,325.24	99,765,924.43	37,944,639.51	38,435,747.22	11,806,685.33	11,806,685.33
减: 所得税费用	160,26	160,26			318,495.88	318,495.88
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	132,175,641.77	89,965,032.61	34,846,264.67	35,330,359.22	11,277,809.60	11,277,809.60
(一) 按经营持续性分类:						
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	132,175,641.77	89,965,032.61	34,846,264.67	35,330,359.22	11,277,809.60	11,277,809.60
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)						
(二) 按所有权归属分类:						
1. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	132,175,641.77	89,965,032.61	34,846,264.67	35,330,359.22	11,277,809.60	11,277,809.60
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)						
五、其他综合收益的税后净额						
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额						
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益						
1. 重新计量设定受益计划变动额						
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益						
3. 其他权益工具投资公允价值变动						
4. 企业自身信用风险公允价值变动						
5. 其他						
(二) 将重分类进损益的其他综合收益						
1. 权益法下可转损益的其他综合收益						
2. 其他权益工具投资公允价值变动						
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益						
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额						
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
6. 其他债权投资公允价值变动						
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)						
8. 外币财务报表折算差额						
9. 其他						
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额						
六、综合收益总额	132,175,641.77	89,965,032.61	34,846,264.67	35,330,359.22	11,277,809.60	11,277,809.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,175,641.77	89,965,032.61	34,846,264.67	35,330,359.22	11,277,809.60	11,277,809.60
归属于少数股东的综合收益总额						
七、每股收益:						
(一) 基本每股收益	2.09		0.67			
(二) 稀释每股收益	2.09		0.67			



王沛

会计机构负责人:



王沛

主管会计工作的负责人:

第 8 页 共 116 页



文胜

法定代表人:

# 现金流量表

单位:人民币元

项目	注释号	2021年度		2020年度		2019年度	
		合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量							
销售商品、提供劳务收到的现金	1	450,564,995.35	408,439,046.99	132,017,098.62	125,553,936.35	67,675,263.14	67,675,263.14
收到的税费返还		8,207,970.04	8,123,669.50	6,979,961.38	6,979,961.38	4,237,425.93	4,237,425.93
收到其他与经营活动有关的现金		20,510,929.62	15,674,831.55	5,204,547.40	4,389,764.11	7,886,061.35	7,886,061.35
经营活动现金流入小计		479,283,895.01	432,237,548.04	144,201,607.40	136,923,661.84	79,798,750.42	79,798,750.42
购买商品、接受劳务支付的现金		73,503,378.46	388,120,176.07	16,435,151.36	9,287,031.49	13,474,374.18	13,474,374.18
支付给职工以及为职工支付的现金		117,139,615.88	70,945,888.65	36,839,468.10	33,154,106.11	22,642,907.82	22,642,907.82
支付的其他与经营活动有关的现金	2	10,389,571.63	10,038,515.40	1,741,273.89	1,741,273.89	222,634.03	222,634.03
经营活动现金流出小计		25,930,101.94	10,528,060.42	13,738,164.72	8,532,907.46	4,418,363.48	4,418,363.48
经营活动产生的现金流量净额		226,962,667.91	479,632,640.54	68,754,058.07	52,715,318.95	40,758,279.51	40,758,279.51
二、投资活动产生的现金流量							
收回投资收到的现金		38,690,000.00	38,690,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		
取得投资收益收到的现金		234,395.92	234,395.92	39,057.54	39,057.54		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,236,409.86	590,238.25				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额							
收到其他与投资活动有关的现金	3			450,000.00	450,000.00	139,543.86	139,543.86
投资活动现金流入小计		41,160,805.78	39,514,634.17	10,489,057.54	10,489,057.54		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		673,946,671.12	149,850,672.29	145,186,106.63	24,669,974.74		
投资支付的现金		8,700,000.00	88,700,000.00	39,990,000.00	189,990,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额							
支付其他与投资活动有关的现金	4			185,176,106.63	20,000,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00
投资活动现金流出小计		682,646,671.12	238,550,672.29	-174,687,049.09	234,659,974.74	49,174,263.25	49,174,263.25
投资活动产生的现金流量净额		-641,485,865.34	-199,036,038.12		-224,170,917.20	-47,271,209.39	-47,271,209.39
三、筹资活动产生的现金流量							
吸收投资收到的现金		200,000,000.00	200,000,000.00	280,000,058.29	280,000,058.29	100,400,000.00	100,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金							
取得借款收到的现金		321,412,169.59	190,386,923.80	79,845,513.24	79,845,513.24	19,000,000.00	19,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		106,906,067.35	831,330.03	70,000,000.00	70,000,000.00	3,748,269.00	3,748,269.00
筹资活动现金流入小计		628,318,236.94	391,218,253.83	429,845,513.24	429,845,513.24	123,148,269.00	123,148,269.00
偿还债务支付的现金		57,732,620.05	57,732,620.05	46,120,784.91	46,120,784.91	12,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,792,382.19	7,478,794.07	1,730,962.67	1,272,676.22	510,145.87	510,145.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润							
支付其他与筹资活动有关的现金		122,231,712.18	63,014,810.34	212,845,410.67	192,697,524.25	79,846,009.72	79,846,009.72
筹资活动现金流出小计		188,756,714.42	128,226,224.46	260,697,188.25	240,090,985.38	92,356,155.59	92,356,155.59
筹资活动产生的现金流量净额		439,561,522.52	262,992,029.37	169,148,413.28	189,754,586.15	30,792,113.41	30,792,113.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响		-525,764.72	-116,918.62	37,592.45	-122,495.03	-1,708.92	-1,708.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响							
五、现金及现金等价物净增加额		49,871,119.56	16,443,980.13	69,946,505.97	49,669,516.81	22,559,666.01	22,559,666.01
加:期初现金及现金等价物余额		93,426,732.97	73,149,680.93	23,480,227.00	23,480,227.00	920,560.99	920,560.99
六、期末现金及现金等价物余额		143,297,852.53	89,593,661.06	93,426,732.97	73,149,680.93	23,480,227.00	23,480,227.00

法定代表人:

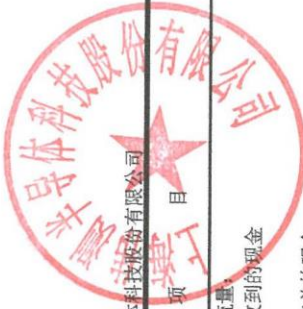
主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

第 9 页 共 116 页

3-2-1-11

45



625202

王沛

王沛

# 合并所有者权益变动表

单位：人民币元

项	2021年度										2020年度										
	归属于母公司所有者权益					归属于母公司所有者权益					归属于母公司所有者权益					归属于母公司所有者权益					
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
一、上年期末余额	61,320,000.00	476,694,678.02	2,951,932.62	25,652,661.95	568,780,408.91	35,915,786.00	147,060,173.07	1,799,173.51	15,084,590.42	199,690,723.00	61,320,000.00	476,694,678.02	2,951,932.62	25,652,661.95	568,780,408.91	35,915,786.00	147,060,173.07	1,799,173.51	15,084,590.42	199,690,723.00	
加：会计政策变更				-229,263.69	-229,263.69																
前期差错更正																					
同一控制下企业合并																					
其他																					
二、本年期初余额	61,320,000.00	476,694,678.02	2,951,932.62	25,652,661.95	568,780,408.91	35,915,786.00	147,060,173.07	1,799,173.51	15,084,590.42	199,690,723.00	61,320,000.00	476,694,678.02	2,951,932.62	25,652,661.95	568,780,408.91	35,915,786.00	147,060,173.07	1,799,173.51	15,084,590.42	199,690,723.00	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,088,000.00	195,912,000.00	8,998,603.26	123,179,038.51	332,175,641.77	25,403,214.00	329,604,504.95	1,152,719.11	10,997,471.53	387,127,942.59	4,088,000.00	195,912,000.00	8,998,603.26	123,179,038.51	332,175,641.77	25,403,214.00	329,604,504.95	1,152,719.11	10,997,471.53	387,127,942.59	
（一）综合收益总额				132,175,641.77	132,175,641.77																
（二）所有者投入和减少资本	4,088,000.00	195,912,000.00			200,000,000.00	12,304,022.00	319,977,632.92			334,845,284.67					334,845,284.67						
1. 所有者投入的普通股	4,088,000.00	195,912,000.00			200,000,000.00	12,304,022.00	319,977,632.92			334,845,284.67					334,845,284.67						
2. 其他权益工具持有者投入资本																					
3. 股份支付计入所有者权益的金额																					
4. 其他																					
（三）利润分配				-8,998,603.26	-8,998,603.26																
1. 提取盈余公积				-8,998,603.26	-8,998,603.26																
2. 提取一般风险准备																					
3. 对所有者（或股东）的分配																					
4. 其他																					
（四）所有者权益内部结转																					
1. 资本公积转增资本（或股本）						13,098,192.00	9,626,842.03														
2. 盈余公积转增资本（或股本）																					
3. 盈余公积弥补亏损																					
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																					
5. 其他综合收益结转留存收益																					
6. 其他																					
（五）专项储备																					
1. 本期提取																					
2. 本期使用																					
（六）其他																					
四、本期末余额	65,408,000.00	672,596,678.02	11,948,535.88	149,002,838.78	698,956,052.68	61,320,000.00	476,694,678.02	2,951,932.62	26,052,681.95	597,008,672.59	65,408,000.00	672,596,678.02	11,948,535.88	149,002,838.78	698,956,052.68	61,320,000.00	476,694,678.02	2,951,932.62	26,052,681.95	597,008,672.59	

法定代表人：  王胜文  王胜文

主管会计工作的负责人：  王沛  王沛




会计机构负责人：  王沛  王沛

# 合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2019年度

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	其他权益工具		资本公积	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益		
	优先股	永续债										
一、上期期末余额	38,983,510.00		49,116,490.00				671,392.55	4,934,561.78			83,105,954.33	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	38,983,510.00		49,116,490.00				671,392.55	4,934,561.78			83,105,954.33	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,533,276.00		97,963,683.07				1,127,760.96	10,150,028.64			116,774,768.67	
（一）综合收益总额								11,277,809.60			11,277,809.60	
（二）所有者投入和减少资本	7,533,276.00		97,963,683.07								105,496,959.07	
1. 所有者投入的普通股	7,533,276.00		92,666,724.00								100,400,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额			1,527,765.26								1,527,765.26	
4. 其他			3,569,193.81								3,569,193.81	
（三）利润分配							1,127,760.96	-1,127,760.96				
1. 提取盈余公积							1,127,760.96	-1,127,760.96				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	35,916,786.00		147,080,173.07				1,799,173.51	15,094,590.42			199,890,723.00	

法定代表人：  王胜  
 主管会计工作的负责人：  王胜  
 会计机构负责人：  王胜





# 母公司所有者权益变动表

会计04表  
单位：人民币元

项 目	2021年										2020年度									
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债									其他	优先股							
一、上年期末余额	61,320,000.00			476,684,678.02				2,951,932.62	26,567,393.62	567,524,004.26	35,916,786.00			147,080,173.07				1,799,173.51	15,115,827.54	199,911,960.12
加：会计政策变更									-128,701.78	-128,701.78										
前期差错更正																				
其他																				
二、本年期初余额	61,320,000.00			476,684,678.02				2,951,932.62	26,438,691.84	567,395,302.48	35,916,786.00			147,080,173.07				1,799,173.51	15,115,827.54	199,911,960.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,088,000.00			195,912,000.00				8,996,603.26	80,969,429.35	289,966,032.61	25,403,214.00			329,604,504.95				1,152,759.11	11,451,566.08	367,612,044.14
(一)综合收益总额									89,966,032.61	89,966,032.61									35,330,359.22	35,330,359.22
(二)所有者投入和减少资本	4,088,000.00			195,912,000.00				12,304,022.00		200,000,000.00	12,304,022.00			319,977,662.92						332,281,684.92
1.所有者投入的普通股	4,088,000.00			195,912,000.00				12,304,022.00		200,000,000.00	12,304,022.00			317,696,036.29						330,000,058.29
2.其他权益工具持有者投入资本																				
3.股份支付计入所有者权益的金额																				
4.其他														2,155,804.20						2,155,804.20
(三)利润分配								8,996,603.26	-8,996,603.26					125,822.43						125,822.43
1.提取盈余公积								8,996,603.26	-8,996,603.26											2,951,932.62
2.对所有者(或股东)的分配								8,996,603.26	-8,996,603.26											2,951,932.62
3.其他																				
(四)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)											13,099,192.00			9,626,842.03						-1,799,173.51
2.盈余公积转增资本(或股本)																				-20,926,660.52
3.盈余公积弥补亏损																				
4.设定受益计划变动额结转留存收益																				
5.其他综合收益结转留存收益																				
6.其他																				
(五)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(六)其他																				
四、本期期末余额	65,408,000.00			672,596,678.02				11,946,535.88	107,408,121.19	857,361,335.09	61,320,000.00			476,684,678.02				2,951,932.62	26,567,393.62	567,524,004.26

会计机构负责人：  
 王沛之印

主管会计工作的负责人：  
 王沛之印

法定代表人：  
 文胜之印

# 母公司所有者权益变动表

会计04表  
单位：人民币元

编制单位：上海华测半导体科技股份有限公司

项 目	2019年度									
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债							
一、上年期末余额	28,383,510.00			49,116,490.00				671,392.55	4,955,796.90	83,137,191.45
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	28,383,510.00			49,116,490.00				671,392.55	4,955,796.90	83,137,191.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,533,276.00			97,963,683.07				1,127,780.96	10,150,028.64	116,774,768.67
（一）综合收益总额									11,277,809.60	11,277,809.60
（二）所有者投入和减少资本	7,533,276.00			97,963,683.07						105,496,959.07
1. 所有者投入的普通股	7,533,276.00			92,866,724.00						100,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,527,765.26						1,527,765.26
4. 其他				3,569,193.81						3,569,193.81
（三）利润分配								1,127,780.96	-1,127,780.96	
1. 提取盈余公积								1,127,780.96	-1,127,780.96	
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	35,916,786.00			147,080,173.07				1,799,173.51	15,115,827.54	199,911,960.12

法定代表人：

*王沛*



主管会计工作的负责人：

*王沛*



会计机构负责人：

*王沛*



---

# 上海伟测半导体科技股份有限公司

## 财务报表附注

2019年1月1日至2021年12月31日

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原上海伟测半导体科技有限公司（以下简称伟测半导体公司），伟测半导体公司系由李峰投资设立，于2016年5月6日在上海市浦东新区市场监督管理局登记注册，取得统一社会信用代码为91310115MA1H7PY66D的营业执照。伟测半导体公司成立时注册资本2,000.00万元。伟测半导体公司以2020年4月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2020年9月4日在上海市市场监督管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为91310115MA1H7PY66D营业执照，注册资本6,540.80万元，股份总数6,540.80万股（每股面值1元）。

本公司属集成电路测试行业。主要经营活动为集成电路测试，包括：晶圆测试和芯片成品测试。

本财务报表业经公司2022年4月15日第一届董事会第十二次会议批准对外报出。

本公司将上海威矽半导体科技有限公司、无锡伟测半导体科技有限公司、厦门伟测半导体科技有限公司、南京伟测半导体科技有限公司4家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

### 二、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

#### （三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （五）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### （六）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （七）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

#### （八）金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允

---

价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上

---

几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济



其他应收款——账龄组合	账 龄	状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
-------------	-----	--

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账 龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

---

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### （九）存货

##### 1. 存货的分类

存货包括在提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

##### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

#### （十）合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

---

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### （十一）长期股权投资

##### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

##### 2. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

---

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的  
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新

计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## (十二) 固定资产

### 1. 2021 年度

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20		5.00
专用设备	年限平均法	5-10		10.00-20.00
办公设备	年限平均法	2-5		20.00-50.00

### 2. 2019-2020 年度

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
专用设备	年限平均法	5-10		10.00-20.00
办公设备	年限平均法	2-5		20.00-50.00

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

---

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%) ]；4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### (十三) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### (十四) 借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### （十五）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、软件使用权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件使用权	5
土地使用权	32

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （十六）部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

#### （十七）长期待摊费用

---

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十八）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

##### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

##### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定



---

进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### （十九）股份支付

##### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### （1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

###### （2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

###### （3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值

---

为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## （二十）收入

### 1. 2020-2021 年度

#### （1）收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### （2）收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不

---

会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### (3) 收入确认的具体方法

公司主要提供晶圆和芯片成品测试服务。属于在某一时点履行履约义务。测试服务收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定完成测试服务并交付测试结果，且测试服务收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭据且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 2. 2019 年度

### (1) 收入确认原则

#### 1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：① 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；② 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③ 收入的金额能够可靠地计量；④ 相关的经济利益很可能流入；⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (2) 收入确认的具体方法

公司主要提供晶圆和芯片成品测试服务。测试服务收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定完成测试服务并交付测试结果，且测试服务收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭据且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## (二十一) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府

---

补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

### (二十二) 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### (二十三) 递延所得税资产

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂

---

时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (二十四) 租赁

##### 1. 2021 年度

##### (1) 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

##### 1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：① 租赁负债的初始计量金额；② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③ 承租人发生的初始直接费用；④ 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

##### 2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

---

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## (2) 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## (3) 售后租回

### 1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

### 2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

## 2. 2019-2020 年度

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## (二十五) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、7%

教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	2021 年度	2020 年度	2019 年度
本公司	12.5%	12.5%	12.5%
上海威矽半导体科技有限公司	25%	25%	25%
厦门伟测半导体科技有限公司	已注销	25%	25%
无锡伟测半导体科技有限公司	25%	25%	未成立
南京伟测半导体科技有限公司	25%	未成立	未成立

(二) 税收优惠

1. 根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于进一步鼓励集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2015〕6号）和《上海市集成电路封装、测试企业以及集成电路关键专用材料生产企业、集成电路专用设备生产企业享受税收优惠的证明出具办法》（沪发改规范〔2018〕10号），本公司自2017年起享受企业所得税两免三减半优惠，故2019-2021年企业所得税税率为12.5%。

2. 公司于2018年11月取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（GR201831002935），故2019-2020年公司可适用企业所得税税率为15%。2021年12月取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（GR202131004437），故2021年度公司可适用企业所得税税率为15%。公司实际2019-2021年度所得税税率为12.5%。

3. 根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财税〔2019〕39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。报告期内，公司实际未享受。

4. 根据国税总局《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》（国家税务总局公告〔2012〕第24号）第九条第（四）项第2目第（1）点规定，本公司来料加工业务免缴增值税。

**五、合并财务报表项目注释**



(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
库存现金	209. 18	209. 18	313. 68
银行存款	143, 297, 096. 44	93, 424, 304. 08	23, 470, 109. 92
其他货币资金	6, 400, 546. 91	2, 219. 71	9, 803. 40
合 计	149, 697, 852. 53	93, 426, 732. 97	23, 480, 227. 00

(2) 其他说明

2021年12月31日公司其他货币资金中使用受限的金额为保函保证金6,400,000.00元。

2. 交易性金融资产

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		29, 990, 000. 00	
其中：理财产品		29, 990, 000. 00	
合 计		29, 990, 000. 00	

3. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	2021. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	4, 030, 000. 00	100. 00			4, 030, 000. 00
其中：银行承兑汇票	4, 030, 000. 00	100. 00			4, 030, 000. 00
合 计	4, 030, 000. 00	100. 00			4, 030, 000. 00

(续上表)

种 类	2020. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按组合计提坏账准备	1,889,459.00	100.00	2,599.00	0.14	1,886,860.00
其中：银行承兑汇票	1,837,479.00	97.25			1,837,479.00
商业承兑汇票	51,980.00	2.75	2,599.00	5.00	49,381.00
合 计	1,889,459.00	100.00	2,599.00	0.14	1,886,860.00

(续上表)

种 类	2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	730,000.00	100.00			730,000.00
其中：银行承兑汇票	730,000.00	100.00			730,000.00
合 计	730,000.00	100.00			730,000.00

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项 目	2021.12.31			2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	4,030,000.00			1,837,479.00		
商业承兑汇票组合				51,980.00	2,599.00	5.00
小 计	4,030,000.00			1,889,459.00	2,599.00	0.14

(续上表)

项 目	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	730,000.00		
小 计	730,000.00		

(2) 坏账准备变动情况

1) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,599.00	-2,599.00						
小 计	2,599.00	-2,599.00						

2) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	

按组合计提坏账准备		2,599.00					2,599.00
小计		2,599.00					2,599.00

(3) 公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	2021.12.31		2020.12.31	
	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票		4,030,000.00		1,737,479.00
商业承兑汇票				51,980.00
小计		4,030,000.00		1,789,459.00

(续上表)

项目	2019.12.31	
	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票		630,000.00
小计		630,000.00

由信用等级较高的大型商业银行、上市股份制商业银行承兑的银行承兑汇票在背书或贴现时终止确认，由信用等级一般的其他商业银行承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书或贴现时继续确认应收票据，待到期承兑后终止确认。

#### 4. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种类	2021.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	137,572,051.95	100.00	6,878,776.50	5.00	130,693,275.45
合计	137,572,051.95	100.00	6,878,776.50	5.00	130,693,275.45

(续上表)

种类	2020.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	67,659,708.41	100.00	3,385,956.98	5.00	64,273,751.43

合 计	67,659,708.41	100.00	3,385,956.98	5.00	64,273,751.43
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------

(续上表)

种 类	2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	33,087,119.70	100.00	1,658,353.95	5.01	31,428,765.75
合 计	33,087,119.70	100.00	1,658,353.95	5.01	31,428,765.75

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合中,采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账 龄	2021.12.31			2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	137,568,573.71	6,878,428.68	5.00	67,600,277.08	3,380,013.85	5.00
1-2年	3,478.24	347.82	10.00	59,431.33	5,943.13	10.00
小 计	137,572,051.95	6,878,776.50	5.00	67,659,708.41	3,385,956.98	5.00

(续上表)

账 龄	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	33,007,160.35	1,650,358.01	5.00
1-2年	79,959.35	7,995.94	10.00
小 计	33,087,119.70	1,658,353.95	5.01

(2) 坏账准备变动情况

1) 2021年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	3,385,956.98	3,492,819.52						6,878,776.50
小 计	3,385,956.98	3,492,819.52						6,878,776.50

2) 2020年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,658,353.95	1,727,603.03						3,385,956.98
小 计	1,658,353.95	1,727,603.03						3,385,956.98

3) 2019 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	936,787.71	721,566.24						1,658,353.95
小 计	936,787.71	721,566.24						1,658,353.95

(3) 应收账款金额前 5 名情况

1) 2021 年度

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户 A	24,476,506.33	17.79	1,223,825.32
晶晨半导体(上海)股份有限公司	21,333,894.07	15.51	1,066,694.70
紫光展锐科技有限公司	13,403,574.40	9.74	670,178.72
Bitmain Technologies Limited	7,810,884.97	5.68	390,544.25
甬矽电子(宁波)股份有限公司	6,022,920.71	4.38	301,146.04
小 计	73,047,780.48	53.10	3,652,389.03

2) 2020 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
晶晨半导体(上海)股份有限公司	9,720,972.54	14.37	486,048.63
深圳市中兴微电子技术有限公司	9,628,030.46	14.23	481,401.52
普冉半导体(上海)股份有限公司	8,134,702.58	12.02	406,735.13
客户 A	4,962,464.77	7.33	248,123.24
甬矽电子(宁波)股份有限公司	2,970,976.47	4.39	148,548.82
小 计	35,417,146.82	52.34	1,770,857.34

3) 2019 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
普冉半导体(上海)有限公司	4,695,590.43	14.19	234,779.52
星科金朋半导体(江阴)有限公司	2,223,852.55	6.72	111,192.63
江苏长电科技股份有限公司	1,886,532.31	5.70	94,326.62
吉林华微电子股份有限公司	1,734,424.03	5.24	86,721.20

广东晟矽微电子有限公司	1,546,539.37	4.67	77,326.97
小 计	12,086,938.69	36.52	604,346.94

5. 应收款项融资

(1) 明细情况

项 目	2021.12.31		2020.12.31	
	账面价值	累计确认的 信用减值准备	账面价值	累计确认的 信用减值准备
银行承兑汇票	535,519.48		962,940.10	
合 计	535,519.48		962,940.10	

(续上表)

项 目	2019.12.31	
	账面价值	累计确认的 信用减值准备
银行承兑汇票	92,096.00	
合 计	92,096.00	

(2) 公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	终止确认金额		
	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
银行承兑汇票	2,935,022.42	2,401,431.81	903,363.68
小 计	2,935,022.42	2,401,431.81	903,363.68

注：终止确认原因详见本财务报表附注五(一)3(3)之说明

6. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	2021.12.31				2020.12.31			
	账面余额	比例(%)	减值 准备	账面价值	账面余额	比例(%)	减值 准备	账面价值
1年以内	45,563.97	92.30		45,563.97	447,954.73	100.00		447,954.73
1-2年	3,800.00	7.70		3,800.00				
合 计	49,363.97	100.00		49,363.97	447,954.73	100.00		447,954.73

(续上表)

账 龄	2019.12.31
-----	------------

	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1 年以内	1,001,777.47	100.00		1,001,777.47
合 计	1,001,777.47	100.00		1,001,777.47

(2) 预付款项金额前 5 名情况

1) 2021 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
Premtek International Inc	15,620.47	31.64
王彪	8,997.50	18.23
王建来	6,000.00	12.15
张若唯	5,600.00	11.34
王晓霞	5,578.00	11.30
小 计	41,795.97	84.66

2) 2020 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
无锡发润电子科技有限公司	220,000.00	49.11
苏州中科集成电脑设计中心有限公司	80,000.00	17.86
周尔生	19,500.00	4.35
上海奥世管理体系认证有限公司	14,000.00	3.13
邱瑞明	10,850.00	2.42
小 计	344,350.00	76.87

3) 2019 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
苏州中科集成电脑设计中心有限公司	315,849.06	31.53
上海宏测半导体科技有限公司	243,474.48	24.30
GLTTEK CO LTD	150,552.00	15.03
上海捷策创电子科技有限公司	74,304.74	7.42
中国石化销售有限公司上海石油分公司	54,268.38	5.42
小 计	838,448.66	83.70

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	2021. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	27,958,513.05	100.00	2,553,707.87	9.13	25,404,805.18
合 计	27,958,513.05	100.00	2,553,707.87	9.13	25,404,805.18

(续上表)

种 类	2020. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	14,083,852.85	100.00	829,463.38	5.89	13,254,389.47
合 计	14,083,852.85	100.00	829,463.38	5.89	13,254,389.47

(续上表)

种 类	2019. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	15,138,100.58	100.00	1,040,994.99	6.88	14,097,105.59
合 计	15,138,100.58	100.00	1,040,994.99	6.88	14,097,105.59

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2021. 12. 31			2020. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	27,958,513.05	2,553,707.87	9.13	14,083,852.85	829,463.38	5.89
其中：1 年以内	14,524,527.50	726,226.38	5.00	11,578,438.20	578,921.91	5.00
1-2 年	11,013,570.90	1,101,357.09	10.00	2,505,414.65	250,541.47	10.00
2-3 年	2,420,414.65	726,124.40	30.00			
小 计	27,958,513.05	2,553,707.87	9.13	14,083,852.85	829,463.38	5.89

(续上表)

组合名称	2019. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)



账龄组合	15,138,100.58	1,040,994.99	6.88
其中：1年以内	9,456,301.52	472,815.08	5.00
1-2年	5,681,799.06	568,179.91	10.00
小计	15,138,100.58	1,040,994.99	6.88

(2) 坏账准备变动情况

1) 2021 年度

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
期初数	578,921.91	250,541.47		829,463.38
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-549,554.60	549,554.60		
--转入第三阶段		-243,041.47	243,041.47	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	696,859.07	544,302.49	483,082.93	1,724,244.49
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	726,226.38	1,101,357.09	726,124.40	2,553,707.87

2) 2020 年度

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
期初数	472,815.08	568,179.91		1,040,994.99
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-125,270.73	125,270.73		
--转入第三阶段				

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	231,377.56	-442,909.17		-211,531.61
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	578,921.91	250,541.47		829,463.38

3) 2019 年度

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
期初数[注]	421,948.68	250,690.35		672,639.03
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-284,089.95	284,089.95		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	334,956.35	33,399.61		368,355.96
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	472,815.08	568,179.91		1,040,994.99

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	2021. 12. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
押金保证金	22,005,518.69	14,077,780.76	14,579,589.48
应收暂付款	5,946,922.27		
拆借款			450,000.00

备用金	6,072.09	6,072.09	108,511.10
合计	27,958,513.05	14,083,852.85	15,138,100.58

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

1) 2021 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
北亚融资租赁(上海)有限公司	融资租赁保证金	7,146,400.90	1 年以内、1-2 年	25.56	545,352.01
苏州融华租赁有限公司	融资租赁保证金	5,990,715.43	1 年以内、1-2 年、2-3 年	21.43	904,055.16
中华人民共和国无锡海关	应收暂付款	5,946,922.27	1 年以内	21.27	297,346.11
平安国际融资租赁有限公司	融资租赁保证金	3,769,454.00	1 年以内	13.48	188,472.70
无锡星洲能源发展有限公司	电力保证金	1,952,867.95	1 年以内、1-2 年	6.98	139,564.87
小计		24,806,360.55		88.72	2,074,790.85

2) 2020 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
北亚融资租赁(上海)有限公司	融资租赁保证金	5,996,792.96	1 年以内	42.58	299,839.65
苏州融华租赁有限公司	融资租赁保证金	5,010,715.43	1 年以内、1-2 年	35.58	339,031.68
无锡星洲能源发展有限公司	电力保证金	838,429.51	1 年以内	5.95	41,921.48
上海新发创运置业有限公司	厂房押金	590,496.56	1 年以内、1-2 年	4.19	58,799.66
无锡星洲工业园区开发股份有限公司	厂房押金	531,096.30	1 年以内	3.77	26,554.82
小计		12,967,530.76		92.07	766,147.29

3) 2019 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
北亚融资租赁(上海)有限公司	融资租赁保证金	11,893,122.07	1 年以内、1-2 年	78.56	871,246.06
苏州融华租赁有限公司	融资租赁保证金	1,774,930.50	1 年以内	11.72	88,746.53

上海新发创运置业有限公司	厂房押金	611,536.91	1年以内	4.04	30,576.85
骈文胜	拆借款及备用金	304,952.10	1年以内	2.01	15,247.61
仲利国际租赁有限公司	融资租赁保证金	150,000.00	1-2年	0.99	15,000.00
小计		14,734,541.58		97.32	1,020,817.05

## 8. 存货

项目	2021.12.31			2020.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	6,336,607.23		6,336,607.23	3,623,857.16		3,623,857.16
合计	6,336,607.23		6,336,607.23	3,623,857.16		3,623,857.16

(续上表)

项目	2019.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	1,529,967.74		1,529,967.74
合计	1,529,967.74		1,529,967.74

## 9. 其他流动资产

项目	2021.12.31			2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣增值税	75,102,854.12		75,102,854.12	45,559,776.40		45,559,776.40
IPO申报费用	1,327,358.49		1,327,358.49			
合计	76,430,212.61		76,430,212.61	45,559,776.40		45,559,776.40

(续上表)

项目	2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣增值税	13,145,488.00		13,145,488.00
合计	13,145,488.00		13,145,488.00

## 10. 固定资产

### (1) 明细情况

1) 2021 年度

项 目	房屋及建筑物	办公设备	专用设备	合计
账面原值				
期初数		1,039,104.06	403,073,848.13	404,112,952.19
本期增加金额	18,193,375.24	1,009,391.33	398,710,395.44	417,913,162.01
① 购置	18,193,375.24	1,009,391.33		19,202,766.57
② 在建工程转入			398,710,395.44	398,710,395.44
本期减少金额			3,507,740.47	3,507,740.47
其中：处置或报废			3,507,740.47	3,507,740.47
期末数	18,193,375.24	2,048,495.39	798,276,503.10	818,518,373.73
累计折旧				
期初数		774,165.56	49,010,854.30	49,785,019.86
本期增加金额	379,028.65	210,582.32	59,098,633.09	59,688,244.06
其中：计提	379,028.65	210,582.32	59,098,633.09	59,688,244.06
本期减少金额			1,251,753.75	1,251,753.75
其中：处置或报废			1,251,753.75	1,251,753.75
期末数	379,028.65	984,747.88	106,857,733.64	108,221,510.17
减值准备				
账面价值				
期末账面价值	17,814,346.59	1,063,747.51	691,418,769.46	710,296,863.56
期初账面价值[注]		264,938.50	354,062,993.83	354,327,932.33

[注]期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注十四(四)之说明

2) 2020 年度

项 目	办公设备	专用设备	合计
账面原值			
期初数	981,723.53	220,620,670.21	221,602,393.74
本期增加金额	57,380.53	321,011,828.18	321,069,208.71
① 购置	57,380.53		57,380.53

② 在建工程转入		321,011,828.18	321,011,828.18
本期减少金额			
期末数	1,039,104.06	541,632,498.39	542,671,602.45
累计折旧			
期初数	553,715.64	23,774,250.01	24,327,965.65
本期增加金额	220,449.92	31,463,155.12	31,683,605.04
其中：计提	220,449.92	31,463,155.12	31,683,605.04
本期减少金额			
期末数	774,165.56	55,237,405.13	56,011,570.69
减值准备			
账面价值			
期末账面价值	264,938.50	486,395,093.26	486,660,031.76
期初账面价值	428,007.89	196,846,420.20	197,274,428.09

3) 2019 年度

项 目	办公设备	专用设备	合计
账面原值			
期初数	779,442.15	96,508,326.55	97,287,768.70
本期增加金额	203,407.17	124,246,873.58	124,450,280.75
① 购置	203,407.17	81,504.44	284,911.61
② 在建工程转入		124,165,369.14	124,165,369.14
本期减少金额	1,125.79	134,529.92	135,655.71
其中：处置或报废	1,125.79	134,529.92	135,655.71
期末数	981,723.53	220,620,670.21	221,602,393.74
累计折旧			
期初数	274,986.16	9,008,102.87	9,283,089.03
本期增加金额	279,855.27	14,786,812.43	15,066,667.70
其中：计提	279,855.27	14,786,812.43	15,066,667.70
本期减少金额	1,125.79	20,665.29	21,791.08
其中：处置或报废	1,125.79	20,665.29	21,791.08

期末数	553,715.64	23,774,250.01	24,327,965.65
减值准备			
账面价值			
期末账面价值	428,007.89	196,846,420.20	197,274,428.09
期初账面价值	504,455.99	87,500,223.68	88,004,679.67

(2) 融资租入固定资产

1) 2020年12月31日

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	138,558,650.26	6,226,550.83		132,332,099.43
小计	138,558,650.26	6,226,550.83		132,332,099.43

2) 2019年12月31日

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	127,901,581.00	9,652,971.30		118,248,609.70
小计	127,901,581.00	9,652,971.30		118,248,609.70

(3) 经营租出固定资产

项目	2021.12.31 账面价值	2020.12.31 账面价值	2019.12.31 账面价值
专用设备	40,165,343.95	10,380,220.88	1,834,818.96
小计	40,165,343.95	10,380,220.88	1,834,818.96

(4) 其他说明

截至2021年12月31日，公司已有账面价值296,659,718.87元的专用设备及17,814,346.59元的房屋建筑物用于银行借款及融资租赁抵押担保，详见本财务报表附注五(四)1之说明。

截至2020年12月31日，公司已有账面价值249,738,446.67元的专用设备用于融资租赁抵押担保，详见本财务报表附注五(四)1之说明。

截至2019年12月31日，公司已有账面价值44,819,329.08元的专用设备用于融资租赁抵押担保，详见本财务报表附注五(四)1之说明。

11. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	2021. 12. 31			2020. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
测试设备	79,163,116.39		79,163,116.39	78,861,262.31		78,861,262.31
厂务工程	29,097,175.04		29,097,175.04	14,778,683.31		14,778,683.31
软件使用权				43,419.77		43,419.77
其他	1,369,312.57		1,369,312.57	2,126,751.18		2,126,751.18
合 计	109,629,604.00		109,629,604.00	95,810,116.57		95,810,116.57

(续上表)

项 目	2019. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
测试设备	38,436,755.52		38,436,755.52
厂务工程	1,900,711.53		1,900,711.53
软件使用权	113,347.80		113,347.80
其他	2,096,052.15		2,096,052.15
合 计	42,546,867.00		42,546,867.00

(2) 重要在建工程项目报告期变动情况

1) 2021 年度

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少[注]	期末数
测试设备	78,861,262.31	502,499,713.89	379,934,066.14	122,263,793.67	79,163,116.39
上海厂务工程	3,608,431.32	2,612,476.79		6,154,888.69	66,019.42
无锡厂务工程	11,170,251.99	28,334,362.21		16,056,146.51	23,448,467.69
南京厂务工程		5,582,687.93			5,582,687.93
软件使用权	43,419.77	1,083,643.95		1,127,063.72	
其他	2,126,751.18	18,018,890.69	18,776,329.30		1,369,312.57
小 计	95,810,116.57	558,131,775.46	398,710,395.44	145,601,892.59	109,629,604.00

2) 2020 年度

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少[注]	期末数
测试设备	38,436,755.52	353,568,523.86	313,144,017.07		78,861,262.31



上海厂务工程	1,900,711.53	4,102,576.78		2,394,856.99	3,608,431.32
无锡厂务工程		19,168,737.58		7,998,485.59	11,170,251.99
软件使用权	113,347.80	336,084.67		406,012.70	43,419.77
其他	2,096,052.15	7,898,510.14	7,867,811.11		2,126,751.18
小计	42,546,867.00	385,074,433.03	321,011,828.18	10,799,355.28	95,810,116.57

3) 2019 年度

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少[注]	期末数
测试设备	29,590,693.97	129,619,363.81	120,773,302.26		38,436,755.52
上海厂务工程	1,300,920.00	1,554,041.12		954,249.59	1,900,711.53
软件使用权	558,620.04	78,834.82		524,107.06	113,347.80
其他	1,448,303.71	4,039,815.32	3,392,066.88		2,096,052.15
小计	32,898,537.72	135,292,055.07	124,165,369.14	1,478,356.65	42,546,867.00

[注]其他减少主要系厂务工程转入长期待摊费用、软件使用权转入无形资产以及测试设备转入使用权资产中核算

(3) 其他说明

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已有账面价值 18,094,671.04 元的在建工程用于融资租赁抵押担保，详见本财务报表附注五(四)1 之说明。

12. 使用权资产

(1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	专用设备	合计
成本			
期初数	15,455,207.37	138,558,650.26	154,013,857.63
本期增加金额	44,424,818.22	122,263,793.67	166,688,611.89
其中：经营租入	44,424,818.22		44,424,818.22
融资租赁		122,263,793.67	122,263,793.67
本期减少金额	10,498,328.34		10,498,328.34
其中：租赁终止	10,498,328.34		10,498,328.34
期末数	49,381,697.25	260,822,443.93	310,204,141.18

累计折旧			
期初数	2,255,515.89	6,226,550.83	8,482,066.72
本期增加金额	5,967,904.47	20,080,543.11	26,048,447.58
其中：计提	5,967,904.47	20,080,543.11	26,048,447.58
本期减少金额	1,578,851.28		1,578,851.28
其中：租赁终止	1,578,851.28		1,578,851.28
期末数	6,644,569.08	26,307,093.94	32,951,663.02
减值准备			
账面价值			
期末账面价值	42,737,128.17	234,515,349.99	277,252,478.16
期初账面价值[注]	13,199,691.48	132,332,099.43	145,531,790.91

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注十四(四)之说明

(2) 其他说明

截至2021年12月31日，公司已有账面价值162,691,754.51元的专用设备用于融资租赁抵押担保，详见本财务报表附注五(四)1之说明。

13. 无形资产

(1) 明细情况

1) 2021年度

项 目	软件使用权	土地使用权	合计
账面原值			
期初数	2,418,501.10		2,418,501.10
本期增加金额	1,127,063.72	7,959,594.11	9,086,657.83
① 购置		7,959,594.11	7,959,594.11
② 在建工程转入	1,127,063.72		1,127,063.72
本期减少金额			
期末数	3,545,564.82	7,959,594.11	11,505,158.93
累计摊销			

期初数	708,318.90		708,318.90
本期增加金额	641,334.95	103,640.54	744,975.49
其中：计提	641,334.95	103,640.54	744,975.49
本期减少金额			
期末数	1,349,653.85	103,640.54	1,453,294.39
减值准备			
账面价值			
期末账面价值	2,195,910.97	7,855,953.57	10,051,864.54
期初账面价值	1,710,182.20		1,710,182.20

2) 2020 年度

项 目	软件使用权	合计
账面原值		
期初数	1,970,739.36	1,970,739.36
本期增加金额	447,761.74	447,761.74
① 购置	41,749.04	41,749.04
② 在建工程转入	406,012.70	406,012.70
本期减少金额		
期末数	2,418,501.10	2,418,501.10
累计摊销		
期初数	255,780.53	255,780.53
本期增加金额	452,538.37	452,538.37
其中：计提	452,538.37	452,538.37
本期减少金额		
期末数	708,318.90	708,318.90
减值准备		
账面价值		
期末账面价值	1,710,182.20	1,710,182.20
期初账面价值	1,714,958.83	1,714,958.83

3) 2019 年度

项 目	软件使用权	合计
账面原值		
期初数	643,965.57	643,965.57
本期增加金额	1,326,773.79	1,326,773.79
① 购置	802,666.73	802,666.73
② 在建工程转入	524,107.06	524,107.06
本期减少金额		
期末数	1,970,739.36	1,970,739.36
累计摊销		
期初数	29,798.85	29,798.85
本期增加金额	225,981.68	225,981.68
其中：计提	225,981.68	225,981.68
本期减少金额		
期末数	255,780.53	255,780.53
减值准备		
账面价值		
期末账面价值	1,714,958.83	1,714,958.83
期初账面价值	614,166.72	614,166.72

(2) 其他说明

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已有账面价值 7,855,953.57 元的土地使用权用于银行借款抵押担保，详见本财务报表附注五(四)1 之说明。

14. 长期待摊费用

(1) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
企业邮箱服务费	12,484.86		9,116.13	3,368.73
专利使用费	1,697,135.47		318,212.92	1,378,922.55
厂房配套工程	14,546,684.35	22,211,035.20	2,761,527.29	33,996,192.26
消防工程	1,846,215.45		201,243.56	1,644,971.89

电力设施费用		1,104,424.78	36,814.14	1,067,610.64
合 计	18,102,520.13	23,315,459.98	3,326,914.04	38,091,066.07

(2) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
SYMC 租赁费	5,299.22		5,299.22	
企业邮箱服务费	16,650.48	3,795.38	7,961.00	12,484.86
专利使用费	2,015,348.35		318,212.88	1,697,135.47
厂房配套工程	6,656,365.67	8,494,536.98	604,218.30	14,546,684.35
消防工程		1,898,805.60	52,590.15	1,846,215.45
合 计	8,693,663.72	10,397,137.96	988,281.55	18,102,520.13

(3) 2019 年度

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
SYMC 租赁费	13,247.91		7,948.69	5,299.22
企业邮箱服务费	16,990.29	5,266.99	5,606.80	16,650.48
专利使用费	1,197,445.01	1,097,385.00	279,481.66	2,015,348.35
厂房配套工程	6,036,517.12	954,249.59	334,401.04	6,656,365.67
合 计	7,264,200.33	2,056,901.58	627,438.19	8,693,663.72

15. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2021.12.31		2020.12.31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,878,776.50	1,163,537.96	3,388,555.98	427,076.08
未弥补亏损	439,093.09	109,773.27		
合 计	7,317,869.59	1,273,311.23	3,388,555.98	427,076.08

(续上表)

项 目	2019.12.31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	1,658,353.95	207,294.24
合 计	1,658,353.95	207,294.24

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
可抵扣暂时性差异	2,553,707.87	829,463.38	1,040,994.99
可抵扣亏损		890,281.35	
小 计	2,553,707.87	1,719,744.73	1,040,994.99

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31	备注
2025年		890,281.35		
小 计		890,281.35		

16. 其他非流动资产

项 目	2021.12.31			2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备工程款	29,580,128.02		29,580,128.02			
合 计	29,580,128.02		29,580,128.02			

(续上表)

项 目	2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备工程款	1,159,904.66		1,159,904.66
合 计	1,159,904.66		1,159,904.66

17. 短期借款

项 目	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
保证借款	58,868,520.54	30,834,986.30	14,599,070.78
保证及抵押借款		9,510,020.55	2,517,081.17
信用借款	44,039,328.77		
合 计	102,907,849.31	40,345,006.85	17,116,151.95

18. 应付账款

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
设备采购款	73,485,554.24	78,396,112.38	15,529,680.57
材料款	12,948,311.11	8,117,535.79	2,332,706.51
设备租赁款	1,818,622.00	4,498,505.20	
安装工程	40,013.00	4,400.00	16,800.00
其他	380,218.23	516,496.00	292,575.39
合 计	88,672,718.58	91,533,049.37	18,171,762.47

19. 预收款项

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
预收货款			40,419.80
合 计			40,419.80

20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

1) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	8,616,070.50	122,707,116.67	107,860,347.50	23,462,839.67
离职后福利—设定提存计划	1,415,320.01	8,719,521.53	9,433,632.24	701,209.30
合 计	10,031,390.51	131,426,638.20	117,293,979.74	24,164,048.97

2) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	3,256,563.55	42,080,253.34	36,720,746.39	8,616,070.50
离职后福利—设定提存计划	226,321.31	1,334,763.00	145,764.30	1,415,320.01
合 计	3,482,884.86	43,415,016.34	36,866,510.69	10,031,390.51

3) 2019 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,546,624.73	22,302,071.97	20,592,133.15	3,256,563.55

离职后福利—设定提存计划	162,323.45	2,123,625.68	2,059,627.82	226,321.31
合 计	1,708,948.18	24,425,697.65	22,651,760.97	3,482,884.86

(2) 短期薪酬明细情况

1) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	7,661,443.33	103,130,465.14	88,018,895.13	22,773,013.34
职工福利费		11,148,619.54	11,148,619.54	
社会保险费	835,370.17	5,334,161.67	5,694,021.51	475,510.33
其中：医疗保险费	757,460.04	5,079,241.17	5,433,085.45	403,615.76
工伤保险费	50,438.54	123,868.53	130,583.43	43,723.64
生育保险费	27,471.59	131,051.97	130,352.63	28,170.93
住房公积金	119,257.00	3,093,870.32	2,998,811.32	214,316.00
小 计	8,616,070.50	122,707,116.67	107,860,347.50	23,462,839.67

2) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,073,504.73	34,625,888.42	30,037,949.82	7,661,443.33
职工福利费		5,132,835.59	5,132,835.59	
社会保险费	117,007.82	1,052,056.33	333,693.98	835,370.17
其中：医疗保险费	91,872.32	976,765.86	311,178.14	757,460.04
工伤保险费	15,467.99	47,343.97	12,373.42	50,438.54
生育保险费	9,667.51	27,946.50	10,142.42	27,471.59
住房公积金	66,051.00	1,269,473.00	1,216,267.00	119,257.00
小 计	3,256,563.55	42,080,253.34	36,720,746.39	8,616,070.50

3) 2019 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,371,466.40	18,125,188.35	16,423,150.02	3,073,504.73
职工福利费		2,399,377.10	2,399,377.10	
社会保险费	129,823.33	1,130,465.52	1,143,281.03	117,007.82
其中：医疗保险费	112,941.69	876,547.98	897,617.35	91,872.32



工伤保险费	10,388.70	156,256.95	151,177.66	15,467.99
生育保险费	6,492.94	97,660.59	94,486.02	9,667.51
住房公积金	45,335.00	647,041.00	626,325.00	66,051.00
小 计	1,546,624.73	22,302,071.97	20,592,133.15	3,256,563.55

(3) 设定提存计划明细情况

1) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	1,297,041.44	8,455,293.61	9,147,764.60	604,570.45
失业保险费	118,278.57	264,227.92	285,867.64	96,638.85
小 计	1,415,320.01	8,719,521.53	9,433,632.24	701,209.30

2) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	177,983.84	1,240,129.50	121,071.90	1,297,041.44
失业保险费	48,337.47	94,633.50	24,692.40	118,278.57
小 计	226,321.31	1,334,763.00	145,764.30	1,415,320.01

3) 2019 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	129,858.76	1,635,322.72	1,587,197.64	177,983.84
失业保险费	32,464.69	488,302.96	472,430.18	48,337.47
小 计	162,323.45	2,123,625.68	2,059,627.82	226,321.31

21. 应交税费

项 目	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
企业所得税	13,882,861.43	2,535,298.25	762,199.06
代扣代缴个人所得税	215,225.45	60,861.59	33,819.00
印花税	119,008.33	107,049.88	14,517.50
房产税	55,987.66		
土地使用税	13,642.20		
合 计	14,286,725.07	2,703,209.72	810,535.56

22. 其他应付款

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
拆借款及利息		206, 215. 07	
费用款	4, 610, 115. 79	2, 242, 477. 57	2, 136, 747. 08
合 计	4, 610, 115. 79	2, 448, 692. 64	2, 136, 747. 08

23. 一年内到期的非流动负债

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
一年内到期的长期借款	56, 070, 206. 27	3, 474, 909. 44	
一年内到期的长期应付款		54, 981, 685. 60	42, 738, 318. 65
一年内到期的租赁负债	104, 549, 316. 69		
合 计	160, 619, 522. 96	58, 456, 595. 04	42, 738, 318. 65

24. 长期借款

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
保证及抵押借款	166, 670, 450. 52	6, 969, 197. 23	
合 计	166, 670, 450. 52	6, 969, 197. 23	

25. 租赁负债

项 目	2021. 12. 31
尚未支付的租赁付款额	97, 157, 947. 94
减：未确认融资费用	6, 669, 514. 66
合 计	90, 488, 433. 28

26. 长期应付款

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
融资租赁款		72, 177, 041. 80	47, 146, 667. 39
合 计		72, 177, 041. 80	47, 146, 667. 39

27. 递延收益

(1) 明细情况

1) 2021 年度

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	4,463,333.25	14,200,000.00	686,296.38	17,977,036.87	
合计	4,463,333.25	14,200,000.00	686,296.38	17,977,036.87	

2) 2020 年度

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	5,578,333.33	255,000.00	1,370,000.08	4,463,333.25	
合计	5,578,333.33	255,000.00	1,370,000.08	4,463,333.25	

3) 2019 年度

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	595,000.00	5,200,000.00	216,666.67	5,578,333.33	
合计	595,000.00	5,200,000.00	216,666.67	5,578,333.33	

(2) 政府补助明细情况

1) 2021 年度

项目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损 益[注]	期末数	与资产相关/ 与收益相关
超大规模集成电路 芯片集成测试平台 技术改造	4,463,333.25	5,200,000.00	520,000.08	9,143,333.17	与资产相关
关键核心芯片晶圆 级系统级全生态测 试能力提升改造		4,000,000.00	120,000.00	3,880,000.00	与资产相关
固定资产投入补贴		5,000,000.00	46,296.30	4,953,703.70	与资产相关
小计	4,463,333.25	14,200,000.00	686,296.38	17,977,036.87	

2) 2020 年度

项目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损 益[注]	期末数	与资产相关/与收 益相关
基于集成电路测 试大数据的自动 测试平台	595,000.00	255,000.00	850,000.00		与收益相关

超大规模集成电路芯片集成测试平台技术改造	4,983,333.33		520,000.08	4,463,333.25	与资产相关
小 计	5,578,333.33	255,000.00	1,370,000.08	4,463,333.25	

3) 2019 年度

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损益 [注]	期末数	与资产相关/与收 益相关
基于集成电路测试大数据的自动测试平台	595,000.00			595,000.00	与收益相关
超大规模集成电路芯片集成测试平台技术改造		5,200,000.00	216,666.67	4,983,333.33	与资产相关
小 计	595,000.00	5,200,000.00	216,666.67	5,578,333.33	

[注]政府补助计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

28. 股本

(1) 明细情况

股东类别	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
上海蕊测半导体科技有限公司	27,032,838.00	27,032,838.00	19,950,671.00
江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)[注]	5,304,716.00	5,304,716.00	3,914,966.00
深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)	5,327,516.00	4,918,716.00	3,261,084.00
苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业(有限合伙)	4,684,516.00	4,684,516.00	3,292,618.00
苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)	4,604,867.00	3,378,467.00	
南京金浦新潮创业投资合伙企业(有限合伙)	3,086,086.00	3,086,086.00	2,070,529.00
上海芯伟半导体合伙企业(有限合伙)	2,247,669.00	2,247,669.00	1,621,915.00
江苏新潮科技集团有限公司	2,240,713.00	2,240,713.00	1,503,348.00
涂洁	1,680,867.00	1,578,667.00	
远海明晟(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙)	1,560,000.00	1,560,000.00	
苏州市德同心创业投资合伙企业(有限合伙)	1,400,000.00	1,400,000.00	
中小企业发展基金(深圳南山有限合伙)	3,035,200.00	1,400,000.00	
顾成标	1,636,800.00	1,228,000.00	

广西泰达新原股权投资有限公司	836,600.00	530,000.00	
无锡先锋智造投资合伙企业（有限合伙）	449,612.00	449,612.00	301,655.00
克拉玛依云泽裕庆股权投资有限合伙企业	280,000.00	280,000.00	
合 计	65,408,000.00	61,320,000.00	35,916,786.00

[注]苏州韋泉致芯股权投资合伙企业（有限合伙）于2020年2月3日更名为江苏韋泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）

## (2) 其他说明

根据2019年1月17日股东会决议和章程修正案，经全体股东一致同意，股东长兴君桐投资管理合伙企业(有限合伙)将其持有公司股权2,936,225.00元转让给股东苏州韋泉致芯股权投资合伙企业(有限合伙)。同时公司增加实收资本2,432,872.00元，由深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)以货币出资30,000,000.00元，其中2,432,872元计入实收资本，27,567,128.00元计入资本公积。本次变更业经北京永坤会计师事务所(普通合伙)审验，并由其于2021年2月5日出具《验资报告》（永坤验字〔2021〕第J-18304号）。2019年4月29日，已在上海市浦东新区市场监督管理局办理变更登记。

根据2019年5月17日股东会决议和章程修正案，经全体股东一致同意，原股东长兴君桐投资管理合伙企业(有限合伙)将其持有公司股权1,503,348.00元转让给股东江苏新潮科技集团有限公司，2019年7月1日，已在上海市浦东新区市场监督管理局办理变更登记。

根据2019年7月19日股东会决议和章程修正案，公司增加实收资本5,100,404.00元，由苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业(有限合伙)、无锡先锋智造投资合伙企业(有限合伙)、深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)、江苏新潮科技集团有限公司及上海芯伟半导体合伙企业(有限合伙)以货币出资70,400,000.00元，其中5,100,404.00元计入实收资本，65,299,596.00元计入资本公积。本次变更业经北京永坤会计师事务所(普通合伙)审验，并由其于2021年2月27日出具《验资报告》（永坤验字〔2021〕第J-18519号）。2019年10月30日，已在上海市浦东新区市场监督管理局办公变更登记。

根据2019年11月19日股东会决议和章程修正案，经全体股东一致同意，股东江苏新潮科技集团有限公司将其持有公司股权2,070,529.00元转让给股东南京金浦新潮创业投资合伙企业(有限合伙)，2019年12月27日，已在上海市浦东新区市场监督管理局办理变更登记。

根据2019年12月15日股东会决议和章程修正案，公司增加实收资本984,022.00元，

---

由涂洁以货币出资 20,000,000.00 元，其中 984,022.00 元计入实收资本，19,015,978.00 元计入资本公积，公司于 2020 年 3 月 20 日收到此次增资款 20,000,000.00 元。本次变更业经北京永坤会计师事务所(普通合伙)审验，并由其于 2021 年 3 月 13 日出具《验资报告》(永坤验字(2021)第 J-18882 号)。2020 年 4 月 20 日，已在上海市浦东新区市场监督管理局办理变更登记。

根据公司 2020 年 7 月 15 日股东会决议和章程修正案，由上海伟测半导体科技有限公司全体出资者以其拥有的截至 2020 年 4 月 30 日止经审计的净资产 225,722,993.10 元整体变更为股份有限公司，其中折合股本人民币 50,000,000.00 元，资本公积 175,722,993.10 元。本次变更业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2020 年 9 月 7 日出具《验资报告》(天健验(2020)6-66 号)，2020 年 9 月 4 日，已在上海市工商行政管理局办理变更登记。

根据公司 2020 年度第二次临时股东大会决议和章程修正案，公司向苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业(有限合伙)、无锡先锋智造投资合伙企业(有限合伙)、深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)、江苏新潮科技集团有限公司、上海芯伟半导体合伙企业(有限合伙)、南京金浦新潮创业投资合伙企业(有限合伙)、涂洁、远海明晟(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙)、广西泰达新原股权投资有限公司、苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)合计增发 550 万股，发行价格 20 元/股，共计募集资金 110,000,058.29 元，其中苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)以债转股的形式出资 50,000,000.00 元，此次增资 5,500,000.00 元计入股本，104,500,058.29 元计入资本公积。本次增资业经上海鳌浩会计师事务所审验，并由其于 2020 年 9 月 30 日出具《验资报告》(沪鳌验字(2020)第 041 号)，2020 年 10 月 12 日，已在上海市工商行政管理局办理变更登记。

根据公司 2020 年度第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司向顾成标增发 50 万股，发行价格 20 元/股，共计募集资金 10,000,000.00 元，其中 500,000.00 元计入股本，9,500,000.00 元计入资本公积。本次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2020 年 10 月 20 日出具《验资报告》(天健验(2020)6-80 号)，2020 年 11 月 3 日，已在上海市工商行政管理局办理变更登记。

根据公司 2020 年度第四次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司向涂洁、顾成标、克拉玛依云泽裕庆股权投资有限合伙企业、远海明晟(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙)、中小企业发展基金(深圳南山有限合伙)、苏州市德同合心创业投资合伙企业(有限合伙)、广

西泰达新原股权投资有限公司、苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）合计增发 532 万股，发行价格 35.71 元/股，共计募集资金 190,000,000.00 元，其中 5,320,000.00 元计入股本，184,680,000.00 元计入资本公积。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 11 月 28 日出具《验资报告》（天健验（2020）6-108 号），2020 年 12 月 15 日，已在上海市工商行政管理局办理变更登记。

根据公司 2021 年 5 月 28 日第一次临时股东大会决议和修改后章程规定，公司向涂洁、顾成标、深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）、广西泰达新原股权投资有限公司、苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）合计增发 408.80 万股，发行价格 48.92 元/股，共计募集资金 200,000,000.00 元，其中 4,088,000.00 元计入股本，195,912,000.00 元计入资本公积。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2021 年 6 月 18 日出具《验资报告》（天健验（2021）6-62 号），2021 年 6 月 17 日，已在上海市工商行政管理局办理变更登记。

## 29. 资本公积

### (1) 明细情况

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
资本溢价	670,315,051.39	474,403,051.39	141,983,214.00
其他资本公积—股东捐赠	125,822.43	125,822.43	3,569,193.81
其他资本公积—股份支付	2,155,804.20	2,155,804.20	1,527,765.26
合 计	672,596,678.02	476,684,678.02	147,080,173.07

### (2) 其他说明

报告期内，资本公积-资本溢价增加系增资产生的股本溢价，详见本财务报表附注五（一）28 之说明。

其他资本公积-股东捐赠增加，主要系大股东上海蕊测半导体科技有限公司对公司的捐赠。员工股权激励形成的股份支付，相应增加资本公积，详见本财务报表附注十一之说明。

## 30. 盈余公积

### (1) 明细情况

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
法定盈余公积	11,948,535.88	2,951,932.62	1,799,173.51
合 计	11,948,535.88	2,951,932.62	1,799,173.51

(2) 其他说明

报告期内增加均系根据公司章程按照母公司净利润的 10%计提法定盈余公积，减少系公司整体变更为股份有限公司净资产折股所致。

31. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
调整前上期末未分配利润	26,052,061.95	15,084,590.42	4,934,561.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-228,263.68		
调整后期初未分配利润	25,823,798.27	15,084,590.42	4,934,561.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	132,175,641.77	34,846,264.67	11,277,809.60
减：提取法定盈余公积	8,996,603.26	2,951,932.62	1,127,780.96
净资产折股转出		20,926,860.52	
期末未分配利润	149,002,836.78	26,052,061.95	15,084,590.42

(2) 调整期初未分配利润明细

2021 年度，由于公司执行新租赁准则进行追溯调整，影响期初未分配利润-228,263.68 元，详见本财务报表附注十四(四)之说明。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	2021 年度		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	472,106,467.91	230,551,582.82	152,321,807.20	73,493,551.32
其他业务	21,037,789.18	13,753,265.95	8,874,413.58	6,169,950.38
合 计	493,144,257.09	244,304,848.77	161,196,220.78	79,663,501.70
其中：与客户之间的合	488,204,415.80	242,980,815.67	159,582,771.22	78,621,710.87



同产生的收入			
(续上表)			
项 目	2019 年度		
	收入	成本	
主营业务	75,008,616.47	35,820,424.13	
其他业务	2,924,618.82	1,875,040.16	
合 计	77,933,235.29	37,695,464.29	

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

1) 2021 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 A	78,961,097.20	16.01
晶晨半导体(上海)股份有限公司	69,648,533.56	14.12
上海安路信息科技股份有限公司	30,364,609.34	6.16
北京兆易创新科技股份有限公司[注 1]	23,727,950.03	4.81
深圳市中兴微电子技术有限公司[注 2]	20,303,848.03	4.12
小 计	223,006,038.16	45.22

2) 2020 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
普冉半导体(上海)股份有限公司	17,977,381.34	11.15
晶晨半导体(上海)股份有限公司	11,785,396.43	7.31
Bitmain Technologies Limited[注 3]	11,561,809.56	7.17
深圳市中兴微电子技术有限公司	10,727,201.19	6.65
江苏长电科技股份有限公司[注 4]	8,832,588.68	5.48
小 计	60,884,377.20	37.76

3) 2019 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
江苏长电科技股份有限公司[注 4]	13,710,133.61	17.59
普冉半导体(上海)有限公司	9,969,172.49	12.79
上海复旦微电子集团股份有限公司	3,870,589.60	4.97

上海安路信息科技有限公司	3,147,748.13	4.04
甬矽电子（宁波）股份有限公司	2,398,653.64	3.08
小 计	33,096,297.47	42.47

[注 1] 实际为北京兆易创新科技股份有限公司、合肥格易集成电路有限公司、上海思立微电子科技有限公司及 GIGADEVICE SEMICONDUCTOR (HK) LTD 合并披露，系关联公司

[注 2] 实际为深圳市中兴微电子技术有限公司及其子公司西安克瑞斯半导体技术有限公司合并披露，系关联公司

[注 3] 实际为 Bitmain Technologies Limited、Bitmaintech Pte.Ltd 合并披露，系关联公司

[注 4] 实际为江苏长电科技股份有限公司、江阴长电先进封装有限公司以及星科金朋半导体(江阴)有限公司合并披露，系关联公司

(3) 收入按主要类别的分解信息

1) 收入按商品或服务类型分解

收入按商品或服务类型分解详见本财务报表附注十四(一)之说明。

2) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	2021 年度	2020 年度
在某一时点确认收入	488,204,415.80	159,582,771.22
在某一时段确认收入	4,939,841.29	1,613,449.56
小 计	493,144,257.09	161,196,220.78

2. 税金及附加

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
印花税	653,018.55	288,748.78	76,680.52
房产税	91,535.39		
土地使用税	22,737.00		
教育费附加	29.51		
地方教育附加	19.67		
城市维护建设税	9.84		
合 计	767,349.96	288,748.78	76,680.52

### 3. 销售费用

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	6,449,624.58	2,379,035.87	1,458,294.14
销售运费	2,595,038.99	2,252,718.76	704,332.30
业务开拓费	1,101,689.87	732,695.54	365,459.59
业务招待费	769,064.42	48,309.82	62,579.60
差旅交通费	138,784.87	53,115.10	93,964.49
其他	99,615.37	23,943.14	162,473.95
合 计	11,153,818.10	5,489,818.23	2,847,104.07

### 4. 管理费用

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	9,316,406.88	4,098,446.79	2,211,895.89
折旧摊销	3,304,343.55	276,988.18	105,307.12
中介服务费	2,566,583.19	2,966,517.85	1,614,540.07
维修费	1,451,611.54	605,087.87	675,007.02
办公费	1,302,818.85	586,340.71	357,875.18
房租水电费	1,269,094.11	1,378,932.40	355,845.35
业务招待费	1,233,076.32	354,403.07	20,921.00
差旅交通费	536,455.92	143,297.55	147,329.08
保险费	221,018.33	440,177.65	66,990.59
股份支付		2,155,804.20	1,527,765.26
其他	592,722.38	151,532.07	129,198.45
合 计	21,794,131.07	13,157,528.34	7,212,675.01

### 5. 研发费用

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	36,197,982.62	15,120,302.47	10,264,773.97

折旧与摊销	5,967,044.13	3,124,247.82	1,730,523.99
机物料消耗费	2,562,103.50	1,704,500.52	461,407.34
技术服务费	1,253,919.46		
能源费	1,253,282.85	585,951.05	431,853.00
专利使用权	318,212.85	318,212.88	283,696.51
其他	190,288.60	160,748.35	199,407.96
合 计	47,742,834.01	21,013,963.09	13,371,662.77

#### 6. 财务费用

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
利息支出	18,174,951.38	7,836,069.62	6,150,247.54
汇兑损益	-1,761,654.32	-2,001,146.51	-344,218.18
票据贴现支出	611,625.00		
手续费	174,867.94	964,452.98	51,792.35
减：利息收入	2,037,553.26	95,284.40	38,786.81
贷款担保费		129,997.58	93,163.72
合 计	15,162,236.74	6,834,089.27	5,912,198.62

#### 7. 其他收益

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
与资产相关的政府补助[注]	686,296.38	520,000.08	216,666.67
与收益相关的政府补助[注]	4,262,529.34	4,145,773.73	1,899,389.45
代扣个人所得税手续费返还	10,847.02	9,907.21	
合 计	4,959,672.74	4,675,681.02	2,116,056.12

[注]计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

#### 8. 投资收益

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
交易性金融资产在持有期间	237,750.80	39,057.54	

的投资收益			
票据贴现利息	-3,354.88		
合计	234,395.92	39,057.54	

9. 信用减值损失

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
坏账损失	-5,214,465.01	-1,518,670.42	-1,089,922.20
合计	-5,214,465.01	-1,518,670.42	-1,089,922.20

10. 资产处置收益

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
长期资产处置收益	195,683.15		-36,898.60
合计	195,683.15		-36,898.60

11. 营业外收入

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
政府补助[注]			300,000.00
非流动资产毁损报废损失	160.26		
其他			18,495.58
合计	160.26		318,495.58

[注]计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

12. 营业外支出

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
其他	13,705.72		25,084.00
合计	13,705.72		25,084.00

13. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
当期所得税费用	21,051,373.16	3,318,156.68	912,483.09
递延所得税费用	-846,235.15	-219,781.84	-90,195.78
合 计	20,205,138.01	3,098,374.84	822,287.31

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
利润总额	152,380,779.78	37,944,639.51	12,100,096.91
按母公司适用税率计算的所得税费用	19,047,597.46	4,743,079.94	1,512,512.11
子公司适用不同税率的影响	6,578,816.61	-3,506.59	
调整以前期间所得税的影响		198,781.81	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	251,827.72	35,565.65	517,324.09
研发加计扣除影响	-5,630,501.49	-1,874,491.58	-1,253,593.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-222,570.34		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	319,007.09	-1,054.39	46,044.50
本期税率变动导致递延所得税负债/递延所得税资产计提差异的影响	-139,039.04		
所得税费用	20,205,138.01	3,098,374.84	822,287.31

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
利息收入	2,037,553.26	95,284.40	38,786.81
政府补助	18,462,529.34	3,550,773.73	7,399,389.45
其他往来净额		1,548,582.06	429,389.51
其他	10,847.02	9,907.21	18,495.58
合 计	20,510,929.62	5,204,547.40	7,886,061.35

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
-----	---------	---------	---------

付现的期间费用	18,343,830.79	13,676,911.74	4,341,487.13
支付履约保证金	6,400,000.00		
其他往来净额	997,697.49		
银行手续费	174,867.94	61,252.98	51,792.35
其他	13,705.72		25,084.00
合 计	25,930,101.94	13,738,164.72	4,418,363.48

### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
收回其他拆借款		450,000.00	1,763,500.00
合 计		450,000.00	1,763,500.00

### 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
支付其他拆借款			1,780,000.00
合 计			1,780,000.00

### 5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
收到其他拆借款	92,906,067.35	70,000,000.00	3,748,269.00
商业承兑汇票贴现	14,000,000.00		
合 计	106,906,067.35	70,000,000.00	3,748,269.00

### 6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
支付租赁相关款项	120,086,513.62	191,581,215.60	66,925,177.00
IPO 上市相关中介服务 费	1,327,358.49		
票据贴现	611,625.00		

偿还其他拆借款本金或利息	206,215.07	21,134,197.49	12,827,669.00
支付贷款担保费		129,997.58	93,163.72
合计	122,231,712.18	212,845,410.67	79,846,009.72

## 7. 现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2021 年度	2020 年度
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	132,175,641.77	34,846,264.67
加: 资产减值准备	5,214,465.01	1,518,670.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,688,244.06	31,683,605.04
使用权资产折旧	26,048,447.58	
无形资产摊销	744,975.49	452,538.37
长期待摊费用摊销	3,326,914.04	988,281.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-195,683.15	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-160.26	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	16,985,342.19	6,498,158.82
投资损失(收益以“-”号填列)	-234,395.92	-39,057.54
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-846,235.15	-219,781.84
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,712,750.07	-2,093,889.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-85,098,163.93	-35,946,630.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	97,224,585.44	35,477,762.69
其他		2,281,626.63
经营活动产生的现金流量净额	252,321,227.10	75,447,549.33
2) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	143,297,852.53	93,426,732.97



减：现金的期初余额	93,426,732.97	23,480,227.00
现金及现金等价物净增加额	49,871,119.56	69,946,505.97

(续上表)

补充资料	2019 年度	
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,277,809.60	
加：资产减值准备	1,089,922.20	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,066,667.70	
无形资产摊销	225,981.68	
长期待摊费用摊销	627,438.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)	36,898.60	
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	5,930,006.32	
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-90,195.78	
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-638,256.05	
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-15,012,863.27	
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	15,430,102.65	
其他	5,096,959.07	
经营活动产生的现金流量净额	39,040,470.91	
2) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	23,480,227.00	
减：现金的期初余额	920,560.99	
现金及现金等价物净增加额	22,559,666.01	

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2021.12.31	2020.12.31
-----	------------	------------

1) 现金	143,297,852.53	93,426,732.97
其中：库存现金	209.18	209.18
可随时用于支付的银行存款	143,297,096.44	93,424,304.08
可随时用于支付的其他货币资金	546.91	2,219.71
2) 期末现金及现金等价物余额	143,297,852.53	93,426,732.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(续上表)

项 目	2019.12.31	
1) 现金	23,480,227.00	
其中：库存现金	313.68	
可随时用于支付的银行存款	23,470,109.92	
可随时用于支付的其他货币资金	9,803.40	
2) 期末现金及现金等价物余额	23,480,227.00	
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(3) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

现金流量表中现金期末数为 143,297,852.53 元，资产负债表中货币资金期末数为 149,697,852.53 元，差额 6,400,000.00 元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的履约保证金 6,400,000.00 元。

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 2021 年 12 月 31 日

项 目	账面价值	受限原因
其他货币资金	6,400,000.00	开具保函保证金
应收票据	4,030,000.00	票据已背书未终止确认
固定资产	314,474,065.46	用于银行借款及融资租赁抵押担保
使用权资产	162,691,754.51	用于融资租赁抵押担保

无形资产	7,855,953.57	用于银行借款
合 计	495,451,773.54	

(2) 2020年12月31日

项 目	账面价值	受限原因
应收票据	1,789,459.00	票据已背书未终止确认
固定资产	249,738,446.67	用于融资租赁抵押担保
合 计	251,527,905.67	

(3) 2019年12月31日

项 目	账面价值	受限原因
应收票据	630,000.00	票据已背书未终止确认
固定资产	44,819,329.08	用于融资租赁抵押担保
在建工程	18,094,671.04	用于融资租赁抵押担保
合 计	63,544,000.12	

## 2. 外币货币性项目

(1) 2021年12月31日

项 目	外币余额	折算汇率	折算成人民币余额
货币资金			739,740.09
其中：美元	116,024.92	6.3757	739,740.09
应收账款			8,813,258.47
其中：美元	1,382,320.13	6.3757	8,813,258.47
应付账款			57,219,373.16
其中：美元	8,974,602.50	6.3757	57,219,373.16
长期借款			19,053,464.75
其中：美元	2,988,450.64	6.3757	19,053,464.75
一年内到期的非流动负债			17,282,436.97
其中：美元	2,710,672.86	6.3757	17,282,436.97

(2) 2020年12月31日

项 目	外币余额	折算汇率	折算成人民币余额
-----	------	------	----------

货币资金			5,746,788.12
其中：美元	880,747.31	6.5249	5,746,788.12
应收账款			2,671,913.86
其中：美元	409,494.99	6.5249	2,671,913.86
长期借款			6,969,197.21
其中：美元	1,068,092.57	6.5249	6,969,197.21
一年内到期的非流动负债			3,474,909.42
其中：美元	532,561.33	6.5249	3,474,909.42

(3) 2019年12月31日

项 目	外币余额	折算汇率	折算成人民币余额
货币资金			521,061.94
其中：美元	74,691.37	6.9762	521,061.94
应收账款			2,260,887.85
其中：美元	324,085.87	6.9762	2,260,887.85

### 3. 政府补助

#### (1) 明细情况

##### 1) 2021年度

##### ① 与资产相关的政府补助、总额法

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
超大规模集成电路芯片集成测试平台技术改造	4,463,333.25	5,200,000.00	520,000.08	9,143,333.17	其他收益	上海市经济信息化委、市财政局关于印发《上海市技术改造专项支持实施细则》的通知（沪经信规范〔2018〕1号）
关键核心芯片晶圆级系统级全生态测试能力提升改造		4,000,000.00	120,000.00	3,880,000.00	其他收益	上海市经济信息化委、市财政局关于印发《上海市技术改造专项支持实施细则》的通知（沪经信规范〔2018〕1号）
固定资产投资补贴		5,000,000.00	46,296.30	4,953,703.70	其他收益	《无锡国家高新技术产业开发区管理委员会，关于进一步推动科技创新

						的实施意见》(锡高管发(2017)40号)
小计	4,463,333.25	14,200,000.00	686,296.38	17,977,036.87		

② 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
进口设备贴息	2,053,154.34	其他收益	财政部商务部关于印发《外经贸发展专项资金管理办法》的通知(财企(2014)36号)及《上海市商务委关于2020年进口贴息资金申报的通知》
小巨人项目补贴	600,000.00	其他收益	关于印发《上海市科技小巨人工程实施办法》的通知_规范性文件沪科规(2021)12号
科技发展基金	600,000.00	其他收益	《浦东新区科技发展基金重点企业研发机构补贴资金操作细则》
政策扶持补贴	568,500.00	其他收益	《无锡国家高新技术产业开发区管理委员会，关于进一步推动科技创新的实施意见》(锡高管发(2017)40号)
中小企业专项补贴	250,000.00	其他收益	《浦东新区科技发展基金重点企业研发机构补贴资金操作细则》
创新业务补贴	95,000.00	其他收益	《上海市经济信息化委市财政局关于开展2020年融资担保创新业务支持项目申报工作的通知》(沪经信企(2020)1051号)
担保补贴	40,375.00	其他收益	《关于延续〈浦东新区小微企业增信基金管理办法〉的通知》(浦财经(2019)18号)
稳岗补贴	27,700.00	其他收益	《关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划大力开展以工代训工作的通知》(锡人社发(2020)59号)及和《关于进一步支持企业开展以工代训工作的补充通知》(锡人社发(2020)75号)
岗前培训补贴	12,000.00	其他收益	《上海市人力资源和社会保障局上海市财政局关于进一步落实受疫情影响企业职工线上职业培训补贴政策有关事项的通知》(沪人社规(2021)4号)
专利资助款	7,500.00	其他收益	《上海市专利资助办法(沪知局规(2018)1号)》
就业补贴	3,000.00	其他收益	《省政府关于应对新型冠状病毒肺炎疫情影响推动经济循环畅通和稳定持续发展的若干政策措施》(苏政发(2020)15号)、《市委市政府关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关保障经济平稳运行的政策意见的通知》(锡委发(2020)20号)
毕业生补贴	2,000.00	其他收益	《无锡市人民政府关于促进高校毕业生来锡就业创业的若干措施的通知》(锡政发(2020)12号)
其他	3,300.00	其他收益	
小计	4,262,529.34		

2) 2020年度

① 与资产相关的政府补助、总额法

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
----	--------	--------	------	--------	----------	----

超大规模集成电路芯片集成测试平台技术改造	4,983,333.33		520,000.08	4,463,333.25	其他收益	上海市经济信息化委、市财政局关于印发《上海市技术改造专项支持实施细则》的通知（沪经信规范（2018）1号）
小计	4,983,333.33		520,000.08	4,463,333.25		

② 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
基于集成电路测试大数据的自动测试平台（信息化生产）	595,000.00	255,000.00	850,000.00		其他收益	《浦东新区智慧城市智慧城市建设专项资金管理办法》
小计	595,000.00	255,000.00	850,000.00			

③ 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
2020年第三批中小企业发展专项	900,000.00	其他收益	《上海市中小企业专项资金管理办法》（沪经信规范（2019）9号）
科技发展基金	800,000.00	其他收益	《浦东新区科技发展基金重点企业研发机构补贴资金操作细则》
进口设备贴息	817,991.62	其他收益	财政部商务部关于印发《外经贸发展专项资金管理办法》的通知（财企（2014）36号）及《上海市商务委关于2020年进口贴息资金申报的通知》
支持高成长科创小微企业	400,000.00	其他收益	《关于开展2020年度浦东新区促进小微企业创新创业财政扶持项目申报工作的通知》
科技券	247,781.11	其他收益	《关于开展2020年度浦东新区科技发展基金科技创新券专项资金申报工作的通知》
稳岗补贴	60,530.00	其他收益	《关于做好本市稳就业工作有关事项的通知》（沪人社规（2019）34号）
履约保险保费补贴	52,371.00	其他收益	关于开展2020年度浦东新区科技发展基金科技型小微企业贷款贴息专项资金申报工作的通知
岗前培训	15,300.00	其他收益	中共无锡市委、无锡市人民政府印发《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关保障经济平稳运行的政策意见》的通知
培训补贴	1,800.00	其他收益	

小 计	3,295,773.73		
-----	--------------	--	--

3) 2019 年度

① 与资产相关的政府补助、总额法

项 目	期初 递延 收益	本期新增 补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
超大规模集成电路芯片集成测试平台技术改造		5,200,000.00	216,666.67	4,983,333.33	其他收益	上海市经济信息化委、市财政局关于印发《上海市技术改造专项支持实施细则》的通知（沪经信规范（2018）1号）
小 计		5,200,000.00	216,666.67	4,983,333.33		

② 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
基于集成电路测试大数据的自动测试平台（信息化生产）	595,000.00			595,000.00		《浦东新区智慧城市建设专项资金管理办法》
小 计	595,000.00			595,000.00		

③ 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
支持小微企业创新能力补贴款	1,000,000.00	其他收益	《浦东新区促进小微企业创新创业财政扶持办法实施细则》
科技型中小企业技术创新基金	652,100.00	其他收益	《关于开展 2019 年度浦东新区促进小微企业创新创业财政扶持项目申报工作的通知》
第七届创新创业大赛三等奖	300,000.00	营业外收入	获得第七届中国创新创业大赛成长组优秀企业奖
进口设备贴息	211,692.45	其他收益	财政部商务部关于印发《外经贸发展专项资金管理办法》的通知（财企（2014）36号）及《上海市商务委关于 2019 年中央进口贴息资金申报的通知》
稳岗补贴	35,597.00	其他收益	《关于做好本市稳就业工作有关事项的通知》（沪人社规（2019）34号）
小 计	2,199,389.45		

(2) 计入当期损益的政府补助金额

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
计入当期损益的政府补助金额	4,948,825.72	4,665,773.81	2,416,056.12

## 六、合并范围的变更

### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
2021 年度				
南京伟测半导体科技有限公司	新设	2021/10/21	50,000,000.00	100.00%
2020 年度				
无锡伟测半导体科技有限公司	新设	2020/6/9	180,000,000.00	100.00%

### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润
2020 年度				
厦门伟测半导体科技有限公司	清算	2020/12/7		

## 七、在其他主体中的权益

### 重要子公司基本情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
南京伟测半导体科技有限公司	南京	南京	集成电路检测	100.00		设立
无锡伟测半导体科技有限公司	无锡	无锡	集成电路检测	100.00		设立
上海威矽半导体科技有限公司	上海	上海	半导体技术开发	100.00		设立

## 八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和



---

进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

###### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5及五(一)7之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的53.10%(2020年12月31日：52.34%；2019年12月31日：36.52%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

##### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	2021. 12. 31				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	325,648,506.10	353,786,986.48	161,795,304.82	113,203,120.62	78,788,561.04
应付账款	88,672,718.58	88,672,718.58	88,672,718.58		
其他应付款	4,610,115.79	4,610,115.79	4,610,115.79		
一年内到期的非流动负	104,549,316.69	113,202,001.87	113,202,001.87		

债					
租赁负债	90,488,433.28	97,157,947.94		97,157,947.94	
小 计	613,969,090.44	657,429,770.66	368,280,141.06	210,361,068.56	78,788,561.04

(续上表)

项 目	2020.12.31				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	50,789,113.52	52,196,382.82	44,963,963.32	7,232,419.50	
应付账款	91,533,049.37	91,533,049.37	91,533,049.37		
其他应付款	2,448,692.64	2,448,692.64	2,448,692.64		
一年内到期的非流动负债	54,981,685.60	65,540,979.05	65,540,979.05		
长期应付款	72,177,041.80	76,264,629.82		76,264,629.82	
小 计	271,929,582.93	287,983,733.70	204,486,684.38	83,497,049.32	

(续上表)

项 目	2019.12.31				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	17,116,151.95	17,669,329.15	17,669,329.15		
应付账款	18,171,762.47	18,171,762.47	18,171,762.47		
其他应付款	2,136,747.08	2,136,747.08	2,136,747.08		
一年内到期的非流动负债	42,738,318.65	47,195,032.94	47,195,032.94		
长期应付款	47,146,667.39	54,737,426.40		54,737,426.40	
小 计	127,309,647.54	139,910,298.04	85,172,871.64	54,737,426.40	

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本

公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币289,312,604.38元及5,699,123.50美元(2020年12月31日：人民币40,300,000.00元及1,597,684.00美元；2019年12月31日：人民币17,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币2,521,797.58元(2020年12月31日：减少/增加人民币849,544.47元；2019年12月31日：减少/增加人民币339,741.96元)，净利润减少/增加人民币2,521,797.58元(2020年度：减少/增加人民币849,544.47元；2019年度：减少/增加人民币339,741.96元)。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 九、公允价值的披露

以公允价值计量的资产和负债的公允价值明细情况

### 1. 2021年12月31日

项 目	公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产				
(1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
理财产品				
2. 应收款项融资			535,519.48	535,519.48

### 2. 2020年12月31日

项 目	公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产			29,990,000.00	29,990,000.00
(1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			29,990,000.00	29,990,000.00
理财产品			29,990,000.00	29,990,000.00
2. 应收款项融资			962,940.10	962,940.10

3. 2019年12月31日

项 目	公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产				
(1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
理财产品				
2. 应收款项融资			92,096.00	92,096.00

## 十、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
上海蕊测半导体科技有限公司	上海	半导体芯片开发	23,960,000.00	41.33	41.33

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

#### 3. 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
骈文胜	董事长、总经理
闻国涛	董事、副总经理
路峰	董事、副总经理
龚金新	原监事
乔从缓	监事

周歆瑶	监事
秦君梅	实控人骈文胜之配偶
闻国澜	董事闻国涛之弟
上海市浦东新区唐镇国澜餐饮店	董事闻国涛之弟闻国澜成立的个体工商户
普冉半导体（上海）股份有限公司	董事陈凯担任董事的公司
中微半导体（深圳）股份有限公司	董事陈凯担任董事的公司
上海承括电子科技有限公司	实控人骈文胜配偶秦君梅控制的公司
江苏长电科技股份有限公司	曾为公司持股 5%以上股东江苏新潮科技集团有限公司曾经控制的公司，根据实质重于形式的原则，将江苏长电科技股份有限公司认定为关联方
星科金朋半导体(江阴)有限公司	江苏长电科技股份有限公司子公司
江阴长电先进封装有限公司	江苏长电科技股份有限公司子公司
强一半导体（苏州）有限公司	董事祁耀亮担任董事的公司
上海季丰电子股份有限公司	董事祁耀亮担任董事的公司

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品的关联交易

关联方	关联交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
强一半导体（苏州）有限公司	探针卡及维修	1,921,617.24	77,005.30	41,009.73
上海季丰电子股份有限公司	测试备件及服务	539,738.32	136,100.00	51,002.65
上海市浦东新区唐镇国澜餐饮店	餐饮		707,565.00	1,014,950.00
上海承括电子科技有限公司	速干墨水			24,180.00
江苏长电科技股份有限公司[注]	测试设备	3,124,164.00		
小 计		5,585,519.56	920,670.30	1,131,142.38

[注]实际为江苏长电科技股份有限公司、江阴长电先进封装有限公司以及星科金朋半导体(江阴)有限公司合并披露，系关联公司，下同

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2021 年度	2020 年度
-----	--------	---------	---------

普冉半导体（上海）股份有限公司	检测服务及治具销售	16,240,233.51	17,977,381.34
中微半导体（深圳）股份有限公司	检测服务及治具销售	416,119.96	353,591.92
江苏长电科技股份有限公司[注]	检测服务	593,201.61	8,832,588.68
小 计		17,249,555.08	27,163,561.94

(续上表)

关联方	关联交易内容	2019 年度
普冉半导体（上海）股份有限公司	检测服务及治具销售	9,969,172.49
江苏长电科技股份有限公司[注]	检测服务	13,710,133.61
小 计		23,679,306.10

## 2. 关联租赁情况

### (1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	2021 年度确认的 租赁收入	2020 年度确认的 租赁收入	2019 年度确认的 租赁收入
江苏长电科技股份有限公司[注]	检测设备	240,000.00	161,150.44	82,743.35

[注]实际为江苏长电科技股份有限公司、江阴长电先进封装有限公司以及星科金朋半导体(江阴)有限公司合并披露，系关联公司

### (2) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	2021 年度确认的 租赁费	2020 年度确认的 租赁费	2019 年度确认的 租赁费
江苏长电科技股份有限公司	检测设备	25,510,000.66	4,916,871.17	
上海季丰电子股份有限公司	检测设备		133,000.00	
小 计		25,510,000.66	5,049,871.17	

## 3. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
骈文胜、秦君梅	4,800,000.00	2021/3/12	2022/3/11	否
	10,000,000.00	2021/4/22	2022/4/21	
	9,000,000.00	2021/1/15	2022/1/14	
	10,000,000.00	2021/9/26	2022/9/25	

骈文胜[注 1]	35,000,000.00	2021/6/10	2023/6/9
骈文胜	15,000,000.00	2021/11/18	2022/11/17
	3,276,000.00	2021/6/7	2024/6/7
	6,724,000.00	2021/9/6	2024/6/7
	10,000,000.00	2021/6/11	2022/5/30
	6,790,902.59	2020/12/15	2023/12/15
骈文胜[注 2]	9,172,507.07	2021/1/12	2023/12/15
	10,100,530.96	2021/2/9	2023/12/15
	10,271,961.11	2021/6/3	2024/5/20
	429,905.13	2019/12/5	2022/1/14
骈文胜[注 3]	1,375,213.88	2019/12/17	2022/2/13
	970,963.80	2019/12/17	2022/12/2
	976,932.17	2020/2/28	2023/2/1
	3,534,802.02	2020/5/27	2023/5/12
骈文胜、秦君梅、上海蕊测半导体科技有限公司[注 4]	4,211,125.99	2020/8/14	2023/8/14
	3,755,352.42	2020/8/14	2023/8/29
	1,164,085.47	2020/9/3	2023/9/28
	3,046,366.10	2020/11/3	2023/11/16
	1,959,675.27	2020/11/3	2023/11/16
	1,108,286.15	2019/7/31	2022/7/16
	1,306,907.47	2019/9/30	2022/9/14
骈文胜、闻国涛[注 6]	2,255,385.35	2019/4/22	2022/4/22
	8,033,963.02	2021/3/22	2023/3/22
骈文胜、闻国涛、上海蕊测半导体科技有限公司[注 7]	1,268,494.42	2019/8/10	2022/8/10
	2,469,104.02	2019/9/22	2022/9/21
骈文胜、秦君梅[注 8]	3,749,999.95	2020/9/29	2022/9/21
骈文胜[注 9]	21,818,181.81	2020/11/17	2023/11/16
骈文胜[注 10]	1,839,356.74	2021/5/27	2024/5/27
	7,827,033.60	2021/7/9	2024/7/9
骈文胜、闻国涛、路峰[注 11]	12,985,558.28	2020/10/23	2023/10/22



骈文胜、闻国涛[注 12]	6,327,219.75	2021/2/22	2023/2/22
上海蕊测半导体科技有限公司	5,039,297.01	2021/6/29	2024/6/29
	12,545,230.19	2021/6/30	2024/6/30
	10,591,878.94	2021/6/30	2024/6/30
骈文胜、上海蕊测半导体科技有限公司	12,825,834.31	2021/7/29	2023/6/29
	9,669,940.25	2021/8/23	2023/7/23
骈文胜、闻国涛[注 13]	9,833,254.54	2020/10/23	2022/10/21
骈文胜[注 14]	130,194,359.32	2021/8/3	2026/8/2

[注 1] 该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 66,969,204.43 元的固定资产提供抵押担保

[注 2] 该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 42,084,074.37 元的固定资产提供抵押担保

[注 3] 该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 5,825,637.88 元的使用权资产提供抵押担保

[注 4] 该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为 23,517,038.99 元的使用权资产提供抵押担保

[注 5] 该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为 9,838,859.35 元的固定资产提供抵押担保

[注 6] 该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为 26,637,711.37 元的使用权资产提供抵押担保

[注 7] 该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为 14,405,440.11 元的使用权资产提供抵押担保

[注 8] 该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 12,981,643.50 元的固定资产提供抵押担保

[注 9] 该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 37,986,749.70 元的固定资产提供抵押担保

[注 10] 该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为 13,396,302.23 元的使用权资产提供抵押担保

[注 11] 该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 3,464,506.10 元固定资产及 24,365,381.69 元的使用权资产提供抵押担保

[注 12] 该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 12,436,316.78 元的使用权资产提供抵押担保

[注 13] 该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 33,941,258.89 元的使用权资产提供抵押担保

[注 14] 该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 97,381,953.99 元的固定资产以及账面价值为 7,855,953.57 元的无形资产提供抵押担保

#### 4. 关联方资金拆借

##### (1) 2021 年度

本期无关联方资金拆借。

##### (2) 2020 年度

关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金拆借利息
拆出					
骈文胜	300,000.00		300,000.00		
路峰	150,000.00		150,000.00		
小 计	450,000.00		450,000.00		

##### (3) 2019 年度

关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金拆借利息
拆入					
上海蕊测半导体科技有限公司	2,999,400.00	1,598,269.00	4,597,669.00		675,291.93
龚金新	200,000.00		200,000.00		15,696.44
路峰	1,380,000.00		1,380,000.00		108,115.28
秦君梅	1,000,000.00		1,000,000.00		78,344.40
小 计	5,579,400.00	1,598,269.00	7,177,669.00		877,448.05
拆出					
路峰		150,000.00		150,000.00	
闻国涛	100,000.00	1,050,000.00	1,150,000.00		
骈文胜	333,500.00	580,000.00	613,500.00	300,000.00	
小 计	433,500.00	1,780,000.00	1,763,500.00	450,000.00	

#### 5. 关键管理人员报酬

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
关键管理人员报酬	5,533,372.35	2,187,779.24	1,534,605.84

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	2021.12.31		2020.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	普冉半导体(上海)股份有限公司	2,348,048.51	117,402.43	8,134,702.58	406,735.13
	中微半导体(深圳)股份有限公司	93,004.81	4,650.24	111,041.35	5,552.07
	江苏长电科技股份有限公司	90,365.51	4,518.28	189,693.86	9,484.69
	江阴长电先进封装有限公司			135,600.00	6,780.00
	星科金朋半导体(江阴)有限公司			20,826.15	1,041.31
小 计		2,531,418.83	126,570.95	8,591,863.94	429,593.20

(续上表)

项目名称	关联方	2019.12.31	
		账面余额	坏账准备
应收账款			
	普冉半导体(上海)股份有限公司	4,695,590.43	234,779.52
	江苏长电科技股份有限公司	1,886,532.31	94,326.62
	星科金朋半导体(江阴)有限公司	2,223,852.55	111,192.63
小 计		8,805,975.29	440,298.77
其他应收款			
	骈文胜	304,952.10	15,247.61
	路峰	150,000.00	7,500.00
	乔从缓	3,552.00	177.60
	周歆瑶	18,569.00	928.45
小 计		477,073.10	23,853.66

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	2021. 12. 31	2020. 12. 31
应付账款			
	星科金朋半导体（江阴）有限公司	870,000.00	972,545.98
	江阴长电先进封装有限公司		1,858,319.35
	江苏长电科技股份有限公司		1,667,639.86
	强一半导体（苏州）有限公司	1,547,400.48	46,796.00
	上海季丰电子股份有限公司	24,374.10	97,858.00
小 计		2,441,774.58	4,643,159.19
其他应付款			
	上海蕊测半导体科技有限公司	1,300.00	1,300.00
小 计		1,300.00	1,300.00

(续上表)

项目名称	关联方	2019. 12. 31
应付账款		
	上海承括电子科技有限公司	8,814.00
	强一半导体（苏州）有限公司	29,925.00
小 计		38,739.00
其他应付款		
	闻国涛	900.00
	龚金新	87,696.44
	路峰	108,115.28
	秦君梅	78,344.40
	上海蕊测半导体科技有限公司	676,591.95
小 计		951,648.07

## 十一、股份支付

### (一) 股份支付总体情况

#### 1. 明细情况

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
-----	---------	---------	---------

公司本期授予的各项权益工具总额		145,972.35	1,621,915.00
公司本期行权的各项权益工具总额		145,972.35	1,621,915.00

## 2. 其他说明

公司股东上海芯伟半导体合伙企业（有限合伙）于 2019 年设立并对公司出资，上海芯伟半导体合伙企业（有限合伙）系公司员工持股平台。公司员工通过上海芯伟半导体合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,621,915 股股份，2019 年上海芯伟半导体合伙企业（有限合伙）对公司增资，出资价格为每股 12.33 元，小于同期投资者直接购买公司股权的价格，两者的差额以股权支付的形式一次性计入管理费用同时增加资本公积。

2020 年上海芯伟半导体合伙企业（有限合伙）原股东将部分合伙企业的财产份额转让给其他员工，其他员工通过上海芯伟半导体合伙企业（有限合伙）间接持有公司 145,972.35 股股份。公司将员工受让的股份总额（转让价格 1,800,000 元）与同时期上海芯伟半导体合伙企业（有限合伙）该部分股份公允价值的差额以股权支付的形式一次性计入管理费用同时增加资本公积。

### （二）以权益结算的股份支付情况

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
授予日权益工具公允价值的确定方法		根据公司最近一次股份增发价格确定	根据公司最近一次股份增发价格确定
可行权权益工具数量的确定依据		根据本公司员工增持公司股东的股份数量换算确定	根据本公司员工增持公司股东的股份数量换算确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额		2,155,804.20	1,527,765.26
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额		2,155,804.20	1,527,765.26

## 十二、承诺及或有事项

### （一）承诺事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司向银行申请开立但尚未到期的保函保证金余额为 6,400,000.00 元。除此之外，本公司不存在需要披露的其他重要承诺事项。

### （二）或有事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十三、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

### 十四、其他重要事项

#### (一) 分部信息

公司不存在多种经营，故不存在报告分部，本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

#### (1) 2021 年度

项 目	主营业务收入	主营业务成本
晶圆测试	274,345,086.38	109,977,469.32
芯片成品测试	197,761,381.53	120,574,113.50
小 计	472,106,467.91	230,551,582.82

#### (2) 2020 年度

项 目	主营业务收入	主营业务成本
晶圆测试	109,443,125.86	51,520,008.17
芯片成品测试	42,878,681.34	21,973,543.15
小 计	152,321,807.20	73,493,551.32

#### (3) 2019 年度

项 目	主营业务收入	主营业务成本
晶圆测试	69,315,175.38	32,812,090.86
芯片成品测试	5,693,441.09	3,008,333.27
小 计	75,008,616.47	35,820,424.13

#### (二) 执行新金融工具准则的影响

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司

考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

### (三) 执行新收入准则的影响

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	40,419.80	-40,419.80	
合同负债		35,769.73	35,769.73
其他流动负债		4,650.07	4,650.07

### (四) 执行新租赁准则的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)。公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
固定资产	486,660,031.76	-132,332,099.43	354,327,932.33
使用权资产		145,531,790.91	145,531,790.91

租赁负债		83,060,348.34	83,060,348.34
一年内到期的非流动负债	58,456,595.04	2,544,648.62	61,001,243.66
长期应付款	72,177,041.80	-72,177,041.80	
未分配利润	26,052,061.95	-228,263.68	25,823,798.27

(五) 租赁

1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)12之说明；

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十四)1之说明。本期计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	2021 年度
短期租赁费用	32,952,356.78
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	
合 计	32,952,356.78

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	2021 年度
租赁负债的利息费用	10,161,645.32
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
与租赁相关的总现金流出	146,298,999.91
售后租回交易产生的相关损益	385,064.47

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注八(二)之说明。

2. 公司作为出租人

经营租赁

(1) 租赁收入

项 目	2021 年度
租赁收入	4,939,841.29
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入	

(2) 经营租赁资产

项 目	2021.12.31



固定资产	40,165,343.95
小 计	40,165,343.95

经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)10之说明。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	2021.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	119,666,678.69	100.00	5,561,561.66	4.65	114,105,117.03
合 计	119,666,678.69	100.00	5,561,561.66	4.65	114,105,117.03

(续上表)

种 类	2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	70,240,986.88	100.00	3,357,904.35	4.78	66,883,082.53
合 计	70,240,986.88	100.00	3,357,904.35	4.78	66,883,082.53

(续上表)

种 类	2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	33,087,119.70	100.00	1,658,353.95	5.01	31,428,765.75
合 计	33,087,119.70	100.00	1,658,353.95	5.01	31,428,765.75

#### 2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

##### ① 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	2021.12.31			2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	111,227,755.07	5,561,561.66	5.00	67,098,655.83	3,357,904.35	5.00

合并范围内关联方款项组合	8,438,923.62			3,142,331.05		
小计	119,666,678.69	5,561,561.66	4.65	70,240,986.88	3,357,904.35	4.78

(续上表)

项目	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	33,087,119.70	1,658,353.95	5.01
合并范围内关联方款项组合			
小计	33,087,119.70	1,658,353.95	5.01

② 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2021.12.31			2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	111,224,276.83	5,561,213.84	5.00	67,039,224.50	3,351,961.22	5.00
1-2年	3,478.24	347.82	10.00	59,431.33	5,943.13	10.00
小计	111,227,755.07	5,561,561.66	5.00	67,098,655.83	3,357,904.35	5.00

(续上表)

账龄	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	33,007,160.35	1,650,358.01	5.00
1-2年	79,959.35	7,995.94	10.00
小计	33,087,119.70	1,658,353.95	5.01

③ 采用合并范围内关联方款项组合提坏账准备的应收账款

往来单位	2021.12.31			2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
无锡伟测半导体科技有限公司	8,438,923.62			3,142,331.05		
小计	8,438,923.62			3,142,331.05		

(2) 坏账准备变动情况

1) 2021年度

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提	3,357,904.35	2,203,657.31						5,561,561.66

坏账准备								
小 计	3,357,904.35	2,203,657.31						5,561,561.66

2) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,658,353.95	1,699,550.40						3,357,904.35
小 计	1,658,353.95	1,699,550.40						3,357,904.35

3) 2019 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	936,787.71	721,566.24						1,658,353.95
小 计	936,787.71	721,566.24						1,658,353.95

(3) 应收账款金额前 5 名情况

1) 2021 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户 A	24,476,506.33	20.45	1,223,825.32
晶晨半导体(上海)股份有限公司	21,333,894.07	17.83	1,066,694.70
紫光展锐科技有限公司	13,403,574.40	11.20	670,178.72
无锡伟测半导体科技有限公司	8,438,923.62	7.05	
甬矽电子(宁波)股份有限公司	5,651,325.60	4.72	282,566.28
小 计	73,304,224.02	61.25	3,243,265.02

2) 2020 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
晶晨半导体(上海)股份有限公司	9,720,972.54	13.84	486,048.63
深圳市中兴微电子技术有限公司	9,628,030.46	13.71	481,401.52
普冉半导体(上海)股份有限公司	8,134,702.58	11.58	406,735.13
客户 A	4,962,464.77	7.06	248,123.24
无锡伟测半导体科技有限公司	3,142,331.05	4.47	
小 计	35,588,501.40	50.66	1,622,308.52

3) 2019年12月31日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
普冉半导体(上海)有限公司	4,695,590.43	14.19	234,779.52
星科金朋半导体(江阴)有限公司	2,223,852.55	6.72	111,192.63
江苏长电科技股份有限公司	1,886,532.31	5.70	94,326.62
吉林华微电子股份有限公司	1,734,424.03	5.24	86,721.20
广东晟矽微电子有限公司	1,546,539.37	4.67	77,326.97
小计	12,086,938.69	36.52	604,346.94

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	2021.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	88,227,650.76	100.00	1,521,199.21	1.72	86,706,451.55
合计	88,227,650.76	100.00	1,521,199.21	1.72	86,706,451.55

(续上表)

种类	2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	30,021,923.33	100.00	626,366.90	2.09	29,395,556.43
合计	30,021,923.33	100.00	626,366.90	2.09	29,395,556.43

(续上表)

种类	2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	15,138,100.58	100.00	1,040,994.99	6.88	14,097,105.59
合计	15,138,100.58	100.00	1,040,994.99	6.88	14,097,105.59

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

合并范围内关联方款项组合	77,422,248.71		
账龄组合	10,805,402.05	1,521,199.21	14.08
其中：1年以内	868,478.72	43,423.94	5.00
1-2年	7,516,508.68	751,650.87	10.00
2-3年	2,420,414.65	726,124.40	30.00
小计	88,227,650.76	1,521,199.21	1.72

(续上表)

组合名称	2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方款项组合	20,000,000.00		
账龄组合	10,021,923.33	626,366.90	6.25
其中：1年以内	7,516,508.68	375,825.43	5.00
1-2年	2,505,414.65	250,541.47	10.00
小计	30,021,923.33	626,366.90	2.09

(续上表)

组合名称	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方款项组合			
账龄组合	15,138,100.58	1,040,994.99	6.88
其中：1年以内	9,456,301.52	472,815.08	5.00
1-2年	5,681,799.06	568,179.91	10.00
小计	15,138,100.58	1,040,994.99	6.88

(2) 坏账准备变动情况

1) 2021年度

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初数	375,825.43	250,541.47		626,366.90
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-375,825.43	375,825.43		

--转入第三阶段		-243,041.47	243,041.47	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	43,423.94	368,325.44	483,082.93	894,832.31
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	43,423.94	751,650.87	726,124.40	1,521,199.21

2) 2020 年度

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
期初数	472,815.08	568,179.91		1,040,994.99
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-125,270.73	125,270.73		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	28,281.08	-442,909.17		-414,628.09
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	375,825.43	250,541.47		626,366.90

3) 2019 年度

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	

期初数	421,948.68	250,690.35		672,639.03
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-284,089.95	284,089.95		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	334,956.35	33,399.61		368,355.96
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	472,815.08	568,179.91		1,040,994.99

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
押金保证金	10,799,329.96	10,015,851.24	14,579,589.48
设备处置款	77,422,248.71		
拆借款		20,000,000.00	450,000.00
备用金	6,072.09	6,072.09	108,511.10
合计	88,227,650.76	30,021,923.33	15,138,100.58

(4) 其他应收款金额前5名情况

1) 2021年12月31日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
无锡伟测半导体科技有限公司	设备处置款	77,422,248.71	1年以内	87.75	
苏州融华租赁有限公司	押金	5,010,715.43	1年以内、1-2年、2-3年	5.68	855,055.16
北亚融资租赁(上海)有限公司	押金、融资租赁保证金	4,384,812.12	1年以内、1-2年	4.97	407,272.57
上海新发创运置业有限公司	厂房押金	819,802.41	1年以内、1-2年、2-3年	0.93	183,864.26
浦银金融租赁股份有限公司	融资租赁保证金	500,000.00	1-2年	0.57	50,000.00

小 计		88,137,578.67		99.90	1,496,191.99
-----	--	---------------	--	-------	--------------

2) 2020年12月31日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
无锡伟测半导体科技有 限公司	拆借款	20,000,000.00	1年以内	66.62	
苏州融华租赁有限公司	融资租赁保证金	5,010,715.43	1年以内、 1-2年	16.69	339,031.68
北亚融资租赁(上海) 有限公司	融资租赁保证金	3,760,639.25	1年以内	12.53	188,031.96
上海新发创运置业有 限公司	厂房押金	590,496.56	1年以内、 1-2年	1.97	58,799.66
浦银金融租赁股份有 限公司	融资租赁保证金	500,000.00	1年以内	1.67	25,000.00
小 计		29,861,851.24		99.48	610,863.30

3) 2019年12月31日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收 款余额的比 例(%)	坏账准备
北亚融资租赁(上海)有 限公司	融资租赁保证金	11,893,122.07	1年以内、 1-2年	78.56	871,246.06
苏州融华租赁有限公司	融资租赁保证金	1,774,930.50	1年以内	11.72	88,746.53
上海新发创运置业有 限公司	厂房押金	611,536.91	1年以内	4.04	30,576.85
骈文胜	拆借款及备用金	304,952.10	1年以内	2.01	15,247.61
仲利国际租赁有限公司	融资租赁保证金	150,000.00	1-2年	0.99	15,000.00
小 计		14,734,541.58		97.32	1,020,817.05

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	2021.12.31			2020.12.31		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公 司投资	230,030,000.00		230,030,000.00	150,030,000.00		150,030,000.00
合 计	230,030,000.00		230,030,000.00	150,030,000.00		150,030,000.00



(续上表)

项 目	2019. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,000.00		30,000.00
合 计	30,000.00		30,000.00

(2) 对子公司投资

1) 2021 年度

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
上海威矽半导体 科技有限公司	30,000.00			30,000.00		
无锡伟测半导体 科技有限公司	150,000,000.00	30,000,000.00		180,000,000.00		
南京伟测半导体 科技有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
小 计	150,030,000.00	80,000,000.00		230,030,000.00		

2) 2020 年度

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
上海威矽半导体 科技有限公司	30,000.00			30,000.00		
无锡伟测半导体 科技有限公司		150,000,000.00		150,000,000.00		
小 计	30,000.00	150,000,000.00		150,030,000.00		

3) 2019 年度

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
上海威矽半导体 科技有限公司	30,000.00			30,000.00		
小 计	30,000.00			30,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	2021 年度		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	410,503,030.33	250,835,377.96	145,923,560.13	70,826,328.04
其他业务	21,043,541.97	17,316,004.03	11,795,977.33	8,792,746.73
合计	431,546,572.30	268,151,381.99	157,719,537.46	79,619,074.77
其中：与客户之间的合同产生的收入	426,866,731.01	266,055,219.34	156,106,087.91	78,577,283.95

(续上表)

项目	2019年度	
	收入	成本
主营业务	75,008,616.47	35,820,424.13
其他业务	2,924,618.82	1,875,040.16
合计	77,933,235.29	37,695,464.29

(2) 公司前5名客户的营业收入情况

1) 2021年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户A	76,748,212.34	17.79
晶晨半导体(上海)股份有限公司	69,118,733.56	16.02
上海安路信息科技股份有限公司	30,364,609.34	7.04
深圳市中兴微电子技术有限公司[注1]	23,663,270.37	5.48
普冉半导体(上海)股份有限公司	16,240,233.51	3.76
小计	216,135,059.12	50.09

2) 2020年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
普冉半导体(上海)股份有限公司	17,977,381.34	11.40
晶晨半导体(上海)股份有限公司	11,785,396.43	7.47
Bitmain Technologies Limited[注2]	11,561,988.60	7.33
江苏长电科技股份有限公司[注3]	8,832,588.68	5.60
深圳市中兴微电子技术有限公司[注1]	7,355,578.41	4.66
小计	57,512,933.46	36.46

3) 2019年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏长电科技股份有限公司[注 3]	13,710,133.61	17.59
普冉半导体(上海)有限公司	9,969,172.49	12.79
上海复旦微电子集团股份有限公司	3,870,589.60	4.97
上海安路信息科技有限公司	3,147,748.13	4.04
甬矽电子(宁波)股份有限公司	2,398,653.64	3.08
小 计	33,096,297.47	42.47

[注 1]实际为深圳市中兴微电子技术有限公司及其子公司西安克瑞斯半导体技术有限公司合并披露，系关联公司

[注 2]实际为 Bitmain Technologies Limited、BitmaintechPte.Ltd 合并披露，系关联公司

[注 3]实际为江苏长电科技股份有限公司、江阴长电先进封装有限公司以及星科金朋半导体(江阴)有限公司合并披露，系关联公司

## 2. 研发费用

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	24,230,669.09	14,394,338.18	10,264,773.97
折旧与摊销	4,357,599.21	3,113,217.31	1,730,523.99
技术服务费	1,253,919.46		
机物料消耗费	1,227,167.35	1,467,501.82	461,407.34
能源费	798,247.09	576,984.57	431,853.00
专利使用权	318,212.85	318,212.88	283,696.51
其他	94,650.64	149,052.87	199,407.96
合 计	32,280,465.69	20,019,307.63	13,371,662.77

## 3. 投资收益

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
交易性金融资产在持有期间的投资收益	237,750.80	39,057.54	
票据贴现利息	-3,354.88		

合 计	234,395.92	39,057.54	
-----	------------	-----------	--

## 十六、其他补充资料

### (一) 净资产收益率及每股收益

#### 1. 明细情况

##### (1) 净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)		
	2021 年度	2020 年度	2019 年度
归属于公司普通股股东的净利润	18.04	12.51	9.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.41	11.71	9.26

##### (2) 每股收益

报告期利润	每股收益(元/股)			
	基本每股收益		稀释每股收益	
	2021 年度	2020 年度	2021 年度	2020 年度
归属于公司普通股股东的净利润	2.09	0.67	2.09	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.01	0.63	2.01	0.63

#### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	2021 年度	2020 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	132,175,641.77	34,846,264.67
非经常性损益	B	4,578,395.33	2,244,805.06
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	127,597,246.44	32,601,459.61
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	566,780,408.91	199,880,723.00
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	200,000,000.00	20,000,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	6	9
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2		110,000,058.29
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2		3
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3		10,000,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3		2
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E4		190,000,000.00

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F4		1
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
股份支付及大股东捐赠的影响	I		2,281,626.63
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J		6
报告期月份数	K	12	12
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	732,868,229.80	278,444,683.22
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	18.04%	12.51%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	17.41%	11.71%

(续上表)

项 目	序号	2019 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	11,277,809.60
非经常性损益	B	739,203.36
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	10,538,606.24
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	83,105,954.33
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	30,000,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	9
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	70,400,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E4	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F4	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
股份支付及大股东捐赠的影响	I	5,096,959.07
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K - G \times$	113,793,338.67

	$H/K \pm I \times J/K$	
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	9.91%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	9.26%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2021 年度	2020 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	132,175,641.77	34,846,264.67
非经常性损益	B	4,578,395.33	2,244,805.06
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	127,597,246.44	32,601,459.61
期初股份总数	D	61,320,000.00	35,916,786.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E		13,099,192.00
发行新股或债转股等增加股份数	F1	4,088,000.00	984,022.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G1	6	9
发行新股或债转股等增加股份数	F2		5,500,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G2		3
发行新股或债转股等增加股份数	F3		500,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G3		2
发行新股或债转股等增加股份数	F4		5,320,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G4		1
因回购等减少股份数	H		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I		
报告期缩股数	J		
报告期月份数	K	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I / K-J$	63,364,000.00	51,655,661.17
基本每股收益	$M=A/L$	2.09	0.67
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	2.01	0.63

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

#### (二) 公司主要财务报表项目的异常情况原因说明

1. 2021 年度比 2020 年度

资产负债表项目	2021. 12. 31	2020. 12. 31	变动幅度	变动原因说明
货币资金	149,697,852.53	93,426,732.97	60.23%	主要系公司本期外部股权融资及债权融资增加所致
交易性金融资产		29,990,000.00	-100.00%	主要系公司本期赎回理财产品所致
应收票据	4,030,000.00	1,886,860.00	1.14 倍	主要系公司业务增长,客户采用票据付款相应增加所致
应收账款	130,693,275.45	64,273,751.43	1.03 倍	主要系公司业务增长,应收账款相应增加所致
其他应收款	25,404,805.18	13,254,389.47	91.67%	主要系公司本期融资租赁业务增长,支付的融资租赁保证金相应增加所致
固定资产	710,296,863.56	486,660,031.76	45.95%	主要系公司本期扩大产能,采购测试设备增加所致
使用权资产	277,252,478.16			主要系公司本期执行新租赁准则,经营租赁及融资租赁导致使用权资产增加所致
无形资产	10,051,864.54	1,710,182.20	4.88 倍	主要系公司本期购买土地使用权所致
长期待摊费用	38,091,066.07	18,102,520.13	1.10 倍	主要系公司本期全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司租用厂房工程投入增加所致
短期借款	102,907,849.31	40,345,006.85	1.55 倍	主要系公司本期银行借款增加所致
应付职工薪酬	24,164,048.97	10,031,390.51	1.41 倍	主要系公司员工人数增加所致
一年内到期的非流动负债	160,619,522.96	58,456,595.04	1.75 倍	主要系公司本期即将到期的长期负债增加所致
长期借款	166,670,450.52	6,969,197.23	22.92 倍	主要系公司本期银行借款增加所致
租赁负债	90,488,433.28			主要系公司本期执行新租赁准则,经营租赁及融资租赁导致租赁负债增加所致
长期应付款		72,177,041.80	-100.00%	主要系公司本期执行新租赁准则,融资租赁长期应付款调整至租赁负债所致
递延收益	17,977,036.87	4,463,333.25	3.03 倍	主要系公司本期收到的与资产相关的政府补助增加所致
利润表项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度	变动原因说明
营业收入	493,144,257.09	161,196,220.78	2.06 倍	主要系公司本期业务规模扩大,收入增长所致

营业成本	244,304,848.77	79,663,501.70	2.07 倍	主要系公司本期业务规模扩大，成本相应增加所致
销售费用	11,153,818.10	5,489,818.23	1.03 倍	主要系公司本期业务规模扩大，销售人员薪酬增加所致
管理费用	21,794,131.07	13,157,528.34	65.64%	主要系公司本期新设南京子公司，管理费用相应增加以及中介服务费增加所致
研发费用	47,742,834.01	21,013,963.09	1.27 倍	主要系公司本期加大研发投入所致
财务费用	15,162,236.74	6,834,089.27	1.22 倍	主要系公司无锡子公司贷款利息、融资租赁利息、经营租赁利息支出增多所致
所得税费用	20,205,138.01	3,098,374.84	5.52 倍	主要系公司本期业务规模扩大，实现盈利增加所致

## 2. 2020 年度比 2019 年度

资产负债表项目	2020.12.31	2019.12.31	变动幅度	变动原因说明
货币资金	93,426,732.97	23,480,227.00	2.98 倍	主要系公司本期外部股权融资及债权融资增加所致
交易性金融资产	29,990,000.00			主要系公司本期融资增加，流动资金充足，公司购买银行理财产品
应收票据	1,886,860.00	730,000.00	1.58 倍	主要系公司本期业务增长，与客户结算采用票据形式增加所致
应收账款	64,273,751.43	31,428,765.75	1.05 倍	主要系公司业务增长，应收账款相应增加
其他流动资产	45,559,776.40	13,145,488.00	2.47 倍	主要系公司本期采购的设备增加导致公司待抵扣的增值税进项税增加所致
固定资产	486,660,031.76	197,274,428.09	1.47 倍	主要系公司本期扩大产能，采购检测设备增加所致
在建工程	95,810,116.57	42,546,867.00	1.25 倍	原因同固定资产
长期待摊费用	18,102,520.13	8,693,663.72	1.08 倍	主要系公司本期新设无锡伟测半导体科技有限公司，租用厂房工程投入增加所致
短期借款	40,345,006.85	17,116,151.95	1.36 倍	主要系公司本期银行借款增加所致
应付账款	91,533,049.37	18,171,762.47	4.04 倍	主要系公司本期扩大产能，加大设备投入，期末应付设备供应商款项增加所致
应付职工薪酬	10,031,390.51	3,482,884.86	1.88 倍	主要系公司本期扩大产能，同时新成立无锡子公司，人员增加所致
长期借款	6,969,197.23			主要系公司本期银行借款增加所致
长期应付款	72,177,041.80	47,146,667.39	53.09%	主要系公司本期扩大产能，通过融



利润表项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度	变动原因说明
				资租赁设备增加所致
营业收入	161,196,220.78	77,933,235.29	1.07 倍	主要系公司本期业务规模扩大, 收入增长所致
营业成本	79,663,501.70	37,695,464.29	1.11 倍	主要系公司本期业务规模扩大, 成本相应增加所致
销售费用	5,489,818.23	2,847,104.07	92.82%	主要系公司本期业务规模扩大, 销售人员薪酬增加所致
管理费用	13,157,528.34	7,212,675.01	82.42%	主要系公司本期新设无锡子公司, 管理费用相应增加以及中介服务费增加所致
研发费用	21,013,963.09	13,371,662.77	57.15%	主要系公司本期加大研发投入所致
其他收益	4,675,681.02	2,116,056.12	1.21 倍	主要系公司本期收到政府补助增加所致
所得税费用	3,098,374.84	822,287.31	2.77 倍	主要系公司本期业务规模扩大, 实现盈利增加所致

上海伟测半导体科技股份有限公司

二〇二二年四月十五日



# 营业执照 (副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码  
获取企业信用信息  
更多服务  
请登录、许可、监  
管信息



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



2022年3月1日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送年度报告  
国家市场监督管理总局监制  
仅为上海伟测半导体科技股份有限公司IPO申报之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制



证书序号：0007666

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

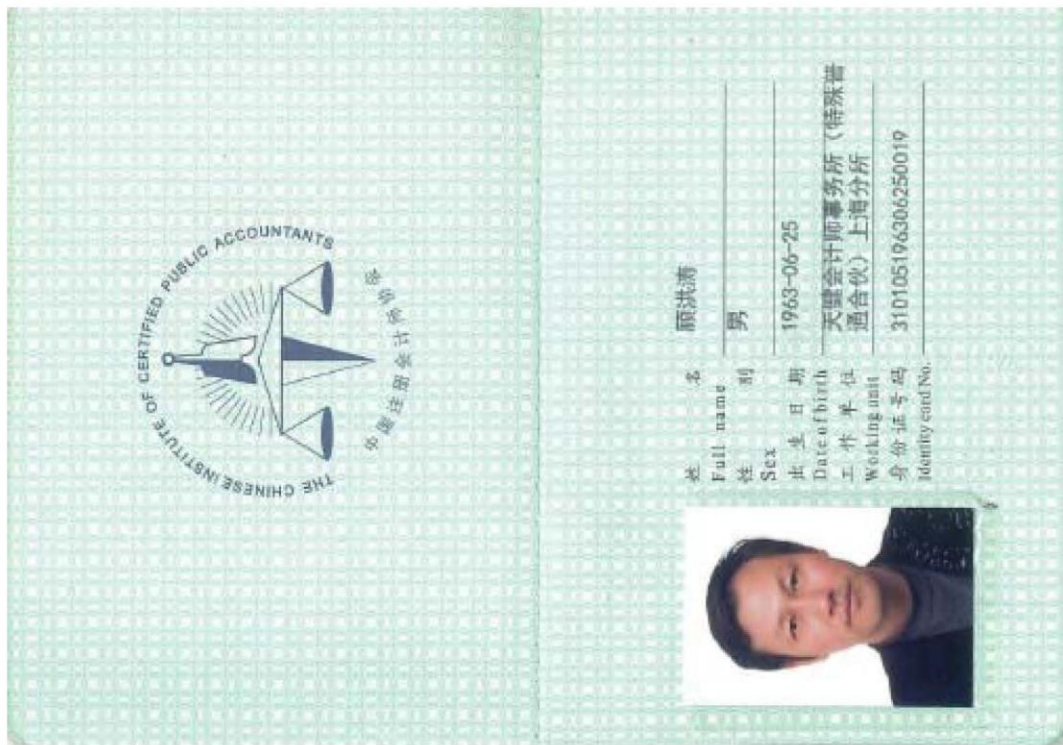
发证机关：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为上海伟测半导体科技股份有限公司IPO申报之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为 上海伟测半导体科技股份有限公司 IPO 申报 之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明 顾洪涛 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



仅为上海伟测半导体科技股份有限公司 IPO 申报之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 陈灵灵 是中国注册会计师 未经本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

上海伟测半导体科技股份有限公司

2022 年 1-6 月审阅报告

# 目 录

一、审阅报告	第 1 页
二、财务报表	第 2—7 页
(一) 合并资产负债表	第 2 页
(二) 母公司资产负债表	第 3 页
(三) 合并利润表	第 4 页
(四) 母公司利润表	第 5 页
(五) 合并现金流量表	第 6 页
(六) 母公司现金流量表	第 7 页
三、财务报表附注	第 8—26 页
四、附件	第 27—30 页
(一) 本所营业执照复印件	第 27 页
(二) 本所执业证书复印件	第 28 页
(三) 注册会计师执业资格证书复印件	第 29-30 页

## 审 阅 报 告

天健审〔2022〕6-428号

上海伟测半导体科技股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称伟测科技公司)财务报表,包括2022年6月30日的合并及母公司资产负债表,2022年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表,以及财务报表附注。这些财务报表的编制是伟测科技公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问伟测科技公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映伟测科技公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·杭州

中国注册会计师:

中国注册会计师:



二〇二二年八月二十三日





# 合并资产负债表

2022年6月30日

会合01表

单位：人民币元

编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		183,981,286.23	149,697,852.53	短期借款	6	208,286,779.17	102,907,849.31
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产		60,000,000.00		交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		2,912,103.36	4,030,000.00	应付票据			
应收账款	1	176,872,707.39	130,693,275.45	应付账款		74,473,310.21	88,672,718.58
应收款项融资			535,519.48	预收款项			
预付款项		1,808,502.94	49,363.97	合同负债		196,304.64	
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款		18,483,556.56	25,404,805.18	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬		25,219,198.21	24,164,048.97
存货		4,254,272.66	6,336,607.23	应交税费		2,293,713.20	14,286,725.07
合同资产				其他应付款		6,312,388.45	4,610,115.79
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	2	27,107,569.77	76,430,212.61	持有待售负债			
流动资产合计		475,419,998.91	393,177,636.45	一年内到期的非流动负债	7	166,432,030.17	160,619,522.96
				其他流动负债		11,778.28	
				流动负债合计		483,225,502.33	395,260,980.68
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款和垫款				保险合同准备金			
债权投资				长期借款	8	229,993,645.01	166,670,450.52
其他债权投资				应付债券			
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资				永续债			
其他权益工具投资				租赁负债		48,449,967.51	90,488,433.28
其他非流动金融资产				长期应付款		49,000,000.00	
投资性房地产				长期应付职工薪酬			
固定资产	3	994,613,357.45	710,296,863.56	预计负债			
在建工程	4	60,743,764.98	109,629,604.00	递延收益		38,421,580.18	17,977,036.87
生产性生物资产				递延所得税负债			
油气资产				其他非流动负债			
使用权资产	5	211,757,636.86	277,252,478.16	非流动负债合计		365,865,192.70	275,135,920.67
无形资产		10,460,476.46	10,051,864.54	负债合计		849,090,695.03	670,396,901.35
开发支出				所有者权益(或股东权益)：			
商誉				实收资本(或股本)		65,408,000.00	65,408,000.00
长期待摊费用		78,722,286.63	38,091,066.07	其他权益工具			
递延所得税资产		1,051,154.49	1,273,311.23	其中：优先股			
其他非流动资产		29,330,445.17	29,580,128.02	永续债			
非流动资产合计		1,386,679,122.04	1,176,175,315.58	资本公积		672,596,678.02	672,596,678.02
资产总计		1,862,099,120.95	1,569,352,952.03	减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		11,948,535.88	11,948,535.88
				一般风险准备			
				未分配利润		263,055,212.02	149,002,836.78
				归属于母公司所有者权益合计		1,013,008,425.92	898,956,050.68
				少数股东权益			
				所有者权益合计		1,013,008,425.92	898,956,050.68
				负债和所有者权益总计		1,862,099,120.95	1,569,352,952.03

法定代表人：

*Handwritten signature*



主管会计工作的负责人：

*Handwritten signature*



会计机构负责人：

*Handwritten signature*





# 母公司资产负债表

2022年6月30日

会企01表

单位:人民币元

编制单位:上海伟测半导体科技股份有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		118,868,555.17	89,593,661.06	短期借款		134,737,763.46	88,907,849.31
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		2,912,103.36	30,000.00	应付票据			14,000,000.00
应收账款		137,212,479.73	114,105,117.03	应付账款		54,492,145.00	12,818,415.96
应收款项融资			477,554.20	预收款项			
预付款项		153,579,070.26	210,043,856.59	合同负债		196,304.64	
其他应收款		112,803,947.83	86,706,451.55	应付职工薪酬		12,686,087.18	14,322,487.90
存货		1,152,414.58	2,799,687.98	应交税费		1,955,829.09	3,268,026.86
合同资产				其他应付款		1,846,420.59	2,499,101.93
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		98,713,868.74	92,403,952.11
其他流动资产		7,295,512.60	8,531,243.60	其他流动负债		11,778.28	
流动资产合计		533,824,083.53	512,287,572.01	流动负债合计		304,640,196.98	228,219,834.07
				非流动负债:			
非流动资产:				长期借款		21,555,016.77	49,310,044.79
债权投资				应付债券			
其他债权投资				其中: 优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资		350,030,000.00	230,030,000.00	租赁负债		17,818,872.35	37,422,985.67
其他权益工具投资				长期应付款		49,000,000.00	
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		336,868,057.94	317,869,937.17	递延收益		12,180,476.19	13,023,333.17
在建工程		774,351.87	4,674,979.71	递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		100,554,365.31	99,756,363.63
使用权资产		68,962,611.02	102,123,811.38	负债合计		405,194,562.29	327,976,197.70
无形资产		1,914,745.93	1,923,891.36	所有者权益(或股东权益):			
开发支出				实收资本(或股本)		65,408,000.00	65,408,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用		14,689,013.35	15,078,119.62	其中: 优先股			
递延所得税资产		1,016,633.34	834,234.25	永续债			
其他非流动资产		2,684,250.00	514,987.29	资本公积		672,596,678.02	672,596,678.02
非流动资产合计		776,939,663.45	673,049,960.78	减: 库存股			
				其他综合收益			
资产总计		1,310,763,746.98	1,185,337,532.79	专项储备			
				盈余公积		11,948,535.88	11,948,535.88
				未分配利润		155,615,970.79	107,408,121.19
				所有者权益合计		905,569,184.69	857,361,335.09
				负债和所有者权益总计		1,310,763,746.98	1,185,337,532.79

法定代表人:

王胜



主管会计工作的负责人:

王沛



会计机构负责人:

王沛





# 合并利润表

2022年1-6月

会合02表

单位：人民币元

编制单位：上海伟瀚半导体科技股份有限公司

项 目	注释号	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		355,967,125.13	214,164,164.47
其中：营业收入	1	355,967,125.13	214,164,164.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		248,414,611.01	150,279,272.29
其中：营业成本	1	179,080,011.60	111,658,046.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		524,582.64	253,594.94
销售费用		7,324,398.70	4,613,019.71
管理费用	2	14,562,899.31	8,280,671.12
研发费用	3	28,571,616.84	19,822,819.02
财务费用	4	18,351,101.92	5,651,121.19
其中：利息费用		15,082,836.84	6,855,587.20
利息收入		651,548.60	267,144.02
加：其他收益	5	4,191,181.98	391,747.06
投资收益（损失以“-”号填列）		49,863.02	237,750.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,873,396.61	-2,824,448.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		850,453.13	-19,563.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		109,770,615.64	61,670,377.98
加：营业外收入		25,175.62	160.26
减：营业外支出		34,993.71	2,634.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		109,760,797.55	61,667,903.87
减：所得税费用	6	-4,291,577.69	7,484,990.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		114,052,375.24	54,182,913.14
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		114,052,375.24	54,182,913.14
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		114,052,375.24	54,182,913.14
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		114,052,375.24	54,182,913.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		114,052,375.24	54,182,913.14
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.74	0.88
（二）稀释每股收益		1.74	0.88

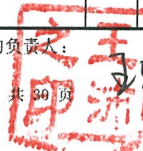
法定代表人：

王



主管会计工作的负责人：

王



会计机构负责人：

王





# 母公司利润表

2022年1-6月

会企02表

编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

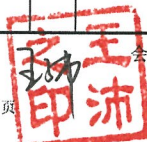
单位：人民币元

项 目	注释号	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		249,631,468.21	199,209,649.66
减：营业成本		155,851,055.67	126,318,570.77
税金及附加		153,277.75	194,482.92
销售费用		4,416,701.26	3,796,654.66
管理费用		8,961,951.41	6,275,433.53
研发费用		17,823,370.83	14,408,298.64
财务费用		9,443,610.55	4,008,953.53
其中：利息费用		7,761,302.16	4,745,549.27
利息收入		444,624.66	252,478.48
加：其他收益		2,248,220.21	368,247.06
投资收益（损失以“-”号填列）			237,750.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,867,574.40	-1,967,823.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		850,453.13	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		54,212,599.68	42,845,430.42
加：营业外收入		25,175.26	160.26
减：营业外支出		34,993.71	2,634.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		54,202,781.23	42,842,956.31
减：所得税费用		5,994,931.63	3,939,886.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,207,849.60	38,903,069.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,207,849.60	38,903,069.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		48,207,849.60	38,903,069.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





# 合并现金流量表

2022年1-6月

会合03表

单位：人民币元

编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

项目	注释号	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		328,236,513.32	201,770,624.98
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		89,985,490.09	8,123,669.50
收到其他与经营活动有关的现金		29,366,506.03	399,051.30
经营活动现金流入小计		447,588,509.44	210,293,345.78
购买商品、接受劳务支付的现金		45,179,339.74	42,968,554.06
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		101,366,633.15	48,792,330.49
支付的各项税费		8,034,507.90	5,377,475.74
支付其他与经营活动有关的现金		6,844,060.78	13,427,445.52
经营活动现金流出小计		161,424,541.58	110,565,805.81
经营活动产生的现金流量净额		286,163,967.86	99,727,539.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			38,690,000.00
取得投资收益收到的现金		49,863.02	237,750.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,430,061.50	664,499.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,479,924.52	39,592,250.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		340,769,142.42	193,584,164.47
投资支付的现金		60,000,000.00	8,700,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		400,769,142.42	202,284,164.47
投资活动产生的现金流量净额		-398,289,217.90	-162,691,913.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		254,052,459.09	127,662,923.80
收到其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00	25,413,787.00
筹资活动现金流入小计		324,052,459.09	353,076,710.80
偿还债务支付的现金		52,744,807.91	26,811,078.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,648,103.86	2,071,842.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		110,350,858.05	67,837,197.60
筹资活动现金流出小计		171,743,769.82	96,720,119.06
筹资活动产生的现金流量净额		152,308,689.27	256,356,591.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		99,994.47	-982,532.70
五、现金及现金等价物净增加额		40,283,433.70	192,409,685.31
加：期初现金及现金等价物余额		143,297,852.53	93,426,732.97
六、期末现金及现金等价物余额		183,581,286.23	285,836,418.28

法定代表人：

*[Signature]*



主管会计工作的负责人：

*[Signature]*



会计机构负责人：

*[Signature]*





# 母公司现金流量表

2022年1-6月

会企03表

编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		235,000,168.43	187,320,137.77
收到的税费返还			8,123,669.50
收到其他与经营活动有关的现金		469,799.92	508,199.47
经营活动现金流入小计		235,469,968.35	195,952,006.74
购买商品、接受劳务支付的现金		12,870,572.25	123,109,212.40
支付给职工以及为职工支付的现金		55,347,519.20	35,847,417.67
支付的各项税费		7,632,811.11	5,232,235.44
支付其他与经营活动有关的现金		6,104,046.33	9,242,002.58
经营活动现金流出小计		81,954,948.89	173,430,868.09
经营活动产生的现金流量净额		153,515,019.46	22,521,138.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			38,690,000.00
取得投资收益收到的现金			237,750.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,244,930.56	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			20,000,000.00
投资活动现金流入小计		20,244,930.56	58,927,750.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,490,389.14	94,543,492.24
投资支付的现金		120,000,000.00	38,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00	
投资活动现金流出小计		182,490,389.14	133,243,492.24
投资活动产生的现金流量净额		-162,245,458.58	-74,315,741.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			200,000,000.00
取得借款收到的现金		79,500,000.00	113,662,923.80
收到其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		149,500,000.00	313,662,923.80
偿还债务支付的现金		52,744,807.91	26,811,078.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,530,570.74	2,071,842.65
支付其他与筹资活动有关的现金		54,157,872.78	46,852,904.61
筹资活动现金流出小计		111,433,251.43	75,735,826.07
筹资活动产生的现金流量净额		38,066,748.57	237,927,097.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-61,415.34	-37,211.47
五、现金及现金等价物净增加额		29,274,894.11	186,095,283.47
加：期初现金及现金等价物余额		89,593,661.06	73,149,680.93
六、期末现金及现金等价物余额		118,868,555.17	259,244,964.40

法定代表人：

**文胜**

主管会计工作的负责人：

**王浦**

会计机构负责人：

**王浦**



# 上海伟测半导体科技股份有限公司

## 财务报表附注

2022 年 1-6 月

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由上海伟测半导体有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，于 2020 年 9 月 4 日在上海市市场监督管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 91310115MA1H7PY66D 的营业执照，现有注册资本 6,540.80 万元，股份总数 6,540.80 万股（每股面值 1 元）。

本公司属集成电路测试行业。主要经营活动为集成电路测试，包括：晶圆测试和芯片成品测试。

### 二、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，除本财务报表附注三所述的会计政策变更事项外，采用的会计政策与上年度财务报表相一致，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 三、公司会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

（一）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（二）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

### 四、经营季节性特征

本公司经营活动不存在季节性特征。

## 五、合并财务报表范围的变更

本期公司合并财务报表范围未发生变更。

## 六、性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的上年年末数和期初数指 2021 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2022 年 6 月 30 日财务报表数，本中期指 2022 年 1-6 月，上年度可比中期指 2021 年 1-6 月。

### （一）合并资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### （1）明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	186,181,797.25	100.00	9,309,089.86	5.00	176,872,707.39
合 计	186,181,797.25	100.00	9,309,089.86	5.00	176,872,707.39

（续上表）

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	137,572,051.95	100.00	6,878,776.50	5.00	130,693,275.45
合 计	137,572,051.95	100.00	6,878,776.50	5.00	130,693,275.45

##### 2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	186,181,797.25	9,309,089.86	5.00
小 计	186,181,797.25	9,309,089.86	5.00



(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收 回	其 他	转 回	核 销	其 他	
按组合计提 坏账准备	6,878,776.50	2,430,313.36						9,309,089.86
合 计	6,878,776.50	2,430,313.36						9,309,089.86

(3) 应收账款金额前 5 名情况

2022 年 6 月 30 日余额前 5 名的应收账款合计数为 84,926,886.21 元，占应收账款余额合计数的比例为 45.61%，相应计提的坏账准备合计数为 4,246,344.31 元。

2. 其他流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
待抵扣增值税	23,953,796.18		23,953,796.18	75,102,854.12		75,102,854.12
IPO 申报费用	3,153,773.59		3,153,773.59	1,327,358.49		1,327,358.49
合 计	27,107,569.77		27,107,569.77	76,430,212.61		76,430,212.61

3. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	办公设备	专用设备	合 计
账面原值				
期初数	18,193,375.24	2,048,495.39	798,276,503.10	818,518,373.73
本期增加金额			350,119,301.16	350,119,301.16
1) 融资租赁到期买 断			64,667,408.18	64,667,408.18
2) 在建工程转入			285,451,892.98	285,451,892.98
本期减少金额			4,035,917.36	4,035,917.36
其中：处置或报废			4,035,917.36	4,035,917.36
期末数	18,193,375.24	2,048,495.39	1,144,359,886.90	1,164,601,757.53

累计折旧				
期初数	379,028.65	984,747.88	106,857,733.64	108,221,510.17
本期增加金额	454,834.38	185,581.28	63,582,783.24	64,223,198.90
1) 计提	454,834.38	185,581.28	49,105,889.40	49,746,305.06
2) 融资租赁到期买断			14,476,893.84	14,476,893.84
本期减少金额			2,456,308.99	2,456,308.99
其中：处置或报废			2,456,308.99	2,456,308.99
期末数	833,863.03	1,170,329.16	167,984,207.89	169,988,400.08
减值准备				
账面价值				
期末账面价值	17,359,512.21	878,166.23	976,375,679.01	994,613,357.45
期初账面价值	17,814,346.59	1,063,747.51	691,418,769.46	710,296,863.56

(2) 经营租出固定资产

项 目	期末账面价值
专用设备	40,485,676.64
小 计	40,485,676.64

(3) 其他说明

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已有账面价值 329,748,138.27 元的专用设备及 17,359,512.21 元的房屋建筑物用于银行借款及融资租赁抵押担保，详见本财务报表附注八(四)之说明。

4. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
测试设备	56,336,794.05		56,336,794.05	79,163,116.39		79,163,116.39
厂务工程				29,097,175.04		29,097,175.04

软件使用权	131,795.47		131,795.47		
其他	4,275,175.46		4,275,175.46	1,369,312.57	1,369,312.57
合 计	60,743,764.98		60,743,764.98	109,629,604.00	109,629,604.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少[注]	期末数
测试设备	79,163,116.39	255,585,590.32	278,411,912.66		56,336,794.05
上海厂务工程	66,019.42			66,019.42	
无锡厂务工程	23,448,467.69	3,551,532.62		27,000,000.31	
南京厂务工程	5,582,687.93	11,431,983.21		17,014,671.14	
软件使用权		1,093,002.20		961,206.73	131,795.47
其他	1,369,312.57	10,254,044.76	7,039,980.32	308,201.55	4,275,175.46
小 计	109,629,604.00	281,916,153.11	285,451,892.98	45,350,099.15	60,743,764.98

[注]其他减少主要系厂务工程转入长期待摊费用、软件使用权转入无形资产以及测试设备转入使用权资产中核算

5. 使用权资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	专用设备	合 计
成本			
期初数	49,381,697.25	260,822,443.93	310,204,141.18
本期增加金额	2,579,940.96		2,579,940.96
其中：经营租入	2,579,940.96		2,579,940.96
本期减少金额	27,068.13	64,667,408.18	64,694,476.31
其中：租赁终止		64,667,408.18	64,667,408.18
租赁内容变更	27,068.13		27,068.13
期末数	51,934,570.08	196,155,035.75	248,089,605.83
累计折旧			

期初数	6,644,569.08	26,307,093.94	32,951,663.02
本期增加金额	4,403,978.05	13,457,733.11	17,861,711.16
其中：计提	4,403,978.05	13,457,733.11	17,861,711.16
本期减少金额	4,511.37	14,476,893.84	14,481,405.21
其中：租赁终止		14,476,893.84	14,476,893.84
租赁内容变更	4,511.37		4,511.37
期末数	11,044,035.76	25,287,933.21	36,331,968.97
减值准备			
账面价值			
期末账面价值	40,890,534.32	170,867,102.54	211,757,636.86
期初账面价值	42,737,128.17	234,515,349.99	277,252,478.16

(2) 其他说明

截至2022年6月30日，公司已有账面价值104,677,118.77元的专用设备用于融资租赁抵押担保，详见本财务报表附注八(四)之说明。

6. 短期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	81,059,023.90	58,868,520.54
信用借款	127,227,755.27	44,039,328.77
合计	208,286,779.17	102,907,849.31

7. 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	79,564,615.08	56,070,206.27
一年内到期的长期应付款	21,000,000.00	
一年内到期的租赁负债	65,867,415.09	104,549,316.69
合计	166,432,030.17	160,619,522.96

## 8. 长期借款

项 目	期末数	期初数
保证及抵押借款	229,993,645.01	166,670,450.52
合 计	229,993,645.01	166,670,450.52

### (二) 合并利润表项目注释

#### 1. 营业收入/营业成本

##### (1) 明细情况

项 目	本中期	上年度可比中期
主营业务收入	340,961,270.12	206,547,340.94
其他业务收入	15,005,855.01	7,616,823.53
营业成本	179,080,011.60	111,658,046.31

##### (2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

2022 年 1-6 月营业收入前 5 名的合计数为 183,700,632.69 元，占营业收入合计数的比例为 51.61%。

#### 2. 管理费用

项 目	本中期	上年度可比中期
职工薪酬	8,641,121.15	3,404,883.44
折旧摊销	2,645,431.36	964,866.62
房租水电费	568,500.38	504,957.82
业务招待费	769,771.06	527,260.04
中介服务费	715,867.78	922,583.65
办公费	481,389.55	561,677.12
维修费	262,114.30	695,721.80
保险费	130,308.47	159,031.61
差旅交通费	107,155.09	208,749.76
其他	241,240.17	330,939.26
合 计	14,562,899.31	8,280,671.12

### 3. 研发费用

项 目	本中期	上年度可比中期
职工薪酬	22,113,184.80	14,646,833.78
折旧与摊销	3,398,037.33	2,884,194.71
机物料消耗费	1,381,766.31	811,839.34
能源费	823,101.92	558,540.14
技术服务费	654,544.00	609,519.46
专利使用权	159,106.38	159,106.44
其他	41,876.10	152,785.15
合 计	28,571,616.84	19,822,819.02

### 4. 财务费用

项 目	本中期	上年度可比中期
利息支出	15,082,836.84	6,855,587.20
汇兑损益	3,502,518.05	-1,606,005.34
票据贴现支出		611,625.00
手续费	417,295.63	57,058.35
减：利息收入	651,548.60	267,144.02
合 计	18,351,101.92	5,651,121.19

### 5. 其他收益

项 目	本中期	上年度可比中期	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	1,529,156.69	260,000.04	1,529,156.69
与收益相关的政府补助	680,300.00	120,900.00	680,300.00
代扣个人所得税手续费返还	35,781.81	10,847.02	35,781.81
增值税加计抵减	1,945,943.48		1,945,943.48
合 计	4,191,181.98	391,747.06	4,191,181.98

## 6. 所得税费用

### (1) 明细情况

项 目	本中期	上年度可比中期
当期所得税费用	-4,513,734.43	7,876,674.39
递延所得税费用	222,156.74	-391,683.66
合 计	-4,291,577.69	7,484,990.73

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本中期	上年度可比中期
利润总额	109,760,797.55	61,667,903.87
按母公司适用税率计算的所得税费用	16,464,119.63	7,708,487.98
子公司适用不同税率的影响	-8,224,709.87	2,243,575.52
调整以前期间所得税的影响	-272,922.22	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	213,203.38	53,047.59
研发加计扣除影响	-2,051,513.44	-2,366,000.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-222,570.34
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	103,928.59	182,471.81
本期税率变动导致递延所得税负债/递延所得税资产计提差异的影响	329,303.71	-114,021.26
税收优惠影响	-10,852,987.47	
所得税费用	-4,291,577.69	7,484,990.73

## 七、关联方关系及其交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
上海蕊测半导体科	上海	半导体芯	23,960,000.00	41.33	41.33

技有限公司		片开发			
-------	--	-----	--	--	--

2. 本公司的子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京伟测半导体科技有限公司	南京	南京	集成电路检测	100.00		设立
无锡伟测半导体科技有限公司	无锡	无锡	集成电路检测	100.00		设立
上海威矽半导体科技有限公司	上海	上海	半导体技术开发	100.00		设立

3. 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
普冉半导体（上海）股份有限公司	董事陈凯担任董事的公司
中微半导体（深圳）股份有限公司	董事陈凯担任董事的公司
江苏长电科技股份有限公司	曾为公司持股 5%以上股东江苏新潮科技集团有限公司曾经控制的公司，根据实质重于形式的原则，将江苏长电科技股份有限公司认定为关联方
星科金朋半导体(江阴)有限公司	江苏长电科技股份有限公司子公司
强一半导体（苏州）有限公司	董事祁耀亮担任董事的公司
上海季丰电子股份有限公司	董事祁耀亮担任董事的公司

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本中期	上年度可比中期
强一半导体（苏州）有限公司	探针卡及维修	688,040.64	582,068.16
上海季丰电子股份有限公司	测试备件及服务	214,951.93	42,590.00
江苏长电科技股份有限公司 [注]	测试设备		3,124,164.00
小 计		902,992.57	3,748,822.16

[注]实际为江苏长电科技股份有限公司、江阴长电先进封装有限公司以及星科金朋半导体(江阴)有限公司合并披露，系关联公司，下同

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易



关联方	关联交易内容	本中期	上年度可比中期
普冉半导体（上海）股份有限公司	检测服务及治具销售	7,629,522.23	9,157,669.58
中微半导体（深圳）股份有限公司	检测服务及治具销售	347,046.85	170,106.41
江苏长电科技股份有限公司	检测服务		353,324.72
小 计		7,976,569.08	9,681,100.71

## 2. 关联租赁情况

### (1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本中期确认的 租赁收入	上年度可比中期确 认的租赁收入
江苏长电科技股份有限公司	检测设备		240,000.00

### (2) 公司承租情况

#### 本中期

出租方名称	租赁资产 种类	简化处理的短期租赁 和低价值资产租赁的 租金费用以及未纳入 租赁负债计量的可变 租赁付款额	支付的租金（不包括简化 处理的短期租赁和低价 值资产租赁的租金以及 未纳入租赁负债计量的 可变租赁付款额）	增加的使用 权资产	确认的利 息支出
江苏长电科技 股份有限公司	检测设备	3,489,945.38			

#### 上年度可比中期

出租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费
江苏长电科技股份有限公司	检测设备	23,121,549.52

## 3. 关联担保情况

### 本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履 行完毕
骈文胜、秦君梅	10,000,000.00	2021/9/26	2022/9/25	否
骈文胜[注 1]	38,000,000.00	2021/6/10	2023/6/9	
骈文胜	15,000,000.00	2021/11/18	2022/11/17	
	2,184,000.00	2021/6/7	2024/6/7	

	5,604,000.00	2021/9/6	2024/6/7
	9,500,000.00	2022/1/28	2023/1/26
骈文胜[注 2]	5,361,348.20	2020/12/15	2023/12/15
	7,241,600.60	2021/1/12	2023/12/15
	7,974,265.98	2021/2/9	2023/12/15
	8,575,677.78	2021/6/3	2024/5/20
骈文胜[注 3]	218,935.24	2019/12/5	2022/12/20
	700,347.03	2019/12/17	2022/12/2
	494,476.99	2019/12/17	2022/12/2
	567,318.94	2020/2/28	2023/2/1
骈文胜、秦君梅、上海蕊测半导体科技有限公司[注 4]	2,319,691.46	2020/5/27	2023/5/12
	2,996,076.25	2020/8/14	2023/8/14
	2,671,808.21	2020/8/14	2023/8/29
	845,090.10	2020/9/3	2023/9/28
	2,283,386.91	2020/11/3	2023/11/16
	1,472,079.03	2020/11/3	2023/11/16
骈文胜、闻国涛[注 5]	4,333,270.31	2021/3/22	2023/3/22
骈文胜、秦君梅[注 6]	1,249,999.93	2020/9/29	2022/9/21
骈文胜[注 7]	1,478,585.75	2021/5/27	2024/5/27
	6,397,761.55	2021/7/9	2024/7/9
骈文胜、闻国涛[注 8]	3,201,457.05	2021/2/22	2023/2/22
上海蕊测半导体科技有限公司	4,072,912.56	2021/6/29	2024/6/29
	10,139,435.23	2021/6/30	2024/6/30
	8,560,677.57	2021/6/30	2024/6/30
骈文胜、上海蕊测半导体科技有限公司	8,706,721.68	2021/7/29	2023/6/29
	6,736,918.19	2021/8/23	2023/7/23
骈文胜、闻国涛[注 9]	1,991,373.43	2020/10/23	2022/10/21
骈文胜[注 10]	130,194,359.32	2021/8/3	2026/8/2

骈文胜	15,201,321.00	2022/1/28	2023/1/20
	11,422,249.51	2022/2/22	2023/2/21
	12,362,398.80	2022/3/1	2023/2/28
	6,966,433.20	2022/3/3	2023/3/1
骈文胜[注 11]	48,333,140.00	2022/3/31	2028/3/23

[注 1] 该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 63,300,248.80 元的固定资产提供抵押担保

[注 2] 该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 30,812,496.97 元的固定资产提供抵押担保

[注 3] 该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 5,307,932.79 元的使用权资产提供抵押担保

[注 4] 该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为 22,104,508.01 元的使用权资产提供抵押担保

[注 5] 该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为 12,704,236.57 元的使用权资产提供抵押担保

[注 6] 该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 11,804,684.06 元的固定资产提供抵押担保

[注 7] 该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为 12,702,099.00 元的使用权资产提供抵押担保

[注 8] 该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 11,770,085.54 元的使用权资产提供抵押担保

[注 9] 该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 32,355,218.69 元的使用权资产提供抵押担保

[注 10] 该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 94,018,711.98 元的固定资产以及账面价值为 7,699,091.43 元的无形资产提供抵押担保

[注 11] 该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 50,192,050.97 元的固定资产提供抵押担保

#### 4. 关键管理人员报酬

项 目	本中期	上年度可比中期
关键管理人员报酬	2,918,987.40	1,769,628.88

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	普冉半导体（上海）股份有限公司	5,167,180.60	258,359.03	2,348,048.51	117,402.43
	中微半导体（深圳）股份有限公司	212,593.06	10,629.65	93,004.81	4,650.24
	江苏长电科技股份有限公司			90,365.51	4,518.28
小 计		5,379,773.66	268,988.68	2,531,418.83	126,570.95

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	强一半导体（苏州）有限公司		1,547,400.48
	上海季丰电子股份有限公司	58,778.00	24,374.10
	星科金朋半导体（江阴）有限公司	465,000.00	870,000.00
小 计		523,778.00	2,441,774.58
其他应付款			
	上海蕊测半导体科技有限公司	1,300.00	1,300.00
小 计		1,300.00	1,300.00

## 八、其他重要事项

(一) 资产负债表日后事项中的非调整事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

(二) 或有事项

截至2022年6月30日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(三) 承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司向银行申请开立但尚未到期的保函保证金余额为 400,000.00 元。除此之外，本公司不存在需要披露的其他重要承诺事项。

(四) 资产受限情况

截至期末，本公司资产受限情况如下：

项 目	账面价值	受限原因
其他货币资金	400,000.00	保函保证金
应收票据	2,912,103.36	票据已背书未终止确认
固定资产	347,107,650.48	用于银行借款及融资租赁抵押担保
使用权资产	104,677,118.77	用于融资租赁抵押担保
无形资产	7,699,091.43	用于银行借款
合 计	462,795,964.04	

**九、其他补充资料**

(一) 非经常性损益

1. 明细情况

项 目	本中期
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	850,453.13
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,945,943.48
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,209,456.69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	49,863.02
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,963.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	5,081,680.04
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	559,127.41
少数股东权益影响额（税后）	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	4,522,552.63

## 2. 重大非经常性损益项目说明

### (1) 与资产相关的政府补助、总额法

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
超大规模集成电路芯片集成测试平台技术改造	9,143,333.17		499,999.84	8,643,333.33	其他收益	上海市经济信息化委、市财政局关于印发《上海市技术改造专项支持实施细则》的通知（沪经信规范〔2018〕1号）
关键核心芯片晶圆级系统级全生态测试能力提升改造	3,880,000.00		342,857.14	3,537,142.86	其他收益	上海市经济信息化委、市财政局关于印发《上海市技术改造专项支持实施细则》的通知（沪经信规范〔2018〕1号）
固定资产投入补贴	4,953,703.70		277,777.80	4,675,925.90	其他收益	《无锡国家高新技术产业开发区管理委员会，关于进一步推动科技创新的实施意见》（锡高管发〔2017〕40号）
设备贴息		1,973,700.00	75,188.57	1,898,511.43	其他收益	《关于做好2021年度部省商务发展资金项目申报工作的通知》锡商财〔2021〕235号
集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目		20,000,000.00	333,333.34	19,666,666.66	其他收益	《集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目补充协议》
小 计	17,977,036.87	21,973,700.00	1,529,156.69	38,421,580.18		

## (2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
外贸稳增长补贴	680,000.00	其他收益	《国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》（国办发〔2020〕28号）
岗前培训补贴	300.00	其他收益	《上海市人力资源和社会保障局 上海市财政局 关于进一步落实受疫情影响企业职工线上职业培训补贴政策有关事项的通知》（沪人社规〔2021〕4号）
小计	680,300.00		

## (二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.93	1.74	1.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.46	1.67	1.67

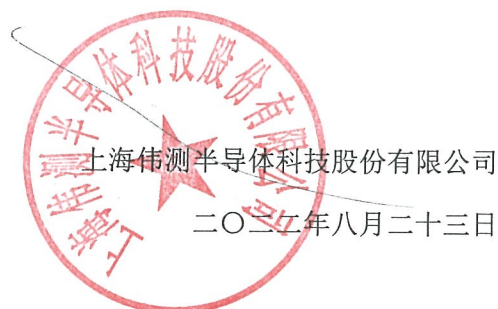
## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本中期
归属于公司普通股股东的净利润	A	114,052,375.24
非经常性损益	B	4,522,552.63
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	109,529,822.61
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	898,956,050.68
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K$	955,982,238.30
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	11.93%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	11.46%

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明



资产负债表项目	期末数	上年年末数	变动幅度 (%)	变动原因说明
应收账款	176,872,707.39	130,693,275.45	35.33	主要系公司本期业务增长, 应收账款相应增加所致
其他流动资产	27,107,569.77	76,430,212.61	-64.53	主要系公司收入进一步增长, 销项税额增加, 导致期末留抵税额减少所致
固定资产	994,613,357.45	710,296,863.56	40.03	主要系公司本期扩大产能, 采购测试设备增加所致
使用权资产	211,757,636.86	277,252,478.16	-23.62	主要系公司融资租赁设备租赁到期, 行使购买选择权所致
短期借款	208,286,779.17	102,907,849.31	1.02 倍	主要系本期新增借款所致
长期借款	229,993,645.01	166,670,450.52	37.99	主要系本期新增借款所致
利润表项目	年初至本中 期末	上年年初至上 年度可比中期末	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	355,967,125.13	214,164,164.47	66.21	主要系公司本期业务规模扩大, 收入增长所致
营业成本	179,080,011.60	111,658,046.31	60.38	主要系公司本期业务规模扩大, 成本相应增加所致
管理费用	14,562,899.31	8,280,671.12	75.87	主要系公司管理人员工资增加, 新设南京子公司故管理费用相应增加以及中介服务费增加所致
研发费用	28,571,616.84	19,822,819.02	44.13	主要系公司工资及折旧费较上年同期增加所致
财务费用	18,351,101.92	5,651,121.19	2.24 倍	主要系公司贷款利息、融资租赁利息、经营租赁利息支出增加所致
所得税费用	-4,291,577.69	7,484,990.73	-157.34	主要系无锡子公司在本期获得两免三减半税收优惠政策批文, 冲销上期计提的企业所得税所致





SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

# 营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



2022年3月1日

仅为上海伟测半导体科技股份有限公司IPO申报之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营\_未经\_本所\_书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



## 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：




2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为上海伟测半导体科技股份有限公司 IPO 申报之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名	顾洪涛
Full name	男
性别	1963-06-25
Sex	天健会计师事务所(特殊普 通合伙)上海分所
出生日期	310105196306250019
Date of birth	身份证号码
工作单位	Identity card No.
Working unit	

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



顾洪涛(310000671542)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

证书编号: 310000671542

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1992年 1月 16日

Due of issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



顾洪涛(310000671542)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

证书编号: 310000671542

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年08月31日

Due of issuance

仅为 上海伟测半导体科技股份有限公司 IPO 申报 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 顾洪涛 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为上海伟测半导体科技股份有限公司 IPO 申报之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 陈灵灵 是中国注册会计师 未经本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

上海伟测半导体科技股份有限公司

内部控制鉴证报告

## 目 录

一、内部控制的鉴证报告..... 第 1—2 页

二、关于内部会计控制制度有关事项的说明..... 第 3—8 页

# 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告

天健审〔2022〕6-269号

上海伟测半导体科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称伟测科技公司）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2021年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

## 一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

## 二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供伟测科技公司首次公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为伟测科技公司首次公开发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起报送。

## 三、管理层的责任

伟测科技公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2021年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

## 四、注册会计师的责任



我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。

## 五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 六、鉴证结论

我们认为，伟测科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二二年四月十五日

# 上海伟测半导体科技股份有限公司

## 关于内部会计控制制度有关事项的说明

### 一、公司基本情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原上海伟测半导体科技有限公司（以下简称伟测半导体公司），伟测半导体公司系由李峰投资设立，于 2016 年 5 月 6 日在上海市浦东新区市场监督管理局登记注册，取得统一社会信用代码为 91310115MA1H7PY66D 的营业执照。伟测半导体公司成立时注册资本 2,000.00 万元。伟测半导体公司以 2020 年 4 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2020 年 9 月 4 日在上海市市场监督管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 91310115MA1H7PY66D 营业执照，注册资本 6,540.80 万元，股份总数 6,540.80 万股（每股面值 1 元）。

本公司属于集成电路测试行业。主要经营活动为集成电路测试。包括：晶圆测试和芯片成品测试。

### 二、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则

#### （一）公司内部会计控制制度的目标

1. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。
2. 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。
3. 确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

#### （二）公司内部会计控制制度建立遵循的基本原则

1. 内部会计控制符合国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求和公司的实际情况。
2. 内部会计控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力。
3. 内部会计控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
4. 内部会计控制保证公司内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

5. 内部会计控制遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

6. 内部会计控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

### 三、公司内部会计控制制度的有关情况

公司 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制制度设置和执行情况如下：

#### (一) 公司的内部控制要素

##### 1. 控制环境

###### (1) 对诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，并通过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行将这些多渠道、全方位地落实。

###### (2) 对胜任能力的重视

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的用途能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识能力的要求。全公司目前共有 927 名员工，其中具有高级职称的 1 人，具有中级职称的 3 人，具有初级职称的 7 人；其中硕士研究生 8 人，本科生 177 人，大专生 296 人。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工都能胜任目前所处的工作岗位。

###### (3) 治理层的参与程序

治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以明确规定。治理层通过其自身的活动并在审计委员会的支持下，监督公司会计政策以及内部、外部的审计工作和结果。治理层的职责还包括了监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。

###### (4) 管理层的理念和经营风格

公司由管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督。董事会、审计委员会对其实施有效地监督。管理层对内部控制包括信息技术控制、信息管理人员以及财会人员都给予了高度重视，对收到的有关内部控制弱点及违规事件报告都及时作出了适当处理。本公司秉承用心服务，客户至上的服务理念，致力于成为国内领先，世界一流的测试服务及解决方案供应商。诚实守信、合法经营。

###### (5) 组织结构

公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。同时，切实做到与公司的控股股东“五独立”。公司已指定专门的人员具体负责内部的稽核，保证相关会计控制制度的贯彻实施。

###### (6) 职权与责任的分配

公司采用向部门分配控制职责的方法，建立了一整套执行特定职能（包括交易授权）的授权机制，并确保每个人都清楚地了解报告关系和责任。为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督，公司逐步建立了预算控制制度，能较及时地按照情况的变化修改会计系统的控制政策。财务部门通过各种措施较合理地保证业务活动按照适当的授权进行；较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合会计准则的相关要求。

#### (7) 人力资源政策与实务

公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。

#### 2. 风险评估过程

公司制定了紧跟行业步伐，不断提供半导体检测技术，夯实业务基础的长远整体目标，并辅以具体策略和业务流程层面的计划将企业经营目标明确地传达到每一位员工。公司建立了有效的风险评估过程，以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。

#### 3. 信息系统与沟通

公司为向管理层及时有效地提供业绩报告建立了强大的信息系统，信息系统人员（包括财务人员）恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行赋予的职责。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。

公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

#### 4. 控制活动

公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层对预算、利润、其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。

(1) 交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

(2) 责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一

个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

(3) 凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等），并且将记录同相应的分录独立比较。

(4) 资产接触与记录使用控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

(5) 独立稽查控制：公司专门设立内审机构，对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

(6) 公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

#### 5. 对控制的监督

公司定期对各项内部控制进行评价，同时一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

#### (二) 公司主要内部控制制度的执行情况和存在的问题

本公司已对内会计控制制度设计和执行的有效性进行自我评估，现对公司主要内会计控制制度的执行情况和存在的问题一并说明如下：

1. 公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司已按国务院《现金管理暂行条例》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。公司已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。公司在 2019 年存在向关联方骈文胜、闻国涛、路峰出借多余资金情形，2019 年合计出借资金 1,780,000.00 元，上述出借资金，公司陆续在各年收回，截至 2020 年末已全部收回上述出借资金，且公司加强并规范资金管理制度，在 2020 年、2021 年公司不存在出借多余资金情况。公司规定下属企业严禁进行期货交易、严禁擅自向外单位出借多余资金、严禁向职工集资、严禁私设银行账户等。上述规范后，公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处。

2. 公司已形成了筹资业务的管理制度，能较合理地确定筹资规模和筹资结构，选择恰当的筹资方式，较严格地控制财务风险，以降低资金成本。公司筹措的资金没有严重背离原计划使用的情况。

3. 公司已较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。明确了周转材料的请购、审批、采购、验收程序，特别对来料检测物资加强了管理。应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。权限上，在公司本部的授权范围内，下属企业可自主对外办理采购与付款业务。公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

4. 公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。

5. 公司已建立了成本费用控制系统及全面的预算体系，能做好成本费用管理和预算的各项基础工作，明确了费用的开支标准。但在及时对比实际业绩和计划目标，并将比较结果作用于实际工作方面还欠深入和及时。

6. 公司已制定了比较可行的销售政策，已对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。股份公司范围内企业之间销售商品、提供劳务按照统一的内部结算价格进行结算。整体来说公司对应收账款回收的管理力度较强，回款速度较快。

7. 公司已建立了较科学的固定资产管理程序及工程项目决策程序。固定资产实行“财务部门负责固定资产的登记，各部门经理、财务总监、总经理负责审批，采购部经理负责供应商洽谈和采购，仓库主管负责验收，设备部门负责设备的后续管理”的办法。固定资产及工程项目的款项必须在相关资产已经落实，手续齐备下才能支付。

8. 为严格控制投资风险，公司建立了较科学的对外投资决策程序，实行重大投资决策的责任制度，相应对外投资的权限集中于公司本部（采用不同的投资额分别由公司不同层次的权力机构决策的机制），各子公司一律不得擅自对外投资。对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节的管理较强。公司没有严重偏离公司投资政策和程序的行为。

#### **四、公司准备采取的措施**

公司现有内部会计控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。对于目前公司在内部会计控制制度方面存在的问题，公司拟采取下列措施加以改进：

（一）进一步完善预算体系与实际业绩的对比情况，制定定期将预算与实际核对的机制，并对比较结果进行分析，将预算体系融入公司日常管理工作中。

（二）进一步完善应收账款的回收管理制度，细化催款责任制，进一步重视对账款回收的管理，优化经营性现金流。

（三）加大力度开展相关人员的培训工作，学习相关法律法规制度准则，及时更新知识，

不断提高员工相应的工作胜任能力。

综上，公司认为，根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

上海伟测半导体科技股份有限公司

二〇二二年四月十五日







	
<h2>会计师事务所 执业证书</h2>	
名 称:	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
首席合伙人:	胡少先
主任会计师:	
经 营 场 所:	浙江省杭州市西溪路128号6楼
组 织 形 式:	特殊普通合伙
执业证书编号:	33000001
批准执业文号:	浙财会 (2011) 25 号
批准执业日期:	1998 年 11 月 21 日设立, 2011 年 6 月 20 日转制

证书序号: 0007666

### 说 明

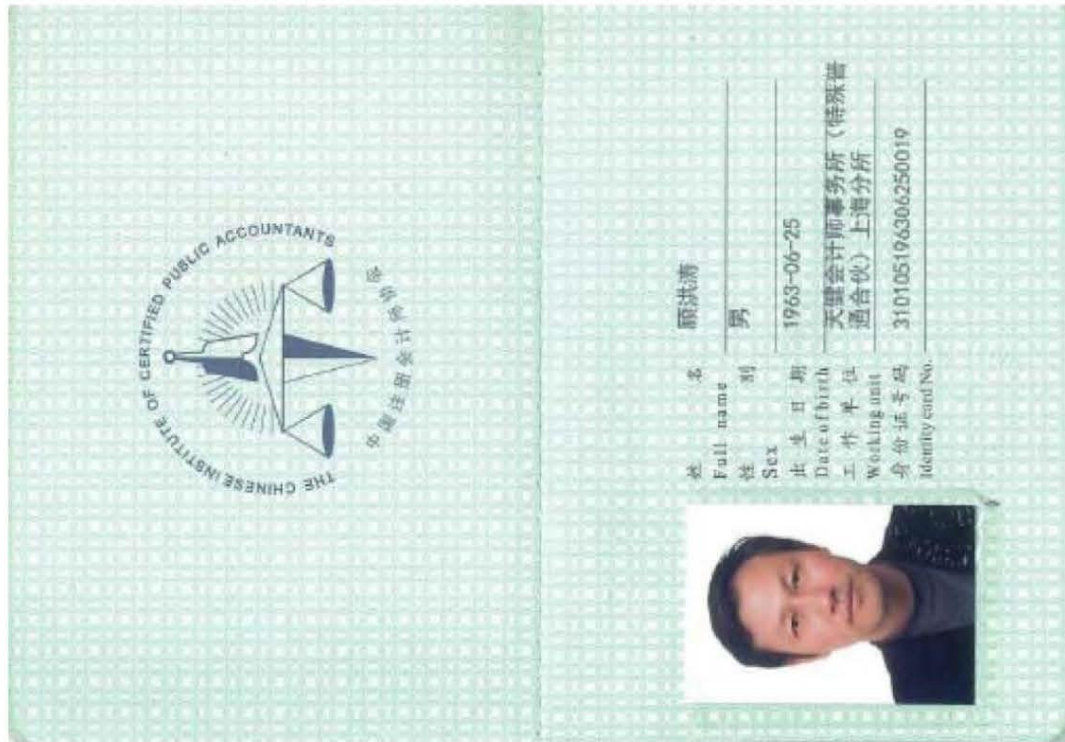
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:  2019 年 12 月 25 日

中华人民共和国财政部制



仅为上海伟测半导体科技股份有限公司 IPO 申报之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有执业资质, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



仅为 上海伟测半导体科技股份有限公司 IPO 申报 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 顾洪涛 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为上海伟测半导体科技股份有限公司 IPO 申报之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 陈灵灵 是中国注册会计师 未经本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

上海伟测半导体科技股份有限公司

最近三年非经常性损益鉴证报告

## 目 录

一、最近三年非经常性损益的鉴证报告·····	第 1—2 页
二、最近三年非经常性损益明细表·····	第 3—4 页
三、最近三年非经常性损益明细表附注·····	第 5—8 页

# 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告

天健审〔2022〕6-271号

上海伟测半导体科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称伟测科技公司）管理层编制的最近三年非经常性损益明细表（2019—2021年度）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供伟测科技公司首次公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为伟测科技公司首次公开发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

## 二、管理层的责任

伟测科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的规定编制非经常性损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对伟测科技公司管理层编制的上述明细表独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，伟测科技公司管理层编制的非经常性损益明细表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的规定，如实反映了伟测科技公司最近三年非经常性损益情况。



中国注册会计师：  

中国注册会计师：  

二〇二二年四月十五日

### 最近三年非经常性损益明细表

编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	195,843.41		-36,898.60
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,948,825.72	4,665,773.81	2,416,056.12
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	237,750.80	39,057.54	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			



项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,858.70	9,907.21	-6,588.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-2,155,804.20	-1,527,765.26
小 计	5,379,561.23	2,558,934.36	844,803.84
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	801,165.90	314,129.30	105,600.48
少数股东损益			
归属于母公司股东的非经常性损益净额	4,578,395.33	2,244,805.06	739,203.36

法定代表人：




主管会计工作的负责人：




会计机构负责人：




**上海伟测半导体科技股份有限公司**  
**最近三年非经常性损益明细表附注**

金额单位：人民币元

**一、重大非经常性损益项目说明**

(一) 计入当期损益的政府补助

1. 2021 年度

项 目	金 额	依据文件
进口设备贴息	2,053,154.34	财政部 商务部关于印发《外经贸发展专项资金管理办法》的通知(财企(2014)36号)及《上海市商务委关于2020年进口贴息资金申报的通知》
小巨人项目补贴	600,000.00	关于印发《上海市科技小巨人工程实施办法》的通知_规范性文件沪科规(2021)12号
科技发展基金	600,000.00	《浦东新区科技发展基金重点企业研发机构补贴资金操作细则》
政策扶持补贴	568,500.00	《无锡国家高新技术产业开发区管理委员会,关于进一步推动科技创新的实施意见》(锡高管发(2017)40号)
超大规模集成电路芯片集成测试平台技术改造	520,000.08	上海市经济信息化委、市财政局关于印发《上海市技术改造专项支持实施细则》的通知(沪经信规范(2018)1号)
中小企业专项补贴	250,000.00	《浦东新区科技发展基金重点企业研发机构补贴资金操作细则》
关键核心芯片晶圆级系统级全生态测试能力提升改造	120,000.00	上海市经济信息化委、市财政局关于印发《上海市技术改造专项支持实施细则》的通知(沪经信规范(2018)1号)
创新业务补贴	95,000.00	《上海市经济信息化委 市财政局关于开展2020年融资担保创新业务支持项目申报工作的通知》(沪经信企(2020)1051号)
固定资产投资补贴	46,296.30	《无锡国家高新技术产业开发区管理委员会,关于进一步推动科技创新的实施意见》(锡高管发(2017)40号)
担保补贴	40,375.00	《关于延续〈浦东新区小微企业增信基金管理办法〉的通知》(浦财经(2019)18号)
稳岗补贴	27,700.00	《关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划大力开展以工代训工作的通知》(锡人社发(2020)59号)及和《关于进一步支持企业开展以工代训工作的补

		充通知》(锡人社发〔2020〕75号)
岗前培训补贴	12,000.00	《上海市人力资源和社会保障局 上海市财政局 关于进一步落实受疫情影响企业职工线上职业培训补贴政策有关事项的通知》(沪人社规〔2021〕4号)
专利资助款	7,500.00	《上海市专利资助办法(沪知局规〔2018〕1号)》
就业补贴	3,000.00	《省政府关于应对新型冠状病毒肺炎疫情影响推动经济循环畅通和稳定持续发展的若干政策措施》(苏政发〔2020〕15号)、《市委市政府关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关保障经济平稳运行的政策意见的通知》(锡委发〔2020〕20号)
毕业生补贴	2,000.00	《无锡市人民政府关于促进高校毕业生来锡就业创业的若干措施的通知》(锡政发〔2020〕12号)
其他	3,300.00	
合 计	4,948,825.72	

## 2. 2020 年度

项 目	金 额	依据文件
2020 年第三批中小企业发展专项资金	900,000.00	《上海市中小企业专项资金管理办法》(沪经信规范〔2019〕9号)
基于集成电路测试大数据的自动测试平台	850,000.00	《浦东新区智慧城市建设专项资金管理办法》
科技发展基金	800,000.00	《浦东新区科技发展基金重点企业研发机构补贴资金操作细则》
进口设备贴息	817,991.62	财政部 商务部关于印发《外经贸发展专项资金管理办法》的通知(财企〔2014〕36号)及《上海市商务委关于2020年进口贴息资金申报的通知》
超大规模集成电路芯片集成测试平台技术改造	520,000.08	上海市经济信息化委、市财政局关于印发《上海市技术改造专项支持实施细则》的通知(沪经信规范〔2018〕1号)
支持高成长科创小微企业	400,000.00	《关于开展2020年度浦东新区促进小微企业创新创业财政扶持项目申报工作的通知》
科技券	247,781.11	《关于开展2020年度浦东新区科技发展基金科技创新券专项资金申报工作的通知》
稳岗补贴	60,530.00	《关于做好本市稳就业工作有关

		事项的通知》（沪人社规〔2019〕34号）
履约保险保费补贴	52,371.00	关于开展2020年度浦东新区科技发展基金科技型小微企业贷款贴息专项资金申报工作的通知
岗前培训	15,300.00	中共无锡市委、无锡市人民政府印发《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关保障经济平稳运行的政策意见》的通知
培训补贴	1,800.00	
合计	4,665,773.81	

### 3. 2019年度

项目	金额	依据文件
支持小微企业创新能力补贴款	1,000,000.00	《浦东新区促进小微企业创新创业财政扶持办法实施细则》
科技型中小企业技术创新基金	652,100.00	《关于开展2019年度浦东新区促进小微企业创新创业财政扶持项目申报工作的通知》
第七届创新创业大赛三等奖	300,000.00	获得第七届中国创新创业大赛成长组优秀企业奖
超大规模集成电路芯片集成测试平台技术改造	216,666.67	上海市经济信息化委、市财政局关于印发《上海市技术改造专项支持实施细则》的通知（沪经信规范〔2018〕1号）
进口设备贴息	211,692.45	财政部 商务部关于印发《外经贸发展专项资金管理办法》的通知（财企〔2014〕36号）及《上海市商务委关于2019年中央进口贴息资金申报的通知》
稳岗补贴	35,597.00	《关于做好本市稳就业工作有关事项的通知》（沪人社规〔2019〕34号）
合计	2,416,056.12	

## 二、“其他符合非经常性损益定义的损益项目”说明

2019年度其他符合非经常性损益定义的损益项目系公司股东上海芯伟半导体合伙企业（有限合伙）（以下简称上海芯伟）于2019年设立并对本公司出资，上海芯伟系伟测科技公司员工持股平台，部分员工通过上海芯伟间接持有公司股份1,621,915股，出资价为每股12.33元与公司同时期其他投资者出资价的差异确认为股份支付，并一次性计入当期损益，属于非经常性损益。2020年度其他符合非经常性损益定义的损益项目系公司员工持股平台上海芯伟原股东将部分合伙企业的财产份额转让给其他员工，其他员工通过上海芯伟间接持有公司股份145,972.35股。股权转让价与公司同时期其他投资者出资价的差异确认为股份支付，并一次性计入当期损益，属于非经常损益。

第7页共8页

3-2-5-9

支付，并一次性计入当期损益，属于非经常损益。

**三、根据公司自身正常经营业务的性质和特点将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明**

无根据公司自身正常经营业务的性质和特点将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

上海伟测半导体科技股份有限公司



二〇二二年四月十五日



# 营业执照 (副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定及其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2022年3月1日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>  
市场监管总局监制  
国家市场监管总局监制  
本所 未经 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。  
仅为上海伟测半导体科技股份有限公司 IPO 申报之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 合法经营



## 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日改制

证书序号：0007666

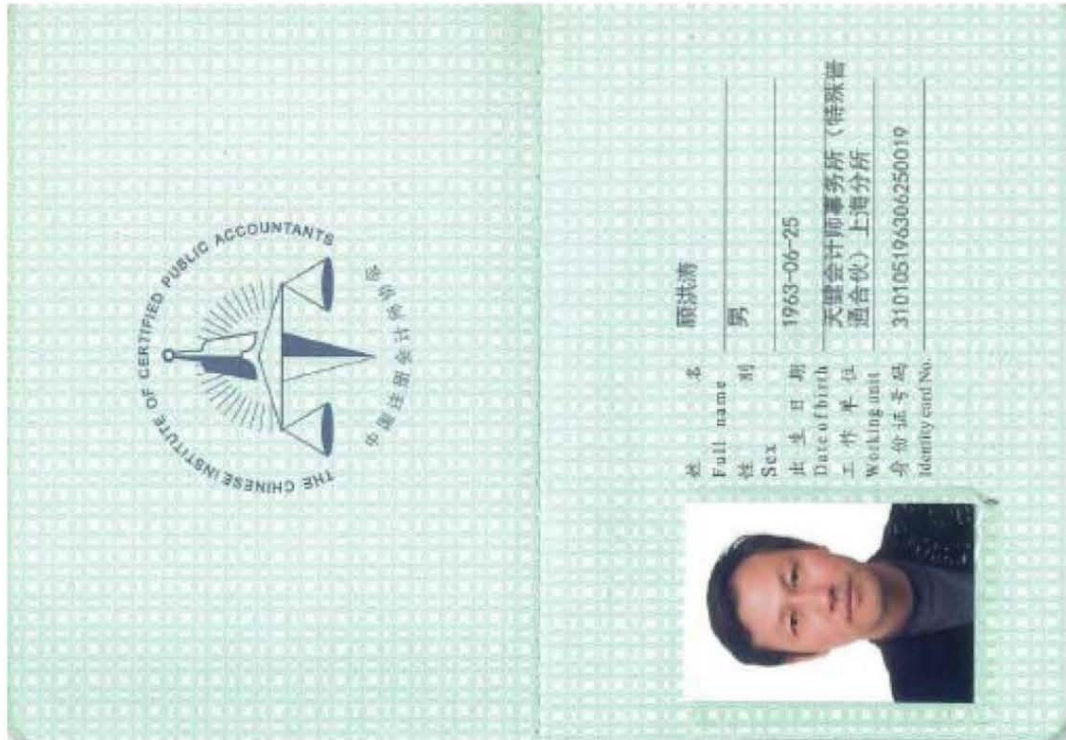
### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：浙江省财政厅  
2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为上海伟测半导体科技股份有限公司IPO申报材料之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为 上海伟测半导体科技股份有限公司 IPO 申报 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 顾洪涛 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





仅为上海伟测半导体科技股份有限公司 IPO 申报之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 陈灵灵 是中国注册会计师 未经本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

上海市锦天城律师事务所  
关于上海伟测半导体科技股份有限公司  
首次公开发行股票并在科创板上市的

法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层  
电话：021-20511000                      传真：021-20511999  
邮编：200120

## 目 录

声明事项.....	1
释 义.....	3
正 文.....	5
一、 本次发行上市的批准和授权.....	5
二、 发行人本次发行上市的主体资格.....	5
三、 发行人本次发行上市的实质条件.....	6
四、 发行人的设立.....	11
五、 发行人的独立性.....	12
六、 发起人、股东及实际控制人.....	13
七、 发行人的股本及其演变.....	14
八、 发行人的业务.....	14
九、 关联交易及同业竞争.....	15
十、 发行人的主要财产.....	16
十一、 发行人的重大债权债务.....	16
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并.....	17
十三、 发行人公司章程的制定与修改.....	17
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	18
十五、 发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化.....	18
十六、 发行人的税务.....	19
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.....	19
十八、 发行人募集资金的运用.....	20
十九、 发行人业务发展目标.....	20
二十、 诉讼、仲裁或行政处罚.....	20
二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价.....	21
二十二、 发行人律师认为需要说明的其他问题.....	21
二十三、 结论意见.....	22

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于上海伟测半导体科技股份有限公司**  
**首次公开发行股票并在科创板上市的**  
**法律意见书**

案号：01F20202132

**致：上海伟测半导体科技股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“伟测科技”）的委托，并根据发行人与本所签订的《聘请律师合同》，作为发行人首次公开发行股票并在科创板上市项目（以下简称“本次发行上市”）的特聘专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《科创板首发管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，就本次发行上市所涉有关事宜出具本法律意见书。

### 声明事项

一、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

二、本所及本所律师仅就与发行人本次发行上市有关法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估、内部控制、盈利预测等专业事项发表意见。在本法律意见书和为本次发行上市出具的《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告和内部控制报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。

三、本法律意见书中，本所及本所律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件发生时所应当适用的法律、法规、规章及规范性文件为依据。

四、本法律意见书的出具已经得到发行人如下保证：发行人已经提供了本所为出具本法律意见书和《律师工作报告》所要求发行人提供的全部原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

五、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依据有关政府部门、发行人或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见。

六、本所同意发行人在《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》（以下简称“《招股说明书（申报稿）》”）中自行引用或按上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核要求引用本法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

七、本法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所及本所律师根据有关法律、法规、规章和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上交所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

## 释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述含义：

发行人、伟测科技、公司	指	上海伟测半导体科技股份有限公司
伟测有限	指	上海伟测半导体科技有限公司，发行人前身
蕊测半导体、控股股东	指	上海蕊测半导体科技有限公司，发行人股东
芯伟半导体	指	上海芯伟半导体合伙企业（有限合伙），发行人股东
苏民智能	指	苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业（有限合伙），发行人股东
先锋智造	指	无锡先锋智造投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
走泉元禾	指	江苏走泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
深圳南海	指	深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙），发行人股东
新潮投资	指	江苏新潮创新投资集团有限公司，发行人股东
金浦新潮	指	南京金浦新潮创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
远海明晟	指	远海明晟（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
德同合心	指	苏州市德同合心创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
云泽裕庆	指	克拉玛依云泽裕庆股权投资有限合伙企业，发行人股东
南山基金	指	中小企业发展基金（深圳南山有限合伙），发行人股东
子公司	指	发行人合并报表范围内的全资、控股子公司
本所、锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
保荐机构、平安证券	指	平安证券股份有限公司
天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
A 股	指	境内上市人民币普通股
本次发行上市、本次发行	指	发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市
报告期、三年一期	指	2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月
《招股说明书（申报稿）》	指	发行人为本次发行上市制作的《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》
《上市保荐书》	指	保荐机构出具的《关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》

《预计市值的分析报告》	指	保荐机构出具的《关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之预计市值的分析报告》
法律意见书、本法律意见书	指	《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》
《审计报告》	指	天健会计师出具的“天健审〔2021〕6-331号”《上海伟测半导体科技股份有限公司审计报告》
《内控鉴证报告》	指	天健会计师出具的“天健审〔2021〕6-332号”《关于上海伟测半导体科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》
《公司章程》	指	根据上下文意所需，指发行人及其前身制定并不时修订的公司章程，另有说明的除外
《公司章程(草案)》	指	发行人为本次发行上市制定的《上海伟测半导体科技股份有限公司章程(草案)》，于2021年10月8日经发行人2021年第二次临时股东大会审议通过，于发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌交易之日起生效
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《科创板首发管理办法》	指	《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》
《科创板股票上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
中国、境内	指	中华人民共和国(包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)，为本法律意见书之目的，指中国大陆地区
境外	指	除中国大陆地区以外的国家及地区
法律法规	指	提及当时公布并生效的中国大陆法律、行政法规、地方性法规、规章以及规范性文件
国家企业信用信息公示系统	指	中华人民共和国国家市场监督管理总局主办的国家企业信用信息公示系统网站，其网址为 <a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a>
元、万元	指	人民币元、万元，上下文另有说明的除外

注：除特别说明外，本法律意见书中若出现总计数与分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

## 正文

### 一、本次发行上市的批准和授权

(一) 2021年9月20日, 发行人召开第一届董事会第九次会议, 审议通过了与本次发行上市有关的议案, 并决定将上述议案提请发行人于2021年10月8日召开的2021年第二次临时股东大会审议。

(二) 2021年10月8日, 发行人召开2021年第二次临时股东大会, 审议批准了与本次发行上市有关的议案。

经本所律师查验, 发行人2021年第二次临时股东大会的召集、召开方式、与会股东资格、表决方式及决议内容, 符合《证券法》《公司法》《科创板首发管理办法》等有关法律法规以及公司章程的规定; 该次股东大会授权董事会办理有关本次发行上市事宜的授权范围及程序合法、有效。

综上所述, 本所律师认为, 发行人2021年第二次临时股东大会已依法定程序做出批准本次发行上市的决议; 股东大会决议中关于本次发行上市的内容合法有效; 发行人股东大会已授权董事会办理本次发行上市相关事宜, 该等授权的授权范围、程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定, 合法有效。发行人本次发行上市尚需取得上交所的审核同意并经中国证监会注册, 待完成公开发售后, 股票上市尚需取得上交所的同意。

### 二、发行人本次发行上市的主体资格

(一) 根据上海市市场监督管理局于2021年6月17日颁发的现行有效《营业执照》, 并经本所律师对国家企业信用信息公示系统的公开查询, 截至本法律意见书出具之日, 发行人基本信息如下:

企业名称	上海伟测半导体科技股份有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1H7PY66D
住所	上海市浦东新区东胜路38号A区2栋2F
法定代表人	骈文胜
注册资本	6,540.80 万元



公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立日期	2016年05月06日
经营期限	2016年05月06日至2066年05月05日
经营范围	一般项目：半导体芯片的研发、测试、销售，电子器件制造（除显示器件、集成电路，有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的），电子产品、计算机软硬件的开发及销售，仪器仪表、机电设备的销售，自有设备租赁，从事半导体芯片测试领域内的技术服务、技术咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）发行人系由伟测有限按账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，发行人设立的程序、资格、条件、方式等符合当时法律法规的规定。根据发行人的公司章程，发行人是长期存续的股份有限公司。根据发行人的确认、以及本所律师对国家企业信用信息公示系统的公开查询，截至本法律意见书出具之日，发行人未出现根据法律法规、发行人《公司章程》需要终止的情形。

（三）伟测有限设立时于2016年5月6日取得了上海市浦东新区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310115MA1H7PY66D）。自伟测有限设立之日起算，至本法律意见书出具之日，发行人持续经营时间已经超过三年。

（四）经本所律师查验，发行人已经具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

综上所述，本所律师认为，发行人为依法设立、有效存续且持续经营时间三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《科创板首发管理办法》第十条之规定，具备本次发行上市的主体资格，截至本法律意见书出具之日，发行人未出现根据法律法规及《公司章程》需要终止的情形。

### 三、发行人本次发行上市的实质条件

经逐条对照《公司法》《证券法》《科创板首发管理办法》《科创板股票上市规则》等法律法规的规定，本所律师认为，发行人符合股份有限公司公开发行新股及申请股票在科创板上市的相关实质条件：

(一) 发行人本次发行上市符合《公司法》及《证券法》规定的相关条件

1、发行人已就本次发行上市聘请了平安证券作为保荐机构，符合《证券法》第十条第一款的规定。

2、根据发行人本次发行的《招股说明书（申报稿）》及发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过之《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》，发行人本次发行的股票均为人民币普通股（A 股）股票，每一股份具有同等权利，每股的发行条件和价格相同，发行价格根据向询价对象询价结果并参考市场情况确定，不低于票面金额，符合《公司法》第一百二十六条、一百二十七条的规定。

3、根据发行人 2021 年第二次临时股东大会会议文件，发行人本次发行已经依照《公司章程》的规定由股东大会和董事会对发行股票的种类、数量、价格、对象等事项作出决议，符合《公司法》第一百三十三条的规定。

4、经本所律师查验，发行人已设立了股东大会、董事会、监事会及董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，选举了董事（包括独立董事）、各董事会专门委员会委员、监事（包括职工代表监事），并聘请了总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员，在报告期内发行人根据《公司章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会会议，历次股东大会、董事会和监事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法規以及当时适用的《公司章程》的规定，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项之规定。

5、发行人为长期存续的股份有限公司，其依照法律的规定在其经营范围内开展经营活动，截至本法律意见书出具之日，发行人依法有效存续，生产经营正常，具备生产经营所需的各项资质证书，能够支付到期债务，不存在影响其持续经营的法律障碍，具有持续经营能力。根据《审计报告》，发行人业务在报告期内有包括现金流量、营业收入、交易客户、管理费用支出等内容的持续营运记录；发行人不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项；亦不存在依据《公司法》及《公司章程》规定需要解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项之规定。

6、根据《审计报告》，发行人有关会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。天健会计师针对发行人最近三年一期的财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项之规定。

7、根据发行人及其控股股东、实际控制人出具的确认、公安机关出具的无犯罪记录证明、本所律师与实际控制人、发行人主要负责人的面谈及通过中国证监会、中国执行信息公开网等网站的公开查询，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项之规定。

## （二）发行人本次发行上市符合《科创板首发管理办法》规定的发行条件

1、经本所律师查验，发行人是依法设立且持续经营 3 年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，具备本次发行上市的主体资格，符合《科创板首发管理办法》第十条之规定。

2、根据《审计报告》及发行人的确认，并经本所律师访谈发行人财务总监，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由天健会计师出具了标准无保留意见的《审计报告》，符合《科创板首发管理办法》第十一条第一款之规定。

3、根据《内控鉴证报告》及发行人的确认，并经本所律师查验，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由天健会计师出具了无保留结论的《内控鉴证报告》，符合《科创板首发管理办法》第十一条第二款之规定。

4、经本所律师查验，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《科创板首发管理办法》第十二条第一款第（一）项之规定。

5、经本所律师查验，最近 2 年内发行人主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员没有发生重大不利变化，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近两年实际控制人没有发生变更，符合《科

科创板首发管理办法》第十二条第一款第（二）项之规定。

6、经本所律师查验，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等重大权属纠纷，发行人不存在重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项。根据《招股说明书（申报稿）》及本所律师与发行人管理层的访谈，截至本法律意见书出具之日，在其合理预见范围内，不存在发行人所处行业的经营环境已经或者将要发生重大变化并对发行人持续经营有重大不利影响，亦不存在其他对发行人持续经营有重大不利影响的事项，发行人已经在《招股说明书（申报稿）》披露了相关风险因素，符合《科创板首发管理办法》第十二条第一款第（三）项之规定。

7、根据《招股说明书（申报稿）》及发行人的说明，发行人的主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。发行人及其子公司所从事的业务均在工商行政管理部门登记的经营范围内，发行人主营业务所属的行业亦为国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年修订）中的“鼓励类”产业。其经营符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，符合国家产业政策。经本所律师查验，发行人持有经营所需的各项资质证书，有关证书均在有效期内。经本所律师比对国家发展和改革委员会颁布之《产业结构调整指导目录（2019年本）》及中华人民共和国环境保护部颁布之《环境保护综合名录（2021年版）》，发行人现有经营不涉及前述产业结构调整指导目录中列示的限制类和淘汰类产业，发行人现有产品不属于前述环境保护综合名录中列示的高污染、高环境风险产品，符合《科创板首发管理办法》第十三条第一款之规定。

8、根据发行人及其控股股东、实际控制人出具的确认、本所律师与发行人主要法务负责人的面谈，并经本所律师通过中国证监会、中国执行信息公开网等网站进行公开查询，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《科创板首发管理办法》第十三条第二款之规定。

9、根据发行人的确认、发行人董事、监事及高级管理人员填写的调查表、作出的声明和承诺以及公安机关出具的无犯罪记录证明，并经本所律师通过中国

证监会、中国执行信息公开网等网站的公开查询，发行人的现任董事、监事和高级管理人员不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《科创板首发管理办法》第十三条第三款之规定。

**（三）发行人本次发行上市符合《科创板股票上市规则》规定的上市条件**

1、如本法律意见书前文所述，发行人满足《科创板首发管理办法》第十条至第十三条规定的发行条件，符合《科创板股票上市规则》第2.1.1条第一款第（一）项之规定。

2、根据发行人的历次验资报告以及发行人现时有效的《营业执照》，发行人本次发行上市前股本总额为6,540.8万元，发行后股本总额不会低于3,000万元，符合《科创板股票上市规则》第2.1.1条第一款第（二）项之规定。

3、根据经发行人2021年第二次临时股东大会审议通过之《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》及《招股说明书（申报稿）》，发行人本次发行前股份总数为6,540.8万股，发行人本次拟向社会公开发行的股份数不超过2,180.27万股，本次发行方案确定的拟发行股份数不低于发行后总股本的25%，符合《科创板股票上市规则》第2.1.1条第一款第（三）项之规定。

4、根据《上市保荐书》及《预计市值的分析报告》，发行人预计总市值不低于人民币10亿元，根据《审计报告》，发行人2020年度经审计的净利润为34,846,264.67元且营业收入为161,196,220.78元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元，发行人的市值及财务指标符合《科创板股票上市规则》第2.1.2条规定的第一项标准，发行人符合《科创板股票上市规则》第2.1.1条第一款第（四）项之规定。

**（四）发行人符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（1）-（4）项之规定**

1、根据《审计报告》，发行人2018年、2019年、2020年的研发费用分别为7,700,810.45元、13,371,662.77元、21,013,963.09元，占最近三年营业收入的比例分别为17.63%、17.16%、13.04%，满足最近三年研发投入占营业收入比例5%以上的要求，符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（1）项之规定。

2、根据《招股说明书（申报稿）》，截至2020年末，公司研发人员总数为100人，公司员工总数为311人，研发人员占当年公司员工总人数的比例为32.15%，不低于10%，因此符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（2）项之规定。

3、经本所律师查验有关专利证书以及本所律师通过国家知识产权局公开信息的查询，截至本法律意见书出具之日，发行人及其子公司合法拥有6项形成主营业务收入的发明专利。因此符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（3）项之规定。

4、根据《审计报告》，发行人2018年、2019年、2020年的营业收入分别为43,689,477.38元、77,933,235.29元、161,196,220.78元，复合增长率超过20%，因此符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（4）项之规定。

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行上市已经满足《公司法》《证券法》《科创板首发管理办法》《科创板股票上市规则》《科创属性评价指引（试行）》规定的各项实质条件，尚需取得上交所的审核通过并经中国证监会同意注册，待完成公开发行后，股票上市尚需取得上交所的同意。

#### 四、发行人的设立

（一）发行人采取发起设立的方式由伟测有限按原账面净资产值整体折股变更为股份有限公司，发行人设立的程序、资格、条件和方式，符合法律法规的规定，并已办理相关登记及备案手续。

（二）发行人在设立过程中签署的《发起人协议》，符合法律法规的规定。

（三）发行人在由有限责任公司整体变更为股份有限公司的过程中已经履行了有关审计、评估及验资等必要程序，符合法律法规的规定。

（四）发行人设立时股东大会的程序及所议事项符合法律法规的规定。

（五）发行人设立的程序、发起人资格、条件和方式，符合法律法规的规定，并已办理相关登记及备案手续；发行人设立过程中签署的《发起人协议》符合有关法律法规的规定，不会因此引致发行人设立行为存在潜在纠纷；发行人设立过程中已履行了必要的评估、审计、验资程序，符合法律法规的要求；

发行人创立大会的程序及所议事项符合法律法规的规定。

## 五、发行人的独立性

### （一）发行人的资产独立完整

根据相关资产评估报告、验资报告，经本所律师核查，发行人设立已经天健会计师事务所验资，发行人注册资本已足额缴纳。根据发行人提供的不动产登记证书、商标注册证、专利证书等有关文件资料，发行人合法拥有与经营相关的不动产权、注册商标权、专利权，且不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用的情形。据此，本所律师认为，发行人的资产独立完整。

### （二）发行人的人员独立

根据发行人与其高级管理人员签订的劳动合同以及发行人提供的董事、监事及高级管理人员收入情况说明并经本所律师核查，发行人的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均与发行人签订劳动合同，均在发行人领取薪酬。发行人的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领取薪酬，且发行人的财务人员也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。据此，本所律师认为，发行人在人员方面具有独立性。

### （三）发行人的财务独立

经发行人说明、本所律师访谈发行人财务总监并经本所律师核查，发行人已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度；发行人独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；发行人的财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。据此，本所律师认为，发行人在财务方面具有独立性。

### （四）发行人的机构独立

根据发行人提供的组织结构图并经本所律师实地调查，发行人设立了制造部、研发中心、销售客服部、质量部、采购部、人力资源部、财务部等内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。不存在发行人内部经营管理机构与其控股股

东、实际控制人控制的其他企业发生机构混同的情形。据此，本所律师认为，发行人在机构方面具有独立性。

#### （五）发行人的业务独立

根据《招股说明书（申报稿）》及发行人的说明，发行人主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。根据天健会计师出具的《审计报告》，并经本所律师核查，发行人业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。据此，本所律师认为，发行人在业务方面具有独立性。

综上所述，本所律师认为，发行人资产独立完整，业务、人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

## 六、发起人、股东及实际控制人

（一）经本所律师查验，发行人设立时共有 9 名发起人，分别为蕊测半导体、惠泉元禾、苏民智能、深圳南海、金浦新潮、芯伟半导体、新潮投资、涂洁、先锋智造。发行人的上述发起人中，1 名发起人为中国国籍自然人，2 名发起人为依照中国法律设立的有限责任公司，6 名发起人为依照中国法律设立有限合伙企业。该等发起人均具备向发行人出资、成为发起人股东的资格，发行人的发起人人数、住所和出资比例均符合有关法律法规的规定。

（二）发起人股东在发行人设立前所持有的伟测有限股权权属清晰，其以净资产折股方式认缴发行人的股本符合《公司法》的规定，不存在法律障碍。

（三）截至本法律意见书出具之日，发行人共有 16 名股东，其中自然人股东 2 名，机构股东 14 名。该等股东均具备法律法规规定担任股份有限公司股东的资格。

（四）经本所律师查验，发行人是由有限责任公司整体变更为股份有限公司，伟测有限的债权债务依法由发行人承继，不存在法律障碍和风险。

（五）发行人的控股股东为蕊测半导体，骈文胜系发行人的实际控制人。根据《<首次公开发行股票并上市管理办法>第十二条“实际控制人没有发生变



更”的理解和适用-证券期货法律适用意见第1号》的规定，发行人最近两年的实际控制人未发生变化，实际控制权稳定。

（六）经本所律师查验，发行人不存在申报前一年内新增股东的情形。

## 七、发行人的股本及其演变

（一）经本所律师查验，伟测有限设立后至今历次股权结构的变动均已依法履行公司内部决策程序，历次股权变动合法、有效。

（二）经本所律师查验，发行人的股权清晰，各股东所持发行人的股份不存在冻结、质押等权利限制情形。

## 八、发行人的业务

（一）经本所律师查验，发行人主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。与其《营业执照》所记载的经营范围相符，其经营范围和经营方式符合有关法律法规的规定。

（二）经本所律师查验，发行人及其子公司实际从事的业务没有超出其营业执照核准的经营范围，其经营范围和经营方式符合有关法律法规的规定。

（三）经本所律师查验，截至本法律意见书出具之日，发行人没有在中国大陆以外的其他国家和地区从事经营活动。

（四）经本所律师查验，发行人最近两年的主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。最近两年，发行人主营业务未发生变更。

（五）根据《审计报告》，报告期内发行人的营业收入以主营业务为主，发行人的主营业务突出。

（六）经本所律师查验，截至本法律意见书出具之日，发行人及子公司依照法律法规在其经营范围内开展经营，具备生产经营所需的各项资质证书或认证、备案文件，不存在影响其持续经营的法律障碍。根据《招股说明书（申报稿）》及发行人确认，截至本法律意见书出具之日，在其合理预见范围内，不存在发行人所处行业的产业政策已经或者将要发生重大变化并对发行人持续经

营有重大不利影响的情形，发行人已经在《招股说明书（申报稿）》披露了相关风险因素。

## 九、关联交易及同业竞争

（一）经本所律师查验，截至本法律意见书出具之日，发行人的主要关联方已经列于《律师工作报告》正文第九部分“关联交易及同业竞争”之“（一）关联方”。

（二）在报告期内，除向董事、监事、高级管理人员支付薪酬外，发行人与关联方之间存在关联担保、关联方往来等关联交易。发行人于报告期内向董事、监事及高级管理人员支付薪酬情况及发行人与其关联方之间发生的关联交易已经列于《律师工作报告》正文第九部分“关联交易及同业竞争”之“（二）关联交易”。经本所律师查验，发行人与其关联方之间进行的基础性关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则，经常性的关联交易和偶发性的关联交易对公司的财务状况和经营成果未产生重大不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

（三）经本所律师查验，发行人已制定关联交易的决策程序。

（四）为有效规范和减少关联交易，发行人控股股东蕊测半导体、实际控制人骈文胜、持股 5%以上的股东及发行人董事、监事、高级管理人员分别出具了书面承诺，上述承诺内容合法、有效，且对承诺人有约束力。

（五）截至本法律意见书出具之日，发行人的控股股东蕊测半导体、实际控制人骈文胜及其控制的其他企业均未从事与发行人业务相同或相似的业务；发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。为有效防止及避免同业竞争，发行人控股股东蕊测半导体、实际控制人骈文胜已向发行人出具了书面承诺，上述承诺内容合法、有效。

综上所述，本所律师认为，发行人报告期内不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易；发行人已在《公司章程》《公司章程（草案）》及其内部制度中规定了关联交易的决策程序；截至本法律意见书出具之日，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。

## 十、发行人的主要财产

(一) 经本所律师查验,截至本法律意见书出具之日,发行人及其子公司拥有的不动产权及租赁使用权情况详见《律师工作报告》正文第十部分“发行人的主要财产”之(一)“不动产权及租赁使用权”。发行人及子公司占有、使用上述房产不存在限制及障碍。发行人租赁的房产虽未办理备案登记但该等未办理备案的房产具有可替代租赁房源,不会对发行人主营业务构成实质性影响,故前述未办理租赁备案事宜不会对发行人的持续经营能力产生重大不利影响,不会对发行人本次发行上市构成实质性法律障碍。

(二) 经本所律师查验,截至本法律意见书出具之日,发行人拥有3项注册商标,具体情况详见《律师工作报告》第十部分“发行人的主要财产”之“(二) 发行人拥有的知识产权”之“1、商标”;截至本法律意见书出具之日,发行人及其子公司合法拥有24项境内专利(其中包括6项发明专利和18项实用新型专利),具体情况详见《律师工作报告》第十部分“发行人的主要财产”之“(二) 发行人拥有的知识产权”之“2、专利”。

(三) 经本所律师查验,截至本法律意见书出具之日,发行人的主要生产经营设备为专用设备及办公设备,该等设备均由发行人实际占有和使用,均通过合法途径取得,主要经营设备不存在产权纠纷或争议。

(四) 经本所律师查验,截至本法律意见书出具之日,发行人拥有3家全资子公司,另有1家子公司已于报告期内注销。

经本所律师查验,发行人的上述财产均通过合法途径取得,截至本法律意见书出具之日,上述财产不存在产权纠纷,不存在权利受到限制的情形。

## 十一、发行人的重大债权债务

(一) 截至本法律意见书出具之日,发行人及其子公司于报告期内已履行和正在履行的对公司报告期内生产经营、财务状况或公司未来发展具有重大影响的销售合同及采购合同均合法有效,未发生与上述合同相关的重大纠纷或争议。

(二) 经发行人说明并经本所律师查验,截至本法律意见书出具之日,发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重

大侵权之债。

（三）根据《审计报告》并经本所律师查验，截至报告期末，发行人与关联方之间不存在重大债权债务关系。

（四）根据《审计报告》并经本所律师查验，截至报告期末，发行人存在关联方为其提供担保的情形，具体情况详见《律师工作报告》第九部分“关联交易及同业竞争”之“（二）关联交易”，发行人不存在为关联方提供担保的情形。

（五）经本所律师查验，截至报告期末，发行人金额较大的其他应收款以及其他应付款均系发行人正常生产经营而发生的往来款，合法有效。

## 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

（一）经本所律师查验，截至本法律意见书出具之日，除《律师工作报告》第七部分“发行人的股本及演变”已披露的股本变动情况外，发行人自成立以来，未有合并、分立或者减少注册资本的行为，其历次股本变动均已经履行了必要的法律手续，合法有效。

（二）根据发行人的说明并经本所律师核查，报告期内，发行人不存在重大资产变化、收购或出售资产行为。

（三）根据发行人的确认并经本所律师查验，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等行为。

## 十三、发行人公司章程的制定与修改

（一）2020年7月18日，发行人创立大会决议通过了《关于〈上海伟测半导体科技股份有限公司章程〉的议案》，修改后的章程已经在上海市市场监督管理局备案。

（二）发行人报告期内的章程修改情况详见《律师工作报告》第十三部分“发行人章程的制定与修改”之“（二）发行人报告期内的章程修改情况”。

（三）发行人《公司章程》的制定与修改均已履行法定程序，内容符合法律法规的有关规定。

（四）经本所律师查验，发行人本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》

系由其董事会依据《上市公司章程指引（2019年修订）》拟订，并经发行人2021年第二次临时股东大会审议通过。

（五）经本所律师查验，发行人历次章程的制定与修改均履行了法定程序，由股东大会审议通过并经公司登记机关备案，章程内容合法有效。发行人现行的《公司章程》及《公司章程（草案）》均符合现行法律法规的规定。

#### 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）经本所律师查验，发行人根据《公司章程》设置了股东大会、董事会和监事会等决策、监督机构，并对其职权作出了明确的划分，发行人按照《公司法》等法律法规的规定，建立了法人治理机构，具有健全的经营管理机构和组织机构。

（二）经本所律师查验，《公司章程》对发行人股东大会、董事会、监事会的议事规则和表决程序作出了具体规定，且发行人于2020年11月27日召开的2020年第五次临时股东大会审议制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在科创板上市，根据《科创板首发管理办法》《科创板股票上市规则》等相关规定，2021年10月8日，发行人召开2021年第二次临时股东大会审议修改了前述议事规则并制订草案，于发行人上市之日起生效。发行人现行有效的股东大会、董事会及监事会议事规则符合法律法规的有关规定。

（三）自发行人整体变更为股份有限公司时起至今，发行人历次股东大会、董事会、监事会会议的召开、决议内容及签署合法、有效。

（四）发行人股东大会对公司董事会的历次授权或重大决策行为符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定，合法、有效。

#### 十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化

（一）截至本法律意见书出具之日，发行人的董事、监事和高级管理人员的任职资格符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

（二）经本所律师查验，最近2年发行人的核心技术人员没有发生重大不利变化。

(三) 发行人董事、监事近两年所发生的变化符合法律法规及《公司章程》的规定，并且履行了必要的法律程序；上述董事、监事的变动，主要为完善公司内部治理及业务发展的需要、建立健全符合上市公司要求的法人治理结构进行的必要调整，系根据公司经营管理与公司治理实际需要而发生，上述变动使得公司治理结构得到进一步规范和优化。最近两年，发行人部分董事、监事的变动对公司日常管理不构成重大影响，也不影响公司的持续经营。据此，本所律师认为，公司最近两年内董事、监事未发生重大不利变化，未影响发行人的持续经营、发展战略及业务目标的延续性。

(四) 发行人独立董事的设立、任职资格及职权范围均符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在违反法律法规和《公司章程》规定的情形。

## 十六、发行人的税务

(一) 发行人及其子公司报告期内执行的主要税种、税率符合法律法规的规定。

(二) 经本所律师查验，发行人及其境内子公司在报告期内享受的税收优惠符合法律、法规的规定。

(三) 经本所律师查验，报告期内，发行人及其境内子公司享受的财政补贴具有相应的政策依据，合法有效。

(四) 经本所律师查验，报告期内，发行人及其境内子公司不存在因重大税务违法行为被处以行政处罚的情形。

## 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

(一) 发行人的生产经营活动符合国家和地方环保法规的要求，报告期内不存在因违反环境保护方面法律法规而受到重大处罚的情形，发行人募投项目符合国家有关环境保护的要求。

(二) 发行人及子公司报告期内不存在因违反质量技术监督方面法律、法规而被行政处罚的情形。

(三) 报告期内，发行人及其子公司能够按国家有关法律法规进行安全生

产，不存在因违反安全生产方面的法律法规而被主管应急管理部门给予行政处罚的情形。

（四）报告期内，发行人及其子公司存在未严格按照国家相关法律法规足额缴纳社保、公积金的情形，经本所律师查验，部分未缴纳系退休返聘人员、中国台湾籍人员、新入职/月底入职员工错过申报点，后续月份进行补缴、劳动合同签署于当月缴纳申报窗口关闭之后、试用期末缴纳或补缴前离职等原因。发行人报告期内不存在因劳动人事、社会保险、住房公积金等相关事项受到有关部门处罚的情形。

## 十八、发行人募集资金的运用

（一）发行人本次发行上市的募投项目现阶段已经取得相关部门的同意并已履行相关手续，募投项目的实施不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。

（二）本所律师认为，发行人募集资金拟投资项目符合国家产业政策，不涉及与他人合作的情形，亦不会导致同业竞争，并已经有权政府部门核准和发行人内部批准，符合相关法律法规的规定。发行人已建立募集资金管理制度，募集资金将存放于董事会指定的专项账户。

## 十九、发行人业务发展目标

（一）根据发行人确认及本所律师核查，发行人在其为本次发行上市编制的《招股说明书（申报稿）》中所述的业务发展目标与主营业务一致。

（二）根据发行人确认及本所律师核查，发行人在其为本次发行上市编制的《招股说明书（申报稿）》中所述的业务发展目标符合国家法律法规的规定，不存在潜在的法律风险。

## 二十、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）根据发行人说明、相关政府主管部门出具的证明及本所律师对发行人实际控制人的访谈并经本所律师通过中国“裁判文书网”、“全国法院被执行人信息查询系统”、“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”等公示

系统进行的查询，截至本法律意见书出具之日，发行人及其子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项。

（二）根据发行人持股 5%以上股份的股东、控股股东出具的调查表，并经本所律师通过中国“裁判文书网”、“全国法院被执行人信息查询系统”、“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”等公示系统进行的查询，截至本法律意见书出具之日，发行人持股 5%以上股份的股东、控股股东不涉及其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。

（三）根据发行人董事、高级管理人员填写的调查表、公安机关出具的无违法犯罪证明等相关材料，并经本所律师通过中国“裁判文书网”、“全国法院被执行人信息查询系统”、“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”等公示系统进行的查询，截至本法律意见书出具之日，发行人现任董事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情况。

## 二十一、发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师参与了《招股说明书（申报稿）》的讨论，已审阅《招股说明书（申报稿）》，特别对发行人引用本法律意见书及《律师工作报告》相关内容已认真审阅，《招股说明书（申报稿）》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。

## 二十二、发行人律师认为需要说明的其他问题

### （一）发行人历史沿革中的代持事项

截至本法律意见书出具之日，发行人历史上存在的所有代持均已解除。发行人股东持有的发行人股份权属清晰，不存在代持等未披露的股份安排，亦不存在权属纠纷及潜在纠纷。

### （二）发行人员工持股计划

发行人通过芯伟半导体实施的员工持股计划已履行必要的内部程序，合法、有效。芯伟半导体不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，也不存



在由基金管理人进行管理、基金托管人进行托管的情形。因此，芯伟半导体无需履行私募基金备案程序。芯伟半导体历史上中存在的代持现已完全解除。芯伟半导体已出具股份锁定及减持承诺。报告期内，芯伟半导体不存在受到工商税务等部门行政处罚的情形。

### （三）对赌协议

发行人、控股股东蕊测半导体、管理团队骈文胜、闻国涛、路峰与外部投资者存在于历次增资、股权转让协议及其补充协议中约定了对赌条款及其他特殊权利安排的情形。截至本法律意见书出具之日，对赌条款虽设有恢复条款，但发行人作为对赌、特殊权利义务人的条款已经彻底清理且不可恢复，恢复时的回购、赔偿义务由控股股东蕊测半导体、骈文胜、闻国涛、路峰承担，并且仅在撤回上市申请、或上市申请被驳回等情形下恢复履行，不存在影响公司持续经营能力或其他影响投资者权益的情形。

### （四）劳务外包

截止本法律意见书出具之日，为发行人及其子公司提供劳务外包服务的公司为独立经营主体，未因向发行人提供劳务外包服务而涉及违法违规行为，且劳务外包公司与发行人不存在任何关联关系。

### （五）信息披露豁免

发行人已建立完善的内控管理制度并得到有效执行，发行人申请信息豁免事项具有合理的商业诉求，如披露将导致发行人违约。发行人的董事长已在豁免申请文件中签字确认，豁免披露的信息尚未泄漏。截至本法律意见书出具之日，公司的信息披露方式对投资者判断公司价值不存在重大影响。

## 二十三、结论意见

综上，本所律师认为，发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，发行人符合《证券法》《公司法》《科创板首发管理办法》《科创板股票上市规则》《科创属性评价指引（试行）》等有关法律法规中有关公司首次公开发行股票并在科创板上市的条件，其股票公开发行并于上交所科创板上市不存在法律障碍；发行人《招股说明书（申报稿）》所引用的本法律意见书和《律师工

作报告》的内容适当；发行人本次发行上市已经取得现阶段必要的批准和授权，尚需取得上交所的审核同意并经中国证监会同意注册，待完成公开发行后，股票上市尚需取得上交所的同意。

（本页以下无正文）

(本页无正文,系《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

负责人:

顾功耘

经办律师:

乔文湘

经办律师:

夏瑜杰

2021 年 12 月 22 日

上海市锦天城律师事务所  
关于上海伟测半导体科技股份有限公司  
首次公开发行股票并在科创板上市的

补充法律意见书（一）



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层  
电话：021-20511000                      传真：021-20511999  
邮编：200120

## 目 录

声明事项 .....	3
释 义 .....	5
正 文 .....	7
问题 2.关于核心技术来源 .....	7
问题 5.关于销售和客户 .....	27
问题 16.关于股东 .....	30
问题 18.关于其他问题 .....	34

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于上海伟测半导体科技股份有限公司**  
**首次公开发行股票并在科创板上市的**  
**补充法律意见书（一）**

案号：01F20202132

**致：上海伟测半导体科技股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“伟测科技”）的委托，并根据发行人与本所签订的《聘请律师合同》，作为发行人首次公开发行股票并在科创板上市项目（以下简称“本次发行上市”）的特聘专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《科创板首发管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，就本次发行上市所涉有关事宜于 2021 年 12 月 22 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）和《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）。

鉴于上海证券交易所于 2022 年 1 月 17 日向发行人下发了《关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）（2022）26 号）（以下简称“《问询函》”），本所律师在对相关事项进行审慎核查后出具《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“本补充法律意见书”），以对《法律意见书》及《律师工作报告》中披露的内容进行相应的修订或补充。

## 声明事项

一、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

二、本所及本所律师仅就与发行人本次发行上市有关法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估、内部控制、盈利预测等专业事项发表意见。在本补充法律意见书和为本次发行上市出具的《法律意见书》《律师工作报告》中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告和内部控制报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。

三、本补充法律意见书中，本所及本所律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件发生时所应当适用的法律、法规、规章及规范性文件为依据。

四、本补充法律意见书的出具已经得到发行人如下保证：发行人已经提供了本所为出具本补充法律意见书所要求发行人提供的全部原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

五、对于本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依据有关政府部门、发行人或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见。

六、本所同意发行人在《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》（以下简称“《招股说明书（申报稿）》”）中自行引用或按上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核要求引用本补充法

律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

七、本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所及本所律师根据有关法律、法规、规章和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上交所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本补充法律意见书。



## 释 义

本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述含义：

发行人、伟测科技、公司	指	上海伟测半导体科技股份有限公司
伟测有限	指	上海伟测半导体科技有限公司，发行人前身
蕊测半导体、控股股东	指	上海蕊测半导体科技有限公司，发行人股东
子公司	指	发行人合并报表范围内的全资、控股子公司
本所、锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
保荐机构	指	平安证券股份有限公司
天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行上市、本次发行	指	发行人首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市
报告期、三年一期	指	2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月
《招股说明书（申报稿）》	指	发行人为本次发行上市制作的《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》
本补充法律意见书	指	《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（一）》
IDM	指	Integrated Design and Manufacture，即垂直整合模式，该模式下企业能够独立完成芯片设计、晶圆制造、封装测试的所有环节
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司
晟碟半导体	指	晟碟半导体（上海）有限公司
菲尼萨	指	菲尼萨光电通讯（上海）有限公司
紫光展锐	指	紫光展锐（上海）科技有限公司
中兴微电子	指	深圳市中兴微电子技术有限公司
晶晨股份	指	晶晨半导体（上海）股份有限公司
安路科技	指	上海安路信息科技股份有限公司
比特大陆	指	Bitmain Technologies Limited，比特大陆科技有限公司
兆易创新	指	北京兆易创新科技股份有限公司
卓胜微	指	江苏卓胜微电子股份有限公司
普冉股份	指	普冉半导体（上海）股份有限公司
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司
中颖电子	指	中颖电子股份有限公司
复旦微电	指	上海复旦微电子集团股份有限公司

北京君正	指	北京君正集成电路股份有限公司
摩托罗拉	指	摩托罗拉（中国）电子有限公司，现已更名为摩托罗拉系统（中国）有限公司
日月光	指	日月光封装测试（上海）有限公司
晶丰明源	指	上海晶丰明源半导体股份有限公司
艾为电子	指	上海艾为电子技术股份有限公司
《审计报告》	指	天健会计师出具的“天健审（2021）6-331 号”《上海伟测半导体科技股份有限公司审计报告》
《公司章程》	指	根据上下文意所需，指发行人及其前身制定并不时修订的公司章程，另有说明的除外
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
中国、境内	指	中华人民共和国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区），为本补充法律意见书之目的，指中国大陆地区
法律法规	指	提及当时公布并生效的中国大陆法律、行政法规、地方性法规、规章以及规范性文件
国家企业信用信息公示系统	指	中华人民共和国国家市场监督管理总局主办的国家企业信用信息公示系统网站，其网址为 <a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a>
元、万元	指	人民币元、万元，上下文另有说明的除外

注：除特别说明外，本补充法律意见书中若出现总计数与分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

## 正文

### 问题 2.关于核心技术来源

2.1 根据招股说明书，1) 公司 2016 年成立后即进入晶圆测试领域，2017 年实现盈利，2019 年末开拓了芯片测试业务。发行人的核心技术系自主开发，并随着测试经验的积累逐步完善。2) 截至本招股说明书签署日，公司及其子公司取得 24 项专利、1 项软件著作权，其中有 6 项发明专利，18 项实用新型专利。3) 公司有 4 名核心技术人员，就职前曾在日月光封测、长电科技等同行业公司任职，其中一名核心技术人员于 2020 年 2 月入职。另根据申报材料，部分专利发明人目前已离职。

请发行人说明：

(1) 公司 6 项发明专利的具体来源、发明人的具体情况，是否为公司员工，该 6 项发明专利在发行人主营业务中的具体应用情况；

(2) 结合核心技术人员和专利发明人（包括已离职人员）的从业经历，说明其在技术形成过程中发挥的作用，并结合行业研发周期、客户认证周期、测试方案开发和验证周期，说明主营业务发展和核心技术形成的关键历史节点，技术来源是否为自主研发，是否合法合规；

(3) 结合核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）的任职经历，说明该等人员是否存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，是否存在纠纷或潜在纠纷。

请保荐机构和发行人律师进行核查，完善核查方式，说明核查过程并发表明确意见。

回复：

一、公司 6 项发明专利的具体来源、发明人的具体情况，是否为公司员工，该 6 项发明专利在发行人主营业务中的具体应用情况

发行人 6 项发明专利的具体来源、发明人的具体情况及在发行人主营业务中的具体应用情况如下表所示：

序号	专利名称	申请号/专利号	技术来源	发明人	是否公司员工	具体应用
1	晶圆区域性问题的分析系统及方法	202110310750.9	自主研发	杨恭乾、路峰、高大会、闻国涛、骈文胜	皆是	1、是一种对测试环节的数据进行大量数据分析以发现异常和测试环节的问题，并对测试问题的根本原因进行智能判断的一套分析系统。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试业务。
2	多晶硅工艺保险丝的熔断装置及方法	202110248636.8	自主研发	傅郁晓、吴庆、陈迎涛、杨栓、张丽霞	皆是	1、大规模测试服务中保险丝熔断工艺较为普遍，该发明是用一种简单的替代方法在保证质量的同时达成熔断工艺。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试业务与芯片成品测试业务。
3	一种测试机匹配检测系统及其方法	202011533224.0	自主研发	傅郁晓、吴庆、骈文胜、闻国涛、杨恭乾	皆是	1、是一种软件系统，主要用于测试机对设计公司提供产品进行自动适应性配置。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试与芯片成品测试业务。
4	一种 Wafer ID 烧写防呆的系统	202011523844.6	自主研发	骈文胜、傅郁晓	皆是	1、在大规模测试服务中确保每个芯片被正确识别和跟踪，并可以持续保证最高的测试质量；当遇有多流程的情况时不会出现测试错误，是大规模测试服务中质量管理系统的关键环节。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试业务。
5	一种多平台联动提效机构	202011489734.2	自主研发	杨栓、关姜维、刘栋栋	皆是	1、将两个测试机对接到一个探针台上，可以在保证测试质量的同时提高测试效率和设备利用率。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试业务。
6	一种集成电路精确测试小电阻的方法	202011160294.6	自主研发	左上勇、袁常乐、王敏	皆是	1、属于一种测试的优化方法，在保证高精度的同时，运用简单仪器测试小电阻。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试与芯片成品测试业务。

如上表所示，上述 6 项发明专利均由发行人员工自主研发形成并应用于主营业务。

二、结合核心技术人员和专利发明人（包括已离职人员）的从业经历，说明其在技术形成过程中发挥的作用，并结合行业研发周期、客户认证周期、测

试方案开发和验证周期，说明主营业务发展和核心技术形成的关键历史节点，技术来源是否为自主研发，是否合法合规。

1、发行人核心技术人员和专利发明人（包括已离职人员）的从业经历及其在技术形成过程中发挥的作用

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
1	骈文胜	核心技术人员、专利发明人	本科学历，电子精密机械专业。1993年-2000年任摩托罗拉（中国）电子有限公司设备经理；2000年-2004年任职于威宇科技测试封装（上海）有限公司；2004年-2009年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任测试厂长、封装厂长、资材处长；2009年-2016年任职于江苏长电科技股份有限公司，任事业中心总经理、集团海外销售副总裁；2016年11月至今任公司董事长、总经理。	1、基于 ARM 架构的高性能处理器的测试解决方案	1、项目统筹规划； 2、参与制定产品测试量产的规范并设计量产的流程和相应的管控机制； 3、技术规范评估。
				2、晶圆测试中烧写写入工艺防呆管控技术	1、项目统筹规划； 2、参与晶圆烧写写入工艺防呆管控技术的方案设计和相应的验收标准的制定。
				3、晶圆测试良率分析和优选管控技术	1、项目统筹规划； 2、参与设计测试良率分析架构体系和设备自动优选的方案核心代码分解。
				4、基于 TCG 架构的先进网络安全芯片晶圆测试解决方案	1、项目统筹规划； 2、参与研究网络安全芯片测试的核心难点，为解决方案提供技术路线。
2	闻国涛	核心技术人员、专利发明人	本本科学历，机械设计及其自动化专业。2001年-2004年任威宇科技测试封装（上海）有限公司设备工程师；2004年-2016年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任测试设备主管、经理、封装厂长、测试厂长；2016年5月至今任公司董事、副总经理。	1、高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案	1、项目可行性分析，落实专案前期立项工作 2、比对、分析、定制、优化技术方案； 3、制定验收标准及检验阶段性目标。
				2、解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	1、项目统筹规划； 2、参与稳压套环通过电极接线、电性连接于测试电极方案。
				3、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案	1、项目统筹规划； 2、参与研究测试的核心难点，为解决方案提供技术路线。
				4、测试机配置匹配提效技术	1、项目统筹规划； 2、参与调研设计测试机配置匹配规则； 3、参与测试机配置匹配流程的设计以及流程图的规划设计； 4、制定验收标准以及检验阶段性目标。
3	路峰	核心技术人员、专利发明人	本本科学历，电子工程系专业。1993-2000年任摩托罗拉（中国）电子有限公司 IT 自动化经理；2000年-2004年任威宇科技测试封装（上海）有限公司 IT 部门	1、晶圆测试良率分析和优选管控技术	1、负责项目可行性分析，落实专案前期立项工作； 2、参与创建测试良率分析建模方案； 3、参与设计测试良率分析架构体

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
			经理；2004年-2006年任日月光封装测试（上海）有限公司IT部门经理；2006年-2018年任职于晟碟半导体（上海）有限公司，历任IT部门经理、总监；2018年5月至今任公司董事、副总经理。	2、基于TCG架构的先进网络安全芯片晶圆测试解决方案	系、设备优选数学模型； 4、制定验收标准以及检验阶段性目标。 1、负责项目可行性分析，落实专案前期立项工作； 2、参与研究网络安全芯片测试的核心难点并针对性提出解决方案； 3、参与网络安全芯片软硬件测试方案的开设计、开发和调试。
4	刘琨	核心技术人员	本科学历，检测技术及仪器专业。1997年-2001年任摩托罗拉（中国）电子有限公司产品工程师；2001年-2004年任职威宇科技测试封装（上海）有限公司，历任高级产品工程师、产品工程主管；2004年-2005年任英特尔（上海）有限公司工程主管；2005年-2009年任泰瑞达（上海）有限公司应用工程经理，负责中国北方区域；2009年-2015年任北京汉迪龙科技有限公司副总经理；2015年-2020年任上海旻艾半导体有限公司总经理；2020年2月至今，担任公司副总经理。	1、薄片晶圆测试技术  2、可选择性导片装置	1、负责项目可行性分析，落实专案前期立项工作； 2、参与薄片晶圆测试技术路线设计； 3、参与薄片晶圆治具设计和工艺开发； 4、制定验收标准以及检验阶段性目标。  1、项目统筹规划； 2、负责可选择性导片材质选择和确定； 3、参与规划设计可选择性导片电路及与测试机的配合机制； 4、制定验收标准以及检验阶段性目标。
5	左上勇	专利发明人	本科学历，材料化学专业。2010年-2019年任职于日月光封装测试有限公司，历任测试设备工程师、测试开发工程师、开发主任工程师；2010年-2019年任职于上海月芯半导体科技有限责任公司，任开发主任工程师；2019年6月至今任公司研发中心总监。	1、5G通信射频前端晶圆测试解决方案	1、研究5G通信射频前端通用测试参数并进行晶圆可测性设计； 2、制定使用低频参数测试加数据仿真反馈产品射频性能的技术方案。
6	杨恭乾	专利发明人	本科学历，信息与计算科学专业。2009年-2013年任职中芯国际集成电路制造（上海）有限公司，历任IT测试部工程师，部门主管；2013年-2018年任职菲尼萨光电通讯（上海）有限公司，历任高级工程师，IT测试部经理，高级经理；2018年2月至今任公司研发中心总监。	1、测试机配置匹配提效技术  2、晶圆测试良率分析和优选管控技术  3、基于TCG架构的先进网络安全芯片晶圆测试	1、调研设计测试机配置匹配规则； 2、进行测试机配置匹配流程设计以及流程图的规划设计； 3、设计测试机配置匹配软件核心架构及进行功能模块分解开发。 1、创建测试良率分析建模方案； 2、设计测试良率分析架构体系、设备优选数学模型； 3、设备自动优选方案核心代码的分解、开发与调试。 1、研究网络安全芯片测试的核心难点并针对性提出解决方案；

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
				解决方案	2、网络安全芯片软硬件测试方案的设计、开发和调试。
7	傅郁晓	专利发明人	本科学历，微电子专业。2007年-2016年任日月光封装测试（上海）有限公司测试设备主管；2016年5月-2020年7月任上海伟测半导体科技有限公司研发中心经理；2020年7月至今任公司销售总监。	1、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案  2、晶圆测试中对位辅助调整装置  3、WIFI6无线网络通讯芯片测试解决方案  4、自动降温装置  5、延长墨管使用寿命的装置  6、测试机配置匹配提效技术  7、晶圆测试中烧写写入工艺防呆管控技术  8、基于ARM架构的高性能处理器的测试解决方案  9、高性能汽车电子芯片测试解决方案	1、进行高速高分辨率电流型数模转换器实际测试数据和理论数据的修调和数据校准处理； 2、对实际测试数据和测试结果进行稳定分析，并参与测试方案的验收。  1、参与晶圆测试中对位过程的分析和总结，制作对位动作流程图并分析其必要性和优化空间； 2、设计一种新型可以提高打点产品效率的模具，以替代原有设备在对产品外围需要打四到五圈墨点的方案。  1、追踪WIFI6技术规范，进行相关数据收集整理，设计公司WIFI6通用测试规范以及相应的测试规格书； 2、根据行业标准和WIFI6通用测试规范制定项目验收标准。  1、参与研发自动降温装置。  1、设计实验方法以及设计打点器的机械装置。  1、测试机配置匹配需求分析和应用验证。  1、晶圆烧写写入工艺防呆管控技术的方案设计和相应验收标准的制定； 2、设计实验进行晶圆烧写写入工艺防呆管控技术的验证，并进行风险分析。  1、参与ARM架构的高性能处理器的测试项目规划、选定标的产品规范和设计测试硬件，并进行测试程序的开发和设计； 2、制定产品测试量产的规范并设计量产的流程和相应的管控机制； 3、执行工程验证和工程验收的标准，并进行测试稳定性的评估。  1、追踪高性能汽车电子行业技术规范，并和相关的设计公司进行测试规格和测试流程的规划设计，相应制定公司高性能汽车电子行业通用测试规范以及相应的测试流程； 2、制定符合行业标准的高性能汽

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
					车电子行业通用项目验收标准和规范。
8	张伟军	专利发明人	本科学历，电子科学与技术专业。2016年6月至今任公司研发中心工程师、经理。	1、解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	1、分析并设计实验验证背银、背金晶圆高压测试不稳定的原因和失效模式； 2、设计稳压装置来保持电极电压的稳定，解决 prober chuck 电源会影响测试的问题。
				2、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案	1、参与分析高速高分辨率电流型数模转换器测试的核心难点并提供相应的解决方案； 2、负责高速高分辨率电流型数模转换器软件测试方案的设计，开发和调试。
				3、晶圆外观检测平台的改造装置	1、根据新型的外观检测承载平台方案设计模具并进行仿真模拟； 2、制定新型模具验证流程和验收标准。
				4、WIFI6 无线网络通讯芯片测试解决方案	1、进行 WIFI6 无线测试的可行性分析和具体测试实现方案的构思，形成项目规划； 2、根据项目规划选定标的产品规范，设计测试硬件并进行测试程序的开发和设计。
				5、探针台自动清洁装置	1、系统分析芯片失效模式及原因； 2、基于失效芯片的数据，分析灰尘对芯片测试结果的影响； 3、参与设计、研发探针台自动清洁装置。
9	晏云飞	专利发明人	本科学历，电子信息与工程专业。2013年-2017年3月任职于京隆科技（苏州）有限公司，历任测试部门组长，代理课长；2017年3月至2018年5月任公司研发中心工程师。	1、测试机多方位使用兼容装置	1、根据方位运动控制机制和测试机需求规格设计新型测试机的空间运动机构，进行建模并设计整体构建图； 2、对新型测试机的空间运动机构进行模拟设计，并设计机构的生产制作图纸。
				2、高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案	1、分析高速数字通信芯片行业规范已经制定的技术规范，进行测试的可行性分析和具体测试实现方案的设计，形成项目规划； 2、根据项目规划选定标的产品规范设计测试硬件，并进行测试程序的开发和设计。
				3、探针台自动清洁装置	1、数据收集和分析，形成结案报告供项目研讨。
10	陈迎	专利发明人	本科学历。2007年-2016年历任日月光封装测试（上海）有限公	1、测试机多方位使用兼容装置	1、进行新型测试机的空间运动机构的制作和安装，并评估其实际



序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
	涛		司测试一厂生产组长，生产主任；2016年5月至今历任上海伟测生产经理，南京伟测厂长。		效果是否符合预期； 2、测试机多方位使用兼容装置项目的验收。
				2、探针台自动清洁装置	1、评估喷吹管，脉冲电磁阀，气包，控制仪，出气嘴的选型和功能；
				3、芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术	1、进行熔丝烧调工艺精密控制的实验验证技术的开发，制定评价标准； 2、执行熔丝烧调工艺精密控制的实验验证，对稳定性及一致性进行分析。
				4、高性能汽车电子芯片测试解决方案	1、根据测试方案，进行测试硬件原理图、布线图的制作以及各种治具的设计； 2、执行各类硬件的制作，并制定和执行相应的硬件验收及标准。
11	周俊	专利发明人	本科学历，机械设计及其自动化专业。2008年-2017年5月任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任设备工程师，测试设备专案工程师，主任工程师；2017年7月至今历任公司上海伟测厂长、无锡伟测总经理。	1、测试机多方位使用兼容装置	1、分析现有测试机的空间运动机构，整理当前测试机无法实现全方位探测的原因，并提出具体控制模式； 2、提供需要增加的测试机方位运动控制机制并提供测试机需求规格。
				2、探针台自动清洁装置	1、设计自动清洁装置的机械图纸； 2、设计实验收集性能参数。
12	史小奇	专利发明人	专科学历，机电一体化专业。2007年-2017年任上海纪元微科电子有限公司测试工程师；2017年-2020年任上海伟测研发中心资深工程师；2020年至今历任无锡伟测研发中心经理、研发中心副总监。	1、晶圆测试过程中针痕精密管控工艺技术	1、针对集成电路针测过程容易扎偏的情况提出研发针痕管控的工艺思路； 2、设计防偏结构以及图纸。
				2、高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案	1、追踪高速数字通信芯片技术规范，和设计公司进行相关数据收集，整理高速数字通信芯片通用测试规范以及相应的测试规格书； 2、根据行业标准和高速数字通信芯片通用测试规范制定项目验收标准。
13	张洪亮	专利发明人	本科学历，电子信息工程专业。2009年-2011年任福州福顺半导体有限公司测试工程师；2011年-2015年任日月光封装测试（上海）有限公司测试设备工程师；2016年-2017年任歌尔股份有限公司测试部项目经理；2017年-2018年任公司研发中心工程师。	1、晶圆测试过程中针痕精密管控工艺技术	1、实验数据收集，及进行部分元器件焊接。
				2、高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案	1、根据制定好的高速数字通信芯片测试规范，制定产品测试量产的规范，并设计量产的流程和相应的管控机制； 2、执行高速数字通信芯片工程验证和工程验收，并进行测试稳定性的评估。

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
14	俞磊	专利发明人	本科学历，自动化专业。2011年-2016年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任品质工程师、专案工程师；2016年9月-2020年任公司研发中心工程师；2020年至今，任无锡伟测研发中心经理。	1、晶圆测试中对位辅助调整装置	1、根据设计图纸进行新型模具的制作并根据验证流程进行验证； 2、根据验收标准，执行新型模具的验收，评估实际效果。
				2、晶圆外观检测平台的改造装置	1、根据外观检测承载平台设计图纸进行新型模具的制作，并根据验证流程进行验证； 2、根据验收标准，执行外观检测承载平台模具的验收，并评估实际效果。
				3、WIFI6 无线网络通讯芯片测试解决方案	1、根据测试硬件设计图纸，进行测试硬件的制作并制定测试硬件的验收规范； 2、执行测试硬件的验收并评估硬件性能的评估。
				4、晶圆测试过程中针痕精密管控工艺技术	1、设计测试管控工艺监控报警机制； 2、负责载板、导向套管、触杆和触控开关的选型。
				5、高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案	1、根据测试硬件设计图纸，对高速数字通信芯片进行测试硬件的制作并制定测试硬件的验收规范； 2、执行高速数字通信芯片测试硬件的验收并评估硬件性能的评估。
15	崔勇彬	专利发明人	本科学历。2016年至今历任公司生产组长、生产主任、生产经理。	1、解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	1、设计试验对当只有一个测试电极电压触点且离电压触点远时测试电压逐渐衰减情况的验证。
				2、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案	1、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆 DOE 测试的验证设计和操作； 2、测试流程设计和良率管控规则的制定。
				3、自动降温装置	1、分析降温装置的降温媒介以及在 prober 上使用的便捷性； 2、设计降温装置的机械图纸。
				4、延长墨管使用寿命的装置	1、分析油墨干涩的原因； 2、设计新的油墨打点器，增强油墨的流动性从而使提高油墨利用率。
16	关姜维	专利发明人	本科学历，电子信息科学与技术专业。2010年-2016年历任日月光封装测试（上海）有限公司工程师，工程主管；2016年6月至今任公司研发中心经理、总监。	1、高清图像传感器芯片晶圆主流测试方案的分析并提出通用化的设计方案； 2、设计通用性高、可程序控制、可执行校准的通用性光源解决方案； 3、设计通用性高模块化的程序架	

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
					构方案。
				2、晶圆测试中对位辅助调整装置	1、根据新型模具的设计方案产生模具设计图纸并进行仿真模拟； 2、设计和制定新型模具验证流程和验收标准。
				3、晶圆外观检测平台的改造装置	1、分析现有晶圆外观检测平台机构并分析现有平台的承载平台的运动和控制机制的优缺点； 2、提出新型的一种真空吸附检测台的外观检测平台承载平台的运动和控制机制并分析可行性和风险管控机制。
				4、WIFI6 无线网络通讯芯片测试解决方案	1、根据制定好的测试规范制定产品测试量产的规范，并设计量产的流程和相应的管控机制； 2、执行工程验证和工程验收的规范，并进行测试稳定性的评估。
				5、自动降温装置	1、设计实验步骤以及方法，评估不同媒介的降温效率；
				6、多平台联动提效技术	1、为提升测试机的使用效率，立项研发多平台联动机构； 2、设计信息采集模块。
17	赵阿勇	专利发明人	专科学历。2016年-2018年8月任公司研发中心工程师。	1、自动降温装置	1、收集不同媒介的降温时间，汇总实验数据。
				2、延长墨管使用寿命的装置	1、收集不同规格油墨连续打点不干涩的数据并整理分析实验数据。
18	吉晋阳	专利发明人	本科学历，电子信息工程专业。2009年-2016年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任测试设备主管、主任；2016年6月至今任公司研发中心经理、总监。	1、高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案	1、负责通用高清图像传感器芯片晶圆测试通用探针卡的设计并评估探针卡对光路的影响； 2、负责通用性高模块化的程序架构的程序的开发和调试。
				2、解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	1、负责稳压套环通过电极接线、电性连接于测试电极的方案设计； 2、提供多种连接与测试电极的方案，并安排 DOE 方案验证。
				3、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案	1、参与分析高速高分辨率电流型数模转换器测试的硬件难点并提供相应的解决方案例； 2、负责高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试使用的硬件-屏蔽针卡的设计、制作和性能评估。
19	柴振极	专利发明人	专科学历。2016年7月至今担任研发中心技术员、工程师。	1、解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	1、根据稳压套环通过电极接线、电性连接于测试电极方案和 DOE 方案，进行实验硬件的制作并进行设备的安装。

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
20	李峰	专利发明人	本科学历，电力系统及其自动化专业。2005年-2007年1月，在日月光封装测试（上海）有限公司担任厂务经理；2007年-2016年任上海峰越机电设备安装有限公司经理；2016年至今，任公司厂务。	1、高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案	1、执行通用性光源和模块化的程序采集实验数据，并进行稳定性和准确性分析； 2、培训研发中心工程师光模块使用方法。
21	吴庆	专利发明人	本科学历，电子工程专业。2007年-2015年任职于晟碟半导体有限公司，历任设备组长，测试设备工程师；2015年-2017年任职于丽恒光微半导体，历任设备工程师，设备经理；2017年6月至今任公司研发中心经理。	1、测试机配置匹配提效技术	1、测试机配置匹配代码撰写和调试。
				2、芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术	1、根据熔丝烧调工艺精密控制的实现方案提出具体的实施方式，并进行相应的外围电路设计； 2、对外围电路的设计进行制作，并对硬件进行相应的验收。
				3、高性能汽车电子芯片测试解决方案	1、根据标的产品的测试方案和硬件设计，执行具体测试项目的开发和调试，并执行相应的产品特性分析； 2、制定相应的测试项目开发的验收标准，并按照标准进行数据分析处理。
22	杨栓	专利发明人	本科学历。2013年-2014年上海樊境智能科技责任有限公司任销售经理；2014年-2019年任上海旻艾半导体有限公司测试工程师；2019年12月至今任公司研发中心工程师。	1、多平台联动提效技术	1、设计技术图纸并制作样品； 2、分析待测晶圆的移动路径，模拟测试过程对移动次数进行计算。
				2、芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术	1、分析传统熔丝烧调工艺技术的实现方式，分析测试良率、稳定性以及研究传统技术是否可以满足未来的严格测试要求，如汽车电子和工业电子的严苛需求； 2、提出新型电子运用如汽车电子和工业电子对测试中熔丝烧调工艺的需求，并设计熔丝烧调工艺精密控制的实现方案及验收标准。
				3、高性能汽车电子芯片测试解决方案	1、分析汽车电子产品的通用特点，根据汽车电子产品的测试开发特性选取和整理测试要求及测试规范； 2、根据标的产品的测试规范，制定相应的测试方案和根据产品制定相应的验收标准。
23	张丽霞	专利发明人	本科学历。2018年3月至今任公司研发中心工程师。	1、芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术	1、执行熔丝烧调工艺精密控制工艺化验证和DOE方案的设计； 2、执行熔丝烧调工艺精密控制技术的项目验收和工艺稳定分析。
				2、高性能汽车电子芯片测试解决方案	1、执行标的产品验证和数据分析确实测试的稳定性和数据的一致

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
					性； 2、设计 DOE 方案的设计和执行业并进行风险的评估。
24	刘栋栋	专利发明人	本科学历，电子信息工程专业，2013 年-2018 年年任矽品科技（苏州）有限公司测试产品工程师；2018 年-2021 年 3 月任公司研发中心工程师；2021 年 3 月至今任无锡伟测研发中心经理。	1、多平台联动提效技术	1、设计控制系统包括信号配置单元、路径规划单元等； 2、进行多平台联动通讯驱动开发和 GPIB 信号调试。
25	袁常乐	专利发明人	本科学历，物理系电子信息科学与技术专业。2019 年至今任公司研发中心工程师。	1、5G 通信射频前端晶圆测试解决方案	1、执行测试硬件的设计、测试软件的开发和调试； 2、对测试结果和实验室测试结果进行一致性分析并优化测试算法。
26	王敏	专利发明人	本科学历，功能材料专业。2017 年-2019 年任日月光封装测试有限公司工程部产品测试工程师；2019 年 7 月至 2021 年 7 月任公司研发中心工程师。	1、5G 通信射频前端晶圆测试解决方案	1、设计验收规则和数据分析规则； 2、设计 DOE 验证的实验以及执行 DOE 的实验验证工作。
27	高大合	专利发明人	专科学历，电工电子专业。2002 年-2004 年任职于飞利浦光磁电子（上海）有限公司，任生产领班；2007 年-2015 年任职于日月光封装测试有限公司，历任储备组长，组长 生产管理师，主任；2015 年 2 月-2015 年 9 月任职于环维电子（上海）有限公司，任组长；2015 年 9 月-2016 年 11 月任职于环旭电子股份有限公司，历任组长，课长；2016 年 12 月至今任公司生产经理。	1、晶圆测试良率分析和优选管控技术	1、进行自动优选方案验证和数据分析结果分析，并提供优化需求； 2、对自动优选方案进行验收和接收。
				2、基于 TCG 架构的先进网络安全芯片晶圆测试解决方案	1、进行网络安全芯片晶圆测试方案的实际测试稳定性分析，并和测试结果进行一致性分析； 2、进行网络安全芯片晶圆测试方案测试效率分析。
28	赵坤鹏	专利发明人	本科学历，机电一体化工程专业。2011 年-2019 年任日月光封装测试封装（上海）有限公司设备工程师；2019 年-2020 年任无锡华润微电子测试厂设备主管；2020 年 4 月至今担任无锡伟测研发中心经理。	1、测试方案开发的系统验证板	1、参与系统验证板的需求分析； 2、参与系统验证板原理图设计以及 PCB layout 出图； 3、制定参数验收标准。
				2、延长墨管使用寿命的装置	1、核对实验数据并提交报告给项目组审核；
				3、低温测试工艺结霜控制技术	1、低温测试过程中测试硬件上产生冷凝结霜原因分析； 2、参与研发项目可行性分析以及方案制定。
				4、32 位微控制单元芯片晶圆测试解决方案	1、对通用型硬件重新设计和优化； 2、电路板原理图设计以及 PCB layout 出图； 3、自动开发软件代码的撰写并完善测试标准库。
				5、修调卡及线缆快速验	1、线缆异常信息分类分析；

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
				证装置	2、设计快速验证装置图纸并协调生产制作。
29	杨征	专利发明人	专科学历，机械制造与自动化专业。2010年-2020年任日月光封装测试（昆山）有限公司设备主管；2020年9月-2021年5月任无锡伟测研发中心经理。	1、测试方案开发的系统验证板 2、低温测试工艺结霜控制技术 3、32位微控制单元芯片晶圆测试解决方案 4、修调卡及线缆快速验证装置	1、系统验证板样品生产进度协调； 2、收集实验数据以及提交报告给项目组审核。 1、追踪方案验证实施结果以及实验数据收集； 2、对应用技术后的测试结果进行验证； 3、分析效率提升部分数据并提交报告。 1、参与研发中心测试程序的自动化生成方法的设计； 2、电路板验收以及提交报告。 1、参与验证装置的异常信息分类归纳； 2、参与验收装置数据以及提交报告。

截至本补充法律意见书出具之日，上述核心技术人员与专利发明人中，晏云飞、赵阿勇、张洪亮、王敏、杨征等5人已离职，其余人员均尚在公司任职。

2、结合行业研发周期、客户认证周期、测试方案开发和验证周期，说明主营业务发展和核心技术形成的关键历史节点，技术来源是否为自主研发，是否合法合规

#### （1）行业研发周期

经本所律师核查，行业缺乏研发周期的相关统计数据，同行业上市公司和公开渠道亦未披露相关数据。报告期内发行人各类测试核心技术的研发周期一般在5-18个月之间。

#### （2）客户认证周期和测试方案开发和验证周期的一般情况

在客户认证周期方面，公司成为客户的合格供应商的认证过程一般包括双方初步接洽、签署保密协议、客户来厂参观及验厂、公司通过合格供应商认证等几个环节，整个认证周期一般在30天至90天之间。发行人针对某特定产品进行测试方案开发和验证的周期一般为1-3个月左右。

#### （3）公司主营业务发展过程

公司自设立以来，一直专注于经营集成电路测试服务业务。公司成立以来，主营业务的发展情况如下：

A. 2016年-2017年公司处于创业摸索和积累阶段，主要提供晶圆测试服务

公司成立之初，选择了技术含量高、市场竞争格局好的“晶圆测试”业务，在工厂选址上，选择毗邻中国最大的集成电路产业集群上海张江。在业务方面，公司得到了以晶丰明源、艾为电子等为代表的模拟类客户的认可，并开始逐步导入中高端测试平台及客户，拓展数字类的客户和测试服务。

B. 2018年-2019年公司进入快速成长阶段，并开始介入芯片成品测试业务

在该期间，公司不断完善整套测试作业体系，加强测试技术和测试工艺的研发投入，大力引进中高端测试平台，不断提升公司的高端测试服务能力。2019年末，鉴于公司在晶圆测试积累的客户基础以及行业口碑，公司又适时开拓芯片成品测试业务，为公司的发展创造了新的增长点。

C. 2020年至今，公司开始确立行业领先地位，确定了以“以晶圆测试为核心，积极发展中高端芯片成品测试”的差异化竞争策略

“高端化、顶尖客户、全力扩产”是这一阶段的公司发展策略，公司抓住“美国打压中国半导体行业，中国大陆的一线芯片设计公司加快测试服务供应商的国产化替代”的历史契机，一方面加大研发投入，重点突破7nm-14nm先进制程芯片、5G射频芯片、高性能CPU芯片、高性能计算芯片、FPGA芯片、复杂SoC芯片等各类高端芯片的测试工艺难点，另一方面快速扩充高端测试产能，使得公司具备承接中国大陆高端芯片设计公司测试订单的技术实力和产能规模。2020年，公司在另一重要的集成电路产业集群江苏省无锡市设立子公司，优化了产业布局。

(4) 公司核心技术形成的关键历史节点

截至本补充法律意见书出具之日，公司拥有的核心技术形成的关键历史节点情况如下：

序号	核心技术大	技术形成的关键历史节点
----	-------	-------------

	类	时间节点	形成的核心技术	应用范围
1	测试方案开发技术	2016年-2017年	高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案	数模转换芯片
			高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案	图像传感芯片
		2018年-2019年	高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案	数据通信芯片
			WiFi6 无线网络通讯芯片测试解决方案	无线网络芯片
			第3代快闪存储器IP的晶圆测试方案	存储器芯片
			基于TCG架构的先进网络安全芯片晶圆测试解决方案	安全芯片
			现场可编程逻辑门阵列芯片测试解决方案	FPGA 芯片
		2020年以后	5G通信射频前端晶圆测试解决方案	5G射频前端芯片
			基于ARM架构的高性能处理器的测试解决方案	处理器芯片
			高性能汽车电子芯片测试解决方案	汽车芯片
			高性能区块链算力芯片晶圆测试方案	AI、区块链芯片
			32位微控制单元芯片晶圆测试解决方案	微控制器芯片
		2	测试工艺难点突破与精益测试提效技术	2016年-2017年
2018年-2019年	测试机配置匹配提效技术			晶圆测试、芯片成品测试
	晶圆测试中烧写写入工艺防呆管控技术			晶圆测试
	低温测试工艺结霜控制技术			晶圆测试、芯片成品测试
2020年以后	芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术			芯片成品测试
	晶圆测试良率分析和优选管控技术			晶圆测试
	薄片晶圆测试技术			晶圆测试
	多平台联动提效技术	晶圆测试		
3	设备改造升级技术	2016年-2017年	测试机多方位使用兼容装置	晶圆测试、芯片成品测试
			解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	晶圆测试
			晶圆测试机抗干扰外壳装置	晶圆测试
		2018年-2019年	探针台自动清洁装置	晶圆测试
			晶圆外观检测平台的改造装置	晶圆测试
		2020年以后	晶圆测试机抗干扰外壳装置	晶圆测试
4	测试治具设计技术	2016年-2017年	延长墨管使用寿命的装置	晶圆测试
			晶圆测试中对位辅助调整装置	晶圆测试
		2018年-2019年	自动降温装置	晶圆测试
			测试方案开发的系统验证板	晶圆测试、芯片成品测试



序号	核心技术大类	技术形成的关键历史节点		
		时间节点	形成的核心技术	应用范围
5	自动化测试及数据分析技术	2020年以后	修调卡及线缆快速验证装置	晶圆测试、芯片成品测试
			可选择性导片装置	晶圆测试
		2018年-2019年	数据挖掘与多维度分析系统	数据分析系统
			测试参数大数据多维度统计分析系统	数据分析系统
2020年以后	Mapping 分析系统	数据分析系统		

### （5）技术来源及其合法合规性

公司是由骈文胜、闻国涛等几位在集成电路封测行业具有丰富从业经验的资深人士于2016年创立。公司设立时就对标国内一流和国际领先的测试企业，通过自主研发，不断攻克测试技术难点，提升服务水平和服务能力，立志通过技术驱动打造一家具有核心竞争力的独立第三方专业测试服务商。创立以来，公司高度重视技术研发，不断加大研发投入，通过自主研发和技术积累逐步形成了公司在测试方案开发、设备改造升级技术、测试治具设计、测试自动化和智能化等方面的核心技术。发行人主要技术均来源于自主研发，且拥有自主知识产权，不存在合作开发、委托开发的情形。截至2021年12月31日，公司已经取得24项专利，其中有6项发明专利。公司核心技术的来源合法合规，均为自主研发，不存在来源于其他任何无关第三方。发行人现有专利、核心技术等无形资产不存在侵犯知识产权、商业秘密的情形，亦不存在权属纠纷或潜在纠纷。

三、结合核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）的任职经历，说明该等人员是否存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，是否存在纠纷或潜在纠纷。

核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）的任职经历详见本补充法律意见书“问题2/二/1、发行人核心技术人员和专利发明人（包括已离职人员）的从业经历及其在技术形成过程中发挥的作用”。

### 1、核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）是否存在违反原任职单位关于竞业禁止的情形

根据公司核心技术人员、专利发明人提供的劳动合同、与原任职单位有交易的银行卡流水、原任职单位出具的说明等资料并经本所律师访谈核心技术人员和专利发明人，公司核心技术人员和专利发明人与原任职单位是否签订竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同以及是否获得竞业禁止补偿金等情况如下表所示：

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同	是否收到竞业禁止补偿金	是否违反竞业禁止约定	备注
1	骈文胜	核心技术人员、专利发明人	否	否	否	1、未签订竞业禁止协议，离职后未收到过竞业禁止补偿金； 2、原单位直属领导接受访谈，证明其不存在违反竞业禁止方面的纠纷、诉讼或仲裁； 3、原单位长电科技与公司一直保持良好的合作关系，且2018年和2019年长电科技均为公司的第一大客户；
2	闻国涛	核心技术人员、专利发明人	否	否	否	未签订竞业禁止协议且原任职单位出具其不负竞业禁止义务的说明
3	路峰	核心技术人员、专利发明人	是	否	否	1、离职后未收到过竞业禁止补偿金； 2、原单位直属领导接受了访谈，证明其不存在违反竞业禁止方面的纠纷、诉讼或仲裁；

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同	是否收到竞业禁止补偿金	是否违反竞业禁止约定	备注
						3、原单位晟碟半导体从事存储器业务，与公司的业务不存在直接竞争关系；
4	刘琨	核心技术人员	否	否	否	未签订竞业禁止协议且原任职单位出具其不负竞业禁止义务的说明
5	左上勇	专利发明人	否	否	否	
6	杨恭乾	专利发明人	是	否	否	1、离职后未收到过竞业禁止补偿金； 2、原单位菲尼萨从事光通信业务，与公司的业务不存在直接竞争关系
7	傅郁晓	专利发明人	否	否	否	
8	张伟军	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	不适用	
9	晏云飞	专利发明人	否	否	否	
10	陈迎涛	专利发明人	否	否	否	
11	周俊	专利发明人	否	否	否	
12	史小奇	专利发明人	否	否	否	
13	张洪亮	专利发明人	否	否	否	
14	俞磊	专利发明人	否	否	否	
15	崔勇彬	专利发明人	否，入职前为自由职业	不适用	不适用	
16	关姜维	专利发明人	否	否	否	
17	赵阿勇	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	不适用	
18	吉晋阳	专利发明人	否	否	否	
19	柴振极	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	不适用	
20	李峰	专利发明人	否	否	不适用	原任职单位系其本人设立的公司
21	吴庆	专利发明人	否	否	否	
22	杨栓	专利发明人	否	否	否	

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同	是否收到竞业禁止补偿金	是否违反竞业禁止约定	备注
23	张丽霞	专利发明人	否，入职前为自由职业	不适用	不适用	
24	刘栋栋	专利发明人	否	否	否	
25	袁常乐	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	不适用	
26	王敏	专利发明人	否	否	否	
27	高大会	专利发明人	否	否	否	
28	赵坤鹏	专利发明人	否	否	否	
29	杨征	专利发明人	否	否	否	

如上表所示，公司核心技术人员和专利发明人中仅路峰、杨恭乾 2 人与原任职单位签订过含竞业禁止条款的劳动合同，由于其未收到过竞业禁止补偿金，因此不负竞业禁止的义务。其余人员因未签署过竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同，并且未收到过竞业禁止补偿金，因此亦不负竞业禁止的义务。

## 2、核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）是否存在违反原任职单位关于保密协议约定的情形

根据公司核心技术人员、专利发明人提供的劳动合同、保密协议等资料并经本所律师访谈核心技术人员和专利发明人，公司核心技术人员、专利发明人与原任职单位是否签订保密协议或含保密条款的劳动合同以及是否违反保密约定等情况如下表所示：

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订保密协议或含保密条款的劳动合同	是否违反保密约定	备注
1	骈文胜	核心技术人员、专利发明人	是	否	原单位直属领导接受访谈，证明其不存在违反保密约定方面的纠纷、诉讼或仲裁
2	闻国涛	核心技术人员、专利发明人	是	否	原任职单位出具其未违反保密义务的说明
3	路峰	核心技术人员、专利发明人	是	否	原任职单位直属领导接受访谈，证明其不存在违反保密约定方面的纠纷、诉讼或仲裁
4	刘琨	核心技术人员	是	否	原任职单位出具其未违反保密义务的说明

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订保密协议或含保密条款的劳动合同	是否违反保密约定	备注
5	左上勇	专利发明人	是	否	
6	杨恭乾	专利发明人	是	否	
7	傅郁晓	专利发明人	是	否	
8	张伟军	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	
9	晏云飞	专利发明人	是	否	
10	陈迎涛	专利发明人	是	否	
11	周俊	专利发明人	是	否	
12	史小奇	专利发明人	是	否	
13	张洪亮	专利发明人	是	否	
14	俞磊	专利发明人	是	否	
15	崔勇彬	专利发明人	否，入职前为自由职业	不适用	
16	关姜维	专利发明人	是	否	
17	赵阿勇	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	
18	吉晋阳	专利发明人	是	否	
19	柴振极	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	
20	李峰	专利发明人	否	不适用	原任职单位系其本人设立的公司
21	吴庆	专利发明人	是	否	
22	杨栓	专利发明人	是	否	
23	张丽霞	专利发明人	否，入职前为自由职业	不适用	
24	刘栋栋	专利发明人	是	否	
25	袁常乐	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	
26	王敏	专利发明人	是	否	
27	高大会	专利发明人	是	否	
28	赵坤鹏	专利发明人	是	否	
29	杨征	专利发明人	是	否	

如上表所示，公司核心技术人员、专利发明人中有 22 人与原任职单位签订了保密协议或包含保密条款的劳动合同。经本所律师访谈上述人员并对其进行网络核查，上述人员未违反保密约定且与原任职单位不存在诉讼、仲裁或其他纠纷。

### 3、核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）与原单位是否存在纠纷

## 或潜在纠纷

根据公司核心技术人员、专利发明人提供的相关资料并经本所律师访谈、网络核查，公司核心技术人员和专利发明人与原任职单位不存在任何与竞业禁止义务、保密义务或知识产权相关的诉讼或仲裁，公司核心技术人员、专利发明人与原任职单位不存在纠纷或潜在纠纷。

### 四、核查过程

1、查阅发行人拥有的专利证书，并获取国家知识产权局出具的专利批量法律状态证明；

2、查阅发行人出具的6项发明专利在主营业务中具体应用情况的说明；

3、查阅核心技术人员、专利发明人与原任职单位的劳动合同或同时期劳动合同模板、保密协议（如有）、竞业禁止协议（如有）；

4、访谈骈文胜、路峰原任职单位的直属领导，查阅闻国涛、刘琨原任职单位出具的说明；

5、查阅发行人出具的说明，了解核心技术人员、其他专利发明人的从业经历、参与的专利发明情况、核心技术形成过程中发挥的作用以及核心技术形成的历史节点等；

6、访谈核心技术人员与专利发明人，了解其与原任职单位关于是否签订竞业禁止或竞业限制、保密义务相关协议以及是否收到原任职单位的竞业禁止补偿金等情况；

7、取得并查阅核心技术人员、在职的其他专利发明人与原任职单位有交易的银行卡流水；

8、通过中国裁判文书网、中国执行信息公开网等公开网站对发行人专利、核心技术人员及专利发明人是否存在纠纷的情况进行网络核查。

### 五、核查意见

经核查，本所律师认为：

1、公司6项发明专利均为公司自主研发，专利发明人均为公司员工，该6项发明专利均运用于发行人主营业务；

2、公司核心技术来源均为公司自主研发，合法合规；

3、公司核心技术人员、专利发明人（已离职人员）不存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，不存在纠纷或潜在纠纷。

## 问题 5.关于销售和客户

5.1 根据招股说明书，公司按产品的测试工时向客户收取测试费用，获得测试收入。

请发行人说明：

（1）与封测一体化厂商相比，发行人获取客户的方式及获客优势，获取的测试服务订单的特点、测试的内容差异等情况；

（2）测试服务的定价机制及与同行业可比公司定价是否存在差异；

（3）报告期内芯片成品测试、晶圆测试平均销售与市场价格、同行业可比公司是否存在显著差异及合理性；

（4）结合获取客户方式、客户认证周期等，分析发行人成立时间较短即具有国内外知名厂商客户的合理性，是否符合行业惯例。

请发行人律师对问题（4）进行核查并发表明确意见。

回复：

### 一、发行人获取客户的方式

发行人为独立第三方测试企业，只经营集成电路测试一种业务，获客方式包括三种类型：①销售团队上门拜访，即公司的销售团队通过主动上门拜访等方式开发各类新客户；②客户上门联系，最近两年集成电路行业产能紧张，客户主动上门寻求与公司开展业务合作的情形也较为普遍；③客户引荐，基于公司测试技术和服务品质的良好口碑，老客户主动为公司引荐新客户也是公司十分重要的获客方式。

### 二、发行人主要客户的认证周期

发行人成为知名客户的合格供应商的认证过程一般包括双方初步接洽、签

署保密协议、客户来厂参观及验厂、公司通过合格供应商认证等几个环节，不同客户的完整认证周期一般在 30 天至 90 天不等。

### 三、发行人成立时间较短即具有国内外知名厂商客户的合理性

公司成立于 2016 年 5 月，通过 5 年多时间的积累，截至 2021 年 6 月 30 日，公司客户数量超过 170 家，客户涵盖芯片设计、制造、封装、IDM 等类型的企业，其中不乏紫光展锐、中兴微电子、晶晨股份、安路科技、比特大陆、兆易创新、卓胜微、普冉股份、长电科技、中颖电子、复旦微电、北京君正等国内外知名厂商。公司成立时间较短即具有较多的国内外知名厂商客户，主要原因有以下三个方面：

#### 1、公司的获客方式及客户认证周期方面的原因

在获客方式方面，通过主动登门拜访开展营销是公司主要的获客方式之一。对于行业知名客户，为了保障客户开发的成功率，公司董事长骈文胜先生会亲自挂帅，全程领导客户开发工作。由于公司高层对知名客户开发工作的重视，加上公司自身良好的技术实力、服务品质及行业口碑，公司在知名客户的开发方面取得了良好的效果。

在客户认证周期方面，公司成为知名客户的合格供应商的认证周期一般在 30 天至 90 天。由于客户认证周期较短，有利于公司在较短时间内成为知名客户的合格供应商。

#### 2、自身竞争优势和竞争策略方面的原因

在竞争优势方面，公司的核心团队成员深耕集成电路行业二十余年，是国内最早从事集成电路测试的一批资深人士，曾参与建立了中国大陆最早的晶圆测试工厂之一的威宇科技测试封装（上海）有限公司。团队主要成员曾先后在摩托罗拉、日月光、长电科技等全球知名半导体企业或封测龙头企业从事测试业务技术研发和管理工作，拥有深厚的专业背景，对测试技术研发、测试方案开发、量产导入、精益生产、测试产线自动化管理有着丰富的实践经验。公司成立之后，一直注重构建保持公司长期发展的各项竞争优势，具体包括技术团队的专业水平、公司的技术实力、测试服务的品质及效率、测试作业的自动化和智能化水平等内容，公司在这些方面处于国内领先地位，从而获得了国内外



知名客户的认可。

在竞争策略方面，公司在发展过程中一直坚持“以晶圆测试为核心，积极发展中高端芯片成品测试”的差异化竞争策略。由于历史和产业分工的原因，公司设立时，在晶圆测试领域，中国大陆还没有出现一家规模和技术实力都较强的内资测试企业，在中高端芯片成品测试领域，整个行业的产能也较为紧张，中国大陆的芯片设计公司只能将晶圆和中高端芯片成品大量送往中国台湾地区或海外地区开展测试。公司的差异化竞争策略和扩产方向瞄准了细分行业相对空白的领域，有效满足了中国大陆知名客户在晶圆测试和中高端芯片成品测试的需求，加速了公司开发高端知名客户的进程。

### 3、行业的历史性机遇方面的原因

中兴、华为禁令事件发生以前，中国大陆知名芯片设计公司的高端测试订单主要由中国台湾地区的厂商和海外厂商来完成，中兴、华为禁令事件发生之后，为了保障测试服务供应的自主可控，中国大陆的芯片设计公司开始大力扶持内资的测试服务供应商。公司积极把握行业发展历史机遇，一方面快速扩充高端测试产能，另一方面加大研发投入，重点突破各类高端芯片的测试工艺难点，使得公司能够较快成为中国大陆各大知名芯片设计公司高端芯片测试的国产化替代的重要供应商之一。

综上所述，公司成立时间较短即具有较多的国内外知名厂商客户，主要得益于公司高层对于客户开发的重视、客户认证周期较短、公司自身的竞争优势和差异化的竞争策略、行业的发展机遇等有利因素，具有合理性。

### 四、发行人成立时间较短即具有国内外知名厂商客户是否符合行业惯例

根据近期国内集成电路行业已上市或拟上市公司公开披露的相关资料，近几年集成电路行业发展迅速，其中包括普冉半导体（上海）股份有限公司（于2016年成立）、恒玄科技（上海）股份有限公司（于2015年成立）、中科寒武纪科技股份有限公司（于2016年成立）等行业内知名公司均存在成立时间较短即具有国内外知名厂商客户的情形。

综上所述，发行人成立时间较短即具有国内外知名厂商客户符合集成电路行业发展惯例。

## 五、核查过程

1、访谈发行人董事长、销售总监，了解发行人的获取客户方式、客户认证周期、业务优势、行业竞争格局等情况；

2、访谈发行人的部分知名客户，了解客户选择供应商的方式、认证周期以及选择发行人作为供应商的原因等问题；

3、查阅发行人所获荣誉情况；

4、查阅近期国内集成电路行业公司公开披露的相关资料。

## 六、核查意见

经核查，本所律师认为：

发行人成立时间较短即具有国内外知名厂商客户具有合理性，符合集成电路行业发展惯例。

## 问题 16.关于股东

**16.1** 根据招股说明书，发行人控股股东为蕊测半导体科技有限责任公司。公司创立初期，蕊测半导体是骈文胜、闻国涛、路峰、邵颖、沈爽恒、李峰 6 名创始人的持股平台。伟测有限设立时，出于便利手续办理的考虑，李峰代蕊测半导体持有伟测有限的全部股权，后代持解除。目前蕊测半导体的股东有骈文胜、闻国涛、路峰、邵颖、李峰和深圳市智汇科创科技有限公司。

请发行人说明：

蕊测半导体的历史沿革和股本演变情况，股权是否清晰，是否存在纠纷或潜在纠纷。

请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查并发表意见。

回复：

### 一、蕊测半导体的历史沿革和股本演变情况

1、2015 年 12 月，蕊测半导体成立

骈文胜、闻国涛、路峰、邵颖、沈爽恒、李峰 6 名创始人（以下简称“创

始团队”）在启动创业的初期各方达成如下口头约定：设立伟测科技作为具体业务的经营实体，以蕊测半导体作为创始团队的持股平台，蕊测半导体直接控股伟测科技。为了操作上的便利性，创始团队一致同意由李峰以个人名义先行完成两家公司的工商注册和前期筹备工作，后续再通过股权转让的方式将两家公司的股权架构调整成真实状态。

上海蕊测半导体科技有限公司于 2015 年 12 月 29 日由李峰和宋寅清设立，注册资本为 2,000 万元。同日，上海市浦东新区市场监督管理局核发了《营业执照》。

蕊测半导体设立时的股权结构如下所示：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	李峰	1,200	60
2	宋寅清	800	40
合计		2,000	100

此次设立蕊测半导体系李峰按照创始团队的约定，先行完成持股平台的工商注册。为了操作便利，李峰委托一家负责园区招商的公司协助办理工商注册相关事宜，因一人有限责任公司存在诸多限制，也将该园区招商公司的员工宋寅清其登记为股东。

## 2、蕊测半导体的股权变动

### （1）2016 年 2 月，蕊测半导体第一次股权转让

2016 年 2 月 18 日，宋寅清与赵影签署《股权转让协议》，协议约定宋寅清将其所持有的蕊测半导体 40% 的股权（对应认缴出资额 800 万元，实缴出资为 0 元）转让给赵影。上述股权转让主要因为宋寅清离职，因此园区招商公司安排另一名工作人员赵影持有股权。同日，蕊测半导体股东会作出相关决议。

2016 年 2 月 24 日，上海市浦东新区市场监督管理局准予了蕊测半导体的变更登记申请，对蕊测半导体章程进行备案，并核发《营业执照》。

变更后蕊测半导体的股权结构如下所示：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	李峰	1,200	60

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
2	赵影	800	40
合计		2,000	100

（2）2016年4月，蕊测半导体第二次股权转让

2016年4月10日，赵影与闻国涛签订《股权转让协议》，协议约定赵影将其所持有的蕊测半导体40%的股权（对应认缴出资额800万元，实缴出资额0元）作价0万元人民币转让给闻国涛。同日，蕊测半导体股东会作出相关决议。

2016年4月25日，上海市浦东新区市场监督管理局准予了蕊测半导体的变更登记申请，对蕊测半导体章程进行备案，并核发《营业执照》。

变更后蕊测半导体的股权结构如下所示：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	李峰	1,200	60
2	闻国涛	800	40
合计		2,000	100

该次股权转让系蕊测半导体创始团队希望更换持股主体为创始团队成员，所以蕊测半导体股东由园区招商公司工作人员赵影变更为发行人创始团队成员闻国涛。

（3）2017年9月，蕊测半导体第一次增资

2017年9月1日，蕊测半导体作出股东会决议，公司注册资本由2,000万元增至2,396万元，其中股东闻国涛认缴396万元，出资方式为货币。

2017年9月14日，上海市浦东新区市场监督管理局准予了蕊测半导体的变更登记申请，对公司章程进行备案，并核发《营业执照》。

变更后蕊测半导体的股权结构如下所示：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	李峰	1,200	50.08
2	闻国涛	1,196	49.92
合计		2,396	100

闻国涛认缴的396万元为代创始团队持有该部分股权，创始团队成员的实

际出资情况和出资比例以 2017 年 10 月代持还原后的股权状态为准。

#### （4）2017 年 10 月，蕊测半导体第三次股权转让

2017 年 9 月 18 日，李峰、闻国涛与骈文胜、路峰、邵颖、深圳市智汇科创科技有限公司签署《股权转让协议》，协议约定：李峰将所持有蕊测半导体 46.75% 股权（对应认缴出资 1,120 万元，实缴出资额 0 元）作价 0 万元人民币转让给骈文胜；闻国涛将所持有蕊测半导体 4.80% 股权（对应认缴出资 115 万元，实缴出资额 0 元）作价 0 万元转让给骈文胜；闻国涛将所持有蕊测半导体 9.60% 股权（对应认缴出资 230 万元，实缴出资额 0 元）作价 0 万元转让给路峰；闻国涛将所持有蕊测半导体 5.43% 股权（对应认缴出资 130 万元，实缴出资额 0 元）作价 0 万元转让给邵颖；闻国涛将所持有蕊测半导体 4.17% 股权（对应认缴出资 100 万元，实缴出资额 0 元）作价 0 万元转让给深圳市智汇科创科技有限公司。2017 年 9 月 19 日，蕊测半导体股东会作出相关决议。

2017 年 10 月 16 日，上海市浦东新区市场监督管理局准予了蕊测半导体的变更登记申请，对公司章程进行备案，并核发《营业执照》。

变更后蕊测半导体的股权结构如下所示：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	骈文胜	1,235	51.5442
2	闻国涛	621	25.9182
3	路峰	230	9.5994
4	李峰	80	3.3389
5	邵颖	130	5.4257
6	深圳市智汇科创科技有限公司	100	4.1736
合计		2,396	100

上述股权转让为蕊测半导体的代持解除，李峰与闻国涛将其所持有的股份按照约定的出资比例转让给其他创始团队成员，将股权结构还原成真实的状态。

自上述变更完成后至本补充法律意见书出具之日，蕊测半导体的股权结构未曾改变。

## 二、蕊测半导体股权是否清晰，是否存在纠纷或潜在纠纷

经本所律师核查，蕊测半导体股权的历史沿革中曾存在股权代持的情形，蕊测半导体的股东已经通过股权转让的方式解除了代持行为，股权代持的解除过程和最新的股权结构清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。

### 三、核查过程

- 1、查阅蕊测半导体全套工商档案，梳理蕊测半导体的历史沿革；
- 2、查阅蕊测半导体银行流水，核查历史沿革中股东出资的情况；
- 3、访谈蕊测半导体历史及现有股东，了解股权代持的背景和解除过程；
- 4、查阅蕊测半导体全体现有股东出具的确认函；
- 5、通过中国裁判文书网、中国执行信息公开网等公开网站对蕊测半导体是否存在涉及股权纠纷的情况进行网络核查。

### 四、核查意见

经核查，本所律师认为：

截至本补充法律意见书出具之日，蕊测半导体股权清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。

## 问题 18.关于其他问题

**18.1** 根据申报材料，上海承括电子科技有限公司成立于 2014 年 8 月 25 日，主营业务为科技推广和应用服务业，实际控制人配偶秦君梅在该公司持股 70%，并担任执行董事。

请发行人说明：

承括电子实际从事的具体业务，是否与发行人从事相同或相似业务，是否构成同业竞争。

请发行人律师进行核查，说明核查过程并发表意见。

回复：

一、承括电子实际从事的具体业务、是否与发行人从事相同或相似业务，是否构成同业竞争

根据承括电子的营业执照、工商档案等资料，承括电子的经营范围为：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、电子元器件、模具、机械设备及配件的销售。

根据承括电子提供的银行流水、部分业务合同并经本所律师访谈承括电子执行董事秦君梅，承括电子报告期内仅存在零星的贸易业务（墨水、不锈钢板、金属层架等），目前无具体经营的业务。承括电子不存在与发行人从事相同或相似业务的情形，与发行人不构成同业竞争。

## 二、核查过程

- 1、查阅发行人及承括电子的营业执照、工商档案；
- 2、查阅承括电子报告期内的银行流水、部分业务合同；
- 3、访谈承括电子执行董事秦君梅；
- 4、查阅承括电子出具的《关于主营业务的说明》。

## 三、核查意见

经核查，本所律师认为：

承括电子报告期内仅存在零星的贸易业务（墨水、不锈钢板、金属层架等），目前无具体经营的业务。承括电子不存在与发行人从事相同或相似业务的情形，与发行人不构成同业竞争。

**18.2 招股说明书披露，发行人子公司厦门伟测成立于 2017 年 7 月 5 日，2020 年 12 月 7 日已经注销。厦门伟测自成立之后至注销前均未实际开展过生产经营活动。**

请发行人说明厦门伟测成立又注销的具体原因，未实际开展生产经营活动的原因，注销过程中的资产和债务处置情况，存续期间是否存在重大违法违规行为。

请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查，说明核查过程并发表意见。

回复：

一、厦门伟测成立又注销的具体原因，未实际开展生产经营活动的原因

根据本所律师访谈发行人实际控制人，厦门伟测的设立主要因为公司于 2017 年拟引进厦门当地某国有基金作为股东。在商谈具体投资计划的过程中，该投资人要求公司在厦门当地设立子公司。后续由于公司融资计划改变，最终未引进该国有基金，厦门伟测也一直未实际开展生产经营活动。基于精简机构的需要，公司于 2020 年经内部决策后决定予以注销。

## 二、厦门伟测注销过程中的资产和债务处置情况

厦门伟测在注销之前，公司未向厦门伟测实际出资，厦门伟测未实际开展业务，亦未开立银行账户，未购置资产，无未清理的债权债务。

综上所述，厦门伟测注销前未实际经营，不涉及注销过程中的资产和债务处置情况。

## 三、厦门伟测持续期间是否存在重大违法违规行为

厦门伟测存续期间未实际开展业务，亦未开立银行账户，未购置资产，不存在重大违法违规行为。

## 四、核查过程

- 1、查阅厦门伟测的工商档案；
- 2、访谈发行人实际控制人、董事长骈文胜，了解厦门伟测成立及注销的背景；
- 3、查阅厦门伟测出具的《简易注销全体投资人承诺书》；
- 4、查阅天健会计师出具的《审计报告》；
- 5、通过国家企业信用信息公示系统、信用中国等公开网站对厦门伟测是否存在重大违法违规行为进行网络核查。

## 五、核查意见

经核查，本所律师认为：

- 1、厦门伟测的设立主要因为公司于 2017 年拟引进厦门当地某国有基金作为股东。在商谈具体投资计划的过程中，该投资人要求公司在厦门当地设立子公司。后续由于公司融资计划改变，最终未引进该国有基金，厦门伟测也一直未实际开展生产经营活动。基于精简机构的需要，公司于 2020 年经内部决策后



决定予以注销。

2、厦门伟测在注销之前，发行人未向厦门伟测实际出资，厦门伟测未实际开展业务，亦未开立银行账户，不涉及资产及债务处置的情况。

3、报告期内厦门伟测不存在任何行政处罚的情况，不存在重大违法违规行为。

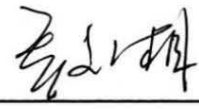
（本页以下无正文）


(本页无正文,系《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书(一)》之签署页)



上海市锦天城律师事务所

负责人:   
顾功耘

经办律师:   
乔文湘

经办律师:   
夏瑜杰

2022年2月28日

上海市锦天城律师事务所  
关于上海伟测半导体科技股份有限公司  
首次公开发行股票并在科创板上市的

补充法律意见书（二）



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层  
电话：021-20511000                      传真：021-20511999  
邮编：200120

## 目 录

声明事项 .....	2
释 义 .....	4
正 文 .....	6
第一部分 补充核查事项 .....	6
一、 本次发行上市的批准和授权.....	6
二、 发行人本次发行上市的主体资格.....	6
三、 发行人本次发行上市的实质条件.....	6
四、 发行人的设立.....	11
五、 发行人的独立性.....	11
六、 发起人、股东及实际控制人.....	11
七、 发行人的股本及其演变.....	14
八、 发行人的业务.....	14
九、 关联交易及同业竞争.....	17
十、 发行人的主要财产.....	24
十一、 发行人的重大债权债务.....	29
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并.....	37
十三、 发行人公司章程的制定与修改.....	37
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	37
十五、 发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化.....	38
十六、 发行人的税务.....	38
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.....	40
十八、 发行人募集资金的运用.....	41
十九、 发行人业务发展目标.....	41
二十、 诉讼、仲裁或行政处罚.....	41
二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价.....	41
二十二、 发行人律师认为需要说明的其他问题.....	42
二十三、 结论意见.....	43
第二部分 关于《第一轮问询函》相关回复的更新 .....	44
问题 2.关于核心技术来源.....	44

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于上海伟测半导体科技股份有限公司**  
**首次公开发行股票并在科创板上市的**  
**补充法律意见书（二）**

案号：01F20202132

**致：上海伟测半导体科技股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“伟测科技”）的委托，并根据发行人与本所签订的《聘请律师合同》，作为发行人首次公开发行股票并在科创板上市项目（以下简称“本次发行上市”）的特聘专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《科创板首发管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，就本次发行上市所涉有关事宜于 2021 年 12 月 22 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）和《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”），并于 2022 年 2 月 28 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）。

本所律师根据发行人自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日期间（以下简称“补充核查期间”）已经存在或者发生的经营情况及事实情况，对发行人相关法律事项进行补充核查，现出具《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（二）》

（以下简称“本补充法律意见书”）。本补充法律意见书是对《律师工作报告》、《法律意见书》及《补充法律意见书（一）》的更新和补充，对于在《律师工作报告》、《法律意见书》及《补充法律意见书（一）》中已经表述的部分，本补充法律意见书不再赘述。

## 声明事项

一、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

二、本所及本所律师仅就与发行人本次发行上市有关法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估、内部控制、盈利预测等专业事项发表意见。在本补充法律意见书和为本次发行上市出具的《法律意见书》《律师工作报告》中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告和内部控制报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。

三、本补充法律意见书中，本所及本所律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件发生时所应当适用的法律、法规、规章及规范性文件为依据。

四、本补充法律意见书的出具已经得到发行人如下保证：发行人已经提供了本所为出具本补充法律意见书所要求发行人提供的全部原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

五、对于本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依据有关政府部门、发行人或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见。

六、本所同意发行人在《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)》(以下简称“《招股说明书(申报稿)》”)中自行引用或按上海证券交易所(以下简称“上交所”)审核要求引用本补充法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

七、本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所及本所律师根据有关法律、法规、规章和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及上交所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本补充法律意见书。

## 释 义

本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述含义：

发行人、伟测科技、公司	指	上海伟测半导体科技股份有限公司
伟测有限	指	上海伟测半导体科技有限公司，发行人前身
蕊测半导体、控股股东	指	上海蕊测半导体科技有限公司，发行人股东
走泉元禾	指	江苏走泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
新潮投资	指	江苏新潮创新投资集团有限公司，发行人股东
德同合心	指	苏州市德同合心创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
子公司	指	发行人合并报表范围内的全资、控股子公司
南京伟测	指	南京伟测半导体科技有限公司，发行人子公司
本所、锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
保荐机构、平安证券	指	平安证券股份有限公司
天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
A 股	指	境内上市人民币普通股
本次发行上市、本次发行	指	发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市
报告期	指	2019 年度、2020 年度及 2021 年度
补充核查期间	指	2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
《招股说明书（申报稿）》	指	发行人为本次发行上市制作的《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》
《上市保荐书》	指	保荐机构出具的《关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》
《预计市值的分析报告》	指	保荐机构出具的《关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之预计市值的分析报告》
本补充法律意见书	指	《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（二）》
《审计报告》	指	天健会计师出具的“天健审（2022）6-268 号”《上海伟测半导体科技股份有限公司三年期审计报告》
《内控鉴证报告》	指	天健会计师出具的“天健审（2022）6-269 号”《上海伟测半导体科技股份有限公司内部控制鉴证报告》
《公司章程》	指	根据上下文意所需，指发行人及其前身制定并不时修订的公司章程，另有说明的除外



《公司章程（草案）》	指	发行人为本次发行上市制定的《上海伟测半导体科技股份有限公司章程（草案）》，于2021年10月8日经发行人2021年第二次临时股东大会审议通过，于发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌交易之日起生效
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《科创板首发管理办法》	指	《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《科创板股票上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
中国、境内	指	中华人民共和国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区），为本补充法律意见书之目的，指中国大陆地区
境外	指	除中国大陆地区以外的国家及地区
法律法规	指	提及当时公布并生效的中国大陆法律、行政法规、地方性法规、规章以及规范性文件
国家企业信用信息公示系统	指	中华人民共和国国家市场监督管理总局主办的国家企业信用信息公示系统网站，其网址为 <a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a>
元、万元	指	人民币元、万元，上下文另有说明的除外

注：除特别说明外，本补充法律意见书中若出现总计数与分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

## 正文

### 第一部分 补充核查事项

#### 一、本次发行上市的批准和授权

本所律师已在《法律意见书》和《律师工作报告》中详细披露了发行人 2021 年第二次临时股东大会作出的批准本次发行上市以及授权董事会处理本次发行上市相关事宜的决议。截至本补充法律意见书出具之日，发行人本次发行上市的批准和授权情况未发生变化。

#### 二、发行人本次发行上市的主体资格

发行人为依法设立、有效存续且持续经营时间三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《科创板首发管理办法》第十条之规定，具备本次发行上市的主体资格，截至本补充法律意见书出具之日，发行人未出现根据法律法规及《公司章程》需要终止的情形。

#### 三、发行人本次发行上市的实质条件

经逐条对照《公司法》《证券法》《科创板首发管理办法》《科创板股票上市规则》等法律法规的规定，本所律师认为，发行人符合股份有限公司公开发行新股及申请股票在科创板上市的相关实质条件：

##### （一）发行人本次发行上市符合《公司法》及《证券法》规定的相关条件

1、发行人已就本次发行上市聘请了平安证券作为保荐机构，符合《证券法》第十条第一款的规定。

2、根据发行人本次发行的《招股说明书（申报稿）》及发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过之《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》，发行人本次发行的股票均为人民币普通股（A 股）股票，每一股份具有同等权利，每股的发行条件和价格相同，发行价格根据向询价对象询价结果并参考市场情况确定，不低于票面金额，符合《公司法》第一百二十六条、一百二十七条的规定。

3、根据发行人 2021 年第二次临时股东大会会议文件，发行人本次发行已经依照《公司章程》的规定由股东大会和董事会对发行股票的种类、数量、价格、对象等事项作出决议，符合《公司法》第一百三十三条的规定。

4、经本所律师查验，发行人已设立了股东大会、董事会、监事会及董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，选举了董事（包括独立董事）、各董事会专门委员会委员、监事（包括职工代表监事），并聘请了总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员，在报告期内发行人根据《公司章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会会议，历次股东大会、董事会和监事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法規以及当时适用的《公司章程》的规定，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项之规定。

5、发行人为长期存续的股份有限公司，其依照法律的规定在其经营范围内开展经营活动，截至本补充法律意见书出具之日，发行人依法有效存续，生产经营正常，具备生产经营所需的各项资质证书，能够支付到期债务，不存在影响其持续经营的法律障碍，具有持续经营能力。根据《审计报告》，发行人业务在报告期内有包括现金流量、营业收入、交易客户、管理费用支出等内容的持续营运记录；发行人不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项；亦不存在依据《公司法》及《公司章程》规定需要解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项之规定。

6、根据《审计报告》，发行人有关会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。天健会计师针对发行人最近三年一期的财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项之规定。

7、根据发行人及其控股股东、实际控制人出具的确认、公安机关出具的无犯罪记录证明、本所律师与实际控制人、发行人主要负责人的面谈及通过中国证监会、中国执行信息公开网等网站的公开查询，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项之规定。

（二）发行人本次发行上市符合《科创板首发管理办法》规定的发行条件

1、经本所律师查验，发行人是依法设立且持续经营 3 年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，具备本次发行上市的主体资格，符合《科创板首发管理办法》第十条之规定。

2、根据《审计报告》及发行人的确认，并经本所律师访谈发行人财务总监，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由天健会计师出具了标准无保留意见的《审计报告》，符合《科创板首发管理办法》第十一条第一款之规定。

3、根据《内控鉴证报告》及发行人的确认，并经本所律师查验，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由天健会计师出具了无保留结论的《内控鉴证报告》，符合《科创板首发管理办法》第十一条第二款之规定。

4、经本所律师查验，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《科创板首发管理办法》第十二条第一款第（一）项之规定。

5、经本所律师查验，最近 2 年内发行人主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员没有发生重大不利变化，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近两年实际控制人没有发生变更，符合《科创板首发管理办法》第十二条第一款第（二）项之规定。

6、经本所律师查验，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等重大权属纠纷，发行人不存在重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项。根据《招股说明书（申报稿）》及本所律师与发行人管理层的访谈，截至本补充法律意见书出具之日，在其合理预见范围内，不存在发行人所处行业的经营环境已经或者将要发生重大变化并对发行人持续经营有重大不利影响，亦不存在其他对发行人持续经营有重大不利影响的事项，发行人已经在《招股说明书（申报稿）》披露了相关风险因素，符合《科创板首发管理办法》第十二条第一款第（三）项之规定。

7、根据《招股说明书（申报稿）》及发行人的说明，发行人的主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。发行人及其子公司所从事的业务均在工商行政管理部门登记的经营范围内，发行人主营业务所属的行业亦为国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年修订）中的“鼓励类”产业。其经营符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，符合国家产业政策。经本所律师查验，发行人持有经营所需的各项资质证书，有关证书均在有效期内。经本所律师比对国家发展和改革委员会颁布之《产业结构调整指导目录（2019年本）》及中华人民共和国环境保护部颁布之《环境保护综合名录（2021年版）》，发行人现有经营不涉及前述产业结构调整指导目录中列示的限制类和淘汰类产业，发行人现有产品不属于前述环境保护综合名录中列示的高污染、高环境风险产品，符合《科创板首发管理办法》第十三条第一款之规定。

8、根据发行人及其控股股东、实际控制人出具的确认，并经本所律师通过中国证监会、中国执行信息公开网等网站进行公开查询，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《科创板首发管理办法》第十三条第二款之规定。

9、根据发行人的确认、发行人董事、监事及高级管理人员填写的调查表、作出的声明和承诺以及公安机关出具的无犯罪记录证明，并经本所律师通过中国证监会、中国执行信息公开网等网站的公开查询，发行人的现任董事、监事和高级管理人员不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《科创板首发管理办法》第十三条第三款之规定。

### （三）发行人本次发行上市符合《科创板股票上市规则》规定的上市条件

1、如本补充法律意见书前文所述，发行人满足《科创板首发管理办法》第十条至第十三条规定的发行条件，符合《科创板股票上市规则》第2.1.1条第一款第（一）项之规定。

2、根据发行人的历次验资报告以及发行人现时有效的《营业执照》，发行

人本次发行上市前股本总额为 6,540.80 万元，发行后股本总额不会低于 3,000 万元，符合《科创板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（二）项之规定。

3、根据经发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过之《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》及《招股说明书（申报稿）》，发行人本次发行前股份总数为 6,540.80 万股，发行人本次拟向社会公开发行的股份数不超过 2,180.27 万股，本次发行方案确定的拟发行股份数不低于发行后总股本的 25%，符合《科创板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（三）项之规定。

4、根据《上市保荐书》及《预计市值的分析报告》，发行人预计总市值不低于人民币 10 亿元，根据《审计报告》，发行人 2021 年度经审计的净利润为 132,175,641.77 元且营业收入为 493,144,257.09 元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元，发行人的市值及财务指标符合《科创板股票上市规则》第 2.1.2 条规定的第一项标准，发行人符合《科创板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（四）项之规定。

**（四）发行人符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（1）-（4）项之规定**

1、根据《审计报告》，发行人 2019 年、2020 年、2021 年的研发费用分别为 13,371,662.77 元、21,013,963.09 元、47,742,834.01 元，占最近三年营业收入的比例分别为 17.16%、13.04%、9.68%，满足最近三年研发投入占营业收入比例 5% 以上的要求，符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（1）项之规定。

2、根据《招股说明书（申报稿）》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司研发人员总数为 176 人，公司员工总数为 927 人，研发人员占当年公司员工总人数的比例为 18.99%，不低于 10%，因此符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（2）项之规定。

3、经本所律师查验有关专利证书以及本所律师通过国家知识产权局公开信息的查询，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司合法拥有 7 项形成主营业务收入的发明专利。因此符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（3）项之规定。

4、根据《审计报告》，发行人 2019 年、2020 年、2021 年的营业收入分别为 77,933,235.29 元、161,196,220.78 元、493,144,257.09 元，复合增长率超过 20%，

因此符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（4）项之规定。

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行上市已经满足《公司法》《证券法》《科创板首发管理办法》《科创板股票上市规则》《科创属性评价指引（试行）》规定的各项实质条件，尚需取得上交所的审核通过并经中国证监会同意注册，待完成公开发行后，股票上市尚需取得上交所的同意。

#### 四、发行人的设立

本所律师已在《法律意见书》和《律师工作报告》中详细披露发行人的设立程序、条件等事项。经本所律师核查，补充核查期间，发行人的设立事宜未发生变化。

#### 五、发行人的独立性

本所律师已在《法律意见书》和《律师工作报告》中详细披露发行人的独立性情况。根据发行人的说明并经本所律师核查，补充核查期间，发行人资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性未发生变化，截至本补充法律意见书出具之日，发行人仍具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

#### 六、发起人、股东及实际控制人

##### （一）发行人的发起人

经本所律师核查，补充核查期间，发行人的发起人未发生变化。发行人的发起人均具备向发行人出资、成为发起人股东的资格，发行人的发起人人数、住所和出资比例均符合有关法律法规的规定。

##### （二）发行人现有股东

经本所律师查验，补充核查期间，发行人共有 16 名股东，未发生变化，部分股东的相关信息发生变更，具体如下：

##### 1、惠泉元禾

截至本法律意见书出具之日，惠泉元禾合伙人及合伙份额情况如下表所示：

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比例 (%)	合伙人类型
----	----------	-------------	---------------	-------

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比例 (%)	合伙人类型
1	苏州亚投荣基股权投资中心 (有限合伙)	80,000	24.3902	有限合伙人
2	苏州元禾控股股份有限公司	75,000	22.8658	有限合伙人
3	国家集成电路产业投资基金股 份有限公司	70,000	21.3415	有限合伙人
4	江苏省政府投资基金(有限合 伙)	45,000	13.7195	有限合伙人
5	深圳市鲲鹏股权投资有限公司	20,000	6.0976	有限合伙人
6	苏州汾湖创新产业投资中心 (有限合伙)	20,000	6.0976	有限合伙人
7	长三角协同优势产业股权投资 合伙企业(有限合伙)	6,250	1.9055	有限合伙人
8	上海清恩资产管理合伙企业 (有限合伙)	4,375	1.3338	有限合伙人
9	上海科创中心二期私募投资基 金合伙企业(有限合伙)	4,375	1.3338	有限合伙人
10	苏州致芯方维投资管理合伙企 业(有限合伙)	3,000	0.9146	普通合伙人
合计		328,000	100	--

## 2、新潮投资

2021年9月29日，新潮投资的企业名称由“江苏新潮科技集团有限公司”变更为“江苏新潮创新投资集团有限公司”

## 3、德同合心

截至本法律意见书出具之日，德同合心合伙人及合伙份额情况如下表所示：

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比 例(%)	合伙人类型
1	西藏德同企业管理有限公司	5,000	2.5000	普通合伙人
2	上海科创中心一期股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	20,000	10.0000	有限合伙人
3	苏州市吴江产业投资有限公司	20,000	10.0000	有限合伙人
4	国投创合国家新兴产业创业投 资引导基金(有限合伙)	20,000	10.0000	有限合伙人
5	前海股权投资基金(有限合伙)	15,000	7.5000	有限合伙人
6	平潭坤盛鼎兴股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	8,400	4.2000	有限合伙人
7	江西省发展升级引导基金(有限	10,000	5.0000	有限合伙人



序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比 例 (%)	合伙人类型
	合伙)			
8	上海青浦投资有限公司	10,000	5.0000	有限合伙人
9	苏州工业园区元禾招商股权投资 投资基金合伙企业(有限合伙)	10,000	5.0000	有限合伙人
10	上海世丞股权投资基金管理有 限公司	7,000	3.5000	有限合伙人
11	上海德心股权投资基金管理有 限公司	8,370	4.1850	有限合伙人
12	深圳市丰源昌意投资中心(有限 合伙)	5,800	2.9000	有限合伙人
13	新余市晟创投资管理有限公司	7,000	3.5000	有限合伙人
14	远海明晟(苏州)股权投资合伙 企业(有限合伙)	7,000	3.5000	有限合伙人
15	南通江海产业发展投资基金(有 限合伙)	5,000	2.5000	有限合伙人
16	横琴宏帷股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	4,550	2.2750	有限合伙人
17	招商证券投资有限公司	5,000	2.5000	有限合伙人
18	嘉善县金融投资有限公司	5,000	2.5000	有限合伙人
19	苏州娄城国发高新技术产业投 资企业(有限合伙)	3,000	1.5000	有限合伙人
20	上海灿辉投资发展有限公司	2,500	1.2500	有限合伙人
21	平阳箴言德同投资管理合伙企 业(有限合伙)	2,000	1.0000	有限合伙人
22	辉县市豫辉哈工产业引导基金 合伙企业(有限合伙)	2,000	1.0000	有限合伙人
23	共青城乾堃荣福投资合伙企业 (有限合伙)	3,250	1.6250	有限合伙人
24	北京京北时代投资中心(有限合 伙)	1,000	0.5000	有限合伙人
25	宁波京北未来成功投资中心(有 限合伙)	1,000	0.5000	有限合伙人
26	宁波海威同心股权投资中心(有 限合伙)	1,000	0.5000	有限合伙人
27	东渡丰汇投资发展集团有限公 司	1,000	0.5000	有限合伙人
28	惠州市润博信息咨询部(有限合 伙)	1,000	0.5000	有限合伙人
29	杭州易盛投资合伙企业(有限合 伙)	1,000	0.5000	有限合伙人

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比 例 (%)	合伙人类型
30	南昌辰景咨询管理有限公司	1,500	0.7500	有限合伙人
31	上海德榮资产管理有限公司	630	0.3150	有限合伙人
32	共青城函数厚颐投资管理合伙企业（有限合伙）	1,505	0.7525	有限合伙人
33	共青城函数泽源投资管理合伙企业（有限合伙）	1,495	0.7475	有限合伙人
34	深圳涵鑫六号投资中心（有限合伙）	3,000	1.5000	有限合伙人
合计		200,000	100	-

### （三）发行人的控股股东和实际控制人

发行人的控股股东为蕊测半导体，骈文胜系发行人的实际控制人。补充核查期间，发行人的控股股东和实际控制人未发生变化。

## 七、发行人的股本及其演变

本所律师已在《律师工作报告》中详细披露了发行人的股本及其演变。经本所律师核查，补充核查期间，发行人的股本及演变情况未发生变化。发行人各股东所持发行人的股份不存在冻结、质押等权利限制的情形。

## 八、发行人的业务

### （一）发行人的经营范围和经营方式

#### 1、发行人的经营范围

经本所律师查验，补充核查期间，发行人主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。与其《营业执照》所记载的经营范围相符，其经营范围和经营方式符合有关法律法规的规定。

#### 2、发行人境内子公司的经营范围

经本所律师查验，补充核查期间，发行人新增一家全资子公司南京伟测，发行人及其子公司实际从事的业务没有超出其营业执照核准的经营范围，其经营范围和经营方式符合有关法律法规的规定。

### （二）发行人及其子公司取得的资质、许可、备案文件

经本所律师查验，补充核查期间，发行人资质、许可、备案文件变化如下所示：

#### 1、进出口相关证书文件

序号	持证主体	证书名称	登记机关	海关注册编码/ 登记备案表编号	登记日期
1	伟测科技	中华人民共和国海关 报关单位注册登记证 书	浦东海关	3122260CSL	2017-04-19
2	伟测科技	对外贸易经营者备案 登记表	上海市浦东新 区商务委员会	02725948	2021-01-13
3	无锡伟测	海关进出口货物收发 货人备案回执	无锡海关	32023631KN	2020-08-05
4	无锡伟测	对外贸易经营者备案 登记表	无锡市对外贸 易经济合作局	04184930	2020-07-31
5	南京伟测	海关进出口货物收发 货人备案回执	金陵海关	3201960JYX	2021-11-24

#### 2、管理体系证书

序号	持证主体	证书类型	颁发机构	证书编号	证书内容	有效期限
1	伟测科技	质量管理 体系认证 证书	NOA Certificati on 挪亚检测	NOA16128 67	质量管理体系符合 GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2015 标 准 认证范围：半导体芯 片测试	2021/08/23-20 22/08/15
2	伟测科技	环境管理 体系认证 证书	NOA Certificati on 挪亚检测	NOA16128 68	环境管理体系符合 GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015 标准 认证范围：半导体芯 片测试	2021/08/23-20 22/08/15
3	伟测科技	职业健康 安全管理 体系认证 证书	NOA Certificati on 挪亚检测	NOA19947 51	职业健康安全管 理体系符合 GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准 认证范围：半导体芯 片测试	2021/08/23-20 22/08/12
4	伟测科技	质量管理 体系认证 证书	Quality Austria 奥世认证	10515/0	质量管理体系符合 IATF 16949:2016 不含产品设计 半导体芯片的熔丝	2020/05/28-20 23/05/27

序号	持证主体	证书类型	颁发机构	证书编号	证书内容	有效期限
					微调	
5	无锡伟测	质量管理体系认证证书	Quality Austria 奥世认证	25033/0	质量管理体系符合 ISO 9001:2015 集成电路芯片的熔丝微调 and 测试服务	2020/11/05-2023/11/04
6	无锡伟测	环境管理体系认证证书	Quality Austria 奥世认证	04198/0	环境管理体系符合 ISO 14001:2015 集成电路芯片的熔丝微调 and 测试服务	2020/11/05-2023/11/04
7	无锡伟测	职业健康安全管理体系认证证书	Quality Austria 奥世认证	00903/0	职业健康安全管理体系符合 ISO 4500:2018 集成电路芯片的熔丝微调 and 测试服务	2020/11/05-2023/11/04
8	无锡伟测	质量管理体系认证证书	Quality Austria 奥世认证	12314/0	质量管理体系符合 IATF 16949:2016 不含产品设计 半导体芯片的熔丝微调	2021/11/03-2024/11/02

### 3、高新技术企业证书

2021年12月发行人获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202131004437，有效期为3年。

（三）经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人未在中国大陆以外的其他国家和地区从事经营活动。

（四）经本所律师查验，最近两年，发行人主营业务未发生变更。

（五）根据《审计报告》，报告期内发行人的营业收入以主营业务为主，发行人的主营业务突出。

（六）经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及子公司依照法律法规在其经营范围内开展经营活动，具备生产经营所需的各项资质证书或认证、备案文件，不存在影响其持续经营的法律障碍。根据《招股说明书（申报稿）》及发行人确认，截至本补充法律意见书出具之日，在其合理预见范围内，不存在发行人所处行业的产业政策已经或者将要发生重大变化并对发行人持续

经营有重大不利影响的情形，发行人已经在《招股说明书（申报稿）》披露了相关风险因素。

## 九、关联交易及同业竞争

### （一）关联方

经本所律师查验，补充核查期间，发行人新增部分关联方，具体如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	南京伟测	发行人子公司
2	天津环球海洋工程装备有限公司	监事高晓配偶的弟弟担任执行董事的公司
3	天津环球水下系统作业装备有限公司	监事高晓配偶的弟弟担任执行董事的公司

### （二）关联交易

根据《审计报告》、相关关联交易协议等文件，发行人及其子公司在报告期内与关联方发生的主要关联交易如下：

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### （1）采购商品的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
强一半导体（苏州）有限公司	探针卡及维修	1,921,617.24	77,005.30	41,009.73
上海季丰电子股份有限公司	测试备件及服务	539,738.32	136,100.00	51,002.65
上海市浦东新区唐镇国澜餐饮店	餐饮		707,565.00	1,014,950.00
上海承括电子科技有限公司	速干墨水			24,180.00
江苏长电科技股份有限公司 [注]	测试设备	3,124,164.00		
小计		<b>5,585,519.56</b>	<b>920,670.30</b>	<b>1,131,142.38</b>

注：实际为江苏长电科技股份有限公司、江阴长电先进封装有限公司以及星科金朋半导体（江阴）有限公司合并披露，系关联公司

##### （2）出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
普冉半导体（上海）股份有限公司	检测服务及治具销售	16,240,233.51	17,977,381.34	9,969,172.49
中微半导体（深圳）股份有限公司	检测服务及治具销售	416,119.96	353,591.92	
江苏长电科技股份有限公司 [注]	检测服务	593,201.61	8,832,588.68	13,710,133.61
小计		<b>17,249,555.08</b>	<b>27,163,561.94</b>	<b>23,679,306.10</b>

注：实际为江苏长电科技股份有限公司、江阴长电先进封装有限公司以及星科金朋半导体（江阴）有限公司合并披露，系关联公司

## 2、关联租赁

### （1）公司出租情况

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	2021 年度确认的 租赁收入	2020 年度确认的 租赁收入	2019 年度确认的 租赁收入
江苏长电科技股份有限公司 [注]	检测设备	240,000.00	161,150.44	82,743.35

注：实际为江苏长电科技股份有限公司、江阴长电先进封装有限公司以及星科金朋半导体（江阴）有限公司合并披露，系关联公司

### （2）公司承租情况

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2021 年度确认的 租赁费	2020 年度确认的 租赁费	2019 年度确认的 租赁费
江苏长电科技股份有限公司	检测设备	25,510,000.66	4,916,871.17	
上海季丰电子股份有限公司	检测设备		133,000.00	
小计		<b>25,510,000.66</b>	<b>5,049,871.17</b>	

## 3、关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
骈文	4,800,000.00	2021/3/12	2022/3/11	否	

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
胜、秦君梅	10,000,000.00	2021/4/22	2022/4/21		
	9,000,000.00	2021/1/15	2022/1/14		
	10,000,000.00	2021/9/26	2022/9/25		
骈文胜	35,000,000.00	2021/6/10	2023/6/9	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 66,969,204.43 元的固定资产提供抵押担保
骈文胜	15,000,000.00	2021/11/18	2022/11/17	否	
	3,276,000.00	2021/6/7	2024/6/7		
	6,724,000.00	2021/9/6	2024/6/7		
	10,000,000.00	2021/6/11	2022/5/30		
骈文胜	6,790,902.59	2020/12/15	2023/12/15	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 42,084,074.37 元的固定资产提供抵押担保
	9,172,507.07	2021/1/12	2023/12/15		
	10,100,530.96	2021/2/9	2023/12/15		
	10,271,961.11	2021/6/3	2024/5/20		
骈文胜	429,905.13	2019/12/5	2022/1/14	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 5,825,637.88 元的使用权资产提供抵押担保
	1,375,213.88	2019/12/17	2022/2/13		
	970,963.80	2019/12/17	2022/12/2		
	976,932.17	2020/2/28	2023/2/1		
骈文胜、秦君梅、上海蕊测半导体科技有限公司	3,534,802.02	2020/5/27	2023/5/12	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为 23,517,038.99 元的使用权资产提供抵押担保
	4,211,125.99	2020/8/14	2023/8/14		
	3,755,352.42	2020/8/14	2023/8/29		
	1,164,085.47	2020/9/3	2023/9/28		
	3,046,366.10	2020/11/3	2023/11/16		
	1,959,675.27	2020/11/3	2023/11/16		
骈文胜	1,108,286.15	2019/7/31	2022/7/16	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为 9,838,859.35 元的固定资产提供抵押担保
	1,306,907.47	2019/9/30	2022/9/14		
骈文胜、闻国涛	2,255,385.35	2019/4/22	2022/4/22	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为 26,637,711.37 元的使用权资产提供抵押担保
	8,033,963.02	2021/3/22	2023/3/22		
骈文胜、闻国涛、上海蕊测半导体科技	1,268,494.42	2019/8/10	2022/8/10	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为 14,405,440.11 元的使用权资产提供抵押担保
	2,469,104.02	2019/9/22	2022/9/21		

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
有限公司					
骈文胜、秦君梅	3,749,999.95	2020/9/29	2022/9/21	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为12,981,643.50元的固定资产提供抵押担保
骈文胜	21,818,181.81	2020/11/17	2023/11/16	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为37,986,749.70元的固定资产提供抵押担保
骈文胜	1,839,356.74	2021/5/27	2024/5/27	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为13,396,302.23元的使用权资产提供抵押担保
	7,827,033.60	2021/7/9	2024/7/9		
骈文胜、闻国涛、路峰	12,985,558.28	2020/10/23	2023/10/22	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为3,464,506.10元固定资产及24,365,381.69元的使用权资产提供抵押担保
骈文胜、闻国涛	6,327,219.75	2021/2/22	2023/2/22	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为12,436,316.78元的使用权资产提供抵押担保
上海蕊测半导体科技有限公司	5,039,297.01	2021/6/29	2024/6/29	否	
	12,545,230.19	2021/6/30	2024/6/30		
	10,591,878.94	2021/6/30	2024/6/30		
骈文胜、上海蕊测半导体科技有限公司	12,825,834.31	2021/7/29	2023/6/29	否	
	9,669,940.25	2021/8/23	2023/7/23		
骈文胜、闻国涛	9,833,254.54	2020/10/23	2022/10/21	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为33,941,258.89元的使用权资产提供抵押担保
骈文胜	130,194,359.32	2021/8/3	2026/8/2	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为97,381,953.99元的固定资产以及账面价值为7,855,953.57元的无形资产提供抵押担保

#### 4、关联方资金拆借

##### (1) 2021年度

无。



## (2) 2020 年度

单位：元

关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金拆借利息
拆出					
骈文胜	300,000.00		300,000.00		
路峰	150,000.00		150,000.00		
小计	<b>450,000.00</b>		<b>450,000.00</b>		

## (3) 2019 年度

单位：元

关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金拆借利息
拆入					
上海蕊测半导体科技有限公司	2,999,400.00	1,598,269.00	4,597,669.00		675,291.93
龚金新	200,000.00		200,000.00		15,696.44
路峰	1,380,000.00		1,380,000.00		108,115.28
秦君梅	1,000,000.00		1,000,000.00		78,344.40
小计	<b>5,579,400.00</b>	<b>1,598,269.00</b>	<b>7,177,669.00</b>		<b>877,448.05</b>
拆出					
路峰		150,000.00		150,000.00	
闻国涛	100,000.00	1,050,000.00	1,150,000.00		
骈文胜	333,500.00	580,000.00	613,500.00	300,000.00	
小计	<b>433,500.00</b>	<b>1,780,000.00</b>	<b>1,763,500.00</b>	<b>450,000.00</b>	

## 5、关键管理人员报酬

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
关键管理人员报酬	5,533,372.35 元	2,187,779.24 元	1,534,605.84 元

## (三) 关联方应收应付款项

## 1、应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款							
	普冉半导体(上海)股份有限公司	2,348,048.51	117,402.43	8,134,702.58	406,735.13	4,695,590.43	234,779.52
	中微半导体(深圳)股份有限公司	93,004.81	4,650.24	111,041.35	5,552.07		
	江苏长电科技股份有限公司	90,365.51	4,518.28	189,693.86	9,484.69	1,886,532.31	94,326.62
	江阴长电先进封装有限公司			135,600.00	6,780.00		
	星科金朋半导体(江阴)有限公司			20,826.15	1,041.31	2,223,852.55	111,192.63
小计		<b>2,531,418.83</b>	<b>126,570.95</b>	<b>8,591,863.94</b>	<b>429,593.20</b>	<b>8,805,975.29</b>	<b>440,298.77</b>
其他应收款							
	骈文胜					304,952.10	15,247.61
	路峰					150,000.00	7,500.00
	乔从缓					3,552.00	177.60
	周歆瑶					18,569.00	928.45
小计						<b>477,073.10</b>	<b>23,853.66</b>

## 2、应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应付账款				
	星科金朋半导体(江阴)有限公司	870,000.00	972,545.98	

项目名称	关联方	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
	江阴长电先进封装有限公司		1,858,319.35	
	江苏长电科技股份有限公司		1,667,639.86	
	强一半导体（苏州）有限公司	1,547,400.48	46,796.00	29,925.00
	上海季丰电子股份有限公司	24,374.10	97,858.00	
	上海承括电子科技有限公司			8,814.00
小计		<b>2,441,774.58</b>	<b>4,643,159.19</b>	<b>38,739.00</b>
其他应付款				
	上海蕊测半导体科技有限公司	1,300.00	1,300.00	676,591.95
	闻国涛			900.00
	龚金新			87,696.44
	路峰			108,115.28
	秦君梅			78,344.40
小计		<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>951,648.07</b>

#### （四）发行人的关联交易决策程序

经本所律师查验，针对补充核查期间新增的关联交易，发行人履行了如下决策程序：

1、发行人第一届董事会第十二次会议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行及 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

2、发行人独立董事对于《关于公司 2021 年度日常关联交易执行及 2022 年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见及独立意见，认为相关关联交易对公司及子公司日常生产经营有积极影响，遵循自愿、有偿和公平的商业原则，履行了相关决策程序，关联董事已按规定回避表决，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

据此，本所律师认为，补充核查期间，发行人已制定的关联交易的决策程序得到有效执行，保护了发行人及股东的利益。

#### （五）同业竞争

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。为有效防止及避免同业竞争，发行人控股股东蕊测半导体、实际控制人

骈文胜已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

综上所述，本所律师认为，发行人报告期内不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易；发行人已在《公司章程》《公司章程（草案）》及其内部制度中规定了关联交易的决策程序；截至本补充法律意见书出具之日，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。

## 十、发行人的主要财产

### （一）不动产权及租赁使用权

#### 1、自有不动产权

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司拥有的不动产权未发生变化。

#### 2、不动产租赁使用权

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司的主要租赁使用权情况更新如下：

序号	出租方	承租方	租赁坐落	租赁用途	面积	租赁期间
1	上海新发创运置业有限公司	伟测科技	上海市浦东新区东胜路38号A区2幢	生产	1,984.89 m <sup>2</sup>	2019/03/30-2024/03/29
2	上海新发创运置业有限公司	伟测科技	上海市浦东新区胜利路188号D区1幢	生产、办公	3,704.43 m <sup>2</sup>	2021/03/01-2031/02/28
3	无锡星洲工业园区开发股份有限公司	无锡伟测	无锡新加坡工业园301地块503号厂房	办公	7,875.65 m <sup>2</sup> /12,751.29m <sup>2</sup>	2021/06/01-2026/05/31
4	南京天弘源资产管理有限公司	南京伟测	南京市浦口经济开发区双浦路77号辉瑞控股南京智能装备产业园A4栋防火分区5	生产、办公	5,195.5 m <sup>2</sup>	2021/12/01-2026/11/30

### （二）发行人拥有的知识产权

## 1、商标

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司所拥有的商标未发生变化。

## 2、专利

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司所拥有的专利情况更新如下：

序号	专利申请名称	类型	取得方式	申请号/专利号	权利期限	专利权人	他项权利
1	晶圆区域性问题的分析系统及方法	发明专利	原始取得	202110310750.9	2021/03/24-2041/03/23	伟测科技	无
2	多晶硅工艺保险丝的熔断装置及方法	发明专利	专利转让	202110248636.8	2021/03/08-2041/03/07	无锡伟测	
3	一种测试机匹配检测系统及其方法	发明专利	原始取得	202011533224.0	2020/12/23-2040/12/22	伟测科技	
4	一种 Wafer ID 烧写防呆的系统	发明专利	原始取得	202011523844.6	2020/12/22-2040/12/21	伟测科技	
5	一种多平台联动提效机构	发明专利	原始取得	202011489734.2	2020/12/17-2040/12/16	伟测科技	
6	一种集成电路精确测试小电阻的方法	发明专利	原始取得	202011160294.6	2020/10/27-2040/10/26	伟测科技	
7	腐蚀粉在整形铂金探针的应用和铂金探针的整形方法	发明专利	原始取得	202110234659.3	2021/03/03-2041/03/02	伟测科技	
8	一种 Chroma Q-type 转接板开路断路检验装置	实用新型	原始取得	202120877907.1	2021/04/26-2031/04/25	无锡伟测	
9	一种子母式探针卡装配结构	实用新型	原始取得	202120864029.X	2021/04/25-2031/04/24	无锡伟测	
10	一种延长墨管使用寿命的装置	实用新型	原始取得	202120868460.1	2021/04/25-2031/04/24	无锡伟测	
11	一种防止测试载板结霜的装置	实用新型	原始取得	202120866185.X	2021/04/25-2031/04/24	无锡伟测	
12	一种方便操作的便携式有线线缆检测机构	实用新型	原始取得	202120554510.9	2021/03/18-2031/03/17	无锡伟测	
13	一种探针卡针延长寿命用的垫座	实用新型	原始取得	202120556145.5	2021/03/18-2031/03/17	无锡伟测	
14	一种芯片测试机上的真空除尘结构	实用新型	原始取得	201721787488.2	2017/12/20-2027/12/19	伟测科技	

序号	专利申请名称	类型	取得方式	申请号/专利号	权利期限	专利权人	他项权利
15	一种防止集成电路针测扎偏的装置	实用新型	原始取得	201721787486.3	2017/12/20-2027/12/19	伟测科技	
16	一种芯片测试机的翻转机构	实用新型	原始取得	201721787489.7	2017/12/20-2027/12/19	伟测科技	
17	一种电路板测试装置	实用新型	原始取得	201721231664.4	2017/09/25-2027/09/25	伟测科技	
18	一种真空吸附检测台的承载平台	实用新型	专利转让	201721231321.8	2017/09/25-2027/09/24	无锡伟测	
19	一种可以提高打点产品效率的模具	实用新型	专利转让	201721231323.7	2017/09/25-2027/09/24	无锡伟测	
20	一种自动油墨打点器	实用新型	专利转让	201721231624.X	2017/09/25-2027/09/24	无锡伟测	
21	一种自动降温器	实用新型	原始取得	201721231457.9	2017/09/25-2027/09/24	伟测科技	
22	一种利用工业空调冷却水实现测试机冷循环装置	实用新型	原始取得	201720068187.8	2017/01/20-2027/01/19	伟测科技	
23	一种背银、背金晶圆测试稳压装置	实用新型	原始取得	201720068189.7	2017/01/20-2027/01/19	伟测科技	
24	一种易于安装的晶圆测试装置	实用新型	原始取得	201720068329.0	2017/01/20-2027/01/19	伟测科技	
25	一种抗干扰晶圆测试机外壳	实用新型	原始取得	201720068188.2	2017/01/20-2027/01/19	伟测科技	
26	一种探针卡拆卸防呆装置	实用新型	原始取得	202120870208.4	2021/04/25-2031/04/24	无锡伟测	
27	一种集成电路检测设备	实用新型	原始取得	202121569857.7	2021/07/09-2031/07/08	无锡伟测	
28	料盘翘曲平整装置	实用新型	原始取得	202121715058.6	2021/07/26-2031/07/25	无锡伟测	
29	一种用于半导体自动分选机快速降温装置	实用新型	原始取得	202121422099.6	2021/06/24-2031/06/23	无锡伟测	

注：无锡伟测通过“专利转让”获得的1项发明专利和3项实用新型专利系从发行人处受让取得，转让过程合法、有效，并已在国家知识产权局备案。

### 3、许可专利使用权情况

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司拥有的专利许可使用权情况更新如下所示：

序号	名称	专利号	类型	授权公告日	发明人	权利人
1	一种晶圆芯片检测工装	201521040030.1	实用新型	2016/05/11	邹磊	普砾电子（上海）有限公司

序号	名称	专利号	类型	授权公告日	发明人	权利人
2	一种晶元自动检测设备用探针定位夹具	201521035597.X	实用新型	2016/05/11	杨会会	普钰电子（上海）有限公司
3	一种探针安装座	201521035631.3	实用新型	2016/05/11	张旆	普钰电子（上海）有限公司
4	一种简易探针固定座	201521035633.2	实用新型	2016/05/11	邹磊	普钰电子（上海）有限公司
5	一种晶元芯片检测头结构	201521035528.9	实用新型	2016/05/11	邹磊	普钰电子（上海）有限公司
6	一种晶元芯片检测头组件	201521035600.8	实用新型	2016/05/11	杨会会	普钰电子（上海）有限公司
7	一种晶元片检测头结构	201620794181.4	实用新型	2017/03/15	范秋萍	普钰电子（上海）有限公司
8	一种调节式晶元片检测头组件	201620794239.5	实用新型	2017/01/25	何佳	普钰电子（上海）有限公司
9	一种基于探针的检测头组件	201620794220.0	实用新型	2017/01/25	郑清林	普钰电子（上海）有限公司
10	一种稳定型晶元片检测头组件	201620794217.9	实用新型	2017/01/25	周莲国	普钰电子（上海）有限公司
11	一种基于晶元片检测的集成式检测头组件	201820211613.3	实用新型	2018/09/25	杨明亮	普钰电子（上海）有限公司
12	一种组合式晶元片检测头组件	201820211657.6	实用新型	2018/09/25	洪家萍	普钰电子（上海）有限公司

#### 4、集成电路布图设计

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司拥有的集成电路布图设计情况未发生变化。

#### 5、计算机软件著作权

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司拥有的计算机软件著作权情况更新如下：

序号	证书编号	软件名称	取得方式	著作权人	首次发表日期	权利期限
1	软著登字第2042850号	伟测自动测试报告系统	原始取得	伟测科技	2017/06/05	50年
2	软著登字第8590308号	伟测TEL型号探针台的晶圆图转换软件	原始取得	无锡伟测	未发表	50年

序号	证书编号	软件名称	取得方式	著作权人	首次发表日期	权利期限
3	软著登字第8672298号	伟测 TXT&Excel 与晶圆&Bin 坐标对比软件	原始取得	无锡伟测	未发表	50年
4	软著登字第8672285号	伟测测试机 STDF 大文件压缩转换软件	原始取得	无锡伟测	未发表	50年
5	软著登字第9043690号	伟测测试机 CSV 文件到 TSK 探针台的晶圆图转换软件	原始取得	无锡伟测	未发表	50年
6	软著登字第9248208号	伟测测试机 XML/TXT 文件探针台的 MAP 图转换软件	原始取得	无锡伟测	未发表	50年

## 6、域名

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司拥有的域名情况未发生变化。

### （三）发行人拥有的生产经营设备

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的主要生产经营设备为专用设备及办公设备，该等设备均由发行人实际占有和使用，均通过合法途径取得，主要经营设备不存在产权纠纷或争议。

### （四）发行人拥有的出资权益或股权

经本所律师查验，补充核查期间，发行人新增一家子公司南京伟测，截至本补充法律意见书出具之日，南京伟测的基本情况如下所示：

企业名称	南京伟测半导体科技有限公司
统一社会信用代码	91320111MA2798JE32
法定代表人	骈文胜
住所	南京市浦口区浦口经济开发区双峰路 69 号 C-93
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	7,000 万元人民币
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限	2021-10-21 至无固定期限

经本所律师查验，发行人的上述财产均通过合法途径取得，截至本补充法



律意见书出具之日，上述财产不存在产权纠纷，不存在权利受到限制的情形。

## 十一、发行人的重大债权债务

截至本补充法律意见书出具之日，发行人的重大债权债务更新情况如下所示：

### （一）重大合同

#### 1、重大销售合同

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人已签订的正在履行的重大销售合同更新如下：

序号	客户名称	合同标的	形式	签订日期	履行情况
1	客户 A	集成电路测试服务	框架合同	2020/10/12	正在履行
2	晶晨半导体（上海）股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2021/1/2	正在履行
3	深圳市中兴微电子技术有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2017/12/20	正在履行
4	上海安路信息科技股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2020/2/1	正在履行
5	普冉半导体（上海）股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2021/5/11	正在履行
6	Bitmain Technologies Limited（比特大陆）	集成电路测试服务	框架合同	2021/4/1	正在履行
7	江苏长电科技股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2020/3/2	正在履行
8	上海复旦微电子集团股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2018/6/6	正在履行
9	甬矽电子（宁波）股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2021/10/9	正在履行
10	北京兆易创新科技股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2020/4/17	正在履行

#### 2、重大采购合同

发行人报告期内已签订的正在履行或履行完毕的金额在 100 万美元以上的或 1,000 万人民币以上的重大采购订单以及重大的采购框架协议为公司的重大采购合同，更新情况如下：

序号	供应商名称	合同标的	币别	金额（万元）	签订日期	履行情况
1	致茂电子股份有限公司	集成电路测试机	USD	390.00	2021/6/4	正在履行
		集成电路测试机	USD	455.00	2020/3/16	正在履行

序号	供应商名称	合同标的	币别	金额（万元）	签订日期	履行情况
		集成电路测试机	USD	399.00	2019/6/5	正在履行
		集成电路测试机	USD	130.00	2020/8/28	履行完毕
		集成电路测试机	USD	75.00	2020/12/30	履行完毕
		集成电路测试机	USD	65.00	2020/12/30	履行完毕
		集成电路测试机	USD	65.00	2020/11/30	履行完毕
2	先域微电子技术 服务（上海）有限 公司	高速转塔测试机	RMB	1,459.19	2020/11/19	正在履行
3	ADVANTEST CORPORATION	集成电路测试机	-	框架合同	2021/6/29	正在履行
4	Teradyne (Asia) Pte.Ltd	集成电路测试机	USD	23.80	2020/8/28	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	22.80	2020/8/28	履行完毕
		集成电路测试机	USD	160.40	2020/8/28	履行完毕
		集成电路测试机	USD	89.00	2020/12/23	履行完毕
		集成电路测试机	USD	44.50	2020/12/24	履行完毕
		集成电路测试机	USD	89.00	2020/8/10	履行完毕
		测试机、设备板 卡及备件	USD	94.20	2020/8/21	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	2.70	2021/5/18	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	29.80	2021/4/16	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	29.80	2021/5/9	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	27.23	2021/5/20	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	7.78	2021/6/1	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	56.00	2021/10/20	履行完毕
		集成电路测试机	USD	303.90	2021/9/29	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	104.10	2021/7/15	履行完毕
		集成电路测试机	USD	133.50	2021/10/22	履行完毕
		集成电路测试机	USD	133.50	2021/11/4	履行完毕
集成电路测试机	USD	133.50	2021/11/27	履行完毕		
5	Semics.Inc	自动探针台	USD	530.00	2019/12/3	履行完毕
		探针台	USD	102.00	2020/9/15	履行完毕
		探针台	USD	51.00	2021/3/11	履行完毕
		探针台	USD	153.00	2021/3/11	履行完毕
		探针台	USD	20.40	2021/3/11	履行完毕
		其他周转材料	USD	0.24	2021/3/22	履行完毕

序号	供应商名称	合同标的	币别	金额（万元）	签订日期	履行情况
		探针台	USD	20.40	2021/4/26	履行完毕
		探针台	USD	397.00	2021/6/23	履行完毕
		探针台	USD	241.10	2021/7/2	履行完毕
		其他周转材料	USD	30.60	2021/7/1	履行完毕
6	Tokyo Seimitsu Co., Ltd	探针台	JPY	16,600.00	2020/8/25	履行完毕
		探针台	JPY	49,305.00	2021/6/19	正在履行
7	天津金海通自动化设备股份有限公司	集成电路测试机	-	框架协议	2020/11/30	正在履行
8	鸿劲精密股份有限公司	分选机	USD	160.00	2021/6/10	履行完毕
		分选机	USD	160.00	2021/6/10	履行完毕
		分选机	USD	204.00	2021/5/25	履行完毕
		分选机	USD	67.50	2021/7/7	履行完毕
9	上海午盛实业有限公司	厂务设备及工程	RMB	2,700.00	2021/7/7	履行完毕

经本所律师查验，发行人上述重大采购和销售合同合法有效，截至本补充法律意见书出具之日，发行人未发生与上述合同相关的重大纠纷或争议。

### 3、重大借款合同及担保合同

经本所律师查验，发行人报告期内已签订正在履行或履行完毕的合同金额超过 500 万元更新如下：

序号	借款合同名称及编号	融资银行	担保（抵押）合同名称及编号	担保形式	借款开始日	借款到期日	币种	合同金额（万元）	履行情况
1	Z2005LN15676636	交通银行股份有限公司上海新区支行	保证合同（C200514GR3109480）	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2020/6/1	2021/5/27	RMB	800.00	履行完毕
2	Z2007LN15624919		保证合同、抵押担保（C190311MG3107572、C200514GR3109480、JTYH00220200101202）	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保、上海市中小微企业政策性融资担保基金管	2020/8/11	2021/7/16	RMB	950.00	履行完毕

序号	借款合同名称及编号	融资银行	担保（抵押）合同名称及编号	担保形式	借款开始日	借款到期日	币种	合同金额（万元）	履行情况
			01231)	理中心提供担保					
3	Z2108LN 15614930		-	-	2021/8/24	2022/8/24	RMB	3,000.00	履行完毕
4	97162020 280206	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	最高额保证合同 ZB9716202 000000027	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2020/6/23	2021/6/22	RMB	500.00	履行完毕
5	97162020 280312		最高额保证合同 ZB9716202 000000027	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2020/9/9	2021/9/8	RMB	500.00	履行完毕
6	97162021 280289		最高额保证合同 ZB9716202 000000027	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2021/9/26	2022/9/25	RMB	1,000.00	正在履行
7	97162021 280114		最高额保证合同 (ZB97162 020000000 27)	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2021/4/22	2022/4/21	RMB	1,000.00	正在履行
8	平银沪科 创贷字 20210111 第001号	平安银行上海分行营业部	最高额保证担保合同【平银沪科创额保字 20210111 第001号、 002号】	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2021/1/15	2022/1/14	RMB	900.00	履行完毕
9	Z2105LN 15651734	交通银行股份有限公司上海新区支行	保证合同 (C200514 GR3109480 )	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2021/6/11	2022/5/30	RMB	1,000.00	正在履行
10	CL20201 2003	浦发硅谷银行有限	CL2020120 02-PG、 CL2020120 03-EM	骈文胜最高额不可撤销担保、机器	2020/12/15	2023/12/15	USD	159.77	正在履行

序号	借款合同名称及编号	融资银行	担保（抵押）合同名称及编号	担保形式	借款开始日	借款到期日	币种	合同金额（万元）	履行情况
		公司		设备抵押					
11	CL202012003		CL20201202-PG、CL20201203-EM	骈文胜最高额不可撤销担保、机器设备抵押	2021/1/12	2023/12/15	USD	215.80	正在履行
12	CL202012003		CL20201202-PG、CL20201203-EM	骈文胜最高额不可撤销担保、机器设备抵押	2021/2/9	2023/12/15	USD	224.43	正在履行
13	CL202105002		CL20210502-EM	机器设备抵押	2021/6/3	2024/5/20	USD	200.00	正在履行
14	公授信字第02702021213200号	中国民生银行股份有限公司上海分行	最高额保证合同（公高保字第02702021213201号）、最高额抵押合同：公高抵字第02702021213202号、公高抵字第02702021213204号	骈文胜最高额不可撤销担保	2021/6/10	2023/6/9	RMB	3,500.00	正在履行
15	121XY2021032339	招商银行股份有限公司上海分行	最高额不可撤销担保书（121XY2021032339）	骈文胜最高额不可撤销担保	2021/11/18	2022/11/17	RMB	1,500.00	正在履行
16	2021082601	招商银行股份有限公司无锡分行	最高额抵押合同（202108260104）、抵押合同（202108260103）	骈文胜最高额不可撤销担保、机器设备抵押	2021/8/3	2026/8/2	RMB	15,000.00	正在履行

## 4、融资租赁合同

经本所律师查验，发行人报告期内已签订的正在履行或履行完毕的融资租赁合同更新如下：

序号	出租人	合同名称及编号	租金 (元或美元/月)	签订日期/ 起租日	租赁期限	履行情况
（一）上海伟测半导体科技股份有限公司						
1	北亚融资租赁 (上海)有限公司	设备融资租赁合同 NAFL201629-12 补充协议 NAFL20170102	95,108.00 元	2017/1/17	24 个月	履行完毕
2		设备融资租赁合同 NAFL2017032-05	45,425.92 美元	2017/5/31	24 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL2017032-05 补充协议 NAFL20170801	12,310.84 美元	2017/8/10	24 个月	履行完毕
3		设备融资租赁合同 NAFL2017046-07 (第一批)	35,270.81 美元	2017/7/31	24 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL2017046-07 (第二批)	60,371.38 美元	2017/7/31	24 个月	履行完毕
4		设备融资租赁合同 NAFL2017056-09	20,328.41 美元	2017/9/20	24 个月	履行完毕
5		设备融资租赁合同 NAFL2017066-11	529,201.16 元	2017/12/11	24 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL2017066-11 补充协议 NAFL20180201	128,742.81 元	2018/2/10	24 个月	履行完毕
6		设备融资租赁合同 NAFL2018013-05	467,057.00 元	2018/5/8	24 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL2018013-05-02	334,590.22 元	2018/5/18	36 个月	履行完毕
7	设备融资租赁合同 NAFL2018026-07	350,537.88 元	2018/7/9	36 个月	履行完毕	
	设备融资租赁合同 NAFL2018026-07 补充协议 NAFL20180810	30,431.49 元	2018/8/10	36 个月	履行完毕	
8	设备融资租赁合同 NAFL2018028-09 (第一批)	42,896.99 元	2018/9/21	36 个月	履行完毕	
	设备融资租赁合同 NAFL2018028-09 (第二批)	23,035.83 元	2018/9/21	36 个月	履行完毕	
	设备融资租赁合同 NAFL2018028-09 补充协议 NAFL20181217	177,896.88 元	2018/12/10	36 个月	履行完毕	
9	设备融资租赁合同 NAFL2019007-04	565,060.29 元	2019/5/5	36 个月	履行完毕	
	设备融资租赁合同 NAFL2019007-04	289,719.82 元	2019/6/10	36 个月	履行完毕	
10	设备融资租赁合同 NAFL2019023-08 (第一批)	163,136.11 元	2019/8/23	36 个月	正在履行	
	设备融资租赁合同 NAFL2019023-08 (第二批)	283,145.52 元	2019/8/23	36 个月	正在履行	
	设备融资租赁合同 NAFL2019023-08 补充协议 NAFL20191015	133,461.81 元	2019/10/10	36 个月	履行完毕	

序号	出租人	合同名称及编号	租金 (元或美元/月)	签订日期/ 起租日	租赁期限	履行情况
		设备融资租赁合同 NAFL2019023-08 补充协议 NAFL20191101	142,305.81 元	2019/11/10	24 个月	履行完毕
11		设备融资租赁合同 NAFL2019030-11	499,195.28 元	2019/11/19	24 个月	履行完毕
12		设备融资租赁合同 NAFL2020034-02	638,955.70 元	2020/2/20	24 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL2020034-02 补充协议 NAFL20200415001	279,593.69 元	2020/4/21	24 个月	履行完毕
13		设备融资租赁合同 NAFL2021047-02	556,554.15 元	2021/3/26	24 个月	正在履行
14	浦银金 融租赁 股份有 限公司	融资租赁合同（售后回租类） PYHZ0120200030	416,666.67 元	2020/9/29	24 个月	正在履行
15	交银金 融租赁 有限责 任公司	融资租赁合同（回租）交银租赁字 【20190213】号	398,355.13 元	2019/12/26	24 个月	履行完毕
16	芯鑫融 资租赁 有限责 任公司	售后回租赁合同 SINOICL2020D08Y002-L-01	4,583,999.65 元	2020/3/31	36 个月	履行完毕
17	中电投 融和融 资租赁 有限公 司	融资租赁合同（售后回租） RHZL-2020-101-1382-SHWCBDT-001	2,727,272.73 元	2020/11/10	36 个月	正在履行
18	仲利国 际租赁 有限公 司	融资租赁合同 AA18100338AKX	140,625 元	2018/10/12	24 个月	履行完毕
19	苏州融 华租赁 有限公 司	融资租赁合同 RH-L-2019009-1	162,469.75 元	2019/6/6	36 个月	正在履行
20		融资租赁合同 RH-L-2019009-2	149,972.10 元	2019/8/15	36 个月	正在履行
21		融资租赁合同 RH-L-2019023-1	37,287.45 元	2019/12/2	36 个月	正在履行
22		融资租赁合同 RH-L-2019023-2	119,278.00 元	2019/12/17	36 个月	正在履行
23		融资租赁合同 RH-L-2019023-3	84,216.00 元	2019/12/20	36 个月	正在履行
24		融资租赁合同 RH-L-2019023-4	72,669.00 元	2020/2/25	36 个月	正在履行
25		融资租赁合同 RH-L-2020003-1	7,757,856 元	2020/5/25	36 个月	正在履行
26		补充协议 RH-L-2020003-1/S01	216,978.00 元	2020/6/12	36 个月	正在履行
27		融资租赁合同 RH-L-2020003-2	140,162.00 元	2020/7/25	36 个月	正在履行
28		补充协议 RH-L-2020003-3/S01	223,014.00 元	2020/9/3	36 个月	正在履行

序号	出租人	合同名称及编号	租金 (元或美元/月)	签订日期/ 起租日	租赁期限	履行情况
29		融资租赁合同 RH-L-2020003-4	90,976.00 元	2020/8/31	36 个月	正在履行
30		融资租赁合同 RH-L-2020003-5	199,026.00 元	2020/8/27	36 个月	正在履行
31		补充协议 RH-L-2020003-5/S01	198,877.00 元	2020/10/20	36 个月	正在履行
32		融资租赁合同 RH-L-2020003-6	2,170,152.00 元	2020/9/3	36 个月	正在履行
33		补充协议 RH-L-2020003-6/S01	58,871.00 元	2020/10/20	36 个月	正在履行
34	海通恒 信国际 融资租 赁股份 有限公 司	融资租赁合同 L21A0441003	68,283.60 元	2021/4/26	36 个月	正在履行
35		融资租赁合同 L21A0441004	273,134.40 元	2021/4/26	36 个月	正在履行
(二) 无锡伟测半导体科技有限公司						
1	北亚融 资租赁 (上 海)有 限公司	设备融资租赁合同 NAFL2020042-10	1,018,064.88 元	2020/10/23	24 个月	正在履行
2		设备融资租赁合同 NAFL2021046-02	468,512.94 元	2021/2/22	24 个月	正在履行
3	诚泰融 资租赁 (上 海)有 限公司	融资租赁合同 CHTDCS4355-C001-L01	620,607.52 元	2020/10/23	36 个月	正在履行
4	平安国 际融资 租赁有 限公司	融资租赁合同 2021PAZL0101129-ZL-01	177,204.70 元	2021/6/8	36 个月	正在履行
5		融资租赁合同 2021PAZL0101132-ZL-01	441,147.60 元	2021/6/30	36 个月	正在履行
6		融资租赁合同 2021PAZL0101133-ZL-01	372,458.85 元	2021/6/30	36 个月	正在履行
7	远东国 际融资 租赁有 限公司	融资租赁合同 IFELC21DG1FCBW-L-01	755,028.01 元	2021/6/27	24 个月	正在履行
8		融资租赁合同 IFELC21DG1USW5-L-01	540,907.32 元	2021/7/15	24 个月	正在履行
9	苏州融 华租赁 有限公 司	融资租赁合同 RH-L-2021009-1	302,372.00 元	2021/4/9	36 个月	正在履行

注：苏州融华租赁有限公司的《融资租赁合同 RH-L-2019009-1》、《融资租赁合同 RH-L-2019009-2》为售后回租。

#### 5、其他重大合同



经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人其他重大合同未发生变化。

（二）经发行人说明并经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（三）根据《审计报告》并经本所律师查验，截至报告期末，发行人与关联方之间不存在重大债权债务关系。

（四）根据《审计报告》并经本所律师查验，截至报告期末，发行人存在关联方为其提供担保的情形，具体情况详见本补充法律意见书“九、关联交易及同业竞争”之“（二）关联交易”，发行人不存在为关联方提供担保的情形。

（五）经本所律师查验，截至报告期末，发行人金额较大的其他应收款以及其他应付款均系发行人正常生产经营而发生的往来款，合法有效。

## 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

（一）经本所律师查验，补充核查期间，发行人不存在合并、分立、增加或者减少注册资本的行为。

（二）经本所律师查验，补充核查期间，发行人不存在重大资产变化、收购或出售资产行为。

（三）根据发行人的确认并经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等行为。

## 十三、发行人公司章程的制定与修改

经本所律师查验，补充核查期间，发行人《公司章程》未发生变化，发行人现行的《公司章程》及《公司章程（草案）》均符合现行法律法规的规定。

## 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）经本所律师查验，补充核查期间，发行人的组织机构未发生变化。

（二）经本所律师查验，补充核查期间，发行人股东大会、董事会及监事会

议事规则未发生变化且符合法律法规的有关规定。

（三）经本所律师查验，补充核查期间，发行人历次股东大会、董事会、监事会会议的召开、决议内容及签署合法、有效。

（四）经本所律师查验，补充核查期间，发行人股东大会对公司董事会的历次授权或重大决策行为符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

## 十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化

经本所律师核查，补充核查期间，除发行人董事祁耀亮于 2021 年 12 月不再担任美芯晟科技（北京）有限公司董事之外，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况未发生变化。

## 十六、发行人的税务

### （一）发行人执行的税种、税率

根据《审计报告》并经本所律师查验，报告期内，发行人及其子公司报告期内执行的主要税种和税率为：

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明			
纳税主体名称	2021 年度	2020 年度	2019 年度
本公司	12.5%	12.5%	12.5%
上海威矽半导体科技有限公司	25%	25%	25%
厦门伟测半导体科技有限公司	已注销	25%	25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明			
无锡伟测半导体科技有限公司	25%	25%	未成立
南京伟测半导体科技有限公司	25%	未成立	未成立

经本所律师查验，发行人及其子公司报告期内执行的主要税种、税率符合法律法规的规定。

### （二）发行人享受的税收优惠

经本所律师查验，补充核查期间，发行人及其境内子公司在报告期内享受的税收优惠未发生变化且符合法律、法规的规定。

### （三）发行人享受的财政补贴

根据《审计报告》并经本所律师查验，2021 年度，发行人及其境内子公司享受的财政补贴更新如下所示：

序号	金额	项目名称	补贴依据
1	5,200,000.00	超大规模集成电路芯片集成测试平台技术改造	上海市经济信息化委、市财政局关于印发《上海市技术改造专项支持实施细则》的通知（沪经信规范〔2018〕1号）
2	4,000,000.00	关键核心芯片晶圆级系统级全生态测试能力提升改造	上海市经济信息化委、市财政局关于印发《上海市技术改造专项支持实施细则》的通知（沪经信规范〔2018〕1号）
3	5,000,000.00	固定资产投资补贴	《无锡国家高新技术产业开发区管理委员会，关于进一步推动科技创新的实施意见》（锡高管发〔2017〕40号）
4	2,053,154.34	进口设备贴息	财政部商务部关于印发《外经贸发展专项资金管理办法》的通知（财企〔2014〕36号）及《上海市商务委关于2020年进口贴息资金申报的通知》
5	600,000.00	小巨人项目补贴	关于印发《上海市科技小巨人工程实施办法》的通知规范性文件沪科规〔2021〕12号
6	600,000.00	科技发展基金	《浦东新区科技发展基金重点企业研发机构补贴资金操作细则》
7	568,500.00	政策扶持补贴	《无锡国家高新技术产业开发区管理委员会，关于进一步推动科技创新的实施意见》（锡高管发〔2017〕40号）
8	250,000.00	中小企业专项补贴	《浦东新区科技发展基金重点企业研发机构补贴资金操作细则》
9	95,000.00	创新业务补贴	《上海市经济信息化委市财政局关于开展2020年融资担保创新业务支持项目申

序号	金额	项目名称	补贴依据
			报工作的通知》（沪经信企〔2020〕1051号）
10	40,375.00	担保补贴	《关于延续〈浦东新区小微企业增信基金管理办法〉的通知》（浦财经〔2019〕18号）
11	27,700.00	稳岗补贴	《关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划大力开展以工代训工作的通知》（锡人社发〔2020〕59号）及和《关于进一步支持企业开展以工代训工作的补充通知》（锡人社发〔2020〕75号）
12	12,000.00	岗前培训补贴	《上海市人力资源和社会保障局上海市财政局关于进一步落实受疫情影响企业职工线上职业培训补贴政策有关事项的通知》（沪人社规〔2021〕4号）
13	7,500.00	专利资助款	《上海市专利资助办法（沪知局规〔2018〕1号）》
14	3,000.00	就业补贴	《省政府关于应对新型冠状病毒肺炎疫情影响推动经济循环畅通和稳定持续发展的若干政策措施》（苏政发〔2020〕15号）、《市委市政府关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关保障经济平稳运行的政策意见的通知》（锡委发〔2020〕20号）
15	2,000.00	毕业生补贴	《无锡市人民政府关于促进高校毕业生来锡就业创业的若干措施的通知》（锡政发〔2020〕12号）
16	3,300.00	其他	/

#### （四）发行人税务合规情况

经本所律师查验，补充核查期间，发行人及其境内子公司不存在因重大税务违法行为被处以行政处罚的情形。

## 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）经本所律师查验，补充核查期间，发行人及其子公司不存在因违反环境保护方面法律法规而受到重大处罚的情形，发行人募投项目符合国家有关环境保护的要求。

（二）经本所律师查验，补充核查期间，发行人及其子公司不存在因违反质量技术监督方面法律、法规而被行政处罚的情形。

（三）经本所律师查验，补充核查期间，发行人及其子公司能够按国家有关法律法规进行安全生产，不存在因违反安全生产方面的法律法规而被主管应急管理部门给予行政处罚的情形。

（四）经本所律师查验，补充核查期间，发行人不存在因劳动人事、社会保险、住房公积金等相关事项受到有关部门处罚的情形。

## 十八、发行人募集资金的运用

本所律师已在《法律意见书》、《律师工作报告》中详细披露了发行人募集资金的运用情况。根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人募集资金的运用情况未发生变化。

## 十九、发行人业务发展目标

本所律师已在《法律意见书》、《律师工作报告》中详细披露了发行人的业务发展目标，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的业务发展目标未发生变化。

## 二十、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项。

（二）经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人持股 5% 以上股份的股东、控股股东不涉及其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。

（三）经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人现任董事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情况。

## 二十一、发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师已审阅《招股说明书（申报稿）》，特别对发行人引用本补充法律

意见书及《律师工作报告》相关内容已认真审阅，《招股说明书（申报稿）》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。

## 二十二、发行人律师认为需要说明的其他问题

### （一）发行人历史沿革中的代持事项

本所律师已在《律师工作报告》中详细披露了发行人的代持相关事宜，截至本补充法律意见书出具之日，发行人历史上存在的所有代持均已解除。发行人股东持有的发行人股份权属清晰，不存在代持等未披露的股份安排，亦不存在权属纠纷及潜在纠纷。

### （二）发行人员工持股计划

本所律师已在《律师工作报告》中详细披露了发行人的员工持股计划相关事宜，补充核查期间，发行人的员工持股计划相关情况未发生变化。

### （三）对赌协议

本所律师已在《律师工作报告》中详细披露了发行人对赌协议的相关事宜，补充核查期间，发行人的对赌协议相关情况未发生变化。

### （四）劳务外包

经本所律师查验，补充核查期间，发行人及其子公司新增一家合作的劳务公司，发行人子公司南京伟测将测试过程中部分辅助性工作如物料搬运、物料收货、成品打包、条形码扫描等工作外包给劳务公司，该劳务公司基本情况如下所示：

序号	公司名称	统一社会信用代码	经营范围
1	江苏天为 人力资源 有限公司	91320105M A1NGKWD 14	人力资源信息咨询；劳务派遣；园林绿化工程、建筑工程、室内外装饰工程设计、施工；设计、制作、代理、发布国内各类广告；市场营销策划；公关礼仪服务；创意策划服务；企业管理咨询服务；职业中介服务；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；电子产品及零配件、塑胶制品、机械零配件、汽车零配件加工、销售；搬运、装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经本所律师查验，截至报告期末，为发行人及其子公司提供劳务外包服务

的公司为独立经营主体，未因向发行人提供劳务外包服务而涉及违法违规行为，且劳务外包公司与发行人不存在任何关联关系。

#### （五）信息豁免披露

经本所律师查验发行人相关内控管理制度及签订的《保密协议》，发行人已建立完善的内控管理制度并得到有效执行，发行人申请信息豁免披露事项具有合理的商业诉求，如披露将导致发行人违约。发行人的董事长已在豁免申请文件中签字确认，豁免披露的信息尚未泄漏。截至本补充法律意见书出具之日，公司的信息披露方式对投资者判断公司价值不存在重大影响。

### 二十三、结论意见

综上所述，本所律师认为，发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，发行人符合《证券法》《公司法》《科创板首发管理办法》《科创板股票上市规则》《科创属性评价指引（试行）》等有关法律法规中有关公司首次公开发行股票并在科创板上市的条件，其股票公开发行并于上交所科创板上市不存在法律障碍；发行人《招股说明书（申报稿）》所引用的本补充法律意见书和《律师工作报告》的内容适当；发行人本次发行上市已经取得现阶段必要的批准和授权，尚需取得上交所的审核同意并经中国证监会同意注册，待完成公开发行后，股票上市尚需取得上交所的同意。

## 第二部分 关于《第一轮问询函》相关回复的更新

### 问题 2.关于核心技术来源

2.1 根据招股说明书，1) 公司 2016 年成立后即进入晶圆测试领域，2017 年实现盈利，2019 年末开拓了芯片测试业务。发行人的核心技术系自主开发，并随着测试经验的积累逐步完善。2) 截至本招股说明书签署日，公司及其子公司取得 24 项专利、1 项软件著作权，其中有 6 项发明专利，18 项实用新型专利。3) 公司有 4 名核心技术人员，就职前曾在日月光封测、长电科技等同行业公司任职，其中一名核心技术人员于 2020 年 2 月入职。另根据申报材料，部分专利发明人目前已离职。

请发行人说明：

(1) 公司 6 项发明专利的具体来源、发明人的具体情况，是否为公司员工，该 6 项发明专利在发行人主营业务中的具体应用情况；

(2) 结合核心技术人员和专利发明人（包括已离职人员）的从业经历，说明其在技术形成过程中发挥的作用，并结合行业研发周期、客户认证周期、测试方案开发和验证周期，说明主营业务发展和核心技术形成的关键历史节点，技术来源是否为自主研发，是否合法合规；

(3) 结合核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）的任职经历，说明该等人员是否存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，是否存在纠纷或潜在纠纷。

请保荐机构和发行人律师进行核查，完善核查方式，说明核查过程并发表明确意见。

回复：

一、公司 6 项发明专利的具体来源、发明人的具体情况，是否为公司员工，该 6 项发明专利在发行人主营业务中的具体应用情况

发行人 6 项发明专利的具体来源、发明人的具体情况及在发行人主营业务中的具体应用情况如下表所示：



序号	专利名称	申请号/专利号	技术来源	发明人	是否公司员工	具体应用
1	晶圆区域性问题的分析系统及方法	202110310750.9	自主研发	杨恭乾、路峰、高大会、闻国涛、骈文胜	皆是	1、是一种对测试环节的数据进行大量数据分析以发现异常和测试环节的问题，并对测试问题的根本原因进行智能判断的一套分析系统。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试业务。
2	多晶硅工艺保险丝的熔断装置及方法	202110248636.8	自主研发	傅郁晓、吴庆、陈迎涛、杨栓、张丽霞	皆是	1、大规模测试服务中保险丝熔断工艺较为普遍，该发明是用一种简单的替代方法在保证质量的同时达成熔断工艺。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试业务与芯片成品测试业务。
3	一种测试机匹配检测系统及其方法	202011533224.0	自主研发	傅郁晓、吴庆、骈文胜、闻国涛、杨恭乾	皆是	1、是一种软件系统，主要用于测试机对设计公司提供产品进行自动适应性配置。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试与芯片成品测试业务。
4	一种 Wafer ID 烧写防呆的系统	202011523844.6	自主研发	骈文胜、傅郁晓	皆是	1、在大规模测试服务中确保每个芯片被正确识别和跟踪，并可以持续保证最高的测试质量；当遇有多流程的情况时不会出现测试错误，是大规模测试服务中质量管理系统的关键环节。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试业务。
5	一种多平台联动提效机构	202011489734.2	自主研发	杨栓、关姜维、刘栋栋	皆是	1、将两个测试机对接到一个探针台上，可以在保证测试质量的同时提高测试效率和设备利用率。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试业务。
6	一种集成电路精确测试小电阻的方法	202011160294.6	自主研发	左上勇、袁常乐、王敏	皆是	1、属于一种测试的优化方法，在保证高精度的同时，运用简单仪器测试小电阻。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试与芯片成品测试业务。

如上表所示，上述 6 项发明专利均由发行人员工自主研发形成并应用于主营业务。

二、结合核心技术人员和专利发明人（包括已离职人员）的从业经历，说明其在技术形成过程中发挥的作用，并结合行业研发周期、客户认证周期、测

试方案开发和验证周期，说明主营业务发展和核心技术形成的关键历史节点，技术来源是否为自主研发，是否合法合规。

1、发行人核心技术人员和专利发明人（包括已离职人员）的从业经历及其在技术形成过程中发挥的作用

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
1	骈文胜	核心技术人员、专利发明人	本科学历，电子精密机械专业。1993年-2000年任摩托罗拉（中国）电子有限公司设备经理；2000年-2004年任职于威宇科技测试封装（上海）有限公司；2004年-2009年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任测试厂长、封装厂长、资材处长；2009年-2016年任职于江苏长电科技股份有限公司，任事业中心总经理、集团海外销售副总裁；2016年11月至今任公司董事长、总经理。	1、基于 ARM 架构的高性能处理器的测试解决方案 2、晶圆测试中烧写写入工艺防呆管控技术 3、晶圆测试良率分析和优选管控技术 4、基于 TCG 架构的先进网络安全芯片晶圆测试解决方案 5、晶圆测试探针卡精密管控技术	1、项目统筹规划； 2、参与制定产品测试量产的规范并设计量产的流程和相应的管控机制； 3、技术规范评估。 1、项目统筹规划； 2、参与晶圆烧写写入工艺防呆管控技术的方案设计和相应的验收标准的制定。 1、项目统筹规划； 2、参与设计测试良率分析架构体系和设备自动优选的方案核心代码分解。 1、项目统筹规划； 2、参与研究网络安全芯片测试的核心难点，为解决方案提供技术路线。 1、项目统筹规划； 2、参与铂金针测试良率与针痕管控的方案设计。
2	闻国涛	核心技术人员、专利发明人	本科学历，机械设计及其自动化专业。2001年-2004年任威宇科技测试封装（上海）有限公司设备工程师；2004年-2016年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任测试设备主管、经理、封装厂长、测试厂长；2016年5月至今任公司董事、副总经理。	1、高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案 2、解决背银、背金晶圆的测试稳压装置 3、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案 4、测试机配置匹配提效技术 5、晶圆测试探针卡精密管控技术	1、项目可行性分析，落实专案前期立项工作 2、比对、分析、定制、优化技术方案； 3、制定验收标准及检验阶段性目标。 1、项目统筹规划； 2、参与稳压套环通过电极接线、电性连接于测试电极方案。 1、项目统筹规划； 2、参与研究测试的核心难点，为解决方案提供技术路线。 1、项目统筹规划； 2、参与调研设计测试机配置匹配规则； 3、参与测试机配置匹配流程的设计以及流程图的规划设计； 4、制定验收标准以及检验阶段性目标。 1、项目可行性分析，落实专案前期立项工作；

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
3	路峰	核心技术人员、专利发明人	本科学历，电子工程专业。1993-2000年任摩托罗拉（中国）电子有限公司IT自动化经理；2000年-2004年任威宇科技测试封装（上海）有限公司IT部门经理；2004年-2006年任日月光封装测试（上海）有限公司IT部门经理；2006年-2018年任职于晟碟半导体（上海）有限公司，历任IT部门经理、总监；2018年5月至今任公司董事、副总经理。	1、晶圆测试良率分析和优选管控技术  2、基于TCG架构的先进网络安全芯片晶圆测试解决方案	2、参与研究铂金探针的应用和整形的核心难点，为解决方案确定技术路线。  1、负责项目可行性分析，落实专案前期立项工作； 2、参与创建测试良率分析建模方案； 3、参与设计测试良率分析架构体系、设备优选数学模型； 4、制定验收标准以及检验阶段性目标。  1、负责项目可行性分析，落实专案前期立项工作； 2、参与研究网络安全芯片测试的核心难点并针对性提出解决方案； 3、参与网络安全芯片软硬件测试方案的开设计、开发和调试。
4	刘琨	核心技术人员	本科学历，检测技术及仪器专业。1997年-2001年任摩托罗拉（中国）电子有限公司产品工程师；2001年-2004年任职威宇科技测试封装（上海）有限公司，历任高级产品工程师、产品工程主管；2004年-2005年任英特尔（上海）有限公司工程主管；2005年-2009年任泰瑞达（上海）有限公司应用工程经理，负责中国北方区域；2009年-2015年任北京汉迪龙科技有限公司副总经理；2015年-2020年任上海旻艾半导体有限公司总经理；2020年2月至今，担任公司副总经理。	1、薄片晶圆测试技术  2、可选择性导片装置	1、负责项目可行性分析，落实专案前期立项工作； 2、参与薄片晶圆测试技术路线设计； 3、参与薄片晶圆治具设计和工艺开发； 4、制定验收标准以及检验阶段性目标。  1、项目统筹规划； 2、负责可选择性导片材质选择和确定； 3、参与规划设计可选择性导片电路及与测试机的配合机制； 4、制定验收标准以及检验阶段性目标。
5	左上勇	专利发明人	本科学历，材料化学专业。2010年-2019年任职于日月光封装测试有限公司，历任测试设备工程师、测试开发工程师、开发主任工程师；2010年-2019年任职于上海月芯半导体科技有限责任公司，任开发主任工程师；2019年6月至今任公司研发中心总监。	1、5G通信射频前端晶圆测试解决方案	1、研究5G通信射频前端通用测试参数并进行晶圆可测性设计； 2、制定使用低频参数测试加数据仿真反馈产品射频性能的技术方案。
6	杨恭乾	专利发明人	本科学历，信息与计算科学专业。2009年-2013年任职中芯国际集成电路制造（上海）有限公司，历任IT测试部工程师，部门主管；2013年-2018年任职菲	1、测试机配置匹配提效技术	1、调研设计测试机配置匹配规则； 2、进行测试机配置匹配流程设计以及流程图的规划设计； 3、设计测试机配置匹配软件核心

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
			尼萨光电通讯(上海)有限公司, 历任高级工程师, IT 测试部经理, 高级经理; 2018 年 2 月至今任公司研发中心总监。		架构及进行功能模块分解开发。
				2、晶圆测试良率分析和优选管控技术	1、创建测试良率分析建模方案; 2、设计测试良率分析架构体系、设备优选数学模型; 3、设备自动优选方案核心代码的分解、开发与调试。
				3、基于 TCG 架构的先进网络安全芯片晶圆测试解决方案	1、研究网络安全芯片测试的核心难点并针对性提出解决方案; 2、网络安全芯片软硬件测试方案的设计、开发和调试。
7	傅郁晓	专利发明人	本科学历, 微电子专业。2007 年-2016 年任日月光封装测试(上海)有限公司测试设备主管; 2016 年 5 月-2020 年 7 月任上海伟测半导体科技有限公司研发中心经理; 2020 年 7 月至今任公司销售总监。	1、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案	1、进行高速高分辨率电流型数模转换器实际测试数据和理论数据的修调和数据校准处理; 2、对实际测试数据和测试结果进行稳定分析, 并参与测试方案的验收。
				2、晶圆测试中对位辅助调整装置	1、参与晶圆测试中对位过程的分析 and 总结, 制作对位动作流程图并分析其必要性和优化空间; 2、设计一种新型可以提高打点产品效率的模具, 以替代原有设备在对产品外围需要打四到五圈墨点的方案。
				3、WIFI6 无线网络通讯芯片测试解决方案	1、追踪 WIFI6 技术规范, 进行相关数据收集整理, 设计公司 WIFI6 通用测试规范以及相应的测试规格书; 2、根据行业标准和 WIFI6 通用测试规范制定项目验收标准。
				4、自动降温装置	1、参与研发自动降温装置。
				5、延长墨管使用寿命的装置	1、设计实验方法以及设计打点器的机械装置。
				6、测试机配置匹配提效技术	1、测试机配置匹配需求分析和应用验证。
				7、晶圆测试中烧写写入工艺防呆管控技术	1、晶圆烧写写入工艺防呆管控技术的方案设计和相应验收标准的制定; 2、设计实验进行晶圆烧写写入工艺防呆管控技术的验证, 并进行风险分析。
				8、基于 ARM 架构的高性能处理器的测试解决方案	1、参与 ARM 架构的高性能处理器的测试项目规划、选定标的产品规范和设计测试硬件, 并进行测试程序的开发和设计; 2、制定产品测试量产的规范并设计量产的流程和相应的管控机制;

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
				9、高性能汽车电子芯片测试解决方案	3、执行工程验证和工程验收的标准，并进行测试稳定性的评估。 1、追踪高性能汽车电子行业技术规范，并和相关的设计公司进行测试规格和测试流程的规划设计，相应制定公司高性能汽车电子行业通用测试规范以及相应的测试流程； 2、制定符合行业标准的高性能汽车电子行业通用项目验收标准和规范。
8	张伟军	专利发明人	本科学历，电子科学与技术专业。2016年6月至今任公司研发中心工程师、经理。	1、解决背银、背金晶圆的测试稳压装置 2、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案 3、晶圆外观检测平台的改造装置 4、WIFI6无线网络通讯芯片测试解决方案 5、探针台自动清洁装置	1、分析并设计实验验证背银、背金晶圆高压测试不稳定的原因和失效模式； 2、设计稳压装置来保持电极电压的稳定，解决 prober chuck 电源会影响测试的问题。 1、参与分析高速高分辨率电流型数模转换器测试的核心难点并提供相应的解决方案； 2、负责高速高分辨率电流型数模转换器软件测试方案的设计，开发和调试。 1、根据新型的外观检测承载平台方案设计模具并进行仿真模拟； 2、制定新型模具验证流程和验收标准。 1、进行 WIFI6 无线测试的可行性分析和具体测试实现方案的构思，形成项目规划； 2、根据项目规划选定标的产品规范，设计测试硬件并进行测试程序的开发和设计。 1、系统分析芯片失效模式及原因； 2、基于失效芯片的数据，分析灰尘对芯片测试结果的影响； 3、参与设计、研发探针台自动清洁装置。
9	晏云飞	专利发明人	本科学历，电子信息与工程专业。2013年-2017年3月任职于京隆科技（苏州）有限公司，历任测试部门组长，代理课长；2017年3月至2018年5月任公司研发中心工程师。	1、测试机多方位使用兼容装置 2、高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案	1、根据方位运动控制机制和测试机需求规格设计新型测试机的空间运动机构，进行建模并设计整体构建图； 2、对新型测试机的空间运动机构进行模拟设计，并设计机构的生产制作图纸。 1、分析高速数字通信芯片行业规范已经制定的技术规范，进行测

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
					<p>试的可行性分析和具体测试实现方案的设计，形成项目规划；</p> <p>2、根据项目规划选定标的产品规范设计测试硬件，并进行测试程序的开发和设计。</p>
				3、探针台自动清洁装置	1、数据收集和分析，形成结案报告供项目研讨。
10	陈迎涛	专利发明人	本科学历。2007年-2016年历任日月光封装测试（上海）有限公司测试一厂生产组长，生产主任；2016年5月至今历任上海伟测生产经理，南京伟测厂长。	1、测试机多方位使用兼容装置	1、进行新型测试机的空间运动机构的制作和安装，并评估其实际效果是否符合预期； 2、测试机多方位使用兼容装置项目的验收。
				2、探针台自动清洁装置	1、评估喷吹管，脉冲电磁阀，气包，控制仪，出气嘴的选型和功能；
				3、芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术	1、进行熔丝烧调工艺精密控制的实验验证技术的开发，制定评价标准； 2、执行熔丝烧调工艺精密控制的实验验证，对稳定性及一致性进行分析。
				4、高性能汽车电子芯片测试解决方案	1、根据测试方案，进行测试硬件原理图、布线图的制作以及各种治具的设计； 2、执行各类硬件的制作，并制定和执行相应的硬件验收及标准。
11	周俊	专利发明人	本科学历，机械设计及其自动化专业。2008年-2017年5月任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任设备工程师，测试设备专案工程师，主任工程师；2017年7月至今历任公司上海伟测厂长、无锡伟测总经理。	1、测试机多方位使用兼容装置	1、分析现有测试机的空间运动机构，整理当前测试机无法实现全方位探测的原因，并提出具体控制模式； 2、提供需要增加的测试机方位运动控制机制并提供测试机需求规格。
				2、探针台自动清洁装置	1、设计自动清洁装置的机械图纸； 2、设计实验收集性能参数。
12	史小奇	专利发明人	专科学历，机电一体化专业。2007年-2017年任上海纪元微科电子有限公司测试工程师；2017年-2020年任上海伟测研发中心资深工程师；2020年至今历任无锡伟测研发中心经理、研发中心副总监。	1、晶圆测试过程中针痕精密管控工艺技术	1、针对集成电路针测过程容易扎偏的情况提出研发针痕管控的工艺技术思路； 2、设计防偏结构以及图纸。
				2、高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案	1、追踪高速数字通信芯片技术规范，和设计公司进行相关数据收集，整理高速数字通信芯片通用测试规范以及相应的测试规格书； 2、根据行业标准和高速数字通信芯片通用测试规范制定项目验收标准。

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
13	张洪亮	专利发明人	本科学历，电子信息工程专业。2009年-2011年任福州福顺半导体有限公司测试工程师；2011年-2015年任日月光封装测试（上海）有限公司测试设备工程师；2016年-2017年任歌尔股份有限公司测试部项目经理；2017年-2018年任公司研发中心工程师。	1、晶圆测试过程中针痕精密管控工艺技术	1、实验数据收集，及进行部分元器件焊接。
				2、高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案	1、根据制定好的高速数字通信芯片测试规范，制定产品测试量产的规范，并设计量产的流程和相应的管控机制； 2、执行高速数字通信芯片工程验证和工程验收，并进行测试稳定性的评估。
14	俞磊	专利发明人	本科学历，自动化专业。2011年-2016年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任品质工程师、专案工程师；2016年9月-2020年任公司研发中心工程师；2020年至今，任无锡伟测研发中心经理。	1、晶圆测试中对位辅助调整装置	1、根据设计图纸进行新型模具的制作并根据验证流程进行验证； 2、根据验收标准，执行新型模具的验收，评估实际效果。
				2、晶圆外观检测平台的改造装置	1、根据外观检测承载平台设计图纸进行新型模具的制作，并根据验证流程进行验证； 2、根据验收标准，执行外观检测承载平台模具的验收，并评估实际效果。
				3、WIFI6 无线网络通讯芯片测试解决方案	1、根据测试硬件设计图纸，进行测试硬件的制作并制定测试硬件的验收规范； 2、执行测试硬件的验收并评估硬件性能的评估。
				4、晶圆测试过程中针痕精密管控工艺技术	1、设计测试管控工艺监控报警机制； 2、负责载板、导向套管、触杆和触控开关的选型。
				5、高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案	1、根据测试硬件设计图纸，对高速数字通信芯片进行测试硬件的制作并制定测试硬件的验收规范； 2、执行高速数字通信芯片测试硬件的验收并评估硬件性能的评估。
15	崔勇彬	专利发明人	本科学历。2016年至今历任公司生产组长、生产主任、生产经理。	1、解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	1、设计试验对当只有一个测试电极电压触点且离电压触点远时测试电压逐渐衰减情况的验证。
				2、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案	1、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆 DOE 测试的验证设计和操作； 2、测试流程设计和良率管控规则的制定。
				3、自动降温装置	1、分析降温装置的降温媒介以及在 prober 上使用的便捷性； 2、设计降温装置的机械图纸。
				4、延长墨管使用寿命的装置	1、分析油墨干湿的原因； 2、设计新的油墨打点器，增强油

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
16	关姜维	专利发明人	本科学历，电子信息科学与技术专业。2010年-2016年历任日月光封装测试（上海）有限公司工程师，工程主管；2016年6月至今任公司研发中心经理、总监。	1、高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案	1、高清图像传感器芯片晶圆主流测试方案的分析和提出通用化的设计方案； 2、设计通用性高、可程序控制、可执行校准的通用性光源解决方案； 3、设计通用性高模块化的程序架构方案。
				2、晶圆测试中对位辅助调整装置	1、根据新型模具的设计方案产生模具设计图纸并进行仿真模拟； 2、设计和制定新型模具验证流程和验收标准。
				3、晶圆外观检测平台的改造装置	1、分析现有晶圆外观检测平台机构并分析现有平台的承载平台的运动和控制机制的优缺点； 2、提出新型的一种真空吸附检测台的外观检测平台承载平台的运动和控制机制并分析可行性和风险管控机制。
				4、WIFI6无线网络通讯芯片测试解决方案	1、根据制定好的测试规范制定产品测试量产的规范，并设计量产的流程和相应的管控机制； 2、执行工程验证和工程验收的规范，并进行测试稳定性的评估。
				5、自动降温装置	1、设计实验步骤以及方法，评估不同媒介的降温效率；
				6、多平台联动提效技术	1、为提升测试机的使用效率，立项研发多平台联动机构； 2、设计信息采集模块。
				7、晶圆测试探针卡精密管控技术	1、参与技术规格的制定以及机台参数的选定； 2、设计并验证铂金探针整形后良率监控技术方案。
17	赵阿勇	专利发明人	专科学历。2016年-2018年8月任公司研发中心工程师。	1、自动降温装置	1、收集不同媒介的降温时间，汇总实验数据。
				2、延长墨管使用寿命的装置	1、收集不同规格油墨连续打点不干涩的数据并整理分析实验数据。
18	吉晋阳	专利发明人	本科学历，电子信息工程专业。2009年-2016年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任测试设备主管、主任；2016年6月至今任公司研发中心经理、总监。	1、高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案	1、负责通用高清图像传感器芯片晶圆测试通用探针卡的设计并评估探针卡对光路的影响； 2、负责通用性高模块化的程序架构的程序的开发和调试。
				2、解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	1、负责稳压套环通过电极接线、电性连接于测试电极的方案设计；



序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
					2、提供多种连接与测试电极的方案，并安排 DOE 方案验证。
				3、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案	1、参与分析高速高分辨率电流型数模转换器测试的硬件难点并提供相应的解决方案； 2、负责高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试使用的硬件-屏蔽针卡的设计、制作和性能评估。
19	柴振极	专利发明人	本科学历。2016 年 7 月至今担任研发中心技术员、工程师。	1、解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	1、根据稳压套环通过电极接线、电性连接于测试电极方案和 DOE 方案，进行实验硬件的制作并进行设备的安装。
20	李峰	专利发明人	本科学历，电力系统及其自动化专业。2005 年-2007 年 1 月，在日月光封装测试（上海）有限公司担任厂务经理；2007 年-2016 年任上海峰越机电设备安装有限公司经理；2016 年至今，任公司厂务。	1、高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案	1、执行通用性光源和模块化的程序采集实验数据，并进行稳定性和准确性分析； 2、培训研发中心工程师光模块使用方法。
21	吴庆	专利发明人	本科学历，电子工程专业。2007 年-2015 年任职于晟碟半导体有限公司，历任设备组长，测试设备工程师；2015 年-2017 年任职于丽恒光微半导体，历任设备工程师，设备经理；2017 年 6 月至今任公司研发中心经理。	1、测试机配置匹配提效技术	1、测试机配置匹配代码撰写和调试。
				2、芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术	1、根据熔丝烧调工艺精密控制的实现方案提出具体的实施方式，并进行相应的外围电路设计； 2、对外围电路的设计进行制作，并对硬件进行相应的验收。
				3、高性能汽车电子芯片测试解决方案	1、根据标的产品的测试方案和硬件设计，执行具体测试项目的开发和调试，并执行相应的产品特性分析； 2、制定相应的测试项目开发的验收标准，并按照标准进行数据分析处理。
22	杨栓	专利发明人	本科学历。2013 年-2014 年上海樊境智能科技责任有限公司任销售经理；2014 年-2019 年任上海旻艾半导体有限公司测试工程师；2019 年 12 月至今任公司研发中心工程师。	1、多平台联动提效技术	1、设计技术图纸并制作样品； 2、分析待测晶圆的移动路径，模拟测试过程对移动次数进行计算。
				2、芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术	1、分析传统熔丝烧调工艺技术的实现方式，分析测试良率、稳定性以及研究传统技术是否可以满足未来的严格测试要求，如汽车电子和工业电子的严苛需求； 2、提出新型电子运用如汽车电子和工业电子对测试中熔丝烧调工艺的需求，并设计熔丝烧调工艺精密控制的实现方案及验收标准。
				3、高性能汽车电子芯片	1、分析汽车电子产品的通用特

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
				测试解决方案	点，根据汽车电子产品的测试开发特性选取和整理测试要求及测试规范； 2、根据标的产品的测试规范，制定相应的测试方案和根据产品制定相应的验收标准。
23	张丽霞	专利发明人	本科学历。2018年3月至今任公司研发中心工程师。	1、芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术	1、执行熔丝烧调工艺精密控制工艺化验证和DOE方案的设计； 2、执行熔丝烧调工艺精密控制技术的项目验收和工艺稳定分析。
				2、高性能汽车电子芯片测试解决方案	1、执行标的产品验证和数据分析确实测试的稳定性和数据的一致性； 2、设计DOE方案的设计和执行业并进行风险的评估。
24	刘栋栋	专利发明人	本科学历，电子信息工程专业，2013年-2018年年任矽品科技（苏州）有限公司测试产品工程师；2018年-2021年3月任公司研发中心工程师；2021年3月至今任无锡伟测研发中心经理。	1、多平台联动提效技术	1、设计控制系统包括信号配置单元、路径规划单元等； 2、进行多平台联动通讯驱动开发和 GPIB 信号调试。
25	袁常乐	专利发明人	本科学历，物理系电子信息科学与技术专业。2019年至今任公司研发中心工程师。	1、5G通信射频前端晶圆测试解决方案	1、执行测试硬件的设计、测试软件的开发和调试； 2、对测试结果和实验室测试结果进行一致性分析并优化测试算法。
26	王敏	专利发明人	本科学历，功能材料专业。2017年-2019年任日月光封装测试有限公司工程部产品测试工程师；2019年7月至2021年7月任公司研发中心工程师。	1、5G通信射频前端晶圆测试解决方案	1、设计验收规则和数据分析规则； 2、设计DOE验证的实验以及执行DOE的实验验证工作。
27	高大会	专利发明人	专科学历，电工电子专业。2002年-2004年任职于飞利浦光磁电子（上海）有限公司，任生产领班；2007年-2015年任职于日月光封装测试有限公司，历任储备组长，组长 生产管理师，主任；2015年2月-2015年9月任职于环维电子（上海）有限公司，任组长；2015年9月-2016年11月任职于环旭电子股份有限公司，历任组长，课长；2016年12月至今任公司生产经理。	1、晶圆测试良率分析和优选管控技术	1、进行自动优选方案验证和数据结果分析，并提供优化需求； 2、对自动优选方案进行验收和接收。
				2、基于TCG架构的先进网络安全芯片晶圆测试解决方案	1、进行网络安全芯片晶圆测试方案的实际测试稳定性分析，并和测试结果进行一致性分析； 2、进行网络安全芯片晶圆测试方案测试效率分析。
28	赵坤鹏	专利发明人	本科学历，机电一体化工程专业。2011年-2019年任日月光封装测试封装（上海）有限公司设备工程师；2019年-2020年任无锡华润微电子电子有限公司测试厂	1、测试方案开发的系统验证板	1、参与系统验证板的需求分析； 2、参与系统验证板原理图设计以及PCB layout 出图； 3、制定参数验收标准。
				2、延长墨管使用寿命的	1、核对实验数据并提交报告给项

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
			设备主管；2020年4月至今担任无锡伟测研发中心经理。	装置	目组审核；
				3、低温测试工艺结霜控制技术	1、低温测试过程中测试硬件上产生冷凝结霜原因分析； 2、参与研发项目可行性分析以及方案制定； 3、设计解决料盘翘曲的压盘结构的技术方案； 4、机械装置图纸设计。
				4、32位微控制单元芯片晶圆测试解决方案	1、对通用型硬件重新设计和优化； 2、电路板原理图设计以及PCB layout出图； 3、自动开发软件代码的撰写并完善测试标准库。
				5、修调卡及线缆快速验证装置	1、线缆异常信息分类分析； 2、设计快速验证装置图纸并协调生产制作。
				6、测试机配置匹配提效技术	1、分析无法及时检测集成电路产品从分选机上掉落或者没有吸起的原因； 2、设计改善方案和装置图纸。
				7、自动降温装置	1、设计常高温快速切换的方案； 2、评估各种技术方案降温的时间以及成本。
				8、晶圆测试探针卡精密管控技术	1、设计防呆装置的结构； 2、确定防尘盖的评估选型； 3、对加工卡槽的密封性进行优化。
				29	杨征
2、低温测试工艺结霜控制技术	1、追踪方案验证实施结果以及实验数据收集； 2、对应用技术后的测试结果进行验证； 3、分析效率提升部分数据并提交报告； 4、参与验证装置的报警信息分类调试； 5、装置试验数据确认以及提交报告。				
3、32位微控制单元芯片晶圆测试解决方案	1、参与研发中心测试程序的自动化生成方法的设计； 2、电路板验收以及提交报告。				
4、修调卡及线缆快速验证装置	1、参与验证装置的异常信息分类归纳；				

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
					2、参与验收装置数据以及提交报告。
				5、晶圆测试探针卡精密管控技术	1、设计装置下单制作及交期追踪； 2、实验数据收集以及报告整理提交。
				6、试机配置匹配提效技术	1、参与验收装置数据以及提交报告。
				7、自动降温装置	1、降温装置机械图纸设计和加工制作； 2、实验数据收集以及报告整理。
30	张秀超	专利发明人	本科学历，物流管理专业。2013-2014年任日月光封装测试（上海）有限公司 QA LAB 工程师；2017年2月至今任公司研发中心工程师。	1、晶圆测试探针卡精密管控技术	1、设计并验证探针卡延长寿命方案； 2、设计探针台增加组合清针方案； 3、试验并确定失效验证分析办法。
31	赵怀菊	专利发明人	专科学历，电子商务专业。2014年1月-2015年5月，任欣阳精密模具（上海）有限公司质量工程师；2018年1月至今任公司研发中心工程师。	1、晶圆测试探针卡精密管控技术	1、设计并验证探针卡低温封孔解决方案； 2、设计并验证探针卡抗干扰处理方案； 3、试验并确定快速有效验证探针卡异常方法。

截至本补充法律意见书出具之日，上述核心技术人员与专利发明人中，晏云飞、赵阿勇、张洪亮、王敏、杨征等5人已离职，其余人员均尚在公司任职。

2、结合行业研发周期、客户认证周期、测试方案开发和验证周期，说明主营业务发展和核心技术形成的关键历史节点，技术来源是否为自主研发，是否合法合规

#### （1）行业研发周期

经本所律师核查，行业缺乏研发周期的相关统计数据，同行业上市公司和公开渠道亦未披露相关数据。报告期内发行人各类测试核心技术的研发周期一般在5-18个月之间。

#### （2）客户认证周期和测试方案开发和验证周期的一般情况

在客户认证周期方面，公司成为客户的合格供应商的认证过程一般包括双方初步接洽、签署保密协议、客户来厂参观及验厂、公司通过合格供应商认证等几个环节，整个认证周期一般在30天至90天之间。发行人针对某特定产品进行测试

方案开发和验证的周期一般为1-3个月左右。

### （3）公司主营业务发展过程

公司自设立以来，一直专注于经营集成电路测试服务业务。公司成立以来，主营业务的发展情况如下：

#### A. 2016年-2017年公司处于创业摸索和积累阶段，主要提供晶圆测试服务

公司成立之初，选择了技术含量高、市场竞争格局好的“晶圆测试”业务，在工厂选址上，选择毗邻中国最大的集成电路产业集群上海张江。在业务方面，公司得到了以晶丰明源、艾为电子等为代表的模拟类客户的认可，并开始逐步导入中高端测试平台及客户，拓展数字类的客户和测试服务。

#### B. 2018年-2019年公司进入快速成长阶段，并开始介入芯片成品测试业务

在该期间，公司不断完善整套测试作业体系，加强测试技术和测试工艺的研发投入，大力引进中高端测试平台，不断提升公司的高端测试服务能力。2019年末，鉴于公司在晶圆测试积累的客户基础以及行业口碑，公司又适时开拓芯片成品测试业务，为公司的发展创造了新的增长点。

C. 2020年至今，公司开始确立行业领先地位，确定了以“以晶圆测试为核心，积极发展中高端芯片成品测试”的差异化竞争策略

“高端化、顶尖客户、全力扩产”是这一阶段的公司发展策略，公司抓住“美国打压中国半导体行业，中国大陆的一线芯片设计公司加快测试服务供应商的国产化替代”的历史契机，一方面加大研发投入，重点突破6nm-14nm先进制程芯片、5G射频芯片、高性能CPU芯片、高性能计算芯片、FPGA芯片、复杂SoC芯片等各类高端芯片的测试工艺难点，另一方面快速扩充高端测试产能，使得公司具备承接中国大陆高端芯片设计公司测试订单的技术实力和产能规模。

### （4）公司核心技术形成的关键历史节点

截至本补充法律意见书出具之日，公司拥有的核心技术形成的关键历史节点情况如下：

序号	核心技术大类	技术形成的关键历史节点				
		时间节点	形成的核心技术	应用范围		
1	测试方案开发技术	2016年-2017年	高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案	数模转换芯片		
			高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案	图像传感芯片		
		2018年-2019年	高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案	数据通信芯片		
			WiFi6无线网络通讯芯片测试解决方案	无线网络芯片		
			第3代快闪存储器IP的晶圆测试方案	存储器芯片		
			基于TCG架构的先进网络安全芯片晶圆测试解决方案	安全芯片		
			现场可编程逻辑门阵列芯片测试解决方案	FPGA芯片		
		2020年以后	5G通信射频前端晶圆测试解决方案	5G射频前端芯片		
			基于ARM架构的高性能处理器的测试解决方案	处理器芯片		
			高性能汽车电子芯片测试解决方案	汽车芯片		
			高性能区块链算力芯片晶圆测试方案	AI、区块链芯片		
			32位微控制单元芯片晶圆测试解决方案	微控制器芯片		
		2	测试工艺难点突破与精益测试提效技术	2016年-2017年	晶圆测试过程中针痕精密管控工艺技术	晶圆测试
				2018年-2019年	测试机配置匹配提效技术	晶圆测试、芯片成品测试
					晶圆测试中烧写写入工艺防呆管控技术	晶圆测试
低温测试工艺结霜控制技术	晶圆测试、芯片成品测试					
2020年以后	芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术			芯片成品测试		
	晶圆测试良率分析和优选管控技术			晶圆测试		
	薄片晶圆测试技术			晶圆测试		
	多平台联动提效技术			晶圆测试		
3	设备改造升级技术	2016年-2017年	测试机多方位使用兼容装置	晶圆测试、芯片成品测试		
			解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	晶圆测试		
			晶圆测试机抗干扰外壳装置	晶圆测试		
		2018年-2019年	探针台自动清洁装置	晶圆测试		
			晶圆外观检测平台的改造装置	晶圆测试		
		2020年以后	晶圆测试机抗干扰外壳装置	晶圆测试		
4	测试治具设计技术	2016年-2017年	延长墨管使用寿命的装置	晶圆测试		
			晶圆测试中对位辅助调整装置	晶圆测试		

序号	核心技术大类	技术形成的关键历史节点		
		时间节点	形成的核心技术	应用范围
		2018年-2019年	自动降温装置	晶圆测试
			测试方案开发的系统验证板	晶圆测试、芯片成品测试
		2020年以后	修调卡及线缆快速验证装置	晶圆测试、芯片成品测试
			可选择性导片装置	晶圆测试
			晶圆测试探针卡精密管控技术	晶圆测试
5	自动化测试及数据分析技术	2018年-2019年	数据挖掘与多维度分析系统	数据分析系统
			测试参数大数据多维度统计分析系统	数据分析系统
			生产稼动率统计分析和管控系统	数据分析系统
			数据挖掘与多维度分析系统	数据分析系统
		2020年以后	Mapping 分析系统	数据分析系统

### （5）技术来源及其合法合规性

公司是由骈文胜、闻国涛等几位在集成电路封测行业具有丰富从业经验的资深人士于2016年创立。公司设立时就对标国内一流和国际领先的测试企业，通过自主研发，不断攻克测试技术难点，提升服务水平和服务能力，立志通过技术驱动打造一家具有核心竞争力的独立第三方专业测试服务商。创立以来，公司高度重视技术研发，不断加大研发投入，通过自主研发和技术积累逐步形成了公司在测试方案开发、设备改造升级技术、测试治具设计、测试自动化和智能化等方面的核心技术。发行人主要技术均来源于自主研发，且拥有自主知识产权，不存在合作开发、委托开发的情形。截至本补充法律意见书出具之日，公司已经取得29项专利，其中有7项发明专利。公司核心技术的来源合法合规，均为自主研发，不存在来源于其他任何无关第三方。发行人现有专利、核心技术等无形资产不存在侵犯知识产权、商业秘密的情形，亦不存在权属纠纷或潜在纠纷。

三、结合核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）的任职经历，说明该等人员是否存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，是否存在纠纷或潜在纠纷。

核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）的任职经历详见本补充法

律意见书“第二部分/问题 2/二/1、发行人核心技术人员和专利发明人（包括已离职人员）的从业经历及其在技术形成过程中发挥的作用”。

### 1、核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）是否存在违反原任职单位关于竞业禁止的情形

根据公司核心技术人员、专利发明人提供的劳动合同、与原任职单位有交易的银行卡流水、原任职单位出具的说明等资料并经本所律师访谈核心技术人员和专利发明人，公司核心技术人员和专利发明人与原任职单位是否签订竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同以及是否获得竞业禁止补偿金等情况如下表所示：

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同	是否收到竞业禁止补偿金	是否违反竞业禁止约定	备注
1	骈文胜	核心技术人员、专利发明人	否	否	否	1、未签订竞业禁止协议，离职后未收到过竞业禁止补偿金； 2、原单位直属领导接受访谈，证明其不存在违反竞业禁止方面的纠纷、诉讼或仲裁； 3、原单位长电科技与公司一直保持良好的合作关系，且 2018 年和 2019 年长电科技均为公司的第一大客户；
2	闻国涛	核心技术人员、专利发明人	否	否	否	未签订竞业禁止协议且原任职单位出具其不负竞业禁止义务的说明
3	路峰	核心技术人员、专利发明人	是	否	否	1、离职后未收到过竞业禁止补偿金； 2、原单位直属领导接受了访谈，证明其不存在违反



序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同	是否收到竞业禁止补偿金	是否违反竞业禁止约定	备注
						竞业禁止方面的纠纷、诉讼或仲裁； 3、原单位晟碟半导体从事存储器业务，与公司的业务不存在直接竞争关系；
4	刘琨	核心技术人员	否	否	否	未签订竞业禁止协议且原任职单位出具其不负竞业禁止义务的说明
5	左上勇	专利发明人	否	否	否	
6	杨恭乾	专利发明人	是	否	否	1、离职后未收到过竞业禁止补偿金； 2、原单位菲尼萨从事光通信业务，与公司的业务不存在直接竞争关系
7	傅郁晓	专利发明人	否	否	否	
8	张伟军	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	不适用	
9	晏云飞	专利发明人	否	否	否	
10	陈迎涛	专利发明人	否	否	否	
11	周俊	专利发明人	否	否	否	
12	史小奇	专利发明人	否	否	否	
13	张洪亮	专利发明人	否	否	否	
14	俞磊	专利发明人	否	否	否	
15	崔勇彬	专利发明人	否，入职前为自由职业	不适用	不适用	
16	关姜维	专利发明人	否	否	否	
17	赵阿勇	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	不适用	
18	吉晋阳	专利发明人	否	否	否	
19	柴振极	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	不适用	
20	李峰	专利发明人	否	否	不适用	原任职单位系其

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同	是否收到竞业禁止补偿金	是否违反竞业禁止约定	备注
						本人设立的公司
21	吴庆	专利发明人	否	否	否	
22	杨栓	专利发明人	否	否	否	
23	张丽霞	专利发明人	否，入职前为自由职业	不适用	不适用	
24	刘栋栋	专利发明人	否	否	否	
25	袁常乐	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	不适用	
26	王敏	专利发明人	否	否	否	
27	高大会	专利发明人	否	否	否	
28	赵坤鹏	专利发明人	否	否	否	
29	杨征	专利发明人	否	否	否	
30	张秀超	专利发明人	否	否	否	
31	赵怀菊	专利发明人	否	否	否	

如上表所示，公司核心技术人员和专利发明人中仅路峰、杨恭乾 2 人与原任职单位签订过竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同，由于其未收到过竞业禁止补偿金，因此不负竞业禁止的义务。其余人员因未签署过竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同，并且未收到过竞业禁止补偿金，因此亦不负竞业禁止的义务。

## 2、核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）是否存在违反原任职单位关于保密协议约定的情形

根据公司核心技术人员、专利发明人提供的劳动合同、保密协议等资料并经本所律师访谈核心技术人员和专利发明人，公司核心技术人员、专利发明人与原任职单位是否签订保密协议或含保密条款的劳动合同以及是否违反保密约定等情况如下表所示：

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订保密协议或含保密条款的劳动合同	是否违反保密约定	备注
1	骈文胜	核心技术人员、专利发明人	是	否	原单位直属领导接受访谈，证明其不存在违反保密约定方面的纠纷、诉讼或仲裁

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订保密协议或含保密条款的劳动合同	是否违反保密约定	备注
2	闻国涛	核心技术人员、专利发明人	是	否	原任职单位出具其未违反保密义务的说明
3	路峰	核心技术人员、专利发明人	是	否	原任职单位直属领导接受访谈，证明其不存在违反保密约定方面的纠纷、诉讼或仲裁
4	刘琨	核心技术人员	是	否	原任职单位出具其未违反保密义务的说明
5	左上勇	专利发明人	是	否	
6	杨恭乾	专利发明人	是	否	
7	傅郁晓	专利发明人	是	否	
8	张伟军	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	
9	晏云飞	专利发明人	是	否	
10	陈迎涛	专利发明人	是	否	
11	周俊	专利发明人	是	否	
12	史小奇	专利发明人	是	否	
13	张洪亮	专利发明人	是	否	
14	俞磊	专利发明人	是	否	
15	崔勇彬	专利发明人	否，入职前为自由职业	不适用	
16	关姜维	专利发明人	是	否	
17	赵阿勇	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	
18	吉晋阳	专利发明人	是	否	
19	柴振极	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	
20	李峰	专利发明人	否	不适用	原任职单位系其本人设立的公司
21	吴庆	专利发明人	是	否	
22	杨栓	专利发明人	是	否	
23	张丽霞	专利发明人	否，入职前为自由职业	不适用	
24	刘栋栋	专利发明人	是	否	
25	袁常乐	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	
26	王敏	专利发明人	是	否	
27	高大会	专利发明人	是	否	
28	赵坤鹏	专利发明人	是	否	
29	杨征	专利发明人	是	否	

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订保密协议或含保密条款的劳动合同	是否违反保密约定	备注
30	张秀超	专利发明人	是	否	
31	赵怀菊	专利发明人	否	否	

如上表所示，公司核心技术人员、专利发明人中有 23 人与原任职单位签订了保密协议或包含保密条款的劳动合同。经本所律师访谈上述人员并对其进行网络核查，上述人员未违反保密约定且与原任职单位不存在诉讼、仲裁或其他纠纷。

### 3、核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）与原单位是否存在纠纷或潜在纠纷

根据公司核心技术人员、专利发明人提供的相关资料并经本所律师访谈、网络核查，公司核心技术人员和专利发明人与原任职单位不存在任何与竞业禁止义务、保密义务或知识产权相关的诉讼或仲裁，公司核心技术人员、专利发明人与原任职单位不存在纠纷或潜在纠纷。

## 四、核查过程

1、查阅发行人拥有的专利证书，并获取国家知识产权局出具的专利批量法律状态证明；

2、查阅发行人出具的 6 项发明专利在主营业务中具体应用情况的说明；

3、查阅核心技术人员、专利发明人与原任职单位的劳动合同或同时期劳动合同模板、保密协议（如有）、竞业禁止协议（如有）；

4、访谈骈文胜、路峰原任职单位的直属领导，查阅闻国涛、刘琨原任职单位出具的说明；

5、查阅发行人出具的说明，了解核心技术人员、其他专利发明人的从业经历、参与的专利发明情况、核心技术形成过程中发挥的作用以及核心技术形成的历史节点等；

6、访谈核心技术人员与专利发明人，了解其与原任职单位关于是否签订竞业禁止或竞业限制、保密义务相关协议以及是否收到原任职单位的竞业禁止补偿金等情况；

7、取得并查阅核心技术人员、在职的其他专利发明人与原任职单位有交易的银行卡流水；

8、通过中国裁判文书网、中国执行信息公开网等公开网站对发行人专利、核心技术人员及专利发明人是否存在纠纷的情况进行网络核查。

#### 五、核查意见

经核查，本所律师认为：

1、公司6项发明专利均为公司自主研发，专利发明人均为公司员工，该6项发明专利均运用于发行人主营业务；

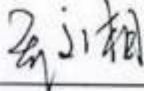
2、公司核心技术来源均为公司自主研发，合法合规；

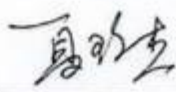
3、公司核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）不存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，不存在纠纷或潜在纠纷。

（本页以下无正文）

(本页无正文,系《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书(二)》之签署页)


  
 上海市锦天城律师事务所  
 负责人:   
 顾功耘

经办律师:   
 乔文湘

经办律师:   
 夏瑜杰

2021年4月27日

上海市锦天城律师事务所  
关于上海伟测半导体科技股份有限公司  
首次公开发行股票并在科创板上市的

补充法律意见书（一）



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层  
电话：021-20511000                      传真：021-20511999  
邮编：200120

## 目 录

声明事项 .....	3
释 义 .....	5
正 文 .....	7
问题 2.关于核心技术来源 .....	7
问题 5.关于销售和客户 .....	27
问题 16.关于股东 .....	30
问题 18.关于其他问题 .....	34



**上海市锦天城律师事务所**  
**关于上海伟测半导体科技股份有限公司**  
**首次公开发行股票并在科创板上市的**  
**补充法律意见书（一）**

案号：01F20202132

**致：上海伟测半导体科技股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“伟测科技”）的委托，并根据发行人与本所签订的《聘请律师合同》，作为发行人首次公开发行股票并在科创板上市项目（以下简称“本次发行上市”）的特聘专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《科创板首发管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，就本次发行上市所涉有关事宜于 2021 年 12 月 22 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）和《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）。

鉴于上海证券交易所于 2022 年 1 月 17 日向发行人下发了《关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）〔2022〕26 号）（以下简称“《问询函》”），本所律师在对相关事项进行审慎核查后出具《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“本补充法律意见书”），以对《法律意见书》及《律师工作报告》中披露的内容进行相应的修订或补充。

## 声明事项

一、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

二、本所及本所律师仅就与发行人本次发行上市有关法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估、内部控制、盈利预测等专业事项发表意见。在本补充法律意见书和为本次发行上市出具的《法律意见书》《律师工作报告》中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告和内部控制报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。

三、本补充法律意见书中，本所及本所律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件发生时所应当适用的法律、法规、规章及规范性文件为依据。

四、本补充法律意见书的出具已经得到发行人如下保证：发行人已经提供了本所为出具本补充法律意见书所要求发行人提供的全部原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

五、对于本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依据有关政府部门、发行人或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见。

六、本所同意发行人在《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》（以下简称“《招股说明书（申报稿）》”）中自行引用或按上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核要求引用本补充法

律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

七、本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所及本所律师根据有关法律、法规、规章和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上交所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本补充法律意见书。

## 释 义

本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述含义：

发行人、伟测科技、公司	指	上海伟测半导体科技股份有限公司
伟测有限	指	上海伟测半导体科技有限公司，发行人前身
蕊测半导体、控股股东	指	上海蕊测半导体科技有限公司，发行人股东
子公司	指	发行人合并报表范围内的全资、控股子公司
本所、锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
保荐机构	指	平安证券股份有限公司
天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行上市、本次发行	指	发行人首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市
报告期、三年一期	指	2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月
《招股说明书（申报稿）》	指	发行人为本次发行上市制作的《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》
本补充法律意见书	指	《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（一）》
IDM	指	Integrated Design and Manufacture，即垂直整合模式，该模式下企业能够独立完成芯片设计、晶圆制造、封装测试的所有环节
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司
晟碟半导体	指	晟碟半导体（上海）有限公司
菲尼萨	指	菲尼萨光电通讯（上海）有限公司
紫光展锐	指	紫光展锐（上海）科技有限公司
中兴微电子	指	深圳市中兴微电子技术有限公司
晶晨股份	指	晶晨半导体（上海）股份有限公司
安路科技	指	上海安路信息科技股份有限公司
比特大陆	指	Bitmain Technologies Limited，比特大陆科技有限公司
兆易创新	指	北京兆易创新科技股份有限公司
卓胜微	指	江苏卓胜微电子股份有限公司
普冉股份	指	普冉半导体（上海）股份有限公司
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司
中颖电子	指	中颖电子股份有限公司
复旦微电	指	上海复旦微电子集团股份有限公司

北京君正	指	北京君正集成电路股份有限公司
摩托罗拉	指	摩托罗拉（中国）电子有限公司，现已更名为摩托罗拉系统（中国）有限公司
日月光	指	日月光封装测试（上海）有限公司
晶丰明源	指	上海晶丰明源半导体股份有限公司
艾为电子	指	上海艾为电子技术股份有限公司
《审计报告》	指	天健会计师出具的“天健审（2021）6-331 号”《上海伟测半导体科技股份有限公司审计报告》
《公司章程》	指	根据上下文意所需，指发行人及其前身制定并不时修订的公司章程，另有说明的除外
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
中国、境内	指	中华人民共和国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区），为本补充法律意见书之目的，指中国大陆地区
法律法规	指	提及当时公布并生效的中国大陆法律、行政法规、地方性法规、规章以及规范性文件
国家企业信用信息公示系统	指	中华人民共和国国家市场监督管理总局主办的国家企业信用信息公示系统网站，其网址为 <a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a>
元、万元	指	人民币元、万元，上下文另有说明的除外

注：除特别说明外，本补充法律意见书中若出现总计数与分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

## 正文

### 问题 2.关于核心技术来源

2.1 根据招股说明书，1) 公司 2016 年成立后即进入晶圆测试领域，2017 年实现盈利，2019 年末开拓了芯片测试业务。发行人的核心技术系自主开发，并随着测试经验的积累逐步完善。2) 截至本招股说明书签署日，公司及其子公司取得 24 项专利、1 项软件著作权，其中有 6 项发明专利，18 项实用新型专利。3) 公司有 4 名核心技术人员，就职前曾在日月光封测、长电科技等同行业公司任职，其中一名核心技术人员于 2020 年 2 月入职。另根据申报材料，部分专利发明人目前已离职。

请发行人说明：

(1) 公司 6 项发明专利的具体来源、发明人的具体情况，是否为公司员工，该 6 项发明专利在发行人主营业务中的具体应用情况；

(2) 结合核心技术人员和专利发明人（包括已离职人员）的从业经历，说明其在技术形成过程中发挥的作用，并结合行业研发周期、客户认证周期、测试方案开发和验证周期，说明主营业务发展和核心技术形成的关键历史节点，技术来源是否为自主研发，是否合法合规；

(3) 结合核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）的任职经历，说明该等人员是否存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，是否存在纠纷或潜在纠纷。

请保荐机构和发行人律师进行核查，完善核查方式，说明核查过程并发表明确意见。

回复：

一、公司 6 项发明专利的具体来源、发明人的具体情况，是否为公司员工，该 6 项发明专利在发行人主营业务中的具体应用情况

发行人 6 项发明专利的具体来源、发明人的具体情况及在发行人主营业务中的具体应用情况如下表所示：

序号	专利名称	申请号/专利号	技术来源	发明人	是否公司员工	具体应用
1	晶圆区域性问题的分析系统及方法	202110310750.9	自主研发	杨恭乾、路峰、高大会、闻国涛、骈文胜	皆是	1、是一种对测试环节的数据进行大量数据分析以发现异常和测试环节的问题，并对测试问题的根本原因进行智能判断的一套分析系统。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试业务。
2	多晶硅工艺保险丝的熔断装置及方法	202110248636.8	自主研发	傅郁晓、吴庆、陈迎涛、杨栓、张丽霞	皆是	1、大规模测试服务中保险丝熔断工艺较为普遍，该发明是用一种简单的替代方法在保证质量的同时达成熔断工艺。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试业务与芯片成品测试业务。
3	一种测试机匹配检测系统及其方法	202011533224.0	自主研发	傅郁晓、吴庆、骈文胜、闻国涛、杨恭乾	皆是	1、是一种软件系统，主要用于测试机对设计公司提供产品进行自动适应性配置。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试与芯片成品测试业务。
4	一种 Wafer ID 烧写防呆的系统	202011523844.6	自主研发	骈文胜、傅郁晓	皆是	1、在大规模测试服务中确保每个芯片被正确识别和跟踪，并可以持续保证最高的测试质量；当遇有多流程的情况时不会出现测试错误，是大规模测试服务中质量管理系统的关键环节。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试业务。
5	一种多平台联动提效机构	202011489734.2	自主研发	杨栓、关姜维、刘栋栋	皆是	1、将两个测试机对接到一个探针台上，可以在保证测试质量的同时提高测试效率和设备利用率。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试业务。
6	一种集成电路精确测试小电阻的方法	202011160294.6	自主研发	左上勇、袁常乐、王敏	皆是	1、属于一种测试的优化方法，在保证高精度的同时，运用简单仪器测试小电阻。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试与芯片成品测试业务。

如上表所示，上述 6 项发明专利均由发行人员工自主研发形成并应用于主营业务。

二、结合核心技术人员和专利发明人（包括已离职人员）的从业经历，说明其在技术形成过程中发挥的作用，并结合行业研发周期、客户认证周期、测

试方案开发和验证周期，说明主营业务发展和核心技术形成的关键历史节点，技术来源是否为自主研发，是否合法合规。

1、发行人核心技术人员和专利发明人（包括已离职人员）的从业经历及其在技术形成过程中发挥的作用

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
1	骈文胜	核心技术人员、专利发明人	本科学历，电子精密机械专业。1993年-2000年任摩托罗拉（中国）电子有限公司设备经理；2000年-2004年任职于威宇科技测试封装（上海）有限公司；2004年-2009年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任测试厂长、封装厂长、资材处长；2009年-2016年任职于江苏长电科技股份有限公司，任事业中心总经理、集团海外销售副总裁；2016年11月至今任公司董事长、总经理。	1、基于 ARM 架构的高性能处理器的测试解决方案	1、项目统筹规划； 2、参与制定产品测试量产的规范并设计量产的流程和相应的管控机制； 3、技术规范评估。
				2、晶圆测试中烧写写入工艺防呆管控技术	1、项目统筹规划； 2、参与晶圆烧写写入工艺防呆管控技术的方案设计和相应的验收标准的制定。
				3、晶圆测试良率分析和优选管控技术	1、项目统筹规划； 2、参与设计测试良率分析架构体系和设备自动优选的方案核心代码分解。
				4、基于 TCG 架构的先进网络安全芯片晶圆测试解决方案	1、项目统筹规划； 2、参与研究网络安全芯片测试的核心难点，为解决方案提供技术路线。
2	闻国涛	核心技术人员、专利发明人	本科学历，机械设计及其自动化专业。2001年-2004年任威宇科技测试封装（上海）有限公司设备工程师；2004年-2016年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任测试设备主管、经理、封装厂长、测试厂长；2016年5月至今任公司董事、副总经理。	1、高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案	1、项目可行性分析，落实专案前期立项工作 2、比对、分析、定制、优化技术方案； 3、制定验收标准及检验阶段性目标。
				2、解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	1、项目统筹规划； 2、参与稳压套环通过电极接线、电性连接于测试电极方案。
				3、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案	1、项目统筹规划； 2、参与研究测试的核心难点，为解决方案提供技术路线。
				4、测试机配置匹配提效技术	1、项目统筹规划； 2、参与调研设计测试机配置匹配规则； 3、参与测试机配置匹配流程的设计以及流程图的规划设计； 4、制定验收标准以及检验阶段性目标。
3	路峰	核心技术人员、专利发明人	本科学历，电子工程系专业。1993-2000年任摩托罗拉（中国）电子有限公司 IT 自动化经理；2000年-2004年任威宇科技测试封装（上海）有限公司 IT 部门	1、晶圆测试良率分析和优选管控技术	1、负责项目可行性分析，落实专案前期立项工作； 2、参与创建测试良率分析建模方案； 3、参与设计测试良率分析架构体



序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
			经理；2004年-2006年任日月光封装测试（上海）有限公司IT部门经理；2006年-2018年任职于晟碟半导体（上海）有限公司，历任IT部门经理、总监；2018年5月至今任公司董事、副总经理。		系、设备优选数学模型； 4、制定验收标准以及检验阶段性目标。
				2、基于TCG架构的先进网络安全芯片晶圆测试解决方案	1、负责项目可行性分析，落实专案前期立项工作； 2、参与研究网络安全芯片测试的核心难点并针对性提出解决方案； 3、参与网络安全芯片软硬件测试方案的开设计、开发和调试。
4	刘琨	核心技术人员	本科学历，检测技术及仪器专业。1997年-2001年任摩托罗拉（中国）电子有限公司产品工程师；2001年-2004年任职威宇科技测试封装（上海）有限公司，历任高级产品工程师、产品工程主管；2004年-2005年任英特尔（上海）有限公司工程主管；2005年-2009年任泰瑞达（上海）有限公司应用工程经理，负责中国北方区域；2009年-2015年任北京汉迪龙科科技有限公司副总经理；2015年-2020年任上海旻艾半导体有限公司总经理；2020年2月至今，担任公司副总经理。	1、薄片晶圆测试技术	1、负责项目可行性分析，落实专案前期立项工作； 2、参与薄片晶圆测试技术路线设计； 3、参与薄片晶圆治具设计和工艺开发； 4、制定验收标准以及检验阶段性目标。
				2、可选择性导片装置	1、项目统筹规划； 2、负责可选择性导片材质选择和确定； 3、参与规划设计可选择性导片电路及与测试机的配合机制； 4、制定验收标准以及检验阶段性目标。
5	左上勇	专利发明人	本科学历，材料化学专业。2010年-2019年任职于日月光封装测试有限公司，历任测试设备工程师、测试开发工程师、开发主任工程师；2010年-2019年任职于上海月芯半导体科技有限责任公司，任开发主任工程师；2019年6月至今任公司研发中心总监。	1、5G通信射频前端晶圆测试解决方案	1、研究5G通信射频前端通用测试参数并进行晶圆可测性设计； 2、制定使用低频参数测试加数据仿真反馈产品射频性能的技术方案。
6	杨恭乾	专利发明人	本科学历，信息与计算科学专业。2009年-2013年任职中芯国际集成电路制造（上海）有限公司，历任IT测试部工程师，部门主管；2013年-2018年任职菲尼萨光电通讯（上海）有限公司，历任高级工程师，IT测试部经理，高级经理；2018年2月至今任公司研发中心总监。	1、测试机配置匹配提效技术	1、调研设计测试机配置匹配规则； 2、进行测试机配置匹配流程设计以及流程图的规划设计； 3、设计测试机配置匹配软件核心架构及进行功能模块分解开发。
				2、晶圆测试良率分析和优选管控技术	1、创建测试良率分析建模方案； 2、设计测试良率分析架构体系、设备优选数学模型； 3、设备自动优选方案核心代码的分解、开发与调试。
				3、基于TCG架构的先进网络安全芯片晶圆测试	1、研究网络安全芯片测试的核心难点并针对性提出解决方案；

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
				解决方案	2、网络安全芯片软硬件测试方案的设计、开发和调试。
7	傅郁晓	专利发明人	本科学历，微电子专业。2007年-2016年任日月光封装测试（上海）有限公司测试设备主管；2016年5月-2020年7月任上海伟测半导体科技有限公司研发中心经理；2020年7月至今任公司销售总监。	1、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案 2、晶圆测试中对位辅助调整装置 3、WIFI6无线网络通讯芯片测试解决方案 4、自动降温装置 5、延长墨管使用寿命的装置 6、测试机配置匹配提效技术 7、晶圆测试中烧写写入工艺防呆管控技术 8、基于ARM架构的高性能处理器的测试解决方案 9、高性能汽车电子芯片测试解决方案	1、进行高速高分辨率电流型数模转换器实际测试数据和理论数据的修调和数据校准处理； 2、对实际测试数据和测试结果进行稳定分析，并参与测试方案的验收。 1、参与晶圆测试中对位过程的分析和总结，制作对位动作流程图并分析其必要性和优化空间； 2、设计一种新型可以提高打点产品效率的模具，以替代原有设备在对产品外围需要打四到五圈墨点的方案。 1、追踪 WIFI6 技术规范，进行相关数据收集整理，设计公司 WIFI6 通用测试规范以及相应的测试规格书； 2、根据行业标准和 WIFI6 通用测试规范制定项目验收标准。 1、参与研发自动降温装置。 1、设计实验方法以及设计打点器的机械装置。 1、测试机配置匹配需求分析和应用验证。 1、晶圆烧写写入工艺防呆管控技术的方案设计和相应验收标准的制定； 2、设计实验进行晶圆烧写写入工艺防呆管控技术的验证，并进行风险分析。 1、参与 ARM 架构的高性能处理器的测试项目规划、选定标的产品规范和设计测试硬件，并进行测试程序的开发和设计； 2、制定产品测试量产的规范并设计量产的流程和相应的管控机制； 3、执行工程验证和工程验收的标准，并进行测试稳定性的评估。 1、追踪高性能汽车电子行业技术规范，并和相关的设计公司进行测试规格和测试流程的规划设计，相应制定公司高性能汽车电子行业通用测试规范以及相应的测试流程； 2、制定符合行业标准的高性能汽

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
8	张伟军	专利发明人	本科学历，电子科学与技术专业。2016年6月至今任公司研发中心工程师、经理。	1、解决背银、背金晶圆的测试稳压装置 2、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案 3、晶圆外观检测平台的改造装置 4、WIFI6无线网络通讯芯片测试解决方案 5、探针台自动清洁装置	车电子行业通用项目验收标准和规范。 1、分析并设计实验验证背银、背金晶圆高压测试不稳定的原因和失效模式； 2、设计稳压装置来保持电极电压的稳定，解决 prober chuck 电源会影响测试的问题。 1、参与分析高速高分辨率电流型数模转换器测试的核心难点并提供相应的解决方案； 2、负责高速高分辨率电流型数模转换器软件测试方案的设计，开发和调试。 1、根据新型的外观检测承载平台方案设计模具并进行仿真模拟； 2、制定新型模具验证流程和验收标准。 1、进行 WIFI6 无线测试的可行性分析和具体测试实现方案的构思，形成项目规划； 2、根据项目规划选定标的产品规范，设计测试硬件并进行测试程序的开发和设计。 1、系统分析芯片失效模式及原因； 2、基于失效芯片的数据，分析灰尘对芯片测试结果的影响； 3、参与设计、研发探针台自动清洁装置。
9	晏云飞	专利发明人	本科学历，电子信息与工程专业。2013年-2017年3月任职于京隆科技（苏州）有限公司，历任测试部门组长，代理课长；2017年3月至2018年5月任公司研发中心工程师。	1、测试机多方位使用兼容装置 2、高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案 3、探针台自动清洁装置	1、根据方位运动控制机制和测试机需求规格设计新型测试机的空间运动机构，进行建模并设计整体构建图； 2、对新型测试机的空间运动机构进行模拟设计，并设计机构的生产制作图纸。 1、分析高速数字通信芯片行业规范已经制定的技术规范，进行测试的可行性分析和具体测试实现方案的设计，形成项目规划； 2、根据项目规划选定标的产品规范设计测试硬件，并进行测试程序的开发和设计。 1、数据收集和分析，形成结案报告供项目研讨。
10	陈迎	专利发明人	本科学历。2007年-2016年历任日月光封装测试（上海）有限公	1、测试机多方位使用兼容装置	1、进行新型测试机的空间运动机构的制作和安装，并评估其实际

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
	涛		司测试一厂生产组长，生产主任；2016年5月至今历任上海伟测生产经理，南京伟测厂长。		效果是否符合预期； 2、测试机多方位使用兼容装置项目的验收。
				2、探针台自动清洁装置	1、评估喷吹管，脉冲电磁阀，气包，控制仪，出气嘴的选型和功能；
				3、芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术	1、进行熔丝烧调工艺精密控制的实验验证技术的开发，制定评价标准； 2、执行熔丝烧调工艺精密控制的实验验证，对稳定性及一致性进行分析。
				4、高性能汽车电子芯片测试解决方案	1、根据测试方案，进行测试硬件原理图、布线图的制作以及各种治具的设计； 2、执行各类硬件的制作，并制定和执行相应的硬件验收及标准。
11	周俊	专利发明人	本科学历，机械设计及其自动化专业。2008年-2017年5月任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任设备工程师，测试设备专案工程师，主任工程师；2017年7月至今历任公司上海伟测厂长、无锡伟测总经理。	1、测试机多方位使用兼容装置	1、分析现有测试机的空间运动机构，整理当前测试机无法实现全方位探测的原因，并提出具体控制模式； 2、提供需要增加的测试机方位运动控制机制并提供测试机需求规格。
				2、探针台自动清洁装置	1、设计自动清洁装置的机械图纸； 2、设计实验收集性能参数。
12	史小奇	专利发明人	专科学历，机电一体化专业。2007年-2017年任上海纪元微科电子有限公司测试工程师；2017年-2020年任上海伟测研发中心资深工程师；2020年至今历任无锡伟测研发中心经理、研发中心副总监。	1、晶圆测试过程中针痕精密管控工艺技术	1、针对集成电路针测过程容易扎偏的情况提出研发针痕管控的工艺技术思路； 2、设计防偏结构以及图纸。
				2、高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案	1、追踪高速数字通信芯片技术规范，和设计公司进行相关数据收集，整理高速数字通信芯片通用测试规范以及相应的测试规格书； 2、根据行业标准和高速数字通信芯片通用测试规范制定项目验收标准。
13	张洪亮	专利发明人	本科学历，电子信息工程专业。2009年-2011年任福州福顺半导体有限公司测试工程师；2011年-2015年任日月光封装测试（上海）有限公司测试设备工程师；2016年-2017年任歌尔股份有限公司测试部项目经理；2017年-2018年任公司研发中心工程师。	1、晶圆测试过程中针痕精密管控工艺技术	1、实验数据收集，及进行部分元器件焊接。
				2、高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案	1、根据制定好的高速数字通信芯片测试规范，制定产品测试量产的规范，并设计量产的流程和相应的管控机制； 2、执行高速数字通信芯片工程验证和工程验收，并进行测试稳定性的评估。

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
14	俞磊	专利发明人	本科学历，自动化专业。2011年-2016年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任品质工程师、专案工程师；2016年9月-2020年任公司研发中心工程师；2020年至今，任无锡伟测研发中心经理。	1、晶圆测试中对位辅助调整装置	1、根据设计图纸进行新型模具的制作并根据验证流程进行验证； 2、根据验收标准，执行新型模具的验收，评估实际效果。
				2、晶圆外观检测平台的改造装置	1、根据外观检测承载平台设计图纸进行新型模具的制作，并根据验证流程进行验证； 2、根据验收标准，执行外观检测承载平台模具的验收，并评估实际效果。
				3、WIFI6无线网络通讯芯片测试解决方案	1、根据测试硬件设计图纸，进行测试硬件的制作并制定测试硬件的验收规范； 2、执行测试硬件的验收并评估硬件性能的评估。
				4、晶圆测试过程中针痕精密管控工艺技术	1、设计测试管控工艺监控报警机制； 2、负责载板、导向套管、触杆和触控开关的选型。
				5、高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案	1、根据测试硬件设计图纸，对高速数字通信芯片进行测试硬件的制作并制定测试硬件的验收规范； 2、执行高速数字通信芯片测试硬件的验收并评估硬件性能的评估。
15	崔勇彬	专利发明人	本科学历。2016年至今历任公司生产组长、生产主任、生产经理。	1、解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	1、设计试验对当只有一个测试电极电压触点且离电压触点远时测试电压逐渐衰减情况的验证。
				2、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案	1、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆 DOE 测试的验证设计和操作； 2、测试流程设计和良率管控规则的制定。
				3、自动降温装置	1、分析降温装置的降温媒介以及在 prober 上使用的便捷性； 2、设计降温装置的机械图纸。
				4、延长墨管使用寿命的装置	1、分析油墨干涩的原因； 2、设计新的油墨打点器，增强油墨的流动性从而使提高油墨利用率。
16	关姜维	专利发明人	本科学历，电子信息科学与技术专业。2010年-2016年历任日月光封装测试（上海）有限公司工程师，工程主管；2016年6月至今任公司研发中心经理、总监。	1、高清图像传感器芯片晶圆主流测试方案的分析并提出通用化的设计方案； 2、设计通用性高、可程序控制、可执行校准的通用性光源解决方案； 3、设计通用性高模块化的程序架	

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
					构方案。
				2、晶圆测试中对位辅助调整装置	1、根据新型模具的设计方案产生模具设计图纸并进行仿真模拟； 2、设计和制定新型模具验证流程和验收标准。
				3、晶圆外观检测平台的改造装置	1、分析现有晶圆外观检测平台机构并分析现有平台的承载平台的运动和控制机制的优缺点； 2、提出新型的一种真空吸附检测台的外观检测平台承载平台的运动和控制机制并分析可行性和风险管控机制。
				4、WIFI6 无线网络通讯芯片测试解决方案	1、根据制定好的测试规范制定产品测试量产的规范，并设计量产的流程和相应的管控机制； 2、执行工程验证和工程验收的规范，并进行测试稳定性的评估。
				5、自动降温装置	1、设计实验步骤以及方法，评估不同媒介的降温效率；
				6、多平台联动提效技术	1、为提升测试机的使用效率，立项研发多平台联动机构； 2、设计信息采集模块。
17	赵阿勇	专利发明人	专科学历。2016年-2018年8月任公司研发中心工程师。	1、自动降温装置 2、延长墨管使用寿命的装置	1、收集不同媒介的降温时间，汇总实验数据。 1、收集不同规格油墨连续打点不干涩的数据并整理分析实验数据。
18	吉晋阳	专利发明人	本科学历，电子信息工程专业。2009年-2016年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任测试设备主管、主任；2016年6月至今任公司研发中心经理、总监。	1、高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案	1、负责通用高清图像传感器芯片晶圆测试通用探针卡的设计并评估探针卡对光路的影响； 2、负责通用性高模块化的程序架构的程序的开发和调试。
				2、解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	1、负责稳压套环通过电极接线、电性连接于测试电极的方案设计； 2、提供多种连接与测试电极的方案，并安排 DOE 方案验证。
				3、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案	1、参与分析高速高分辨率电流型数模转换器测试的硬件难点并提供相应的解决方案例； 2、负责高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试使用的硬件-屏蔽针卡的设计、制作和性能评估。
19	柴振极	专利发明人	专科学历。2016年7月至今担任研发中心技术员、工程师。	1、解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	1、根据稳压套环通过电极接线、电性连接于测试电极方案和 DOE 方案，进行实验硬件的制作并进行设备的安装。

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
20	李峰	专利发明人	本科学历，电力系统及其自动化专业。2005年-2007年1月，在日月光封装测试（上海）有限公司担任厂务经理；2007年-2016年任上海峰越机电设备安装有限公司经理；2016年至今，任公司厂务。	1、高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案	1、执行通用性光源和模块化的程序采集实验数据，并进行稳定性和准确性分析； 2、培训研发中心工程师光模块使用方法。
21	吴庆	专利发明人	本科学历，电子工程专业。2007年-2015年任职于晟碟半导体有限公司，历任设备组长，测试设备工程师；2015年-2017年任职于丽恒光微半导体，历任设备工程师，设备经理；2017年6月至今任公司研发中心经理。	1、测试机配置匹配提效技术	1、测试机配置匹配代码撰写和调试。
				2、芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术	1、根据熔丝烧调工艺精密控制的实现方案提出具体的实施方式，并进行相应的外围电路设计； 2、对外围电路的设计进行制作，并对硬件进行相应的验收。
				3、高性能汽车电子芯片测试解决方案	1、根据标的产品的测试方案和硬件设计，执行具体测试项目的开发和调试，并执行相应的产品特性分析； 2、制定相应的测试项目开发的验收标准，并按照标准进行数据分析处理。
22	杨栓	专利发明人	本科学历。2013年-2014年上海樊境智能科技责任有限公司任销售经理；2014年-2019年任上海旻艾半导体有限公司测试工程师；2019年12月至今任公司研发中心工程师。	1、多平台联动提效技术	1、设计技术图纸并制作样品； 2、分析待测晶圆的移动路径，模拟测试过程对移动次数进行计算。
				2、芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术	1、分析传统熔丝烧调工艺技术的实现方式，分析测试良率、稳定性以及研究传统技术是否可以满足未来的严格测试要求，如汽车电子和工业电子的严苛需求； 2、提出新型电子运用如汽车电子和工业电子对测试中熔丝烧调工艺的需求，并设计熔丝烧调工艺精密控制的实现方案及验收标准。
				3、高性能汽车电子芯片测试解决方案	1、分析汽车电子产品的通用特点，根据汽车电子产品的测试开发特性选取和整理测试要求及测试规范； 2、根据标的产品的测试规范，制定相应的测试方案和根据产品制定相应的验收标准。
23	张丽霞	专利发明人	本科学历。2018年3月至今任公司研发中心工程师。	1、芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术	1、执行熔丝烧调工艺精密控制工艺化验证和DOE方案的设计； 2、执行熔丝烧调工艺精密控制技术的项目验收和工艺稳定分析。
				2、高性能汽车电子芯片测试解决方案	1、执行标的产品验证和数据分析确实测试的稳定性和数据的一致

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
					性； 2、设计 DOE 方案的设计和执行业并进行风险的评估。
24	刘栋栋	专利发明人	本科学历，电子信息工程专业，2013 年-2018 年年任矽品科技（苏州）有限公司测试产品工程师；2018 年-2021 年 3 月任公司研发中心工程师；2021 年 3 月至今任无锡伟测研发中心经理。	1、多平台联动提效技术	1、设计控制系统包括信号配置单元、路径规划单元等； 2、进行多平台联动通讯驱动开发和 GPIB 信号调试。
25	袁常乐	专利发明人	本科学历，物理系电子信息科学与技术专业。2019 年至今任公司研发中心工程师。	1、5G 通信射频前端晶圆测试解决方案	1、执行测试硬件的设计、测试软件的开发和调试； 2、对测试结果和实验室测试结果进行一致性分析并优化测试算法。
26	王敏	专利发明人	本科学历，功能材料专业。2017 年-2019 年任日月光封装测试有限公司工程部产品测试工程师；2019 年 7 月至 2021 年 7 月任公司研发中心工程师。	1、5G 通信射频前端晶圆测试解决方案	1、设计验收规则和数据分析规则； 2、设计 DOE 验证的实验以及执行 DOE 的实验验证工作。
27	高大合	专利发明人	专科学历，电工电子专业。2002 年-2004 年任职于飞利浦光磁电子（上海）有限公司，任生产领班；2007 年-2015 年任职于日月光封装测试有限公司，历任储备组长，组长 生产管理师，主任；2015 年 2 月-2015 年 9 月任职于环维电子（上海）有限公司，任组长；2015 年 9 月-2016 年 11 月任职于环旭电子股份有限公司，历任组长，课长；2016 年 12 月至今任公司生产经理。	1、晶圆测试良率分析和优选管控技术	1、进行自动优选方案验证和数据分析结果分析，并提供优化需求； 2、对自动优选方案进行验收和接收。
				2、基于 TCG 架构的先进网络安全芯片晶圆测试解决方案	1、进行网络安全芯片晶圆测试方案的实际测试稳定性分析，并和测试结果进行一致性分析； 2、进行网络安全芯片晶圆测试方案测试效率分析。
28	赵坤鹏	专利发明人	本科学历，机电一体化工程专业。2011 年-2019 年任日月光封装测试封装（上海）有限公司设备工程师；2019 年-2020 年任无锡华润微电子测试厂设备主管；2020 年 4 月至今担任无锡伟测研发中心经理。	1、测试方案开发的系统验证板	1、参与系统验证板的需求分析； 2、参与系统验证板原理图设计以及 PCB layout 出图； 3、制定参数验收标准。
				2、延长墨管使用寿命的装置	1、核对实验数据并提交报告给项目组审核；
				3、低温测试工艺结霜控制技术	1、低温测试过程中测试硬件上产生冷凝结霜原因分析； 2、参与研发项目可行性分析以及方案制定。
				4、32 位微控制单元芯片晶圆测试解决方案	1、对通用型硬件重新设计和优化； 2、电路板原理图设计以及 PCB layout 出图； 3、自动开发软件代码的撰写并完善测试标准库。
				5、修调卡及线缆快速验	1、线缆异常信息分类分析；



序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
				证装置	2、设计快速验证装置图纸并协调生产制作。
29	杨征	专利发明人	专科学历，机械制造与自动化专业。2010年-2020年任日月光封装测试（昆山）有限公司设备主管；2020年9月-2021年5月任无锡伟测研发中心经理。	1、测试方案开发的系统验证板	1、系统验证板样品生产进度协调； 2、收集实验数据以及提交报告给项目组审核。
				2、低温测试工艺结霜控制技术	1、追踪方案验证实施结果以及实验数据收集； 2、对应用技术后的测试结果进行验证； 3、分析效率提升部分数据并提交报告。
				3、32位微控制单元芯片晶圆测试解决方案	1、参与研发中心测试程序的自动化生成方法的设计； 2、电路板验收以及提交报告。
				4、修调卡及线缆快速验证装置	1、参与验证装置的异常信息分类归纳； 2、参与验收装置数据以及提交报告。

截至本补充法律意见书出具之日，上述核心技术人员与专利发明人中，晏云飞、赵阿勇、张洪亮、王敏、杨征等5人已离职，其余人员均尚在公司任职。

2、结合行业研发周期、客户认证周期、测试方案开发和验证周期，说明主营业务发展和核心技术形成的关键历史节点，技术来源是否为自主研发，是否合法合规

#### （1）行业研发周期

经本所律师核查，行业缺乏研发周期的相关统计数据，同行业上市公司和公开渠道亦未披露相关数据。报告期内发行人各类测试核心技术的研发周期一般在5-18个月之间。

#### （2）客户认证周期和测试方案开发和验证周期的一般情况

在客户认证周期方面，公司成为客户的合格供应商的认证过程一般包括双方初步接洽、签署保密协议、客户来厂参观及验厂、公司通过合格供应商认证等几个环节，整个认证周期一般在30天至90天之间。发行人针对某特定产品进行测试方案开发和验证的周期一般为1-3个月左右。

#### （3）公司主营业务发展过程

公司自设立以来，一直专注于经营集成电路测试服务业务。公司成立以来，主营业务的发展情况如下：

**A. 2016年-2017年公司处于创业摸索和积累阶段，主要提供晶圆测试服务**

公司成立之初，选择了技术含量高、市场竞争格局好的“晶圆测试”业务，在工厂选址上，选择毗邻中国最大的集成电路产业集群上海张江。在业务方面，公司得到了以晶丰明源、艾为电子等为代表的模拟类客户的认可，并开始逐步导入中高端测试平台及客户，拓展数字类的客户和测试服务。

**B. 2018年-2019年公司进入快速成长阶段，并开始介入芯片成品测试业务**

在该期间，公司不断完善整套测试作业体系，加强测试技术和测试工艺的研发投入，大力引进中高端测试平台，不断提升公司的高端测试服务能力。2019年末，鉴于公司在晶圆测试积累的客户基础以及行业口碑，公司又适时开拓芯片成品测试业务，为公司的发展创造了新的增长点。

**C. 2020年至今，公司开始确立行业领先地位，确定了以“以晶圆测试为核心，积极发展中高端芯片成品测试”的差异化竞争策略**

“高端化、顶尖客户、全力扩产”是这一阶段的公司发展策略，公司抓住“美国打压中国半导体行业，中国大陆的一线芯片设计公司加快测试服务供应商的国产化替代”的历史契机，一方面加大研发投入，重点突破7nm-14nm先进制程芯片、5G射频芯片、高性能CPU芯片、高性能计算芯片、FPGA芯片、复杂SoC芯片等各类高端芯片的测试工艺难点，另一方面快速扩充高端测试产能，使得公司具备承接中国大陆高端芯片设计公司测试订单的技术实力和产能规模。2020年，公司在另一重要的集成电路产业集群江苏省无锡市设立子公司，优化了产业布局。

**(4) 公司核心技术形成的关键历史节点**

截至本补充法律意见书出具之日，公司拥有的核心技术形成的关键历史节点情况如下：

序号	核心技术大	技术形成的关键历史节点
----	-------	-------------

	类	时间节点	形成的核心技术	应用范围		
1	测试方案开发技术	2016年-2017年	高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案	数模转换芯片		
			高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案	图像传感芯片		
		2018年-2019年	高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案	数据通信芯片		
			WIFI6无线网络通讯芯片测试解决方案	无线网络芯片		
			第3代快闪存储器IP的晶圆测试方案	存储器芯片		
			基于TCG架构的先进网络安全芯片晶圆测试解决方案	安全芯片		
			现场可编程逻辑门阵列芯片测试解决方案	FPGA芯片		
		2020年以后	5G通信射频前端晶圆测试解决方案	5G射频前端芯片		
			基于ARM架构的高性能处理器的测试解决方案	处理器芯片		
			高性能汽车电子芯片测试解决方案	汽车芯片		
			高性能区块链算力芯片晶圆测试方案	AI、区块链芯片		
			32位微控制单元芯片晶圆测试解决方案	微控制器芯片		
		2	测试工艺难点突破与精益测试提效技术	2016年-2017年	晶圆测试过程中针痕精密管控工艺技术	晶圆测试
				2018年-2019年	测试机配置匹配提效技术	晶圆测试、芯片成品测试
					晶圆测试中烧写写入工艺防呆管控技术	晶圆测试
低温测试工艺结霜控制技术	晶圆测试、芯片成品测试					
2020年以后	芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术			芯片成品测试		
	晶圆测试良率分析和优选管控技术			晶圆测试		
	薄片晶圆测试技术			晶圆测试		
	多平台联动提效技术			晶圆测试		
3	设备改造升级技术	2016年-2017年	测试机多方位使用兼容装置	晶圆测试、芯片成品测试		
			解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	晶圆测试		
			晶圆测试机抗干扰外壳装置	晶圆测试		
		2018年-2019年	探针台自动清洁装置	晶圆测试		
			晶圆外观检测平台的改造装置	晶圆测试		
		2020年以后	晶圆测试机抗干扰外壳装置	晶圆测试		
4	测试治具设计技术	2016年-2017年	延长墨管使用寿命的装置	晶圆测试		
			晶圆测试中对位辅助调整装置	晶圆测试		
		2018年-2019年	自动降温装置	晶圆测试		
			测试方案开发的系统验证板	晶圆测试、芯片成品测试		

序号	核心技术大类	技术形成的关键历史节点		
		时间节点	形成的核心技术	应用范围
5	自动化测试及数据分析技术			试
		2020年以后	修调卡及线缆快速验证装置	晶圆测试、芯片成品测试
			可选择性导片装置	晶圆测试
		2018年-2019年	数据挖掘与多维度分析系统	数据分析系统
			测试参数大数据多维度统计分析系统	数据分析系统
生产稼动率统计分析和管控系统	数据分析系统			
2020年以后	数据挖掘与多维度分析系统	数据分析系统		
		Mapping 分析系统	数据分析系统	

### （5）技术来源及其合法合规性

公司是由骈文胜、闻国涛等几位在集成电路封测行业具有丰富从业经验的资深人士于2016年创立。公司设立时就对标国内一流和国际领先的测试企业，通过自主研发，不断攻克测试技术难点，提升服务水平和服务能力，立志通过技术驱动打造一家具有核心竞争力的独立第三方专业测试服务商。创立以来，公司高度重视技术研发，不断加大研发投入，通过自主研发和技术积累逐步形成了公司在测试方案开发、设备改造升级技术、测试治具设计、测试自动化和智能化等方面的核心技术。发行人主要技术均来源于自主研发，且拥有自主知识产权，不存在合作开发、委托开发的情形。截至2021年12月31日，公司已经取得24项专利，其中有6项发明专利。公司核心技术的来源合法合规，均为自主研发，不存在来源于其他任何无关第三方。发行人现有专利、核心技术等无形资产不存在侵犯知识产权、商业秘密的情形，亦不存在权属纠纷或潜在纠纷。

三、结合核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）的任职经历，说明该等人员是否存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，是否存在纠纷或潜在纠纷。

核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）的任职经历详见本补充法律意见书“问题2./二/1、发行人核心技术人员和专利发明人（包括已离职人员）的从业经历及其在技术形成过程中发挥的作用”。

### 1、核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）是否存在违反原任职单位关于竞业禁止的情形

根据公司核心技术人员、专利发明人提供的劳动合同、与原任职单位有交易的银行卡流水、原任职单位出具的说明等资料并经本所律师访谈核心技术人员和专利发明人，公司核心技术人员和专利发明人与原任职单位是否签订竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同以及是否获得竞业禁止补偿金等情况如下表所示：

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同	是否收到竞业禁止补偿金	是否违反竞业禁止约定	备注
1	骈文胜	核心技术人员、专利发明人	否	否	否	1、未签订竞业禁止协议，离职后未收到过竞业禁止补偿金； 2、原单位直属领导接受访谈，证明其不存在违反竞业禁止方面的纠纷、诉讼或仲裁； 3、原单位长电科技与公司一直保持良好的合作关系，且2018年和2019年长电科技均为公司的第一大客户；
2	闻国涛	核心技术人员、专利发明人	否	否	否	未签订竞业禁止协议且原任职单位出具其不负竞业禁止义务的说明
3	路峰	核心技术人员、专利发明人	是	否	否	1、离职后未收到过竞业禁止补偿金； 2、原单位直属领导接受了访谈，证明其不存在违反竞业禁止方面的纠纷、诉讼或仲裁；

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同	是否收到竞业禁止补偿金	是否违反竞业禁止约定	备注
						3、原单位晟碟半导体从事存储器业务，与公司的业务不存在直接竞争关系；
4	刘琨	核心技术人员	否	否	否	未签订竞业禁止协议且原任职单位出具其不负竞业禁止义务的说明
5	左上勇	专利发明人	否	否	否	
6	杨恭乾	专利发明人	是	否	否	1、离职后未收到过竞业禁止补偿金； 2、原单位菲尼萨从事光通信业务，与公司的业务不存在直接竞争关系
7	傅郁晓	专利发明人	否	否	否	
8	张伟军	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	不适用	
9	晏云飞	专利发明人	否	否	否	
10	陈迎涛	专利发明人	否	否	否	
11	周俊	专利发明人	否	否	否	
12	史小奇	专利发明人	否	否	否	
13	张洪亮	专利发明人	否	否	否	
14	俞磊	专利发明人	否	否	否	
15	崔勇彬	专利发明人	否，入职前为自由职业	不适用	不适用	
16	关姜维	专利发明人	否	否	否	
17	赵阿勇	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	不适用	
18	吉晋阳	专利发明人	否	否	否	
19	柴振极	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	不适用	
20	李峰	专利发明人	否	否	不适用	原任职单位系其本人设立的公司
21	吴庆	专利发明人	否	否	否	
22	杨栓	专利发明人	否	否	否	

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同	是否收到竞业禁止补偿金	是否违反竞业禁止约定	备注
23	张丽霞	专利发明人	否，入职前为自由职业	不适用	不适用	
24	刘栋栋	专利发明人	否	否	否	
25	袁常乐	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	不适用	
26	王敏	专利发明人	否	否	否	
27	高大会	专利发明人	否	否	否	
28	赵坤鹏	专利发明人	否	否	否	
29	杨征	专利发明人	否	否	否	

如上表所示，公司核心技术人员和专利发明人中仅路峰、杨恭乾 2 人与原任职单位签订过含竞业禁止条款的劳动合同，由于其未收到过竞业禁止补偿金，因此不负竞业禁止的义务。其余人员因未签署过竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同，并且未收到过竞业禁止补偿金，因此亦不负竞业禁止的义务。

## 2、核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）是否存在违反原任职单位关于保密协议约定的情形

根据公司核心技术人员、专利发明人提供的劳动合同、保密协议等资料并经本所律师访谈核心技术人员和专利发明人，公司核心技术人员、专利发明人与原任职单位是否签订保密协议或含保密条款的劳动合同以及是否违反保密约定等情况如下表所示：

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订保密协议或含保密条款的劳动合同	是否违反保密约定	备注
1	骈文胜	核心技术人员、专利发明人	是	否	原单位直属领导接受访谈，证明其不存在违反保密约定方面的纠纷、诉讼或仲裁
2	闻国涛	核心技术人员、专利发明人	是	否	原任职单位出具其未违反保密义务的说明
3	路峰	核心技术人员、专利发明人	是	否	原任职单位直属领导接受访谈，证明其不存在违反保密约定方面的纠纷、诉讼或仲裁
4	刘琨	核心技术人员	是	否	原任职单位出具其未违反保密义务的说明

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订保密协议或含保密条款的劳动合同	是否违反保密约定	备注
5	左上勇	专利发明人	是	否	
6	杨恭乾	专利发明人	是	否	
7	傅郁晓	专利发明人	是	否	
8	张伟军	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	
9	晏云飞	专利发明人	是	否	
10	陈迎涛	专利发明人	是	否	
11	周俊	专利发明人	是	否	
12	史小奇	专利发明人	是	否	
13	张洪亮	专利发明人	是	否	
14	俞磊	专利发明人	是	否	
15	崔勇彬	专利发明人	否，入职前为自由职业	不适用	
16	关姜维	专利发明人	是	否	
17	赵阿勇	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	
18	吉晋阳	专利发明人	是	否	
19	柴振极	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	
20	李峰	专利发明人	否	不适用	原任职单位系其本人设立的公司
21	吴庆	专利发明人	是	否	
22	杨栓	专利发明人	是	否	
23	张丽霞	专利发明人	否，入职前为自由职业	不适用	
24	刘栋栋	专利发明人	是	否	
25	袁常乐	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	
26	王敏	专利发明人	是	否	
27	高大会	专利发明人	是	否	
28	赵坤鹏	专利发明人	是	否	
29	杨征	专利发明人	是	否	

如上表所示，公司核心技术人员、专利发明人中有 22 人与原任职单位签订了保密协议或包含保密条款的劳动合同。经本所律师访谈上述人员并对其进行网络核查，上述人员未违反保密约定且与原任职单位不存在诉讼、仲裁或其他纠纷。

### 3、核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）与原单位是否存在纠纷



## 或潜在纠纷

根据公司核心技术人员、专利发明人提供的相关资料并经本所律师访谈、网络核查，公司核心技术人员和专利发明人与原任职单位不存在任何与竞业禁止义务、保密义务或知识产权相关的诉讼或仲裁，公司核心技术人员、专利发明人与原任职单位不存在纠纷或潜在纠纷。

## 四、核查过程

1、查阅发行人拥有的专利证书，并获取国家知识产权局出具的专利批量法律状态证明；

2、查阅发行人出具的6项发明专利在主营业务中具体应用情况的说明；

3、查阅核心技术人员、专利发明人与原任职单位的劳动合同或同时期劳动合同模板、保密协议（如有）、竞业禁止协议（如有）；

4、访谈骈文胜、路峰原任职单位的直属领导，查阅闻国涛、刘琨原任职单位出具的说明；

5、查阅发行人出具的说明，了解核心技术人员、其他专利发明人的从业经历、参与的专利发明情况、核心技术形成过程中发挥的作用以及核心技术形成的历史节点等；

6、访谈核心技术人员与专利发明人，了解其与原任职单位关于是否签订竞业禁止或竞业限制、保密义务相关协议以及是否收到原任职单位的竞业禁止补偿金等情况；

7、取得并查阅核心技术人员、在职的其他专利发明人与原任职单位有交易的银行卡流水；

8、通过中国裁判文书网、中国执行信息公开网等公开网站对发行人专利、核心技术人员及专利发明人是否存在纠纷的情况进行网络核查。

## 五、核查意见

经核查，本所律师认为：

1、公司6项发明专利均为公司自主研发，专利发明人均为公司员工，该6项发明专利均运用于发行人主营业务；

2、公司核心技术来源均为公司自主研发，合法合规；

3、公司核心技术人员、专利发明人（已离职人员）不存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，不存在纠纷或潜在纠纷。

## 问题 5.关于销售和客户

5.1 根据招股说明书，公司按产品的测试工时向客户收取测试费用，获得测试收入。

请发行人说明：

（1）与封测一体化厂商相比，发行人获取客户的方式及获客优势，获取的测试服务订单的特点、测试的内容差异等情况；

（2）测试服务的定价机制及与同行业可比公司定价是否存在差异；

（3）报告期内芯片成品测试、晶圆测试平均销售与市场价格、同行业可比公司是否存在显著差异及合理性；

（4）结合获取客户方式、客户认证周期等，分析发行人成立时间较短即具有国内外知名厂商客户的合理性，是否符合行业惯例。

请发行人律师对问题（4）进行核查并发表明确意见。

回复：

### 一、发行人获取客户的方式

发行人为独立第三方测试企业，只经营集成电路测试一种业务，获客方式包括三种类型：①销售团队上门拜访，即公司的销售团队通过主动上门拜访等方式开发各类新客户；②客户上门联系，最近两年集成电路行业产能紧张，客户主动上门寻求与公司开展业务合作的情形也较为普遍；③客户引荐，基于公司测试技术和品质服务的良好口碑，老客户主动为公司引荐新客户也是公司十分重要的获客方式。

### 二、发行人主要客户的认证周期

发行人成为知名客户的合格供应商的认证过程一般包括双方初步接洽、签

署保密协议、客户来厂参观及验厂、公司通过合格供应商认证等几个环节，不同客户的完整认证周期一般在 30 天至 90 天不等。

### 三、发行人成立时间较短即具有国内外知名厂商客户的合理性

公司成立于 2016 年 5 月，通过 5 年多时间的积累，截至 2021 年 6 月 30 日，公司客户数量超过 170 家，客户涵盖芯片设计、制造、封装、IDM 等类型的企业，其中不乏紫光展锐、中兴微电子、晶晨股份、安路科技、比特大陆、兆易创新、卓胜微、普冉股份、长电科技、中颖电子、复旦微电、北京君正等国内外知名厂商。公司成立时间较短即具有较多的国内外知名厂商客户，主要原因有以下三个方面：

#### 1、公司的获客方式及客户认证周期方面的原因

在获客方式方面，通过主动登门拜访开展营销是公司主要的获客方式之一。对于行业知名客户，为了保障客户开发的成功率，公司董事长骈文胜先生会亲自挂帅，全程领导客户开发工作。由于公司高层对知名客户开发工作的重视，加上公司自身良好的技术实力、服务品质及行业口碑，公司在知名客户的开发方面取得了良好的效果。

在客户认证周期方面，公司成为知名客户的合格供应商的认证周期一般在 30 天至 90 天。由于客户认证周期较短，有利于公司在较短时间内成为知名客户的合格供应商。

#### 2、自身竞争优势和竞争策略方面的原因

在竞争优势方面，公司的核心团队成员深耕集成电路行业二十余年，是国内最早从事集成电路测试的一批资深人士，曾参与建立了中国大陆最早的晶圆测试工厂之一的威宇科技测试封装（上海）有限公司。团队主要成员曾先后在摩托罗拉、日月光、长电科技等全球知名半导体企业或封测龙头企业从事测试业务技术研发和管理工作，拥有深厚的专业背景，对测试技术研发、测试方案开发、量产导入、精益生产、测试产线自动化管理有着丰富的实践经验。公司成立之后，一直注重构建保持公司长期发展的各项竞争优势，具体包括技术团队的专业水平、公司的技术实力、测试服务的品质及效率、测试作业的自动化和智能化水平等内容，公司在这些方面处于国内领先地位，从而获得了国内外

知名客户的认可。

在竞争策略方面，公司在发展过程中一直坚持“以晶圆测试为核心，积极发展中高端芯片成品测试”的差异化竞争策略。由于历史和产业分工的原因，公司设立时，在晶圆测试领域，中国大陆还没有出现一家规模和技术实力都较强的内资测试企业，在中高端芯片成品测试领域，整个行业的产能也较为紧张，中国大陆的芯片设计公司只能将晶圆和中高端芯片成品大量送往中国台湾地区或海外地区开展测试。公司的差异化竞争策略和扩产方向瞄准了细分行业相对空白的领域，有效满足了中国大陆知名客户在晶圆测试和中高端芯片成品测试的需求，加速了公司开发高端知名客户的进程。

### 3、行业的历史性机遇方面的原因

中兴、华为禁令事件发生以前，中国大陆知名芯片设计公司的高端测试订单主要由中国台湾地区的厂商和海外厂商来完成，中兴、华为禁令事件发生之后，为了保障测试服务供应的自主可控，中国大陆的芯片设计公司开始大力扶持内资的测试服务供应商。公司积极把握行业发展历史机遇，一方面快速扩充高端测试产能，另一方面加大研发投入，重点突破各类高端芯片的测试工艺难点，使得公司能够较快成为中国大陆各大知名芯片设计公司高端芯片测试的国产化替代的重要供应商之一。

综上所述，公司成立时间较短即具有较多的国内外知名厂商客户，主要得益于公司高层对于客户开发的重视、客户认证周期较短、公司自身的竞争优势和差异化的竞争策略、行业的发展机遇等有利因素，具有合理性。

### 四、发行人成立时间较短即具有国内外知名厂商客户是否符合行业惯例

根据近期国内集成电路行业已上市或拟上市公司公开披露的相关资料，近几年集成电路行业发展迅速，其中包括普冉半导体（上海）股份有限公司（于2016年成立）、恒玄科技（上海）股份有限公司（于2015年成立）、中科寒武纪科技股份有限公司（于2016年成立）等行业内知名公司均存在成立时间较短即具有国内外知名厂商客户的情形。

综上所述，发行人成立时间较短即具有国内外知名厂商客户符合集成电路行业发展惯例。

## 五、核查过程

1、访谈发行人董事长、销售总监，了解发行人的获取客户方式、客户认证周期、业务优势、行业竞争格局等情况；

2、访谈发行人的部分知名客户，了解客户选择供应商的方式、认证周期以及选择发行人作为供应商的原因等问题；

3、查阅发行人所获荣誉情况；

4、查阅近期国内集成电路行业公司公开披露的相关资料。

## 六、核查意见

经核查，本所律师认为：

发行人成立时间较短即具有国内外知名厂商客户具有合理性，符合集成电路行业发展惯例。

## 问题 16.关于股东

**16.1** 根据招股说明书，发行人控股股东为蕊测半导体科技有限责任公司。公司创立初期，蕊测半导体是骈文胜、闻国涛、路峰、邵颖、沈爽恒、李峰 6 名创始人的持股平台。伟测有限设立时，出于便利手续办理的考虑，李峰代蕊测半导体持有伟测有限的全部股权，后代持解除。目前蕊测半导体的股东有骈文胜、闻国涛、路峰、邵颖、李峰和深圳市智汇科创科技有限公司。

请发行人说明：

蕊测半导体的历史沿革和股本演变情况，股权是否清晰，是否存在纠纷或潜在纠纷。

请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查并发表意见。

回复：

### 一、蕊测半导体的历史沿革和股本演变情况

1、2015 年 12 月，蕊测半导体成立

骈文胜、闻国涛、路峰、邵颖、沈爽恒、李峰 6 名创始人（以下简称“创

始团队”）在启动创业的初期各方达成如下口头约定：设立伟测科技作为具体业务的经营实体，以蕊测半导体作为创始团队的持股平台，蕊测半导体直接控股伟测科技。为了操作上的便利性，创始团队一致同意由李峰以个人名义先行完成两家公司的工商注册和前期筹备工作，后续再通过股权转让的方式将两家公司的股权架构调整成真实状态。

上海蕊测半导体科技有限公司于 2015 年 12 月 29 日由李峰和宋寅清设立，注册资本为 2,000 万元。同日，上海市浦东新区市场监督管理局核发了《营业执照》。

蕊测半导体设立时的股权结构如下所示：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	李峰	1,200	60
2	宋寅清	800	40
合计		2,000	100

此次设立蕊测半导体系李峰按照创始团队的约定，先行完成持股平台的工商注册。为了操作便利，李峰委托一家负责园区招商的公司协助办理工商注册相关事宜，因一人有限责任公司存在诸多限制，也将该园区招商公司的员工宋寅清其登记为股东。

## 2、蕊测半导体的股权变动

### （1）2016 年 2 月，蕊测半导体第一次股权转让

2016 年 2 月 18 日，宋寅清与赵影签署《股权转让协议》，协议约定宋寅清将其所持有的蕊测半导体 40% 的股权（对应认缴出资额 800 万元，实缴出资为 0 元）转让给赵影。上述股权转让主要因为宋寅清离职，因此园区招商公司安排另一名工作人员赵影持有股权。同日，蕊测半导体股东会作出相关决议。

2016 年 2 月 24 日，上海市浦东新区市场监督管理局准予了蕊测半导体的变更登记申请，对蕊测半导体章程进行备案，并核发《营业执照》。

变更后蕊测半导体的股权结构如下所示：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	李峰	1,200	60

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
2	赵影	800	40
合计		2,000	100

（2）2016年4月，蕊测半导体第二次股权转让

2016年4月10日，赵影与闻国涛签订《股权转让协议》，协议约定赵影将其所持有的蕊测半导体40%的股权（对应认缴出资额800万元，实缴出资额0元）作价0万元人民币转让给闻国涛。同日，蕊测半导体股东会作出相关决议。

2016年4月25日，上海市浦东新区市场监督管理局准予了蕊测半导体的变更登记申请，对蕊测半导体章程进行备案，并核发《营业执照》。

变更后蕊测半导体的股权结构如下所示：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	李峰	1,200	60
2	闻国涛	800	40
合计		2,000	100

该次股权转让系蕊测半导体创始团队希望更换持股主体为创始团队成员，所以蕊测半导体股东由园区招商公司工作人员赵影变更为发行人创始团队成员闻国涛。

（3）2017年9月，蕊测半导体第一次增资

2017年9月1日，蕊测半导体作出股东会决议，公司注册资本由2,000万元增至2,396万元，其中股东闻国涛认缴396万元，出资方式为货币。

2017年9月14日，上海市浦东新区市场监督管理局准予了蕊测半导体的变更登记申请，对公司章程进行备案，并核发《营业执照》。

变更后蕊测半导体的股权结构如下所示：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	李峰	1,200	50.08
2	闻国涛	1,196	49.92
合计		2,396	100

闻国涛认缴的396万元为代创始团队持有该部分股权，创始团队成员的实

际出资情况和出资比例以 2017 年 10 月代持还原后的股权状态为准。

（4）2017 年 10 月，蕊测半导体第三次股权转让

2017 年 9 月 18 日，李峰、闻国涛与骈文胜、路峰、邵颖、深圳市智汇科创科技有限公司签署《股权转让协议》，协议约定：李峰将所持有蕊测半导体 46.75% 股权（对应认缴出资 1,120 万元，实缴出资额 0 元）作价 0 万元人民币转让给骈文胜；闻国涛将所持有蕊测半导体 4.80% 股权（对应认缴出资 115 万元，实缴出资额 0 元）作价 0 万元转让给骈文胜；闻国涛将所持有蕊测半导体 9.60% 股权（对应认缴出资 230 万元，实缴出资额 0 元）作价 0 万元转让给路峰；闻国涛将所持有蕊测半导体 5.43% 股权（对应认缴出资 130 万元，实缴出资额 0 元）作价 0 万元转让给邵颖；闻国涛将所持有蕊测半导体 4.17% 股权（对应认缴出资 100 万元，实缴出资额 0 元）作价 0 万元转让给深圳市智汇科创科技有限公司。2017 年 9 月 19 日，蕊测半导体股东会作出相关决议。

2017 年 10 月 16 日，上海市浦东新区市场监督管理局准予了蕊测半导体的变更登记申请，对公司章程进行备案，并核发《营业执照》。

变更后蕊测半导体的股权结构如下所示：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	骈文胜	1,235	51.5442
2	闻国涛	621	25.9182
3	路峰	230	9.5994
4	李峰	80	3.3389
5	邵颖	130	5.4257
6	深圳市智汇科创科技有限公司	100	4.1736
合计		<b>2,396</b>	<b>100</b>

上述股权转让为蕊测半导体的代持解除，李峰与闻国涛将其所持有的股份按照约定的出资比例转让给其他创始团队成员，将股权结构还原成真实的状态。

自上述变更完成后至本补充法律意见书出具之日，蕊测半导体的股权结构未曾改变。

## 二、蕊测半导体股权是否清晰，是否存在纠纷或潜在纠纷



经本所律师核查，蕊测半导体股权的历史沿革中曾存在股权代持的情形，蕊测半导体的股东已经通过股权转让的方式解除了代持行为，股权代持的解除过程和最新的股权结构清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。

### 三、核查过程

- 1、查阅蕊测半导体全套工商档案，梳理蕊测半导体的历史沿革；
- 2、查阅蕊测半导体银行流水，核查历史沿革中股东出资的情况；
- 3、访谈蕊测半导体历史及现有股东，了解股权代持的背景和解除过程；
- 4、查阅蕊测半导体全体现有股东出具的确认函；
- 5、通过中国裁判文书网、中国执行信息公开网等公开网站对蕊测半导体是否存在涉及股权纠纷的情况进行网络核查。

### 四、核查意见

经核查，本所律师认为：

截至本补充法律意见书出具之日，蕊测半导体股权清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。

## 问题 18.关于其他问题

**18.1 根据申报材料，上海承括电子科技有限公司成立于 2014 年 8 月 25 日，主营业务为科技推广和应用服务业，实际控制人配偶秦君梅在该公司持股 70%，并担任执行董事。**

请发行人说明：

承括电子实际从事的具体业务，是否与发行人从事相同或相似业务，是否构成同业竞争。

请发行人律师进行核查，说明核查过程并发表意见。

回复：

一、承括电子实际从事的具体业务、是否与发行人从事相同或相似业务，是否构成同业竞争

根据承括电子的营业执照、工商档案等资料，承括电子的经营范围为：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、电子元器件、模具、机械设备及配件的销售。

根据承括电子提供的银行流水、部分业务合同并经本所律师访谈承括电子执行董事秦君梅，承括电子报告期内仅存在零星的贸易业务（墨水、不锈钢板、金属层架等），目前无具体经营的业务。承括电子不存在与发行人从事相同或相似业务的情形，与发行人不构成同业竞争。

## 二、核查过程

- 1、查阅发行人及承括电子的营业执照、工商档案；
- 2、查阅承括电子报告期内的银行流水、部分业务合同；
- 3、访谈承括电子执行董事秦君梅；
- 4、查阅承括电子出具的《关于主营业务的说明》。

## 三、核查意见

经核查，本所律师认为：

承括电子报告期内仅存在零星的贸易业务（墨水、不锈钢板、金属层架等），目前无具体经营的业务。承括电子不存在与发行人从事相同或相似业务的情形，与发行人不构成同业竞争。

**18.2 招股说明书披露，发行人子公司厦门伟测成立于 2017 年 7 月 5 日，2020 年 12 月 7 日已经注销。厦门伟测自成立之后至注销前均未实际开展过生产经营活动。**

请发行人说明厦门伟测成立又注销的具体原因，未实际开展生产经营活动的原因，注销过程中的资产和债务处置情况，存续期间是否存在重大违法违规行为。

请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查，说明核查过程并发表意见。

回复：

一、厦门伟测成立又注销的具体原因，未实际开展生产经营活动的原因

根据本所律师访谈发行人实际控制人，厦门伟测的设立主要因为公司于 2017 年拟引进厦门当地某国有基金作为股东。在商谈具体投资计划的过程中，该投资人要求公司在厦门当地设立子公司。后续由于公司融资计划改变，最终未引进该国有基金，厦门伟测也一直未实际开展生产经营活动。基于精简机构的需要，公司于 2020 年经内部决策后决定予以注销。

## 二、厦门伟测注销过程中的资产和债务处置情况

厦门伟测在注销之前，公司未向厦门伟测实际出资，厦门伟测未实际开展业务，亦未开立银行账户，未购置资产，无未清理的债权债务。

综上所述，厦门伟测注销前未实际经营，不涉及注销过程中的资产和债务处置情况。

## 三、厦门伟测持续期间是否存在重大违法违规行为

厦门伟测存续期间未实际开展业务，亦未开立银行账户，未购置资产，不存在重大违法违规行为。

## 四、核查过程

- 1、查阅厦门伟测的工商档案；
- 2、访谈发行人实际控制人、董事长骈文胜，了解厦门伟测成立及注销的背景；
- 3、查阅厦门伟测出具的《简易注销全体投资人承诺书》；
- 4、查阅天健会计师出具的《审计报告》；
- 5、通过国家企业信用信息公示系统、信用中国等公开网站对厦门伟测是否存在重大违法违规行为进行网络核查。

## 五、核查意见

经核查，本所律师认为：

- 1、厦门伟测的设立主要因为公司于 2017 年拟引进厦门当地某国有基金作为股东。在商谈具体投资计划的过程中，该投资人要求公司在厦门当地设立子公司。后续由于公司融资计划改变，最终未引进该国有基金，厦门伟测也一直未实际开展生产经营活动。基于精简机构的需要，公司于 2020 年经内部决策后

决定予以注销。

2、厦门伟测在注销之前，发行人未向厦门伟测实际出资，厦门伟测未实际开展业务，亦未开立银行账户，不涉及资产及债务处置的情况。

3、报告期内厦门伟测不存在任何行政处罚的情况，不存在重大违法违规行为。

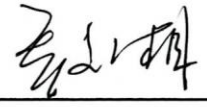
（本页以下无正文）


(本页无正文,系《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书(一)》之签署页)



上海市锦天城律师事务所

负责人:   
顾功耘

经办律师:   
乔文湘

经办律师:   
夏瑜杰

2022年2月28日

地址: 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11/12层, 邮编:200120  
电话: (86) 21-20511000; 传真: (86) 21-20511999  
网址: <http://www.allbrightlaw.com/>

上海市锦天城律师事务所  
关于上海伟测半导体科技股份有限公司  
首次公开发行股票并在科创板上市的

补充法律意见书（二）



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层  
电话：021-20511000                      传真：021-20511999  
邮编：200120

## 目 录

声明事项 .....	2
释 义 .....	4
正 文 .....	6
<b>第一部分 补充核查事项 .....</b>	<b>6</b>
一、 本次发行上市的批准和授权.....	6
二、 发行人本次发行上市的主体资格.....	6
三、 发行人本次发行上市的实质条件.....	6
四、 发行人的设立.....	11
五、 发行人的独立性.....	11
六、 发起人、股东及实际控制人.....	11
七、 发行人的股本及其演变.....	14
八、 发行人的业务.....	14
九、 关联交易及同业竞争.....	17
十、 发行人的主要财产.....	24
十一、 发行人的重大债权债务.....	29
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并.....	37
十三、 发行人公司章程的制定与修改.....	37
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	37
十五、 发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化.....	38
十六、 发行人的税务.....	38
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.....	40
十八、 发行人募集资金的运用.....	41
十九、 发行人业务发展目标.....	41
二十、 诉讼、仲裁或行政处罚.....	41
二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价.....	41
二十二、 发行人律师认为需要说明的其他问题.....	42
二十三、 结论意见.....	43
<b>第二部分 关于《第一轮问询函》相关回复的更新 .....</b>	<b>44</b>
问题 2.关于核心技术来源 .....	44

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于上海伟测半导体科技股份有限公司**  
**首次公开发行股票并在科创板上市的**  
**补充法律意见书（二）**

案号：01F20202132

**致：上海伟测半导体科技股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“伟测科技”）的委托，并根据发行人与本所签订的《聘请律师合同》，作为发行人首次公开发行股票并在科创板上市项目（以下简称“本次发行上市”）的特聘专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《科创板首发管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，就本次发行上市所涉有关事宜于 2021 年 12 月 22 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）和《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”），并于 2022 年 2 月 28 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）。

本所律师根据发行人自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日期间（以下简称“补充核查期间”）已经存在或者发生的经营情况及事实情况，对发行人相关法律事项进行补充核查，现出具《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（二）》



（以下简称“本补充法律意见书”）。本补充法律意见书是对《律师工作报告》、《法律意见书》及《补充法律意见书（一）》的更新和补充，对于在《律师工作报告》、《法律意见书》及《补充法律意见书（一）》中已经表述的部分，本补充法律意见书不再赘述。

## 声明事项

一、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

二、本所及本所律师仅就与发行人本次发行上市有关法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估、内部控制、盈利预测等专业事项发表意见。在本补充法律意见书和为本次发行上市出具的《法律意见书》《律师工作报告》中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告和内部控制报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。

三、本补充法律意见书中，本所及本所律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件发生时所应当适用的法律、法规、规章及规范性文件为依据。

四、本补充法律意见书的出具已经得到发行人如下保证：发行人已经提供了本所为出具本补充法律意见书所要求发行人提供的全部原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

五、对于本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依据有关政府部门、发行人或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见。

六、本所同意发行人在《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)》(以下简称“《招股说明书(申报稿)》”)中自行引用或按上海证券交易所(以下简称“上交所”)审核要求引用本补充法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

七、本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所及本所律师根据有关法律、法规、规章和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及上交所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本补充法律意见书。

## 释 义

本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述含义：

发行人、伟测科技、公司	指	上海伟测半导体科技股份有限公司
伟测有限	指	上海伟测半导体科技有限公司，发行人前身
蕊测半导体、控股股东	指	上海蕊测半导体科技有限公司，发行人股东
遑泉元禾	指	江苏遑泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
新潮投资	指	江苏新潮创新投资集团有限公司，发行人股东
德同合心	指	苏州市德同合心创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
子公司	指	发行人合并报表范围内的全资、控股子公司
南京伟测	指	南京伟测半导体科技有限公司，发行人子公司
本所、锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
保荐机构、平安证券	指	平安证券股份有限公司
天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
A 股	指	境内上市人民币普通股
本次发行上市、本次发行	指	发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市
报告期	指	2019 年度、2020 年度及 2021 年度
补充核查期间	指	2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
《招股说明书（申报稿）》	指	发行人为本次发行上市制作的《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》
《上市保荐书》	指	保荐机构出具的《关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》
《预计市值的分析报告》	指	保荐机构出具的《关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之预计市值的分析报告》
本补充法律意见书	指	《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（二）》
《审计报告》	指	天健会计师出具的“天健审（2022）6-268 号”《上海伟测半导体科技股份有限公司三年期审计报告》
《内控鉴证报告》	指	天健会计师出具的“天健审（2022）6-269 号”《上海伟测半导体科技股份有限公司内部控制鉴证报告》
《公司章程》	指	根据上下文意所需，指发行人及其前身制定并不时修订的公司章程，另有说明的除外

《公司章程（草案）》	指	发行人为本次发行上市制定的《上海伟测半导体科技股份有限公司章程（草案）》，于2021年10月8日经发行人2021年第二次临时股东大会审议通过，于发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌交易之日起生效
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《科创板首发管理办法》	指	《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《科创板股票上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
中国、境内	指	中华人民共和国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区），为本补充法律意见书之目的，指中国大陆地区
境外	指	除中国大陆地区以外的国家及地区
法律法规	指	提及当时公布并生效的中国大陆法律、行政法规、地方性法规、规章以及规范性文件
国家企业信用信息公示系统	指	中华人民共和国国家市场监督管理总局主办的国家企业信用信息公示系统网站，其网址为 <a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a>
元、万元	指	人民币元、万元，上下文另有说明的除外

注：除特别说明外，本补充法律意见书中若出现总计数与分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

## 正文

### 第一部分 补充核查事项

#### 一、本次发行上市的批准和授权

本所律师已在《法律意见书》和《律师工作报告》中详细披露了发行人 2021 年第二次临时股东大会作出的批准本次发行上市以及授权董事会处理本次发行上市相关事宜的决议。截至本补充法律意见书出具之日，发行人本次发行上市的批准和授权情况未发生变化。

#### 二、发行人本次发行上市的主体资格

发行人为依法设立、有效存续且持续经营时间三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《科创板首发管理办法》第十条之规定，具备本次发行上市的主体资格，截至本补充法律意见书出具之日，发行人未出现根据法律法规及《公司章程》需要终止的情形。

#### 三、发行人本次发行上市的实质条件

经逐条对照《公司法》《证券法》《科创板首发管理办法》《科创板股票上市规则》等法律法规的规定，本所律师认为，发行人符合股份有限公司公开发行新股及申请股票在科创板上市的相关实质条件：

##### （一）发行人本次发行上市符合《公司法》及《证券法》规定的相关条件

1、发行人已就本次发行上市聘请了平安证券作为保荐机构，符合《证券法》第十条第一款的规定。

2、根据发行人本次发行的《招股说明书（申报稿）》及发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过之《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》，发行人本次发行的股票均为人民币普通股（A 股）股票，每一股份具有同等权利，每股的发行条件和价格相同，发行价格根据向询价对象询价结果并参考市场情况确定，不低于票面金额，符合《公司法》第一百二十六条、第一百二十七条的规定。

3、根据发行人 2021 年第二次临时股东大会会议文件，发行人本次发行已经依照《公司章程》的规定由股东大会和董事会对发行股票的种类、数量、价格、对象等事项作出决议，符合《公司法》第一百三十三条的规定。

4、经本所律师查验，发行人已设立了股东大会、董事会、监事会及董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，选举了董事（包括独立董事）、各董事会专门委员会委员、监事（包括职工代表监事），并聘请了总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员，在报告期内发行人根据《公司章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会会议，历次股东大会、董事会和监事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规以及当时适用的《公司章程》的规定，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项之规定。

5、发行人为长期存续的股份有限公司，其依照法律的规定在其经营范围内开展经营，截至本补充法律意见书出具之日，发行人依法有效存续，生产经营正常，具备生产经营所需的各项资质证书，能够支付到期债务，不存在影响其持续经营的法律障碍，具有持续经营能力。根据《审计报告》，发行人业务在报告期内有包括现金流量、营业收入、交易客户、管理费用支出等内容的持续营运记录；发行人不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项；亦不存在依据《公司法》及《公司章程》规定需要解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项之规定。

6、根据《审计报告》，发行人有关会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。天健会计师针对发行人最近三年一期的财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项之规定。

7、根据发行人及其控股股东、实际控制人出具的确认、公安机关出具的无犯罪记录证明、本所律师与实际控制人、发行人主要负责人的面谈及通过中国证监会、中国执行信息公开网等网站的公开查询，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项之规定。

## （二）发行人本次发行上市符合《科创板首发管理办法》规定的发行条件

1、经本所律师查验，发行人是依法设立且持续经营 3 年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，具备本次发行上市的主体资格，符合《科创板首发管理办法》第十条之规定。

2、根据《审计报告》及发行人的确认，并经本所律师访谈发行人财务总监，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由天健会计师出具了标准无保留意见的《审计报告》，符合《科创板首发管理办法》第十一条第一款之规定。

3、根据《内控鉴证报告》及发行人的确认，并经本所律师查验，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由天健会计师出具了无保留结论的《内控鉴证报告》，符合《科创板首发管理办法》第十一条第二款之规定。

4、经本所律师查验，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《科创板首发管理办法》第十二条第一款第（一）项之规定。

5、经本所律师查验，最近 2 年内发行人主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员没有发生重大不利变化，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近两年实际控制人没有发生变更，符合《科创板首发管理办法》第十二条第一款第（二）项之规定。

6、经本所律师查验，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等重大权属纠纷，发行人不存在重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项。根据《招股说明书（申报稿）》及本所律师与发行人管理层的访谈，截至本补充法律意见书出具之日，在其合理预见范围内，不存在发行人所处行业的经营环境已经或者将要发生重大变化并对发行人持续经营有重大不利影响，亦不存在其他对发行人持续经营有重大不利影响的事项，发行人已经在《招股说明书（申报稿）》披露了相关风险因素，符合《科创板首发管理办法》第十二条第一款第（三）项之规定。

7、根据《招股说明书（申报稿）》及发行人的说明，发行人的主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。发行人及其子公司所从事的业务均在工商行政管理部门登记的经营范围内，发行人主营业务所属的行业亦为国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年修订）中的“鼓励类”产业。其经营符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，符合国家产业政策。经本所律师查验，发行人持有经营所需的各项资质证书，有关证书均在有效期内。经本所律师比对国家发展和改革委员会颁布之《产业结构调整指导目录（2019年本）》及中华人民共和国环境保护部颁布之《环境保护综合名录（2021年版）》，发行人现有经营不涉及前述产业结构调整指导目录中列示的限制类和淘汰类产业，发行人现有产品不属于前述环境保护综合名录中列示的高污染、高环境风险产品，符合《科创板首发管理办法》第十三条第一款之规定。

8、根据发行人及其控股股东、实际控制人出具的确认，并经本所律师通过中国证监会、中国执行信息公开网等网站进行公开查询，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《科创板首发管理办法》第十三条第二款之规定。

9、根据发行人的确认、发行人董事、监事及高级管理人员填写的调查表、作出的声明和承诺以及公安机关出具的无犯罪记录证明，并经本所律师通过中国证监会、中国执行信息公开网等网站的公开查询，发行人的现任董事、监事和高级管理人员不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《科创板首发管理办法》第十三条第三款之规定。

### （三）发行人本次发行上市符合《科创板股票上市规则》规定的上市条件

1、如本补充法律意见书前文所述，发行人满足《科创板首发管理办法》第十条至第十三条规定的发行条件，符合《科创板股票上市规则》第2.1.1条第一款第（一）项之规定。

2、根据发行人的历次验资报告以及发行人现时有效的《营业执照》，发行



人本次发行上市前股本总额为 6,540.80 万元，发行后股本总额不会低于 3,000 万元，符合《科创板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（二）项之规定。

3、根据经发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过之《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》及《招股说明书（申报稿）》，发行人本次发行前股份总数为 6,540.80 万股，发行人本次拟向社会公开发行的股份数不超过 2,180.27 万股，本次发行方案确定的拟发行股份数不低于发行后总股本的 25%，符合《科创板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（三）项之规定。

4、根据《上市保荐书》及《预计市值的分析报告》，发行人预计总市值不低于人民币 10 亿元，根据《审计报告》，发行人 2021 年度经审计的净利润为 132,175,641.77 元且营业收入为 493,144,257.09 元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元，发行人的市值及财务指标符合《科创板股票上市规则》第 2.1.2 条规定的第一项标准，发行人符合《科创板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（四）项之规定。

#### **（四）发行人符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（1）-（4）项之规定**

1、根据《审计报告》，发行人 2019 年、2020 年、2021 年的研发费用分别为 13,371,662.77 元、21,013,963.09 元、47,742,834.01 元，占最近三年营业收入的比例分别为 17.16%、13.04%、9.68%，满足最近三年研发投入占营业收入比例 5% 以上的要求，符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（1）项之规定。

2、根据《招股说明书（申报稿）》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司研发人员总数为 176 人，公司员工总数为 927 人，研发人员占当年公司员工总人数的比例为 18.99%，不低于 10%，因此符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（2）项之规定。

3、经本所律师查验有关专利证书以及本所律师通过国家知识产权局公开信息的查询，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司合法拥有 7 项形成主营业务收入的发明专利。因此符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（3）项之规定。

4、根据《审计报告》，发行人 2019 年、2020 年、2021 年的营业收入分别为 77,933,235.29 元、161,196,220.78 元、493,144,257.09 元，复合增长率超过 20%，

因此符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（4）项之规定。

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行上市已经满足《公司法》《证券法》《科创板首发管理办法》《科创板股票上市规则》《科创属性评价指引（试行）》规定的各项实质条件，尚需取得上交所的审核通过并经中国证监会同意注册，待完成公开发行后，股票上市尚需取得上交所的同意。

#### 四、发行人的设立

本所律师已在《法律意见书》和《律师工作报告》中详细披露发行人的设立程序、条件等事项。经本所律师核查，补充核查期间，发行人的设立事宜未发生变化。

#### 五、发行人的独立性

本所律师已在《法律意见书》和《律师工作报告》中详细披露发行人的独立性情况。根据发行人的说明并经本所律师核查，补充核查期间，发行人资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性未发生变化，截至本补充法律意见书出具之日，发行人仍具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

#### 六、发起人、股东及实际控制人

##### （一）发行人的发起人

经本所律师核查，补充核查期间，发行人的发起人未发生变化。发行人的发起人均具备向发行人出资、成为发起人股东的资格，发行人的发起人人数、住所和出资比例均符合有关法律法規的规定。

##### （二）发行人现有股东

经本所律师查验，补充核查期间，发行人共有 16 名股东，未发生变化，部分股东的相关信息发生变更，具体如下：

##### 1、惠泉元禾

截至本法律意见书出具之日，惠泉元禾合伙人及合伙份额情况如下表所示：

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比例 (%)	合伙人类型
----	----------	-------------	---------------	-------

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比例 (%)	合伙人类型
1	苏州亚投荣基股权投资中心 (有限合伙)	80,000	24.3902	有限合伙人
2	苏州元禾控股股份有限公司	75,000	22.8658	有限合伙人
3	国家集成电路产业投资基金股份 有限公司	70,000	21.3415	有限合伙人
4	江苏省政府投资基金(有限合 伙)	45,000	13.7195	有限合伙人
5	深圳市鲲鹏股权投资有限公司	20,000	6.0976	有限合伙人
6	苏州汾湖创新产业投资中心 (有限合伙)	20,000	6.0976	有限合伙人
7	长三角协同优势产业股权投资 合伙企业(有限合伙)	6,250	1.9055	有限合伙人
8	上海清恩资产管理合伙企业 (有限合伙)	4,375	1.3338	有限合伙人
9	上海科创中心二期私募投资基 金合伙企业(有限合伙)	4,375	1.3338	有限合伙人
10	苏州致芯方维投资管理合伙企 业(有限合伙)	3,000	0.9146	普通合伙人
合计		<b>328,000</b>	<b>100</b>	--

## 2、新潮投资

2021年9月29日，新潮投资的企业名称由“江苏新潮科技集团有限公司”变更为“江苏新潮创新投资集团有限公司”

## 3、德同合心

截至本法律意见书出具之日，德同合心合伙人及合伙份额情况如下表所示：

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比 例(%)	合伙人类型
1	西藏德同企业管理有限公司	5,000	2.5000	普通合伙人
2	上海科创中心一期股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	20,000	10.0000	有限合伙人
3	苏州市吴江产业投资有限公司	20,000	10.0000	有限合伙人
4	国投创合国家新兴产业创业投 资引导基金(有限合伙)	20,000	10.0000	有限合伙人
5	前海股权投资基金(有限合伙)	15,000	7.5000	有限合伙人
6	平潭坤盛鼎兴股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	8,400	4.2000	有限合伙人
7	江西省发展升级引导基金(有限	10,000	5.0000	有限合伙人

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比 例 (%)	合伙人类型
	合伙)			
8	上海青浦投资有限公司	10,000	5.0000	有限合伙人
9	苏州工业园区元禾招商股权投资 投资基金合伙企业(有限合伙)	10,000	5.0000	有限合伙人
10	上海世丞股权投资基金管理有 限公司	7,000	3.5000	有限合伙人
11	上海德心股权投资基金管理有 限公司	8,370	4.1850	有限合伙人
12	深圳市丰源昌意投资中心(有限 合伙)	5,800	2.9000	有限合伙人
13	新余市晟创投资管理有限公司	7,000	3.5000	有限合伙人
14	远海明晟(苏州)股权投资合伙 企业(有限合伙)	7,000	3.5000	有限合伙人
15	南通江海产业发展投资基金(有 限合伙)	5,000	2.5000	有限合伙人
16	横琴宏帷股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	4,550	2.2750	有限合伙人
17	招商证券投资有限公司	5,000	2.5000	有限合伙人
18	嘉善县金融投资有限公司	5,000	2.5000	有限合伙人
19	苏州娄城国发高新技术产业投 资企业(有限合伙)	3,000	1.5000	有限合伙人
20	上海灿辉投资发展有限公司	2,500	1.2500	有限合伙人
21	平阳箴言德同投资管理合伙企 业(有限合伙)	2,000	1.0000	有限合伙人
22	辉县市豫辉哈工产业引导基金 合伙企业(有限合伙)	2,000	1.0000	有限合伙人
23	共青城乾堃荣福投资合伙企业 (有限合伙)	3,250	1.6250	有限合伙人
24	北京京北时代投资中心(有限合 伙)	1,000	0.5000	有限合伙人
25	宁波京北未来成功投资中心(有 限合伙)	1,000	0.5000	有限合伙人
26	宁波海威同心股权投资中心(有 限合伙)	1,000	0.5000	有限合伙人
27	东渡丰汇投资发展集团有限公 司	1,000	0.5000	有限合伙人
28	惠州市润博信息咨询部(有限合 伙)	1,000	0.5000	有限合伙人
29	杭州易盛投资合伙企业(有限合 伙)	1,000	0.5000	有限合伙人

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比 例 (%)	合伙人类型
30	南昌辰景咨询管理有限公司	1,500	0.7500	有限合伙人
31	上海德槃资产管理有限公司	630	0.3150	有限合伙人
32	共青城函数厚颐投资管理合伙企业（有限合伙）	1,505	0.7525	有限合伙人
33	共青城函数泽源投资管理合伙企业（有限合伙）	1,495	0.7475	有限合伙人
34	深圳涵鑫六号投资中心（有限合伙）	3,000	1.5000	有限合伙人
合计		200,000	100	-

### （三）发行人的控股股东和实际控制人

发行人的控股股东为蕊测半导体，骈文胜系发行人的实际控制人。补充核查期间，发行人的控股股东和实际控制人未发生变化。

## 七、发行人的股本及其演变

本所律师已在《律师工作报告》中详细披露了发行人的股本及其演变。经本所律师核查，补充核查期间，发行人的股本及演变情况未发生变化。发行人各股东所持发行人的股份不存在冻结、质押等权利限制的情形。

## 八、发行人的业务

### （一）发行人的经营范围和经营方式

#### 1、发行人的经营范围

经本所律师查验，补充核查期间，发行人主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。与其《营业执照》所记载的经营范围相符，其经营范围和经营方式符合有关法律法规的规定。

#### 2、发行人境内子公司的经营范围

经本所律师查验，补充核查期间，发行人新增一家全资子公司南京伟测，发行人及其子公司实际从事的业务没有超出其营业执照核准的经营范围，其经营范围和经营方式符合有关法律法规的规定。

### （二）发行人及其子公司取得的资质、许可、备案文件

经本所律师查验，补充核查期间，发行人资质、许可、备案文件变化如下所示：

### 1、进出口相关证书文件

序号	持证主体	证书名称	登记机关	海关注册编码/ 登记备案表编号	登记日期
1	伟测科技	中华人民共和国海关 报关单位注册登记证 书	浦东海关	3122260CSL	2017-04-19
2	伟测科技	对外贸易经营者备案 登记表	上海市浦东新 区商务委员会	02725948	2021-01-13
3	无锡伟测	海关进出口货物收发 货人备案回执	无锡海关	32023631KN	2020-08-05
4	无锡伟测	对外贸易经营者备案 登记表	无锡市对外贸 易经济合作局	04184930	2020-07-31
5	南京伟测	海关进出口货物收发 货人备案回执	金陵海关	3201960JYX	2021-11-24

### 2、管理体系证书

序号	持证主体	证书类型	颁发机构	证书编号	证书内容	有效期限
1	伟测科技	质量管理 体系认证 证书	NOA Certificati on 挪亚检测	NOA16128 67	质量管理体系符合 GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2015 标 准 认证范围：半导体芯 片测试	2021/08/23-20 22/08/15
2	伟测科技	环境管理 体系认证 证书	NOA Certificati on 挪亚检测	NOA16128 68	环境管理体系符合 GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015 标准 认证范围：半导体芯 片测试	2021/08/23-20 22/08/15
3	伟测科技	职业健康 安全管理 体系认证 证书	NOA Certificati on 挪亚检测	NOA19947 51	职业健康安全管 理体系符合 GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准 认证范围：半导体芯 片测试	2021/08/23-20 22/08/12
4	伟测科技	质量管理 体系认证 证书	Quality Austria 奥世认证	10515/0	质量管理体系符合 IATF 16949:2016 不含产品设计 半导体芯片的熔丝	2020/05/28-20 23/05/27

序号	持证主体	证书类型	颁发机构	证书编号	证书内容	有效期限
					微调	
5	无锡伟测	质量管理体系认证证书	Quality Austria 奥世认证	25033/0	质量管理体系符合 ISO 9001:2015 集成电路芯片的熔丝微调 and 测试服务	2020/11/05-2023/11/04
6	无锡伟测	环境管理体系认证证书	Quality Austria 奥世认证	04198/0	环境管理体系符合 ISO 14001:2015 集成电路芯片的熔丝微调 and 测试服务	2020/11/05-2023/11/04
7	无锡伟测	职业健康安全管理体系认证证书	Quality Austria 奥世认证	00903/0	职业健康安全管理体系符合 ISO 4500:2018 集成电路芯片的熔丝微调 and 测试服务	2020/11/05-2023/11/04
8	无锡伟测	质量管理体系认证证书	Quality Austria 奥世认证	12314/0	质量管理体系符合 IATF 16949:2016 不含产品设计 半导体芯片的熔丝微调	2021/11/03-2024/11/02

### 3、高新技术企业证书

2021年12月发行人获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202131004437，有效期为3年。

（三）经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人未在中国大陆以外的其他国家和地区从事经营活动。

（四）经本所律师查验，最近两年，发行人主营业务未发生变更。

（五）根据《审计报告》，报告期内发行人的营业收入以主营业务为主，发行人的主营业务突出。

（六）经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及子公司依照法律法规在其经营范围内开展经营，具备生产经营所需的各项资质证书或认证、备案文件，不存在影响其持续经营的法律障碍。根据《招股说明书（申报稿）》及发行人确认，截至本补充法律意见书出具之日，在其合理预见范围内，不存在发行人所处行业的产业政策已经或者将要发生重大变化并对发行人持续

经营有重大不利影响的情形，发行人已经在《招股说明书（申报稿）》披露了相关风险因素。

## 九、关联交易及同业竞争

### （一）关联方

经本所律师查验，补充核查期间，发行人新增部分关联方，具体如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	南京伟测	发行人子公司
2	天津环球海洋工程装备有限公司	监事高晓配偶的弟弟担任执行董事的公司
3	天津环球水下系统作业装备有限公司	监事高晓配偶的弟弟担任执行董事的公司

### （二）关联交易

根据《审计报告》、相关关联交易协议等文件，发行人及其子公司在报告期内与关联方发生的主要关联交易如下：

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### （1）采购商品的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
强一半导体（苏州）有限公司	探针卡及维修	1,921,617.24	77,005.30	41,009.73
上海季丰电子股份有限公司	测试备件及服务	539,738.32	136,100.00	51,002.65
上海市浦东新区唐镇国澜餐饮店	餐饮		707,565.00	1,014,950.00
上海承括电子科技有限公司	速干墨水			24,180.00
江苏长电科技股份有限公司 [注]	测试设备	3,124,164.00		
<b>小计</b>		<b>5,585,519.56</b>	<b>920,670.30</b>	<b>1,131,142.38</b>

注：实际为江苏长电科技股份有限公司、江阴长电先进封装有限公司以及星科金朋半导体（江阴）有限公司合并披露，系关联公司

##### （2）出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元



关联方	关联交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
普冉半导体（上海）股份有限公司	检测服务及治具销售	16,240,233.51	17,977,381.34	9,969,172.49
中微半导体（深圳）股份有限公司	检测服务及治具销售	416,119.96	353,591.92	
江苏长电科技股份有限公司 [注]	检测服务	593,201.61	8,832,588.68	13,710,133.61
<b>小计</b>		<b>17,249,555.08</b>	<b>27,163,561.94</b>	<b>23,679,306.10</b>

注：实际为江苏长电科技股份有限公司、江阴长电先进封装有限公司以及星科金朋半导体（江阴）有限公司合并披露，系关联公司

## 2、关联租赁

### （1）公司出租情况

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	2021 年度确认的 租赁收入	2020 年度确认的 租赁收入	2019 年度确认的 租赁收入
江苏长电科技股份有限公司 [注]	检测设备	240,000.00	161,150.44	82,743.35

注：实际为江苏长电科技股份有限公司、江阴长电先进封装有限公司以及星科金朋半导体（江阴）有限公司合并披露，系关联公司

### （2）公司承租情况

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2021 年度确认的 租赁费	2020 年度确认的 租赁费	2019 年度确认的 租赁费
江苏长电科技股份有限公司	检测设备	25,510,000.66	4,916,871.17	
上海季丰电子股份有限公司	检测设备		133,000.00	
<b>小计</b>		<b>25,510,000.66</b>	<b>5,049,871.17</b>	

## 3、关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
骈文	4,800,000.00	2021/3/12	2022/3/11	否	

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
胜、秦君梅	10,000,000.00	2021/4/22	2022/4/21		
	9,000,000.00	2021/1/15	2022/1/14		
	10,000,000.00	2021/9/26	2022/9/25		
骈文胜	35,000,000.00	2021/6/10	2023/6/9	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 66,969,204.43 元的固定资产提供抵押担保
骈文胜	15,000,000.00	2021/11/18	2022/11/17	否	
	3,276,000.00	2021/6/7	2024/6/7		
	6,724,000.00	2021/9/6	2024/6/7		
	10,000,000.00	2021/6/11	2022/5/30		
骈文胜	6,790,902.59	2020/12/15	2023/12/15	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 42,084,074.37 元的固定资产提供抵押担保
	9,172,507.07	2021/1/12	2023/12/15		
	10,100,530.96	2021/2/9	2023/12/15		
	10,271,961.11	2021/6/3	2024/5/20		
骈文胜	429,905.13	2019/12/5	2022/1/14	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 5,825,637.88 元的使用权资产提供抵押担保
	1,375,213.88	2019/12/17	2022/2/13		
	970,963.80	2019/12/17	2022/12/2		
	976,932.17	2020/2/28	2023/2/1		
骈文胜、秦君梅、上海蕊测半导体科技有限公司	3,534,802.02	2020/5/27	2023/5/12	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为 23,517,038.99 元的使用权资产提供抵押担保
	4,211,125.99	2020/8/14	2023/8/14		
	3,755,352.42	2020/8/14	2023/8/29		
	1,164,085.47	2020/9/3	2023/9/28		
	3,046,366.10	2020/11/3	2023/11/16		
	1,959,675.27	2020/11/3	2023/11/16		
骈文胜	1,108,286.15	2019/7/31	2022/7/16	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为 9,838,859.35 元的固定资产提供抵押担保
	1,306,907.47	2019/9/30	2022/9/14		
骈文胜、闻国涛	2,255,385.35	2019/4/22	2022/4/22	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为 26,637,711.37 元的使用权资产提供抵押担保
	8,033,963.02	2021/3/22	2023/3/22		
骈文胜、闻国涛、上海蕊测半导体科技	1,268,494.42	2019/8/10	2022/8/10	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为 14,405,440.11 元的使用权资产提供抵押担保
	2,469,104.02	2019/9/22	2022/9/21		

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
有限公司					
骈文胜、秦君梅	3,749,999.95	2020/9/29	2022/9/21	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为12,981,643.50元的固定资产提供抵押担保
骈文胜	21,818,181.81	2020/11/17	2023/11/16	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为37,986,749.70元的固定资产提供抵押担保
骈文胜	1,839,356.74	2021/5/27	2024/5/27	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为13,396,302.23元的使用权资产提供抵押担保
	7,827,033.60	2021/7/9	2024/7/9		
骈文胜、闻国涛、路峰	12,985,558.28	2020/10/23	2023/10/22	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为3,464,506.10元固定资产及24,365,381.69元的使用权资产提供抵押担保
骈文胜、闻国涛	6,327,219.75	2021/2/22	2023/2/22	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为12,436,316.78元的使用权资产提供抵押担保
上海蕊测半导体科技有限公司	5,039,297.01	2021/6/29	2024/6/29	否	
	12,545,230.19	2021/6/30	2024/6/30		
	10,591,878.94	2021/6/30	2024/6/30		
骈文胜、上海蕊测半导体科技有限公司	12,825,834.31	2021/7/29	2023/6/29	否	
	9,669,940.25	2021/8/23	2023/7/23		
骈文胜、闻国涛	9,833,254.54	2020/10/23	2022/10/21	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为33,941,258.89元的使用权资产提供抵押担保
骈文胜	130,194,359.32	2021/8/3	2026/8/2	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为97,381,953.99元的固定资产以及账面价值为7,855,953.57元的无形资产提供抵押担保

#### 4、关联方资金拆借

（1）2021年度

无。

## (2) 2020 年度

单位：元

关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金拆借利息
拆出					
骈文胜	300,000.00		300,000.00		
路峰	150,000.00		150,000.00		
小计	<b>450,000.00</b>		<b>450,000.00</b>		

## (3) 2019 年度

单位：元

关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金拆借利息
拆入					
上海蕊测半导体科技有限公司	2,999,400.00	1,598,269.00	4,597,669.00		675,291.93
龚金新	200,000.00		200,000.00		15,696.44
路峰	1,380,000.00		1,380,000.00		108,115.28
秦君梅	1,000,000.00		1,000,000.00		78,344.40
小计	<b>5,579,400.00</b>	<b>1,598,269.00</b>	<b>7,177,669.00</b>		<b>877,448.05</b>
拆出					
路峰		150,000.00		150,000.00	
闻国涛	100,000.00	1,050,000.00	1,150,000.00		
骈文胜	333,500.00	580,000.00	613,500.00	300,000.00	
小计	<b>433,500.00</b>	<b>1,780,000.00</b>	<b>1,763,500.00</b>	<b>450,000.00</b>	

## 5、关键管理人员报酬

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
关键管理人员报酬	5,533,372.35 元	2,187,779.24 元	1,534,605.84 元

## (三) 关联方应收应付款项

## 1、应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款							
	普冉半导体（上海）股份有限公司	2,348,048.51	117,402.43	8,134,702.58	406,735.13	4,695,590.43	234,779.52
	中微半导体（深圳）股份有限公司	93,004.81	4,650.24	111,041.35	5,552.07		
	江苏长电科技股份有限公司	90,365.51	4,518.28	189,693.86	9,484.69	1,886,532.31	94,326.62
	江阴长电先进封装有限公司			135,600.00	6,780.00		
	星科金朋半导体（江阴）有限公司			20,826.15	1,041.31	2,223,852.55	111,192.63
小计		<b>2,531,418.83</b>	<b>126,570.95</b>	<b>8,591,863.94</b>	<b>429,593.20</b>	<b>8,805,975.29</b>	<b>440,298.77</b>
其他应收款							
	骈文胜					304,952.10	15,247.61
	路峰					150,000.00	7,500.00
	乔从缓					3,552.00	177.60
	周歆瑶					18,569.00	928.45
小计						<b>477,073.10</b>	<b>23,853.66</b>

## 2、应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应付账款				
	星科金朋半导体（江阴）有限公司	870,000.00	972,545.98	

项目名称	关联方	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
	江阴长电先进封装有限公司		1,858,319.35	
	江苏长电科技股份有限公司		1,667,639.86	
	强一半导体（苏州）有限公司	1,547,400.48	46,796.00	29,925.00
	上海季丰电子股份有限公司	24,374.10	97,858.00	
	上海承括电子科技有限公司			8,814.00
<b>小计</b>		<b>2,441,774.58</b>	<b>4,643,159.19</b>	<b>38,739.00</b>
其他应付款				
	上海蕊测半导体科技有限公司	1,300.00	1,300.00	676,591.95
	闻国涛			900.00
	龚金新			87,696.44
	路峰			108,115.28
	秦君梅			78,344.40
<b>小计</b>		<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>951,648.07</b>

#### （四）发行人的关联交易决策程序

经本所律师查验，针对补充核查期间新增的关联交易，发行人履行了如下决策程序：

1、发行人第一届董事会第十二次会议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行及 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

2、发行人独立董事对于《关于公司 2021 年度日常关联交易执行及 2022 年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见及独立意见，认为相关关联交易对公司及子公司日常生产经营有积极影响，遵循自愿、有偿和公平的商业原则，履行了相关决策程序，关联董事已按规定回避表决，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

据此，本所律师认为，补充核查期间，发行人已制定的关联交易的决策程序得到有效执行，保护了发行人及股东的利益。

#### （五）同业竞争

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。为有效防止及避免同业竞争，发行人控股股东蕊测半导体、实际控制人

骈文胜已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

综上所述，本所律师认为，发行人报告期内不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易；发行人已在《公司章程》《公司章程（草案）》及其内部制度中规定了关联交易的决策程序；截至本补充法律意见书出具之日，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。

## 十、发行人的主要财产

### （一）不动产权及租赁使用权

#### 1、自有不动产权

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司拥有的不动产权未发生变化。

#### 2、不动产租赁使用权

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司的主要租赁使用权情况更新如下：

序号	出租方	承租方	租赁坐落	租赁用途	面积	租赁期间
1	上海新发创运置业有限公司	伟测科技	上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 幢	生产	1,984.89 m <sup>2</sup>	2019/03/30-2024/03/29
2	上海新发创运置业有限公司	伟测科技	上海市浦东新区胜利路 188 号 D 区 1 幢	生产、办公	3,704.43 m <sup>2</sup>	2021/03/01-2031/02/28
3	无锡星洲工业园区开发股份有限公司	无锡伟测	无锡新加坡工业园 301 地块 503 号厂房	办公	7,875.65 m <sup>2</sup> /12,751.29m <sup>2</sup>	2021/06/01-2026/05/31
4	南京天弘源资产管理有限公司	南京伟测	南京市浦口经济开发区双浦路 77 号辉瑞控股南京智能装备产业园 A4 栋防火分区 5	生产、办公	5,195.5 m <sup>2</sup>	2021/12/01-2026/11/30

### （二）发行人拥有的知识产权

## 1、商标

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司所拥有的商标未发生变化。

## 2、专利

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司所拥有的专利情况更新如下：

序号	专利申请名称	类型	取得方式	申请号/专利号	权利期限	专利权人	他项权利
1	晶圆区域性问题的分析系统及方法	发明专利	原始取得	202110310750.9	2021/03/24-2041/03/23	伟测科技	无
2	多晶硅工艺保险丝的熔断装置及方法	发明专利	专利转让	202110248636.8	2021/03/08-2041/03/07	无锡伟测	
3	一种测试机匹配检测系统及其方法	发明专利	原始取得	202011533224.0	2020/12/23-2040/12/22	伟测科技	
4	一种 Wafer ID 烧写防呆的系统	发明专利	原始取得	202011523844.6	2020/12/22-2040/12/21	伟测科技	
5	一种多平台联动提效机构	发明专利	原始取得	202011489734.2	2020/12/17-2040/12/16	伟测科技	
6	一种集成电路精确测试小电阻的方法	发明专利	原始取得	202011160294.6	2020/10/27-2040/10/26	伟测科技	
7	腐蚀粉在整形铂金探针的应用和铂金探针的整形方法	发明专利	原始取得	202110234659.3	2021/03/03-2041/03/02	伟测科技	
8	一种 Chroma Q-type 转接板开路断路检验装置	实用新型	原始取得	202120877907.1	2021/04/26-2031/04/25	无锡伟测	
9	一种子母式探针卡装配结构	实用新型	原始取得	202120864029.X	2021/04/25-2031/04/24	无锡伟测	
10	一种延长墨管使用寿命的装置	实用新型	原始取得	202120868460.1	2021/04/25-2031/04/24	无锡伟测	
11	一种防止测试载板结霜的装置	实用新型	原始取得	202120866185.X	2021/04/25-2031/04/24	无锡伟测	
12	一种方便操作的便携式有线线缆检测机构	实用新型	原始取得	202120554510.9	2021/03/18-2031/03/17	无锡伟测	
13	一种探针卡针延长寿命用的垫座	实用新型	原始取得	202120556145.5	2021/03/18-2031/03/17	无锡伟测	
14	一种芯片测试机上的真空除尘结构	实用新型	原始取得	201721787488.2	2017/12/20-2027/12/19	伟测科技	



序号	专利申请名称	类型	取得方式	申请号/专利号	权利期限	专利权人	他项权利
15	一种防止集成电路针测扎偏的装置	实用新型	原始取得	201721787486.3	2017/12/20-2027/12/19	伟测科技	
16	一种芯片测试机的翻转机构	实用新型	原始取得	201721787489.7	2017/12/20-2027/12/19	伟测科技	
17	一种电路板测试装置	实用新型	原始取得	201721231664.4	2017/09/25-2027/09/25	伟测科技	
18	一种真空吸附检测台的承载平台	实用新型	专利转让	201721231321.8	2017/09/25-2027/09/24	无锡伟测	
19	一种可以提高打点产品效率的模具	实用新型	专利转让	201721231323.7	2017/09/25-2027/09/24	无锡伟测	
20	一种自动油墨打点器	实用新型	专利转让	201721231624.X	2017/09/25-2027/09/24	无锡伟测	
21	一种自动降温器	实用新型	原始取得	201721231457.9	2017/09/25-2027/09/24	伟测科技	
22	一种利用工业空调冷却水实现测试机冷循环装置	实用新型	原始取得	201720068187.8	2017/01/20-2027/01/19	伟测科技	
23	一种背银、背金晶圆测试稳压装置	实用新型	原始取得	201720068189.7	2017/01/20-2027/01/19	伟测科技	
24	一种易于安装的晶圆测试装置	实用新型	原始取得	201720068329.0	2017/01/20-2027/01/19	伟测科技	
25	一种抗干扰晶圆测试机外壳	实用新型	原始取得	201720068188.2	2017/01/20-2027/01/19	伟测科技	
26	一种探针卡拆卸防呆装置	实用新型	原始取得	202120870208.4	2021/04/25-2031/04/24	无锡伟测	
27	一种集成电路检测设备	实用新型	原始取得	202121569857.7	2021/07/09-2031/07/08	无锡伟测	
28	料盘翘曲平整装置	实用新型	原始取得	202121715058.6	2021/07/26-2031/07/25	无锡伟测	
29	一种用于半导体自动分选机快速降温装置	实用新型	原始取得	202121422099.6	2021/06/24-2031/06/23	无锡伟测	

注：无锡伟测通过“专利转让”获得的1项发明专利和3项实用新型专利系从发行人处受让取得，转让过程合法、有效，并已在国家知识产权局备案。

### 3、许可专利使用权情况

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司拥有的专利许可使用权情况更新如下所示：

序号	名称	专利号	类型	授权公告日	发明人	权利人
1	一种晶圆芯片检测工装	201521040030.1	实用新型	2016/05/11	邹磊	普镛电子（上海）有限公司

序号	名称	专利号	类型	授权公告日	发明人	权利人
2	一种晶元自动检测设备用探针定位夹具	201521035597.X	实用新型	2016/05/11	杨会会	普钰电子（上海）有限公司
3	一种探针安装座	201521035631.3	实用新型	2016/05/11	张旆	普钰电子（上海）有限公司
4	一种简易探针固定座	201521035633.2	实用新型	2016/05/11	邹磊	普钰电子（上海）有限公司
5	一种晶元芯片检测头结构	201521035528.9	实用新型	2016/05/11	邹磊	普钰电子（上海）有限公司
6	一种晶元芯片检测头组件	201521035600.8	实用新型	2016/05/11	杨会会	普钰电子（上海）有限公司
7	一种晶元片检测头结构	201620794181.4	实用新型	2017/03/15	范秋萍	普钰电子（上海）有限公司
8	一种调节式晶元片检测头组件	201620794239.5	实用新型	2017/01/25	何佳	普钰电子（上海）有限公司
9	一种基于探针的检测头组件	201620794220.0	实用新型	2017/01/25	郑清林	普钰电子（上海）有限公司
10	一种稳定型晶元片检测头组件	201620794217.9	实用新型	2017/01/25	周莲国	普钰电子（上海）有限公司
11	一种基于晶元片检测的集成式检测头组件	201820211613.3	实用新型	2018/09/25	杨明亮	普钰电子（上海）有限公司
12	一种组合式晶元片检测头组件	201820211657.6	实用新型	2018/09/25	洪家萍	普钰电子（上海）有限公司

#### 4、集成电路布图设计

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司拥有的集成电路布图设计情况未发生变化。

#### 5、计算机软件著作权

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司拥有的计算机软件著作权情况更新如下：

序号	证书编号	软件名称	取得方式	著作权人	首次发表日期	权利期限
1	软著登字第2042850号	伟测自动测试报告系统	原始取得	伟测科技	2017/06/05	50年
2	软著登字第8590308号	伟测 TEL 型号探针台的晶圆图转换软件	原始取得	无锡伟测	未发表	50年

序号	证书编号	软件名称	取得方式	著作权人	首次发表日期	权利期限
3	软著登字第8672298号	伟测 TXT&Excel 与晶圆&Bin 坐标对比软件	原始取得	无锡伟测	未发表	50年
4	软著登字第8672285号	伟测测试机 STDF 大文件压缩转换软件	原始取得	无锡伟测	未发表	50年
5	软著登字第9043690号	伟测测试机 CSV 文件到 TSK 探针台的晶圆图转换软件	原始取得	无锡伟测	未发表	50年
6	软著登字第9248208号	伟测测试机 XML/TXT 文件探针台的 MAP 图转换软件	原始取得	无锡伟测	未发表	50年

## 6、域名

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司拥有的域名情况未发生变化。

### （三）发行人拥有的生产经营设备

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的主要生产经营设备为专用设备及办公设备，该等设备均由发行人实际占有和使用，均通过合法途径取得，主要经营设备不存在产权纠纷或争议。

### （四）发行人拥有的出资权益或股权

经本所律师查验，补充核查期间，发行人新增一家子公司南京伟测，截至本补充法律意见书出具之日，南京伟测的基本情况如下所示：

企业名称	南京伟测半导体科技有限公司
统一社会信用代码	91320111MA2798JE32
法定代表人	骈文胜
住所	南京市浦口区浦口经济开发区双峰路 69 号 C-93
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	7,000 万元人民币
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限	2021-10-21 至无固定期限

经本所律师查验，发行人的上述财产均通过合法途径取得，截至本补充法

律意见书出具之日，上述财产不存在产权纠纷，不存在权利受到限制的情形。

## 十一、发行人的重大债权债务

截至本补充法律意见书出具之日，发行人的重大债权债务更新情况如下所示：

### （一）重大合同

#### 1、重大销售合同

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人已签订的正在履行的重大销售合同更新如下：

序号	客户名称	合同标的	形式	签订日期	履行情况
1	客户 A	集成电路测试服务	框架合同	2020/10/12	正在履行
2	晶晨半导体（上海）股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2021/1/2	正在履行
3	深圳市中兴微电子技术有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2017/12/20	正在履行
4	上海安路信息科技股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2020/2/1	正在履行
5	普冉半导体（上海）股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2021/5/11	正在履行
6	Bitmain Technologies Limited（比特大陆）	集成电路测试服务	框架合同	2021/4/1	正在履行
7	江苏长电科技股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2020/3/2	正在履行
8	上海复旦微电子集团股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2018/6/6	正在履行
9	甬矽电子（宁波）股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2021/10/9	正在履行
10	北京兆易创新科技股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2020/4/17	正在履行

#### 2、重大采购合同

发行人报告期内已签订的正在履行或履行完毕的金额在 100 万美元以上的或 1,000 万人民币以上的重大采购订单以及重大的采购框架协议为公司的重大采购合同，更新情况如下：

序号	供应商名称	合同标的	币别	金额（万元）	签订日期	履行情况
1	致茂电子股份有限公司	集成电路测试机	USD	390.00	2021/6/4	正在履行
		集成电路测试机	USD	455.00	2020/3/16	正在履行

序号	供应商名称	合同标的	币别	金额（万元）	签订日期	履行情况
		集成电路测试机	USD	399.00	2019/6/5	正在履行
		集成电路测试机	USD	130.00	2020/8/28	履行完毕
		集成电路测试机	USD	75.00	2020/12/30	履行完毕
		集成电路测试机	USD	65.00	2020/12/30	履行完毕
		集成电路测试机	USD	65.00	2020/11/30	履行完毕
2	先域微电子技术 服务（上海）有限 公司	高速转塔测试机	RMB	1,459.19	2020/11/19	正在履行
3	ADVANTEST CORPORATION	集成电路测试机	-	框架合同	2021/6/29	正在履行
4	Teradyne（Asia） Pte.Ltd	集成电路测试机	USD	23.80	2020/8/28	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	22.80	2020/8/28	履行完毕
		集成电路测试机	USD	160.40	2020/8/28	履行完毕
		集成电路测试机	USD	89.00	2020/12/23	履行完毕
		集成电路测试机	USD	44.50	2020/12/24	履行完毕
		集成电路测试机	USD	89.00	2020/8/10	履行完毕
		测试机、设备板 卡及备件	USD	94.20	2020/8/21	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	2.70	2021/5/18	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	29.80	2021/4/16	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	29.80	2021/5/9	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	27.23	2021/5/20	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	7.78	2021/6/1	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	56.00	2021/10/20	履行完毕
		集成电路测试机	USD	303.90	2021/9/29	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	104.10	2021/7/15	履行完毕
		集成电路测试机	USD	133.50	2021/10/22	履行完毕
		集成电路测试机	USD	133.50	2021/11/4	履行完毕
集成电路测试机	USD	133.50	2021/11/27	履行完毕		
5	Semics.Inc	自动探针台	USD	530.00	2019/12/3	履行完毕
		探针台	USD	102.00	2020/9/15	履行完毕
		探针台	USD	51.00	2021/3/11	履行完毕
		探针台	USD	153.00	2021/3/11	履行完毕
		探针台	USD	20.40	2021/3/11	履行完毕
		其他周转材料	USD	0.24	2021/3/22	履行完毕

序号	供应商名称	合同标的	币别	金额（万元）	签订日期	履行情况
		探针台	USD	20.40	2021/4/26	履行完毕
		探针台	USD	397.00	2021/6/23	履行完毕
		探针台	USD	241.10	2021/7/2	履行完毕
		其他周转材料	USD	30.60	2021/7/1	履行完毕
6	Tokyo Seimitsu Co., Ltd	探针台	JPY	16,600.00	2020/8/25	履行完毕
		探针台	JPY	49,305.00	2021/6/19	正在履行
7	天津金海通自动化设备股份有限公司	集成电路测试机	-	框架协议	2020/11/30	正在履行
8	鸿劲精密股份有限公司	分选机	USD	160.00	2021/6/10	履行完毕
		分选机	USD	160.00	2021/6/10	履行完毕
		分选机	USD	204.00	2021/5/25	履行完毕
		分选机	USD	67.50	2021/7/7	履行完毕
9	上海午盛实业有限公司	厂务设备及工程	RMB	2,700.00	2021/7/7	履行完毕

经本所律师查验，发行人上述重大采购和销售合同合法有效，截至本补充法律意见书出具之日，发行人未发生与上述合同相关的重大纠纷或争议。

### 3、重大借款合同及担保合同

经本所律师查验，发行人报告期内已签订正在履行或履行完毕的合同金额超过 500 万元更新如下：

序号	借款合同名称及编号	融资银行	担保（抵押）合同名称及编号	担保形式	借款开始日	借款到期日	币种	合同金额（万元）	履行情况
1	Z2005LN15676636	交通银行股份有限公司上海新区支行	保证合同（C200514GR3109480）	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2020/6/1	2021/5/27	RMB	800.00	履行完毕
2	Z2007LN15624919		保证合同、抵押担保（C190311MG3107572、C200514GR3109480、JTYH00220200101202）	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保、上海市中小微企业政策性融资担保基金管	2020/8/11	2021/7/16	RMB	950.00	履行完毕

序号	借款合同名称及编号	融资银行	担保（抵押）合同名称及编号	担保形式	借款开始日	借款到期日	币种	合同金额（万元）	履行情况
			01231)	理中心提供担保					
3	Z2108LN 15614930		-	-	2021/8/24	2022/8/24	RMB	3,000.00	履行完毕
4	97162020 280206	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	最高额保证合同 ZB9716202 000000027	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2020/6/23	2021/6/22	RMB	500.00	履行完毕
5	97162020 280312		最高额保证合同 ZB9716202 000000027	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2020/9/9	2021/9/8	RMB	500.00	履行完毕
6	97162021 280289		最高额保证合同 ZB9716202 000000027	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2021/9/26	2022/9/25	RMB	1,000.00	正在履行
7	97162021 280114		最高额保证合同 (ZB97162 020000000 27)	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2021/4/22	2022/4/21	RMB	1,000.00	正在履行
8	平银沪科创贷字 20210111 第001号	平安银行上海分行营业部	最高额保证担保合同【平银沪科创额保字 20210111 第001号、 002号】	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2021/1/15	2022/1/14	RMB	900.00	履行完毕
9	Z2105LN 15651734	交通银行股份有限公司上海新区支行	保证合同 (C200514 GR3109480 )	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2021/6/11	2022/5/30	RMB	1,000.00	正在履行
10	CL20201 2003	浦发硅谷银行有限	CL2020120 02-PG、 CL2020120 03-EM	骈文胜最高额不可撤销担保、机器	2020/12/15	2023/12/15	USD	159.77	正在履行

序号	借款合同名称及编号	融资银行	担保（抵押）合同名称及编号	担保形式	借款开始日	借款到期日	币种	合同金额（万元）	履行情况
		公司		设备抵押					
11	CL202012003		CL20201202-PG、CL20201203-EM	骈文胜最高额不可撤销担保、机器设备抵押	2021/1/12	2023/12/15	USD	215.80	正在履行
12	CL202012003		CL20201202-PG、CL20201203-EM	骈文胜最高额不可撤销担保、机器设备抵押	2021/2/9	2023/12/15	USD	224.43	正在履行
13	CL202105002		CL20210502-EM	机器设备抵押	2021/6/3	2024/5/20	USD	200.00	正在履行
14	公授信字第02702021213200号	中国民生银行股份有限公司上海分行	最高额保证合同（公高保字第02702021213201号）、最高额抵押合同：公高抵字第0270202021213202号、公高抵字第02702021213204号	骈文胜最高额不可撤销担保	2021/6/10	2023/6/9	RMB	3,500.00	正在履行
15	121XY2021032339	招商银行股份有限公司上海分行	最高额不可撤销担保书（121XY2021032339）	骈文胜最高额不可撤销担保	2021/11/18	2022/11/17	RMB	1,500.00	正在履行
16	2021082601	招商银行股份有限公司无锡分行	最高额抵押合同（202108260104）、抵押合同（202108260103）	骈文胜最高额不可撤销担保、机器设备抵押	2021/8/3	2026/8/2	RMB	15,000.00	正在履行



## 4、融资租赁合同

经本所律师查验，发行人报告期内已签订的正在履行或履行完毕的融资租赁合同更新如下：

序号	出租人	合同名称及编号	租金 (元或美元/月)	签订日期/ 起租日	租赁期限	履行情况
（一）上海伟测半导体科技股份有限公司						
1	北亚融资租赁 (上海)有限公司	设备融资租赁合同 NAFL201629-12 补充协议 NAFL20170102	95,108.00 元	2017/1/17	24 个月	履行完毕
2		设备融资租赁合同 NAFL2017032-05	45,425.92 美元	2017/5/31	24 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL2017032-05 补充协议 NAFL20170801	12,310.84 美元	2017/8/10	24 个月	履行完毕
3		设备融资租赁合同 NAFL2017046-07 (第一批)	35,270.81 美元	2017/7/31	24 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL2017046-07 (第二批)	60,371.38 美元	2017/7/31	24 个月	履行完毕
4		设备融资租赁合同 NAFL2017056-09	20,328.41 美元	2017/9/20	24 个月	履行完毕
5		设备融资租赁合同 NAFL2017066-11	529,201.16 元	2017/12/11	24 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL2017066-11 补充协议 NAFL20180201	128,742.81 元	2018/2/10	24 个月	履行完毕
6		设备融资租赁合同 NAFL2018013-05	467,057.00 元	2018/5/8	24 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL2018013-05-02	334,590.22 元	2018/5/18	36 个月	履行完毕
7	设备融资租赁合同 NAFL2018026-07	350,537.88 元	2018/7/9	36 个月	履行完毕	
	设备融资租赁合同 NAFL2018026-07 补充协议 NAFL20180810	30,431.49 元	2018/8/10	36 个月	履行完毕	
8	设备融资租赁合同 NAFL2018028-09 (第一批)	42,896.99 元	2018/9/21	36 个月	履行完毕	
	设备融资租赁合同 NAFL2018028-09 (第二批)	23,035.83 元	2018/9/21	36 个月	履行完毕	
	设备融资租赁合同 NAFL2018028-09 补充协议 NAFL20181217	177,896.88 元	2018/12/10	36 个月	履行完毕	
9	设备融资租赁合同 NAFL2019007-04	565,060.29 元	2019/5/5	36 个月	履行完毕	
	设备融资租赁合同 NAFL2019007-04	289,719.82 元	2019/6/10	36 个月	履行完毕	
10	设备融资租赁合同 NAFL2019023-08 (第一批)	163,136.11 元	2019/8/23	36 个月	正在履行	
	设备融资租赁合同 NAFL2019023-08 (第二批)	283,145.52 元	2019/8/23	36 个月	正在履行	
	设备融资租赁合同 NAFL2019023-08 补充协议 NAFL20191015	133,461.81 元	2019/10/10	36 个月	履行完毕	

序号	出租人	合同名称及编号	租金 (元或美元/月)	签订日期/ 起租日	租赁期限	履行情况
		设备融资租赁合同 NAFL2019023-08 补充协议 NAFL20191101	142,305.81 元	2019/11/10	24 个月	履行完毕
11		设备融资租赁合同 NAFL2019030-11	499,195.28 元	2019/11/19	24 个月	履行完毕
12		设备融资租赁合同 NAFL2020034-02	638,955.70 元	2020/2/20	24 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL2020034-02 补充协议 NAFL20200415001	279,593.69 元	2020/4/21	24 个月	履行完毕
13		设备融资租赁合同 NAFL2021047-02	556,554.15 元	2021/3/26	24 个月	正在履行
14	浦银金 融租赁 股份有 限公司	融资租赁合同（售后回租类） PYHZ0120200030	416,666.67 元	2020/9/29	24 个月	正在履行
15	交银金 融租赁 有限责 任公司	融资租赁合同（回租）交银租赁字 【20190213】号	398,355.13 元	2019/12/26	24 个月	履行完毕
16	芯鑫融 资租赁 有限责 任公司	售后回租赁合同 SINOICL2020D08Y002-L-01	4,583,999.65 元	2020/3/31	36 个月	履行完毕
17	中电投 融和融 资租赁 有限公 司	融资租赁合同（售后回租） RHZL-2020-101-1382-SHWCBDT-001	2,727,272.73 元	2020/11/10	36 个月	正在履行
18	仲利国 际租赁 有限公 司	融资租赁合同 AA18100338AKX	140,625 元	2018/10/12	24 个月	履行完毕
19	苏州融 华租赁 有限公 司	融资租赁合同 RH-L-2019009-1	162,469.75 元	2019/6/6	36 个月	正在履行
20		融资租赁合同 RH-L-2019009-2	149,972.10 元	2019/8/15	36 个月	正在履行
21		融资租赁合同 RH-L-2019023-1	37,287.45 元	2019/12/2	36 个月	正在履行
22		融资租赁合同 RH-L-2019023-2	119,278.00 元	2019/12/17	36 个月	正在履行
23		融资租赁合同 RH-L-2019023-3	84,216.00 元	2019/12/20	36 个月	正在履行
24		融资租赁合同 RH-L-2019023-4	72,669.00 元	2020/2/25	36 个月	正在履行
25		融资租赁合同 RH-L-2020003-1	7,757,856 元	2020/5/25	36 个月	正在履行
26		补充协议 RH-L-2020003-1/S01	216,978.00 元	2020/6/12	36 个月	正在履行
27		融资租赁合同 RH-L-2020003-2	140,162.00 元	2020/7/25	36 个月	正在履行
28		补充协议 RH-L-2020003-3/S01	223,014.00 元	2020/9/3	36 个月	正在履行

序号	出租人	合同名称及编号	租金 (元或美元/月)	签订日期/ 起租日	租赁期限	履行情况
29		融资租赁合同 RH-L-2020003-4	90,976.00 元	2020/8/31	36 个月	正在履行
30		融资租赁合同 RH-L-2020003-5	199,026.00 元	2020/8/27	36 个月	正在履行
31		补充协议 RH-L-2020003-5/S01	198,877.00 元	2020/10/20	36 个月	正在履行
32		融资租赁合同 RH-L-2020003-6	2,170,152.00 元	2020/9/3	36 个月	正在履行
33		补充协议 RH-L-2020003-6/S01	58,871.00 元	2020/10/20	36 个月	正在履行
34	海通恒 信国际 融资租 赁股份 有限公 司	融资租赁合同 L21A0441003	68,283.60 元	2021/4/26	36 个月	正在履行
35		融资租赁合同 L21A0441004	273,134.40 元	2021/4/26	36 个月	正在履行
(二) 无锡伟测半导体科技有限公司						
1	北亚融 资租赁 (上 海)有 限公司	设备融资租赁合同 NAFL2020042-10	1,018,064.88 元	2020/10/23	24 个月	正在履行
2		设备融资租赁合同 NAFL2021046-02	468,512.94 元	2021/2/22	24 个月	正在履行
3	诚泰融 资租赁 (上 海)有 限公司	融资租赁合同 CHTDCS4355-C001-L01	620,607.52 元	2020/10/23	36 个月	正在履行
4	平安国 际融资 租赁有 限公司	融资租赁合同 2021PAZL0101129-ZL-01	177,204.70 元	2021/6/8	36 个月	正在履行
5		融资租赁合同 2021PAZL0101132-ZL-01	441,147.60 元	2021/6/30	36 个月	正在履行
6		融资租赁合同 2021PAZL0101133-ZL-01	372,458.85 元	2021/6/30	36 个月	正在履行
7	远东国 际融资 租赁有 限公司	融资租赁合同 IFELC21DG1FCBW-L-01	755,028.01 元	2021/6/27	24 个月	正在履行
8		融资租赁合同 IFELC21DG1USW5-L-01	540,907.32 元	2021/7/15	24 个月	正在履行
9	苏州融 华租赁 有限公 司	融资租赁合同 RH-L-2021009-1	302,372.00 元	2021/4/9	36 个月	正在履行

注：苏州融华租赁有限公司的《融资租赁合同 RH-L-2019009-1》、《融资租赁合同 RH-L-2019009-2》为售后回租。

#### 5、其他重大合同

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人其他重大合同未发生变化。

（二）经发行人说明并经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（三）根据《审计报告》并经本所律师查验，截至报告期末，发行人与关联方之间不存在重大债权债务关系。

（四）根据《审计报告》并经本所律师查验，截至报告期末，发行人存在关联方为其提供担保的情形，具体情况详见本补充法律意见书“九、关联交易及同业竞争”之“（二）关联交易”，发行人不存在为关联方提供担保的情形。

（五）经本所律师查验，截至报告期末，发行人金额较大的其他应收款以及其他应付款均系发行人正常生产经营而发生的往来款，合法有效。

## 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

（一）经本所律师查验，补充核查期间，发行人不存在合并、分立、增加或者减少注册资本的行为。

（二）经本所律师查验，补充核查期间，发行人不存在重大资产变化、收购或出售资产行为。

（三）根据发行人的确认并经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等行为。

## 十三、发行人公司章程的制定与修改

经本所律师查验，补充核查期间，发行人《公司章程》未发生变化，发行人现行的《公司章程》及《公司章程（草案）》均符合现行法律法规的规定。

## 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）经本所律师查验，补充核查期间，发行人的组织机构未发生变化。

（二）经本所律师查验，补充核查期间，发行人股东大会、董事会及监事会

议事规则未发生变化且符合法律法规的有关规定。

（三）经本所律师查验，补充核查期间，发行人历次股东大会、董事会、监事会会议的召开、决议内容及签署合法、有效。

（四）经本所律师查验，补充核查期间，发行人股东大会对公司董事会的历次授权或重大决策行为符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

## 十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化

经本所律师核查，补充核查期间，除发行人董事祁耀亮于 2021 年 12 月不再担任美芯晟科技（北京）有限公司董事之外，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况未发生变化。

## 十六、发行人的税务

### （一）发行人执行的税种、税率

根据《审计报告》并经本所律师查验，报告期内，发行人及其子公司报告期内执行的主要税种和税率为：

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明			
纳税主体名称	2021 年度	2020 年度	2019 年度
本公司	12.5%	12.5%	12.5%
上海威矽半导体科技有限公司	25%	25%	25%
厦门伟测半导体科技有限公司	已注销	25%	25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明			
无锡伟测半导体科技有限公司	25%	25%	未成立
南京伟测半导体科技有限公司	25%	未成立	未成立

经本所律师查验，发行人及其子公司报告期内执行的主要税种、税率符合法律法规的规定。

### （二）发行人享受的税收优惠

经本所律师查验，补充核查期间，发行人及其境内子公司在报告期内享受的税收优惠未发生变化且符合法律、法规的规定。

### （三）发行人享受的财政补贴

根据《审计报告》并经本所律师查验，2021 年度，发行人及其境内子公司享受的财政补贴更新如下所示：

序号	金额	项目名称	补贴依据
1	5,200,000.00	超大规模集成电路芯片集成测试平台技术改造	上海市经济信息化委、市财政局关于印发《上海市技术改造专项支持实施细则》的通知（沪经信规范（2018）1号）
2	4,000,000.00	关键核心芯片晶圆级系统级全生态测试能力提升改造	上海市经济信息化委、市财政局关于印发《上海市技术改造专项支持实施细则》的通知（沪经信规范（2018）1号）
3	5,000,000.00	固定资产投资补贴	《无锡国家高新技术产业开发区管理委员会，关于进一步推动科技创新的实施意见》（锡高管发（2017）40号）
4	2,053,154.34	进口设备贴息	财政部商务部关于印发《外经贸发展专项资金管理办法》的通知（财企（2014）36号）及《上海市商务委关于2020年进口贴息资金申报的通知》
5	600,000.00	小巨人项目补贴	关于印发《上海市科技小巨人工程实施办法》的通知规范性文件沪科规（2021）12号
6	600,000.00	科技发展基金	《浦东新区科技发展基金重点企业研发机构补贴资金操作细则》
7	568,500.00	政策扶持补贴	《无锡国家高新技术产业开发区管理委员会，关于进一步推动科技创新的实施意见》（锡高管发（2017）40号）
8	250,000.00	中小企业专项补贴	《浦东新区科技发展基金重点企业研发机构补贴资金操作细则》
9	95,000.00	创新业务补贴	《上海市经济信息化委市财政局关于开展2020年融资担保创新业务支持项目申

序号	金额	项目名称	补贴依据
			报工作的通知》（沪经信企〔2020〕1051号）
10	40,375.00	担保补贴	《关于延续〈浦东新区小微企业增信基金管理办法〉的通知》（浦财经〔2019〕18号）
11	27,700.00	稳岗补贴	《关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划大力开展以工代训工作的通知》（锡人社发〔2020〕59号）及和《关于进一步支持企业开展以工代训工作的补充通知》（锡人社发〔2020〕75号）
12	12,000.00	岗前培训补贴	《上海市人力资源和社会保障局上海市财政局关于进一步落实受疫情影响企业职工线上职业培训补贴政策有关事项的通知》（沪人社规〔2021〕4号）
13	7,500.00	专利资助款	《上海市专利资助办法（沪知局规〔2018〕1号）》
14	3,000.00	就业补贴	《省政府关于应对新型冠状病毒肺炎疫情影响推动经济循环畅通和稳定持续发展的若干政策措施》（苏政发〔2020〕15号）、《市委市政府关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关保障经济平稳运行的政策意见的通知》（锡委发〔2020〕20号）
15	2,000.00	毕业生补贴	《无锡市人民政府关于促进高校毕业生来锡就业创业的若干措施的通知》（锡政发〔2020〕12号）
16	3,300.00	其他	/

#### （四）发行人税务合规情况

经本所律师查验，补充核查期间，发行人及其境内子公司不存在因重大税务违法行为被处以行政处罚的情形。

## 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）经本所律师查验，补充核查期间，发行人及其子公司不存在因违反环境保护方面法律法规而受到重大处罚的情形，发行人募投项目符合国家有关环境保护的要求。

（二）经本所律师查验，补充核查期间，发行人及其子公司不存在因违反质量技术监督方面法律、法规而被行政处罚的情形。

（三）经本所律师查验，补充核查期间，发行人及其子公司能够按国家有关法律法规进行安全生产，不存在因违反安全生产方面的法律法规而被主管应急管理部门给予行政处罚的情形。

（四）经本所律师查验，补充核查期间，发行人不存在因劳动人事、社会保险、住房公积金等相关事项受到有关部门处罚的情形。

## 十八、发行人募集资金的运用

本所律师已在《法律意见书》、《律师工作报告》中详细披露了发行人募集资金的运用情况。根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人募集资金的运用情况未发生变化。

## 十九、发行人业务发展目标

本所律师已在《法律意见书》、《律师工作报告》中详细披露了发行人的业务发展目标，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的业务发展目标未发生变化。

## 二十、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项。

（二）经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人持股 5% 以上股份的股东、控股股东不涉及其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。

（三）经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人现任董事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情况。

## 二十一、发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师已审阅《招股说明书（申报稿）》，特别对发行人引用本补充法律



意见书及《律师工作报告》相关内容已认真审阅，《招股说明书（申报稿）》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。

## 二十二、发行人律师认为需要说明的其他问题

### （一）发行人历史沿革中的代持事项

本所律师已在《律师工作报告》中详细披露了发行人的代持相关事宜，截至本补充法律意见书出具之日，发行人历史上存在的所有代持均已解除。发行人股东持有的发行人股份权属清晰，不存在代持等未披露的股份安排，亦不存在权属纠纷及潜在纠纷。

### （二）发行人员工持股计划

本所律师已在《律师工作报告》中详细披露了发行人的员工持股计划相关事宜，补充核查期间，发行人的员工持股计划相关情况未发生变化。

### （三）对赌协议

本所律师已在《律师工作报告》中详细披露了发行人对赌协议的相关事宜，补充核查期间，发行人的对赌协议相关情况未发生变化。

### （四）劳务外包

经本所律师查验，补充核查期间，发行人及其子公司新增一家合作的劳务公司，发行人子公司南京伟测将测试过程中部分辅助性工作如物料搬运、物料收货、成品打包、条形码扫描等工作外包给劳务公司，该劳务公司基本情况如下所示：

序号	公司名称	统一社会信用代码	经营范围
1	江苏天为 人力资源 有限公司	91320105M A1NGKWD 14	人力资源信息咨询；劳务派遣；园林绿化工程、建筑工程、室内外装饰工程设计、施工；设计、制作、代理、发布国内各类广告；市场营销策划；公关礼仪服务；创意策划服务；企业管理咨询服务；职业中介服务；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；电子产品及零配件、塑胶制品、机械零配件、汽车零配件加工、销售；搬运、装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经本所律师查验，截至报告期末，为发行人及其子公司提供劳务外包服务

的公司为独立经营主体，未因向发行人提供劳务外包服务而涉及违法违规行为，且劳务外包公司与发行人不存在任何关联关系。

#### （五）信息豁免披露

经本所律师查验发行人相关内控管理制度及签订的《保密协议》，发行人已建立完善的内控管理制度并得到有效执行，发行人申请信息豁免披露事项具有合理的商业诉求，如披露将导致发行人违约。发行人的董事长已在豁免申请文件中签字确认，豁免披露的信息尚未泄漏。截至本补充法律意见书出具之日，公司的信息披露方式对投资者判断公司价值不存在重大影响。

### 二十三、结论意见

综上所述，本所律师认为，发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，发行人符合《证券法》《公司法》《科创板首发管理办法》《科创板股票上市规则》《科创属性评价指引（试行）》等有关法律法规中有关公司首次公开发行股票并在科创板上市的条件，其股票公开发行并于上交所科创板上市不存在法律障碍；发行人《招股说明书（申报稿）》所引用的本补充法律意见书和《律师工作报告》的内容适当；发行人本次发行上市已经取得现阶段必要的批准和授权，尚需取得上交所的审核同意并经中国证监会同意注册，待完成公开发行后，股票上市尚需取得上交所的同意。

## 第二部分 关于《第一轮问询函》相关回复的更新

### 问题 2.关于核心技术来源

2.1 根据招股说明书，1) 公司 2016 年成立后即进入晶圆测试领域，2017 年实现盈利，2019 年末开拓了芯片测试业务。发行人的核心技术系自主开发，并随着测试经验的积累逐步完善。2) 截至本招股说明书签署日，公司及其子公司取得 24 项专利、1 项软件著作权，其中有 6 项发明专利，18 项实用新型专利。3) 公司有 4 名核心技术人员，就职前曾在日月光封测、长电科技等同行业公司任职，其中一名核心技术人员于 2020 年 2 月入职。另根据申报材料，部分专利发明人目前已离职。

请发行人说明：

(1) 公司 6 项发明专利的具体来源、发明人的具体情况，是否为公司员工，该 6 项发明专利在发行人主营业务中的具体应用情况；

(2) 结合核心技术人员和专利发明人（包括已离职人员）的从业经历，说明其在技术形成过程中发挥的作用，并结合行业研发周期、客户认证周期、测试方案开发和验证周期，说明主营业务发展和核心技术形成的关键历史节点，技术来源是否为自主研发，是否合法合规；

(3) 结合核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）的任职经历，说明该等人员是否存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，是否存在纠纷或潜在纠纷。

请保荐机构和发行人律师进行核查，完善核查方式，说明核查过程并发表明确意见。

回复：

一、公司 6 项发明专利的具体来源、发明人的具体情况，是否为公司员工，该 6 项发明专利在发行人主营业务中的具体应用情况

发行人 6 项发明专利的具体来源、发明人的具体情况及在发行人主营业务中的具体应用情况如下表所示：

序号	专利名称	申请号/专利号	技术来源	发明人	是否公司员工	具体应用
1	晶圆区域性问题的分析系统及方法	202110310750.9	自主研发	杨恭乾、路峰、高大会、闻国涛、骈文胜	皆是	1、是一种对测试环节的数据进行大量数据分析以发现异常和测试环节的问题，并对测试问题的根本原因进行智能判断的一套分析系统。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试业务。
2	多晶硅工艺保险丝的熔断装置及方法	202110248636.8	自主研发	傅郁晓、吴庆、陈迎涛、杨栓、张丽霞	皆是	1、大规模测试服务中保险丝熔断工艺较为普遍，该发明是用一种简单的替代方法在保证质量的同时达成熔断工艺。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试业务与芯片成品测试业务。
3	一种测试机匹配检测系统及其方法	202011533224.0	自主研发	傅郁晓、吴庆、骈文胜、闻国涛、杨恭乾	皆是	1、是一种软件系统，主要用于测试机对设计公司提供产品进行自动适应性配置。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试与芯片成品测试业务。
4	一种 Wafer ID 烧写防呆的系统	202011523844.6	自主研发	骈文胜、傅郁晓	皆是	1、在大规模测试服务中确保每个芯片被正确识别和跟踪，并可以持续保证最高的测试质量；当遇有多流程的情况时不会出现测试错误，是大规模测试服务中质量管理系统的关键环节。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试业务。
5	一种多平台联动提效机构	202011489734.2	自主研发	杨栓、关姜维、刘栋栋	皆是	1、将两个测试机对接到一个探针台上，可以在保证测试质量的同时提高测试效率和设备利用率。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试业务。
6	一种集成电路精确测试小电阻的方法	202011160294.6	自主研发	左上勇、袁常乐、王敏	皆是	1、属于一种测试的优化方法，在保证高精度的同时，运用简单仪器测试小电阻。 2、主营业务运用情况：应用于晶圆测试与芯片成品测试业务。

如上表所示，上述 6 项发明专利均由发行人员工自主研发形成并应用于主营业务。

二、结合核心技术人员和专利发明人（包括已离职人员）的从业经历，说明其在技术形成过程中发挥的作用，并结合行业研发周期、客户认证周期、测

试方案开发和验证周期，说明主营业务发展和核心技术形成的关键历史节点，技术来源是否为自主研发，是否合法合规。

1、发行人核心技术人员和专利发明人（包括已离职人员）的从业经历及其在技术形成过程中发挥的作用

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
1	骈文胜	核心技术人员、专利发明人	本科学历，电子精密机械专业。1993年-2000年任摩托罗拉（中国）电子有限公司设备经理；2000年-2004年任职于威宇科技测试封装（上海）有限公司；2004年-2009年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任测试厂长、封装厂长、资材处长；2009年-2016年任职于江苏长电科技股份有限公司，任事业中心总经理、集团海外销售副总裁；2016年11月至今任公司董事长、总经理。	1、基于 ARM 架构的高性能处理器的测试解决方案	1、项目统筹规划； 2、参与制定产品测试量产的规范并设计量产的流程和相应的管控机制； 3、技术规范评估。
				2、晶圆测试中烧写写入工艺防呆管控技术	1、项目统筹规划； 2、参与晶圆烧写写入工艺防呆管控技术的方案设计和相应的验收标准的制定。
				3、晶圆测试良率分析和优选管控技术	1、项目统筹规划； 2、参与设计测试良率分析架构体系和设备自动优选的方案核心代码分解。
				4、基于 TCG 架构的先进网络安全芯片晶圆测试解决方案	1、项目统筹规划； 2、参与研究网络安全芯片测试的核心难点，为解决方案提供技术路线。
				5、晶圆测试探针卡精密管控技术	1、项目统筹规划； 2、参与铂金针测试良率与针痕管控的方案设计。
2	闻国涛	核心技术人员、专利发明人	本本科学历，机械设计及其自动化专业。2001年-2004年任威宇科技测试封装（上海）有限公司设备工程师；2004年-2016年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任测试设备主管、经理、封装厂长、测试厂长；2016年5月至今任公司董事、副总经理。	1、高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案	1、项目可行性分析，落实专案前期立项工作 2、比对、分析、定制、优化技术方案； 3、制定验收标准及检验阶段性目标。
				2、解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	1、项目统筹规划； 2、参与稳压套环通过电极接线、电性连接于测试电极方案。
				3、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案	1、项目统筹规划； 2、参与研究测试的核心难点，为解决方案提供技术路线。
				4、测试机配置匹配提效技术	1、项目统筹规划； 2、参与调研设计测试机配置匹配规则； 3、参与测试机配置匹配流程的设计以及流程图的规划设计； 4、制定验收标准以及检验阶段性目标。
				5、晶圆测试探针卡精密管控技术	1、项目可行性分析，落实专案前期立项工作；

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
3	路峰	核心技术人员、专利发明人	本科学历，电子工程专业。1993-2000年任摩托罗拉（中国）电子有限公司IT自动化经理；2000年-2004年任威宇科技测试封装（上海）有限公司IT部门经理；2004年-2006年任日月光封装测试（上海）有限公司IT部门经理；2006年-2018年任职于晟碟半导体（上海）有限公司，历任IT部门经理、总监；2018年5月至今任公司董事、副总经理。	1、晶圆测试良率分析和优选管控技术	2、参与研究铂金探针的应用和整形的核心难点，为解决方案确定技术路线。 1、负责项目可行性分析，落实专案前期立项工作； 2、参与创建测试良率分析建模方案； 3、参与设计测试良率分析架构体系、设备优选数学模型； 4、制定验收标准以及检验阶段性目标。
				2、基于TCG架构的先进网络安全芯片晶圆测试解决方案	1、负责项目可行性分析，落实专案前期立项工作； 2、参与研究网络安全芯片测试的核心难点并针对性提出解决方案； 3、参与网络安全芯片软硬件测试方案的开设计、开发和调试。
4	刘琨	核心技术人员	本科学历，检测技术及仪器专业。1997年-2001年任摩托罗拉（中国）电子有限公司产品工程师；2001年-2004年任职威宇科技测试封装（上海）有限公司，历任高级产品工程师、产品工程主管；2004年-2005年任英特尔（上海）有限公司工程主管；2005年-2009年任泰瑞达（上海）有限公司应用工程经理，负责中国北方区域；2009年-2015年任北京汉迪龙科科技有限公司副总经理；2015年-2020年任上海旻艾半导体有限公司总经理；2020年2月至今，担任公司副总经理。	1、薄片晶圆测试技术	1、负责项目可行性分析，落实专案前期立项工作； 2、参与薄片晶圆测试技术路线设计； 3、参与薄片晶圆治具设计和工艺开发； 4、制定验收标准以及检验阶段性目标。
				2、可选择性导片装置	1、项目统筹规划； 2、负责可选择性导片材质选择和确定； 3、参与规划设计可选择性导片电路及与测试机的配合机制； 4、制定验收标准以及检验阶段性目标。
5	左上勇	专利发明人	本科学历，材料化学专业。2010年-2019年任职于日月光封装测试有限公司，历任测试设备工程师、测试开发工程师、开发主任工程师；2010年-2019年任职于上海月芯半导体科技有限责任公司，任开发主任工程师；2019年6月至今任公司研发中心总监。	1、5G通信射频前端晶圆测试解决方案	1、研究5G通信射频前端通用测试参数并进行晶圆可测性设计； 2、制定使用低频参数测试加数据仿真反馈产品射频性能的技术方案。
6	杨恭乾	专利发明人	本科学历，信息与计算科学专业。2009年-2013年任职中芯国际集成电路制造（上海）有限公司，历任IT测试部工程师，部门主管；2013年-2018年任职菲	1、测试机配置匹配提效技术	1、调研设计测试机配置匹配规则； 2、进行测试机配置匹配流程设计以及流程图的规划设计； 3、设计测试机配置匹配软件核心

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
7	傅郁晓	专利发明人	尼萨光电通讯(上海)有限公司, 历任高级工程师, IT 测试部经理, 高级经理; 2018 年 2 月至今任公司研发中心总监。		架构及进行功能模块分解开发。
				2、晶圆测试良率分析和优选管控技术	1、创建测试良率分析建模方案; 2、设计测试良率分析架构体系、设备优选数学模型; 3、设备自动优选方案核心代码的分解、开发与调试。
				3、基于 TCG 架构的先进网络安全芯片晶圆测试解决方案	1、研究网络安全芯片测试的核心难点并针对性提出解决方案; 2、网络安全芯片软硬件测试方案的设计、开发和调试。
			本科学历, 微电子专业。2007 年-2016 年任日月光封装测试(上海)有限公司测试设备主管; 2016 年 5 月-2020 年 7 月任上海伟测半导体科技有限公司研发中心经理; 2020 年 7 月至今任公司销售总监。	1、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案	1、进行高速高分辨率电流型数模转换器实际测试数据和理论数据的修调和数据校准处理; 2、对实际测试数据和测试结果进行稳定分析, 并参与测试方案的验收。
				2、晶圆测试中对位辅助调整装置	1、参与晶圆测试中对位过程的分析 and 总结, 制作对位动作流程图并分析其必要性和优化空间; 2、设计一种新型可以提高打点产品效率的模具, 以替代原有设备在对产品外围需要打四到五圈墨点的方案。
				3、WIFI6 无线网络通讯芯片测试解决方案	1、追踪 WIFI6 技术规范, 进行相关数据收集整理, 设计公司 WIFI6 通用测试规范以及相应的测试规格书; 2、根据行业标准和 WIFI6 通用测试规范制定项目验收标准。
				4、自动降温装置	1、参与研发自动降温装置。
				5、延长墨管使用寿命的装置	1、设计实验方法以及设计打点器的机械装置。
6、测试机配置匹配提效技术	1、测试机配置匹配需求分析和应用验证。				
7、晶圆测试中烧写写入工艺防呆管控技术	1、晶圆烧写写入工艺防呆管控技术的方案设计和相应验收标准的制定; 2、设计实验进行晶圆烧写写入工艺防呆管控技术的验证, 并进行风险分析。				
8、基于 ARM 架构的高性能处理器的测试解决方案	1、参与 ARM 架构的高性能处理器的测试项目规划、选定标的产品规范和设计测试硬件, 并进行测试程序的开发和设计; 2、制定产品测试量产的规范并设计量产的流程和相应的管控机制;				

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
					3、执行工程验证和工程验收的标准，并进行测试稳定性的评估。
				9、高性能汽车电子芯片测试解决方案	1、追踪高性能汽车电子行业技术规范，并和相关的设计公司进行测试规格和测试流程的规划设计，相应制定公司高性能汽车电子行业通用测试规范以及相应的测试流程； 2、制定符合行业标准的高性能汽车电子行业通用项目验收标准和规范。
8	张伟军	专利发明人	本科学历，电子科学与技术专业。2016年6月至今任公司研发中心工程师、经理。	1、解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	1、分析并设计实验验证背银、背金晶圆高压测试不稳定的原因和失效模式； 2、设计稳压装置来保持电极电压的稳定，解决 prober chuck 电源会影响测试的问题。
				2、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案	1、参与分析高速高分辨率电流型数模转换器测试的核心难点并提供相应的解决方案； 2、负责高速高分辨率电流型数模转换器软件测试方案的设计，开发和调试。
				3、晶圆外观检测平台的改造装置	1、根据新型的外观检测承载平台方案设计模具并进行仿真模拟； 2、制定新型模具验证流程和验收标准。
				4、WIFI6 无线网络通讯芯片测试解决方案	1、进行 WIFI6 无线测试的可行性分析和具体测试实现方案的构思，形成项目规划； 2、根据项目规划选定标的产品规范，设计测试硬件并进行测试程序的开发和设计。
				5、探针台自动清洁装置	1、系统分析芯片失效模式及原因； 2、基于失效芯片的数据，分析灰尘对芯片测试结果的影响； 3、参与设计、研发探针台自动清洁装置。
9	晏云飞	专利发明人	本科学历，电子信息与工程专业。2013年-2017年3月任职于京隆科技（苏州）有限公司，历任测试部门组长，代理课长；2017年3月至2018年5月任公司研发中心工程师。	1、测试机多方位使用兼容装置	1、根据方位运动控制机制和测试机需求规格设计新型测试机的空间运动机构，进行建模并设计整体构建图； 2、对新型测试机的空间运动机构进行模拟设计，并设计机构的生产制作图纸。
				2、高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案	1、分析高速数字通信芯片行业规范已经制定的技术规范，进行测



序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
					<p>试的可行性分析和具体测试实现方案的设计，形成项目规划；</p> <p>2、根据项目规划选定标的产品规范设计测试硬件，并进行测试程序的开发和设计。</p>
				3、探针台自动清洁装置	1、数据收集和分析，形成结案报告供项目研讨。
10	陈迎涛	专利发明人	本科学历。2007年-2016年历任日月光封装测试（上海）有限公司测试一厂生产组长，生产主任；2016年5月至今历任上海伟测生产经理，南京伟测厂长。	1、测试机多方位使用兼容装置	1、进行新型测试机的空间运动机构的制作和安装，并评估其实际效果是否符合预期； 2、测试机多方位使用兼容装置项目的验收。
				2、探针台自动清洁装置	1、评估喷吹管，脉冲电磁阀，气包，控制仪，出气嘴的选型和功能；
				3、芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术	1、进行熔丝烧调工艺精密控制的实验验证技术的开发，制定评价标准； 2、执行熔丝烧调工艺精密控制的实验验证，对稳定性及一致性进行分析。
				4、高性能汽车电子芯片测试解决方案	1、根据测试方案，进行测试硬件原理图、布线图的制作以及各种治具的设计； 2、执行各类硬件的制作，并制定和执行相应的硬件验收及标准。
11	周俊	专利发明人	本科学历，机械设计及其自动化专业。2008年-2017年5月任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任设备工程师，测试设备专案工程师，主任工程师；2017年7月至今历任公司上海伟测厂长、无锡伟测总经理。	1、测试机多方位使用兼容装置	1、分析现有测试机的空间运动机构，整理当前测试机无法实现全方位探测的原因，并提出具体控制模式； 2、提供需要增加的测试机方位运动控制机制并提供测试机需求规格。
				2、探针台自动清洁装置	1、设计自动清洁装置的机械图纸； 2、设计实验收集性能参数。
12	史小奇	专利发明人	专科学历，机电一体化专业。2007年-2017年任上海纪元微科电子有限公司测试工程师；2017年-2020年任上海伟测研发中心资深工程师；2020年至今历任无锡伟测研发中心经理、研发中心副总监。	1、晶圆测试过程中针痕精密管控工艺技术	1、针对集成电路针测过程容易扎偏的情况提出研发针痕管控的工艺技术思路； 2、设计防偏结构以及图纸。
				2、高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案	1、追踪高速数字通信芯片技术规范，和设计公司进行相关数据收集，整理高速数字通信芯片通用测试规范以及相应的测试规格书； 2、根据行业标准和高速数字通信芯片通用测试规范制定项目验收标准。

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
13	张洪亮	专利发明人	本科学历，电子信息工程专业。2009年-2011年任福州福顺半导体有限公司测试工程师；2011年-2015年任日月光封装测试（上海）有限公司测试设备工程师；2016年-2017年任歌尔股份有限公司测试部项目经理；2017年-2018年任公司研发中心工程师。	1、晶圆测试过程中针痕精密管控工艺技术	1、实验数据收集，及进行部分元器件焊接。
				2、高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案	1、根据制定好的高速数字通信芯片测试规范，制定产品测试量产的规范，并设计量产的流程和相应的管控机制； 2、执行高速数字通信芯片工程验证和工程验收，并进行测试稳定性的评估。
14	俞磊	专利发明人	本科学历，自动化专业。2011年-2016年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任品质工程师、专案工程师；2016年9月-2020年任公司研发中心工程师；2020年至今，任无锡伟测研发中心经理。	1、晶圆测试中对位辅助调整装置	1、根据设计图纸进行新型模具的制作并根据验证流程进行验证； 2、根据验收标准，执行新型模具的验收，评估实际效果。
				2、晶圆外观检测平台的改造装置	1、根据外观检测承载平台设计图纸进行新型模具的制作，并根据验证流程进行验证； 2、根据验收标准，执行外观检测承载平台模具的验收，并评估实际效果。
				3、WIFI6无线网络通讯芯片测试解决方案	1、根据测试硬件设计图纸，进行测试硬件的制作并制定测试硬件的验收规范； 2、执行测试硬件的验收并评估硬件性能的评估。
				4、晶圆测试过程中针痕精密管控工艺技术	1、设计测试管控工艺监控报警机制； 2、负责载板、导向套管、触杆和触控开关的选型。
				5、高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案	1、根据测试硬件设计图纸，对高速数字通信芯片进行测试硬件的制作并制定测试硬件的验收规范； 2、执行高速数字通信芯片测试硬件的验收并评估硬件性能的评估。
15	崔勇彬	专利发明人	本科学历。2016年至今历任公司生产组长、生产主任、生产经理。	1、解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	1、设计试验对当只有一个测试电极电压触点且离电压触点远时测试电压逐渐衰减情况的验证。
				2、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案	1、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆DOE测试的验证设计和操作； 2、测试流程设计和良率管控规则的制定。
				3、自动降温装置	1、分析降温装置的降温媒介以及在prober上使用的便捷性； 2、设计降温装置的机械图纸。
				4、延长墨管使用寿命的装置	1、分析油墨干涩的原因； 2、设计新的油墨打点器，增强油

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
16	关姜维	专利发明人	本科学历，电子信息科学与技术专业。2010年-2016年历任日月光封装测试（上海）有限公司工程师，工程主管；2016年6月至今任公司研发中心经理、总监。	1、高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案	1、高清图像传感器芯片晶圆主流测试方案的分析和提出通用化的设计方案； 2、设计通用性高、可程序控制、可执行校准的通用性光源解决方案； 3、设计通用性高模块化的程序架构方案。
				2、晶圆测试中对位辅助调整装置	1、根据新型模具的设计方案产生模具设计图纸并进行仿真模拟； 2、设计和制定新型模具验证流程和验收标准。
				3、晶圆外观检测平台的改造装置	1、分析现有晶圆外观检测平台机构并分析现有平台的承载平台的运动和控制机制的优缺点； 2、提出新型的一种真空吸附检测台的外观检测平台承载平台的运动和控制机制并分析可行性和风险管控机制。
				4、WIFI6无线网络通讯芯片测试解决方案	1、根据制定好的测试规范制定产品测试量产的规范，并设计量产的流程和相应的管控机制； 2、执行工程验证和工程验收的规范，并进行测试稳定性的评估。
				5、自动降温装置	1、设计实验步骤以及方法，评估不同媒介的降温效率；
				6、多平台联动提效技术	1、为提升测试机的使用效率，立项研发多平台联动机构； 2、设计信息采集模块。
				7、晶圆测试探针卡精密管控技术	1、参与技术规格的制定以及机台参数的选定； 2、设计并验证铂金探针整形后良率监控技术方案。
17	赵阿勇	专利发明人	专科学历。2016年-2018年8月任公司研发中心工程师。	1、自动降温装置	1、收集不同媒介的降温时间，汇总实验数据。
				2、延长墨管使用寿命的装置	1、收集不同规格油墨连续打点不干涩的数据并整理分析实验数据。
18	吉晋阳	专利发明人	本本科学历，电子信息工程专业。2009年-2016年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任测试设备主管、主任；2016年6月至今任公司研发中心经理、总监。	1、高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案	1、负责通用高清图像传感器芯片晶圆测试通用探针卡的设计并评估探针卡对光路的影响； 2、负责通用性高模块化的程序架构的程序的开发和调试。
				2、解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	1、负责稳压套环通过电极接线、电性连接于测试电极的方案设计；

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
					2、提供多种连接与测试电极的方案，并安排 DOE 方案验证。
				3、高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案	1、参与分析高速高分辨率电流型数模转换器测试的硬件难点并提供相应的解决方案； 2、负责高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试使用的硬件-屏蔽针卡的设计、制作和性能评估。
19	柴振极	专利发明人	本科学历。2016 年 7 月至今担任研发中心技术员、工程师。	1、解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	1、根据稳压套环通过电极接线、电性连接于测试电极方案和 DOE 方案，进行实验硬件的制作并进行设备的安装。
20	李峰	专利发明人	本科学历，电力系统及其自动化专业。2005 年-2007 年 1 月，在日月光封装测试（上海）有限公司担任厂务经理；2007 年-2016 年任上海峰越机电设备安装有限公司经理；2016 年至今，任公司厂务。	1、高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案	1、执行通用性光源和模块化的程序采集实验数据，并进行稳定性和准确性分析； 2、培训研发中心工程师光模块使用方法。
21	吴庆	专利发明人	本科学历，电子工程专业。2007 年-2015 年任职于晟碟半导体有限公司，历任设备组长，测试设备工程师；2015 年-2017 年任职于丽恒光微半导体，历任设备工程师，设备经理；2017 年 6 月至今任公司研发中心经理。	1、测试机配置匹配提效技术	1、测试机配置匹配代码撰写和调试。
				2、芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术	1、根据熔丝烧调工艺精密控制的实现方案提出具体的实施方式，并进行相应的外围电路设计； 2、对外围电路的设计进行制作，并对硬件进行相应的验收。
				3、高性能汽车电子芯片测试解决方案	1、根据标的产品的测试方案和硬件设计，执行具体测试项目的开发和调试，并执行相应的产品特性分析； 2、制定相应的测试项目开发的验收标准，并按照标准进行数据分析处理。
22	杨栓	专利发明人	本科学历。2013 年-2014 年上海樊境智能科技责任有限公司任销售经理；2014 年-2019 年任上海旻艾半导体有限公司测试工程师；2019 年 12 月至今任公司研发中心工程师。	1、多平台联动提效技术	1、设计技术图纸并制作样品； 2、分析待测晶圆的移动路径，模拟测试过程对移动次数进行计算。
				2、芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术	1、分析传统熔丝烧调工艺技术的实现方式，分析测试良率、稳定性以及研究传统技术是否可以满足未来的严格测试要求，如汽车电子和工业电子的严苛需求； 2、提出新型电子运用如汽车电子和工业电子对测试中熔丝烧调工艺的需求，并设计熔丝烧调工艺精密控制的实现方案及验收标准。
				3、高性能汽车电子芯片	1、分析汽车电子产品的通用特

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
				测试解决方案	点，根据汽车电子产品的测试开发特性选取和整理测试要求及测试规范； 2、根据标的产品的测试规范，制定相应的测试方案和根据产品制定相应的验收标准。
23	张丽霞	专利发明人	本科学历。2018年3月至今任公司研发中心工程师。	1、芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术	1、执行熔丝烧调工艺精密控制工艺化验证和DOE方案的设计； 2、执行熔丝烧调工艺精密控制技术的项目验收和工艺稳定分析。
				2、高性能汽车电子芯片测试解决方案	1、执行标的产品验证和数据分析确实测试的稳定性和数据的一致性； 2、设计DOE方案的设计和执行业并进行风险的评估。
24	刘栋栋	专利发明人	本科学历，电子信息工程专业，2013年-2018年年任矽品科技（苏州）有限公司测试产品工程师；2018年-2021年3月任公司研发中心工程师；2021年3月至今任无锡伟测研发中心经理。	1、多平台联动提效技术	1、设计控制系统包括信号配置单元、路径规划单元等； 2、进行多平台联动通讯驱动开发和GPIB信号调试。
25	袁常乐	专利发明人	本科学历，物理系电子信息科学与技术专业。2019年至今任公司研发中心工程师。	1、5G通信射频前端晶圆测试解决方案	1、执行测试硬件的设计、测试软件的开发和调试； 2、对测试结果和实验室测试结果进行一致性分析并优化测试算法。
26	王敏	专利发明人	本科学历，功能材料专业。2017年-2019年任日月光封装测试有限公司工程部产品测试工程师；2019年7月至2021年7月任公司研发中心工程师。	1、5G通信射频前端晶圆测试解决方案	1、设计验收规则和数据分析规则； 2、设计DOE验证的实验以及执行DOE的实验验证工作。
27	高大会	专利发明人	专科学历，电工电子专业。2002年-2004年任职于飞利浦光磁电子（上海）有限公司，任生产领班；2007年-2015年任职于日月光封装测试有限公司，历任储备组长，组长 生产管理师，主任；2015年2月-2015年9月任职于环维电子（上海）有限公司，任组长；2015年9月-2016年11月任职于环旭电子股份有限公司，历任组长，课长；2016年12月至今任公司生产经理。	1、晶圆测试良率分析和优选管控技术	1、进行自动优选方案验证和数据结果分析，并提供优化需求； 2、对自动优选方案进行验收和接收。
				2、基于TCG架构的先进网络安全芯片晶圆测试解决方案	1、进行网络安全芯片晶圆测试方案的实际测试稳定性分析，并和测试结果进行一致性分析； 2、进行网络安全芯片晶圆测试方案测试效率分析。
28	赵坤鹏	专利发明人	本科学历，机电一体化工程专业。2011年-2019年任日月光封装测试封装（上海）有限公司设备工程师；2019年-2020年任无锡华润微电子股份有限公司测试厂	1、测试方案开发的系统验证板	1、参与系统验证板的需求分析； 2、参与系统验证板原理图设计以及PCB layout出图； 3、制定参数验收标准。
				2、延长墨管使用寿命的	1、核对实验数据并提交报告给项

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
			设备主管；2020年4月至今担任无锡伟测研发中心经理。	装置	目组审核；
				3、低温测试工艺结霜控制技术	1、低温测试过程中测试硬件上产生冷凝结霜原因分析； 2、参与研发项目可行性分析以及方案制定； 3、设计解决料盘翘曲的压盘结构的技术方案； 4、机械装置图纸设计。
				4、32位微控制单元芯片晶圆测试解决方案	1、对通用型硬件重新设计和优化； 2、电路板原理图设计以及PCB layout出图； 3、自动开发软件代码的撰写并完善测试标准库。
				5、修调卡及线缆快速验证装置	1、线缆异常信息分类分析； 2、设计快速验证装置图纸并协调生产制作。
				6、测试机配置匹配提效技术	1、分析无法及时检测集成电路产品从分选机上掉落或者没有吸起的原因； 2、设计改善方案和装置图纸。
				7、自动降温装置	1、设计常高温快速切换的方案； 2、评估各种技术方案降温的时间以及成本。
				8、晶圆测试探针卡精密管控技术	1、设计防呆装置的结构； 2、确定防尘盖的评估选型； 3、对加工卡槽的密封性进行优化。
				29	杨征
2、低温测试工艺结霜控制技术	1、追踪方案验证实施结果以及实验数据收集； 2、对应用技术后的测试结果进行验证； 3、分析效率提升部分数据并提交报告； 4、参与验证装置的报警信息分类调试； 5、装置试验数据确认以及提交报告。				
3、32位微控制单元芯片晶圆测试解决方案	1、参与研发中心测试程序的自动化生成方法的设计； 2、电路板验收以及提交报告。				
4、修调卡及线缆快速验证装置	1、参与验证装置的异常信息分类归纳；				

序号	姓名	身份	从业经历	参与的核心技术	在技术形成过程中发挥的作用
					2、参与验收装置数据以及提交报告。
				5、晶圆测试探针卡精密管控技术	1、设计装置下单制作及交期追踪； 2、实验数据收集以及报告整理提交。
				6、试机配置匹配提效技术	1、参与验收装置数据以及提交报告。
				7、自动降温装置	1、降温装置机械图纸设计和加工制作； 2、实验数据收集以及报告整理。
30	张秀超	专利发明人	本科学历，物流管理专业。2013-2014年任日月光封装测试（上海）有限公司 QA LAB 工程师；2017年2月至今任公司研发中心工程师。	1、晶圆测试探针卡精密管控技术	1、设计并验证探针卡延长寿命方案； 2、设计探针台增加组合清针方案； 3、试验并确定失效验证分析办法。
31	赵怀菊	专利发明人	专科学历，电子商务专业。2014年1月-2015年5月，任欣阳精密模具（上海）有限公司质量工程师；2018年1月至今任公司研发中心工程师。	1、晶圆测试探针卡精密管控技术	1、设计并验证探针卡低温封孔解决方案； 2、设计并验证探针卡抗干扰处理方案； 3、试验并确定快速有效验证探针卡异常方法。

截至本补充法律意见书出具之日，上述核心技术人员与专利发明人中，晏云飞、赵阿勇、张洪亮、王敏、杨征等5人已离职，其余人员均尚在公司任职。

2、结合行业研发周期、客户认证周期、测试方案开发和验证周期，说明主营业务发展和核心技术形成的关键历史节点，技术来源是否为自主研发，是否合法合规

#### （1）行业研发周期

经本所律师核查，行业缺乏研发周期的相关统计数据，同行业上市公司和公开渠道亦未披露相关数据。报告期内发行人各类测试核心技术的研发周期一般在5-18个月之间。

#### （2）客户认证周期和测试方案开发和验证周期的一般情况

在客户认证周期方面，公司成为客户的合格供应商的认证过程一般包括双方初步接洽、签署保密协议、客户来厂参观及验厂、公司通过合格供应商认证等几个环节，整个认证周期一般在30天至90天之间。发行人针对某特定产品进行测试

方案开发和验证的周期一般为1-3个月左右。

### （3）公司主营业务发展过程

公司自设立以来，一直专注于经营集成电路测试服务业务。公司成立以来，主营业务的发展情况如下：

#### A. 2016年-2017年公司处于创业摸索和积累阶段，主要提供晶圆测试服务

公司成立之初，选择了技术含量高、市场竞争格局好的“晶圆测试”业务，在工厂选址上，选择毗邻中国最大的集成电路产业集群上海张江。在业务方面，公司得到了以晶丰明源、艾为电子等为代表的模拟类客户的认可，并开始逐步导入中高端测试平台及客户，拓展数字类的客户和测试服务。

#### B. 2018年-2019年公司进入快速成长阶段，并开始介入芯片成品测试业务

在该期间，公司不断完善整套测试作业体系，加强测试技术和测试工艺的研发投入，大力引进中高端测试平台，不断提升公司的高端测试服务能力。2019年末，鉴于公司在晶圆测试积累的客户基础以及行业口碑，公司又适时开拓芯片成品测试业务，为公司的发展创造了新的增长点。

C. 2020年至今，公司开始确立行业领先地位，确定了以“以晶圆测试为核心，积极发展中高端芯片成品测试”的差异化竞争策略

“高端化、顶尖客户、全力扩产”是这一阶段的公司发展策略，公司抓住“美国打压中国半导体行业，中国大陆的一线芯片设计公司加快测试服务供应商的国产化替代”的历史契机，一方面加大研发投入，重点突破6nm-14nm先进制程芯片、5G射频芯片、高性能CPU芯片、高性能计算芯片、FPGA芯片、复杂SoC芯片等各类高端芯片的测试工艺难点，另一方面快速扩充高端测试产能，使得公司具备承接中国大陆高端芯片设计公司测试订单的技术实力和产能规模。

### （4）公司核心技术形成的关键历史节点

截至本补充法律意见书出具之日，公司拥有的核心技术形成的关键历史节点情况如下：



序号	核心技术大类	技术形成的关键历史节点		
		时间节点	形成的核心技术	应用范围
1	测试方案开发技术	2016年-2017年	高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案	数模转换芯片
			高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案	图像传感芯片
		2018年-2019年	高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案	数据通信芯片
			WiFi6无线网络通讯芯片测试解决方案	无线网络芯片
			第3代快闪存储器IP的晶圆测试方案	存储器芯片
			基于TCG架构的先进网络安全芯片晶圆测试解决方案	安全芯片
			现场可编程逻辑门阵列芯片测试解决方案	FPGA芯片
		2020年以后	5G通信射频前端晶圆测试解决方案	5G射频前端芯片
			基于ARM架构的高性能处理器的测试解决方案	处理器芯片
			高性能汽车电子芯片测试解决方案	汽车芯片
			高性能区块链算力芯片晶圆测试方案	AI、区块链芯片
			32位微控制单元芯片晶圆测试解决方案	微控制器芯片
		2	测试工艺难点突破与精益测试提效技术	2016年-2017年
2018年-2019年	测试机配置匹配提效技术			晶圆测试、芯片成品测试
	晶圆测试中烧写写入工艺防呆管控技术			晶圆测试
	低温测试工艺结霜控制技术			晶圆测试、芯片成品测试
2020年以后	芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术			芯片成品测试
	晶圆测试良率分析和优选管控技术			晶圆测试
	薄片晶圆测试技术			晶圆测试
	多平台联动提效技术			晶圆测试
3	设备改造升级技术	2016年-2017年	测试机多方位使用兼容装置	晶圆测试、芯片成品测试
			解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	晶圆测试
			晶圆测试机抗干扰外壳装置	晶圆测试
		2018年-2019年	探针台自动清洁装置	晶圆测试
			晶圆外观检测平台的改造装置	晶圆测试
		2020年以后	晶圆测试机抗干扰外壳装置	晶圆测试
4	测试治具设计技术	2016年-2017年	延长墨管使用寿命的装置	晶圆测试
			晶圆测试中对位辅助调整装置	晶圆测试

序号	核心技术大类	技术形成的关键历史节点		
		时间节点	形成的核心技术	应用范围
5	自动化测试及数据分析技术	2018年-2019年	自动降温装置	晶圆测试
			测试方案开发的系统验证板	晶圆测试、芯片成品测试
		2020年以后	修调卡及线缆快速验证装置	晶圆测试、芯片成品测试
			可选择性导片装置	晶圆测试
			晶圆测试探针卡精密管控技术	晶圆测试
		2018年-2019年	数据挖掘与多维度分析系统	数据分析系统
			测试参数大数据多维度统计分析系统	数据分析系统
			生产稼动率统计分析和管控系统	数据分析系统
数据挖掘与多维度分析系统	数据分析系统			
2020年以后	Mapping 分析系统	数据分析系统		

### （5）技术来源及其合法合规性

公司是由骈文胜、闻国涛等几位在集成电路封测行业具有丰富从业经验的资深人士于2016年创立。公司设立时就对标国内一流和国际领先的测试企业，通过自主研发，不断攻克测试技术难点，提升服务水平和服务能力，立志通过技术驱动打造一家具有核心竞争力的独立第三方专业测试服务商。创立以来，公司高度重视技术研发，不断加大研发投入，通过自主研发和技术积累逐步形成了公司在测试方案开发、设备改造升级技术、测试治具设计、测试自动化和智能化等方面的核心技术。发行人主要技术均来源于自主研发，且拥有自主知识产权，不存在合作开发、委托开发的情形。截至本补充法律意见书出具之日，公司已经取得29项专利，其中有7项发明专利。公司核心技术的来源合法合规，均为自主研发，不存在来源于其他任何无关第三方。发行人现有专利、核心技术等无形资产不存在侵犯知识产权、商业秘密的情形，亦不存在权属纠纷或潜在纠纷。

三、结合核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）的任职经历，说明该等人员是否存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，是否存在纠纷或潜在纠纷。

核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）的任职经历详见本补充法

律意见书“第二部分/问题 2./二/1、发行人核心技术人员和专利发明人（包括已离职人员）的从业经历及其在技术形成过程中发挥的作用”。

### 1、核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）是否存在违反原任职单位关于竞业禁止的情形

根据公司核心技术人员、专利发明人提供的劳动合同、与原任职单位有交易的银行卡流水、原任职单位出具的说明等资料并经本所律师访谈核心技术人员和专利发明人，公司核心技术人员和专利发明人与原任职单位是否签订竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同以及是否获得竞业禁止补偿金等情况如下表所示：

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同	是否收到竞业禁止补偿金	是否违反竞业禁止约定	备注
1	骈文胜	核心技术人员、专利发明人	否	否	否	1、未签订竞业禁止协议，离职后未收到过竞业禁止补偿金； 2、原单位直属领导接受访谈，证明其不存在违反竞业禁止方面的纠纷、诉讼或仲裁； 3、原单位长电科技与公司一直保持良好的合作关系，且 2018 年和 2019 年长电科技均为公司的第一大客户；
2	闻国涛	核心技术人员、专利发明人	否	否	否	未签订竞业禁止协议且原任职单位出具其不负竞业禁止义务的说明
3	路峰	核心技术人员、专利发明人	是	否	否	1、离职后未收到过竞业禁止补偿金； 2、原单位直属领导接受了访谈，证明其不存在违反

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同	是否收到竞业禁止补偿金	是否违反竞业禁止约定	备注
						竞业禁止方面的纠纷、诉讼或仲裁； 3、原单位晟碟半导体从事存储器业务，与公司的业务不存在直接竞争关系；
4	刘琨	核心技术人员	否	否	否	未签订竞业禁止协议且原任职单位出具其不负竞业禁止义务的说明
5	左上勇	专利发明人	否	否	否	
6	杨恭乾	专利发明人	是	否	否	1、离职后未收到过竞业禁止补偿金； 2、原单位菲尼萨从事光通信业务，与公司的业务不存在直接竞争关系
7	傅郁晓	专利发明人	否	否	否	
8	张伟军	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	不适用	
9	晏云飞	专利发明人	否	否	否	
10	陈迎涛	专利发明人	否	否	否	
11	周俊	专利发明人	否	否	否	
12	史小奇	专利发明人	否	否	否	
13	张洪亮	专利发明人	否	否	否	
14	俞磊	专利发明人	否	否	否	
15	崔勇彬	专利发明人	否，入职前为自由职业	不适用	不适用	
16	关姜维	专利发明人	否	否	否	
17	赵阿勇	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	不适用	
18	吉晋阳	专利发明人	否	否	否	
19	柴振极	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	不适用	
20	李峰	专利发明人	否	否	不适用	原任职单位系其

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同	是否收到竞业禁止补偿金	是否违反竞业禁止约定	备注
						本人设立的公司
21	吴庆	专利发明人	否	否	否	
22	杨栓	专利发明人	否	否	否	
23	张丽霞	专利发明人	否，入职前为自由职业	不适用	不适用	
24	刘栋栋	专利发明人	否	否	否	
25	袁常乐	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	不适用	
26	王敏	专利发明人	否	否	否	
27	高大会	专利发明人	否	否	否	
28	赵坤鹏	专利发明人	否	否	否	
29	杨征	专利发明人	否	否	否	
30	张秀超	专利发明人	否	否	否	
31	赵怀菊	专利发明人	否	否	否	

如上表所示，公司核心技术人员和专利发明人中仅路峰、杨恭乾 2 人与原任职单位签订过竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同，由于其未收到过竞业禁止补偿金，因此不负竞业禁止的义务。其余人员因未签署过竞业禁止协议或含竞业禁止条款的劳动合同，并且未收到过竞业禁止补偿金，因此亦不负竞业禁止的义务。

## 2、核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）是否存在违反原任职单位关于保密协议约定的情形

根据公司核心技术人员、专利发明人提供的劳动合同、保密协议等资料并经本所律师访谈核心技术人员和专利发明人，公司核心技术人员、专利发明人与原任职单位是否签订保密协议或含保密条款的劳动合同以及是否违反保密约定等情况如下表所示：

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订保密协议或含保密条款的劳动合同	是否违反保密约定	备注
1	骈文胜	核心技术人员、专利发明人	是	否	原单位直属领导接受访谈，证明其不存在违反保密约定方面的纠纷、诉讼或仲裁

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订保密协议或含保密条款的劳动合同	是否违反保密约定	备注
2	闻国涛	核心技术人员、专利发明人	是	否	原任职单位出具其未违反保密义务的说明
3	路峰	核心技术人员、专利发明人	是	否	原任职单位直属领导接受访谈，证明其不存在违反保密约定方面的纠纷、诉讼或仲裁
4	刘琨	核心技术人员	是	否	原任职单位出具其未违反保密义务的说明
5	左上勇	专利发明人	是	否	
6	杨恭乾	专利发明人	是	否	
7	傅郁晓	专利发明人	是	否	
8	张伟军	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	
9	晏云飞	专利发明人	是	否	
10	陈迎涛	专利发明人	是	否	
11	周俊	专利发明人	是	否	
12	史小奇	专利发明人	是	否	
13	张洪亮	专利发明人	是	否	
14	俞磊	专利发明人	是	否	
15	崔勇彬	专利发明人	否，入职前为自由职业	不适用	
16	关姜维	专利发明人	是	否	
17	赵阿勇	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	
18	吉晋阳	专利发明人	是	否	
19	柴振极	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	
20	李峰	专利发明人	否	不适用	原任职单位系其本人设立的公司
21	吴庆	专利发明人	是	否	
22	杨栓	专利发明人	是	否	
23	张丽霞	专利发明人	否，入职前为自由职业	不适用	
24	刘栋栋	专利发明人	是	否	
25	袁常乐	专利发明人	否，入职时是应届生	不适用	
26	王敏	专利发明人	是	否	
27	高大会	专利发明人	是	否	
28	赵坤鹏	专利发明人	是	否	
29	杨征	专利发明人	是	否	

序号	姓名	身份	是否与原任职单位签订保密协议或含保密条款的劳动合同	是否违反保密约定	备注
30	张秀超	专利发明人	是	否	
31	赵怀菊	专利发明人	否	否	

如上表所示，公司核心技术人员、专利发明人中有 23 人与原任职单位签订了保密协议或包含保密条款的劳动合同。经本所律师访谈上述人员并对其进行网络核查，上述人员未违反保密约定且与原任职单位不存在诉讼、仲裁或其他纠纷。

### 3、核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）与原单位是否存在纠纷或潜在纠纷

根据公司核心技术人员、专利发明人提供的相关资料并经本所律师访谈、网络核查，公司核心技术人员和专利发明人与原任职单位不存在任何与竞业禁止义务、保密义务或知识产权相关的诉讼或仲裁，公司核心技术人员、专利发明人与原任职单位不存在纠纷或潜在纠纷。

## 四、核查过程

1、查阅发行人拥有的专利证书，并获取国家知识产权局出具的专利批量法律状态证明；

2、查阅发行人出具的 6 项发明专利在主营业务中具体应用情况的说明；

3、查阅核心技术人员、专利发明人与原任职单位的劳动合同或同时期劳动合同模板、保密协议（如有）、竞业禁止协议（如有）；

4、访谈骈文胜、路峰原任职单位的直属领导，查阅闻国涛、刘琨原任职单位出具的说明；

5、查阅发行人出具的说明，了解核心技术人员、其他专利发明人的从业经历、参与的专利发明情况、核心技术形成过程中发挥的作用以及核心技术形成的历史节点等；

6、访谈核心技术人员与专利发明人，了解其与原任职单位关于是否签订竞业禁止或竞业限制、保密义务相关协议以及是否收到原任职单位的竞业禁止补偿金等情况；

7、取得并查阅核心技术人员、在职的其他专利发明人与原任职单位有交易的银行卡流水；

8、通过中国裁判文书网、中国执行信息公开网等公开网站对发行人专利、核心技术人员及专利发明人是否存在纠纷的情况进行网络核查。

## 五、核查意见

经核查，本所律师认为：

1、公司 6 项发明专利均为公司自主研发，专利发明人均为公司员工，该 6 项发明专利均运用于发行人主营业务；

2、公司核心技术来源均为公司自主研发，合法合规；

3、公司核心技术人员、专利发明人（包括已离职人员）不存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，不存在纠纷或潜在纠纷。

（本页以下无正文）



(本页无正文,系《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书(二)》之签署页)



上海市锦天城律师事务所

Handwritten signature of Gu Gongtun

负责人: 顾功耘

经办律师: 乔文湘

经办律师: 夏瑜杰

2021年4月27日

上海市锦天城律师事务所  
关于上海伟测半导体科技股份有限公司  
首次公开发行股票并在科创板上市的

律师工作报告



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层  
电话：021-20511000 传真：021-20511999  
邮编：200120

## 目 录

声明事项.....	1
引 言.....	3
一、 律师事务所简介.....	3
二、 签字律师简介.....	3
三、 律师工作报告、法律意见书的制作过程.....	4
释 义.....	6
正 文.....	9
一、 本次发行上市的批准和授权.....	9
二、 发行人本次发行上市的主体资格.....	12
三、 发行人本次发行上市的实质条件.....	14
四、 发行人的设立.....	21
五、 发行人的独立性.....	24
六、 发起人、股东及实际控制人.....	26
七、 发行人的股本及演变.....	52
八、 发行人的业务.....	66
九、 关联交易及同业竞争.....	70
十、 发行人的主要财产.....	89
十一、 发行人的重大债权债务.....	99
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并.....	108
十三、 发行人章程的制定与修改.....	108
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	110
十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.....	112
十六、 发行人的税务.....	119
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.....	124
十八、 发行人募集资金的运用.....	126
十九、 发行人的业务发展目标.....	128
二十、 诉讼、仲裁及行政处罚.....	128
二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价.....	129
二十二、 发行人律师认为需要说明的其他问题.....	129
二十三、 结论意见.....	142

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于上海伟测半导体科技股份有限公司**  
**首次公开发行股票并在科创板上市的**  
**律师工作报告**

案号：01F20202132

**致：上海伟测半导体科技股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“伟测科技”）的委托，并根据发行人与本所签订的《聘请律师合同》，作为发行人首次公开发行股票并在科创板上市工作（以下简称“本次发行上市”）的特聘专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《科创板首发管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等有关法律法规的规定，就本次发行上市所涉有关事宜出具本律师工作报告。

### 声明事项

一、本所及本所经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称“《编报规则12号》”）等规定及本律师工作报告出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本律师工作报告所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

二、本所律师仅就与发行人本次发行上市有关的中国境内法律问题发表意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。在《法律意见书》和本律师工作报告中对有关会计、验资及审计、资产评估、境外法律事项等某些数据或结论的引述，并不表明本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所律师并不具备核查和评价该等非法律专业的数据或结论的适当资格。

三、本律师工作报告中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件发生时所应当适用的法律法规为依据。

四、本律师工作报告的出具已经得到发行人如下保证：

（一）发行人已经提供了本所为出具本律师工作报告所要求发行人提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。

（二）发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

五、对于本律师工作报告至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依据有关政府部门、发行人或其他有关单位等出具的说明或证明文件出具法律意见。

六、本所同意将本律师工作报告和法律意见书作为发行人本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

七、本所同意发行人部分或全部在《招股说明书（申报稿）》中自行引用或按上海证券交易所审核要求引用本律师工作报告内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

八、本律师工作报告仅供发行人为本次发行上市之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所及本所律师根据有关法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本律师工作报告。

## 引言

### 一、律师事务所简介

上海市锦天城律师事务所于 1999 年设立，注册地为上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层，在中国大陆二十一个城市（北京、杭州、深圳、苏州、南京、成都、重庆、太原、青岛、厦门、天津、济南、合肥、郑州、福州、南昌、西安、广州、长春、武汉、乌鲁木齐）及中国香港、英国伦敦、美国西雅图和新加坡开设分所，并在香港、深圳前海与史蒂文生黄律师事务所联营，与英国鸿鹄律师事务所 (Bird&Brid LLP) 建立战略合作关系。

本所主要提供直接投资、证券期货、金融银行、公司并购重组、知识产权、房地产、税收及劳动关系相关的诉讼及非诉讼业务，具有中国司法部、上海市司法局等政府机关颁发的专业资质证书，是一家能够为广大客户提供全方位法律服务的综合性律师事务所。

本所的服务宗旨：优质、高效、诚信、敬业。通过汇集法律行业的顶尖人才，本所能够在瞬息万变的商业环境中为境内外客户制定高水平的法律解决方案并提供高效率的法律服务。成立以来，本所多次被司法部、地方司法局、律师协会以及国际知名法律媒体和权威评级机构列为中国最顶尖的法律服务提供者之一。

### 二、签字律师简介

本所为发行人本次发行上市出具法律意见书和律师工作报告的签名律师为乔文湘、夏瑜杰。

乔文湘律师为上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人，法律硕士、工商管理博士，擅长证券与资本市场、银行与金融、公司并购重组等业务，曾参与江苏弘业永润国际贸易有限公司收购荷兰 RAVEN HOLDING B.V 公司、江苏省盐业集团有限责任公司收购香港彩裕集团、台湾 HTC 收购投资上海方付通商务服务有限公司等工作；曾参与深圳达实智能股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、江苏吉鑫风能科技股份有限公司、南京市测绘勘察研究院股份有限公司、上海创侨实业股份有限公司、科盛环保科技股份有限公司、常州天

正工业发展股份有限公司、鑫银科技集团股份有限公司等公司的上市、重组、改制等工作；同时担任多家公司的常年或专项法律顾问。

夏瑜杰律师为上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人，法学学士、哲学博士，中国上市公司的《界面金勋章奖》评审委员会委员。主要执业领域为资本市场、知识产权、房地产、企业法律内控以及民商事诉讼等法律业务，曾参与多家上市公司的 IPO 首发、重组以及香港、荷兰等境外公司的并购业务，主持发行了多支信托、企业私募债、短期融资券、基金等融资项目；同时担任多家公司的常年或专项法律顾问。

以上两位律师的联系方式为：

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 12 楼；

邮政编码：200120；

电话：021-20511000；

传真：021-20511999。

### 三、律师工作报告、法律意见书的制作过程

接受发行人委托后，由签字律师及本所其他若干律师、律师助理组成的项目工作组即全程参与了本次发行上市的各项法律工作。本所律师制作《法律意见书》和本律师工作报告的工作过程主要如下：

1、初步沟通及编制查验计划。本所律师首先与发行人本次发行上市工作组成员进行沟通，全面了解发行人的基本情况、股本演变、股权关系、组织架构、主要资产、重大债权债务、诉讼仲裁等。在此基础上，本所依据《证券法律业务执业规则》和中国证监会的其他有关规定，结合发行人实际情况编制了查验计划，确定了查验事项、查验工作程序和查验方法，查验事项涵盖了出具《法律意见书》和本律师工作报告所需调查的各方面情况，并就需书面审查的事项向发行人提交了法律尽职调查文件清单。在法律尽职调查文件清单提交后，本所律师向发行人对接人员说明了法律尽职调查的要求和责任，并就其在资料搜集过程中提出的相关问题进行了答复。

2、落实查验计划。为全面落实查验计划，本所项目工作组成员分工收集相关支持性文件和资料，遵循审慎性及重要性原则，合理、充分地运用了书面

审查、实地调查、与有关人员面谈、向国家机关查证、查询公开信息等方式进行查验，对发行人提供的文件材料之性质和效力进行了必要的分析和判断，以查证和确认有关事实。在查验过程中，项目工作组成员不时对查验计划的落实进度、效果等进行评估和总结，视情况进行适当调整，多次向发行人提交补充尽职调查文件清单。针对尽职调查工作中发现的问题，本所通过邮件和其他形式，及时向发行人提出了相应的建议和要求，督促与协助发行人依法予以解决。

3、指导发行人规范运作。在落实查验计划过程中，本所律师对发行人是否依法经营和规范运作进行了全面核实，并参照上市公司相关治理标准，对发行人进一步完善公司治理，加强规范运营提出相关建议，参与了发行人规范运作的辅导工作。

4、制作工作底稿。本所已经将《聘请律师合同》、查验计划、实施查验计划中收集到的重要文件资料（包括工商档案文件、公司存档文件、国家机关出具的批文、证照、证明文件、其他中介机构出具的专业报告、重大合同、有关方出具的说明函和确认函等）、拍摄的实地照片、制作的会议纪要、访谈笔录、网上查询结果截屏、《法律意见书》和本律师工作报告草稿等归类成册，制作成工作底稿。

5、律师工作报告和法律意见书的起草、内核与出具。本所律师按照《证券法》《科创板首发管理办法》和《编报规则 12 号》等有关法律法规的规定要求，根据发行人的情况，对完成的查验工作进行归纳总结，拟定《法律意见书》和本律师工作报告。此后，本所律师将律师工作报告和《法律意见书》提交本所证券业务内核委员会进行审核，并对内核委员提出的问题进行了回复并相应更新了律师工作报告和《法律意见书》。本所证券业务内核委员审核通过后，本所向发行人正式提交了本律师工作报告和《法律意见书》。截至本律师工作报告出具之日，本所律师就本次发行上市项目投入的工作时间已累计超过 4,000 个小时。



## 释 义

本律师工作报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述含义：

发行人、伟测科技、公司、股份公司	指	上海伟测半导体科技股份有限公司
伟测有限	指	上海伟测半导体科技有限公司，发行人前身
蕊测半导体、控股股东	指	上海蕊测半导体科技有限公司，发行人股东
芯伟半导体	指	上海芯伟半导体合伙企业（有限合伙），发行人股东
苏民智能	指	苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业（有限合伙），发行人股东
先锋智造	指	无锡先锋智造投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
韋泉元禾	指	江苏韋泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
深圳南海	指	深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙），发行人股东
新潮投资	指	江苏新潮创新投资集团有限公司，发行人股东
金浦新潮	指	南京金浦新潮创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
苏民投君信	指	苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
远海明晟	指	远海明晟（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
广西泰达	指	广西泰达新原股权投资有限公司，发行人股东
德同合心	指	苏州市德同合心创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
云泽裕庆	指	克拉玛依云泽裕庆股权投资有限合伙企业，发行人股东
南山基金	指	中小企业发展基金（深圳南山有限合伙），发行人股东
发行人主要股东	指	持有发行人 5% 以上股份的股东
智汇科创	指	深圳市智汇科创科技有限公司
长兴君桐	指	长兴君桐投资管理合伙企业（有限合伙）
韋泉致芯	指	苏州韋泉致芯股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东江苏韋泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）的前身
新潮科技	指	江苏新潮科技集团有限公司，发行人股东江苏新潮创新投资集团有限公司的前身
控股子公司、全资子公司、子公司	指	发行人合并报表范围内的全资、控股子公司
无锡伟测	指	无锡伟测半导体科技有限公司，发行人子公司
上海威矽	指	上海威矽半导体科技有限公司，发行人子公司
南京伟测	指	南京伟测半导体科技有限公司，发行人子公司

厦门伟测	指	厦门伟测半导体科技有限公司，发行人子公司，已注销
本所、锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
保荐机构、平安证券	指	平安证券股份有限公司
天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
A 股	指	境内上市人民币普通股
本次发行上市、本次发行	指	发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市
报告期、三年一期	指	2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月
《招股说明书（申报稿）》	指	发行人为本次发行上市制作的《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》
《上市保荐书》	指	保荐机构出具的《关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》
《预计市值的分析报告》	指	保荐机构出具的《关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之预计市值的分析报告》
法律意见书	指	《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》
《审计报告》	指	天健会计师出具的“天健审〔2021〕6-331 号”《上海伟测半导体科技股份有限公司审计报告》
《内控鉴证报告》	指	天健会计师出具的“天健审〔2021〕6-332 号”《关于上海伟测半导体科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》
《公司章程》	指	根据上下文意所需，指发行人及其前身制定并不时修订的公司章程，另有说明的除外
《公司章程（草案）》	指	发行人为本次发行上市制定的《上海伟测半导体科技股份有限公司章程（草案）》，于 2021 年 10 月 8 日经发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过，于发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌交易之日起生效
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《科创板首发管理办法》	指	《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《科创板股票上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《证券法律业务管理办法》	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《证券法律业务执业规则》	指	《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
《审核问答（二）》	指	《科创板股票发行上市审核问答（二）》
《编报规则 12 号》	指	《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》

《证券投资基金法》	指	《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募基金管理办法》	指	《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募基金登记备案办法》	指	《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
商标局	指	中华人民共和国国家知识产权局商标局
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
基金业协会	指	中国证券投资基金业协会
中国、境内	指	中华人民共和国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区），为本律师工作报告之目的，指中国大陆地区
境外	指	除中国大陆地区以外的国家及地区
法律法规	指	提及当时公布并生效的中国大陆法律、行政法规、地方性法规、规章以及规范性文件
国家企业信用信息公示系统	指	中华人民共和国国家市场监督管理总局主办的国家企业信用信息公示系统网站，其网址为 <a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a>
元、万元	指	人民币元、万元，上下文另有说明的除外

注：除特别说明外，本律师工作报告中若出现总计数与分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

## 正文

### 一、本次发行上市的批准和授权

(一) 2021年9月20日, 发行人召开第一届董事会第九次会议, 审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年分红回报规划的议案》《关于审议公司2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-6月财务报告及审计报告的议案》《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润处置方案的议案》《关于填补首次公开发行股票并在科创板上市摊薄即期回报影响分析及填补即期回报的措施、承诺的议案》《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》《关于制订公司相关制度的议案》《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》等与本次发行上市有关的议案, 并决定将上述议案提请发行人于2021年10月8日召开的2021年第二次临时股东大会审议。

经本所律师查验, 发行人董事会于2021年9月20日向发行人全体股东发出了召开2021年第二次临时股东大会的通知。

(二) 2021年10月8日, 发行人召开2021年第二次临时股东大会, 逐项审议批准了与本次发行上市有关的下述议案:

- 1、《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》
  - (1) 发行股票种类: 中国境内上市人民币普通股(A股);
  - (2) 发行股票面值: 每股面值为1元人民币;
  - (3) 发行数量: 以公司现行总股本6,540.8万股为基数, 本次拟公开发行

普通股不超过 2,180.27 万股（含 2,180.27 万股，未考虑本次发行的超额配售选择权），本次发行方案确定的拟发行股份数不低于发行后总股本的 25%。若公司股本在发行人因送股、资本公积转增股本等事项而发生变动的，则本次发行股票的发行数量将进行相应的调整。

公司本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。本次实际发行的股票数量将根据公司的资金需求、发行时证券市场的具体情况，由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律法规的规定、证券监管机构的批准情况和市场情况确定；

（4）发行对象：符合中国证监会或上交所规定资格的询价对象和在上交所开设股东账户且符合相关法律法规关于科创板股票投资者条件的境内自然人、法人投资者及其他机构（中国法律、法规和公司须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）；中国证监会或上交所等监管部门另有规定的，按其规定执行；

（5）定价方式：本次发行定价将在充分考虑公司现有股东利益的基础上，遵循市场化原则，根据本次发行时中国证券市场状况，由公司和主承销商根据符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象的询价结果确定，或届时通过中国证监会和上交所认可的其他方式确定；

（6）发行方式：采取网下向战略投资者配售、网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会、上海证券交易所许可的其他方式；

（7）战略配售：本次发行采用战略配售的，战略配售的对象包括但不限于符合条件的战略合作方、依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、公司的保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司、公司的高级管理人员与核心员工等依法设立的专项资产管理计划；

（8）承销方式：本次发行的承销方式为由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销；

（9）发行与上市时间：公司取得上交所同意股票公开发行并上市的审核意见并经中国证监会作出同意注册的决定之日起 12 个月内自主选择新股发行时点；公司首次公开发行股票经中国证监会同意注册并完成股份公开发行后，由

董事会与主承销商协商确定上市时间；

(10) 股票上市地点：上海证券交易所科创板；

(11) 募集资金用途：本次发行募集资金将用于无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目、集成电路测试研发中心建设项目及补充流动资金；

(12) 本次发行决议有效期：自本议案经公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

- 2、《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》
- 3、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年分红回报规划的议案》
- 4、《关于审议公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月财务报告及审计报告的议案》
- 5、《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润处置方案的议案》
- 6、《关于填补首次公开发行股票并在科创板上市摊薄即期回报影响分析及填补即期回报的措施、承诺的议案》
- 7、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》
- 8、《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》
- 9、《关于制订公司上市后适用的相关制度的议案》
- 10、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》
- 11、《关于确认公司最近三年一期关联交易事项的议案》
- 12、《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》

经本所律师查验，发行人 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、

与会股东资格、表决方式及决议内容，符合《证券法》《公司法》《科创板首发管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定；上述股东大会决议的内容合法有效，该次股东大会对董事会的授权范围、程序合法有效。

综上所述，本所律师认为，发行人 2021 年第二次临时股东大会已依法定程序做出批准本次发行上市的决议；股东大会决议中关于本次发行上市的内容合法有效；发行人股东大会已授权董事会办理本次发行上市相关事宜，该等授权的授权范围、程序符合有关法律法规以及公司章程的规定，合法有效。发行人本次发行上市尚需取得上交所的审核同意并经中国证监会注册，待完成公开发行后，股票上市尚需取得上交所的同意。

## 二、发行人本次发行上市的主体资格

### （一）发行人的基本情况

根据上海市市场监督管理局于 2021 年 6 月 17 日颁发的现行有效《营业执照》，并经本所律师对国家企业信用信息公示系统的公开查询，截至本律师工作报告出具之日，发行人基本信息如下：

企业名称	上海伟测半导体科技股份有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1H7PY66D
住所	上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 栋 2F
法定代表人	骈文胜
注册资本	6,540.8 万元人民币
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立日期	2016 年 05 月 06 日
经营期限	2016 年 05 月 06 日至 2066 年 05 月 05 日
经营范围	一般项目：半导体芯片的研发、测试、销售，电子器件制造（除显示器件、集成电路，有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的），电子产品、计算机软硬件的开发及销售，仪器仪表、机电设备的销售，自有设备租赁，从事半导体芯片测试领域内的技术服务、技术咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## （二）发行人为依法设立且合法存续的股份有限公司

根据发行人工商登记档案，并经本所律师查验，发行人系由伟测有限按账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，发行人设立的程序、资格、条件、方式等符合当时法律法规的规定[详见本律师工作报告正文之“四、发行人的设立”部分]。

根据发行人的公司章程，发行人是长期存续的股份有限公司。根据发行人的确认、以及本所律师对国家企业信用信息公示系统的公开查询，截至本律师工作报告出具之日，发行人未出现根据法律法规、发行人公司章程需要终止的情形。

## （三）发行人自伟测有限设立以来已持续经营三年以上

根据发行人的说明及《审计报告》、纳税资料等，并经本所律师查验，伟测有限设立时于2016年5月6日取得了上海市浦东新区市场监督管理局核发的《营业执照》。自伟测有限设立之日起算，至本律师工作报告出具之日，发行人持续经营时间已经超过三年。

## （四）发行人已经具备健全且运行良好的组织机构

经本所律师查验，发行人已经具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责[详见本律师工作报告正文之“十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”部分]。

综上所述，本所律师认为，发行人为依法设立、有效存续且持续经营时间三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《科创板首发管理办法》第十条之规定，具备本次发行上市的主体资格，截至本律师工作报告出具之日，发行人未出现根据法律法规及《公司章程》需要终止的情形。



### 三、发行人本次发行上市的实质条件

经逐条对照《公司法》《证券法》《科创板首发管理办法》《科创板股票上市规则》等中国法律法规的规定，本所律师认为，发行人符合股份有限公司公开发行新股及申请股票在科创板上市的相关实质条件：

#### （一）发行人本次发行上市符合《公司法》及《证券法》规定的相关条件

1、经本所律师查验，发行人已就本次发行上市聘请了平安证券作为保荐机构。

本所律师认为，符合《证券法》第十条第一款的规定。

2、根据发行人本次发行的《招股说明书（申报稿）》及发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过之《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》，发行人本次发行的股票均为人民币普通股（A 股）股票，每一股份具有同等权利，每股的发行条件和价格相同，发行价格根据向询价对象询价结果并参考市场情况确定，不低于票面金额。

本所律师认为，发行人符合《公司法》第一百二十六条、第一百二十七条的规定。

3、根据发行人 2021 年第二次临时股东大会会议文件并经本所律师查验，发行人本次发行已经依照《公司章程》的规定由股东大会和董事会对发行股票的种类、数量、价格、对象等事项作出决议。

本所律师认为，发行人符合《公司法》第一百三十三条的规定。

4、经本所律师查验，发行人已设立了股东大会、董事会、监事会及董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，选举了董事（包括独立董事）、各董事会专门委员会委员、监事（包括职工代表监事），并聘请了总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员，在报告期内发行人根据《公司章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会会议，历次股东大会、董事会和监事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规以及当时适用的《公司章程》的规定。

本所律师认为，发行人符合《证券法》第十二条第一款第（一）项之规定。

5、经本所律师查验及发行人的确认，发行人为长期存续的股份有限公司，其依照法律的规定在其经营范围内开展经营活动，截至本律师工作报告出具之日，发行人依法有效存续，生产经营正常，具备生产经营所需的各项资质证书，能够支付到期债务，不存在影响其持续经营的法律障碍，具有持续经营能力。根据《审计报告》，发行人业务在报告期内有包括现金流量、营业收入、交易客户、管理费用支出等内容的持续营运记录；截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项，亦不存在依据《公司法》《公司章程》规定需要解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形。

本所律师认为，发行人符合《证券法》第十二条第一款第（二）项之规定。

6、根据《审计报告》，发行人有关会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。经本所律师查验，天健会计师针对发行人最近三年一期的财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》。

本所律师认为，发行人符合《证券法》第十二条第一款第（三）项之规定。

7、根据发行人及其控股股东、实际控制人出具的确认、公安机关出具的无犯罪记录证明、本所律师与实际控制人、发行人主要负责人的面谈及通过中国证监会、中国执行信息公开网等网站的公开查询，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪。

本所律师认为，发行人符合《证券法》第十二条第一款第（四）项之规定。

**（二）发行人本次发行上市符合《科创板首发管理办法》规定的发行条件**

1、经本所律师查验，发行人是依法设立且持续经营 3 年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，具备本次发行上市的主体资格。

本所律师认为，发行人符合《科创板首发管理办法》第十条之规定[详见本律师工作报告正文之“二、发行人本次发行上市的主体资格”部分]。

2、根据《审计报告》以及发行人的确认，并经本所律师访谈发行人财务总监，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由天健会计师出具了标准无保留意见的《审计报告》。

本所律师认为，发行人符合《科创板首发管理办法》第十一条第一款之规定。

3、根据《内控鉴证报告》及发行人的确认，并经本所律师查验，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由天健会计师出具了无保留结论的《内控鉴证报告》。

本所律师认为，发行人符合《科创板首发管理办法》第十一条第二款之规定。

4、根据发行人的确认，并经本所律师查验，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立[详见本律师工作报告正文之“五、发行人的独立性”部分]，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争[详见本律师工作报告正文之“九、关联交易及同业竞争”部分]，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易[详见本律师工作报告正文之“九、关联交易及同业竞争”部分]。

本所律师认为，发行人符合《科创板首发管理办法》第十二条第（一）项之规定。

5、经本所律师查验，最近 2 年内发行人主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员没有发生重大不利变化，实际控制人没有发生变更。

(1) 根据招股说明书（申报稿）及发行人工商档案，并经本所律师查验，发行人的主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。发行人最近两年内主营业务没有发生重大变化[详见本律师工作报告正文之“八、发行人的业务”部分]。

(2) 根据发行人的说明，并经本所律师查阅发行人股东大会和董事会关于选举董事、高级管理人员的决议、核心技术人员与发行人及子公司签署的劳动合同等资料，查验最近两年发行人董事、高级管理人员及核心技术人员的变化情况，最近两年发行人董事、高级管理人员变化主要系因公司完善治理结构等原因引起，未对发行人经营管理造成实质性影响，发行人董事和高级管理人员最近两年内未发生重大不利变化；发行人最近两年核心技术人员未发生重大不利变化[详见本律师工作报告正文之“十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”部分]。

(3) 根据发行人的工商档案、《发起人协议》、《公司章程》等文件，并经发行人股东书面确认，发行人的股权清晰，控股股东所持有的发行人股份不存在重大权属纠纷，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

本所律师认为，发行人符合《科创板首发管理办法》第十二条第（二）项的规定。

6、根据发行人的确认，并经本所律师查验，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷[详见本律师工作报告正文之“十、发行人的主要财产”部分]，发行人不存在重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项[详见本律师工作报告正文之“十一、发行人的重大债权债务”及“二十、诉讼、仲裁及行政处罚”部分]。根据《招股说明书（申报稿）》及本所律师与发行人管理层的访谈，截至本律师工作报告出具之日，在其合理预见范围内，不存在发行人所处行业的经营环境已经或者将要发生重大变化并对发行人持续经营有重大不利影响的情形，亦不存在其他对发行人持续经营有重大不利影响的事项，发行人已经在《招股说明书（申报稿）》披露了相关风险因素。

本所律师认为，发行人符合《科创板首发管理办法》第十二条第（三）项之规定。

7、根据《招股说明书（申报稿）》及发行人的说明，发行人的主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。发行人及子公司所从事的业务均在工商行政管理部门登记的经营范围内，发行人主营业务所属的行业亦为国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年修订）中的“鼓励类”产业。其经营符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，符合国家产业政策[详见本律师工作报告正文之“八、发行人的业务”部分]。经本所律师查验，发行人持有经营所需的各项资质证书，有关证书均在有效期内[详见本律师工作报告正文之“八、发行人的业务”之“（二）发行人及子公司取得的的资质、许可、备案文件”]。经本所律师比对国家发展和改革委员会颁布之《产业结构调整指导目录（2019年本）》及中华人民共和国环境保护部颁布之《环境保护综合名录（2021年版）》，发行人现有经营不涉及前述产业结构调整指导目录中列示的限制类和淘汰类产业，发行人现有产品不属于前述环境保护综合名录中列示的高污染、高环境风险产品。

本所律师认为，发行人符合《科创板首发管理办法》第十三条第一款之规定。

8、根据发行人及其控股股东、实际控制人出具的确认文件，并经本所律师与发行人主要负责人的面谈，并经本所律师通过中国证监会、中国执行信息公开网等网站进行公开查询，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

本所律师认为，发行人符合《科创板首发管理办法》第十三条第二款之规定。

9、根据发行人的确认、发行人董事、监事及高级管理人员填写的调查表、声明和承诺、公安机关出具的无犯罪记录证明，并经本所律师通过中国证监

会、中国执行信息公开网等网站的公开查询，发行人的现任董事、监事和高级管理人员不存在最近 3 年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

本所律师认为，发行人符合《科创板首发管理办法》第十三条第三款之规定。

### （三）发行人本次发行上市符合《科创板股票上市规则》规定的上市条件

1、如本律师工作报告前文所述，发行人满足《科创板首发管理办法》第十条至第十三条规定的发行条件。

本所律师认为，发行人符合《科创板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（一）项之规定。

2、根据发行人的历次验资报告以及发行人现时有效的《营业执照》，发行人本次发行上市前股本总额为 6,540.8 万元，发行后股本总额不会低于 3,000 万元。

本所律师认为，发行人符合《科创板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（二）项之规定。

3、根据经发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》及《招股说明书（申报稿）》，发行人本次发行前股份总数为 6,540.8 万股，发行人本次拟向社会公开发行的股份数不超过 2,180.27 万股，本次发行方案确定的拟发行股份数不低于发行后总股本的 25%。

本所律师认为，发行人符合《科创板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（三）项之规定。

4、根据《上市保荐书》及《预计市值的分析报告》，发行人的预计市值不低于 10 亿元。根据《审计报告》，发行人 2020 年度经审计的净利润为 34,846,264.67 元且营业收入为 161,196,220.78 元，最近一年净利润为正且营业

收入不低于人民币 1 亿元，发行人的市值及财务指标符合《科创板股票上市规则》第 2.1.2 条规定的第一项标准。

本所律师认为，发行人符合《科创板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（四）项之规定。

#### **（四）发行人符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（1）-（4）项之规定**

1、根据《审计报告》，发行人 2018 年、2019 年、2020 年的研发费用分别为 7,700,810.45 元、13,371,662.77 元、21,013,963.09 元，占最近三年营业收入的比例分别为 17.63%、17.16%、13.04%，满足最近三年研发投入占营业收入比例 5% 以上的要求，符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（1）项之规定。

2、根据《招股说明书（申报稿）》，研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%，因此符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（2）项之规定。

3、经本所律师查验有关专利证书以及本所律师通过国家知识产权局公开信息的查询，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司合法拥有 6 项形成主营业务收入的发明专利。[详见本律师工作报告正文第十部分之“（二）发行人拥有的知识产权”]，因此符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（3）项之规定。

4、根据《审计报告》，发行人 2018 年、2019 年、2020 年的营业收入分别为 43,689,477.38 元、77,933,235.29 元、161,196,220.78 元，复合增长率超过 20%，因此符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（4）项之规定。

综上，本所律师认为，发行人本次发行上市已经满足《公司法》《证券法》《科创板首发管理办法》《科创板股票上市规则》《科创属性评价指引（试行）》规定的各项实质条件，尚需取得上交所的审核通过并经中国证监会同意注册，待完成公开发行后，股票上市尚需取得上交所的同意。

## 四、发行人的设立

### （一）发行人前身伟测有限的设立

发行人前身伟测有限成立于 2016 年 5 月 6 日[具体情况参见本律师工作报告正文之“七、发行人的股本及演变”]。

根据发行人的工商档案，本所律师认为，伟测有限系以全部资产为限对其债务承担责任的有限责任公司，其设立程序合法、合规。

### （二）发行人设立的程序、资格、条件和方式

#### 1、设立程序

##### （1）名称预核准

2020 年 7 月 3 日，上海市市场监督管理局出具“沪市监注名预核字第 01202007031230 号”《企业名称变更登记通知书》，同意伟测有限申请变更的企业名称为“上海伟测半导体科技股份有限公司”。

##### （2）伟测有限的股东会

2020 年 7 月 15 日，伟测有限召开股东会并作出决议，同意伟测有限由有限责任公司整体变更并发起设立为股份有限公司，伟测有限全体股东均作为拟变更设立的股份有限公司的发起人，公司名称变更为上海伟测半导体科技股份有限公司等事项。

##### （3）审计、评估

为整体变更设立股份有限公司，伟测有限聘请了天健会计师于 2020 年 7 月 14 日出具“天健审（2020）6-241 号”审计报告，确认伟测有限截至 2020 年 4 月 30 日经审计的账面净资产为 225,722,993.10 元；聘请了坤元资产评估有限公司于 2020 年 7 月 15 日出具“坤元评报（2020）1-46 号”资产评估报告，确认伟测有限截至 2020 年 4 月 30 日的净资产评估值为 242,015,030.83 元。

##### （4）发起人协议

2020 年 7 月 15 日，伟测有限全体股东签署《发起人协议》，发起人同意将伟测有限经审计的净资产按 4.51445986:1 的比例折为股份公司的股本，折股



后人民币 5,000 万元作为股份有限公司的注册资本，净资产与股本的差额全部作为股份公司的资本公积金。

#### （5）召开职工代表大会

2020 年 7 月 15 日，伟测有限召开职工代表大会并作出决议，选举乔从缓担任第一届监事会职工代表监事。

#### （6）召开创立大会

2020 年 7 月 18 日，伟测有限全体股东召开上海伟测半导体科技股份有限公司创立大会并作出决议，同意发起设立股份公司；以伟测有限截至 2020 年 4 月 30 日经审计的账面净资产 225,722,993.10 元折合为股份公司注册资本 5,000 万元，超过注册资本的净资产全部计入资本公积；通过股份公司章程；选举骈文胜、路峰、闻国涛、陈凯、祁耀亮、俞克为股份公司董事，选举徐伟、林秀强、王怀芳为股份公司独立董事；选举周歆瑶、高晓为股份公司监事会监事，与职工代表大会选举的职工代表监事乔从缓共同组成股份公司第一届监事会；确认股份公司设立费用；授权股份公司董事会办理登记手续。

#### （7）验资

2020 年 9 月 7 日，天健会计师出具“天健验〔2020〕6-66 号”验资报告，确认截至 2020 年 7 月 31 日止，伟测有限已收到全体出资者所拥有的截至 2020 年 4 月 30 日止上海伟测半导体科技有限公司经审计的净资产 225,722,993.10 元，根据《公司法》的有关规定，按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收股本伍仟万元整（¥50,000,000.00 元），资本公积 175,722,993.10 元。

#### （8）工商登记

2020 年 9 月 4 日，上海市市场监督管理局准予了伟测科技的变更登记登记（NO.00000003202008280007），并通知 10 个工作日换领新的《营业执照》。

## 2、发起人的资格

根据发行人的说明及发起人的营业执照、公司注册证书等资料，并经本所律师查验，发行人共有 9 名发起人，均具备设立股份有限公司的资格[具体情况参见本律师工作报告正文之“六、发起人、股东及实际控制人”]。

### 3、发行人的设立条件

经本所律师查验，发行人具备以下条件：

- (1) 发起人共有 9 名，符合法定人数，且半数以上在中国境内拥有住所；
- (2) 发起人认购股份有限公司设立时的全部股份，且筹办事项符合法律规定；
- (3) 发起人共同制定了发行人的《公司章程》；
- (4) 发行人有公司名称，并且建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等股份有限公司应当具备的组织机构；
- (5) 发行人具有法定住所。

据此，本所律师认为，发行人设立时已符合《公司法》等中国法律法规的相关股份公司设立条件。

### 4、发行人设立的方式

经本所律师查验，发行人系由伟测有限按原账面净资产值整体折股变更为股份有限公司，整体变更不存在累计未弥补亏损的情形，公司设立方式符合法律法规的规定。

据此，本所律师认为，发行人设立的程序、资格、条件和方式，符合法律法规的规定，合法、有效。

#### (三) 《发起人协议》

2020 年 7 月 15 日，蕊测半导体、韋泉元禾、苏民智能、深圳南海、金浦新潮、芯伟半导体、新潮科技、涂洁、先锋智造共 9 名发起人签署《发起人协议》，约定作为发起人共同设立股份有限公司，并就股本与股份比例，各发起人的权利义务以及筹建发行人的相关事宜、违约责任等进行了约定。

据此，本所律师认为，发行人设立过程中签署的《发起人协议》，符合法律法规的规定。

(四) 发行人由有限责任公司整体变更为股份有限公司过程中的审计、评估及验资

发行人就本次整体变更履行了相应的审计、评估及验资手续[详见本律师工作报告正文之“四、发行人的设立”之“(二) 发行人设立的程序、资格、条件和方式”]。

据此，本所律师认为，发行人由有限责任公司整体变更为股份有限公司过程中已经履行了有关审计、评估及验资等必要程序，符合法律法规的规定。

#### **(五) 发行人创立大会的程序及所议事项**

##### **1、发行人创立大会的召集、召开程序**

2020年7月18日，上海伟测半导体科技股份有限公司召开了创立大会，全体发起人均出席了本次会议，并对会议提案进行了审议和表决。

##### **2、发行人创立大会所议事项**

本次会议审议事项：（1）关于伟测科技筹办情况的报告；（2）伟测科技公司章程；（3）选举股份公司第一届董事会成员；（4）选举股份公司第一届监事会成员（非职工代表监事）；（5）伟测科技的设立费用；（6）授权伟测科技董事会办理变更登记。

据此，本所律师认为，发行人设立时股东大会的程序及所议事项符合法律法规的规定。

综上，本所律师认为，发行人设立的程序、发起人资格、条件和方式，符合法律法规的规定；发行人设立过程中签署的《发起人协议》符合有关法律法规的规定，不会因此引致发行人设立行为存在潜在纠纷；发行人设立过程中已履行了必要的评估、审计、验资程序，符合法律法规的要求；发行人创立大会的程序及所议事项符合法律法规的规定。

## **五、发行人的独立性**

### **(一) 发行人的资产独立完整**

根据相关资产评估报告、验资报告，经本所律师查验，发行人设立已经会计师事务所验证，发行人注册资本已足额缴纳。根据发行人提供的不动产登记证书、商标注册证、专利证书等有关文件资料，发行人合法拥有与经营相关的

不动产权、注册商标权、专利权，且不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用的情形。据此，本所律师认为，发行人的资产独立完整。

## （二）发行人的人员独立

根据发行人与其高级管理人员签订的劳动合同以及发行人提供的董事、监事及高级管理人员收入情况说明并经本所律师查验，发行人的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均与发行人及子公司签订劳动合同，均在发行人领取薪酬。发行人的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领取薪酬，且发行人的财务人员也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。据此，本所律师认为，发行人在人员方面具有独立性。

## （三）发行人的财务独立

经发行人说明、本所律师访谈发行人财务总监并经本所律师查验，发行人已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度；发行人独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；发行人的财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。据此，本所律师认为，发行人在财务方面具有独立性。

## （四）发行人的机构独立

根据发行人提供的组织结构图并经本所律师实地调查，发行人设立了制造部、研发中心、销售客服部、质量部、采购部、人力资源部、财务部等内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。不存在发行人内部经营管理机构与其控股股东、实际控制人控制的其他企业发生机构混同的情形。据此，本所律师认为，发行人在机构方面具有独立性。

## （五）发行人的业务独立

根据《招股说明书（申报稿）》及发行人的说明，发行人的主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。根据天健会计

师出具的《审计报告》，并经本所律师查验，发行人业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争[详见本律师工作报告正文之“九、关联交易及同业竞争”之“（六）同业竞争”部分]，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易[详见本律师工作报告正文之“九、关联交易及同业竞争”之“（二）关联交易”部分]。据此，本所律师认为，发行人在业务方面具有独立性。

综上，本所律师认为，发行人资产独立完整，业务、人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

## 六、发起人、股东及实际控制人

### （一）发起人

发行人系伟测有限整体变更设立的股份有限公司。经本所律师查验，发行人设立时共有 9 名发起人，分别为蕊测半导体、韋泉元禾、苏民智能、深圳南海、金浦新潮、芯伟半导体、新潮科技、涂洁、先锋智造。发行人的上述发起人中，1 名发起人为中国国籍自然人，2 名发起人为依照中国法律设立的有限责任公司，6 名发起人为依照中国法律设立有限合伙企业。

经本所律师查验：

- 1、发起人人数、住所、出资比例符合有关法律法规的规定；
- 2、发起人均依法具有相应的民事权利能力和民事行为能力，符合当时有关法律法规的规定，具备向发行人出资、成为发起人股东的资格；
- 3、发起人已投入发行人的资产产权关系清晰，将该等资产投入发行人不存在法律障碍；
- 4、发起人不存在将其全资附属企业或其他企业先注销再以其资产折价入股的情况，也不存在以其他企业中的权益折价入股的情形；
- 5、发起人投入发行人的资产独立完整，相关资产或权利的财产权转移手续已经办理完毕，不存在法律障碍和风险；

6、发行人是由有限责任公司整体变更为股份有限公司，原伟测有限的债权债务依法由股份有限公司承继，不存在法律障碍和风险。

## （二）发行人的现有股东

经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人共有 16 名股东，其中自然人股东 2 名，机构股东 14 名。发行人的股权结构情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	蕊测半导体	27,032,838	41.3296
2	深圳南海	5,327,516	8.1451
3	遑泉元禾	5,304,716	8.1102
4	苏民智能	4,684,516	7.1620
5	苏民投君信	4,604,867	7.0402
6	金浦新潮	3,086,086	4.7182
7	南山基金	3,035,200	4.6404
8	芯伟半导体	2,247,669	3.4364
9	新潮投资	2,240,713	3.4257
10	涂洁	1,680,867	2.5698
11	顾成标	1,636,800	2.5024
12	远海明晟	1,560,000	2.3850
13	德同合心	1,400,000	2.1404
14	广西泰达	836,600	1.2790
15	先锋智造	449,612	0.6874
16	云泽裕庆	280,000	0.4281
	总计	<b>65,408,000</b>	<b>100</b>

### 1、自然人股东的基本情况

根据发行人自然人股东提供的身份证件及填写的调查表等资料，并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人 2 名自然人股东基本情况如下：

序号	姓名	国籍	身份证/护照号码	住址	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	涂洁	中国	362201195906*****	广州市番禺区洛浦街珠江花园*****	否
2	顾成标	中国	310101196508*****	上海市徐汇区天等路 258 弄*****	否

## 2、机构股东的基本情况

### (1) 蕊测半导体

根据蕊测半导体现行有效的营业执照、公司章程，并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统的公开查询，截至本律师工作报告出具之日，蕊测半导体的基本情况如下：

公司名称	上海蕊测半导体科技有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1H7APM9G
注册地址	上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 C303 室
法定代表人	骈文胜
注册资本	2,396 万元人民币
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
营业期限	2015 年 12 月 29 日至 2025 年 12 月 28 日
经营范围	一般项目：从事半导体科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理咨询，信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据蕊测半导体的工商档案，并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，蕊测半导体各股东及其股权结构情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	骈文胜	1,235	51.5442
2	闻国涛	621	25.9182
3	路峰	230	9.5994
4	李峰	80	3.3389

5	邵颖	130	5.4257
6	智汇科创	100	4.1736
合计		<b>2,396.00</b>	<b>100</b>

根据蕊测半导体出具的说明并经本所律师核查，蕊测半导体不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，也不存在由基金管理人进行管理、基金托管人进行托管的情形。因此，蕊测半导体无需按照《私募基金管理办法》《私募基金登记备案办法》等相关法律法规规定履行登记备案程序。

## (2) 惠泉元禾

根据惠泉元禾现行有效的营业执照、合伙协议，并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统的公开查询，截至本律师工作报告出具之日，惠泉元禾的基本情况如下：

企业名称	江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320594MA1UYHED37
注册地址	苏州工业园区苏虹东路 183 号 19 栋 3 楼 301 室
执行事务合伙人	苏州致芯方维投资管理合伙企业（有限合伙）
合伙期限	2018-01-25 至 2029-12-31
经营范围	从事非证券股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据惠泉元禾提供的工商档案，惠泉元禾的合伙人及合伙份额的情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比例 (%)	合伙人类型
1	苏州致芯方维投资管理合伙企业（有限合伙）	3,000	0.9146	普通合伙人
2	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	70,000	21.3415	有限合伙人
3	苏州元禾控股股份有限公司	75,000	22.8658	有限合伙人
4	江苏省政府投资基金（有限合伙）	45,000	13.7195	有限合伙人
5	苏州亚投荣基股权投资中心（有限合伙）	80,000	24.3902	有限合伙人
6	上海清恩资产管理合伙企业	4,375	1.3338	有限合伙人



序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比例 (%)	合伙人类型
	(有限合伙)			
7	深圳市鲲鹏股权投资有限公司	20,000	6.0976	有限合伙人
8	苏州汾湖创新产业投资中心 (有限合伙)	20,000	6.0976	有限合伙人
9	长三角协同优势产业股权投资 合伙企业(有限合伙)	6,250	1.9055	有限合伙人
10	上海科创中心二期私募投资基 金合伙企业(有限合伙)	4,375	1.3338	有限合伙人
合计		<b>328,000</b>	<b>100</b>	--

经本所律师查询基金业协会网站公示的私募投资基金管理人或私募投资基金信息，惠泉元禾属于《证券投资基金法》《私募证券投资基金管理办法》及《私募证券投资基金登记备案办法》等相关法律法规规定的私募投资基金，并已经在基金业协会办理备案手续，具体情况如下：

基金名称	江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)
基金编号	SCW352
备案时间	2018年5月21日
基金类型	股权投资基金
基金管理人名称	元禾璞华(苏州)投资管理有限公司
基金管理人登记编号	P1067993

### (3) 苏民智能

根据苏民智能现行有效的营业执照、合伙协议，并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统的公开查询，截至本律师工作报告出具之日，苏民智能的基本情况如下：

企业名称	苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业(有限合伙)
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320206MA1Q5KRT3A
注册地址	无锡惠山经济开发区智慧路5号北-1808
执行事务合伙人	无锡苏民高科投资管理有限公司
合伙期限	2017-08-29至2024-08-28
经营范围	股权投资；利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据苏民智能提供的工商档案，并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，苏民智能的合伙人及合伙份额情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比 例 (%)	合伙人类型
1	无锡苏民高科投资管理有限公司	1,000	2.0000	普通合伙人
2	无锡太湖浦发股权投资基金企业 (有限合伙)	15,000	30.0000	有限合伙人
3	江苏民营投资控股有限公司	23,000	46.0000	有限合伙人
4	无锡惠开投资管理有限公司	10,000	20.0000	有限合伙人
5	无锡华科大孵化有限公司	1,000	2.0000	有限合伙人
合计		50,000	100	--

经本所律师查询基金业协会网站公示的私募投资基金管理人或私募投资基金信息，苏民智能属于《证券投资基金法》《私募基金管理办法》及《私募基金登记备案办法》等相关法律法规规定的私募投资基金，并已经在基金业协会办理备案手续，具体情况如下：

基金名称	苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业（有限合伙）
基金编号	SY5175
备案时间	2017年12月8日
基金类型	股权投资基金
基金管理人名称	苏民投资管理无锡有限公司
基金管理人登记编号	P1060128

#### （4）深圳南海

根据深圳南海现行有效的营业执照、合伙协议，并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统的公开查询，截至本律师工作报告出具之日，深圳南海的基本情况如下：

企业名称	深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91440300MA5EMNN75R
注册地址	深圳市南山区粤海街道深南大道10128号南山软件园东塔楼805室
执行事务合伙人	深圳同创锦绣资产管理有限公司
合伙期限	2017-07-20至2025-07-19

<b>经营范围</b>	一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；对未上市企业进行股权投资；股权投资；投资咨询。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：
-------------	---

根据深圳南海提供的工商档案，并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，深圳南海的合伙人及合伙份额情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比例 (%)	合伙人类型
1	深圳同创锦绣资产管理有限公司	5,000	1.5596	普通合伙人
2	深圳南海成长同盛股权投资基金 (有限合伙)	97,490	30.4096	有限合伙人
3	深圳市引导基金投资有限公司	75,000	23.3944	有限合伙人
4	工银(深圳)股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	25,000	7.7981	有限合伙人
5	前海股权投资基金(有限合伙)	25,000	7.7981	有限合伙人
6	青岛同创致满创业投资中心(有限 合伙)	22,000	6.8623	有限合伙人
7	深圳市汇通金控基金投资有限公司	20,000	6.2385	有限合伙人
8	深圳市鲲鹏股权投资有限公司	10,000	3.1192	有限合伙人
9	安徽建安投资基金有限公司	10,000	3.1192	有限合伙人
10	中金启融(厦门)股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	8,100	2.5266	有限合伙人
11	远海明晟(苏州)股权投资合伙企 业(有限合伙)	8,000	2.4954	有限合伙人
12	重庆两江新区金智股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	5,000	1.5596	有限合伙人
13	深圳云能基金管理有限公司	5,000	1.5596	有限合伙人
14	国任财产保险股份有限公司	3,000	0.9358	有限合伙人
15	北大方正人寿保险有限公司	2,000	0.6238	有限合伙人
<b>合计</b>		<b>320,590</b>	<b>100</b>	

经本所律师查询基金业协会网站公示的私募投资基金管理人或私募投资基金信息，深圳南海属于《证券投资基金法》《私募基金管理有限公司》及《私募基金登记备案办法》等相关法律法规规定的私募投资基金，并已经在基金业协会办理备案手续，具体情况如下：

<b>基金名称</b>	深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)
-------------	----------------------

基金编号	SY1117
备案时间	2017年11月14日
基金类型	创业投资基金
基金管理人名称	深圳同创伟业资产管理股份有限公司
基金管理人登记编号	P1001165

### (5) 金浦新潮

根据金浦新潮现行有效的营业执照、合伙协议，并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统的公开查询，截至本律师工作报告出具之日，金浦新潮的基本情况如下：

企业名称	南京金浦新潮创业投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320191MA1YQY960H
注册地址	南京市江北新区滨江大道396号
执行事务合伙人	金浦新潮投资管理（上海）有限公司
合伙期限	2019-07-19至2026-07-18
经营范围	创业投资、股权投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据金浦新潮提供的工商档案，并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，金浦新潮的合伙人及合伙份额情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比例 (%)	合伙人类型
1	金浦新潮投资管理（上海）有限公司	100	0.3279	普通合伙人
2	江阴新潮企业管理中心（有限合伙）	9,000	29.5082	有限合伙人
3	上海国方母基金一期创业投资合伙企业（有限合伙）	6,750	22.1311	有限合伙人
4	南靖灏辰股权投资合伙企业（有限合伙）	4,500	14.7541	有限合伙人
5	上海瀚娱动投资有限公司	4,500	14.7541	有限合伙人
6	安吉泽洪宁企业管理合伙企业（有限合伙）	3,000	9.8361	有限合伙人
7	上海国方母基金二期创业投资合伙企业（有限合伙）	2,250	7.3770	有限合伙人

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比 例 (%)	合伙人类型
8	上海烁焜企业管理中心（有限合 伙）	300	0.9836	有限合伙人
9	上海金浦新朋投资管理有限公司	100	0.3279	有限合伙人
合计		<b>30,500</b>	<b>100</b>	--

经本所律师查询基金业协会网站公示的私募投资基金管理人或私募投资基金信息，金浦新潮属于《证券投资基金法》《私募基金管理办法》及《私募基金登记备案办法》等相关法律法规规定的私募投资基金，并已经在基金业协会办理备案手续，具体情况如下：

基金名称	南京金浦新潮创业投资合伙企业（有限合伙）
基金编号	SGX245
备案时间	2019年12月12日
基金类型	股权投资基金
基金管理人名称	金浦新潮投资管理（上海）有限公司
基金管理人登记编号	P1071057

#### （6）芯伟半导体

根据芯伟半导体现行有效的营业执照、合伙协议，并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统的公开查询，截至本律师工作报告出具之日，芯伟半导体的基本情况如下：

企业名称	上海芯伟半导体合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310230MA1JTYCM3H
注册地址	上海市崇明区中兴镇兴工路37号5号楼324室(上海广福经济开发区)
执行事务合伙人	龚金新
合伙期限	2019-07-16至无固定期限
经营范围	一般项目：半导体科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询（不含投资类咨询）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据芯伟半导体提供的工商档案，并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，芯伟半导体的合伙人及合伙份额情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	财产份额比 例 (%)	合伙人类型
1	龚金新	110	5.2381	普通合伙人
2	骈文胜	650	30.9524	有限合伙人
3	路峰	300	14.2857	有限合伙人
4	闻国涛	250	11.9048	有限合伙人
5	吉晋阳	90	4.2857	有限合伙人
6	傅郁晓	50	2.3810	有限合伙人
7	关姜维	50	2.3810	有限合伙人
8	刘琨	50	2.3810	有限合伙人
9	王沛	150	7.1429	有限合伙人
10	周俊	40	1.9048	有限合伙人
11	乔从缓	40	1.9048	有限合伙人
12	徐芳	35	1.6667	有限合伙人
13	刘叶	30	1.4286	有限合伙人
14	周歆瑶	30	1.4286	有限合伙人
15	张伟军	24	1.1429	有限合伙人
16	高大会	20	0.9524	有限合伙人
17	左上勇	20	0.9524	有限合伙人
18	孙玉男	20	0.9524	有限合伙人
19	崔勇彬	20	0.9524	有限合伙人
20	史小奇	20	0.9524	有限合伙人
21	马谦	15	0.7143	有限合伙人
22	刘栋栋	15	0.7143	有限合伙人
23	袁常乐	15	0.7143	有限合伙人
24	俞磊	10	0.4762	有限合伙人
25	杨恭乾	10	0.4762	有限合伙人
26	宣欢	10	0.4762	有限合伙人
27	张志颖	10	0.4762	有限合伙人
28	马凯	5	0.2381	有限合伙人
29	李晓奎	5	0.2381	有限合伙人
30	镇淑平	2	0.0952	有限合伙人
31	李亚武	2	0.0952	有限合伙人
32	姬悄悄	2	0.0952	有限合伙人

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	财产份额比 例 (%)	合伙人类型
	合计	2,100	100	--

根据芯伟半导体出具的声明以及本所律师的核查，芯伟半导体系公司为实施员工激励计划而搭设的员工持股平台，芯伟半导体不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，也不存在由基金管理人进行管理、基金托管人进行托管的情形。因此，芯伟半导体无需按照《私募基金管理办法》《私募基金登记备案办法》等相关法律法规规定履行登记备案程序。

### (7) 新潮投资

根据新潮投资现行有效的营业执照、公司章程，并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统的公开查询，截至本律师工作报告出具之日，新潮投资的基本情况如下：

公司名称	江苏新潮创新投资集团有限公司
统一社会信用代码	91320281722243848Q
注册地址	江阴市滨江开发区澄江东路 99 号
法定代表人	王新潮
注册资本	5,435 万元人民币
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
营业期限	2000-09-07 至 2040-09-06
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器件制造；光电子器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；模具制造；模具销售；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据新潮投资的工商档案，并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，新潮投资各股东及其股权结构情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	王新潮	2,771.1	50.9862
2	严秋月	160	2.9439
3	潘小英	150	2.7599

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	股权比例（%）
4	王炳炎	150	2.7599
5	罗宏伟	150	2.7599
6	王德祥	72.9	1.3413
7	张凤雏	70	1.2879
8	高元强	62	1.1408
9	冯锡生	61	1.1224
10	朱正义	61	1.1224
11	苏卫中	60	1.1040
12	刘明才	60	1.1040
13	钱浩忠	60	1.1040
14	沈幸福	60	1.1040
15	耿丛正	58	1.0672
16	庞伟民	58	1.0672
17	王元甫	58	1.0672
18	沈阳	56	1.0304
19	花建元	55	1.0120
20	支建忠	55	1.0120
21	王庆东	55	1.0120
22	俞玉葱	55	1.0120
23	徐玲红	55	1.0120
24	吴振江	53	0.9752
25	许仕清	53	0.9752
26	陈皋	53	0.9752
27	谢洁人	53	0.9752
28	张伟	53	0.9752
29	李福寿	53	0.9752
30	沈锦新	52	0.9568
31	于燮康	50	0.9200
32	严红月	50	0.9200
33	陶惠娟	50	0.9200
34	张敏	50	0.9200
35	叶文芝	50	0.9200



序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	股权比例（%）
36	汤玲敏	47	0.8648
37	缪国平	45	0.8280
38	黄建良	45	0.8280
39	陆惠芬	45	0.8280
40	费建中	45	0.8280
41	季少武	45	0.8280
42	耿凤美	45	0.8280
43	王刚	45	0.8280
合计		5,435	100

根据新潮投资出具的说明，新潮投资不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，也不存在由基金管理人进行管理、基金托管人进行托管的情形。因此，新潮投资无需按照《私募基金管理办法》《私募基金登记备案办法》等相关法律法规规定履行登记备案程序。

#### （8）先锋智造

根据先锋智造现行有效的营业执照、合伙协议，并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统的公开查询，截至本律师工作报告出具之日，先锋智造的基本情况如下：

企业名称	无锡先锋智造投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320205MA1WEMYT86
注册地址	无锡市锡山区安镇街道丹山路78号锡东创融大厦A座1501室
执行事务合伙人	苏民开源无锡投资有限公司
合伙期限	2018-04-24至无固定期限
经营范围	利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据先锋智造提供的工商档案，并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，先锋智造的合伙人及合伙份额情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额（万元）	合伙份额比例（%）	合伙人类型
1	苏民开源无锡投资有限公司	360	6.0000	普通合伙人

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比 例 (%)	合伙人类型
2	于波	600	10.0000	有限合伙人
3	无锡博士达企业管理有限公司	300	5.0000	有限合伙人
4	孙逸洲	360	6.0000	有限合伙人
5	李涛	360	6.0000	有限合伙人
6	王皓冰	300	5.0000	有限合伙人
7	罗梓丹	540	9.0000	有限合伙人
8	耿斌	480	8.0000	有限合伙人
9	邹昀益	300	5.0000	有限合伙人
10	黄东峰	300	5.0000	有限合伙人
11	王天特	120	2.0000	有限合伙人
12	胡国梁	300	5.0000	有限合伙人
13	陈胜蕾	300	5.0000	有限合伙人
14	姜羽	120	2.0000	有限合伙人
15	郑强	120	2.0000	有限合伙人
16	王磊建	120	2.0000	有限合伙人
17	陈晔	120	2.0000	有限合伙人
18	尹飞虹	120	2.0000	有限合伙人
19	吴巧新	120	2.0000	有限合伙人
20	无锡均喆企业管理有限公司	120	2.0000	有限合伙人
21	无锡均维企业管理有限公司	120	2.0000	有限合伙人
22	无锡嘉橙企业管理有限公司	120	2.0000	有限合伙人
23	沈知	300	5.0000	有限合伙人
合计		6,000	100	--

根据先锋智造出具的说明并经本所律师核查，先锋智造不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，也不存在由基金管理人进行管理、基金托管人进行托管的情形。因此，先锋智造无需按照《私募基金管理办法》《私募基金登记备案办法》等相关法律法规规定履行登记备案程序。

### (9) 远海明晟

根据远海明晟现行有效的营业执照、合伙协议，并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统的公开查询，截至本律师工作报告出具之日，远海明晟的

基本情况如下：

企业名称	远海明晟（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320505MA1UU8HBXH
注册地址	苏州高新区华佗路 99 号 6 幢
执行事务合伙人	远海明华资产管理有限公司
合伙期限	2018-01-03 至 2027-01-02
经营范围	股权投资；对外投资；创业投资；投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据远海明晟提供的工商档案，并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，远海明晟的合伙人及合伙份额情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比 例 (%)	合伙人类型
1	远海明华资产管理有限公司	200	0.1426	普通合伙人
2	中海集团投资有限公司	50,000	35.6506	有限合伙人
3	河北港口集团有限公司	50,000	35.6506	有限合伙人
4	苏州高新产业投资发展企业（有限合伙）	28,050	20.0000	有限合伙人
5	国机资本控股有限公司	3,000	2.1390	有限合伙人
6	青岛港资产管理有限公司	3,000	2.1390	有限合伙人
7	厦门港务创业投资有限公司	3,000	2.1390	有限合伙人
8	中国船东互保协会	3,000	2.1390	有限合伙人
合计		140,250	100	-

经本所律师查询基金业协会网站公示的私募投资基金管理人或私募投资基金信息，远海明晟属于《证券投资基金法》《私募证券投资基金管理办法》及《私募证券投资基金登记备案办法》等相关法律法规规定的私募投资基金，并已经在基金业协会办理备案手续，具体情况如下：

基金名称	远海明晟（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）
基金编号	SCD224
备案时间	2018 年 1 月 12 日
基金类型	股权投资基金
基金管理人名称	远海明华资产管理有限公司

基金管理人登记编号	P1061869
-----------	----------

### (10) 广西泰达

根据广西泰达现行有效的营业执照、公司章程，并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统的公开查询，截至本律师工作报告出具之日，广西泰达的基本情况如下：

公司名称	广西泰达新原股权投资有限公司
统一社会信用代码	91650100095500373M
注册地址	贺州市八步区鞍山西路 83 号综合楼
法定代表人	赵华
注册资本	10,000 万元人民币
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
营业期限	2014-03-25 至 2044-03-24
经营范围	股权投资；股权投资管理；企业管理信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

根据广西泰达的工商档案，并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，广西泰达各股东及其股权结构情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	天津泰达科技投资股份有限公司	10,000	100
	合计	10,000	100

经本所律师查询基金业协会网站公示的私募投资基金管理人或私募投资基金信息，广西泰达属于《证券投资基金法》《私募证券投资基金管理办法》及《私募证券投资基金登记备案办法》等相关法律法规规定的私募投资基金，并已经在基金业协会办理备案手续，具体情况如下：

基金名称	广西泰达新原股权投资有限公司
基金编号	S27660
备案时间	2015 年 5 月 6 日
基金类型	股权投资基金
基金管理人名称	天津泰达科技投资股份有限公司
基金管理人登记编号	P1001349

### (11) 苏民投君信

根据苏民投君信现行有效的营业执照、合伙协议，并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统的公开查询，截至本律师工作报告出具之日，苏民投君信的基本情况如下：

企业名称	苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310000MA1FL60T0W
注册地址	上海市黄浦区中山南路 100 号三层 02 单元
执行事务合伙人	君信（上海）股权投资基金管理有限公司
合伙期限	2018-11-11 至 2023-11-10
经营范围	股权投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

根据苏民投君信提供的工商档案，并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，苏民投君信的合伙人及合伙份额情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比 例 (%)	合伙人类型
1	君信（上海）股权投资基金管理有限公司	1,000	0.8613	普通合伙人
2	上海爱建集团股份有限公司	30,000	25.8398	有限合伙人
3	上海柘中集团股份有限公司	30,000	25.8398	有限合伙人
4	上海黄浦投资控股（集团）有限公司	20,000	17.2265	有限合伙人
5	苏民资本有限公司	10,000	8.6133	有限合伙人
6	上海国方母基金一期创业投资合伙企业（有限合伙）	8,625	7.4289	有限合伙人
7	江苏徐州老工业基地产业发展基金（有限合伙）	5,000	4.3066	有限合伙人
8	上海临港智兆股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,000	3.4453	有限合伙人
9	上海国方母基金二期创业投资合伙企业（有限合伙）	2,875	2.4763	有限合伙人
10	衡山（上海）实业有限公司	2,500	2.1533	有限合伙人
11	上海爱屋投资管理有限公司	1,000	0.8613	有限合伙人
12	信发资产管理有限责任公司	1,000	0.8613	有限合伙人
13	苏民开源无锡投资有限公司	100	0.0861	普通合伙人

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比 例 (%)	合伙人类型
	合计	116,100	100	--

经本所律师查询基金业协会网站公示的私募投资基金管理人或私募投资基金信息，苏民投君信属于《证券投资基金法》《私募基金管理办法》及《私募基金登记备案办法》等相关法律法规规定的私募投资基金，并已经在基金业协会办理备案手续，具体情况如下：

基金名称	苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）
基金编号	SEN459
备案时间	2018年12月20日
基金类型	股权投资基金
基金管理人名称	君信（上海）股权投资基金管理有限公司
基金管理人登记编号	P1066511

#### （12）德同合心

根据德同合心现行有效的营业执照、合伙协议，并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统的公开查询，截至本律师工作报告出具之日，德同合心的基本情况如下：

企业名称	苏州市德同合心创业投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310000MA1FL43230
注册地址	苏州市吴江区黎里镇南新街118号
执行事务合伙人	西藏德同企业管理有限公司
合伙期限	2017-06-12至2027-06-11
经营范围	一般项目：创业投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据德同合心提供的工商档案，并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，德同合心的合伙人及合伙份额情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比 例 (%)	合伙人类型
----	----------	-------------	----------------	-------

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比例 (%)	合伙人类型
1	西藏德同企业管理有限公司	5,000	2.5000	普通合伙人
2	上海科创中心一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000	10.0000	有限合伙人
3	苏州市吴江产业投资有限公司	20,000	10.0000	有限合伙人
4	国投创合国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）	20,000	10.0000	有限合伙人
5	前海股权投资基金（有限合伙）	15,000	7.5000	有限合伙人
6	平潭坤盛鼎兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,000	6.0000	有限合伙人
7	江西省发展升级引导基金（有限合伙）	10,000	5.0000	有限合伙人
8	上海青浦投资有限公司	10,000	5.0000	有限合伙人
9	苏州工业园区元禾招商股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000	5.0000	有限合伙人
10	上海世丞股权投资基金管理有限公司	10,000	5.0000	有限合伙人
11	上海德心股权投资基金管理有限公司	8,370	4.1850	有限合伙人
12	深圳市丰源昌意投资中心（有限合伙）	8,100	4.0500	有限合伙人
13	新余市晟创投资管理有限公司	7,000	3.5000	有限合伙人
14	远海明晟（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）	6,000	3.0000	有限合伙人
15	南通江海产业发展投资基金（有限合伙）	5,000	2.5000	有限合伙人
16	横琴宏帷股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000	2.5000	有限合伙人
17	招商证券投资有限公司	5,000	2.5000	有限合伙人
18	嘉善县金融投资有限公司	5,000	2.5000	有限合伙人
19	苏州娄城国发高新技术产业投资企业（有限合伙）	3,000	1.5000	有限合伙人
20	上海灿辉投资发展有限公司	2,500	1.2500	有限合伙人
21	平阳箴言德同投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000	1.0000	有限合伙人
22	辉县市豫辉哈工业引导基金合伙企业（有限合伙）	2,000	1.0000	有限合伙人
23	共青城乾堃荣福投资合伙企业（有	1,500	0.7500	有限合伙人

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比 例 (%)	合伙人类型
	限合伙)			
24	北京京北时代投资中心(有限合 伙)	1,000	0.5000	有限合伙人
25	宁波京北未来成功投资中心(有限 合伙)	1,000	0.5000	有限合伙人
26	宁波海威同心股权投资中心(有限 合伙)	1,000	0.5000	有限合伙人
27	东渡丰汇投资发展集团有限公司	1,000	0.5000	有限合伙人
28	惠州市润博信息咨询部(有限合 伙)	1,000	0.50000	有限合伙人
29	杭州易盛投资合伙企业(有限合 伙)	1,000	0.5000	有限合伙人
30	南昌辰景咨询管理有限公司	900	0.4500	有限合伙人
31	上海德槃资产管理有限公司	630	0.3150	有限合伙人
合计		200,000	100	-

经本所律师查询基金业协会网站公示的私募投资基金管理人或私募投资基金信息，德同合心属于《证券投资基金法》《私募证券投资基金管理办法》及《私募证券投资基金登记备案办法》等相关法律法规规定的私募投资基金，并已经在基金业协会办理备案手续，具体情况如下：

基金名称	苏州市德同合心创业投资合伙企业(有限合伙)
基金编号	SCH716
备案时间	2018年9月30日
基金类型	创业投资基金
基金管理人名称	德同(上海)私募基金管理股份有限公司
基金管理人登记编号	P1000513

### (13) 云泽裕庆

根据云泽裕庆现行有效的营业执照、合伙协议，并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统的公开查询，截至本律师工作报告出具之日，云泽裕庆的基本情况如下：

企业名称	克拉玛依云泽裕庆股权投资有限合伙企业
类型	有限合伙企业



统一社会信用代码	91650203MA78QYQA9A
注册地址	新疆克拉玛依市克拉玛依区南新路 75-13 号
执行事务合伙人	新疆云泽股权投资管理有限公司
合伙期限	2020-05-29 至无固定期限
经营范围	股权投资。

根据云泽裕庆提供的工商档案，并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，云泽裕庆的合伙人及合伙份额情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比 例 (%)	合伙人类型
1	新疆云泽股权投资管理有限公司	100	9.0909	普通合伙人
2	姜宇涵	428.7	38.9727	有限合伙人
3	曾先敏	394	35.8182	有限合伙人
4	方荡	177.3	16.1182	有限合伙人
合计		<b>1,100</b>	<b>100</b>	--

经本所律师查询基金业协会网站公示的私募投资基金管理人或私募投资基金信息，云泽裕庆属于《证券投资基金法》《私募基金管理办法》及《私募基金登记备案办法》等相关法律法规规定的私募投资基金，并已经在基金业协会办理备案手续，具体情况如下：

基金名称	克拉玛依云泽裕庆股权投资有限合伙企业
基金编号	SNF387
备案时间	2020年11月18日
基金类型	股权投资基金
基金管理人名称	新疆云泽股权投资管理有限公司
基金管理人登记编号	P1062521

#### (14) 南山基金

根据南山基金现行有效的营业执照、合伙协议，并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统的公开查询，截至本律师工作报告出具之日，南山基金的基本情况如下：

企业名称	中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）
类型	有限合伙企业

统一社会信用代码	91440300MA5DR2J60E
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋508
执行事务合伙人	深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司
合伙期限	2016-12-21 至 2026-12-21
经营范围	一般经营项目是：对中小企业发展创业投资业务，股权投资及相关业务（不得从事证券投资活动、不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务），许可经营项目是：

根据南山基金提供的工商档案，并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，南山基金的合伙人及合伙份额情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	合伙份额比 例 (%)	合伙人类型
1	深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司	4,500	1.0000	普通合伙人
2	国家中小企业发展基金有限公司	110,000	24.4444	有限合伙人
3	深圳市引导基金投资有限公司	109,500	24.3333	有限合伙人
4	安信证券股份有限公司	25,000	5.5556	有限合伙人
5	深圳市汇通金控基金投资有限公司	45,000	10.0000	有限合伙人
6	新余市华邦投资管理中心（有限合伙）	56,000	12.4444	有限合伙人
7	万科企业股份有限公司	30,000	6.6667	有限合伙人
8	山证创新投资有限公司	30,000	6.6667	有限合伙人
9	深圳市创东方富盛投资企业（有限合伙）	20,000	4.4444	有限合伙人
10	山西交通产业基金合伙企业（有限合伙）	10,000	2.2222	有限合伙人
11	舟山保泰盈股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000	2.2222	有限合伙、
合计		450,000	100	--

经本所律师查询基金业协会网站公示的私募投资基金管理人或私募投资基金信息，南山基金属于《证券投资基金法》《私募基金管理办法》及《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规规定的私募投资基金，并已经在基金业协会办理备案手续，具体情况如下：

基金名称	中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）
------	--------------------

基金编号	SR5570
备案时间	2017年3月16日
基金类型	股权投资基金
基金管理人名称	深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司
基金管理人登记编号	P1031644

经本所律师核查，上述发行人股东均为中国籍自然人或在中华人民共和国境内注册的企业，不存在工会、职工持股会、契约型基金、信托计划、资产管理计划及境内上市公司且上述股东均具备法律、法规规定的股东资格。

### （三）发行人的控股股东、实际控制人

#### 1、控股股东

经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，蕊测半导体持有发行人2,703.2838万股股份，占本次发行前发行人股份总额的41.3296%，为发行人的控股股东。认定蕊测半导体为发行人的控股股东依据如下：

（1）根据《公司法》第二百一十六条规定，“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。蕊测半导体为公司第一大股东，直接持有发行人41.3296%的股份，远超过其他股东持有或控制的公司股份比例，足以对公司股东大会的决议产生重大影响。

本所律师认为，蕊测半导体对发行人股东大会决策具有重大影响，为发行人的控股股东。

#### 2、实际控制人

截至本律师工作报告出具之日，骈文胜间接持有发行人股份占本次发行前发行人股本总额的22.39%。骈文胜系发行人的实际控制人。认定骈文胜系发行人的实际控制人理由如下：

(1) 骈文胜间接控制的发行人股份的表决权已足以对发行人股东大会的决议产生重大影响。

2018年1月1日至本律师工作报告出具之日，骈文胜一直持有发行人控股股东蕊测半导体51.5442%的股份，且担任蕊测半导体的法定代表人、执行董事。

报告期内发行人其他股东持有股份较为分散，第二大股东持股最高不超过12%。骈文胜在报告期内持续控制的蕊测半导体所持有的发行人股份始终高于现在的41.3296%。

(2) 骈文胜对发行人的经营方针、经营决策、重大经营管理事项、董事会决议、董事的提名和选举具有实质影响力。

骈文胜自2016年11月25日担任伟测有限执行董事兼总经理，后自发行人设立董事会至今，骈文胜一直担任发行人董事长兼法定代表人。同时在报告期内，由骈文胜负责公司发展战略、运营管理和重大人事决策。

自2018年1月1日至本律师工作报告出具之日，报告期内历次股东大会会议不存在否决会议议案的情形，且所有其他股东除回避表决外均保持和骈文胜控制的蕊测半导体一致，所有股东（大）会决议均全票通过。

自2018年1月1日至律师工作报告出具之日，董事会会议均由董事长骈文胜召集并主持，高级管理人员的聘用均由骈文胜提出，重大决策均由发行人董事会提出，除回避表决情况外，发行人其他董事的投票结果均与骈文胜一致，无弃权或反对的情形。

### 3、发行人的实际控制人最近两年内没有发生变化

经本所律师查验，骈文胜为发行人的实际控制人，发行人的实际控制人最近两年没有发生变化，主要理由如下：

(1) 骈文胜作为报告期内持股比例最高股东的地位未发生变化

报告期内，骈文胜始终为发行人第一大股东，截至本律师工作报告出具之日，骈文胜间接持有发行人22.39%股权，仍为发行人第一大股东。

## （2）报告期内公司控制权稳定

公司控制权是能够对股东大会的决议产生重大影响或者能够实际支配公司行为的权力，其渊源是对公司的直接或者间接的股权投资关系。自伟测有限设立至今，骈文胜始终控制发行人控股股东，处于对发行人的绝对控制地位。骈文胜基于其控制公司的股份比例和投票权足以对发行人股东大会、董事会产生重要影响。

报告期内基于骈文胜在公司的持股比例、骈文胜作为公司创始人及持续担任公司董事长一职，骈文胜为公司的领导核心，公司的经营方针和决策、组织机构运作及业务运营等均依照其意志执行。

## （3）发行人未来公司控制权仍能保持稳定

骈文胜已出具关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺，具体如下：

“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的首发前股份，也不由发行人回购该等股份。因发行人进行权益分派等导致本人持有发行人股份发生变化的，仍遵守上述约定；

2、如法律、行政法规、部门规章或中国证监会、上海证券交易所规定的股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按照该等规定执行；

3、本人作为发行人实际控制人，董事长及总经理，未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人股份；

4、锁定期届满后，若本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定；

5、锁定期届满后，在本人担任公司董事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；自公司股票上市之日起 1 年内和离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内本人亦遵守本条承诺。因公司进行权益分派等导致持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定；

6、在本人担任公司核心技术人员的期间，自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；自公司股票上市之日起 1 年内和离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定；

7、在锁定期届满后的两年内本人减持所持有的发行人股份的价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求；

8、证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的，本人将按照届时有效的减持规定依法执行。本人违反上述承诺的，将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任。”

根据骈文胜出具的上述承诺，不存在为锁定期后减持限制而规避监管的情形，有利于公司股权及控制结构稳定。

骈文胜已按照相关规定，作为实际控制人签署了《关于避免同业竞争的承诺函》《关于欺诈上市回购股份的承诺》《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》等承诺，对同业竞争、欺诈上市回购等方面作了限制。

本所律师认为，报告期内，持有、实际支配公司股份表决权比例最高的人未发生变化，均为骈文胜；该等持股结构稳定、可持续，发行人在报告期内且在首发后的可预期期限内控制权系稳定的。根据《<首次公开发行股票并上市管理办法>第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用-证券期货法律适

用意见第 1 号》的规定，发行人最近两年控制权稳定，实际控制人未发生变化。

#### （四）发行人申报前一年新增股东

根据发行人的工商档案及股东名册，发行人不存在申报前一年内新增股东的情形。

### 七、发行人的股本及演变

根据发行人的工商档案及所提供的相关资料，并经本所律师查验，伟测科技系由伟测有限整体变更设立，伟测有限设立以来，股本及演变情况如下：

#### （一）伟测有限的设立

2016 年 4 月 18 日，伟测有限取得了由上海市工商行政管理局颁发的“（沪工商）注名预核字第 01201604180117 号”《企业名称预先核准通知书》。

2016 年 5 月 6 日，上海市浦东新区市场监督管理局准予伟测有限的设立登记申请，对公司章程进行备案，并核发《营业执照》。

伟测有限设立时股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	李峰	2,000.00	100	货币
	合计	2,000.00	100	--

#### （二）伟测有限的股权变动

##### 1、2016 年 11 月，伟测有限第一次股权转让

2016 年 11 月 25 日，伟测有限作出股东决定，同意李峰将其持有的伟测有限 100% 股权（对应出资额 2,000 万元）以 0 万元的对价转让予新股东蕊测半导体。

2016 年 11 月 25 日，李峰与蕊测半导体签署《股权转让协议》，协议约定李峰将其持有的伟测有限 100% 股权（对应认缴出资额 2,000 万元）以 0 万元的对价转让予新股东蕊测半导体。

2016 年 12 月 28 日，上海市浦东新区市场监督管理局出具《准予变更（备案）登记通知》（No.15000003201612220493），准予上述变更登记，并于同日

向伟测有限核发新的《营业执照》。

本次股权转让为伟测有限股权代持的还原转让，本次变更完成后，伟测有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	蕊测半导体	2,000.00	100	货币
	合计	2,000.00	100	--

### 2、2017年9月，伟测有限第一次注册资本增加

2017年9月19日，伟测有限全体股东作出股东会决议，同意：1）长兴君桐为伟测有限新股东，长兴君桐认缴出资 439.0244 万元，出资比例为 18%；2）公司注册资本从 2,000 万元增至 2,439.0244 万元。

2017年9月5日，长兴君桐、蕊测半导体与伟测有限签署《上海伟测半导体科技有限公司增资协议》，协议约定伟测有限注册资本由 2,000 万元增加到 2,439.0244 万元，由长兴君桐以货币方式出资 439.0244 万元，439.0244 万元全部计入伟测有限的注册资本。伟测有限股东放弃对新增注册资本的优先认购权。本次增增资完成后，长兴君桐出资比例为 18%，伟测有限的注册资本为 2,439.0244 万元。

2017年10月23日，上海市浦东新区市场监督管理局出具《准予变更（备案）登记通知》（No.15000003201710170289），准予上述变更登记，并于同日向伟测有限核发新的《营业执照》。

本次增资完成后，伟测有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	蕊测半导体	2,000.0000	82.00	货币
2	长兴君桐	439.0244	18.00	货币
	合计	2,439.0244	100	--

### 3、2018年5月，伟测有限第二次股权转让、第二次注册资本增加

2018年5月18日，有限公司全体股东作出股东会决议，同意：1）蕊测半导体将其持有的伟测有限 0.2022% 股权（对应出资额 4.9329 万元）以 0 万元的对价转让予有限公司股东长兴君桐；2）同意苏民智能、先锋智造为伟测有限新股东，其中，苏民智能认缴出资 274.0477 万元，出资比例为 10%；先锋智造认



缴出资 27.4048 万元，出资比例为 1%；3) 公司注册资本从 2,439.0244 万元增至 2,740.4769 万元。

2018 年 5 月 3 日，蕊测半导体与长兴君桐签署《关于上海伟测半导体科技有限公司的股权转让协议》，协议约定蕊测半导体将其持有的伟测有限 0.2022% 股权（对应出资额 4.9329 万元）以 0 万元的对价转让予伟测有限股东长兴君桐。

根据各方出具的确认函，2018 年 2 月，伟测有限启动新一轮融资，在签署相关协议之前，伟测有限、蕊测半导体、长兴君桐三方达成共识：下一轮增资应以 2,500 万元人民币增加甲方注册资本 10%，以保证长兴君桐的股权比例维持在 16.20%。

2018 年 5 月 3 日，苏民智能、先锋智造与伟测有限与蕊测半导体、长兴君桐与骈文胜、闻国涛、路峰签署《关于上海伟测半导体科技有限公司之投资合作协议》，协议约定伟测有限注册资本由 2,439.0244 万元增加到 2,740.4769 万元，由苏民智能以货币方式出资 2,500 万元，先锋智造投资以货币方式出资 250 万元。其中，苏民智能向伟测有限出资 2,500 万元，274.0477 万元计入伟测有限注册资本，2,225.9523 万元计入伟测有限资本公积金；先锋智造向伟测有限出资 250 万元，27.4048 万元计入伟测有限注册资本，222.5952 万元计入伟测有限资本公积金。伟测有限股东均放弃对新增注册资本的优先认购权。本次增资完成后，苏民智能的出资比例为 10%，先锋智造的出资比例为 1%，伟测有限的注册资本为 2,740.4769 万元。

根据各方出具的确认函，由于上述增资导致长兴君桐的股权比例被多摊薄 0.18%。为推动此次增资协议的签署，蕊测半导体同意，在此次增资协议签署前，以 0 元人民币对价转让伟测有限注册资本 4.9329 万元给长兴君桐，使长兴君桐在增资后的持股比例维持在 16.20%。

2018 年 9 月 13 日，上海市浦东新区市场监督管理局出具《准予变更（备案）登记通知》（No.15000003201809110207），准予上述变更登记，并于同日向伟测有限核发新的《营业执照》。

本次变更完成后，伟测有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	蕊测半导体	1,995.0671	72.80	货币
2	长兴君桐	443.9573	16.20	货币
3	苏民智能	274.0477	10.00	货币
4	先锋智造	27.4048	1.00	货币
合计		<b>2,740.4769</b>	<b>100</b>	--

#### 4、2018年8月，伟测有限第三次注册资本增加

2018年9月30日，伟测有限全体股东作出股东会决议，同意：1）韋泉致芯为新股东，韋泉致芯认缴出资 97.8741 万元，出资比例为 3.4483%；2）伟测有限的注册资本从 2,740.4769 万元增至 2,838.3510 万元。

2018年8月，韋泉致芯与伟测有限、蕊测半导体、长兴君桐、苏民智能、先锋智造与骈文胜、闻国涛、路峰签订《关于上海伟测半导体科技有限公司之投资合作协议》，协议约定伟测有限注册资本由 2,740.4769 万元增加到 2,838.3510 万元，由韋泉致芯以货币方式出资 1,000 万元，其中，97.8741 万元计入伟测有限新增注册资本，902.1259 万元计入伟测有限资本公积金。伟测有限股东均放弃对新增注册资本的优先认购权。本次投资完成后，韋泉致芯的出资比例为 3.4483%，伟测有限注册资本为 2,838.3510 万元。

2018年11月27日，上海市浦东新区市场监督管理局出具《准予变更（备案）登记通知》（No.15000003201811230234），准予上述变更登记，并于同日向伟测有限核发新的《营业执照》。

本次变更完成后，伟测有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	蕊测半导体	1,995.0671	70.2896	货币
2	长兴君桐	443.9573	15.6414	货币
3	苏民智能	274.0477	9.6552	货币
4	韋泉致芯	97.8741	3.4483	货币
5	先锋智造	27.4048	0.9655	货币
合计		<b>2,838.3501</b>	<b>100</b>	--

5、2019年1月，伟测有限第三次股权转让，伟测有限第四次注册资本增加

2019年1月17日，有限公司全体股东作出股东会决议，同意：1) 长兴君桐将其持有的伟测有限10.3448%股权（对应出资额293.6225万元）以3,000万元的对价转让予有限公司股东走泉致芯；2) 深圳南海为新股东，深圳南海认缴出资243.2872万元，出资比例为7.8947%；3) 公司注册资本从2,838.3510万元增至3,081.6382万元。

2019年1月18日，长兴君桐与走泉致芯签署《股权转让协议》，协议约定长兴君桐将其持有的伟测有限出资额293.6225万元以3,000万元的对价转让予股东走泉致芯。

2019年2月15日，深圳南海与伟测有限、蕊测半导体、骈文胜、闻国涛、路峰与长兴君桐、苏民智能、走泉致芯、先锋智造签署《上海伟测半导体科技有限公司增资协议》，协议约定伟测有限注册资本由2,838.3510万元增加到3,081.6382万元，由深圳南海以货币方式认缴出3,000万元，其中，243.3872万元计入伟测有限新增注册资本，2,756.6128万元计入伟测有限资本公积金。伟测有限股东均放弃对新增注册资本的优先认购权。本次增资完成后，长兴君桐出资比例为7.8947%，伟测有限注册资本为3,081.6382万元。

2019年4月29日，上海市浦东新区市场监督管理局出具《准予变更（备案）登记通知》（No.15000003201904230184），准予上述变更登记，并于同日向伟测有限核发新的《营业执照》。

本次增资完成后，伟测有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	蕊测半导体	1,995.0671	64.7405	货币
2	走泉致芯	391.4966	12.7042	货币
3	苏民智能	274.0477	8.8929	货币
4	深圳南海	243.2872	7.8974	货币
5	长兴君桐	150.3448	4.8784	货币
6	先锋智造	27.4048	0.8893	货币
合计		<b>3,081.6382</b>	<b>100</b>	--

#### 6、2019年5月，伟测有限第四次股权转让

2019年5月17日，有限公司全体股东作出股东会决议，同意：公司原股东长兴君桐与新潮科技之间的股权转让，其他股东放弃优先购买权。

2019年5月17日，长兴君桐与新潮科技签署《股权转让协议》，协议约定长兴君桐将其持有的伟测有限4.8784%股权（对应出资额150.3348万元）以1,853.7920万元的对价转让予股东新潮科技。

2019年7月1日，上海市浦东新区市场监督管理局出具《准予变更（备案）登记通知》（No.15000003201906240119），准予上述变更登记，并于同日向伟测有限核发新的《企业法人营业执照》。

本次股权变更后，伟测有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	蕊测半导体	1,995.0671	64.7405	货币
2	走泉致芯	391.4966	12.7042	货币
3	苏民智能	274.0477	8.8929	货币
4	深圳南海	243.2872	7.8974	货币
5	新潮科技	150.3348	4.8784	货币
6	先锋智造	27.4048	0.8893	货币
合计		<b>3,081.6382</b>	<b>100</b>	--

### 7、2019年7月，伟测有限第五次注册资本增加

2019年7月19日，有限公司全体股东作出股东会决议，同意：1）公司注册资本增资到3,591.6786万元，其中，苏民智能增加出资金额55.2141万元，出资比例为1.5373%；先锋智造增加出资金额2.7607万元，出资比例为0.0769%；深圳南海增加出资金额82.8212万元，出资比例为2.3059%；新潮科技增加出资金额207.0529万元，出资比例为5.7648%；新股东芯伟半导体增加出资额162.1915万元，出资比例为4.5157%；其他股东放弃优先认购权。

2019年7月7日，芯伟半导体与伟测有限与蕊测半导体、骈文胜、闻国涛、路峰与深圳南海、苏民智能、走泉致芯、先锋智造、新潮科技签署《上海伟测半导体科技有限公司增资协议》，协议约定伟测有限注册资本由3,081.6382万元增加到3,243.8297万元，由芯伟半导体以货币方式出资2,000万元，其中，162.1915万元计入伟测有限注册资本，1,837.8085万元计入伟测有限资本公积金。伟测有限股东均放弃对新增注册资本的优先认购权。本次增资完成后，芯伟半导体出资比例为5%，伟测有限注册资本为3,243.8297万元。

2019年7月7日，新潮科技与伟测有限与蕊测半导体、骈文胜、闻国涛、路峰与深圳南海、苏民智能、走泉致芯、先锋智造与芯伟半导体签署《上海伟测半导体科技有限公司增资协议》，协议约定伟测有限注册资本由3,243.8297万元增加到3,450.8826万元，由新潮科技以货币方式出资3,000万元，其中，207.0529万元计入伟测有限注册资本，2,792.9471万元计入伟测有限资本公积金。伟测有限股东均放弃对新增注册资本的优先认购权。本次增资完成后，新潮科技出资比例为10.36%，伟测有限注册资本为3,450.8826万元。

2019年7月7日，深圳南海、苏民智能、先锋智造与骈文胜、闻国涛、路峰、蕊测半导体与走泉致芯、新潮科技、芯伟半导体与伟测有限签署《上海伟测半导体科技有限公司增资协议》，协议约定伟测有限注册资本由3,450.8826万元增加到3,591.6786万元，由深圳南海以货币方式出资1,200万元，苏民智能以货币方式出资800万元，先锋智造以货币方式出资40万元，其中，深圳南海出资1,200万元，82.8212万元计入伟测有限注册资本，1,117.1788万元计入伟测有限资本公积金；苏民智能出资800万元，55.2141万元计入伟测有限注册资本，744.7859万元计入伟测有限资本公积金；先锋智造出资40万元，2.7607万元计入伟测有限注册资本，37.2393万元计入伟测有限资本公积金。伟测有限股东均放弃对新增注册资本的优先认购权。本次增资完成后，深圳南海出资比例为9.0796%，苏民智能出资比例为9.1674%，先锋智造出资比例为0.8399%，伟测有限注册资本为3,591.6786万元。

2019年10月30日，上海市浦东新区市场监督管理局出具《准予变更（备案）登记通知》（No.15000003201910250136），准予上述变更登记，并于同日向伟测有限核发新的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，伟测有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	蕊测半导体	1,995.0671	55.5469	货币
2	走泉致芯	391.4966	10.9001	货币
3	新潮科技	357.3877	9.9504	货币
4	苏民智能	329.2618	9.1674	货币
5	深圳南海	326.1084	9.0796	货币

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
6	芯伟半导体	162.1915	4.5157	货币
7	先锋智造	30.1655	0.8399	货币
合计		<b>3,591.6786</b>	<b>100</b>	--

### 8、2019年11月，伟测有限第五次股权转让

2019年11月19日，有限公司全体股东作出股东会决议，同意伟测有限原股东新潮科技与金浦新潮之间的股权转让，其他股东放弃优先购买权，并同意标的股权所附属的相关股东权益、义务一并转让。

2019年11月19日，新潮科技与金浦新潮签署《股权转让协议》，协议约定新潮科技将其持有的伟测有限5.7648%股权（对应出资额207.0529万元）以3,039.4520万元的对价转让予有限公司股东金浦新潮。

2019年12月27日，上海市浦东新区市场监督管理局出具《准予变更（备案）登记通知》（No.15000003201912260012），准予上述变更登记，并于同日向有限公司核发新的《营业执照》。

本次股权变更后，伟测有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	蕊测半导体	1,995.0671	55.5469	货币
2	韋泉致芯	391.4966	10.9001	货币
3	苏民智能	329.2618	9.1674	货币
4	深圳南海	326.1084	9.0796	货币
5	金浦新潮	207.0529	5.7648	货币
6	芯伟半导体	162.1915	4.5158	货币
7	新潮科技	150.3348	4.1856	货币
8	先锋智造	30.1655	0.8399	货币
合计		<b>3,591.6786</b>	<b>100</b>	--

### 9、2019年12月，伟测有限第六次注册资本增加

2019年12月15日，有限公司全体股东作出股东会决议，同意：1）涂洁为公司新股东；2）公司注册资本增资到3,690.0808万元，其中涂洁认缴出资额98.4022万元，出资比例2.6667%。

2019年12月20日，涂洁与骈文胜、闻国涛、路峰、蕊测半导体、伟测有限签订《上海伟测半导体科技有限公司增资扩股协议》，协议约定伟测有限注册资本由3,591.6786万元增至3,690.0808万元，新增注册资本98.4022万元由涂洁认购。

2020年4月20日，上海市浦东新区市场监督管理局出具《准予变更（备案）登记通知》（No.15000003202004160193），准予上述变更登记，并于同日向有限公司核发新的《营业执照》。

本次增资完成后，伟测有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	蕊测半导体	1,995.0671	54.0657	货币
2	韋泉致芯	391.4966	10.6094	货币
3	苏民智能	329.2618	8.9229	货币
4	深圳南海	326.1084	8.8374	货币
5	金浦新潮	207.0529	5.6111	货币
6	芯伟半导体	162.1915	4.3953	货币
7	新潮科技	150.3348	4.0740	货币
8	涂洁	98.4022	2.6667	货币
9	先锋智造	30.1655	0.8175	货币
合计		<b>3,690.0808</b>	<b>100</b>	--

### （三）发行人的设立及设立后的股权变动

#### 1、伟测有限整体变更为股份有限公司

伟测有限整体变更为股份有限公司的情形详见本律师工作报告“四、发行人的设立”部分。

#### 2、2020年9月，伟测科技第一次增资

2020年9月9日，伟测科技召开2020年第二次临时股东大会，审议并作出决议，同意公司增加注册资本550万元，公司注册资本由5,000万元增加至5,550万元。

新增注册资本由以下股东认缴：

序号	增资股东姓名/名称	投资总额 (万元)	计入注册资本 (万元)	计入资本公积 (万元)	出资方式
1	苏民智能	446.1444	22.3072	423.8372	货币
2	深圳南海	1,000.00	50.00	950.00	货币
3	金浦新潮	561.1066	28.0553	533.0513	货币
4	芯伟半导体	100.00	5.00	95.00	货币
5	新潮科技	407.4024	20.3701	387.0323	货币
6	涂洁	266.672629	13.3333	253.339329	货币
7	先锋智造	81.7476	4.0874	77.6602	货币
8	远海明晟	2,000.00	100.00	1,900.00	货币
9	广西泰达	500.00	25.00	475.00	货币
10	苏民投君信	5,636.9322	281.8467	5355.0855	货币
	<b>总计</b>	<b>11,000.00</b>	<b>550.00</b>	<b>10,450.00</b>	--

注：上述苏民投君信投资总额中包括以其持有的公司 5,000 万元债权转增公司股本 250 万元。

本次增资完成后，伟测科技的注册资本为 5,550 万元。

2020 年 9 月 30 日，上海鳌浩会计师事务所（普通合伙）出具“沪鳌验字（2020）第 041 号”《验资报告》，确认截至 2020 年 9 月 21 日止，伟测科技已收到股东缴纳的新增实收资本合计人民币伍佰伍拾万元（大写），股东以货币出资 550.00 万元。本次增资后，伟测科技的注册资本为 5,550 万元，实收资本为 5,550 万元。

2020 年 10 月 12 日，发行人就上述增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，发行人的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认购股份数 (股)	实收股本 (股)	持股比例 (%)	出资方式
1	蕊测半导体	27,032,838.00	27,032,838.00	48.71	货币



序号	股东姓名/名称	认购股份数 (股)	实收股本 (股)	持股比例 (%)	出资方式
2	惠泉元禾	5,304,716.00	5,304,716.00	9.56	货币
3	苏民智能	4,684,516.00	4,684,516.00	8.44	货币
4	深圳南海	4,918,716.00	4,918,716.00	8.86	货币
5	金浦新潮	3,086,086.00	3,086,086.00	5.56	货币
6	芯伟半导体	2,247,669.00	2,247,669.00	4.05	货币
7	新潮科技	2,240,713.00	2,240,713.00	4.04	货币
8	涂洁	1,466,667.00	1,466,667.00	2.64	货币
9	先锋智造	449,612.00	449,612.00	0.81	货币
10	远海明晟	1,000,000.00	1,000,000.00	1.80	货币
11	广西泰达	250,000.00	250,000.00	0.45	货币
12	苏民投君信	2,818,467.00	2,818,467.00	5.08	货币
合计		<b>55,500,000.00</b>	<b>55,500,000.00</b>	<b>100</b>	--

### 3、2020年10月，伟测科技第二次增资

2020年9月25日，伟测科技召开2020年第三次临时股东大会，审议并作出决议，同意公司增加注册资本50万元，公司注册资本由5,550万元增加至5,600万元。

新增注册资本由以下股东认缴：

序号	增资股东姓名/名称	投资总额 (万元)	计入注册资本 (万元)	计入资本公积 (万元)	出资方式
1	顾成标	1,000.00	50.00	950.00	货币
总计		<b>1,000.00</b>	<b>50.00</b>	<b>950.00</b>	--

本次增资完成后，伟测科技的注册资本为5,600万元。

2020年10月20日，天健会计师出具“天健验〔2020〕6-80号”《验资报告》，确认截至2020年10月19日止，伟测科技已收到顾成标缴纳的新增注册资本（实收股本）合计人民币伍拾万元整（¥500,000.00），计入资本公积（股本溢价）9,500,000.00元。出资者以货币出资10,000,000.00元。

2020年11月3日，发行人就上述增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，发行人的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认购股份数 (股)	实收股本 (股)	持股比例 (%)	出资方式
1	蕊测半导体	27,032,838.00	27,032,838.00	48.2729	货币
2	惠泉元禾	5,304,716.00	5,304,716.00	9.4727	货币
3	苏民智能	4,684,516.00	4,684,516.00	8.3652	货币
4	深圳南海	4,918,716.00	4,918,716.00	8.7834	货币
5	金浦新潮	3,086,086.00	3,086,086.00	5.5109	货币
6	芯伟半导体	2,247,669.00	2,247,669.00	4.0137	货币
7	新潮科技	2,240,713.00	2,240,713.00	4.0013	货币
8	涂洁	1,466,667.00	1,466,667.00	2.6190	货币
9	先锋智造	449,612.00	449,612.00	0.8029	货币
10	远海明晟	1,000,000.00	1,000,000.00	1.7857	货币
11	广西泰达	250,000.00	250,000.00	0.4464	货币
12	苏民投君信	2,818,467.00	2,818,467.00	5.0330	货币
13	顾成标	500,000.00	500,000.00	0.8929	货币
合计		<b>56,000,000.00</b>	<b>56,000,000.00</b>	<b>100</b>	--

#### 4、2020年11月，伟测科技第三次增资

2020年11月5日，伟测科技召开2020年第四次临时股东大会，审议并作出决议，同意公司增加注册资本532万元，公司注册资本由5,600万元增加至6,132万元。

新增注册资本由以下股东认缴：

序号	增资股东姓名/名称	投资总额 (万元)	计入注册资本 (万元)	计入资本公积 (万元)	出资方式
1	涂洁	400.00	11.20	388.80	货币
2	顾成标	2,600.00	72.80	2,527.20	货币
3	云泽裕庆	1,000.00	28.00	972.00	货币
4	远海明晟	2,000.00	56.00	1,944.00	货币
5	南山基金	5,000.00	140.00	4,860.00	货币
6	德同合心	5,000.00	140.00	4,860.00	货币

序号	增资股东姓名/名称	投资总额 (万元)	计入注册资本 (万元)	计入资本公积 (万元)	出资方式
7	广西泰达	1,000.00	28.00	972.00	货币
8	苏民投君信	2,000.00	56.00	1,944.00	货币
总计		<b>19,000.00</b>	<b>532.00</b>	<b>18,468.00</b>	--

本次增资完成后，伟测科技的注册资本为 6,132 万元。

2020 年 11 月 28 日，天健会计师出具“天健验字〔2020〕6-108 号”《验资报告》，确认截至 2020 年 11 月 27 日止，伟测科技已收到各自然人及公司缴纳的新增注册资本（实收股本）合计人民币伍佰叁拾贰万元整（¥5,320,000.00），计入资本公积（股本溢价）184,680,000.00 元。出资者已货币出资 190,000,000.00 元。

2020 年 12 月 15 日，发行人就上述增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，发行人的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认购股份数 (股)	实收股本 (股)	持股比例 (%)	出资方式
1	蕊测半导体	27,032,838.00	27,032,838.00	44.0849	货币
2	走泉元禾	5,304,716.00	5,304,716.00	8.6509	货币
3	苏民智能	4,684,516.00	4,684,516.00	7.6395	货币
4	深圳南海	4,918,716.00	4,918,716.00	8.0214	货币
5	金浦新潮	3,086,086.00	3,086,086.00	5.0328	货币
6	芯伟半导体	2,247,669.00	2,247,669.00	3.6655	货币
7	新潮科技	2,240,713.00	2,240,713.00	3.6541	货币
8	涂洁	1,578,667.00	1,578,667.00	2.5745	货币
9	先锋智造	449,612.00	449,612.00	0.7332	货币
10	远海明晟	1,560,000.00	1,560,000.00	2.5440	货币
11	广西泰达	530,000.00	530,000.00	0.8643	货币
12	苏民投君信	3,378,467.00	3,378,467.00	5.5096	货币
13	顾成标	1,228,000.00	1,228,000.00	2.0026	货币
14	德同合心	1,400,000.00	1,400,000.00	2.2831	货币
15	云泽裕庆	280,000.00	280,000.00	0.4566	货币

序号	股东姓名/名称	认购股份数 (股)	实收股本 (股)	持股比例 (%)	出资方式
16	南山基金	1,400,000.00	1,400,000.00	2.2831	货币
合计		<b>61,320,000.00</b>	<b>61,320,000.00</b>	<b>100</b>	<b>-</b>

### 5、2021年5月，伟测科技第四次增资

2021年5月28日，伟测科技召开2021年第一次临时股东大会，审议并作出决议，同意公司增加注册资本408.80万元，公司注册资本由6,132万元增加至6,540.8万元。

新增注册资本由以下股东认缴：

序号	增资股东姓名/名称	投资总额 (万元)	计入注册资本 (万元)	计入资本公积 (万元)	出资方式
1	深圳南海	2,000.00	40.88	1,959.12	货币
2	涂洁	500.00	10.22	489.78	货币
3	广西泰达	1,500.00	30.66	1,469.34	货币
4	苏民投君信	6,000.00	122.64	5,877.36	货币
5	顾成标	2,000.00	40.88	1,959.12	货币
6	南山基金	8,000.00	163.52	7,836.48	货币
总计		<b>20,000.00</b>	<b>408.80</b>	<b>19,591.20</b>	--

本次增资完成后，伟测科技的注册资本为6,540.8万元。

2021年6月18日，天健会计师出具“天健验字〔2021〕6-62号”《验资报告》，确认截至2021年6月11日止，伟测科技已收到各自然人及公司缴纳的新增注册资本（实收股本）合计人民币肆佰零捌万捌千元整（¥4,088,000.00），计入资本公积（股本溢价）195,912,000.00元。出资者已货币出资200,000,000.00元。

2021年6月17日，发行人就上述增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，发行人的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认购股份数 (股)	实收股本 (股)	持股比例 (%)	出资方式
1	蕊测半导体	27,032,838.00	27,032,838.00	41.3296	货币
2	韋泉元禾	5,304,716.00	5,304,716.00	8.1102	货币
3	苏民智能	4,684,516.00	4,684,516.00	7.1620	货币
4	深圳南海	5,327,516.00	5,327,516.00	8.1451	货币
5	金浦新潮	3,086,086.00	3,086,086.00	4.7182	货币
6	芯伟半导体	2,247,669.00	2,247,669.00	3.4364	货币
7	新潮科技	2,240,713.00	2,240,713.00	3.4257	货币
8	涂洁	1,680,867.00	1,680,867.00	2.5698	货币
9	先锋智造	449,612.00	449,612.00	0.6874	货币
10	远海明晟	1,560,000.00	1,560,000.00	2.3850	货币
11	广西泰达	836,600.00	836,600.00	1.2790	货币
12	苏民投君信	4,604,867.00	4,604,867.00	7.0402	货币
13	顾成标	1,636,800.00	1,636,800.00	2.5024	货币
14	德同合心	1,400,000.00	1,400,000.00	2.1404	货币
15	云泽裕庆	280,000.00	280,000.00	0.4281	货币
16	南山基金	3,035,200.00	3,035,200.00	4.6404	货币
合计		<b>65,408,000.00</b>	<b>65,408,000.00</b>	<b>100</b>	-

根据伟测有限及发行人历次股权结构变动的工商登记档案、会议文件、历次验资报告等资料，并经本所律师查验，本所律师认为，伟测有限设立后至今历次股权结构的变动均已依法履行公司内部决策程序，历次股权变动合法、有效，各股东的出资均已实缴。

#### (四) 股东所持发行人股份的质押、冻结情况

根据发行人工商档案、股东调查表及发行人的确认，并经本所律师网络核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人的股权清晰，各股东所持发行人的股份不存在冻结、质押等权利限制情形。

## 八、发行人的业务

### (一) 发行人的经营范围和经营方式

#### 1、发行人的经营范围

根据报告期内发行人历次营业执照、公司章程及工商档案，并经本所律师查验，发行人经营范围为：“一般项目：半导体芯片的研发、测试、销售，电子器件制造（除显示器件、集成电路，有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的），电子产品、计算机软硬件的开发及销售，仪器仪表、机电设备的销售，自有设备租赁，从事半导体芯片测试领域内的技术服务、技术咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

根据招股说明书（申报稿）及发行人的确认，发行人主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务，与其《营业执照》所记载的经营范围相符，其经营范围和经营方式符合有关法律法规的规定。

## 2、发行人境内子公司的经营范围

经本所律师查验，报告期内发行人子公司实际从事的业务没有超出其营业执照核准的经营范围，其经营范围和经营方式符合有关法律法规的规定，具体情况如下：

序号	公司名称	经营范围
1	无锡伟测	许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2	上海威矽	半导体科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，半导体元器件测试、销售，计算机软硬件的开发、销售，仪器仪表、机电设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3	厦门伟测 （于2020年12月7日注销）	其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；专业化设计服务；集成电路制造；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

## （二）发行人及子公司取得的的资质、许可、备案文件

根据发行人提供的资质许可等文件，并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人及子公司拥有如下与经营活动相关的主要资质和许可、备案：

#### 1、进出口相关证书文件

序号	持证主体	证书名称	登记机关	海关注册编码/ 登记备案表编号	登记日期
1	伟测科技	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	浦东海关	3122260CSL	2017-04-19
2	伟测科技	对外贸易经营者备案登记表	上海市浦东新区商务委员会	02725948	2021-01-13
3	无锡伟测	海关进出口货物收发货人备案回执	无锡海关	32023631KN	2020-08-05
4	无锡伟测	对外贸易经营者备案登记表	无锡市对外贸易经济合作局	04184930	2020-07-31

#### 2、管理体系证书

序号	持证主体	证书类型	颁发机构	证书编号	证书内容	有效期限
1	伟测科技	质量管理体系认证证书	NOA Certification 挪亚检测	NOA16128 67	质量管理体系符合 GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2015 标准 认证范围：半导体芯片测试	2021/08/23- 2022/08/15
2	伟测科技	环境管理体系认证证书	NOA Certification 挪亚检测	NOA16128 68	环境管理体系符合 GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015 标准 认证范围：半导体芯片测试	2021/08/23- 2022/08/15
3	伟测科技	职业健康安全管理体系认证证书	NOA Certification 挪亚检测	NOA19947 51	职业健康安全管理体系符合 GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准 认证范围：半导体芯片测试	2021/08/23- 2022/08/12
4	伟测	质量管理	Quality	10515/0	质量管理体系符合	2020/05/28-

序号	持证主体	证书类型	颁发机构	证书编号	证书内容	有效期限
	科技	体系认证证书	Austria 奥世认证		IATF 16949:2016 不含产品设计 半导体芯片的熔丝 微调	2023/05/27
5	无锡伟测	质量管理体系认证证书	Quality Austria 奥世认证	25033/0	质量管理体系符合 ISO 9001:2015 集成电路芯片的熔 丝微调和测试服务	2020/11/05- 2023/11/04
6	无锡伟测	环境管理体系认证证书	Quality Austria 奥世认证	04198/0	环境管理体系符合 ISO 14001:2015 集成电路芯片的熔 丝微调和测试服务	2020/11/05- 2023/11/04
7	无锡伟测	职业健康安全管理体系认证证书	Quality Austria 奥世认证	00903/0	职业健康安全管理体系符合 ISO 4500:2018 集成电路芯片的熔 丝微调和测试服务	2020/11/05- 2023/11/04
8	无锡伟测	质量管理体系认证证书	Quality Austria 奥世认证	12314/0	质量管理体系符合 IATF 16949:2016 不含产品设计 半导体芯片的熔丝 微调	2021/11/03- 2024/11/02

### 3、高新技术企业证书

2018年11月发行人获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201831002935，有效期为3年。2021年度发行人高新技术企业复审已通过认定，截至本律师工作报告出具之日，正处于公示期。

经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日发行人及其境内子公司的经营范围已经工商管理部门核准，并已取得其所从事的相关经营所要求的资质，发行人及其境内子公司的经营范围、实际从事的业务和经营方式符合国家法律、法规和规范性文件的规定和要求。

### (三) 发行人在中国大陆之外从事经营的情况



根据发行人提供的对外投资资料及《审计报告》，并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人未在中国大陆以外的其他国家和地区从事经营活动。

#### （四）发行人业务的变更情况

根据发行人的说明及招股说明书（申报稿），并经本所律师查验，发行人主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。最近两年，发行人主营业务未发生变更。

#### （五）发行人的主营业务突出

根据《审计报告》，报告期内发行人主营业务收入情况如下：

年度	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
主营业务收入（元）	206,547,340.94	152,321,807.20	75,008,616.47	42,825,227.60
营业收入（元）	214,164,164.47	161,196,220.78	77,933,235.29	43,689,477.38
主营业务收入占比	96.44%	94.49%	96.25%	98.02%

根据发行人的上述财务数据，并经本所律师查验，报告期内发行人的营业收入以主营业务为主，发行人的主营业务突出。

#### （六）发行人的持续经营能力

经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人依法有效存续，发行人及境内子公司依照法律法规在其经营范围内开展经营活动，具备生产经营所需的各项资质证书或认证、备案文件，不存在影响其持续经营的法律障碍。根据《招股说明书（申报稿）》及发行人确认，截至本律师工作报告出具之日，在其合理预见范围内，不存在发行人所处行业的产业政策已经或者将要发生重大变化并对发行人持续经营有重大不利影响的情形，发行人已经在《招股说明书（申报稿）》披露了相关风险因素。

## 九、关联交易及同业竞争

### （一）关联方

参照《公司法》《企业会计准则第36号--关联方披露》《科创板股票上市规则》的规定，根据发行人股东及董事、监事及高级管理人员填写的调查表、

《审计报告》及发行人的确认，并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统的公开查询，截至报告期末，发行人主要关联方如下：

#### 1、发行人的控股股东、实际控制人

经本所律师查验，截至报告期末，发行人的控股股东为蕊测半导体、实际控制人为骈文胜。[详见本律师工作报告正文之“六、发起人、股东及实际控制人”]

#### 2、直接或间接持有发行人 5% 以上股份的其他股东

序号	关联方姓名	关联关系说明
1	韋泉元禾	直接持有发行人 8.1102% 股份
2	苏民智能	直接持有发行人 7.1620% 股份
3	深圳南海	直接持有发行人 8.1451% 股份
4	苏民投君信	直接持有发行人 7.0402% 股份
5	闻国涛	间接持有发行人 11.1319% 股份

#### 3、控股股东、实际控制人控制的除发行人外的其他企业

根据发行人控股股东提供的资料，并经本所律师查验，截至报告期末，公司控股股东蕊测半导体除持有发行人 41.3296% 股权外，未持有其他企业的股权。

根据发行人实际控制人骈文胜提供的资料，并经本所律师查验，截至报告期末，公司实际控制人骈文胜除通过蕊测半导体以及芯伟半导体间接持有发行人 22.39% 股权，未投资其他企业。

#### 4、发行人董事、监事及高级管理人员

根据发行人说明，并经本所律师查验，截至报告期末，发行人的董事、监事、高级管理人员共计 14 名。[详见本律师工作报告正文之“十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”部分]

#### 5、发行人的子公司

根据发行人子公司的工商登记档案等资料，并经本所律师查验，截至报告期末，发行人对外投资了 2 家全资子公司即上海威矽、无锡伟测、厦门伟测

（报告期内已注销）。[详见本律师工作报告正文之“十、发行人的主要财产”部分]。

6、直接或间接控制发行人的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或其他主要负责人

根据发行人控股股东的工商档案等资料，并经本所律师查验，截至报告期末，蕊测半导体的总经理为沈爽恒，执行董事为骈文胜，监事为闻国涛。

## 7、其他主要关联方

### （1）其他关联自然人

发行人控股股东、实际控制人、直接或间接持股 5%以上股份的自然人股东、董事、监事、高级管理人员的关系密切家庭成员；中国证监会、上交所或者发行人根据实质重于形式原则认定的其他与发行人有特殊关系，可能导致发行人利益对其倾斜的自然人。

### （2）其他关联法人

发行人的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织均属于发行人的关联方；中国证监会、上交所或者发行人根据实质重于形式原则认定的其他与发行人有特殊关系，可能导致发行人利益对其倾斜的法人或其他组织，该等企业主要包括：

序号	关联方名称	关联关系
1	上海承括电子科技有限公司	实际控制人骈文胜的配偶持股 70%且担任执行董事的公司
2	上海易立德信息技术股份有限公司	董事于波担任董事的公司
3	杭州艾芯智能科技有限公司	董事于波担任董事的公司
4	苏民创业投资有限公司	董事于波担任总裁的公司
5	苏民嘉禾无锡投资管理有限公司	董事于波担任总经理的公司
6	无锡聚源鑫信息科技有限公司	董事于波的弟弟担任总经理、执行董事的公司
7	深圳市锐骏半导体股份有限公司	董事陈凯担任董事的公司

序号	关联方名称	关联关系
8	普冉半导体（上海）股份有限公司	董事陈凯担任董事的公司
9	中微半导体（深圳）股份有限公司	董事陈凯担任董事的公司
10	赣州芯威企业管理中心	董事陈凯控制的公司
11	赣州恒芯远毅企业管理中心（有限合伙）	董事陈凯控制的公司
12	成都启英泰伦科技有限公司	董事祁耀亮担任董事的公司
13	苏州长瑞光电有限公司	董事祁耀亮担任董事的公司
14	同源微（北京）半导体技术有限公司	董事祁耀亮担任董事的公司
15	苏州汉朗光电有限公司	董事祁耀亮担任董事的公司
16	重庆晶朗光电有限公司	董事祁耀亮担任董事的公司
17	上海季丰电子股份有限公司	董事祁耀亮担任董事的公司
18	强一半导体（苏州）有限公司	董事祁耀亮担任董事的公司
19	西安吉利电子新材料股份有限公司	董事祁耀亮担任董事的公司
20	京微齐力（北京）科技有限公司	董事祁耀亮担任董事的公司
21	美芯晟科技（北京）有限公司	董事祁耀亮担任董事的公司
22	昇显微电子（苏州）有限公司	董事祁耀亮担任董事的公司
23	上海铭荃商务咨询中心	董事祁耀亮持股比例 100% 的企业
24	上海楼邻信息科技有限公司	独立董事徐伟的儿子持股比例 99% 的公司
25	上海遐米商务信息咨询中心	独立董事徐伟持股比例 100% 的企业
26	江苏奥德盛海洋装备服务有限公司	监事高晓配偶的父亲持股 75%，配偶的母亲持股 25%，且配偶父亲担任总经理的公司
27	无棣海忠软管制造有限公司	监事高晓配偶的父亲担任董事长的公司
28	江阴市尚时工程装备有限公司	监事高晓配偶的父亲持股 70%，配偶的母亲持股 30%，且配偶父亲担任执行董事的公司
29	中石化石油工程有限公司地球物理华北分公司	独立董事王怀芳哥哥担任副总政工师的公司
30	深圳市智汇科创科技有限公司	发行人控股股东总经理沈爽恒持股 99% 且担任执行董事的公司

序号	关联方名称	关联关系
31	江苏长电科技股份有限公司及其子公司	根据实质重于形式认定
32	上海芯伟半导体合伙企业（有限合伙）	根据实质重于形式认定

## 8、报告期内曾经的关联方

序号	关联方姓名或名称	关联关系
1	上海市浦东新区唐镇国澜餐饮店	董事、副总经理闻国涛弟弟曾经营的个体工商户（已于2021年2月22日注销）
2	长兴君桐	报告期内曾直接持有发行人5%以上的股份，2019年7月起不再持有发行人股份
3	新潮投资	报告期内曾直接持有发行人5%以上的股份，报告期末持有发行人的股份不足5%
4	金浦新潮	报告期内曾最高持有发行人5.7648%股份，报告期末持有的发行人股份不足5%
5	俞克	报告期内曾担任发行人的董事，2020年9月2日辞任
6	张锐	报告期内曾担任发行人的高级管理人员，2020年9月15日辞任
7	龚金新	报告期内曾担任发行人的监事，2019年12月15日不再担任
8	闻威	报告期内曾担任发行人的董事，2019年1月17日不再担任
9	张莉	报告期内曾担任发行人的监事，2019年7月19日不再担任
10	邵颖	报告期前12个月内曾最高间接持有发行人5.4257%股权，报告期末持有发行人的股份不足5%
11	王新潮	报告期内曾最高间接持有发行人5.28%股权，报告期末持有发行人股份不足5%
12	靖昕伟	报告期内曾最高间接持有发

序号	关联方姓名或名称	关联关系
		行人 14.0143% 股权，现已因长兴君桐投资管理合伙企业（有限合伙）退出而不再间接持有发行人的股份
13	江苏艾迪药业股份有限公司	离职董事俞克担任副总经理、财务总监的公司
14	上海尧红汽车租赁有限公司	离职高级管理人员张锐配偶持股 50% 的公司
15	江阴市尚时环境工程有限公司	监事高晓配偶的父亲持股 70%，配偶的母亲持股 30%，且配偶父亲担任执行董事的公司，报告期内已注销
16	江阴市工业设备安装有限公司	监事高晓配偶的父亲持股 70%，配偶的母亲持股 30%，且配偶父亲担任总经理的公司，报告期内已注销
17	南通宏富船务有限公司	监事高晓配偶的父亲于报告期内控制的公司，报告期内已注销
18	江阴市尚时锅炉有限公司	监事高晓配偶的父亲曾经控制的公司，现已注销
19	上海旻艾半导体科技有限公司	副总经理刘琨于报告期内担任总经理的公司，报告期内已离职
20	北京汉迪永创科技有限责任公司	副总经理刘琨于报告期内持有 75% 股权且担任监事的公司，报告期内已离职
21	河南华能房地产开发有限公司	报告期内曾间接持股 5% 以上的自然人靖昕伟持股 38% 的公司
22	河南母亲河文化传播有限公司	报告期内曾间接持股 5% 以上的自然人靖昕伟持股 60% 的公司
23	江阴新潮企业管理中心（有限合伙）	报告期内曾间接持股 5% 以上的自然人王新潮持股 55% 且担任执行事务合伙人的企业
24	江阴优检质量技术服务有限公司	报告期内曾间接持股 5% 以上的自然人王新潮持股

序号	关联方姓名或名称	关联关系
		51%且担任董事的公司
25	上海俊颐商务咨询中心（有限合伙）	离职监事张莉持股 48.5046%的企业
26	共青城利源投资合伙企业（有限合伙）	离职监事张莉持股 32.00% 且担任执行事务合伙人的企 业
27	嘉善君晟创业投资合伙企业（有限合伙）	离职监事张莉持股 99%的 企业
28	嘉善君桐股权投资合伙企业（有限合伙）	离职监事张莉持股 99%的 企业
29	嘉兴君俞投资合伙企业（有限合伙）	离职监事张莉持股 51.43% 的企业
30	深圳前海熠辉投资合伙企业（有限合伙）	离职董事闻威持股 99%的 企业
31	郑州昂普科技有限公司	离职董事闻威持股 79.21% 的公司
32	郑州和讯通信技术有限公司	离职董事闻威持股 79.21% 的公司
33	盐城锐显半导体材料有限公司	离职董事闻威于报告期内间 接持股 78%的公司
34	海口君禹商务信息咨询有限公司	离职董事闻威间接持股 78%且担任执行董事的公司
35	上海君桐股权投资管理有限公司	离职董事闻威持股 78%的 公司
36	上海昂普电子商务有限公司	离职董事闻威持股 67.3333%的公司
37	无锡君熠投资企业（有限合伙）	离职董事闻威持股 41.8137%的企业
38	嘉兴君卓投资合伙企业（有限合伙）	离职董事闻威持股 35.8021%且报告期内曾间 接持股 5%以上的自然人靖 昕伟持股 30.7314%的企业
39	芯存（浙江）科技有限公司	离职董事闻威曾于报告期内 担任经理、执行董事的公 司，报告期内已注销
40	嘉兴君颐投资管理有限公司	离职董事闻威曾于报告期内 间接持股 78%且担任经 理、执行董事的公司，报告 期内已注销
41	苏州桔云科技有限公司	邵颖于报告期内持股 80%

序号	关联方姓名或名称	关联关系
		且担任董事长兼总经理的公司
42	苏州茂地置业发展有限公司	邵颖于报告期内持股 100% 且担任执行董事的企业，报告期内已注销
43	苏州爱瑟菲智能科技有限公司	邵颖于报告期内持股 40% 的公司
44	厦门伟测半导体科技有限公司	发行人报告期内曾存在的全资子公司，2020 年 12 月 7 日注销

## (二) 关联交易

根据《审计报告》、相关关联交易协议等文件，发行人及其子公司在报告期内与关联方发生的主要关联交易如下：

### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### (1) 采购商品的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
强一半导体（苏州）有限公司	探针卡及维修	582,068.16	77,005.30	41,009.73	14,172.41
上海市浦东新区唐镇国澜餐饮店	餐饮		707,565.00	1,014,950.00	220,000.00
上海承括电子科技有限公司	速干墨水			24,180.00	
上海季丰电子股份有限公司	测试备件及服务	42,590.00	136,100.00	51,002.65	
江苏长电科技股份有限公司 [注]	测试设备	3,124,164.00			
小计		3,748,822.16	920,670.30	1,131,142.38	234,172.41

注：实际为江苏长电科技股份有限公司、江阴长电先进封装有限公司以及星科金朋半导体（江阴）有限公司合并披露，系关联公司

#### (2) 出售商品和提供劳务的关联交易



单位：元

关联方	关联交易内容	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
普冉半导体(上海)股份有限公司	检测服务及治具销售	9,157,669.58	17,977,381.34	9,969,172.49	5,331,300.61
中微半导体(深圳)股份有限公司	检测服务及治具销售	170,106.41	353,591.92		
江苏长电科技股份有限公司[注]	检测服务	353,324.72	8,832,588.68	13,710,133.61	12,765,019.17
强一半导体(苏州)有限公司	治具销售				6,600.00
小计		9,681,100.71	27,163,561.94	23,679,306.10	18,102,919.78

注：实际为江苏长电科技股份有限公司、江阴长电先进封装有限公司以及星科金朋半导体(江阴)有限公司合并披露，系关联公司

## 2、关联租赁

### (1) 公司出租情况

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	2021年1-6月确认的租赁收入	2020年度确认的租赁收入	2019年度确认的租赁收入	2018年度确认的租赁收入
江苏长电科技股份有限公司	检测设备	240,000.00	161,150.44	82,743.35	

### (2) 公司承租情况

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2021年1-6月确认的租赁费	2020年度确认的租赁费	2019年度确认的租赁费	2018年度确认的租赁费
江苏长电科技股份有限公司[注]	检测设备	23,121,549.52	4,916,871.17		
上海季丰电子股份有限公司	检测设备		133,000.00		
小计		23,121,549.52	5,049,871.17		

注：实际为江苏长电科技股份有限公司、江阴长电先进封装有限公司以及星科金朋半导体(江阴)有限公司合并披露，系关联公司

### 3、关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
骈文胜、秦君梅	9,500,000.00	2020/8/11	2021/7/16	否	该笔借款同时以骈文胜与李春华所有的房屋及占用范围内的土地使用权（沪房地浦字（2007）第052536号）提供抵押担保
骈文胜、秦君梅	10,000,000.00	2021/6/11	2022/5/30	否	
	4,800,000.00	2020/12/16	2021/9/15		
	4,800,000.00	2021/3/12	2022/3/11		
	5,000,000.00	2020/9/9	2021/9/8		
	10,000,000.00	2021/4/22	2022/4/21		
	9,000,000.00	2021/1/15	2022/1/14		
骈文胜	35,000,000.00	2021/6/10	2023/6/9	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为70,875,752.96元的固定资产提供抵押担保
骈文胜	3,276,000.00	2021/6/7	2024/6/7	否	
	780,300.33	2019/12/26	2021/12/15		
骈文胜	8,600,998.72	2020/12/15	2023/12/15	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为45,417,868.53元的固定资产提供抵押担保
	11,617,413.34	2021/1/12	2023/12/15		
	12,792,799.33	2021/2/9	2023/12/15		
	12,561,305.53	2021/6/3	2024/5/20		
骈文胜	633,238.06	2019/12/5	2022/1/14	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为6,550,425.01元的使用权资产提供抵押担保
	2,025,651.05	2019/12/17	2022/2/13		
	1,430,202.15	2019/12/17	2022/12/2		
	1,373,486.18	2020/2/28	2023/2/1		
骈文胜、秦君梅、	4,715,934.59	2020/5/27	2023/5/12	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为25,150,756.03元的使用权资产提供抵押担保
	5,386,984.78	2020/8/14	2023/8/14		
	4,803,947.55	2020/8/14	2023/8/29		

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
上海蕊测半导体科技有限公司	1,472,800.35	2020/9/3	2023/9/28		
	3,788,096.17	2020/11/3	2023/11/16		
	2,431,582.64	2020/11/3	2023/11/16		
骈文胜	2,019,049.78	2019/7/31	2022/7/16	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为 10,543,644.26 元的固定资产提供抵押担保
	2,136,788.86	2019/9/30	2022/9/14		
骈文胜、闻国涛	5,623,947.75	2019/4/22	2022/4/22	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为 28,262,022.81 元的使用权资产提供抵押担保
	11,088,989.22	2021/3/22	2023/3/22		
骈文胜、闻国涛、上海蕊测半导体科技有限公司	2,178,673.81	2019/8/10	2022/8/10	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为 15,463,001.41 元的使用权资产提供抵押担保
	4,038,936.72	2019/9/22	2022/9/21		
骈文胜、秦君梅	6,249,999.97	2020/9/29	2022/9/21	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 14,406,261.27 元的固定资产提供抵押担保
骈文胜	27,272,727.27	2020/11/17	2023/11/16	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 40,572,973.71 元的固定资产提供抵押担保
骈文胜	2,188,138.60	2021/5/27	2024/5/27	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为 12,678,814.93 元的在建工程提供抵押担保
	8,981,123.00	2021/7/9	2024/7/9		
骈文胜、闻国涛、路峰	16,315,765.94	2020/10/23	2023/10/22	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值为 3,683,316.99 元固定资产及 25,731,664.85 元的使用权资产提供抵押担保
骈文胜、闻国涛	15,442,092.38	2020/10/23	2022/10/21	否	该笔借款同时以公司所拥有的账面价值合计为 49,264,263.19 元的使用权资产提供抵押担保
上海蕊测半导体科技有限公司	5,985,909.73	2021/6/29	2024/6/29	否	
	14,901,803.78	2021/6/30	2024/6/30		
	12,581,522.94	2021/6/30	2024/6/30		

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
骈文胜、上海蕊测半导体科技有限公司	16,797,296.27	2021/7/1	2023/7/1	否	

#### 4、关联方资金拆借

(1) 2021年1-6月

无。

(2) 2020年度

单位：元

关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金拆借利息
拆出					
骈文胜	300,000.00		300,000.00		
路峰	150,000.00		150,000.00		
小计	450,000.00		450,000.00		

(3) 2019年度

单位：元

关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金拆借利息
拆入					
上海蕊测半导体科技有限公司	2,999,400.00	1,598,269.00	4,597,669.00		675,291.93
龚金新	200,000.00		200,000.00		15,696.44
路峰	1,380,000.00		1,380,000.00		108,115.28
秦君梅	1,000,000.00		1,000,000.00		78,344.40
小计	5,579,400.00	1,598,269.00	7,177,669.00		877,448.05
拆出					
路峰		150,000.00		150,000.00	
闻国涛	100,000.00	1,050,000.00	1,150,000.00		
骈文胜	333,500.00	580,000.00	613,500.00	300,000.00	

关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金拆借利息
小计	433,500.00	1,780,000.00	1,763,500.00	450,000.00	

## (4) 2018 年度

单位：元

关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金拆借利息
拆入					
上海蕊测半导体科技有限公司	3,580,400.00	269,000.00	850,000.00	2,999,400.00	490,106.48
龚金新		200,000.00		200,000.00	1,326.74
路峰		1,380,000.00		1,380,000.00	8,964.33
秦君梅		1,000,000.00		1,000,000.00	6,495.89
小计	3,580,400.00	2,849,000.00	850,000.00	5,579,400.00	506,893.44
拆出					
闻国涛	160,000.00	50,000.00	110,000.00	100,000.00	
骈文胜	100,000.00	720,000.00	486,500.00	333,500.00	
小计	260,000.00	770,000.00	596,500.00	433,500.00	

## 5、关键管理人员报酬

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
关键管理人员报酬	1,769,628.88	2,187,779.24	1,534,605.84	1,228,003.43

## (三) 关联方应收应付款项

## 1、应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2021.6.30		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款									
	普冉半导体(上海)股份有限公司	3,093,084.26	154,654.21	8,134,702.58	406,735.13	4,695,590.43	234,779.52	5,357,891.16	267,894.56
	中微半导体(深	116,682.18	5,834.11	111,041.35	5,552.07				

	圳)股份有限公司								
	江苏长电科技股份有限公司	30,357.49	1,517.87	189,693.86	9,484.69	1,886,532.31	94,326.62	2,914,899.69	145,744.98
	江阴长电先进封装有限公司			135,600.00	6,780.00				
	星科金朋半导体(江阴)有限公司			20,826.15	1,041.31	2,223,852.55	111,192.63	113,668.63	5,683.43
小计		3,240,123.93	162,006.19	8,591,863.94	429,593.20	8,805,975.29	440,298.77	8,386,459.48	419,322.97
其他应收款									
	骈文胜					304,952.10	15,247.61	333,500.00	16,675.00
	路峰					150,000.00	7,500.00		
	乔从缓					3,552.00	177.60		
	周歆瑶					18,569.00	928.45		
	龚金新							5,155.63	257.78
	闻国涛							100,000.00	5,000.00
小计						477,073.10	23,853.66	438,655.63	21,932.78

## 2、应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
应付账款					
	星科金朋半导体(江阴)有限公司	2,754,013.71	972,545.98		
	江阴长电先进封装有限公司	1,724,357.40	1,858,319.35		
	江苏长电科技股份有限公司	1,024,660.13	1,667,639.86		
	强一半导体(苏州)有限公司	575,435.00	46,796.00	29,925.00	
	上海季丰电子股份有限公司	48,126.70	97,858.00		
	上海承括电子科技有限公司			8,814.00	
小计		6,126,592.94	4,643,159.19	38,739.00	
其他应付款					

项目名称	关联方	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
	上海蕊测半导体科技有限公司	1,300.00	1,300.00	676,591.95	3,490,806.48
	闻国涛			900.00	900.00
	龚金新			87,696.44	201,326.74
	路峰			108,115.28	1,388,964.33
	秦君梅			78,344.40	1,006,495.89
小计		1,300.00	1,300.00	951,648.07	6,088,493.44

#### (四) 发行人的关联交易决策程序

1、发行人第一届董事会第三次会议及 2020 年第三次临时股东大会通过了《关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2020 年日常关联交易预计的议案》，预计公司 2020 年与关联方发生的关联交易金额如下：

序号	公司名称	2020 年预估关联交易金额（元）
1	普冉半导体（上海）股份有限公司	32,000,000
2	中微半导体（深圳）股份有限公司	600,000

公司为上述关联方提供晶圆测试及成品测试服务，公司综合考虑市场报价及客户需求等因素与上述关联方协商确定价格，同公司其他客户相比，不存在重大差异，交易价格公允。

2、发行人独立董事对发行人 2020 年日常关联交易预计发表了独立意见，认为公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，日常关联交易表决程序合法，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害股东利益。董事会在审议该项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、发行人第一届董事会第九次会议及 2021 年第二次临时股东大会通过了《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》，确认公司最近三年一期的关联交易情况如下：

购销商品、提供和接受劳务的关联交易					
采购商品的关联交易					
关联方	关联交易内容	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
强一半导体	探针卡及维修	582,068.16	77,005.30	41,009.73	14,172.41

(苏州)有限公司					
上海市浦东新区唐镇国澜餐饮店	餐饮		707,565.00	1,014,950.00	220,000.00
上海承括电子科技有限公司	速干墨水			24,180.00	
上海季丰电子股份有限公司	测试备件及服务	42,590.00	136,100.00	51,002.65	
江苏长电科技股份有限公司及其子公司	测试设备	3,124,164.00			
小计		3,748,822.16	920,670.30	1,131,142.38	234,172.41
出售商品和提供劳务的关联交易					
关联方	关联交易内容	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
普冉半导体(上海)股份有限公司	检测服务及治具销售	9,157,669.58	17,977,381.34	9,969,172.49	5,331,300.61
中微半导体(深圳)股份有限公司	检测服务及治具销售	170,106.41	353,591.92		
江苏长电科技股份有限公司及其子公司	检测服务	353,324.72	8,832,588.68	13,710,133.61	12,765,019.17
强一半导体(苏州)有限公司	治具销售				6,600.00
小计		9,681,100.71	27,163,561.94	23,679,306.10	18,102,919.78
<b>关联租赁</b>					
公司出租情况					
承租方名称	租赁资产种类	2021年1-6月确认的租赁收入	2020年度确认的租赁收入	2019年度确认的租赁收入	2018年度确认的租赁收入
江苏长电科技股份有限公司	检测设备	240,000.00	161,150.44	82,743.35	
公司承租情况					
出租方名称	租赁资产种类	2021年1-6月确认的租赁费	2020年度确认的租赁费	2019年度确认的租赁费	2018年度确认的租赁费
江苏长电科技股份有限公司	检测设备	23,121,549.52	4,916,871.17		



公司及其子公司					
上海季丰电子股份有限公司	检测设备		133,000.00		
小计		23,121,549.52	5,049,871.17		
<b>关联方资金拆借</b>					
2021年1-6月，无。					
2020年度					
关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金拆借利息
拆出					
骈文胜	300,000.00		300,000.00		
路峰	150,000.00		150,000.00		
小计	450,000.00		450,000.00		
2019年度					
关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金拆借利息
拆入					
上海蕊测半导体科技有限公司	2,999,400.00	1,598,269.00	4,597,669.00		675,291.93
龚金新	200,000.00		200,000.00		15,696.44
路峰	1,380,000.00		1,380,000.00		108,115.28
秦君梅	1,000,000.00		1,000,000.00		78,344.40
小计	5,579,400.00	1,598,269.00	7,177,669.00		877,448.05
拆出					
路峰		150,000.00		150,000.00	
闻国涛	100,000.00	1,050,000.00	1,150,000.00		
骈文胜	333,500.00	580,000.00	613,500.00	300,000.00	
小计	433,500.00	1,780,000.00	1,763,500.00	450,000.00	
2018年度					
关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金拆借利息
拆入					
上海蕊测半导体科技有限公司	3,580,400.00	269,000.00	850,000.00	2,999,400.00	490,106.48

龚金新		200,000.00		200,000.00	1,326.74
路峰		1,380,000.00		1,380,000.00	8,964.33
秦君梅		1,000,000.00		1,000,000.00	6,495.89
小计	3,580,400.00	2,849,000.00	850,000.00	5,579,400.00	506,893.44
拆出					
闻国涛	160,000.00	50,000.00	110,000.00	100,000.00	
骈文胜	100,000.00	720,000.00	486,500.00	333,500.00	
小计	260,000.00	770,000.00	596,500.00	433,500.00	

4、发行人独立董事发表独立意见如下：“公司最近三年一期的关联交易遵循自愿、有偿和公平的商业原则，履行了相关决策程序，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事已按规定回避表决，会议的召开、审议和表决程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。”

5、经本所律师查验，发行人现行有效的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》规定并明确了关联交易公允决策的程序。

据此，本所律师认为，发行人已制定关联交易的决策程序并有效执行。

#### （五）关联交易承诺

为有效规范与减少关联交易，发行人控股股东蕊测半导体、实际控制人骈文胜、持股 5% 以上的股东及发行人董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于规范关联交易的承诺函》，具体如下：

“1、承诺人将严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定行使股东权利，杜绝非法占用公司资金、资产的行为，不要求发行人为本人提供任何形式的违法违规担保。

2、承诺人将尽量避免和减少与发行人之间的关联交易。对于正常经营范围内或存在其他合理原因无法避免而发生的关联交易，承诺人将遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按相关法律法规、法规以及规范性文件及《公司章程》的规定履行交易审批程序及信息

披露义务，并保证该等关联交易均将基于关联交易原则实施，切实保护发行人及发行人股东利益，保证不通过关联交易损害发行人及发行人股东的合法权益。

3、承诺人保证将按照法律、法规和《公司章程》规定切实遵守公司召开股东大会、董事会进行关联交易表决时相应的回避程序。

4、如承诺人违反上述承诺，将遵照另行出具的《关于未能履行承诺的约束措施的承诺》承担相应责任。”

### （六）同业竞争

发行人的主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。

根据控股股东及实际控制人提供的对外投资企业资料、填写的调查表及控股股东及实际控制人的确认，经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。

为有效防止及避免同业竞争，发行人控股股东蕊测半导体、实际控制人骈文胜已向发行人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体如下：

“1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的其他企业与发行人及其子公司之间不存在同业竞争的情形。

2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与发行人及子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接地从事与发行人及子公司业务相同或相似的业务。

3、承诺人及其控制的其他企业如从任何第三方获得的任何商业机会与发行人及其所控制的企业经营的业务构成或可能构成竞争，则承诺人将立即通知发行人，并承诺将该等商业机会优先让渡于发行人。

4、如发行人或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与发行人及子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业

将在发行人或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。

5、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。

6、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用控股股东的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。

7、承诺函自出具之日起具有法律效力，在承诺人作为发行人控股股东期间持续有效，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司造成损失，承诺人承诺将承担相应的法律责任。”

综上，本所律师认为，发行人报告期内不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易；发行人已在《公司章程》及《公司章程（草案）》及其内部制度中规定了关联交易的决策程序；截至本律师工作报告出具之日，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。

## 十、发行人的主要财产

### （一）不动产权及租赁使用权

#### 1、自有不动产权

根据发行人提供的土地使用权证/不动产权证等资料，并经本所律师查验，截止本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司拥有的不动产权如下所示：

序号	权证编号	坐落位置	面积（m <sup>2</sup> ）	用途	权利人	使用期限	取得方式	他项权利
1	苏（2021）无锡市不动产权第0242580号	新达路28-11，28-12	房屋建筑面积： 5,951.07 独用土地使用权面积： 9,094.80	工业用地/工业、交通、仓储	无锡伟测	至2053年08月29日止	出让	抵押

根据无锡伟测与招商银行无锡分行签订的《最高额抵押合同》，无锡伟测

已将上述不动产抵押给招商银行无锡分行用于授信融资，抵押期限自 2021 年 8 月 3 日至 2026 年 8 月 2 日。

## 2、不动产权租赁情况

根据发行人及其子公司提供的房屋租赁合同等资料，并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司的主要租赁使用权情况如下：

序号	出租方	承租方	租赁坐落	租赁用途	面积	租赁期间
1	上海新发创运置业有限公司	伟测科技	上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 幢	生产	1,984.89 m <sup>2</sup>	2019/03/30 -2024/03/29
2	上海新发创运置业有限公司	伟测科技	上海市浦东新区胜利路 188 号 D 区 1 幢	生产、办公	3,704.43 m <sup>2</sup>	2021/03/01 -2031/02/28
3	无锡星洲工业园区开发股份有限公司	无锡伟测	无锡新加坡工业园 301 地块 503 号厂房	办公	7,875.65 m <sup>2</sup> /12,751.29m <sup>2</sup>	2021/06/01 -2026/05/31

此外，经本所律师查验，上述房屋租赁合同未办理房屋租赁备案手续。根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]11 号）第四条的规定，“若合同当事人并未将登记备案作为房屋租赁合同生效要件的，房屋租赁合同不以办理登记备案手续作为生效要件，未办理登记备案的房屋租赁合同，不存在《中华人民共和国合同法》规定的无效或可撤销的情形时，应认定合法有效，合同签订双方应按约履行合同约定义务”。经本所律师查验，发行人及子公司与出租方签署的房屋租赁合同均未约定以合同登记备案作为合同的生效要件。

据此，本所律师认为，发行人所承租的上述部分房屋存在未办理备案手续的情形，该情形不影响租赁关系的法律效力，不会对发行人持续生产经营造成不利影响。

就上述租赁未履行备案手续事宜，发行人实际控制人骈文胜出具承诺函，承诺如下：如由于上述租赁房产权利瑕疵等相关事项致使第三方主张权利、行

政机关行使职权或其他原因导致发行人受到行政处罚或房产及土地出现无法继续使用或需要搬迁等不利事项，搬迁损失、政府部门的罚款或其他不利后果由承诺人连带承担，若发行人先行承担，则由承诺人无条件以现金方式全额补偿给发行人。承诺人同时承诺将在尽可能短的时间内负责在原经营场所附近寻找商业价值相似的物业供发行人使用，因此产生的额外支出由承诺人承担。

如发行人因租赁房屋未办理登记备案手续而受到处罚，则由承诺人无条件以现金方式全额补偿给发行人，确保发行人不因此而遭受任何经济损失。

综上，本所律师认为，截至本律师工作报告出具之日，发行人及子公司占有、使用上述房产不存在限制及障碍，且该等未办理备案的房产具有可替代租赁房源，不会对发行人主营业务构成实质性影响，故前述未办理租赁备案事宜不会对发行人的持续经营能力产生重大不利影响，不会对发行人本次发行上市构成实质性法律障碍。

## （二）发行人拥有的知识产权

### 1、商标

根据发行人提供的商标注册证书、商标统计汇总表、国家商标局出具的商标档案及本所律师通过国家商标局网站的公开查询，并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人及子公司拥有 3 项注册商标，具体情况如下：

序号	权利人	商标标识	注册号	类别	注册有效期	核定使用商品/服务项目	取得方式
1	伟测科技		20878315	42	2017-09-28 至 2027-09-27	质量检测；质量评估；物理研究；机械研究。	原始取得
2	伟测科技		20878280	42	2017-12-07 至 2027-12-06	技术研究；技术项目研究；质量检测；质量评估；化学分析；材料测试；物理研究；机械研究；信息技术咨询服务。	原始取得
3	伟测科技		20878303	42	2017-12-14 至 2027-12-13	技术研究；技术项目研究；质量检测；质量评估；化学分析；材料测试；物理研	原始取得

序号	权利人	商标标识	注册号	类别	注册有效期	核定使用商品/服务项目	取得方式
						究；机械研究；信息技术咨询服务。	

根据上述核查，本所律师认为，发行人合法拥有上述注册商标，不存在权属纠纷。

## 2、专利

根据发行人提供的专利证书、专利统计汇总表、国家知识产权局出具的专利登记簿副本及本所律师通过国家知识产权局网站的公开查询，截至本律师工作报告出具之日，发行人及子公司已取得有效的发明专利 6 项；实用新型 18 项，目前在专利保护期内的专利具体信息如下：

### (1) 发明专利

序号	名称	权利人	专利号	申请日	取得方式	他项权利
1	晶圆区域性问题的分析系统及方法	伟测科技	202110310750.9	2021-03-24	原始取得	无
2	多晶硅工艺保险丝的熔断装置及方法	无锡伟测	202110248636.8	2021-03-08	专利转让	无
3	一种测试机匹配检测系统及其方法	伟测科技	202011533224.0	2020-12-23	原始取得	无
4	一种 Wafer ID 烧写防呆的系统	伟测科技	202011523844.6	2020-12-22	原始取得	无
5	一种多平台联动提效机构	伟测科技	202011489734.2	2020-12-17	原始取得	无
6	一种集成电路精确测试小电阻的方法	伟测科技	202011160294.6	2020-10-27	原始取得	无

注：上述发明专利的专利期限为二十年，自申请日起算。上述第 2 项专利系无锡伟测从发行人处受让取得，转让过程合法、有效，并已在国家知识产权局备案。

### (2) 实用新型专利

序号	名称	权利人	专利号	申请日	取得方式	他项权利
----	----	-----	-----	-----	------	------

序号	名称	权利人	专利号	申请日	取得方式	他项权利
1	一种 Chroma Q-type 转接板开路 断路检验装置	无锡伟测	202120877907.1	2021-04-26	原始取得	无
2	一种子母式探针 卡装配结构	无锡伟测	202120864029.X	2021-04-25	原始取得	无
3	一种延长墨管使用 寿命的装置	无锡伟测	202120868460.1	2021-04-25	原始取得	无
4	一种防止测试载 板结霜的装置	无锡伟测	202120866185.X	2021-04-25	原始取得	无
5	一种方便操作的 便携式有线线缆 检测机构	无锡伟测	2021205545109	2021-03-18	原始取得	无
6	一种探针卡针延 长寿命用的垫座	无锡伟测	2021205561455	2021-03-18	原始取得	无
7	一种芯片测试机 上的真空除尘结 构	伟测科技	201721787488.2	2017-12-20	原始取得	无
8	一种防止集成电 路针测扎偏的装 置	伟测科技	201721787486.3	2017-12-20	原始取得	无
9	一种芯片测试机 的翻转机构	伟测科技	201721787489.7	2017-12-20	原始取得	无
10	一种电路板测试 装置	伟测科技	201721231664.4	2017-09-25	原始取得	无
11	一种真空吸附检 测台的承载平台	无锡伟测	201721231321.8	2017-09-25	专利转让	无
12	一种可以提高打 点产品效率的模 具	无锡伟测	201721231323.7	2017-09-25	专利转让	无
13	一种自动油墨打 点器	无锡伟测	201721231624.X	2017-09-25	专利转让	无
14	一种自动降温器	伟测科技	201721231457.9	2017-09-25	原始取得	无
15	一种利用工业空 调冷却水实现测 试机冷循环装置	伟测科技	201720068187.8	2017-01-20	原始取得	无
16	一种背银、背金 晶圆测试稳压装 置	伟测科技	201720068189.7	2017-01-20	原始取得	无
17	一种易于安装的 晶圆测试装置	伟测科技	201720068329.0	2017-01-20	原始取得	无



序号	名称	权利人	专利号	申请日	取得方式	他项权利
18	一种抗干扰晶圆测试机外壳	伟测科技	201720068188.2	2017-01-20	原始取得	无

注：上述实用新型专利的专利期限为十年，自申请日起算。上述第 11、12、13 项专利系无锡伟测从发行人处受让取得，转让过程合法、有效，并已在国家知识产权局备案。

据此，本所律师认为，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司合法拥有上述专利，不存在合作研发的情形。上述专利均在专利保护期内，不存在权属纠纷。

### 3、许可专利使用权情况

截至本律师工作报告出具之日，发行人拥有 12 项许可专利使用权，具体情况如下：

序号	名称	专利号	类型	授权公告日	发明人	权利人
1	一种晶元芯片检测工装	201521040030.1	实用新型	2016/05/11	邹磊	普钰电子（上海）有限公司
2	一种晶元自动检测设备用探针定位夹具	201521035597.X	实用新型	2016/05/11	杨会会	普钰电子（上海）有限公司
3	一种探针安装座	201521035631.3	实用新型	2016/05/11	张旆	普钰电子（上海）有限公司
4	一种组合式探针检测头	201521035608.4	实用新型	2016/05/11	张旆	普钰电子（上海）有限公司
5	一种晶元芯片检测头结构	201521035528.9	实用新型	2016/05/11	邹磊	普钰电子（上海）有限公司
6	一种晶元芯片检测头组件	201521035600.8	实用新型	2016/05/11	杨会会	普钰电子（上海）有限公司
7	一种基于探针的检测头结构	201521035563.0	实用新型	2016/05/11	邹磊	普钰电子（上海）有限公司

序号	名称	专利号	类型	授权公告日	发明人	权利人
8	一种调节式晶元片检测头组件	201620794239.5	实用新型	2017/01/25	何佳	普铄电子(上海)有限公司
9	一种基于探针的检测头组件	201620794220.0	实用新型	2017/01/25	郑清林	普铄电子(上海)有限公司
10	一种稳定型晶元片检测头组件	201620794217.9	实用新型	2017/01/25	周莲国	普铄电子(上海)有限公司
11	一种便于更换探针的晶元片检测头	201620793335.8	实用新型	2017/01/25	汤慧敏	普铄电子(上海)有限公司
12	一种基于晶元片检测的探针组件	201620794219.8	实用新型	2017/01/25	何佳	普铄电子(上海)有限公司

#### 4、集成电路布图设计

截至本律师工作报告出具之日，发行人拥有 3 项集成电路布图设计登记证书，具体情况如下：

序号	布图设计权利人名称	布图设计名称	布图设计登记号	布图设计申请日	布图设计创作完成日	布图设计首次投入商业利用日	他项权利
1	伟测科技	电流值智能检测仪电路设计布图	BS.215515021	2021/02/08	2020/08/20	-	无
2	伟测科技	芯片内部温度检测仪电路设计布图	BS.215515048	2021/02/08	2020/08/20	-	无
3	伟测科技	智能电压值检测装置电路设计布图	BS.215515064	2021/02/08	2020/08/20	-	无

根据本所律师核查，发行人拥有的上述集成电路布图设计不存在合作研发的情形亦不存在权属纠纷。

#### 5、计算机软件著作权

根据发行人提供的计算机软件著作权登记证书以及本所律师对中国版权保护中心网站的公开查询，截至本律师工作报告出具之日，发行人总计拥有 1 项

计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	著作权人	名称	登记号	取得方式	首次发表日期	权利期限
1	伟测科技	伟测自动测试报告系统[简称：自动测报系统 V1.0]	2017SR457566	原始取得	2017-06-05	2017/06/05 - 2067/06/04

根据本所律师核查，发行人拥有的上述计算机软件著作权不存在合作研发的情形亦不存在权属纠纷。

## 6、域名

根据发行人提供的域名证书以及本所律师对中华人民共和国工业和信息化部公开信息的公开查询，截至本律师工作报告出具之日，发行人总计拥有 1 项域名并办理了 ICP 备案手续，具体情况如下：

序号	网站名称	网站首页网址	网站域名	审核通过时间	网站备案号
1	上海伟测半导体科技有限公司	www.v-test.com.cn	v-test.com.cn	2020-05-08	沪 ICP 备 16034671 号-1

根据本所律师核查，发行人拥有的上述域名不存在权属纠纷。

### (三) 发行人拥有的生产经营设备

根据发行人提供的固定资产清单、本所律师抽查主要生产经营设备的购买合同和《审计报告》，截止本律师工作报告出具之日，发行人的主要生产经营设备为半导体测试设备，该等设备均由发行人实际占有和使用，均通过合法途径取得，主要经营设备不存在产权纠纷或争议。

### (四) 发行人拥有的出资权益或股权

经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人拥有 3 家子公司，另有 1 家子公司已注销。根据相关公司的《营业执照》、工商档案、注册资料等文件，发行人对外投资的主要情况如下：

#### 1、子公司

##### (1) 无锡伟测

根据无锡市新吴区行政审批局于 2021 年 2 月 23 日核发的《营业执照》

（统一社会信用代码为：91320214MA21NM9A6P），并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统的公开查询，无锡伟测的基本情况如下：

企业名称	无锡伟测半导体科技有限公司
统一社会信用代码	91320214MA21NM9A6P
法定代表人	骈文胜
住所	无锡市新吴区新加坡工业园新达路 28-12 号厂房
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	18,000 万元人民币
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限	2020-06-09 至无固定期限

根据发行人提供的无锡伟测的工商档案、公司章程及发行人的确认，截至本律师工作报告出具之日，无锡伟测系依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人持有无锡伟测 100% 股权，该等股权不存在被质押、冻结等权利限制。

## （2）上海威矽

中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局于 2017 年 6 月 4 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码为 91310115MA1K3JBC3G），并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统的公开查询，上海威矽的基本情况如下：

企业名称	上海威矽半导体科技有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1K3JBC3G
法定代表人	骈文胜
住所	中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	300 万元人民币
经营范围	半导体科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，半导体元器件测试、销售，计算机软硬件的开发、销售，仪器仪表、机电设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	2016-11-08 至 2066-11-07

根据发行人提供的上海威矽的工商档案、公司章程及发行人的确认，截至本律师工作报告出具之日，上海威矽系依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人持有上海威矽 100% 股权，该等股权不存在被质押、冻结等权利限制

### (3) 南京伟测

根据南京市浦口区行政审批局于 2021 年 10 月 21 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码为 91320111MA2798JE32），并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统的公开查询，南京伟测的基本情况如下：

企业名称	南京伟测半导体科技有限公司
统一社会信用代码	91320111MA2798JE32
法定代表人	骈文胜
住所	南京市浦口区浦口经济开发区双峰路 69 号 C-93
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	5,000 万元人民币
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限	2021-10-21 至无固定期限

根据发行人提供的南京伟测的营业执照、公司章程及发行人的确认，截至本律师工作报告出具之日，南京伟测系依法设立并有效存续的有限责任公司，发行人持有南京伟测 100% 股权，该等股权不存在被质押、冻结等权利限制。

## 2、报告期内注销的子公司

### (1) 厦门伟测

根据发行人提供的工商档案并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统的公开查询，厦门伟测注销前的基本情况如下：

企业名称	厦门伟测半导体科技有限公司
统一社会信用代码	91350200MA2YD0KBX9
法定代表人	骈文胜
住所	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区建港路 29 号海沧国际物流大厦 10 楼 1001 单元 F0181

类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	1,500 万元人民币
经营范围	其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；专业化设计服务；集成电路制造；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
经营期限	2017-07-05 至 2067-07-04
股权结构	伟测科技持股 100%

根据发行人提供的厦门伟测工商档案以及发行人的说明，厦门伟测于 2017 年 7 月 5 日设立，仅在登记机关办理工商登记，未在银行开立账户，也未在税务部门办理登记，后因精简机构需要，故通过决议解散公司。

2020 年 8 月 31 日，发行人作为厦门伟测的唯一股东，出具了《简易注销全体投资人承诺》，承诺厦门伟测注销登记前未发生债权债务/已将债权债务清算完结，不存在未结清清算费用、职工工资、社会保险费用、法定补偿金和未交清的应缴纳税款、营业执照遗失因办理企业简易注销手续不再重新补办及其他未了结事务，清算工作已全面完结。

经项目组访谈实际控制人骈文胜并进行网络核查，厦门伟测在存续期间未开展实际经营，不存在纠纷或潜在纠纷，不存在重大违法违规情形。

厦门伟测于 2020 年 12 月 7 日完成工商注销。

综上，根据发行人的说明及本所律师查验，发行人的上述财产均通过合法途径取得，不存在来自于上市公司的情形，截至本律师工作报告出具之日，上述财产不存在产权纠纷，不存在权利受到限制的情形。

## 十一、发行人的重大债权债务

### （一）重大销售合同

报告期内，公司一般与客户签署销售框架合同，而后在合同框架条款下主要通过订单方式交易，客户根据其自身实际需求下单，公司完成订单。公司重大销售合同的认定标准为：报告期内前五大客户的销售框架合同。

截至本律师工作报告出具之日，公司已签订的正在履行的重大销售框架合

同情况如下：

序号	客户名称	销售内容	合同类型/合同金额 (万元)	签署时间	履行情况
1	客户 A	集成电路测试服务	框架合同	2020.10.12	正在履行
2	晶晨半导体（上海）股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2021.01.02	正在履行
3	深圳中兴微电子技术有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2017.12.20	正在履行
4	上海安路信息科技股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2020.02.01	正在履行
5	普冉半导体（上海）股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2021.05.11	正在履行
6	Bitmain Technologies Limited（比特大陆）	集成电路测试服务	框架合同	2019.11.20	正在履行
7	江苏长电科技股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2020.03.02	正在履行
8	上海复旦微电子集团股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2018.06.06	正在履行
9	甬矽电子（宁波）股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2021.10.09	正在履行
10	上海捷策创电子科技有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2018.04.30	正在履行
11	上海艾为电子技术股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2019.12.10	正在履行
12	上海晶丰明源半导体股份有限公司	集成电路测试服务	框架合同	2016.11.22	正在履行

经本所律师查验，公司与主要客户签订的均为框架合同，公司的框架合同一般规定协议届满前，双方未订立新合同或以书面通知对方本协议期满终止，则本协议继续有效。公司报告期内与主要客户签订的框架合同皆在履行，公司不存在已履行的对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的销售合同。

## （二）重大采购合同

报告期内，公司主要的重大采购合同为购买机器设备，发行人及其子公司已签订的正在履行或履行完毕的金额在 100 万美元以上的或 1,000 万人民币以

上的重大采购订单以及重大的采购框架协议为公司的重大采购合同，情况如下：

序号	供应商名称	合同标的	币别	金额（万元）	签订日期	履行情况
1	致茂电子股份有限公司	集成电路测试机	USD	390.00	2021/6/4	正在履行
		集成电路测试机	USD	455.00	2020/3/16	正在履行
		集成电路测试机	USD	399.00	2019/6/5	正在履行
		集成电路测试机	USD	130.00	2020/8/28	履行完毕
		集成电路测试机	USD	75.00	2020/12/30	履行完毕
		集成电路测试机	USD	65.00	2020/12/30	履行完毕
		集成电路测试机	USD	65.00	2020/11/30	履行完毕
2	先域微电子技术服务（上海）有限公司	高速转塔测试机	RMB	1,459.19	2020/11/19	正在履行
3	ADVANTEST CORPORATION	集成电路测试机	-	框架协议	2021/6/29	正在履行
4	Teradyne (Asia) Pte.Ltd	集成电路测试机	USD	23.80	2020/8/28	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	22.80	2020/8/28	履行完毕
		集成电路测试机	USD	160.40	2020/8/28	履行完毕
		集成电路测试机	USD	89.00	2020/12/23	履行完毕
		集成电路测试机	USD	44.50	2020/12/24	履行完毕
		集成电路测试机	USD	89.00	2020/8/10	履行完毕
		测试机、设备板卡及备件	USD	94.20	2020/8/21	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	2.70	2021/5/18	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	29.80	2021/4/16	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	29.80	2021/5/9	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	27.23	2021/5/20	履行完毕
		设备板卡及备件	USD	7.78	2021/6/1	履行完毕
5	Semics.Inc	自动探针台	USD	530.00	2019/12/3	履行完毕
		探针台	USD	102.00	2020/9/15	履行完毕
		探针台	USD	51.00	2021/3/11	履行完毕
		探针台	USD	153.00	2021/3/11	履行完毕
		探针台	USD	20.40	2021/3/11	履行完毕
		其他周转材料	USD	0.24	2021/3/22	履行完毕



序号	供应商名称	合同标的	币别	金额（万元）	签订日期	履行情况
		探针台	USD	20.40	2021/4/26	履行完毕
		探针台	USD	397.00	2021/6/23	履行完毕
6	Tokyo Seimitsu Co., Ltd	探针台	JPY	16,600.00	2020/8/25	履行完毕
			JPY	49,305.00	2021/6/19	正在履行
7	天津金海通自动化设备股份有限公司	集成电路测试机	-	框架协议	2020/11/30	正在履行

注：在公司已签订的正在履行或履行完毕的金额在 100 万美元以上的或 1,000 万人民币以上的重大采购订单以及重大的采购框架协议中，北亚融资租赁（上海）有限公司、海通恒信国际融资租赁股份有限公司、诚泰融资租赁（上海）有限公司、远东国际融资租赁有限公司、苏州融华租赁有限公司未在上表中列示，具体信息详见本律师工作报告正文之“十一、发行人的重大债权债务”之“（四）重大融资租赁合同”

经本所律师查验，发行人上述重大采购和销售合同合法有效，截至本律师工作报告出具之日，发行人未发生与上述合同相关的重大纠纷或争议。

### （三）重大借款合同及担保合同

根据发行人提供的借款合同资料，并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司已履行完毕或正在履行的重大借款合同及担保合同（金额 500 万元人民币以上）如下：

序号	借款合同名称及编号	融资银行	担保（抵押）合同名称及编号	担保形式	借款开始日	借款到期日	币种	合同金额（万元）	履行情况
1	Z2005LN15676636	交通银行股份有限公司上海浦东新区支行	保证合同（C200514GR3109480）	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2020/6/1	2021/5/27	RMB	800.00	履行完毕
2	Z2007LN15624919		保证合同、抵押担保（C190311MG3107572、C200514GR3109480、JTYH0022020010120201231）	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保	2020/8/11	2021/7/16	RMB	950.00	正在履行

序号	借款合同名称及编号	融资银行	担保(抵押)合同名称及编号	担保形式	借款开始日	借款到期日	币种	合同金额(万元)	履行情况
3	97162020280206	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	最高额保证合同 ZB971620200000027	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2020/6/23	2021/6/22	RMB	500.00	履行完毕
4	97162020280312		最高额保证合同 ZB971620200000027	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2020/9/9	2021/9/8	RMB	500.00	正在履行
5	平银沪科创贷字20210111第001号	平安银行上海分行营业部	最高额保证担保合同【平银沪科创额保字20210111第001号、002号】	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2021/1/15	2022/1/14	RMB	900.00	正在履行
6	97162021280114	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	最高额保证合同 (ZB9716202000000027)	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2021/4/22	2022/4/21	RMB	1,000.00	正在履行
7	Z2105LN15651734	交通银行股份有限公司上海浦东新区支行	保证合同 (C200514GR3109480)	骈文胜、秦君梅提供最高额保证担保	2021/6/11	2022/5/30	RMB	1,000.00	正在履行
8	CL202012003	浦发硅谷银行有限公司	CL202012002-PG、 CL202012003-EM	骈文胜最高额不可撤销担保、机器设备抵押	2020/12/15	2023/12/15	USD	159.77	正在履行
9	CL202012003		CL202012002-PG、 CL202012003-EM	骈文胜最高额不可撤销担保、机器设备抵押	2021/1/12	2023/12/15	USD	179.83	正在履行
10	CL202012003		CL202012002-PG、 CL202012003-EM	骈文胜最高额不可撤销担保、机器设备抵押	2021/2/9	2023/12/15	USD	224.43	正在履行
11	CL202105002		CL202105002-EM	机器设备抵押	2021/6/3	2024/5/20	USD	200.00	正在履行
12	公授信字第		中国民生	最高额保证	骈文胜最高	2021/6/10	2023/6/9	RMB	3,500.00

序号	借款合同名称及编号	融资银行	担保(抵押)合同名称及编号	担保形式	借款开始日	借款到期日	币种	合同金额(万元)	履行情况
	02702021213200号	银行股份有限公司上海张江支行	合同(公高保字第02702021213201号)、最高额抵押合同:公高抵字第0270202021213202号、公高抵字第02702021213204号	额不可撤销担保					

#### (四) 重大融资租赁合同

根据发行人提供的融资租赁合同等资料,并经本所律师查验,截至本律师工作报告出具之日,发行人及其子公司正在履行的重大融资租赁合同情况如下:

序号	出租人	合同名称及编号	租金(元或美元/月)	签订日期/起租日	租赁期限	履行情况
(一) 上海伟测半导体科技股份有限公司						
1	北亚融资租赁(上海)有限公司	设备融资租赁合同 NAFL201629-12	5,864.04 美元	2016/12/9	24 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL201629-12 补充协议 NAFL20170102	95,108.00 元	2017/1/17	24 个月	履行完毕
2		设备融资租赁合同 NAFL2017032-05	45,425.92 美元	2017/5/31	24 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL2017032-05 补充协议 NAFL20170801	12,310.84 美元	2017/8/10	24 个月	履行完毕
3		设备融资租赁合同 NAFL2017046-07 (第一批)	35,270.81 美元	2017/7/31	24 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL2017046-07 (第二批)	60,371.38 美元	2017/7/31	24 个月	履行完毕
4		设备融资租赁合同 NAFL2017056-09	20,328.41 美元	2017/9/20	24 个月	履行完毕
5		设备融资租赁合同 NAFL2017066-11	529,201.16 元	2017/12/11	24 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL2017066-11 补充协议 NAFL20180201	128,742.81 元	2018/2/10	24 个月	履行完毕
6		设备融资租赁合同 NAFL2018013-05	467,057.00 元	2018/5/8	24 个月	履行完毕

序号	出租人	合同名称及编号	租金 (元或美元/ 月)	签订日期/ 起租日	租赁期限	履行情况
		设备融资租赁合同 NAFL2018013-05-02	334,590.22 元	2018/5/18	36 个月	履行完毕
7		设备融资租赁合同 NAFL2018026-07	350,537.88 元	2018/7/9	36 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL2018026-07 补充协议 NAFL20180810	30,431.49 元	2018/8/10	36 个月	履行完毕
8		设备融资租赁合同 NAFL2018028-09 (第一批)	42,896.99 元	2018/9/21	36 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL2018028-09 (第二批)	23,035.83 元	2018/9/21	36 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL2018028-09 补充协议 NAFL20181217	177,896.88 元	2018/12/10	36 个月	履行完毕
9		设备融资租赁合同 NAFL2019007-04	565,060.29 元	2019/5/5	36 个月	正在履行
		设备融资租赁合同 NAFL2019007-04	289,719.82 元	2019/6/10	36 个月	履行完毕
10		设备融资租赁合同 NAFL2019023-08 (第一批)	163,136.11 元	2019/8/23	36 个月	正在履行
		设备融资租赁合同 NAFL2019023-08 (第二批)	283,145.52 元	2019/8/23	36 个月	正在履行
		设备融资租赁合同 NAFL2019023-08 补充协议 NAFL20191015	133,461.81 元	2019/10/10	36 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL2019023-08 补充协议 NAFL20191101	142,305.81 元	2019/11/10	24 个月	履行完毕
11		设备融资租赁合同 NAFL2019030-11	499,195.28 元	2019/11/19	24 个月	履行完毕
12		设备融资租赁合同 NAFL2020034-02	638,955.70 元	2020/2/20	24 个月	履行完毕
		设备融资租赁合同 NAFL2020034-02 补充协议 NAFL20200415001	279,593.69 元	2020/4/21	24 个月	履行完毕
13		设备融资租赁合同 NAFL2021047-02	556,554.15 元	2021/3/26	24 个月	正在履行
14	浦银金融 租赁股份 有限公司	融资租赁合同（售后回租类） PYHZ0120200030	416,666.67 元	2020/9/29	24 个月	正在履行
15	交银金融 租赁有限 责任公司	融资租赁合同（回租）交银租赁字 【20190213】号	398,355.13 元	2019/12/26	24 个月	正在履行
16	芯鑫融资 租赁有限 责任公司	售后回租赁合同 SINOICL2020D08Y002-L-01	4,583,999.65 元	2020/3/31	36 个月	履行完毕
17	中电投融 和融资租 赁有限公	融资租赁合同（售后回租）RHZL- 2020-101-1382-SHWCBDT-001	2,727,272.73 元	2020/11/10	36 个月	正在履行

序号	出租人	合同名称及编号	租金 (元或美元/ 月)	签订日期/ 起租日	租赁期限	履行情况
	司					
18	仲利国际 租赁有限 公司	融资租赁合同 AA18100338AKX	140,625 元	2018/10/12	24 个月	履行完毕
19	苏州融华 租赁有限 公司	融资租赁合同 RH-L-2019009-1	162,469.75 元	2019/6/6	36 个月	正在履行
20		融资租赁合同 RH-L-2019009-2	149,972.10 元	2019/8/15	36 个月	正在履行
21		融资租赁合同 RH-L-2019023-1	37,287.45 元	2019/12/2	36 个月	正在履行
22		融资租赁合同 RH-L-2019023-2	119,278.00 元	2019/12/17	36 个月	正在履行
23		融资租赁合同 RH-L-2019023-3	84,216.00 元	2019/12/20	36 个月	正在履行
24		融资租赁合同 RH-L-2019023-4	72,669.00 元	2020/2/25	36 个月	正在履行
25		融资租赁合同 RH-L-2020003-1	7,757,856 元	2020/5/25	36 个月	正在履行
26		补充协议 RH-L-2020003-1/S01	216,978.00 元	2020/6/12	36 个月	正在履行
27		融资租赁合同 RH-L-2020003-2	140,162.00 元	2020/7/25	36 个月	正在履行
28		补充协议 RH-L-2020003-3/S01	223,014.00 元	2020/9/3	36 个月	正在履行
29		融资租赁合同 RH-L-2020003-4	90,976.00 元	2020/8/31	36 个月	正在履行
30		融资租赁合同 RH-L-2020003-5	199,026.00 元	2020/8/27	36 个月	正在履行
31		补充协议 RH-L-2020003-5/S01	198,877.00 元	2020/10/20	36 个月	正在履行
32		融资租赁合同 RH-L-2020003-6	2,170,152.00 元	2020/9/3	36 个月	正在履行
33		补充协议 RH-L-2020003-6/S01	58,871.00 元	2020/10/20	36 个月	正在履行
34	海通恒信 国际融资 租赁股份 有限公司	融资租赁合同 L21A0441003	68,283.60 元	2021/4/26	36 个月	正在履行
35		融资租赁合同 L21A0441004	273,134.40 元	2021/4/26	36 个月	正在履行
(二) 无锡伟测半导体科技有限公司						
1	北亚融资 租赁(上 海)有限 公司	设备融资租赁合同 NAFL2020042-10	1,018,064.88 元	2020/10/23	24 个月	正在履行
2		设备融资租赁合同 NAFL2021046-02	468,512.94 元	2021/2/22	24 个月	正在履行
3	诚泰融资 租赁(上 海)有限 公司	融资租赁合同 CHTDCS4355-C001-L01	620,607.52 元	2020/10/23	36 个月	正在履行
4	平安国际 融资租赁 有限公司	融资租赁合同 2021PAZL0101129-ZL-01	177,204.70 元	2021/6/8	36 个月	正在履行
5		融资租赁合同 2021PAZL0101132-ZL-	441,147.60 元	2021/6/30	36 个月	正在履行

序号	出租人	合同名称及编号	租金 (元或美元/ 月)	签订日期/ 起租日	租赁期限	履行情况
		01				
6		融资租赁合同 2021PAZL0101133-ZL-01	372,458.85 元	2021/6/30	36 个月	正在履行
7	远东国际融资租赁有限公司	融资租赁合同 IFELC21DG1FCBW-L-01	755,028.01 元	2021/6/27	24 个月	正在履行
8	苏州融华租赁有限公司	融资租赁合同 RH-L-2021009-1	302,372.00 元	2021/4/9	36 个月	正在履行

注：苏州融华租赁有限公司的《融资租赁合同 RH-L-2019009-1》、《融资租赁合同 RH-L-2019009-2》为售后回租。

#### （五）其他重大合同

2021 年 7 月 22 日，无锡伟测与无锡星洲开发区工业园股份有限公司签订了《厂房买卖合同》，以 2,666.08 万元的总价格向后者购买了位于无锡新加坡工业园新达路 28-11、28-12 号厂房及土地使用权。

2021 年 10 月 15 日，发行人与南京浦口经济开发区管理委员会签署了《浦口区招商引资重大项目投资协议》，发行人拟在南京浦口建设集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目，项目总投资 9 亿元人民币，其中项目一期开展约 6,000 平方米的工业厂房装修，设备采购的相关投入，计划 2021 年 11 月份启动一期项目建设，待项目一期全面达产后即开展项目二期约 50 亩工业用地建设及设备采购，预计在 2024 年 6 月 30 日前投资建设完成。

#### （六）侵权之债

根据发行人确认并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

#### （七）发行人与关联方的重大债权债务关系及相互提供担保情况

1、根据《审计报告》，并经本所律师查验，截至报告期期末，发行人与关联方之间不存在重大债权债务关系。

2、根据《审计报告》，并经本所律师查验，截至报告期期末，发行人存在关联方为其提供担保的情形[详见本律师工作报告正文之“九、关联交易及同业竞争”部分之“（二）关联交易”]，发行人与关联方之间不存在为关联方提供担保的情形。

#### （八）发行人金额较大的其他应收款和其他应付款

经本所律师查验，截至报告期末，发行人金额较大的其他应收款以及其他应付款主要系发行人正常生产经营而发生的往来款，合法、有效。

## 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

#### （一）发行人成立以来发生的合并、分立、增加注册资本和减少注册资本

根据发行人工商登记档案等资料，并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，除本律师工作报告之“七、发行人的股本及演变”已披露的股本变动情况外，发行人自成立以来，未有合并、分立或者减少注册资本的行为，其历次股本变动均已经履行了必要的法律手续，合法有效。

#### （二）发行人已发生的重大资产变化、收购或出售资产行为

根据发行人的说明并经本所律师查验，报告期内发行人不存在重大资产变化、收购或出售资产行为。

#### （三）拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购行为

根据发行人的确认，并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等行为。

## 十三、发行人章程的制定与修改

根据发行人工商登记档案、历次股东（大）会决议、董事会决议等文件，并经本所律师查验，发行人《公司章程》的制定与修改情况如下：

#### （一）发行人现行有效的《公司章程》的制定情况

2020年7月18日，发行人召开创立大会，审议通过了《关于〈上海伟测半导体科技股份有限公司章程〉的议案》。该章程已经在上海市市场监督管理局备案。

## （二）发行人报告期内的章程修改情况

1、因增加注册资本以及公司董事人数增加，需对公司章程进行修订。2018年5月18日，伟测有限召开股东会并作出修改公司章程的决议，相关章程修订已在上海市浦东新区市场监督管理局备案。

2、因增加注册资本，需对公司章程进行修订。2018年9月30日，伟测有限召开股东会并作出修改公司章程的决议，相关章程修订已在上海市浦东新区市场监督管理局备案。

3、因增加注册资本以及公司董事人数增加，需对公司章程进行修订。2019年1月17日，伟测有限召开股东会并作出修订公司章程的决议，相关章程修订已在上海市浦东新区市场监督管理局备案。

4、因增加注册资本，需对公司章程进行修订。2019年5月17日，伟测有限召开股东会并作出修订公司章程的决议，相关章程修订已在上海市浦东新区市场监督管理局备案。

5、因增加注册资本以及公司董事人数增加，需对公司章程进行修订。2019年7月19日，伟测有限召开股东会并作出修订公司章程的决议，相关章程修订已在上海市浦东新区市场监督管理局备案。

6、因增加注册资本以及经营范围变更，需对公司章程进行修订。2019年11月19日，伟测有限召开股东会并作出修订公司章程的决议，相关章程修订已在上海市浦东新区市场监督管理局备案。

7、因增加注册资本，需对公司章程进行修订。2019年12月15日，伟测有限召开股东会并作出修订公司章程的决议，相关章程修订已在上海市浦东新区市场监督管理局备案。

8、因伟测有限整体变更为股份有限公司，重新制定章程。2020年7月18日，伟测有限全体股东召开上海伟测半导体科技股份有限公司创立大会并作出制定新公司章程的决议，相关章程已在上海市市场监督管理局备案。

9、因增加注册资本以及经营范围变更，需对公司章程进行修订。2020年9月9日，伟测科技召开2020年第二次临时股东大会会议并作出修订公司章程的决议，相关章程修订已在上海市市场监督管理局备案。



10、因增加注册资本以及经营范围变更，需对公司章程进行修订。2020年9月25日，伟测科技召开2020年第三次临时股东大会会议并作出修订公司章程的决议，相关章程修订已在上海市市场监督管理局备案。

11、因增加注册资本，需对公司章程进行修订。2020年11月5日，伟测科技召开2020年第四次临时股东大会会议并作出修订公司章程的决议，相关章程修订已在上海市市场监督管理局备案。

12、因增加注册资本，需对公司章程进行修订。2021年5月28日，伟测科技召开2021年第一次临时股东大会会议并作出修订公司章程的决议，相关章程修订已在上海市市场监督管理局备案。

经本所律师查验，上述《公司章程》的制定与修改均已履行法定程序，内容符合法律法规的有关规定。

### （三）《公司章程（草案）》的制定情况

经本所律师查验，发行人本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》系由其董事会依据《上市公司章程指引（2019年修订）》拟订，并经发行人2021年第二次临时股东大会审议通过。

### （四）关于特别表决权的核查

经本所律师查验，发行人现行的《公司章程》以及发行人本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》中均未设置两个或两个以上种类的股份，且规定同一种类的每一股份应当具有同等权利，持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。发行人不存在特别表决权股份的情形。

综上所述，本所律师认为，发行人历次章程的制定与修改均履行了法定程序，由股东大会审议通过并经公司登记机关备案，章程内容合法有效。发行人现行的《公司章程》及《公司章程（草案）》均符合现行法律法规的规定。

## 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

### （一）发行人具有健全的组织机构

根据发行人说明、发行人《公司章程》及股东大会、董事会、监事会会议文件，并经本所律师查验，发行人根据《公司章程》设置了股东大会、董事会

和监事会等决策、监督机构，并对其职权作出了明确的划分，发行人的组织机构设置如下：

1、股东大会为发行人的最高权力机构。股东大会由全体股东组成，董事会和监事会均对股东大会负责。

2、董事会为发行人常设决策机构，由股东大会选举产生并对股东大会负责。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，独立董事占董事会人数的三分之一以上，并设董事长一名，由董事会全体董事的过半数选举产生。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，对董事会负责。

3、监事会为发行人常设内部监督机构。监事会由三名监事组成，其中职工代表担任的监事一名，占监事会人数的三分之一以上。监事会设监事会主席，由监事会会议选举产生。

4、高级管理人员包括：总经理一名，负责发行人日常经营管理，由董事长提名，董事会聘任；副总经理四名，在总经理领导下负责发行人特定部门日常工作，由总经理提名，董事会聘任；财务负责人一名，负责发行人财务工作，由总经理提名，董事会聘任；董事会秘书一名，负责股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及股东资料管理，办理信息披露事务等事宜，由董事长提名，董事会聘任。

经本所律师查验，发行人按照《公司法》等法律法规的规定，建立了法人治理机构，具有健全的经营管理机构 and 组织机构。

## （二）发行人的股东大会、董事会、监事会等均具有健全的议事规则

经本所律师查验，《公司章程》对发行人股东大会、董事会、监事会的议事规则和表决程序作出了具体规定，且发行人于 2020 年 11 月 27 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在科创板上市，根据《科创板首发管理办法》《科创板股票上市规则》等相关规定，发行人制定了《股东大会议事

规则》（草案）、《董事会议事规则》（草案）和《监事会议事规则》（草案）。2021年10月8日，发行人召开2021年第二次临时股东大会审议通过了前述议事规则，并于发行人首次公开发行股票并上市之日起生效。

经本所律师查验，发行人现行有效的股东大会、董事会及监事会议事规则符合法律法规的有关规定。

### （三）发行人股东大会、董事会、监事会的规范运作

根据发行人提供的历次股东大会、董事会和监事会的会议通知、会议议案、会议记录和会议决议等文件，并经本所律师查验，自发行人整体变更为股份有限公司时起至本律师工作报告出具之日，发行人共召开了8次股东大会会议、9次董事会会议、4次监事会会议。经本所律师查验，发行人历次股东大会、董事会、监事会会议的召开、决议内容及签署合法、有效。

### （四）发行人股东大会或董事会的历次授权或重大决策行为

根据发行人报告期内的股东大会、董事会、监事会会议资料，并经本所律师查验，发行人股东大会对公司董事会的授权或重大决策行为符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。

## 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

### （一）发行人董事、监事及高级管理人员的任职

根据发行人报告期内历次股东大会、董事会、监事会会议文件，并经本所律师查验，发行人现有董事9名（其中独立董事3名）、监事3名（其中职工代表监事1名）、高级管理人员5名。发行人的董事、监事每届任期3年。具体任职职务情况如下：

序号	姓名	任职情况	选举/聘任程序
1	骈文胜	董事长兼总经理	创立大会/第一届董事会第一次会议
2	闻国涛	董事兼副总经理	创立大会/第一届董事会第一次会议
3	路峰	董事兼副总经理	创立大会/第一届董事会第一次会议
4	陈凯	董事	创立大会
5	祁耀亮	董事	创立大会
6	于波	董事	创立大会

序号	姓名	任职情况	选举/聘任程序
7	徐伟	独立董事	创立大会
8	林秀强	独立董事	创立大会
9	王怀芳	独立董事	创立大会
10	乔从缓	职工代表监事、监事会主席	职工代表大会/第一届监事会第一次会议
11	高晓	股东代表监事	创立大会
12	周歆瑶	股东代表监事	创立大会
13	刘琨	副总经理	第一届董事会第一次会议
14	王沛	副总经理、财务总监、董事会秘书	第一届董事会第一次会议

发行人现任董事、监事及高级管理人员简历如下：

1、骈文胜，董事长、总经理。男，中国国籍，无境外永久居留权。1970年5月出生，1993年毕业于电子科技大学电子精密机械专业，本科学历，1993-2000年任摩托罗拉系统（中国）有限公司设备经理，2000-2004年任职于威宇科技测试封装（上海）有限公司，2004-2009年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任测试厂长、封装厂长、资材处长，2009-2016年任职于江苏长电科技股份有限公司，任事业中心总经理、集团海外销售副总裁，2016年5月至今担任公司董事长、总经理。

2、闻国涛，董事、副总经理。男，中国国籍，无境外永久居留权。1978年3月出生，2001年毕业于电子科技大学机械设计及其自动化专业，本科学历，2001-2004年任威宇科技测试封装（上海）有限公司设备工程师，2004-2016年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任测试设备主管、经理、封装厂长、测试厂长，2016年5月至今担任公司董事、副总经理。

3、路峰，董事、副总经理。男，中国国籍，无境外永久居留权。1971年2月出生，1993年毕业于天津大学电子工程系，本科学历，1993-2000年任摩托罗拉中国电子有限公司IT自动化经理，2000-2004年任威宇科技测试封装（上海）有限公司IT部门经理；2004-2006年任日月光封装测试（上海）有限公司IT部门经理；2006-2018年任职于晟碟半导体（上海）有限公司，历任IT部门经理、总监。2018年5月至今担任公司董事、副总经理。

4、陈凯，董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1983年11月出生，

2009年毕业于清华大学电子科学与技术专业，硕士学历。2009-2010年任职于电信科学技术研究院有限公司，担任工程师；2010-2015年任职于AMD中国研发中心，担任高级工程师；2015-2017年任职于中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司，担任高级投资经理；2017年至今任职于深圳同创伟业资产管理股份有限公司，担任董事总经理。2019年10月至今，任深圳市锐骏半导体股份有限公司董事；2020年3月至今，任普冉半导体（上海）股份有限公司董事；2020年6月至今，任中微半导体（深圳）股份有限公司董事。2019年1月至今，担任公司董事。

5、祁耀亮，董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年8月出生，2005年毕业于新南威尔士大学电子学专业，硕士学历。2018年获得清华大学工商管理（MBA）硕士学位。2005年12月至2015年12月，任职于中芯国际集成电路制造有限公司，最高职务为大中华区资深经理；2016年1月至2018年1月，任北京清芯华创投资管理有限公司投资总监；2016年10月至2020年4月，任中芯集成电路（宁波）有限公司监事；2018年1月至2020年11月，任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司董事总经理；2019年1月至今，任同源微（北京）半导体技术有限公司董事；2018年12月至今，任苏州汉朗光电有限公司董事；2018年12月至今，任重庆晶朗光电有限公司董事；2019年2月至今，任昆腾微电子股份有限公司监事；2019年8月至今，任苏州长瑞光电有限公司董事；2019年9月至今，任甬矽电子（宁波）股份有限公司监事；2020年3月至今，任成都启英泰伦科技有限公司董事；2020年11月至今，任强一半导体（苏州）有限公司董事；2020年11月至今，任元禾璞华同芯（苏州）投资管理有限公司董事总经理；2020年11月至今，任新恒汇电子股份有限公司监事；2021年6月至今，任京微齐力（北京）科技有限公司董事；2021年6月至今，任苏州镭明激光科技有限公司监事；2021年7月至今，任上海季丰电子股份有限公司董事；2021年7月至今，任美芯晟科技（北京）有限公司董事；2021年8月至今，任荣芯半导体（淮安）有限公司监事；2021年9月至今，任宁波荣芯一厂半导体有限公司监事；2021年10月至今，任昇显微电子（苏州）有限公司董事；2021年11月至今，任西安吉利电子新材料股份有限公司董事。2019年1月至今，任公司董事。

6、于波，董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年7月出生，2005年毕业于北京大学信号与信息处理专业，工学博士学位。1995-1998年任西安建筑科技大学教师、系团委书记；2005-2006年任无锡新区管委会主任助理（挂职）；2006-2017年任无锡市新区科技金融投资集团有限公司董事长、总经理、党总支书记；2017年至今任江苏民营投资控股有限公司投资业务董事总经理。2020年7月至今，任公司董事。

7、徐伟，独立董事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1957年9月出生，1982年毕业于西安交大电子工程系，本科学历。现任广东芯粤能半导体有限公司总经理，广东省集成电路行业协会副会长，曾任上海市集成电路行业协会秘书长；中国半导体行业协会副理事长；中国电子学会理事（高级会员）；上海市电子学会副理事长；教授级高级工程师。徐伟先生曾任上海华虹宏力半导体制造有限公司党委书记、执行副总裁。2020年7月至今，任公司独立董事。

8、林秀强，独立董事。男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1975年12月出生，1999-2004年任山东胜利股份有限公司区域经理；2005-2006年任中化上海有限公司事业部总经理助理；2006-2008年任上海联纵智达管理咨询公司咨询总监；2008-2016年任北大纵横管理咨询集团咨询中心总经理，现任北大纵横咨询集团转型发展研究院院长、资深合伙人、中睦控股有限公司总经理；2021年至今，任上海焯钻企业管理咨询有限公司总经理；2020年7月至今，任公司独立董事。

9、王怀芳，独立董事。男，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学博士，CPA。1973年出生，1998-2000年任申银万国证券研究所研究员；2000-2001年任天同证券研究所基础部经理；2001-2004年任上海融昌资产管理有限公司研究所所长；2004-2006年任上海六禾投资管理公司董事副总经理；2006年至今，任职于上海国家会计学院，任教研部副教授；2015年6月至2021年8月，任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司独立董事。2016年1月至今，任上海璞泰来新能源科技股份有限公司独立董事；2016年7月至2021年1月，任莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任上海傲世控制科技股份有限公司独立董事；2021年11月至今，担任上海物资贸易股

份有限公司独立董事。2020年7月至今，任公司独立董事。

10、乔从缓，职工代表监事、监事会主席。女，中国国籍，无境外永久居留权。1981年12月出生，2007年毕业于河北工业大学材料科学与工程专业，硕士学历。2007-2015年任职日月光半导体（上海）有限公司质量工程师、质量经理；2015-2017年任职赫思曼汽车通讯设备（上海）有限公司技术供应商管理经理；2018年至今担任公司研发中心总监。2020年7月至今，任公司职工代表监事、监事会主席。

11、高晓，监事。男，中国国籍，无境外永久居留权。1985年10月出生，2007年本科毕业于南京航空航天大学信息工程专业；2009年硕士毕业于英国爱丁堡大学信息处理和通讯专业；上海交通大学 MBA。2007-2008年任江阴市高新区招商局科员；2011-2012年任江阴经济开发区副科长；2012-2018年任江阴市委办科长；2018-2019年任上海金浦新朋投资管理有限公司投资经理；2019年至今任金浦新潮投资管理（上海）有限公司投资经理。2020年7月至今，任公司监事。

12、周歆瑶，监事。女，中国国籍，无境外永久居留权。1993年2月出生，2018年毕业于渤海大学马克思主义学院，硕士学历。2018年12月起任公司人力资源部专员，2020年3月至今任职于公司采购部。2020年7月至今，任公司监事。

13、刘琨，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年10月出生，1996年毕业于电子科技大学检测技术及仪器专业，本科学历。1997-2001年任摩托罗拉中国电子有限公司产品工程师；2001-2004年任职威宇科技测试封装（上海）有限公司，历任高级产品工程师、产品工程主管；2004-2005年任英特尔（上海）有限公司工程主管；2005-2009年任泰瑞达（上海）有限公司应用工程经理，负责中国北方区域；2009-2015年任北京汉迪龙科科技有限公司副总经理，2015-2020年任上海旻艾半导体有限公司总经理；2020年2月至今，担任公司副总经理。

14、王沛，女，中国国籍，无境外永久居留权。1980年11月出生，2002年本科毕业于东北财经大学金融学专业，2007年硕士毕业于上海理工大学财政学专业。2007-2011年任上海领灿投资咨询有限公司融资业务部总监；2011-

2020年任环旭电子股份有限公司证券事务代表。2020年7月至今，任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

根据发行人董事、监事、高级管理人员的任免会议文件及所填写的调查表等资料，并经本所律师查验，上述董事、监事、高级管理人员的任职均经法定程序产生，符合规范的公司治理结构要求，发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

## （二）发行人核心技术人员情况

根据发行人提供的资料，截至本律师工作报告出具之日，发行人核心技术人员情况如下：

序号	姓名	职位
1	骈文胜	总经理
2	闻国涛	副总经理
3	路峰	副总经理
4	刘琨	副总经理

根据发行人核心技术人员填写的调查表，截至报告期末，前述核心技术人员未在发行人以外的其他经营同类业务的公司兼职。

## （三）发行人最近两年内董事、监事及高级管理人员的变化

根据发行人历次股东大会、董事会、监事会会议文件及工商登记档案，并经本所律师查验，发行人最近两年内的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的任职及变动情况如下：

### 1、董事的变化

根据发行人的工商档案、股东大会、董事会、监事会会议资料并经本所律师查验，最近两年内，发行人董事的变化情况如下：

序号	日期	董事会成员	变动情况
1	2019-01-01	骈文胜、闻国涛、路峰、闻威、俞克	/
2	2019-01-17	骈文胜、闻国涛、路峰、祁耀亮、陈凯、沈爽恒、俞克	闻威辞去董事职务，新增董事祁耀亮、陈凯、沈爽恒
3	2019-07-19	骈文胜、闻国涛、路峰、祁耀亮、陈凯、沈爽恒、俞克、高晓	新增董事高晓



4	2020-07-18	骈文胜、闻国涛、路峰、陈凯、祁耀亮、俞克、徐伟、林秀强、王怀芳	股份公司设立选举第一届董事会
5	2020-09-09	骈文胜、闻国涛、路峰、陈凯、祁耀亮、于波、徐伟、林秀强、王怀芳	俞克辞去董事职务，新增董事于波

## 2、监事的变化

根据发行人的工商档案等资料，并经本所律师查验，最近两年内，发行人监事的变化情况如下：

序号	日期	监事/监事会成员	变动情况
1	2019-01-01	张莉	/
2	2019-07-19	龚金新	张莉辞去监事职务，选举龚金新为监事
3	2019-12-15	刘琨	免去龚金新监事职务，选举刘琨为监事
4	2020-07-18	乔从缓、高晓、周歆瑶	股份公司设立选举第一届监事会

## 3、高级管理人员变化情况

根据发行人的工商档案、董事会会议资料并经本所律师查验，最近两年内，伟测科技高级管理人员的变化情况如下：

序号	日期	高级管理人员	变动情况
1	2019-01-01	骈文胜	/
2	2020-07-18	骈文胜、闻国涛、路峰、刘琨、张锐、王沛	股份公司设立聘用高级管理人员
3	2020-09-15	骈文胜、闻国涛、路峰、刘琨、王沛	张锐因个人原因辞去副总经理职务

## 4、核心技术人员的变化

根据发行人提供的相关资料，并经本所律师查验，除刘琨系新加入公司并担任核心技术人员外，伟测科技核心技术人员近两年未发生变化。

经本所律师查验，发行人董事、监事、高级管理人员近两年所发生的变化符合法律法规及《公司章程》的规定，并且履行了必要的法律程序；上述董事、监事的变动，主要为完善公司内部治理及业务发展的需要、建立健全符合上市公司要求的法人治理结构进行的必要调整，系根据公司经营管理与公司治

理实际需要而发生，上述变动使得公司治理结构得到进一步规范和优化。最近两年，发行人部分董事、监事、高级管理人员的变动对公司日常管理不构成重大影响，也不影响公司的持续经营。据此，本所律师认为，公司最近两年内董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未发生重大不利变化，未影响发行人的持续经营、发展战略及业务目标的延续性。

#### （四）发行人的独立董事

经本所律师查验，发行人创立大会选举徐伟、林秀强、王怀芳为发行人第一届董事会独立董事，其中王怀芳符合中国证监会要求的会计专业人士；独立董事人数占董事会总人数三分之一以上；发行人现任独立董事都具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司制订的《独立董事工作制度》所要求的独立性，且具备五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

发行人制订了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职资格、选举与罢免程序、职权范围等内容进行了规定，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

据此，本所律师认为，发行人独立董事的设立、任职资格及职权范围均符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在违反法律法规和《公司章程》规定的情形。

## 十六、发行人的税务

### （一）发行人执行的税种、税率

根据《审计报告》与发行人及其子公司的主要纳税申报表，并经本所律师查验，发行人及其子公司报告期内执行的主要税种和税率为：

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、7%

税种	计税依据	税率
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、25%

根据发行人说明，经本所律师查验，发行人及其子公司报告期内执行的主要税种、税率符合法律法规的规定。

## （二）发行人享受的税收优惠

根据发行人及其子公司的税收优惠文件等资料，并经本所律师查验，发行人及其子公司在报告期内享受的税收优惠政策如下：

1、公司于 2018 年 11 月 27 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局核发的高新技术企业证书（证书编号 GR201831002935），有效期限为三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度适用的企业所得税税率为 15%。公司实际 2018 年免税，2019 年及 2020 年所得税税率为 12.5%。2021 年度公司高新技术企业复审已通过认定，截至本律师工作报告出具之日，正处于公示期，故 2021 年 1-6 月公司可适用企业所得税税率为 15%，公司实际 2021 年 1-6 月所得税税率为 12.5%。

2、根据财政部、国家税务总局、发展改革委员会、工业和信息化部《关于进一步鼓励集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2015〕6 号）和《上海市集成电路封装、测试企业以及集成电路关键专用材料生产企业、集成电路专用设备生产企业享受税收优惠的证明出具办法》（沪发改〔2018〕10 号），本公司自 2017 年起享受企业所得税两免三减半优惠，故发行人 2018 年免税，2019 年至 2021 年 6 月企业所得税税率为 12.5%。

3、根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财税〔2019〕39 号），自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。报告期内，公司实际未享受该税收优惠政策。

4、根据国家税务总局《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》（国家税

务总局公告〔2012〕第 24 号）第九条第（四）项第 2 目第（1）点规定，本公司来料加工业务免缴增值税。

根据发行人的说明，并经本所律师查验，发行人及其境内子公司在报告期内享受的税收优惠符合法律、法规的规定。

### （三）发行人享受的财政补贴

根据《审计报告》及发行人提供的财政补贴资料，并经本所律师查验，报告期内发行人及其子公司享受的主要财政补贴情况如下：

单位:元

年份	序号	金额	项目名称	补贴依据
2021 年 1-6 月	1	95,000.00	创新业务补贴	《上海市经济信息化委 市财政局关于开展 2020 年融资担保创新业务支持项目申报工作的通知》
	2	12,000.00	岗前培训补贴	《关于进一步落实受疫情影响企业职工线上职业培训补贴政策有关事项的通知》
	3	10,900.00	稳岗补贴	《关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划大力开展以工代训工作的通知》(锡人社发〔2020〕59 号)和《关于进一步支持企业开展以工代训的补充通知》(锡人社发〔2020〕75 号)
	4	3,000.00	就业补贴	
2020 年 度	1	255,000.00	基于集成电路测试大数据的自动测试平台(信息化生产)	《浦东新区智慧城市建设专项资金管理办法》
	2	900,000.00	2020 年第三批中小企业发展专项	《上海市中小企业发展专项资金管理办法》(沪经信规范〔2019〕9 号)
	3	800,000.00	科技发展基金	《浦东新区科技发展基金重点企业研发机构补贴资金操作细则》
	4	817,991.62	进口设备贴息	财政部 商务部关于印发《外经贸发展专项资金管理办法》的通知(财企〔2014〕36 号)及《上海市商务委关于 2020 年进口贴息资金申报的通知》
	5	400,000.00	支持高成长科创小微	《关于开展 2020 年度浦东新区促

年份	序号	金额	项目名称	补贴依据
			企业	进小微企业创新创业财政扶持项目申报工作的通知》
	6	247,781.11	科技券	《关于开展 2020 年度浦东新区科技发展基金科技创新券专项资金申报工作的通知》
	7	60,530.00	稳岗补贴	《关于做好本市稳就业工作有关事项的通知》沪人社规〔2019〕34 号
	8	52,371.00	履约保险保费补贴	《关于开展 2020 年度浦东新区科技发展基金科技型小微企业贷款贴息专项资金申报工作的通知》
	9	15,300.00	岗前培训	中共无锡市委、无锡市人民政府印发《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关保障经济平稳运行的政策意见》的通知
	10	1,800.00	培训补贴	
2019 年度	1	5,200,000.00	超大规模集成电路芯片集成测试平台技术改造	上海市经济信息化委、市财政局关于印发《上海市技术改造专项支持实施细则》的通知（沪经信规范〔2018〕1 号）
	2	1,000,000.00	支持小微企业创新能力补贴款	《浦东新区促进小微企业创新创业财政扶持办法实施细则》
	3	652,100.00	科技型中小企业技术创新基金	《关于开展 2019 年度浦东新区促进小微企业创新创业财政扶持项目申报工作的通知》
	4	300,000.00	第七届创新创业大赛三等奖	获得第七届中国创新创业大赛成长组优秀企业奖
	5	211,692.45	进口设备贴息	财政部 商务部关于印发《外经贸发展专项资金管理办法》的通知(财企〔2014〕36 号)及《上海市商务委关于 2019 年中央进口贴息资金申报的通知》
	6	35,597.00	稳岗补贴	《关于做好本市稳就业工作有关事项的通知》（沪人社规〔2019〕34 号）
2018 年度	1	595,000.00	基于集成电路测试大数据的自动测试平台（信息化生产）	《浦东新区智慧城市建设专项资金管理办法》
	2	600,000.00	重点科技创业企业专项资助	上海市浦东新区科学技术委员会关于印发《浦东新区科技发展基金重点科技创业企业专项资金操作细

年份	序号	金额	项目名称	补贴依据
				则》的通知（沪浦科（2016）61号）
	3	115,268.09	进口设备贴息	《财政部 商务部关于〈外经贸发展专项资金管理办法〉的通知》（财企（2014）36号）及《2018年中央进口贴息资金申报通知》
	4	94,200.00	科技型中小企业技术创新基金	浦东新区人民政府关于印发《浦东新区科技发展基金管理办法》的通知（浦府（2016）128号）
	5	44,500.00	科技创新券	关于印发《上海市科技创新券管理办法（试行）》的通知（沪科规（2018）8号）

经发行人确认，并经本所律师查验，发行人享受的上述财政补助具有相应的政策依据，合法、有效。

#### （四）发行人的税务合规情况

经本所律师查验：

1、发行人所在地主管税务机关国家税务总局上海市浦东新区税务局于2021年3月1日和2021年7月6日分别出具证明，确认：伟测科技2018年1月至2021年7月3日能按时申报纳税，无欠税情况，未发现有重大违反税收法律法规的行为而受行政处罚的记录。

2、发行人子公司无锡伟测所在地主管税务机关国家税务总局无锡国家高新技术产业开发区（无锡市高新区）税务局于2021年3月11日和2021年7月16日分别出具证明，确认：无锡伟测2020年6月1日至2021年6月30日能按时申报纳税，无欠税情况，未发现有重大违反税收法律法规的行为而受行政处罚的记录。

3、发行人子公司上海威矽所在地主管税务机关国家税务总局上海市浦东新区税务局于2021年3月11日和2021年7月6日分别出具证明，确认：上海威矽2016年11月1日至2021年7月3日无违反现行税收法律法规受到行政处罚的纪录。

据此，本所律师认为，报告期内，发行人及其境内子公司不存在因重大税务违法行为被处以行政处罚的情形。

## 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

### （一）发行人及其子公司的环境保护

#### 1、环保合法合规情况

根据发行人的说明以及发行人提供的相关环保备案文件并经本所律师查询上海市生态环境局公开的行政处罚信息，报告期内发行人及其子公司未发生过环境污染事故，不存在因违反有关环境保护相关法律法规而受到行政处罚的情形。

#### 2、发行人募集资金投资项目的环境保护情况

关于发行人本次募集资金投资项目已经履行的有关环境保护方面的手续[详见本律师工作报告正文之“十八、发行人募集资金的运用”]。

综上，本所律师认为，发行人的生产经营活动符合国家和地方环保法规的要求，报告期内不存在因违反环境保护方面法律法规而受到重大处罚的情形，发行人募投项目符合国家有关环境保护的要求。

### （二）发行人的质量、技术标准

根据发行人及子公司所在地市场监督管理部门出具的证明及本所律师检索国家企业信用信息公示系统，并经本所律师查验，发行人及子公司报告期内不存在因违反质量技术监督方面法律、法规而被行政处罚的情形。

### （三）发行人的安全生产

根据发行人的说明、相关政府主管部门的证明文件并经本所律师查验“上海浦东门户网站（[www.pudong.gov.cn](http://www.pudong.gov.cn)）和浦东新区安全监管局网站（[www.pudong.gov.cn/ajj](http://www.pudong.gov.cn/ajj)）公开的生产安全事故和安全生产违法行为的行政处罚信息”，报告期内，发行人及子公司能够按国家有关法律法规进行安全生产，不存在因重大违法违规而被主管应急管理部门给予行政处罚的情形。

### （四）发行人社会保险和住房公积金缴纳情况

根据发行人的确认和发行人及其子公司提供的员工花名册和社保及公积金缴纳明细，截止至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其子公司存在未严格按照国家相关法律法规足额缴纳社保、公积金的情形。

鉴于：1、部分未缴纳系退休返聘人员、中国台湾籍人员、新入职/月底入职员工错过申报点，后续月份进行补缴、劳动合同签署于当月缴纳申报窗口关闭之后、试用期末缴纳或补缴前离职等原因。

2、根据上海市社会保险事业管理中心于 2021 年 7 月 27 日出具的《单位参加城镇社会保险基本情况》，确认发行人截至 2021 年 6 月缴费状态为正常缴费，无欠款；根据上海市公积金管理中心于 2021 年 7 月 15 日出具的《上海市单位住房公积金缴存情况证明》，确认发行人于 2016 年 6 月建立住房公积金账户，截止至 2021 年 6 月该单位住房公积金账户处于正常缴存状态，未有该中心的行政处罚记录。

根据无锡市新吴区人力资源和社会保障局于 2021 年 4 月 12 日 2021 年 8 月 23 日出具的《企业劳动保障守法情况的证明》，确认无锡伟测截止至 2021 年 8 月 6 日为止没有受到过劳动行政部门的行政处罚；根据无锡市住房公积金管理中心于 2021 年 7 月 29 日出具的证明，确认无锡伟测截止至说明开具日没有因违法公积金法规受到过行政处罚。

据此，发行人及其子公司不存在因违反国家社会保险和住房公积金相关法律法规而受到相关政府主管部门行政处罚的情形。

3、发行人的控股股东已作出如下承诺：

如发行人及子公司因首次公开发行股票并上市前未能遵守劳动与社会保障、住房公积金等有关法律法规而被有权政府部门要求缴纳罚款、补缴相关款项、滞纳金以及被要求承担其他经济赔偿责任的，本公司将在公司及子公司收到有权政府部门的生效决定后，及时、足额地将等额与公司及子公司被要求缴纳、补缴的罚款、款项、滞纳金以及其他赔偿款支付给有关政府部门或公司及子公司，以避免公司及子公司遭受经济损失。



因此，本所律师认为，报告期内发行人及其子公司存在未严格按照国家相关法律法规足额缴纳社保、公积金的情形不属于重大违法行为，不会对于发行人持续经营、本次发行及上市构成重大不利影响。

#### （五）发行人外汇合规情况

经本所律师核查国家外汇管理局政府网站（www.safe.gov.cn）公开的外汇行政处罚信息，报告期内，发行人及其子公司未有因违反法律、法规、规章及规范性文件而受到外汇管理方面行政处罚的记录。

#### （六）发行人海关合规情况

根据中华人民共和国上海海关以及中华人民共和国无锡海关出具的相关证明文件，在报告期内，发行人及其子公司未发生因违反法律法规受到海关行政处罚的记录。

综上，本所律师认为，发行人及境内子公司在报告期内不存在因违反环境保护、产品质量监管方面的法律法规的规定受到相关主管部门重大行政处罚的情形。

### 十八、发行人募集资金的运用

#### （一）本次募集资金投资项目及批准或授权

根据发行人 2021 年第二次临时股东大会决议及相关议案及募集资金投资项目可研报告，并经本所律师查验，经发行人 2021 年第二次临时股东大会批准，发行人本次股票发行所募集资金在扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目	无锡伟测	48,828.82	48,828.82
2	集成电路测试研发中心建设项目	伟测科技	7,366.92	7,366.92
3	补充流动资金	-	5,000.00	5,000.00

合计	-	61,195.74	61,195.74
----	---	-----------	-----------

根据发行人于 2021 年 10 月 8 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》，发行人本次募集资金运用已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略，具有良好的经济效益和社会效益，与发行人的现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相匹配。

如果募集资金超过上述投资项目的总额，发行人将按照有关规定履行必要的程序后把超募资金用于发行人主营业务。如果本次发行募集资金不足，发行人将通过自筹资金解决资金缺口。

## （二）本次募集资金投资项目涉及的合作

经本所律师查验，本次募集资金投资项目主体均为发行人及其全资子公司，不涉及与他人合作。

## （三）本次募集资金投资项目涉及的环境保护

“无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目”和“集成电路测试研发中心建设项目”均已取得所在地投资主管部门的备案。由于三个募集资金项目均不涉及具体产品的生产和制造，基本不对外排放污染物，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年）（以下简称“《分类管理名录》”）、《上海市不纳入建设项目环评管理的项目类型（2019 年版）》等相关规定，发行人无需取得环评批复或者环评备案。

序号	项目名称	项目备案号/代码	环评批复号
1	无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目	2108-320214-89-01-316458	不适用
2	集成电路测试研发中心建设项目	2108-310115-04-02-771789	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行上市的募投项目现阶段已经取得相关部门的同意并已履行相关手续，募投项目无需取得环评批复或环评备案募投项目的实施不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。

## 十九、发行人的业务发展目标

（一）根据发行人确认及本所律师查验，发行人在其为本次发行上市编制的《招股说明书（申报稿）》中所述的业务发展目标与主营业务一致。

（二）根据发行人确认及本所律师查验，发行人在其为本次发行上市编制的《招股说明书（申报稿）》中所述的业务发展目标符合国家法律法规的规定，不存在潜在的法律风险。

## 二十、诉讼、仲裁及行政处罚

### （一）发行人的重大诉讼、仲裁及行政处罚

根据发行人说明及本所律师对发行人实际控制人的访谈并经本所律师通过中国“裁判文书网”、“全国法院被执行人信息查询系统”、“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”等公示系统进行的查询，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项。

### （二）发行人持股 5%以上股份的股东、控股股东的重大诉讼、仲裁及行政处罚

根据发行人持股 5%以上股份的股东、控股股东出具的调查问卷，并经本所律师通过中国“裁判文书网”、“全国法院被执行人信息查询系统”、“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”等公示系统进行的查询，截至本律师工作报告出具之日，发行人持股 5%以上股份的股东、控股股东不涉及其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。

### （三）发行人董事、高级管理人员的重大诉讼、仲裁及行政处罚

根据发行人董事、高级管理人员填写的调查问卷、公安机关出具的无违法犯罪证明等相关材料，并经本所律师通过中国“裁判文书网”、“全国法院被执行人信息查询系统”、“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”等公示系统进行的查询，截至本律师工作报告出具之日，发行人现任董事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项，不存在

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情况。

## 二十一、发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师参与了《招股说明书（申报稿）》的编制及讨论，已审阅《招股说明书（申报稿）》，特别对发行人引用法律意见书和律师工作报告相关内容已认真审阅，《招股说明书（申报稿）》引用法律意见书和律师工作报告的相关内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。

## 二十二、发行人律师认为需要说明的其他问题

### （一）伟测有限设立之初的代持及代持还原情况

#### 1、伟测有限的历史沿革

伟测有限的历史沿革[详见本律师工作报告正文之“七、发行人的股本及演变”]。

#### 2、伟测有限历史沿革中的代持情况

##### （1）伟测有限设立时的实益股东及其持股情况

根据本所律师访谈伟测有限设立时的显名股东以及设立时背后的隐名股东，并获得其出具的确认函。2016年伟测有限设立时系李峰代蕊测半导体持有全部权益。伟测有限共有骈文胜、闻国涛、路峰、邵颖、沈爽恒、李峰6名创始人，在启动创业的初期各方达成如下安排：设立伟测有限作为具体业务的经营实体，以蕊测半导体作为几名创始人的持股平台，蕊测半导体直接控股伟测有限。

因骈文胜、闻国涛等人的主要精力在公司创业的业务开拓和筹划，故将设立公司等工商登记事宜全权委托给李峰，以其个人名义来处理相关事宜更为简便。因此创始人一致同意：由李峰先行完成设立公司等前期筹备，同时为了方便李峰开展工作，公司由李峰来设立并担任法定代表人，待前期筹备工作完成之后，再通过股权转让的方式将公司的股权架构调整成真实状态。在代持期

间，李峰未对伟测有限实缴出资。

经本所律师核查，伟测有限设立时的实际股权情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	蕊测半导体	2,000.00	100	货币
	合计	<b>2,000.00</b>	<b>100</b>	--

### 3、伟测有限代持还原情况

2016年11月25日，李峰与蕊测半导体签署《股权转让协议》，以0万元的价格将伟测有限100%的股权转让给蕊测半导体，此次转让实为代持股权的还原[详见本律师工作报告正文之“七、发行人的股本及演变”之“（二）伟测有限的股权变动”之1、2016年11月，伟测有限第一次股权转让]。

经上述股权转让，发行人解除了直接股东层面的代持，并作出工商变更，相关过程真实、合规。根据伟测科技的银行流水和验资报告，李峰自始至终未对伟测科技实缴出资，代持解除后的股权结构亦反映了实际出资情况。根据伟测科技各股东就此代持情况出具的《确认函》，各股东对上述代持形成和解除过程进行了确认，并认可代持解除后的股权结构，各方不存在纠纷或潜在纠纷。

伟测有限的代持情况仅存在设立之时且已还原。除此之外，发行人不存在通过他人代为持有或替他人代为持有股权的情形。根据全体股东确认，发行人股权清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。

## （二）发行人的员工持股计划

### 1、员工持股计划的基本情况

#### （1）发行人员工持股计划的决策程序

根据发行人的工商档案，2019年7月5日，公司股东会作出决定，所有股东一致同意关于第一期股权激励计划的方案。方案约定，此次股权激励计划的实施主体为上海芯伟半导体合伙企业（有限合伙），由全体激励对象以货币出资2,000万元人民币认购芯伟半导体100%的份额。

2019年7月16日，上海市崇明区市场监督管理局准予了芯伟半导体的设立登记申请，对合伙协议进行备案，并核发《营业执照》。

(2) 发行人员工持股计划的具体人员构成

根据发行人员工持股计划芯伟半导体的合伙协议，截至本律师工作报告出具之日，芯伟半导体合伙人的基本情况如下：

序号	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例(%)	持股数量	入职时间	任职部门或职务
1	龚金新	110	5.24	120,872	2016/5/17	人力资源部
2	骈文胜	650	30.95	714,240	2016/5/1	董事长、总经理
3	路峰	300	14.29	329,650	2018/5/2	董事、副总经理
4	闻国涛	250	11.90	274,709	2016/4/8	董事、副总经理
5	王沛	150	7.14	104,942	2020/6/18	副总经理、董事会秘书、财务总监
6	吉晋阳	90	4.29	98,895	2016/5/17	研发中心
7	傅郁晓	50	2.38	54,942	2016/5/23	销售客服部
8	关姜维	50	2.38	54,942	2016/6/12	研发中心
9	刘琨	50	2.38	54,942	2020/2/17	副总经理
10	周俊	40	1.90	43,953	2017/7/6	制造部
11	乔从缓	40	1.90	43,953	2018/1/29	研发中心
12	徐芳	35	1.67	38,459	2016/7/25	财务部
13	刘叶	30	1.43	32,965	2019/9/2	制造部
14	周歆瑶	30	1.43	32,965	2018/12/10	采购部
15	张伟军	24	1.14	26,372	2016/6/11	研发中心
16	高大会	20	0.95	21,977	2016/11/21	制造部
17	左上勇	20	0.95	21,977	2019/6/19	研发中心
18	孙玉男	20	0.95	21,977	2016/5/18	销售客服部
19	崔勇彬	20	0.95	21,977	2016/6/20	制造部
20	史小奇	20	0.95	21,977	2017/11/1	研发中心
21	马谦	15	0.71	16,483	2017/10/10	制造部
22	刘栋栋	15	0.71	16,483	2018/8/1	研发中心
23	袁常乐	15	0.71	16,483	2019/3/12	研发中心
24	俞磊	10	0.48	10,988	2016/9/14	制造部
25	杨恭乾	10	0.48	10,988	2018/2/22	研发中心

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）	持股数量	入职时间	任职部门或职务
26	宣欢	10	0.48	10,988	2018/9/18	研发中心
27	张志颖	10	0.48	10,988	2016/11/25	销售客服部
28	马凯	5	0.24	5,494	2017/5/24	研发中心
29	李晓奎	5	0.24	5,494	2016/10/8	研发中心
30	镇淑平	2	0.10	2,198	2018/5/21	研发中心
31	李亚武	2	0.10	2,198	2018/9/30	制造部
32	姬悄悄	2	0.10	2,198	2019/5/27	研发中心
合计		2,100	100	2,247,669	-	-

## 2、员工持股计划的承诺

### （1）锁定期承诺

根据芯伟半导体出具的《关于股份锁定的承诺》，具体如下：

“1、自发行人发行的股票上市交易之日起 12 个月内，本企业不转让或委托任何第三人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。因发行人进行权益分派等导致本企业直接持有发行人股份发行变化的，仍遵守上述约定；

2、如法律、行政法规、部门规章或中国证监会、上海证券交易所规定的股份锁定期长于本承诺，则本企业直接和间接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按照该等规定执行。”

经本所律师核查，发行人员工持股平台不适用“闭环原则”，其上层合伙人穿透并合并计算发行人本次公开发行前的股东人数，未超 200 人的限制。

## 3、员工持股计划的规范运行情况及备案情况

根据芯伟半导体出具的声明，并经本所律师访谈芯伟半导体执行事务合伙人，芯伟半导体不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，也不存在由基金管理人进行管理、基金托管人进行托管的情形。因此，芯伟半导体无需按照《私募基金管理暂行办法》《私募基金登记备案办法》等相关法律法规规定履行登记备案程序。

经本所律师通过“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”等公示系

统进行的查询，并访谈芯伟半导体执行事务合伙人，截至本律师工作报告出具之日，芯伟半导体运行合法合规，不存在受到行政处罚的情形。

#### 4、员工持股计划历史沿革中的代持情况

##### (1) 芯伟半导体的设立

2019年7月16日，芯伟半导体取得了由上海市市场监督管理局颁发的“沪市监注名预核字第01201907102500号”《企业名称核准通知书》。

2019年7月16日，上海市崇明区市场监督管理局准予了芯伟半导体的设立登记申请，对合伙协议进行备案，并核发《营业执照》。

芯伟半导体设立时的财产份额结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	财产份额比例（%）	出资方式
1	徐芳	600.00	30.00	货币
2	杨恭乾	600.00	30.00	货币
3	龚金新	800.00	40.00	货币
	<b>合计</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100</b>	<b>--</b>

根据芯伟半导体出具的说明，并经本所律师核查，芯伟半导体设立时为徐芳、龚金新、杨恭乾三人代其余发行人员工持有芯伟半导体的财产份额。

芯伟半导体设立时的实际财产份额持有人的情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额（万元）	财产份额比例（%）	合伙人类型
1	骈文胜	700	35.00	有限合伙人
2	路峰	300	15.00	有限合伙人
3	闻国涛	300	15.00	有限合伙人
4	徐芳	35	1.75	有限合伙人
5	傅郁晓	50	2.50	有限合伙人
6	周俊	40	2.00	有限合伙人
7	龚金新	110	5.50	有限合伙人
8	乔从缓	40	2.00	有限合伙人
9	杨恭乾	10	0.50	有限合伙人
10	高大会	50	2.50	有限合伙人



序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	财产份额比 例 (%)	合伙人类型
11	吉晋阳	90	4.50	有限合伙人
12	左上勇	20	1.00	有限合伙人
13	孙玉男	20	1.00	有限合伙人
14	俞磊	10	0.50	有限合伙人
15	关姜维	50	2.50	有限合伙人
16	崔勇彬	20	1.00	有限合伙人
17	史小奇	20	1.00	有限合伙人
18	张伟军	24	1.20	有限合伙人
19	马谦	15	0.75	有限合伙人
20	周歆瑶	30	1.50	有限合伙人
21	刘栋栋	15	0.75	有限合伙人
22	马凯	5	0.25	有限合伙人
23	袁常乐	15	0.75	有限合伙人
24	宜欢	10	0.50	有限合伙人
25	李晓奎	5	0.25	有限合伙人
26	张志颖	10	0.50	有限合伙人
27	镇淑平	2	0.10	有限合伙人
28	李亚武	2	0.10	有限合伙人
29	姬悄悄	2	0.10	有限合伙人
合计		2,000	100	--

## (2) 芯伟半导体代持的还原

2020年5月22日，骈文胜、路峰、闻国涛等26名自然人与原合伙人龚金新、杨恭乾、徐芳签订入伙协议，并对于认缴的财产份额按照代持协议及代持解除协议进行重新分配，具体情况如下所示：

代持人姓名	财产份额 (万元)	财产份额比 例 (%)	被代持人	被代持财产份 额 (万元)	被代持财产份 额比例 (%)
龚金新（自有 份额 110 万， 对应财产份额 比例 5.5%）	800	40	骈文胜	650	32.50
			乔从缓	40	2.00
徐芳（自有份	600	30	路峰	300	15.00

代持人姓名	财产份额 (万元)	财产份额比 例 (%)	被代持人	被代持财产份 额 (万元)	被代持财产份 额比例 (%)
额 35 万, 对应 财产份额比例 1.75%)			吉晋阳	90	4.50
			高大会	50	2.50
			傅郁晓	50	2.50
			关姜维	50	2.50
			左上勇	20	1.00
			马凯	5	0.25
杨恭乾 (自有 份额 10 万, 对 应财产份额比 例 0.5%)	600	30	闻国涛	300	15.00
			骈文胜	50	2.50
			周俊	40	2.00
			周歆瑶	30	1.50
			张伟军	24	1.20
			崔勇彬	20	1.00
			史小奇	20	1.00
			孙玉男	20	1.00
			袁常乐	15	0.75
			马谦	15	0.75
			刘栋栋	15	0.75
			俞磊	10	0.50
			宣欢	10	0.50
			张志颖	10	0.50
			李晓奎	5	0.25
			李亚武	2	0.10
镇淑平	2	0.10			
姬悄悄	2	0.10			
合计	2,000	100	-		

根据骈文胜、路峰、闻国涛等 26 名自然人与原合伙人龚金新、杨恭乾、徐芳签订的代持协议及代持解除协议, 并经本所律师核查, 上述协议真实、有效。

2020 年 6 月 2 日, 上海市崇明区市场监督管理局准予了上述变更, 对于新的合伙协议予以备案, 并核发《营业执照》。

根据芯伟半导体全体合伙人的说明并经本所律师核查，此后芯伟半导体涉及的财产份额转让、增加均不涉及代持事项，为芯伟半导体全体合伙人真实的意思表示并依法办理了工商登记。

### （三）对赌协议

#### 1、包含对赌及特殊权利条款协议的签署情况

根据发行人提供的历次增资、股权转让协议及其补充协议，发行人、控股股东及实际控制人、管理团队存在与外部投资者约定对赌条款及其他特殊权利安排的情形，具体情况如下：

序号	对赌、特殊权利 权利人 姓名/名称	协议名称	签署时间
1	长兴君桐	《投资合作框架协议》	2017年7月
2	苏民智能、先锋智造	《关于上海伟测半导体科技有限公司之投资合作协议》	2018年5月3日
3	韋泉元禾	《关于上海伟测半导体科技有限公司之投资合作协议》	2018年8月
4	韋泉元禾	《关于<上海伟测半导体科技有限公司的股权转让协议>之特别约定》	2019年1月18日
5	深圳南海、长兴君桐、苏民智能、韋泉元禾、先锋智造	《【上海伟测半导体科技有限公司】增资扩股协议》	2019年2月15日
6	新潮科技	《关于<上海伟测半导体科技有限公司的股权转让协议>之特别约定》	2019年5月17日
7	新潮科技（业绩+回购） 深圳南海、苏民智能、韋泉元禾、先锋智造（回购）	《【上海伟测半导体科技有限公司】增资扩股协议》	2019年7月7日
8	深圳南海、苏民智能、先锋智造（业绩+回购） 韋泉元禾、新潮科技（回购）	《【上海伟测半导体科技有限公司】增资扩股协议》	2019年
9	金浦新潮	《上海伟测半导体科技有限公司增资扩股协议之权利义务转移协议》	2019年11月28日
10	涂洁	《【上海伟测半导体科技有限公司】增	2019年12月20日

		资入股协议》	
11	苏民智能、先锋智造、韋泉元禾、深圳南海、新潮科技、金浦新潮、涂洁、苏民投君信、远海明晟、广西泰达	《关于上海伟测半导体科技股份有限公司的增资协议补充协议》	2020年9月10日
12	顾成标	《关于上海伟测半导体科技股份有限公司的增资协议》	2020年9月30日
13	苏民智能、先锋智造、韋泉元禾、深圳南海、新潮科技、金浦新潮、涂洁、苏民投君信、远海明晟、广西泰达、顾成标、德同合心、云泽裕庆、南山基金	《关于上海伟测半导体科技股份有限公司的增资协议补充协议》	2020年11月12日

## 2、对赌及特殊权利条款的主要内容

发行人历次签署的包含对赌及特殊权利条款的主要内容如下：

序号	条款类型	主要内容
1	股权回购	<p>如出现：伟测科技未能在规定时间内提交合格上市申报材料（以中国证监会或证券交易所材料受理函时间为准），未能在约定时间前上市；伟测科技的财务指标恶化到一定程度；伟测科技的净利润未达到预期目标等情况，对赌义务人承担全部或部分的回购义务。</p> <p>伟测科技就控股股东及实际控制人的回购义务承担连带责任保证义务。</p> <p>如出现：伟测科技出现欺诈、相关资质、许可被吊销或终止等情况，对赌义务人承担全部或部分的回购义务。</p>
2	业绩激励补偿	<p>如出现：伟测科技实际净利润未达到预期目标等情况，公司需要按照要求重新调整公司估值，对赌义务人需对投资人进行现金补偿或股权补偿。</p>
3	其他特殊权利	<p>其他特殊权利包括但不限于伟测科技历次增资、股权转让协议及补充协议、特别约定下约定的优先认购权、股权转让限制及锁定、优先购买权、共同出售权、领售权、反稀释权、知情权、检查权、清算优先</p>

序号	条款类型	主要内容
		权、最优惠条款等。

### 3、包含对赌及特殊权利条款协议的解除情况

2021年6月23日，发行人、骈文胜、闻国涛、路峰、蕊测半导体与苏民智能、先锋智造、韋泉元禾、深圳南海、新潮投资、金浦新潮、涂洁、苏民投君信、远海明晟、广西泰达、顾成标、德同合心、云泽裕庆、南山基金签署了《关于上海伟测半导体科技股份有限公司之特殊权利条款解除协议》，协议约定：

“（1）各方同意，各方签订的一系列协议中涉及伟测半导体作为义务人的回购义务、赔偿责任、连带责任、保证条款终止执行，且自始无效，对各方均不具有法律约束力

（2）各方同意，自伟测半导体提交上市相关申报材料之日起，发行人签署的历次增资、股权转让协议及补充协议中所涉及的对赌、特殊权利、违约责任与赔偿责任等条款涉及的各方权利义务全部终止。但如果发生如下任一情形时：（a）公司提交上市申请材料后主动撤回或未被受理；（b）提交上市申请材料后被终止审查或被否决的；（c）公司的上市保荐人撤回对公司的上市保荐；（d）公司在其合格上市申请获得证监会发行批文后，未能在发行批文有效期内完成在证券交易所上市交易；（e）或未最终在证券交易所成功挂牌交易的其他情形，且满足下列条件的情况下，有关股权回购、业绩激励补偿的条款可以自动恢复效力：（a）伟测半导体不作为对赌义务当事人；（b）对赌协议不存在可能导致公司实际控制权变化的约定；（c）对赌协议不与公司市值挂钩；（d）对赌协议不存在影响公司持续经营能力或者其他影响投资者权益的情形。”

本所律师经核查后认为，发行人作为对赌、特殊权利义务人的条款已经彻底清理且不可恢复，其他对赌条款虽设有恢复条款，但恢复时的回购、赔偿义务由控股股东蕊测半导体、骈文胜、闻国涛、路峰承担，并且仅在撤回上市申请、或上市申请被驳回等情形下恢复履行。

综上，对赌条款恢复之后，发行人不作为对赌的当事人，亦不存在可能导致公司控制权变化的情形，且未与公司市值挂钩，不存在严重影响公司持续经营能力或其他严重影响公众投资者权益的情形，满足《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》问题 10 的要求。

#### （四）劳务外包

##### 1、劳务外包公司的基本情况

根据发行人提供的劳务外包合同，发行人及其子公司报告期内存在将测试过程中部分辅助性工作如物料搬运、物料收货、成品打包、条形码扫描等工作外包给劳务公司的情况，与发行人及其子公司合作的劳务公司基本情况如下所示：

序号	公司名称	统一社会信用代码	经营范围
1	上海拓企劳务派遣有限公司	91310120580618164J	许可项目：劳务派遣服务；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；国内货物运输代理；机动车驾驶人考试场地服务；物业管理；家政服务；装卸搬运；汽车租赁；酒店管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；运输货物打包服务；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食用农产品、日用百货的销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2	上海灏琨企业服务外包有限公司	91310230MA1K1DYC2H	以服务外包方式从事企业管理，商务信息咨询，保洁服务，搬运装卸服务，仓储服务（除危险化学品），园林绿化工程，计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3	上海誉美劳务派遣服务有限公司	913101205997473536	劳务派遣，以服务外包方式从事家用电器、电脑、光电元器件的组装、包装，以服务外包方式从事生产流程、生产工段、工厂运营管理，物业管理，企业管理服务，企业管理咨询，人才咨询，人工装卸服务，打包服务，第三方物流服务，会务服务，婚庆服务，礼仪服务，企业形象策划，电子商务（不得从事金融业务），办公用品、五金交电、机电设备、服装服饰、汽车配件、机械配件、通讯设

序号	公司名称	统一社会信用代码	经营范围
			备、塑料制品、建筑材料的批发、零售，国内货物运输代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4	无锡市商华通富企业管理服务有限公司	91320214MA1X1G315L	企业管理服务（不含资产管理）；建筑劳务分包；保洁服务；人才中介服务（凭有效许可证经营）；房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、市政公用工程、地基与基础工程、土石方工程、建筑装饰装修工程、机电设备安装工程、幕墙工程、绿化工程、城市及道路照明工程的设计、施工；境内劳务派遣；以承接服务外包方式从事电子产品、通用机械的生产、加工、组装、检测及技术服务；企业管理咨询（不含投资咨询）；工程项目管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5	无锡恩吉服务外包有限公司	91320214MA1YAEJW5F	以承接服务外包方式从事电子产品、光电子器件的研发；通用机械的组装、检测服务；人才中介服务(凭有效许可证经营)；停车场管理；物业管理；汽车租赁；企业后勤管理；搬运装卸；企业管理咨询(不含投资咨询)；餐饮管理；绿化服务；保洁服务；仓储服务；通用机械、专用设备的租赁（不含融资租赁）；市政工程、建筑工程、装饰装潢工程、园林绿化工程的设计与施工；电子产品、金属制品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目：劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
6	无锡汇利鑫企业管理有限公司	91320214MA1NJQJ80W	企业管理服务（不含资产管理）；劳务派遣经营；人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务；人才信息网络服务；人才推荐；人才招聘；人才培训；人才测评；法规、规章规定的其他有关业务；境内职业中介；承接服务外包；搬运装卸；清洁服务；家庭服务；仓储服务；货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7	无锡阿会工业服务外包有限公司	91320214MA20E3TXXG	许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生产线管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；装卸搬运；市政设施管理；餐饮管理；企业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；社会经济咨询服务；物业管理；停车场服务；城市绿化管理；家政服务；建筑物清洁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8	上海何胜	91310120M	以服务外包方式从事企业管理服务，人才咨询，企业管理

序号	公司名称	统一社会信用代码	经营范围
	企业服务外包有限公司	A1HT9FD9 X	咨询，商务信息咨询，机动车驾驶服务，酒店管理，第三方物流服务，国内货物运输代理，电子商务（不得从事金融业务），企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），保洁服务，会务服务，展览展示服务，停车场经营管理，人工装卸服务，打包服务，仓储服务（除危险化学品），园林绿化工程施工，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
9	上海名启人力资源有限公司	91310000M A1H3F3P5 W	一般项目：人力资源服务；房地产咨询；家政服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；汽车租赁；国内货物运输代理；电脑图文设计制作；会议及展览服务；摄影摄像服务；翻译服务；组织文化艺术交流活动；婚庆礼仪服务；餐饮管理；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；仓储服务（除危险化学品）；以服务外包方式从事企业管理；机械设备、家用电器、日用百货的销售；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## 2、劳务外包公司的专业资质

经本所律师核查，并访谈劳务外包公司，劳务外包公司仅提供物料搬运、物料收货、成品打包、条形码扫描等基础工作，无需获得专业资质。

## 3、劳务外包公司的合规情况

根据劳务外包公司提供的营业执照、确认函，并经本所律师访谈劳务外包公司、查询全国企业信用信息公示系统、裁判文书网、中国执行信息公开网，以及上述外包方所在地方政府网站，为报告期内发行人及其子公司提供劳务外包服务的公司为独立经营主体，未因向发行人提供劳务外包服务涉及违法违规行为，且劳务外包公司与发行人不存在任何关联关系。

根据发行人提供的《劳务外包合同》及《劳务外包管理制度》，劳务外包公司提供的结算资料并经本所律师访谈劳务外包公司，发行人已建立相关劳务外包人员管理制度，按照合同所约定的内容使用劳务外包人员。



#### 4、与劳务外包公司交易的背景及风险

经本所律师访谈发行人与劳务外包公司，发行人业务规模持续增长对于生产制造人员的需求增加，生产线中辅助性操作岗位人员的需求也同步增加。发行人所处的长三角地区属于用工集中地区，技术含量较低的辅助性操作岗位人员流动性较大、管理难度较大，发行人自行招聘该等员工进行培训、后续管理具备较高的管理成本，因此采用劳务外包的形式具备合理性。

经本所律师访谈劳务外包公司并查验《劳务外包合同》，发行人与劳务外包人员不存在劳动关系，发行人不承担劳务外包服务过程中的用工风险，发行人与主要劳务外包公司之间发生的业务交易不存在重大风险。

#### （五）信息豁免披露

经本所律师核查发行人相关内控管理制度及签订的《保密协议》并访谈发行人总经理及法务部门，发行人已建立完善的内控管理制度并得到有效执行，发行人申请信息豁免事项具有合理的商业诉求，如披露将导致发行人违约。发行人的董事长已在豁免申请文件中签字确认，豁免披露的信息尚未泄漏。目前公司的信息披露方式对投资者判断公司价值不存在重大影响。


### 二十三、结论意见


综上，本所律师认为，发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，发行人符合《证券法》《公司法》《科创板首发管理办法》《科创板股票上市规则》《科创属性评价指引（试行）》等有关法律法规中有关公司首次公开发行股票并在科创板上市的条件，其股票公开发行并于上交所科创板上市不存在法律障碍；发行人《招股说明书（申报稿）》所引用的法律意见书和律师工作报告的内容适当；发行人本次发行上市已经取得现阶段必要的批准和授权，尚需取得上交所的审核同意并经中国证监会同意注册，待完成公开发行后，股票上市尚需取得上交所的同意。

（本页以下无正文）

(本页无正文,系《上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的律师工作报告》之签署页)

上海市锦天城律师事务所  
  
负责人:   
顾功耘

经办律师:   
乔文湘

经办律师:   
夏瑜杰

2021 年 12 月 22 日

上海伟测半导体科技股份有限公司



2021年10月

## 目 录

第一章 总则.....	1
第二章 经营宗旨和范围.....	2
第三章 股份.....	2
第一节股份发行.....	2
第二节股份增减和回购.....	3
第三节股份转让.....	5
第四章 股东和股东大会.....	5
第一节股东.....	5
第二节股东大会的一般规定.....	8
第三节股东大会的召集.....	11
第四节股东大会的提案与通知.....	12
第五节股东大会的召开.....	14
第六节股东大会的表决和决议.....	17
第五章 董事会.....	21
第一节董事.....	21
第二节董事会.....	24
第六章 总经理及其他高级管理人员.....	28
第七章 监事会.....	30
第一节监事.....	30
第二节监事会.....	31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计.....	32
第一节财务会计制度.....	32
第二节内部审计.....	35
第三节会计师事务所的聘任.....	35
第九章 通知和公告.....	36
第一节通知.....	36
第二节公告.....	37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.....	37
第一节合并、分立、增资、减资.....	37
第二节解散和清算.....	38
第十一章 修改章程.....	40
第十二章 附则.....	40

## 第一章 总则

**第一条** 为维护上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

**第二条** 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91310115MA1H7PY66D。

**第三条** 公司于【】年【】月【】日经【】核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。

**第四条** 公司注册名称：

中文全称：上海伟测半导体科技股份有限公司

英文全称：Shanghai V-Test Semiconductor Technology Co., Ltd.

**第五条** 公司住所：上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 栋 2F。

邮政编码：201201。

**第六条** 公司注册资本为人民币 6540.8 万元。

**第七条** 公司营业期限 2016 年 05 月 06 日至 2066 年 05 月 05 日。

**第八条** 董事长为公司的法定代表人。

**第九条** 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

**第十条** 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

**第十一条** 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、

董事会秘书及公司认定的其他人员。

## 第二章 经营宗旨和范围

**第十二条** 公司的经营宗旨：以客户为导向，推进科技创新，实现股东、客户和员工价值最大化，并致力于成为国内领先、世界一流的半导体测试服务及解决方案供应商。

**第十三条** 公司的经营范围为：半导体芯片的研发、测试、销售，电子器件制造（除显示器件；集成电路；有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的），电子产品、计算机软硬件的开发及销售，仪器仪表、机电设备的销售，自有设备租赁，货物进出口，技术进出口，从事半导体芯片测试领域内的技术服务、技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

## 第三章 股份

### 第一节 股份发行

**第十四条** 公司的股份采取记名股票的形式发行。

**第十五条** 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

**第十六条** 公司发行的股票，每股面值人民币 1 元。

**第十七条** 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

**第十八条** 公司的股份全部由发起人认购。出资时间为 2020 年 04 月 30 日，出资方式：净资产折股，公司发起人认购的股份数及认股比例如下：

序号	股东姓名/名称	统一社会信用代码/身份证号码	认股数(股)	持股比例 (%)	出资时间	出资方式
1	上海蕊测半导体科技有限公司	91310115MA1H7APM9G	27,032,838	54.0657	2020年04月30日	净资产折股
2	江苏昶泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)	91320594MA1UYHED37	5,304,716	10.6094	2020年04月30日	净资产折股

序号	股东姓名/名称	统一社会信用代码/身份证号码	认股数(股)	持股比例 (%)	出资时间	出资方式
3	苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业(有限合伙)	91320206MA1Q5KRT3A	4,461,444	8.9229	2020年04月30日	净资产折股
4	深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)	91440300MA5EMNN75R	4,418,716	8.8374	2020年04月30日	净资产折股
5	南京金浦新潮创业投资合伙企业(有限合伙)	91320191MA1YQY960H	2,805,533	5.6111	2020年04月30日	净资产折股
6	上海芯伟半导体合伙企业(有限合伙)	91310230MA1JTYCM3H	2,197,669	4.3953	2020年04月30日	净资产折股
7	江苏新潮创新投资集团有限公司	91320281722243848Q	2,037,012	4.0740	2020年04月30日	净资产折股
8	涂洁	362201195906210623	1,333,334	2.6667	2020年04月30日	净资产折股
9	无锡先锋智造投资合伙企业(有限合伙)	91320205MA1WEMYT86	408,738	0.8175	2020年04月30日	净资产折股
合计			50,000,000	100	2020年04月30日	净资产折股

**第十九条** 公司股份总数为 65,408,000 股，均为普通股。

**第二十条** 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

## 第二节 股份增减和回购

**第二十一条** 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

**第二十二条** 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

**第二十三条** 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；

（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；

（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

**第二十四条** 公司收购本公司股份的，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。

公司因本章程第二十三条第一款第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

**第二十五条** 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

公司收购本公司股份的，应当按照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。



### 第三节 股份转让

**第二十六条** 公司的股份可以依法转让。

**第二十七条** 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

**第二十八条** 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日 1 年内不得转让。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

**第二十九条** 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

## 第四章 股东和股东大会

### 第一节 股东

**第三十条** 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。

**第三十一条** 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

**第三十二条** 公司股东享有下列权利：

- （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
- （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
- （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

**第三十三条** 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

**第三十四条** 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

**第三十五条** 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者

本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

**第三十六条** 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

**第三十七条** 公司股东承担下列义务：

- （一）遵守法律、行政法规和本章程；
- （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

- （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

**第三十八条** 持有公司 5% 以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当在该事实发生当日，向公司作出书面报告。

**第三十九条** 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利

益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

## 第二节 股东大会的一般规定

**第四十条** 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (三) 审议批准董事会的报告；
- (四) 审议批准监事会报告；
- (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (八) 对发行公司债券作出决议；
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (十) 修改本章程；
- (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (十二) 审议批准第四十一条规定的对外担保事项；
- (十三) 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项，及本章程第四十二条规定的交易事项；
- (十四) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (十五) 审议批准股权激励计划；
- (十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定

的其他事项。

**第四十一条** 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：

- （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
- （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
- （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- （四）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
- （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
- （六）公司应遵守的法律、法规、本章程规定的应提交股东大会审议通过的其他对外担保的情形。

除上述以外的对外担保事项，由董事会审议批准。

对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；前款第四项担保，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**第四十二条** 公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当由股东大会审议批准：

- （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上；
- （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；
- （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元；
- （四）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元；

(五) 交易的成交金额占上市公司市值的 50%以上;

(六) 交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占上市公司市值的 50%以上。

(七) 法律、法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他重大交易。

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

**第四十三条** 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

**第四十四条** 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:

- (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时;
- (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;
- (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;
- (四) 董事会认为必要时;
- (五) 监事会提议召开时;
- (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

**第四十五条** 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点或便于更多股东参加的地点召开股东大会。

股东大会应设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或本章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。

**第四十六条** 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并

公告：

- (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定；
- (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

### 第三节 股东大会的召集

**第四十七条** 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。

对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内作出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应说明理由并公告。

**第四十八条** 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

**第四十九条** 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，

单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

**第五十条** 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

**第五十一条** 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

**第五十二条** 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。

#### 第四节 股东大会的提案与通知

**第五十三条** 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

**第五十四条** 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。



股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

**第五十五条** 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。公司在计算提前通知期限时，不应当包括会议召开当日，但可包括会议通知发出当日。

发出召开股东大会的通知后，会议召开前，召集人可以根据《公司法》和有关规定，发出催告通知。

**第五十六条** 股东大会的通知包括以下内容：

- (一) 会议的时间、地点和会议期限；
- (二) 提交会议审议的事项和提案；
- (三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- (四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；
- (五) 会务常设联系人姓名，电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。

股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

**第五十七条** 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，并至少包括以下内容：

- (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

(二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

(三) 披露持有本公司股份数量；

(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

**第五十八条** 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。

### 第五节 股东大会的召开

**第五十九条** 本公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

**第六十条** 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

**第六十一条** 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示代理人的有效身份证件、股东的授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人的主体资格证明文件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

**第六十二条** 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

(一) 代理人的姓名；

(二) 是否具有表决权；

(三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;

(四) 委托书签发日期和有效期限;

(五) 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位的印章。

**第六十三条** 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

**第六十四条** 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为非自然人的,由其负责人、法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

**第六十五条** 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

**第六十六条** 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。

**第六十七条** 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

**第六十八条** 董事会召集的股东大会,由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经

现场出席股东大会会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

**第六十九条** 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

**第七十条** 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

**第七十一条** 除涉及公司商业机密外，董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

**第七十二条** 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

**第七十三条** 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。

会议记录记载以下内容：

- (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- (二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
- (三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
- (四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- (五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- (六) 律师及计票人、监票人姓名；
- (七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

**第七十四条** 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的

董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

**第七十五条** 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

## 第六节 股东大会的表决和决议

**第七十六条** 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**第七十七条** 下列事项由股东大会以普通决议通过：

- （一）董事会和监事会的工作报告；
- （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （四）公司年度预算方案、决算方案；
- （五）公司年度报告；
- （六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

**第七十八条** 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- （一）公司增加或者减少注册资本；
- （二）公司的分立、合并、解散、清算；
- （三）本章程的修改；

(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；

(五) 股权激励计划；

(六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

**第七十九条** 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以依据相关规定公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

**第八十条** 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以就该关联交易事项作适当陈述，但不参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

**第八十一条** 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

**第八十二条** 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

**第八十三条** 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的

决议，可以实行累积投票制；公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时，应当实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一普通股股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

公司第一届董事会的董事候选人和第一届监事会候选人均由发起人提名。其余各届董事、监事提名的方式和程序为：

（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；独立董事获选人可由董事会、监事会和单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提名；

（二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；

（三）股东应向现任董事会、监事会提交其提名的董事或者监事候选人的简历和基本情况，由现任董事会、监事会进行资格审查，经审查符合董事或者监事任职资格的提交股东大会选举；

（四）董事候选人或者监事候选人应根据公司要求作出书面承诺，包括但不限于：同意接受提名，承诺提交的其个人情况资料真实、完整，保证其当选后切实履行职责等。

**第八十四条** 除累积投票制外，股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。

**第八十五条** 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在该次股东大会上进行表决。

**第八十六条** 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

**第八十七条** 股东大会采取记名方式投票表决。

**第八十八条** 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或者其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

**第八十九条** 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

**第九十条** 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

**第九十一条** 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

**第九十二条** 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

**第九十三条** 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，



应当在股东大会决议公告中作特别提示。

**第九十四条** 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事的就任时间为股东大会决议中指定的时间；若股东大会决议未指明就任时间的，则新任董事、监事的就任时间为股东大会结束之时。

**第九十五条** 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

## 第五章 董事会

### 第一节 董事

**第九十六条** 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

- （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
- （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
- （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
- （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。

**第九十七条** 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门

规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会。

董事的选举程序如下：

(一)根据本章程的规定提出董事候选人名单；

(二)公司在股东大会召开前以公告的形式披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解；

(三)董事候选人在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责；

(四)按本章程的规定对董事候选人名单进行表决。

**第九十八条** 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

(二)不得挪用公司资金；

(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

(四)不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

(六)未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有；

(八)不得擅自披露公司秘密；

(九) 不得利用其关联关系损害公司利益;

(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

**第九十九条** 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:

(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;

(二) 应公平对待所有股东;

(三) 及时了解公司业务经营管理状况;

(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;

(五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;

(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

**第一百条** 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。

**第一百〇一条** 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。

除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

**第一百〇二条** 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在董事辞职生效或任期届满后 1 年内仍然有效,应继续保守其在任期内知悉的公司商业信息或商

业秘密，直至该商业信息或商业秘密成为公开信息。

**第一百〇三条** 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

**第一百〇四条** 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第一百〇五条** 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

## 第二节 董事会

**第一百〇六条** 公司设董事会，对股东大会负责。

**第一百〇七条** 董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，设董事长 1 人。

**第一百〇八条** 董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (二) 执行股东大会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- (九) 决定公司内部管理机构的设置；
- (十) 聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或

者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

- (十一) 制订公司的基本管理制度；
- (十二) 制订本章程的修改方案；
- (十三) 管理公司信息披露事项；
- (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- (十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

公司董事会设立审计委员会，并设立战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

**第一百〇九条** 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

**第一百一十条** 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则由董事会拟定，经股东大会审议通过后执行，作为本章程的附件。

董事会每年度结束时都必须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估，并根据评估结果决定采取的具体改进措施。

**第一百一十一条** 公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议批准：

- (一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

(二) 交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且超过 1000 万元;

(三) 交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且超过 100 万元;

(四) 交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占上市公司市值的 10%以上;

(五) 交易的成交金额占上市公司市值的 10%以上;

(六) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且超过 100 万元;

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

上述交易事项,如法律、法规、本章程规定须提交股东大会审议通过的,应在董事会审议通过后提交股东大会审议。

对于重大投资项目,董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

上市公司与关联人发生的交易金额(提供担保除外)占上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上的交易,且超过 3000 万元,提供评估报告或审计报告,应当提交股东大会审议。除前述关联交易事项外,公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上或者公司与关联法人达成的交易金额在人民币 300 万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值 0.1%以上的关联交易,由董事会审议批准。

除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项,由董事会审议批准。

董事会可以根据公司实际情况对前款董事会权限范围内的事项具体授权给总经理执行。

**第一百一十二条** 董事会设董事长 1 人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

**第一百一十三条** 董事长行使下列职权:

- (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- (二) 督促、检查董事会决议的执行；
- (三) 董事会授予的其他职权；
- (四) 相关法律、行政法规、规章规定的其他职权。

**第一百一十四条** 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

**第一百一十五条** 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。

代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

董事会召开临时董事会会议应当在会议召开 3 日以前通过专人信函、传真、电话、电子邮件以及全体董事认可的其他方式通知全体董事。有紧急情事须及时召开董事会会议的，通知时限不受上述限制，但应在合理期限内提前做出通知。

**第一百一十六条** 董事会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议日期和地点；
- (二) 会议期限；
- (三) 事由及议题；
- (四) 发出通知的日期。

**第一百一十七条** 董事会会议以现场召开为原则，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、书面传签、电子邮件表决等方式召开并作出决议，并由参会董事签字。

**第一百一十八条** 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

**第一百一十九条** 董事与董事会会议拟审议事项有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无

关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

**第一百二十条** 董事会决议表决方式为：填写表决票等书面投票方式或举手表决方式，每名董事有一票表决权。

**第一百二十一条** 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

**第一百二十二条** 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。

**第一百二十三条** 董事会会议记录包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- (三) 会议议程；
- (四) 董事发言要点；
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

## 第六章 总经理及其他高级管理人员

**第一百二十四条** 公司设总经理1名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

**第一百二十五条** 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，适用于高级管理人员。



本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

**第一百二十六条** 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

**第一百二十七条** 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

**第一百二十八条** 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）本章程或董事会授予的其他职权。

除本章程规定的应提交董事会、股东大会审议批准的事项外，公司发生的交易、关联交易事项由公司总经理批准。

未担任公司董事的总经理列席董事会会议。

**第一百二十九条** 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

**第一百三十条** 总经理工作细则包括下列内容：

（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；

（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；

(四) 董事会认为必要的其他事项。

**第一百三十一条** 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

**第一百三十二条** 副总经理由总经理提名，由董事会聘任或者解聘。

副总经理协助总经理的工作并对总经理负责，受总经理委托负责分管有关工作，在职责范围内签发有关的业务文件。总经理不能履行职权时，副总经理可受总经理委托代行总经理职权。

**第一百三十三条** 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书为公司高级管理人员，应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的规定。

**第一百三十四条** 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第七章 监事会

### 第一节 监事

**第一百三十五条** 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

**第一百三十六条** 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

**第一百三十七条** 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。

**第一百三十八条** 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

**第一百三十九条** 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

**第一百四十条** 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或

者建议。

**第一百四十一条** 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第一百四十二条** 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第二节 监事会

**第一百四十三条** 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。股东代表监事由股东大会选举产生。

**第一百四十四条** 监事会行使下列职权：

- (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (二) 检查公司财务；
- (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- (六) 向股东大会提出提案；
- (七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事

务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

**第一百四十五条** 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

**第一百四十六条** 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。

**第一百四十七条** 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存不少于 10 年。

**第一百四十八条** 监事会会议通知包括以下内容：

- (一) 举行会议的日期、地点和会议期限；
- (二) 事由及议题；
- (三) 发出通知的日期。

## 第八章 财务会计制度、利润分配和审计

### 第一节 财务会计制度

**第一百四十九条** 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

**第一百五十条** 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

**第一百五十一条** 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，

不以任何个人名义开立账户存储。

**第一百五十二条** 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

#### （一）利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司分配的利润应重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

#### （二）利润分配方式

公司采取现金、股票、现金股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采取现金分红进行利润分配。采用股票股利进行分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

#### （三）公司现金分红条件

1、公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

- 2、公司累计可供分配的利润为正值；
- 3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 15%。

#### （四） 公司现金分红的比例与间隔

在符合利润分配、满足现金分红的条件前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，以现金方式分配的应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。董事会可根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

#### （五） 利润分配的决策程序

公司进行利润分配时，应当由公司董事会结合公司盈利情况、资金需求、经营发展和股东回报规划先制定分配预案，再行提交公司股东大会进行审议。对于公司当年未分配利润的，董事会在分配预案中应当说明使用计划安排或者原则。公司董事会在决策和形成利润分配预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例；同时，董事会需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见。

董事会审议通过利润分配政策相关议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，独立董事应对相关议案发表独立意见，并及时予以披露。

有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

#### （六） 利润分配政策调整的机制

公司根据生产经营需要、投资计划和长期发展需要，或者外部经营环境发生变化，确有必要对利润政策进行调整或者变更的，董事会在充分研究论证后提出

有关调整利润分配政策的议案，独立董事应对利润分配方案的调整发表独立意见。调整后的利润分配政策应以保护股东权益为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和社会公众股东的意见（包括但不限于通过互联网投票系统、电子邮箱、电话、传真、实地接待等方式）。

### （七）信息披露

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序。公司应严格按照有关规定披露利润分配方案。存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的25%。

**第一百五十三条** 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

## 第二节 内部审计

**第一百五十四条** 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

**第一百五十五条** 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

## 第三节 会计师事务所的聘任

**第一百五十六条** 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。

**第一百五十七条** 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得

在股东大会决定前委任会计师事务所。

**第一百五十八条** 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

**第一百五十九条** 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

**第一百六十条** 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

## 第九章 通知和公告

### 第一节 通知

**第一百六十一条** 公司的通知以下列形式发出：

（一）以专人送出；

（二）以邮件方式送出；

（三）以公告方式送出；

（四）以传真、电子邮件、短信、电子数据交换等可以有形地表现所载内容的数据电文形式送出；

（五）法律、行政法规、规章或本章程规定的其他形式。

**第一百六十二条** 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

**第一百六十三条** 公司召开股东大会的会议通知，以专人、邮件、传真、电子邮件、短信、电子数据交换等可以有形地表现所载内容的数据电文形式进行。

**第一百六十四条** 公司召开董事会的会议通知，以专人、邮件、传真、电子邮件、短信、电子数据交换等可以有形地表现所载内容的数据电文形式进行。

**第一百六十五条** 公司召开监事会的会议通知，以专人、邮件、传真、电子邮件、短信、电子数据交换等可以有形地表现所载内容的数据电文形式进行。



**第一百六十六条** 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期。公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期。公司通知以传真、电子数据交换、电子邮件、短信等可以有形地表现所载内容的形式送出的,发出日期即为送达日期,但应采取合理的方式确认送达对象是否收到。公司通知以公告形式发出的,第一次公告的刊登日期为送达日期,依法须经登报的,公司指定省级以上报纸为公告媒体。

情况紧急,需要尽快召开临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。

**第一百六十七条** 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。

## 第二节 公告

**第一百六十八条** 公司以中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体为公司指定的刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

# 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

## 第一节 合并、分立、增资和减资

**第一百六十九条** 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。

**第一百七十条** 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,依法须经登报的,公司指定省级以上报纸为公告媒体,并于30日内在报纸上公告。

债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

**第一百七十一条** 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

**第一百七十二条** 公司分立,其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。

**第一百七十三条** 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

**第一百七十四条** 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本应不低于法定的最低限额。

**第一百七十五条** 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

## 第二节 解散和清算

**第一百七十六条** 公司因下列原因解散：

- (一) 股东大会决议解散；
- (二) 因公司合并或者分立需要解散；
- (三) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

(四) 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

- (五) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现。

**第一百七十七条** 公司有本章程第一百七十六条第（五）项情形的，可以通过修改本章程而存续。

依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3

以上通过。

**第一百七十八条** 公司因本章程第一百七十六条第（一）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

**第一百七十九条** 清算组在清算期间行使下列职权：

- （一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
- （二）通知、公告债权人；
- （三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
- （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
- （五）清理债权、债务；
- （六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
- （七）代表公司参与民事诉讼活动。

**第一百八十条** 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

**第一百八十一条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。

公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。

**第一百八十二条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

**第一百八十三条** 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

**第一百八十四条** 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第一百八十五条** 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

## 第十一章 修改章程

**第一百八十六条** 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；

（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

（三）股东大会决定修改章程。

**第一百八十七条** 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

**第一百八十八条** 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。

**第一百八十九条** 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。

## 第十二章 附则

**第一百九十条** 释义

(一) 控股股东，是指其持有的普通股占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

(二) 实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

(三) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

**第一百九十一条** 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

**第一百九十二条** 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在上海市市场监督管理局最近一次备案核准登记后的中文版章程为准。

**第一百九十三条** 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“不足”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

**第一百九十四条** 本章程由公司董事会负责解释。

**第一百九十五条** 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

**第一百九十六条** 国家对优先股另有规定的，从其规定。

**第一百九十七条** 本章程经公司股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起实施。



# 中国证券监督管理委员会

证监许可〔2022〕1878号

## 关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复

上海伟测半导体科技股份有限公司：

中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》和《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令第174号）等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批复如下：

- 同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
- 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
- 本批复自同意注册之日起12个月内有效。
- 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发

生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。



---

抄送：上海市人民政府；上海证监局，上海证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司及其上海分公司，方正证券承销保荐有限责任公司。

分送：会领导。

办公厅，发行部，市场一部，上市部，法律部，存档。

---

证监会办公厅

2022年8月22日印发

打字：黄 岩

校对：郝帅龙

共印 15 份

